

股票代碼: 3711

NYSE: ASX

5G



2021 ANNUAL REPORT

日月光投資控股股份有限公司 一一〇年度年報

本年報可於以下網址查詢

公開資訊觀測站 | <https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>

本公司網站 | <https://www.aseglobal.com>

刊印日期 | 中華民國一一一年二月二十八日



日月光集團

科技發展日新月異的浪潮帶動下，電子終端產品朝向更高價值系統整合層次邁進，使功能整合強化與尺度微縮技術齊頭並進，同時也彰顯異質整合封裝的重要性。日月光投資控股結合日月光、矽品以及環電攜手整合集團資源優勢，精進研發並豐富創新文化，提供高階研發與優質的技術解決方案，為永續經營投入最大的努力。

本公司發言人

吳田玉 職稱 | 集團營運長

代理發言人

董宏思 職稱 | 集團財務長

電話 | (02) 66365678

電子郵件信箱 | ir@aseglobal.com

日月光投資控股股份有限公司

地址 | 高雄市楠梓區經三路26號

電話 | (07) 3617131

傳真 | (07) 3613094

日月光半導體製造股份有限公司

地址 | 高雄市楠梓區經三路26號

電話 | (07) 3617131

傳真 | (07) 3613094

工廠地址及電話 | 同上

矽品精密工業股份公司

地址 | 台中市潭子區大豐路三段123號

電話 | (04) 25341525

傳真 | (04) 25358012

工廠地址及電話 | 同上

環電股份有限公司

地址 | 南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號

電話 | (049) 2350876

傳真 | (049) 2391272

工廠地址及電話 | 同上

股票過戶機構

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址 | 台北市松山區東興路8號地下一樓

網址 | <https://www.uni-psg.com>

電話 | (02) 27478266

最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱 | 勤業眾信聯合會計師事務所

會計師姓名 | 吳世宗會計師 郭麗園會計師

地址 | 高雄市前鎮區成功二路88號3樓

網址 | <https://www.deloitte.com.tw>

電話 | (07) 5301888

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱

紐約證券交易所 (NYSE)

查詢該海外有價證券資訊之方式及公司網址

<https://www.aseglobal.com>

壹	04	致股東報告書
	06	經營摘要
貳	09	一一〇年度年報



壹·致股東報告書

各位股東女士、先生：

這兩年來新冠肺炎疫情隨著疫苗接種的普及，人們的工作與生活作息露出逐步恢復正常的曙光。然而在復甦的過程中，半導體供應鏈、航運物流、能源價格波動、通膨隱憂、貿易制裁及地緣政治的危機等問題依然持續干擾著我們。雖然在過去一年疫情對半導體業帶來結構性改變的新契機，讓半導體產業度過美好的一年，但我們仍應戒慎恐懼、小心翼翼的面對將來各種可能的變數，以努力確保甜美的果實。國際貨幣基金(IMF)於2022年1月預估2021年全球經濟成長率為5.9%，2022年為4.4%。

根據工研院產科國際所之統計，2021年台灣IC封裝測試業產值為新台幣6,384億元，較2020年成長約16.3%。其中封裝業產值為新台幣4,354億元，較2020年成長15.3%；測試業產值為新台幣2,030億元，較2020年成長18.4%。茲將本公司暨旗下子公司（以下合稱「本集團」）過去一年來的營運狀況報告如下：

「2021年營業結果」

1 2021年營業計畫實施成果

本集團2021年合併營收約為新台幣5,700億元(包含半導體封測事業3,225億元、電子代工服務2,395億元及其他80億元)，較2020年增加約930億元，年成長約19.5%。創歷史新高。半導體封測事業2021年度合併營收較2020年增加約566億元，年成長約21.3%。另電子代工服務2021年合併營收較2020年增加約348億元，年成長約17.0%。整體財務數據皆較2020年大幅成長。

2 預算執行情形

本公司於2021年並未公開財務預測。

3 財務收支及獲利能力分析

如2021年度合併財務報表所示，本公司2021年度實收資本額約為新台幣441億元，歸屬於本公司業主之權益總計約為新台幣2,601億元，佔總資產新台幣6,729億元之38.6%；長期資金佔不動產、廠房及設備比率為192.6%，流動比率為138.6%，資產報酬率10.9%。此外，2021年合併營業毛利率為19.4%，與2020年的16.3%相較有顯著成長，營業淨利為新台幣621億元，較2020年增加新台幣272億元，成長約78.1%。稅前淨利為新台幣803億元(含處分子公司稅前利益新台幣173億元)，較上年度增加新台幣446億元，成長約124.8%。歸屬於本公司業主之淨利為新台幣639億元(亦含處分子公司利益)，較上年度成長約131.6%。獲利能力相較於2020年度呈現倍數成長。

4 研究發展狀況

在5G的新浪潮帶動下，高速傳輸、低延遲加上AI，物聯網、自動駕駛、智慧製造等將進入一個新里程，電子終端產品發展朝向低價格、多功能、高效能、高整合度發展，而半導體產業鏈努力往更高價值系統整合層次邁進，彰顯出異質晶片封裝在系統整合創新的重要性，使功能整合強化與尺度微縮技術齊頭並進，以創造更高效能的智慧連網環境與裝置，促進人類智能生活更加便利。本公司2021年成功開發之重點產品與技術歸類如下：(1)覆晶封裝：7/10奈米晶片製程技術認證，14/16奈米銅製程/超低介電晶片覆晶封裝應用、銀合金線於混合式覆晶球格陣列式封裝技術。(2)鋁線封裝：第二代先進整合元件內埋封裝技術開發、超細間距與線徑銅/金鋁線技術，移動式記憶體技術開發 (Mobile DRAM)、晶圓級扇出式RDL打線封裝。(3)晶圓級封裝：扇外型30um晶片厚度研磨前切割技術、8 Hi HBM CPD晶圓高精準度(+/- 2um)的研磨技術、晶圓穿導孔、玻璃基板封裝、晶圓級晶片尺寸六面保護封裝技術開發、扇外型PoP晶片產品開發、晶粒貼合晶圓製程技術。(4)先進封裝與模組：低功耗天線設計與封裝技術、可彎曲基板及封裝技術、雙面薄化無線通訊模組技術、5G天線封裝產品開發等。(5)面板級封裝：扇外型動態補償光罩之面板級封裝技術。(6)SiP封裝：開發應用於毫米波相關產品之高介電塑封材料與三維結構塑封技術。

「2022年營業計畫概要」

1 本集團經營方針

- (1) 提供客戶「至高品質」的服務
- (2) 為公司及客戶創造長期且穩定的利潤
- (3) 與協力廠商攜手共創榮景
- (4) 訓練員工成為各領域之專業菁英
- (5) 「公平且合理」地對待所有員工
- (6) 提供員工「和諧、愉快、開放」的工作環境
- (7) 在營運中儘可能地保持彈性

2 預期銷售數量及其依據

依據產業景氣、未來市場需求及本集團之產能狀況，本集團2022年預計銷售量如右：

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約494億個
測試	約82億個

3 重要產銷政策

整體而言，2021年是個好年，封測事業儘管受美國更改出口管制條例(EAR)事件影響，但不論營收、毛利率、稅前淨利及每股盈餘等各項財務指標都大有斬獲，超越預期目標。除了打線封裝業績亮眼，測試事業也受惠公司布局Turnkey效益顯現、成長幅度較去年倍增。在車用產品方面，成長動能將延續至今年甚至以後幾年，期待能達到營收突破10億美元的里程碑。在系統級封裝(SiP)方面，持續新增並擴大客戶組合，期盼新客戶之營收能持續突破5億美元。過去兩年冠狀病毒疫情促使半導體產業創下了新價值、突發需求、漲價及全面投資等多項紀錄。因疫情帶動健康疑慮，讓半導體在健康和數位生活轉型上產生新價值。且在現有基礎建設上需求放量，這種需求既無準備時間也無法預測，造成短週期整個產業鏈所有層級的供需嚴重失衡與漲價，導致產業全面增加投資與產能。政府和企業綠能規劃將影響半導體長線供應鏈布局，而人力資源有限將是半導體新常態，如何利用人工智慧(AI)、系統化、自動化面對不同市場需求，亦會是新挑戰。半導體產業短期將經過價值和供需調整，在半導體新的量變與質變過程中，台灣產業機會多於挑戰。

「本集團未來發展策略」

本公司未來將持續豐富創新文化：將半導體產業鏈往更高價值系統整合，彰顯異質晶片封裝在系統整合創新的重要性。具備跟客戶產品設計端整合的能力，實現數位轉型。再者，提供客戶永續服務：集團子公司雖是獨立的營運個體，仍應就先進封裝技術研發、設備及材料採購等方面進行初步整合，讓研發投資、產能建置、毛利率與營業費用上取得綜效，優化客戶服務並創造最大的價值與利益。兼以綠色轉型為面對氣候年代的重要策略，提供永續製造服務，協助客戶並為社會帶來更便利的生活。最後，攜手夥伴共創榮景供應鏈：因應經濟景氣、全球氣候變化與市場競爭，建立緊密的供應商夥伴關係，積極投入供應鏈永續管理，以負責任的宗旨來提供高品質的產品和服務。展望未來，唯有創新才能增進核心競爭力，在技術、製程、管理、行銷、人才等各方面，必須持續創新。唯有有效的創新思維與作法，才能繼續穩健成長。

「受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響」

今年我們除了在營業面創造佳績，永續治理的表現也是可圈可點。連續第六年整體成績獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」產業最高分，為台灣第一家連續六度獲得產業最高分之公司。同時，23個子項目中的「客戶關係管理、創新管理、風險管理、隱私權保護、環境報告、產品責任、社會報告、人權、企業公民與慈善事業」等共13個項目，取得該群組領先地位，且其中之10項獲得滿分。身為全球封測產業的領導者，我們聚焦在「持續豐富創新文化、提供客戶永續服務、攜手夥伴共創榮景」上，引領整個半導體產業走向永續經營。並將持續以更積極、更正面的態度，為永續經營盡最大的努力。



張慶生

董事長 張慶生



張洪本

副董事長 張洪本

經營摘要

單位 / 新台幣百萬元

合併財務報表 (註1)	106 年	107 年	108 年	109 年	110年
營業收入	290,441.2	371,092.4	413,182.2	476,978.7	569,997.1
營業毛利	52,732.3	61,163.1	64,310.8	77,984.3	110,368.8
營業淨利	25,218.6	26,647.7	23,526.4	34,876.1	62,124.3
稅前淨利	30,928.9	32,047.4	23,362.1	35,733.7	80,335.4
稅後淨利	24,667.4	26,463.8	18,053.1	29,276.8	66,013.6
綜合損益總額	20,067.0	25,611.2	13,799.7	30,128.3	66,659.7
追溯調整之稀釋每股盈餘(元/股)	5.23	5.84	3.86	6.31	14.40
現金股利(元/股)	8.9	2.49868226	1.99802982	4.19149913	(註2)
不動產、廠房及設備	135,168.4	214,592.6	232,093.3	234,365.4	239,867.6
權益合計	204,001.5	220,670.5	214,346.7	234,262.6	274,632.7
資產總計	363,857.8	533,371.2	556,654.3	583,666.8	672,934.3
員工總數(人)	68,753	93,891	96,528	101,981	95,727
總市值(註3)	333,328.2	251,951.0	360,246.3	353,709.9	469,454.0

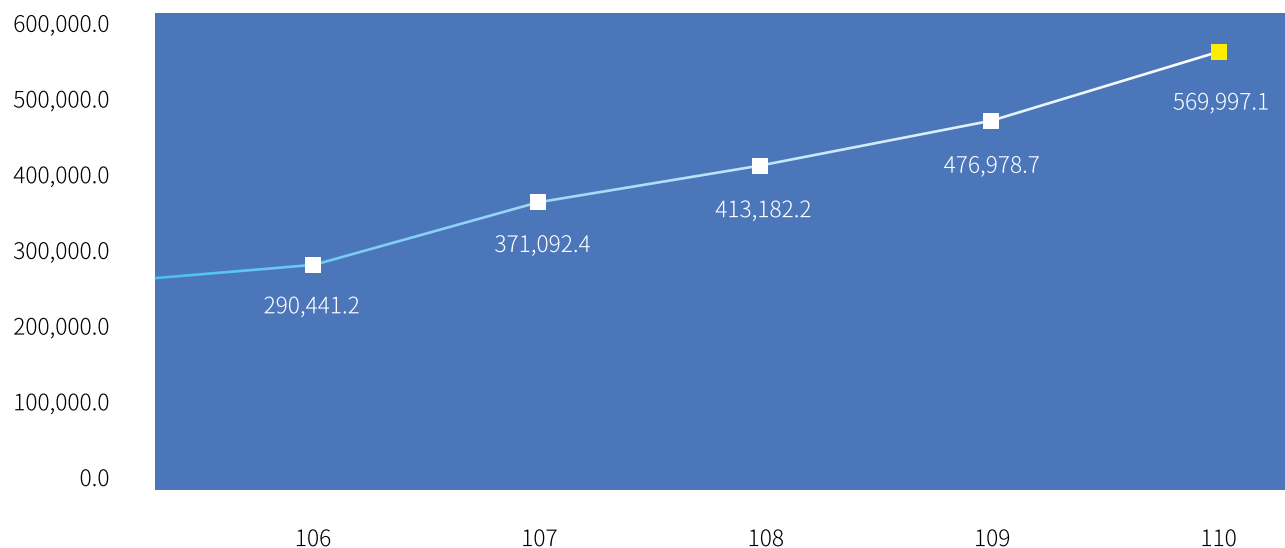
註1：子公司日月光公司及矽品公司於105年6月雙方董事會決議簽署共同轉換股份協議，本公司被視為共同控制下之組織重組，實質上係日月光公司之延續，故106年之財務資料係以日月光公司合併財務報表之內容為並列揭露基礎。

註2：俟董事會授權董事長按除息基準日之股數計算調整之。

註3：總市值=年底收盤價*流通在外股數。

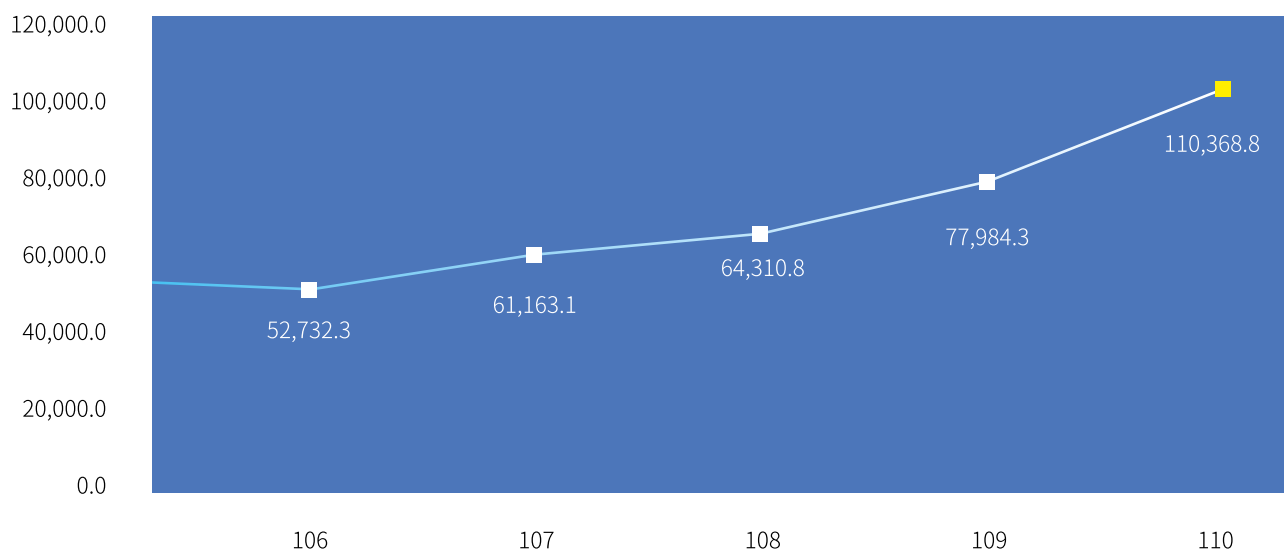
歷年營業收入

單位 / 新台幣百萬元



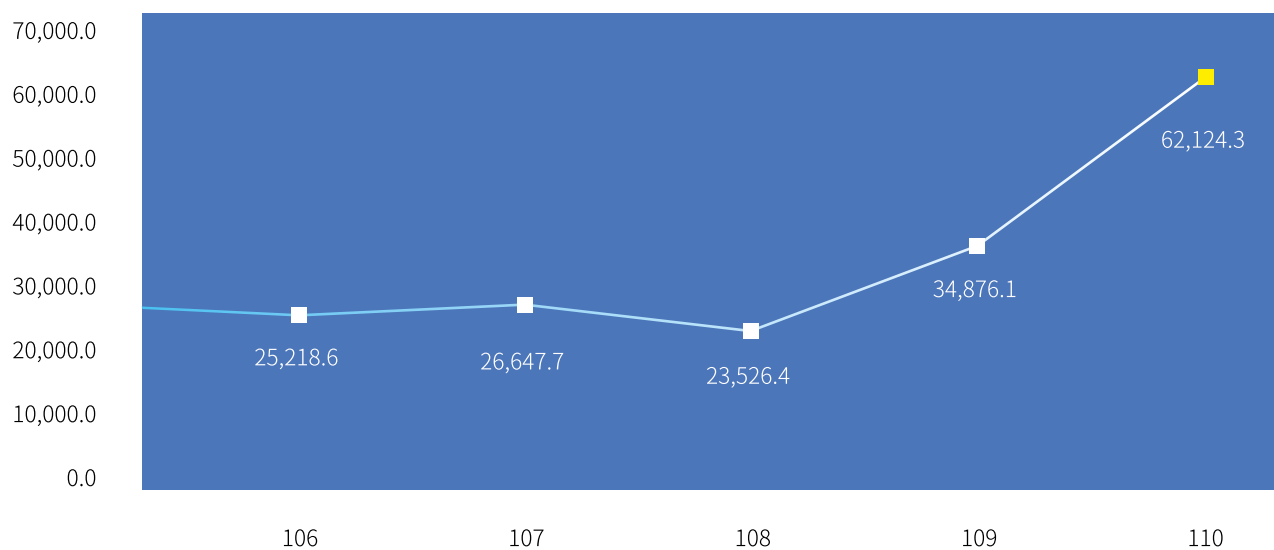
歷年營業毛利

單位 / 新台幣百萬元



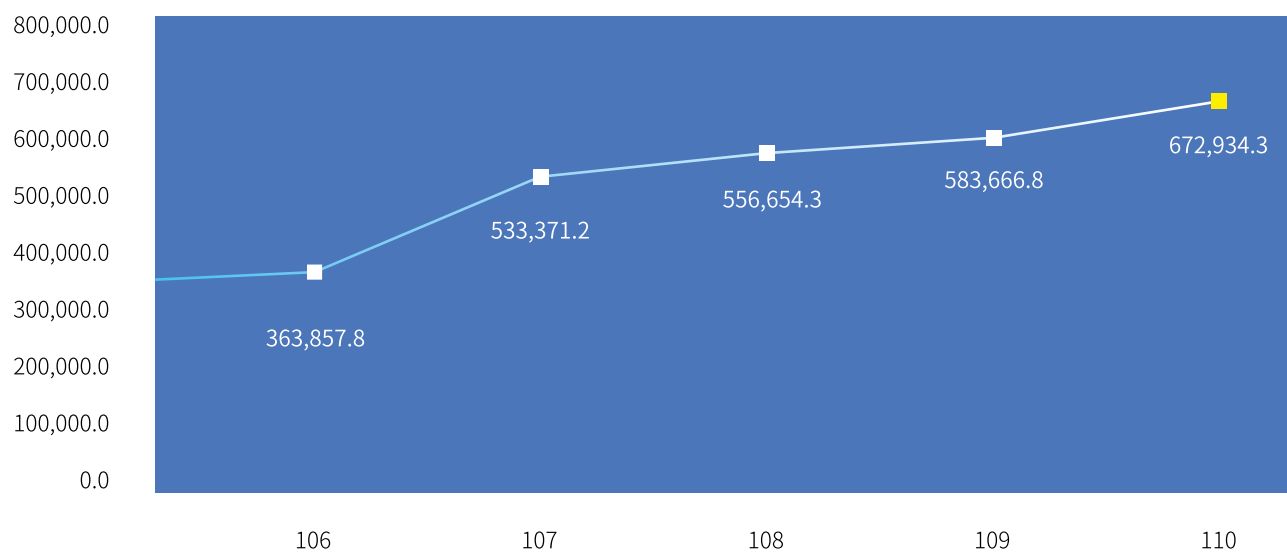
歷年營業淨利

單位 / 新台幣百萬元



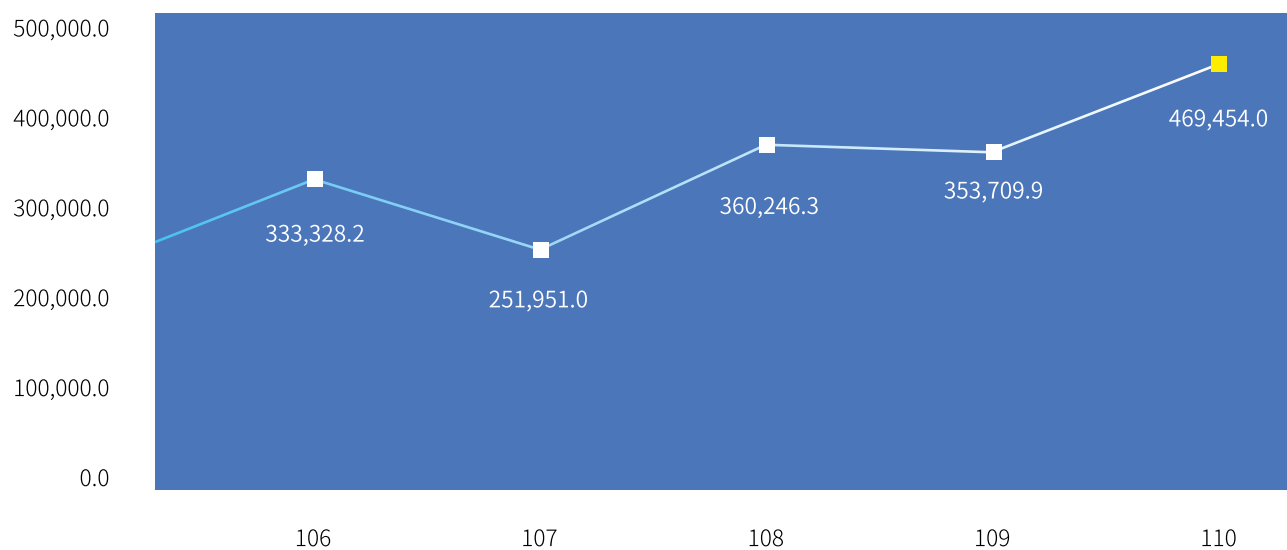
歷年資產總額

單位 / 新台幣百萬元



歷年總市值

單位 / 新台幣百萬元



日月光投資控股股份有限公司
一一〇年度年報(一)

目錄 一一〇年度年報

壹、致股東報告書

貳、公司簡介

參、公司治理報告

- 3 一、組織系統
- 4 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
- 11 三、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金
- 14 四、公司治理運作情形
- 29 五、簽證會計師公費資訊
- 30 六、更換會計師資訊
- 30 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形
- 30 八、董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 31 九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
- 32 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數

肆、募資情形

- 33 一、資本及股份
- 37 二、公司債辦理情形
- 38 三、特別股辦理情形
- 38 四、海外存託憑證辦理情形
- 38 五、員工認股權憑證辦理情形(含限制員工權利新股辦理情形)
- 43 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
- 43 七、資金運用計畫執行情形

伍、營運概況

- 44 一、業務內容
- 62 二、市場及產銷概況
- 70 三、從業員工資料
- 70 四、環保支出資訊
- 74 五、勞資關係
- 79 六、資通安全管理
- 81 七、重要契約

陸、財務概況

- 82 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
- 84 二、最近五年度財務分析
- 86 三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告
- 87 四、最近年度財務報告
- 87 五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告
- 87 六、公司及關係企業發生財務週轉困難情事之影響說明

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

- 88 一、財務狀況
- 88 二、財務績效
- 88 三、現金流量
- 89 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
- 89 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
- 89 六、風險事項分析評估
- 98 七、其他重要事項

捌、特別記載事項

- 99 一、關係企業相關資料
- 116 二、私募有價證券辦理情形
- 117 三、子公司持有或處分公司股票情形
- 117 四、其他必要補充說明事項

玖、其他事項

貳、公司簡介

一、設立日期：民國一〇七年四月三十日

二、公司沿革：

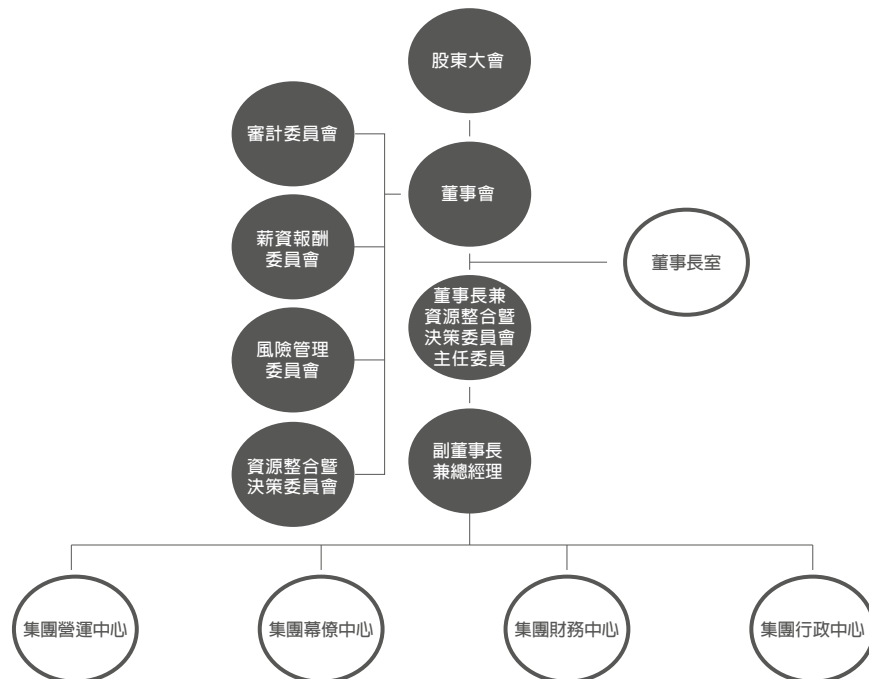
本公司記事如下：

- 107年02月 日月光半導體製造股份有限公司(以下簡稱日月光公司)及矽品精密工業股份有限公司(以下簡稱矽品公司)為期能為半導體產業未來的發展及永續的經營取得制高點及新契機，以提供客戶更優質、有效率及全面的封測服務。雙方共同基於平等、互惠及雙贏的基礎，共同籌組新設控股公司，經107年2月12日日月光公司及矽品公司之股東臨時會決議通過，共同以股份轉換方式設立日月光投資控股(股)公司，並依相關規定申請辦理股票上市買賣。
- 107年04月 經臺灣證券交易所107年3月26日核准，日月光公司及矽品公司之股票於107年4月30日終止上市買賣，暨由日月光投資控股(股)公司股票自同日起上市買賣，掛牌上市產業類別及證券代號分別為「半導體業」及「3711」。
- 108年01月 本公司為整合整體資源，提升集團營運效率，於107年12月經董事會決議通過與本公司百分之百持股之子公司環祥電子(股)公司合併，訂定基準日為108年01月31日，合併後本公司為存續公司，環祥電子(股)公司為消滅公司。
- 本公司董事長張虔生獲頒國立中山大學名譽工學博士學位殊榮，以表彰董事長對半導體產業之貢獻。
- 108年09月 本公司今年首次結合旗下日月光、矽品及環電等重要子公司，入選為世界級企業永續評比道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)之「半導體及半導體設備產業(Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry)」之領導者(Industry Leader)殊榮，亦打破台灣紀錄連續四年蟬聯「半導體及半導體設備產業」領導者地位。
- 108年10月 本公司發行經綠色債券資格認可之108年度第二期無擔保國際普通公司債美金3億元，債券募集之資金將全數增資子公司日月光公司用於綠色投資計畫相關支出。
- 109年01月 本公司榮獲2019年國際氣候變遷專案評比(CDP)之最高等級A List成績，成為臺灣唯一入選三次A List的企業，再次成為全球半導體產業在氣候變遷管理行動之領導者。除此之外，更是臺灣唯一在同年度獲得DJSI產業領導者與CDP A List之企業。
- 109年03月 本公司獲中國大陸國家市場監督管理總局反壟斷局解除日月光公司與矽品公司共組控股公司結合案附加限制條件。
- 109年07月 本公司加入蘋果之供應商清潔能源計劃。
- 109年12月 全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠正式啟動。
- 本公司榮獲「台灣十大永續典範企業獎(製造業組)」，並連續第五年榮獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」領導者(DJSI Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry Leader)殊榮。
- 110年11月 本公司連續第六年整體成績獲道瓊永續指數(DJSI)「半導體及半導體設備產業」最高分，為台灣第一家連續六度獲得產業最高分之公司。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織結構：



(二)主要部門所營業務

〈 董事長室 〉

集團稽核處：獨立確認及改善風險管理、內部控制及治理過程之有效性。

〈 集團行政中心 〉

投控行政長室：處理集團法律事務，建構執行集團法律遵循事項，負責集團公司治理、風險管理及對外公共關係。

投控企業永續中心：規劃與推動投控企業永續與社會責任工作，包含公司治理、供應鏈管理、環境與氣候變遷、員工關懷與發展及社會參與，並彙整與呈現以上永續績效。

〈 集團財務中心 〉

集團會計控管處：集團會計政策制定並監督各公司遵循、合併財務報表編製、集團財務資訊整合及分析與集團各公司財務報表之管控作業等。

集團專案處：集團管理報表整合分析及財務報表分析、控股公司財務支援、財務管理報表系統維運及開發、員工認股權作業。

集團內控管理處：內部控制制度、管理辦法、營運流程暨作業標準之制定協助與評估建議、內部控制之設計有效性評估、集團企業風險揭露暨企業風險管理委員會政策執行協助。

集團公關處：公司企業形象經營、媒體及其他利害關係人之關係建立與維護、公開資訊發佈、公關活動企劃與執行及危機處理。

〈 集團營運中心 〉

集團營運長室：集團管理報表彙整、集團銷售預測系統整合、集團機台利用率系統整合、集團機台移轉協調整合、集團投資支出審視與效益評估分析、跨廠區協調整合、集團政策推動。

〈 集團幕僚中心 〉

集團幕僚長室：策略與市場規劃，包含研究及規劃產業市場趨勢、公司經營績效、營運投資與策略。

集團董事會秘書處：功能性委員會、董事會及股東會之議事管理、公開資訊(含重大訊息)之發佈與公告申報、對外投資案件(大陸投資)之申請與申報、集團中英文年報與股東會議事手冊之編製與管理、主管機關(證交所與投審會等)之溝通聯繫、各子公司應公開資訊之監督及管理。

集團財務處：投資評估與規劃、財務風險管理、資金調度。

集團投資人關係處：經營及維護企業與投資人之關係。與資本市場溝通企業之營運績效、策略與長期方向、資金配置及公司治理等各項議題。反饋投資人與資本市場對於企業之建議及想法予管理階層。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事資料(年報刊印日 111.02.28)

單位：股

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名 (註2)	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數(註1)		配偶、未成年子女 現在持有股份(註1)	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
董事本人	香港	香港商微電子國際公司		110.08.13	三年	80.03.30	684,327,886	15.62%	684,327,886	15.51%	—	—
董事之法人代表人	新加坡	張慶生 (董事長)	男 71-80歲									
	香港	張洪本 (副董事長)	男 71-80歲									
	中華民國	蔡祺文	男 71-80歲									
	中華民國	吳田玉	男 61-70歲									
	中華民國	董宏忠	男 61-70歲									
	中華民國	羅瑞榮	男 61-70歲									
	中華民國	陳天賜	男 51-60歲									
	中華民國	陳昌益	男 51-60歲									
	中華民國	張衍鈞	男 61-70歲									
董事本人	美國	張能傑	男 41-50歲			98.06.25	1,577,647	0.04%	1,577,647	0.04%	—	—
獨立董事	中華民國	游勝福	男 71-80歲			98.06.25	—	—	—	—	2,388	0.00%
獨立董事	中華民國	何美玥	女 71-80歲			99.06.18	—	—	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	翁文祺	男 61-70歲			106.06.30	—	—	—	—	—	—

職 稱	姓 名	利用他人名義持有股份(註1)		主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務(註4)	具配偶或二親等以內關係之其他主管、 董事或監察人			備註 (註3)
		股數	持股比例		職稱	姓名	關係	
董事本人	香港商微電子國際公司			—	—	—	—	—
董事之法人代表人	張慶生 (董事長)	—	—	台灣大學電機工程系畢 美國伊利諾理工學院碩士	副董事長 董事	張洪本 張能傑	弟 子	—
	張洪本 (副董事長)			中原大學工業工程學系畢	董事長	張慶生	兄	—
	蔡祺文			台北工專電機科畢	—	—	—	—
	吳田玉			美國賓州大學應用機械博士	—	—	—	—
	董宏忠			美國南加州大學企管碩士 美商花旗銀行企業融資部副總裁	—	—	—	—
	羅瑞榮			交通大學電子物理系畢	—	—	—	—
	陳天賜			中原大學工業工程與管理系畢	—	—	—	—
	陳昌益			加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士 美商信孚銀行台北分行副總裁	—	—	—	—
	張衍鈞			南台科技大學電子系畢	—	—	—	—
董事本人	張能傑	255,000	0.01%	美國衛斯理大學心理系學士	董事長	張慶生	父	—
獨立董事	游勝福	—	—	台灣大學商學系會計組 政治大學會計研究所碩士	—	—	—	—
獨立董事	何美玥	—	—	台灣大學農化系學士	—	—	—	—
獨立董事	翁文祺	—	—	台灣大學政治系國際關係組學士 倫敦市立大學投資及風險管理碩士	—	—	—	—

註1：截至年報刊印日止實際持有股數。

註2：上述不包含任期屆滿董事資料。

註3：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：本公司並無此情事。

註4：本公司董事(含經理人)目前擔任本公司及兼任其他公司之職務如下表：

張虔生

日月光投資控股(股)公司-董事長兼資源整合暨決策委員會主任委員
日月光半導體製造(股)公司-董事長
日月光瑞(股)公司-董事長
台灣福雷電子(股)公司-董事長
ASE Test Holdings, Ltd.-董事
A.S.E. Holding Ltd. -董事
J&R Holding Ltd. -董事
Innosource Ltd.-董事
ASE Test Limited -董事
日月光投資(昆山)有限公司-董事長
ASE Mauritius Inc.-董事
ASE Corporation -董事
ASE Labuan Inc.-董事
Alto Enterprises Ltd.-董事
Super Zone Holdings Ltd.-董事
上海鼎匯房地產開發有限公司-董事長
上海鼎威房地產開發有限公司-董事長
上海鼎裕房地產開發有限公司-董事長
昆山鼎弘房地產開發有限公司-董事長
上海鼎祺物業管理有限公司-董事長
上海鼎凡商業管理有限公司-董事長
上海鼎限物業管理有限公司-董事長
上海鼎堯置業發展有限公司-董事長
鼎固控股有限公司-董事(代表人)
Wealthy Joy Co. Ltd.-董事
上海鼎榮房地產開發有限公司-董事
重慶鼎固房地產開發有限公司-董事
上海鼎辛置業有限公司-董事
昆山鼎耀房地產開發有限公司-監事
上海鼎嘉房地產開發有限公司-監事
上海鼎通房地產開發有限公司-監事
上海鴻翔置業有限公司-監事
上海名龍建設發展有限公司-監事
上海鼎溢房地產開發有限公司-董事
True Elite Holdings Limited-董事
溫州宏德建設開發有限公司-董事
Forest Symbol Limited-董事
Excellent Worth Holdings Limited-董事
ASE Enterprises-董事
Value Tower Limited-董事
Aintree Limited-董事
JC Holdings Limited-董事
日月光環保永續基金會-董事長
日月光文教基金會-董事
ASE Technology Partners, Limited-董事

蔡祺文

日月光投資控股(股)公司-董事(代表人)
矽品精密工業(股)公司-董事長及總經理
矽品投資(股)公司-董事長
Siliconware USA, Inc.- 董事
SPIL (Cayman) Holding Limited-董事
矽品科技(蘇州)有限公司-董事
SPIL (B.V.I.) Holding Limited-董事

吳田玉

日月光投資控股(股)公司-董事(代表人)及集團營運長
日月光半導體製造(股)公司-總經理暨執行長
日月光電子(股)公司-董事長
日月光半導體(上海)有限公司-董事長
ASE (Korea) Inc.-董事
ASE Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.-董事長
ISE Labs, Inc.-董事長
ASE Singapore Pte. Ltd.-董事長
ASE Japan Co., Ltd.-董事
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.-董事長
GAPT -董事
日月光封裝測試(上海)有限公司-董事長
無錫通芝微電子有限公司-董事長
上海月芯半導體科技有限責任公司-董事長
環電(股)公司-董事(代表人)及執行長
日月光環保永續基金會-董事
日月光文教基金會-董事
ASE Technology Partners, Limited-董事

張洪本

日月光投資控股(股)公司-副董事長及總經理
日月瑞(股)公司-董事(代表人)
Innosource Ltd.-董事
Omniquest Industrial Ltd.-董事
ASE Test Limited -董事
A.S.E. Holding Ltd. -董事
J&R Holding Ltd. -董事
GAPT -董事
日月光半導體(香港)有限公司-董事長
Alto Enterprises Ltd.-董事
Super Zone Holdings Ltd.-董事
鼎固控股有限公司-董事長
Wealthy Joy Co. Ltd.-董事
Peak Vision International Limited-董事
Peak Paramount International Limited-董事
Great Sino Development Ltd. -董事
Sino Engine Group Limited-董事
Fairwheel Holdings Limited-董事
洪裕有限公司-董事
上海鼎固置業有限公司-董事長
上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事長
上海鼎通房地產開發有限公司-董事長
上海鴻翔置業有限公司-董事長
上海名龍建設發展有限公司-董事長
上海鼎榮房地產開發有限公司-董事長
上海鼎森房地產開發有限公司-董事長
上海鼎辛置業有限公司-董事長
昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事長
重慶鼎固房地產開發有限公司-董事長
重慶鼎固物業管理有限公司-執行董事
上海鼎溢房地產開發有限公司-董事長
無錫鼎固房地產開發有限公司-執行董事
溫州宏德建設開發有限公司-董事
重慶鼎好市場經營管理有限公司-執行董事
上海鼎固物業管理有限公司-執行董事
ASE Enterprises-董事
溫地發展有限公司-董事
鼎昌投資(股)公司-董事
萬昌投資(股)公司-董事
萬亞投資(股)公司-董事
鼎固投資(股)公司-董事

董宏忠

日月光投資控股(股)公司-董事(代表人)及集團財務長
日月光半導體製造(股)公司-總經理
日月瑞(股)公司-董事(代表人)
ASE Japan Co., Ltd.-監察人
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.-監察人
Innosource Ltd.-董事
J&R Holding Ltd. -董事
A.S.E. Holding Ltd. -董事
Omniquest Industrial Ltd.-董事
ASE Test Holdings, Ltd.-董事
ASE (Korea) Inc.-董事
ASE Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.-董事
ASE Labuan Inc. -董事
ASE Corporation-董事
Alto Enterprises Ltd.-董事
陸竹開發(股)公司-董事(代表人)
無錫通芝微電子有限公司-監事
笛林傑國際科技(股)公司-董事及總經理
亞太新興產業創業投資(股)公司-董事(代表人)
日月光環保永續基金會-董事
日月光文教基金會-董事

羅瑞榮

日月光投資控股(股)公司-董事(代表人)
日月光半導體製造(股)公司-董事(代表人)及高雄廠區總經理
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)及總經理
日月光環保永續基金會-董事

陳天賜
日月光投資控股(股)公司-董事(代表人)
日月光半導體製造(股)公司-董事(代表人)及中壢分公司總經理
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
陸竹開發(股)公司-董事(代表人)
日月光環保永續基金會-董事
陳昌益
日月光投資控股(股)公司-董事(代表人)
日月光半導體製造(股)公司-董事(代表人)及上海總部總經理
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
日月光半導體(上海)有限公司-監事
ASE (Korea) Inc.-監察人
無錫通芝微電子有限公司-董事
ASE Test Limited -董事
ASE Test Holdings, Ltd.-董事
Omniquest Industrial Ltd.-董事
日月光封裝測試(上海)有限公司-監事
上海鼎匯房地產開發有限公司-董事
日月光電子(股)公司-董事(代表人)
日月光半導體(香港)有限公司-董事
上海鼎威房地產開發有限公司-董事
上海鼎裕房地產開發有限公司-董事
昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事
上海鼎祺物業管理有限公司-董事
上海鼎凡商業管理有限公司-董事
上海鼎煦物業管理有限公司-董事
上海鼎堯置業發展有限公司-董事
Super Zone Holdings Ltd.-董事
環電(股)公司-董事長
Huntington Holdings International Co. Ltd.-董事
環隆電氣(股)公司-董事(代表人)
環旭電子(股)公司-董事長
環鴻電子(昆山)有限公司-董事長
環鴻電子(股)公司-董事
環旭科技有限公司-董事
環鴻科技(股)公司-董事(代表人)
環勝電子(深圳)有限公司-董事
環維電子(上海)有限公司-董事長
環豪電子(上海)有限公司-董事長
Universal Scientific Industrial (France) -董事長
環榮電子(惠州)有限公司-董事長
環海電子有限公司-董事
環旭(深圳)電子科創有限公司-董事長
Real Tech Holdings Litimted -董事
FINANCIÈRE AFG -董事長
ASTEELFLASH GROUP -董事長
三商投資控股(股)公司-獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
日月光環保永續基金會-董事
日月光文教基金會-董事
張能傑
日月光投資控股(股)公司-董事
日月光半導體製造(股)公司-董事(代表人)
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
日月光投資(昆山)有限公司-董事及總經理
環旭電子(股)公司-董事
環電(股)公司-董事(代表人)
張衍鈞
日月光投資控股(股)公司-董事(代表人)
矽品精密工業(股)公司-副董事長暨營運長
矽品投資(股)公司-董事(代表人)
游勝福
日月光投資控股(股)公司-獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員及風險管理委員會委員
日月光半導體製造(股)公司-薪資報酬委員會委員
上大投資有限公司-董事
太景醫藥研發控股(股)公司-獨立董事
何美玥
日月光投資控股(股)公司-獨立董事、審計委員會成員及風險管理委員會委員
友達光電(股)公司-獨立董事及審計委員會成員
晟德大藥廠(股)公司-獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
金寶電子工業(股)公司-獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
Ownard Therapeutics SA -獨立董事

翁文祺
日月光投資控股(股)公司-獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
日月光半導體製造(股)公司-薪資報酬委員會委員
台灣塑膠工業(股)公司-獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
東安資產開發管理(股)公司-副董事長
三喬醫學科技股份有限公司-董事長
潘士華
日月光投資控股(股)公司-集團幕僚長
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.-董事
ASE Japan Co., Ltd.-董事
ASE Test Holdings, Ltd.-董事
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
陸竹開發(股)公司-董事長
笛林傑國際科技(股)公司-董事長
元隆電子(股)公司-董事(代表人)
日月光電子(股)公司-監察人(代表人)
環電(股)公司-董事(代表人)
汪渡村
日月光投資控股(股)公司-集團行政長暨公司治理主管及風險管理委員會委員兼風險長、資安長
日月光半導體製造(股)公司-董事(代表人)及行政長
日月光集成電路製造(中國)有限公司-董事長及總經理
日月光封裝測試(上海)有限公司-董事及總經理
環旭電子(股)公司-董事
日月光環保永續基金會-董事及執行長
日月光文教基金會-董事
宏璟建設(股)公司-董事
宏璟新(股)公司-董事及總經理
鼎固控股有限公司-董事
張姚宏影社會福利慈善事業基金會-董事及執行長
銘傳大學法律學院教授
李柏練
日月光投資控股(股)公司-資深副總經理
日月光半導體製造(股)公司-董事(代表人)及財務長
ASE Test Limited -董事
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
陸竹開發(股)公司-董事(代表人)
笛林傑國際科技(股)公司-董事(代表人)
日月光集成電路製造(中國)有限公司-監事
環電(股)公司-董事(代表人)
漢通創業投資(股)公司-董事(代表人)
ASE Mauritius Inc.-董事
元隆電子(股)公司-董事(代表人)
日月光封裝測試(上海)有限公司-董事
ASE Technology Partners, Limited-董事
郭宏銘
日月光投資控股(股)公司-資深副總經理暨集團會計長
日月光半導體製造(股)公司-資深副總經理暨會計長
台灣福雷電子(股)公司-監察人(代表人)
陸竹開發(股)有限公司-董事(代表人)
張淑琴
日月光投資控股(股)公司-資深副總經理
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
沈貝俐
日月光投資控股(股)公司-副總經理
張聲華
日月光投資控股(股)公司-副總經理
陸竹開發(股)公司-監察人(代表人)
漢通創業投資(股)公司-監察人
項世傑
日月光投資控股(股)公司-副總經理
ISE Labs, Inc. -董事
ISE Services, Inc. -董事
ASE Singapore Pte. Ltd. -董事
ASE (U.S.) Inc. -董事
上海月芯半導體科技有限責任公司-董事

1.1 董事為法人股東其主要股東

111年02月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
香港商微電子國際公司	Aintree Limited	100.00%

1.2 董事為法人股東其主要股東為法人者其上一層主要股東

111年02月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
Aintree Limited	JC Holdings Limited	100.00%

1.3 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
張虔生	- 專業背景：電機工程 - 產業經歷：資訊科技 - 現職： - 日月光投資控股(股)公司董事長 - 日月光半導體製造(股)公司董事長 - 台灣福雷電子(股)公司董事長 - 日月光環保永續基金會董事長 - 鼎固控股有限公司董事(代表人) - 未有公司法第30條各款情事之一	—	0
張洪本	- 專業背景：工業工程 - 產業經歷：資訊科技 - 現職： - 日月光投資控股(股)公司副董事長及總經理 - 日月光半導體(香港)有限公司董事長 - 鼎固控股有限公司董事長 - 未有公司法第30條各款情事之一	—	0
蔡祺文	- 專業背景：電機工程 - 產業經歷：資訊科技 - 現職： - 日月光投資控股(股)公司董事(代表人) - 矽品精密工業(股)公司董事長及總經理 - 矽品投資(股)公司董事長 - Siliconware USA, Inc. 董事 - 矽品科技(蘇州)有限公司董事 - 未有公司法第30條各款情事之一	—	0
吳田玉	- 專業背景：土木、機械 - 產業經歷：資訊科技 - 現職： - 日月光投資控股(股)公司董事(代表人)及集團營運長 - 日月光半導體製造(股)公司總經理暨執行長 - 環電(股)公司董事(代表人)及執行長 - 全球半導體聯盟(GSA)董事 - 國際半導體產業協會(SEMI)董事 - 日月光環保永續基金會董事 - 未有公司法第30條各款情事之一	—	0
董宏忠	- 專業背景：經濟、企管 - 產業經歷：資訊科技、金融 - 現職： - 日月光投資控股(股)公司董事(代表人)及集團財務長 - 亞太新興產業創業投資(股)公司董事(代表人) - 日月光環保永續基金會董事 - 未有公司法第30條各款情事之一	—	0

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
羅瑞榮	- 專業背景：物理 - 產業經歷：資訊科技 - 現職： - 日月光投資控股(股)公司董事(代表人) - 日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及高雄廠區總經理 - 台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)及總經理 - 日月光環保永續基金會董事 - 未有公司法第30條各款情事之一	—	0
陳天賜	- 專業背景：工業工程 - 產業經歷：資訊科技 - 現職： - 日月光投資控股(股)公司董事(代表人) - 日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及中壢分公司總經理 - 台灣福雷電子(股)公司董事(代表人) - 日月光環保永續基金會董事 - 未有公司法第30條各款情事之一	—	0
陳昌益	- 專業背景：財經、企管 - 產業經歷：資訊科技、金融 - 現職： - 日月光投資控股(股)公司董事(代表人) - 日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及上海總部總經理 - 環旭電子(股)公司董事長 - FINANCIERE AFG董事長 - ASTEELFLASH GROUP董事長 - 三商投資控股(股)公司-獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員 - 日月光環保永續基金會董事 - 未有公司法第30條各款情事之一	—	1
張衍鈞	- 專業背景：電子工程 - 產業經歷：資訊科技 - 現職： - 日月光投資控股(股)公司董事(代表人) - 矽品精密工業(股)副董事長暨營運長 - 未有公司法第30條各款情事之一	—	0
張能傑	- 專業背景：心理 - 產業經歷：資訊科技 - 現職： - 日月光投資控股(股)公司董事 - 日月光半導體製造(股)公司-董事(代表人) - 台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人) - 環旭電子(股)公司-董事 - 環電(股)公司-董事(代表人) - 未有公司法第30條各款情事之一	—	0

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
游勝福	- 專業背景：會計 - 產業經歷：資訊科技、金融 - 現職： - 日月光投資控股(股)公司-獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員及風險管理委員會委員 - 日月光半導體製造(股)公司-薪資報酬委員會委員 - 上大投資有限公司-董事 - 太景醫藥研發控股(股)公司-獨立董事 - 未有公司法第30條各款情事之一	- 本公司獨立董事本人、配偶及二親等以內之親屬並未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 - 本公司獨立董事除游勝福之配偶及未成年子女持有本公司股份2,388股外，其餘獨立董事本人、配偶及二親等以內之親屬皆未持有本公司股份。 - 本公司獨立董事並未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 - 本公司獨立董事最近2年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得報酬金額如下： - 游勝福144萬元 - 翁文祺26萬餘元 - 何美玥0元	1
何美玥	- 專業背景：農化 - 產業經歷：資訊科技、醫療保健 - 現職： - 日月光投資控股(股)公司-獨立董事、審計委員會成員及風險管理委員會委員 - 友達光電(股)公司-獨立董事及審計委員會成員 - 晟德大藥廠(股)公司-獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員 - 金寶電子工業(股)公司-獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員 - Ownard Therapeutics SA -獨立董事 - 未有公司法第30條各款情事之一	- 本公司獨立董事本人、配偶及二親等以內之親屬並未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 - 本公司獨立董事除游勝福之配偶及未成年子女持有本公司股份2,388股外，其餘獨立董事本人、配偶及二親等以內之親屬皆未持有本公司股份。 - 本公司獨立董事並未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 - 本公司獨立董事最近2年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得報酬金額如下： - 游勝福144萬元 - 翁文祺26萬餘元 - 何美玥0元	3
翁文祺	- 專業背景：國際關係、投資及風險管理 - 產業經歷：金融 - 現職： - 日月光投資控股(股)公司-獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員 - 日月光半導體製造(股)公司-薪資報酬委員會委員 - 台灣塑膠工業(股)公司-獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員 - 東安資產開發管理(股)公司-副董事長 - 三喬醫學科技股份有限公司-董事長 - 未有公司法第30條各款情事之一	- 本公司獨立董事本人、配偶及二親等以內之親屬並未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 - 本公司獨立董事除游勝福之配偶及未成年子女持有本公司股份2,388股外，其餘獨立董事本人、配偶及二親等以內之親屬皆未持有本公司股份。 - 本公司獨立董事並未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 - 本公司獨立董事最近2年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得報酬金額如下： - 游勝福144萬元 - 翁文祺26萬餘元 - 何美玥0元	1

1.4 董事會多元化及獨立性：

1.4.1 董事會多元化：

本公司之董事會多元化政策，係為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司已制定之公司治理實務守則中明定董事會成員多元化方針及具體管理目標，董事會之組成考量包含性別、年齡、國籍、文化、專業背景及產業經歷等多元互補性，並以持續提升公司整體營運之目標前進。本公司董事會成員所具備之專業知識技能涵蓋電機工程、工業工程、電子工程、機械工程、土木工程、經濟、企管、物理、財經、心理學、會計、農化、國際關係、投資及風險管理等不同領域，已充分落實董事會成員多元化政策。本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形請詳本公司網站https://ir.aseglobal.com/c/ir_board.php。

1.4.2 董事會獨立性：

本公司董事會由十三位董事組成，其中三席為獨立董事(占比23%)，兼任本公司經理人之董事有四席(占比為31%)，未逾董事席次三分之一。本公司董事間，董事長張虔生與副董事長張洪本為兄弟，董事長張虔生與董事張能傑為父子，僅有三席具有二親等以內親屬關係，其他董事席次間均不具配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3第3項及第4項規定。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

單位：股(截至年報刊印日止實際持有股數)

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份	
					股數	持股比例	股數	持股比例
資源整合暨決策委員會主任委員	新加坡	張虔生	男	107.04	—	—	410,000	0.01%
總經理	香港	張洪本	男	107.04	—	—	—	—
集團營運長	中華民國	吳田玉	男	107.04	3,877,473	0.09%	—	—
集團財務長	中華民國	董宏忠	男	107.04	2,602,954	0.06%	137,457	0.00%
集團幕僚長	中華民國	潘士華	男	107.08	1,175,015	0.03%	—	—
集團行政長	中華民國	汪渡村	男	107.04	90,000	0.00%	—	—
資深副總經理	中華民國	李柏練	男	107.04	335,091	0.01%	—	—
資深副總經理暨集團會計長	中華民國	郭宏銘	男	107.04	285,500	0.01%	—	—
資深副總經理	中華民國	張淑琴	女	107.04	697,238	0.02%	17,473	0.00%
副總經理	中華民國	沈貝俐	女	107.08	116,332	0.00%	38	0.00%
副總經理	中華民國	張聲華	男	107.04	60,506	0.00%	—	—
副總經理	中華民國	項世傑	男	108.11	—	—	—	—

職稱	姓名	利用他人名義持有股份		主要學(經)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
		股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
資源整合暨決策委員會主任委員	張虔生	949,352,706	21.52%	台灣大學電機工程學系畢業 美國伊利諾理工學院碩士	請參閱第5頁	副董事長 董事	張洪本 張能傑	父子	—
總經理	張洪本	124,175,228	2.82%	中原大學工業工程學系畢業	請參閱第5頁	董事長	張虔生	兄	—
集團營運長	吳田玉	—	—	美國賓州大學應用機械博士	請參閱第5頁	—	—	—	—
集團財務長	董宏忠	—	—	美國南加州大學企管碩士 美商花旗銀行企業融資部副總裁	請參閱第5頁	—	—	—	—
集團幕僚長	潘士華	—	—	美國加州大學柏克萊分校物理博士 美國伊利諾州大學物理系畢業	請參閱第6頁	—	—	—	—
集團行政長	汪渡村	—	—	國立政治大學法律研究所法學博士 國立中興大學法律研究所法學碩士 國立台灣大學法律學系學士	請參閱第6頁	—	—	—	—
資深副總經理	李柏練	—	—	美國加州大學企管碩士	請參閱第6頁	—	—	—	—
資深副總經理暨集團會計長	郭宏銘	—	—	美國波士頓大學企管碩士	請參閱第6頁	—	—	—	—
資深副總經理	張淑琴	—	—	成功大學高階經營管理碩士	請參閱第6頁	—	—	—	—
副總經理	沈貝俐	—	—	台灣大學財務金融系畢業	請參閱第6頁	—	—	—	—
副總經理	張聲華	—	—	美國麻州大學企管碩士	請參閱第6頁	—	—	—	—
副總經理	項世傑	—	—	美國加州大學柏克萊分校經濟、修辭學雙學士 美國加州會計師	請參閱第6頁	—	—	—	—

註：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：詳第4頁註3。

三、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

110年12月31日

單位：仟股、新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益 之比例		兼任員工領 取相關酬金	
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註2)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及 特支費等(E)(註3)	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事本人	香港商微電子國際公司	—	—	—	—	194,000	301,890	—	—	194,000 0.30%	301,890 0.47%	49,080	453,511
董事之法人代表人	張虔生 (董事長)												
	張洪本 (副董事長)												
	蔡祺文												
	吳田玉												
	董宏忠												
	羅瑞榮												
	陳天賜												
	陳昌益												
張衍鈞													
董事本人	張能傑												
獨立董事 (註1)	游勝福	7,159	7,159	—	—	—	—	—	—	7,159 0.01%	7,159 0.01%	—	—
	何美玥												
	翁文祺												

職稱	姓名	兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項 總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司 以外轉投資 事業或母公司 酬金
		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註2)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
				現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事本人	香港商微電子國際公司	—	—	74,960	—	591,111	—	318,040 0.50%	1,346,511 2.11%	無
董事之法人代表人	張虔生 (董事長)									
	張洪本 (副董事長)									
	蔡祺文									
	吳田玉									
	董宏忠									
	羅瑞榮									
	陳天賜									
	陳昌益									
張衍鈞										
董事本人	張能傑	—	—	—	—	—	—	7,159 0.01%	7,159 0.01%	無
獨立董事 (註1)	游勝福									
	何美玥									
	翁文祺									

註1：獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；依本公司章程十六條之二規定，本公司獨立董事之報酬訂為每人每年新台幣參佰萬元整，惟任期不滿一年者，以其實際所任天數按比例計算之；本公司獨立董事因兼任本公司薪資報酬委員會成員所得兼職酬金，訂為每人每年新台幣參拾陸萬元整，惟任期不滿一年者，以其實際所任天數按比例計算之。

註2：本公司董事會於111年3月31日決議，擬訂分派110年度董事酬勞為新台幣194,000仟元，員工酬勞新台幣122,000仟元(全部以現金發放)，惟截至刊印日止本次員工酬勞分派名單尚未決定，茲以去年員工酬勞之實際分派比例估算擬議分派數如上，上述酬勞分派內容俟本年度股東會議通過後才確定。

註3：本欄位未包含本公司及財務報告內所有公司員工認股權費用化之金額分別為新台幣26,481仟元及新台幣31,853仟元、限制型股票費用化之金額分別為新台幣35,759仟元及新台幣71,517仟元。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	蔡祺文、張衍鈞、張能傑	—	蔡祺文、張衍鈞、張能傑	—
1,000,000元(含)~2,000,000元	翁文祺	翁文祺	翁文祺	翁文祺
2,000,000元(含)~3,500,000元	游勝福、何美玥	游勝福、何美玥	游勝福、何美玥	游勝福、何美玥
3,500,000元(含)~5,000,000元	—	—	—	—
5,000,000元(含)~10,000,000元	—	—	—	—
10,000,000元(含)~15,000,000元	—	張衍鈞、張能傑	—	張衍鈞、張能傑
15,000,000元(含)~30,000,000元	吳田玉、董宏思、羅瑞榮、 陳天賜、陳昌益	吳田玉、董宏思、羅瑞榮、 陳天賜、陳昌益	吳田玉、董宏思、羅瑞榮、 陳天賜、陳昌益	—
30,000,000元(含)~50,000,000元	張洪本	張洪本、蔡祺文	—	蔡祺文
50,000,000元(含)~100,000,000元	張虔生	—	—	—
100,000,000元以上	—	張虔生	張虔生、張洪本	張虔生、張洪本、吳田玉、 董宏思、羅瑞榮、陳天賜、 陳昌益
總計	—	—	—	—

(二) 監察人之酬金

不適用。

(三) 總經理及副總經理之酬金

110年12月31日

單位：仟股；新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)(註1)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)	
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
資源整合暨決策 委員會主任委員	張虔生	28,450	149,131	—	—	28,050	262,244
總經理	張洪本						
集團營運長	吳田玉						
集團財務長	董宏思						
集團幕僚長	潘士華						
集團行政長	汪渡村						
資深副總經理	李柏練						
資深副總經理 暨集團會計長	郭宏銘						
資深副總經理	張淑琴						
副總經理	沈貝俐						
副總經理	張聲華						
副總經理	項世傑						

職稱	姓名	員工酬勞金額(D) (註2)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
		現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
資源整合暨決策委員會主任委員	張虔生	79,650	—	458,931	—	136,150 0.21%	870,306 1.36%	無
總經理	張洪本							
集團營運長	吳田玉							
集團財務長	董宏思							
集團幕僚長	潘士華							
集團行政長	汪渡村							
資深副總經理	李柏練							
資深副總經理暨集團會計長	郭宏銘							
資深副總經理	張淑琴							
副總經理	沈貝俐							
副總經理	張聲華							
副總經理	項世傑							

註1：本欄位未包含本公司及財務報告內所有公司員工認股權費用化之金額分別為新台幣27,695仟元及新台幣27,695仟元、限制型股票分別為新台幣48,632仟元及新台幣48,632仟元。

註2：詳第11頁註2之說明。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	董宏思、汪渡村、郭宏銘、張淑琴、沈貝俐、張聲華	—
1,000,000元(含)~2,000,000元	—	—
2,000,000元(含)~3,500,000元	—	—
3,500,000元(含)~5,000,000元	吳田玉、潘士華、李柏練	—
5,000,000元(含)~10,000,000元	項世傑	—
10,000,000元(含)~15,000,000元	—	沈貝俐、張聲華、項世傑
15,000,000元(含)~30,000,000元	—	潘士華、汪渡村、郭宏銘、張淑琴
30,000,000元(含)~50,000,000元	張虔生	李柏練
50,000,000元(含)~100,000,000元	張洪本	—
100,000,000元以上	—	張虔生、張洪本、吳田玉、董宏思
總計	—	—

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

110年12月31日

單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額(註1)	現金金額(註1)	總計	總額占稅後純益之比例%
經理人	資源整合暨決策委員會主任委員	張虔生	—	79,650	79,650	0.12%
	總經理	張洪本				
	集團營運長	吳田玉				
	集團財務長	董宏思				
	集團幕僚長	潘士華				
	集團行政長	汪渡村				
	資深副總經理	李柏練				
	資深副總經理暨集團會計長	郭宏銘				
	資深副總經理	張淑琴				
	副總經理	沈貝俐				
	副總經理	張聲華				
	副總經理	項世傑				

註1：詳第11頁註2之說明。

(五) 分別比較說明本公司及財務報告內所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

占稅後損益比例	110年度		109年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事酬金總額(註2)	0.51%	2.12%	0.58%	3.27%
總經理及副總經理酬金總額(註2)	0.21%	1.36%	0.16%	1.77%

註2：本公司董事會於111年3月31日決議，擬訂110年度提撥員工酬勞新台幣122,000仟元，全部以現金發放，惟截至刊印日止本次員工酬勞分派名單尚未決定，故酬金總額之計算員工酬勞金額係以去年實際分派比例估算擬議分派數。

董事及經理人績效評估與酬金之連結：

本公司董事及經理人分派之酬勞比例，係依本公司章程第23條規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之零點零一(含)以上，百分之一(含)以下為員工酬勞，並提撥百分之零點七五(含)以下為董事酬勞，作為當年度董事及經理人之酬勞。薪酬委員會會根據公司治理趨勢報告及整體薪酬市場競爭力檢視報告來定期評估董事及經理人薪資報酬。本公司執行長及總經理之薪資係經本公司董事會決議通過，另副總經理之酬金則參照同業水準訂定支付之，每年定期檢視與同業人才競爭廠商比較，確保薪酬的競爭性，其獎金之給付則視本公司盈餘多寡、個人經營績效優劣以達求才與留才之目的。本公司經理人之薪資報酬制度係與本公司其他員工適用相同之「員工酬勞發放辦法」辦理。董事酬勞之擬訂，係依有純益年度之分配順序，將酬勞明訂於上述章程中。本公司董事會每年至少執行一次內部董事會績效評估，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次外部董事會績效評估。各酬金經過綜合考量後給予合理報酬，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事及經理人酬金制度。

四、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

董事會運作情形資訊

110年度截至年報刊印日止董事會開會15次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) B/A(註1)	備註
董事之法人代表人 (香港商微電子國際公司)	張虔生(董事長)	15	0	100%	
	張洪本(副董事長)	15	0	100%	
	林文伯	5	1	71%	任期屆滿(註2)
	蔡祺文	15	0	100%	
	吳田玉	15	0	100%	
	董宏思	15	0	100%	
	羅瑞榮	15	0	100%	
	陳天賜	15	0	100%	
	陳昌益	15	0	100%	
	張衍鈞	8	0	100%	新任(註3)
董事本人	張能傑	14	0	93%	
獨立董事	游勝福	14	1	93%	
	徐大麟	6	1	86%	任期屆滿(註2)
	何美玥	15	0	100%	
	翁文祺	8	0	100%	新任(註3)

註1：實際出席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：110.08.12任期屆滿，本年度可出席董事會開會次數為7次。

註3：110.08.13新任，最近年度截至年報刊印日可出席董事會開會次數為8次。

其他應記載事項：

- 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
 - (1) 證券交易法第14條之3所列事項：無獨立董事成員提出反對或保留意見，故未有進一步處理。
 - (2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
 - (3) 本公司每次董事會皆至少一席獨立董事親自出席。
- 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會日期期別	議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形	董事會決議結果	公司對董事陳述意見之處理
110.05.06 第2屆第36次董事會議	為擬通過本公司「資源整合暨決策委員會組織規程」，並敦聘該委員會主任委員。 董事對利害關係議案迴避之原因及參與表決情形： 因張虔生董事本人為本案資源整合暨決策委員會主任委員之候聘人，與本案之會議內容有自身利害關係，另張洪本董事、張能傑董事為張虔生董事之二親等內血親，為避免利益衝突，張虔生董事、張洪本董事及張能傑董事均迴避不參與討論及表決本議案。	經本案代理主席吳田玉董事徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。	不適用。
110.08.05 第2屆第38次董事會議	為擬訂定本公司一〇九年度之經理人員工酬勞分配明細。 董事對利害關係議案迴避之原因及參與表決情形： 因張洪本董事為本公司一〇九年度經理人員工酬勞擬配發之對象，張虔生董事為張洪本二親等內血親，與本案之會議內容有自身利害關係，為避免利益衝突，張虔生董事與張洪本董事均迴避不參與討論及表決本議案。	經本案代理主席吳田玉董事徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。	不適用。
	為擬訂定本公司一〇九年度之董事酬勞分配明細。 董事對利害關係議案迴避之原因及參與表決情形： 董宏思董事發言摘要－因本人董宏思及張虔生董事、張洪本董事、林文伯董事、蔡祺文董事、吳田玉董事、羅瑞榮董事、陳天賜董事、陳昌益董事所代表之法人香港商微電子國際公司為本公司一〇九年度董事酬勞擬配發之對象，張能傑董事為張虔生董事二親等內血親，與本案之會議內容有自身利害關係，為避免利益衝突，本人董宏思、張虔生董事、張洪本董事、林文伯董事、蔡祺文董事、吳田玉董事、羅瑞榮董事、陳天賜董事、陳昌益董事及張能傑董事均迴避不參與討論及表決本議案。	經本案代理主席游勝福董事徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。	不適用。
110.08.13 第3屆第1次董事會議	為擬委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。 董事對利害關係議案迴避之情形： 游勝福獨立董事發言摘要－因本人游勝福及翁文祺獨立董事皆為本方案中擬被委任為薪資報酬委員會委員之對象，與本案之會議內容有自身利害關係，為避免利益衝突，本人游勝福及翁文祺獨立董事均迴避不參與討論及表決本議案。	經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。	不適用。
110.09.30 第3屆第2次董事會議	為擬委任本公司第二屆風險管理委員會委員。 董事對利害關係議案迴避之原因及參與表決情形： 游勝福獨立董事發言摘要－因本人游勝福及何美玥獨立董事皆為本方案中擬被委任為風險管理委員會委員之對象，與本案之會議內容有自身利害關係，為避免利益衝突，本人游勝福與何美玥獨立董事均迴避不參與討論及表決本議案。	經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。	不適用。
	為擬訂定本公司民國一一〇年度限制員工權利新股之增資基準日、發行股數及獲配員工名單、數量。 董宏思董事發言摘要－因本人董宏思與蔡祺文董事、吳田玉董事、羅瑞榮董事、陳天賜董事、陳昌益董事、張衍鈞董事、張能傑董事皆為本方案中獲配本公司民國一一〇年度限制員工權利新股之對象，與本案之會議內容有自身利害關係，另本次獲配員工名單中，有二位分別與張虔生董事及張洪本董事具有一親等血親之關係，為避免利益衝突，本人董宏思與張虔生董事、張洪本董事、蔡祺文董事、吳田玉董事、羅瑞榮董事、陳天賜董事、陳昌益董事、張衍鈞董事、張能傑董事均迴避不參與討論及表決本議案。	經本案代理主席游勝福董事徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。	不適用。

3. 董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
一、每年執行一次內部評估。	110年1月1日至110年12月31日。	一、內部評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。	一、內部評估之方式包括整體董事會自評、董事成員自評及功能性委員會成員自評。	一、內部評估： (一) 整體董事會績效評估面向：「對公司營運之參與程度」、「董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事的選任及持續進修」、「內部控制」。 (二) 個別董事成員績效評估面向：「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」、「內部控制」。 (三) 功能性委員會績效評估面向： 1. 審計委員會績效評估面向：「對公司營運之參與程度」、「審計委員會職責認知」、「提升審計委員會決策品質」、「審計委員會組成及成員選任」及「內部控制」。 2. 薪資報酬委員會績效評估面向：「對公司營運之參與程度」、「薪資報酬委員會職責認知」、「薪資報酬委員會決策品質」及「薪資報酬委員會組成及成員選任」。 3. 風險管理委員會績效評估面向：「對公司營運之參與程度」、「風險管理委員會職責認知」、「風險管理委員會決策品質」、「風險管理委員會組成及成員選任」及「內部控制」。
二、至少每三年執行一次外部評估。	同上	二、外部評估之範圍為整體董事會之績效評估。	二、外部評估委請臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會進行整體董事會績效評估。	二、外部評估面向：「董事會專業職能」、「董事會決策效能」、「內部控制」及「永續經營及社會責任」。

4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

為健全董事會功能及強化管理機制，本公司陸續於107年4月30日、107年6月22日及109年2月27日成立薪資報酬委員會、審計委員會及風險管理委員會，以提升董事會運作效能。

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司於民國一〇七年訂定「董事會績效評估辦法」，每年進行董事會內部績效評估，並每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行外部評估一次。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

本公司為建立良好公司治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰於民國107年6月22日依證券交易法第十四條之四設立審計委員會。目前該委員會成員人數為三人，由全體獨立董事組成，並由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席，對外代表該委員會。

本公司審計委員會旨在協助董事會，履行其監督公司在執行有關會計、內部稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。此外，為強化公司治理，審計委員會亦負責有關會計、內部會計控制、審計事項、違反商業行為與道德遵循或違反誠信經營等舉報程序之監理。

為健全董事會功能及強化管理機制，本公司該委員會之成員均符合1934年美國證交法規10A-3規定之沙賓法案及臺灣證券交易所上市規章所定義，具備會計或相關財務管理專長之獨立董事，有助於提升董事會運作效能。

本公司審計委員會於110年度截至年報刊印日止共舉行了7次會議。本公司審計委員會其審議之事項主要包括：

1. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核
評估內部控制系統之有效性：
審計委員會評估內部控制制度之設計及執行的有效性，審查管理階層、內部稽核及簽證會計師的定期報告，包括風險管理、法令遵循、內部控制自行評估及對子公司之監督與管理。依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則及2013年COSO發布之內部控制制度－內部控制的整合性架構之內部控制制度有效性之判斷項目，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統係屬有效，能合理確保內部控制目標之達成。
3. 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。

5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告：

審計委員會查核民國一一〇年度決算表冊

董事會造具本公司民國一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

11. 其他公司或主管機關規定之重大事項

依公司治理實務守則第二十九條規定，定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性：

本公司審計委員會定期(至少一年一次)依會計師出具之獨立聲明書進行簽證會計師獨立性之評估，再將評估結果提報董事會。

(1) 評估機制如下：

- A. 簽證會計師與公司及董事均非關係人。
- B. 依照美國沙賓法案規定，簽證會計師事務所於年度簽證及其他各案件委任前，均需取得審計委員會的事先核准。
- C. 依照美國沙賓法案規定，簽證會計師每季向審計委員會彙報執行覆核/查核內容及獨立性等遵守情形。

(2) 評估結果如下：

- A. 簽證會計師之獨立性符合美國Securities and Exchange Commission、Public Company Accounting Oversight Board ("PCAOB")、中華民國會計師法及會計師職業道德規範等相關規定。
- B. 未連續五年委任同一會計師簽證。

審計委員會運作情形資訊

110年度截至年報刊印日止審計委員會開會7次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註1)	備註
獨立董事	游勝福	6	1	86%	
	徐大麟	3	0	100%	任期屆滿(註2)
	何美玥	7	0	100%	
	翁文祺	4	0	100%	新任(註3)

註1：實際出席率(%)以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：110.08.12任期屆滿，本年度可出席審計委員會開會次數為3次。

註3：110.08.13新任，最近年度截至年報刊印日可出席審計委員會開會次數為4次。

其他應記載事項：

1. 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(1) 證券交易法第14條之5所列未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之事項：

審計委員會召開日期、期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
110.09.30 第2屆第1次審計委員會會議	為擬委任本公司第二屆風險管理委員會委員	因游勝福及何美玥獨立董事皆為本擬委任為風險管理委員會委員之對象，與本案之會議內容有自身利害關係，為避免利益衝突，游勝福與何美玥獨立董事將迴避不參與討論及表決本議案，致審計委員會無法就本案作成決議，爰此，擬建議將本案依本公司「審計委員會組織規程」第九條規定，向董事會報告並由董事會決議本案。	本案經主席徵詢出席獨立董事全體同意將本案依本公司「審計委員會組織規程」第九條規定，向董事會報告並由董事會決議本案。	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。	V

(2) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之事項：無。

2. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會日期期別	議案內容	獨立董事姓名	應利益迴避原因	參與表決情形
110.08.13 第3屆第1次董事會議	為擬委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員	游勝福 翁文祺	因游勝福及翁文祺獨立董事皆為本擬被委任為薪資報酬委員會委員之對象，與本案之會議內容有自身利害關係，為避免利益衝突，游勝福與翁文祺獨立董事均迴避不參與討論及表決本議案。	游勝福與翁文祺獨立董事迴避不參與討論及表決，該議案經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。
110.09.30 第3屆第2次董事會議	為擬委任本公司第二屆風險管理委員會委員。	游勝福 何美玥	因游勝福及何美玥獨立董事皆為本擬被委任為風險管理委員會委員之對象，與本案之會議內容有自身利害關係，為避免利益衝突，游勝福與何美玥獨立董事均迴避不參與討論及表決本議案。	游勝福與何美玥獨立董事迴避不參與討論及表決，該議案經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。

3. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包含就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。

- (1) 本公司內部稽核部門每月以電子郵件方式將稽核報告及缺失回應與追蹤彙總報告交付獨立董事查閱。內部稽核主管每季至少一次於單獨溝通會議向獨立董事報告及溝通稽核結果，並於董事會彙報內部稽核業務執行情形。此外，平時若有特殊狀況時，稽核主管亦會即時以電話或電子郵件方式向獨立董事呈報，民國110年度並無上述特殊狀況。截至目前為止本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
- (2) 本公司簽證會計師每季於單獨溝通會議向獨立董事報告當季財務報告查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項。此外，本公司簽證會計師亦依照美國“PCAOB”之要求，每年至少一次於單獨溝通會議向獨立董事報告會計師獨立性、年度查核規劃及關鍵查核事項。除前述外，本公司會計師將其與管理階層間之溝通紀錄，另以電子郵件方式向獨立董事呈報。民國110年度並無其他特殊狀況另行向獨立董事報告。截至目前為止本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

4. 審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理情形：

審計委員會日期期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	證券交易法第14條之5所列事項
110.12.01 第2屆第3次會議	為本公司擬出售間接持有之海外子公司GAPT Holding Limited股份及大陸投資事業日月光半導體(昆山)有限公司股權。	本案於列席人員均離席後，經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	V
111.02.25 第2屆第4次會議	為本公司及日月光半導體製造股份有限公司(含子公司)民國一一一年度簽證會計師公費審查案。	本案於列席人員均離席後，經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	V

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，經董事會通過頒布並揭露於本公司網站，請詳 https://ir.aseglobal.com/c/ir_doc.php 。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		本公司設有投資人關係、公共關係、財務及法務等相關部門專人負責處理股務等相關事宜。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		本公司每月均經由董事及持股10%以上大股東之持股變動申報書，以確實掌握實際控制公司之主要股東名單，並與主要股東保持暢通管道密切聯繫，以掌握其最終控制者。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		本公司透過內部控制制度與相關辦法之制定執行控管，同時稽核單位亦定期監督執行情形。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		本公司已訂定「防範內線交易之管理作業程序」，以避免公司內部人因未諳法規規範誤觸內線交易，同時降低內部人無心之過或故意之誘因，達到促進證券交易市場之公平性，進而維護投資大眾權益。請詳本公司網站(網址同前)。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		本公司於公司治理實務守則中訂定董事會成員組成多元化方針並據以執行。本公司董事會由十三位董事組成，包括三席獨立董事(占比23%)，其中一席獨立董事為女性(占比8%)，一席董事為50歲以下(占比8%)，具員工身份之董事有四席(占比為31%)。董事所具備之專業知識技能涵蓋電機工程、工業工程、電子工程、機械工程、土木工程、經濟、企管、電子物理、財經、心理學、會計、農化、國際關係、投資及風險管理等不同領域，已充分落實董事會成員多元化方針，該具體管理目標及落實情形請詳本公司網站 https://ir.aseglobal.com/c/ir_board.php 。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	√		本公司業已依法設置審計委員會，由董事會指派符合1934年美國證交法規則10A-3規定之沙賓法案及臺灣證券交易所上市規章定義，具備會計或相關財務管理專長之獨立董事擔任本公司審計委員會之委員。本公司董事會依法設置薪資報酬委員會，該委員會目前有三位成員，其中包含兩席獨立董事。本公司另設有風險管理委員會，由二位獨立董事及一位委員所組成，其職責及運作情形請詳本公司網站 https://ir.aseglobal.com/c/ir_committees.php https://www.aseglobal.com/content/ch/csr_risk_management.html 。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		本公司已訂定董事薪資報酬之程序，除依本公司章程第二十三條規定公司如有獲利應提撥年度獲利百分之零點七五(含)以下之董事酬勞外，並考量公司整體營運績效及產業未來發展趨勢，參酌「董事會自我評鑑或同儕評鑑參考範例」訂定董事會績效評估辦法，經董事會通過頒布並揭露於本公司網站。本公司每年定期依據該辦法所訂定之評估程序進行績效評估並將評估結果呈報董事會。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		本公司審計委員會每年定期取得會計師出具之獨立聲明書並評估簽證會計師之獨立性，再將評估結果提報董事會。 (一) 評估機制如下： (1) 簽證會計師與公司及董事均非關係人。 (2) 依照美國沙賓法案規定，簽證會計師事務所於年度簽證及其他各案件委任前，均需取得審計委員會的事先核准。 (3) 依照美國沙賓法案規定，簽證會計師每季向審計委員會彙報執行覆核/查核內容及獨立性等遵守情形。 (4) 遵守公司治理實務守則規定辦理簽證會計師之輪替。 (二) 評估結果如下： (1) 簽證會計師之獨立性符合美國SEC、PCAOB、中華民國會計師法及會計師職業道德規範等相關規定。 (2) 未連續五年委任同一會計師簽證。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	√		本公司已依法指定公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，並經董事會通過。公司治理人員主要職責包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。公司治理主管職權範圍及進修情形請詳本公司網站 https://cms.ase.todayir.com.tw/html/client_tw/ase/attachment/20220111135617250006917_tc.pdf 。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		本公司責成相關單位專責處理股東、客戶及供應商等利害關係人之溝通事宜。本公司於公司網站設有利害關係人專區，提供利害關係人表達意見的管道，有利本公司瞭解利害關係人所關切之議題與做適度回應，並透過年度企業社會責任報告書及公司網站公開揭露相關利害關係人溝通資訊，請詳 https://www.aseglobal.com/ch/csr_stakeholder_engagement 。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
七、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	√		本公司已架設網站，並責成相關部門負責公司財務業務及公司治理資訊之揭露與更新，請詳本公司網站 https://www.aseglobal.com/ch 。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	√		本公司已架設中英文網站，設有專責人員負責公司資訊蒐集及揭露，亦依規定設有發言人及代理發言人制度，以及專責聯絡窗口回覆股東之意見。相關資訊請詳本公司網站(網址同前)。 本公司指定專人負責公開資訊觀測站之申報，包含各項定期及不定期財務、業務資訊並依相關規定發佈重大訊息。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√		本公司於規定期限內公告並申報各季合併財務報告及於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度合併財務報告，本公司亦於規定期限內公告並申報各月份營運情形。相關資訊請至公開資訊觀測站查詢。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	√		(一) 員工權益及僱員關懷：請參考本公司之企業社會責任報告書及網站： https://www.aseglobal.com/content/ch/csr_inclusive_workplace.html 。 (二) 投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利：請參考本公司網站之投資人關係以及利害關係人專區。 (三) 董事及經理人進修之情形：110年董事及經理人進修情形如下附表1及附表2。 (四) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本年報「風險事項分析評估」說明及參考本公司企業社會責任報告書。 (五) 客戶政策之執行情形：請參閱本年報「市場及產銷概況」說明。 (六) 本公司為董事購買責任保險之情形：已投保董(監)事及重要職員責任保險(110年度保險金額為6仟萬美元)。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 依據109年度之公司治理評鑑結果，本公司已改善之指標如下，以強化股東權益之保障及董事會之運作，未來本公司將持續加強公司治理相關資訊之透明度及即時性： (1) 過半數董事(含至少一席獨立董事)及審計委員會召集人親自或以直播連線方式出席股東常會。 (2) 董事長與總經理非為同一人或互為配偶或一親等親屬。 (3) 會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告。				

附表1：最近年度及截至年報刊印日止之董事進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄				
法人董事代表人 (兼經理人)	張虔生	110/10/15	110/10/15	中華公司治理協會	氣候緊張時代的法治暨公司治理下的法律風險管控	3	是
		110/04/15	110/04/15	中華公司治理協會	網路威脅發展趨勢與防禦策略	3	是
法人董事代表人 (兼經理人)	張洪本	110/10/15	110/10/15	中華公司治理協會	氣候緊張時代的法治暨公司治理下的法律風險管控	3	是
		110/04/15	110/04/15	中華公司治理協會	網路威脅發展趨勢與防禦策略	3	是
法人董事代表人	蔡祺文	110/10/15	110/10/15	中華公司治理協會	氣候緊張時代的法治暨公司治理下的法律風險管控	3	是
		110/04/15	110/04/15	中華公司治理協會	網路威脅發展趨勢與防禦策略	3	是
法人董事代表人 (兼經理人)	吳田玉	110/10/15	110/10/15	中華公司治理協會	氣候緊張時代的法治暨公司治理下的法律風險管控	3	是
		110/04/15	110/04/15	中華公司治理協會	網路威脅發展趨勢與防禦策略	3	是

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄				
法人董事代表人 (兼經理人)	董宏忠	110/10/15	110/10/15	中華公司治理協會	氣候緊張時代的法治暨公司治理下的法律風險管控	3	是
		110/04/15	110/04/15	中華公司治理協會	網路威脅發展趨勢與防禦策略	3	是
法人董事代表人	羅瑞榮	110/10/15	110/10/15	中華公司治理協會	氣候緊張時代的法治暨公司治理下的法律風險管控	3	是
		110/04/15	110/04/15	中華公司治理協會	網路威脅發展趨勢與防禦策略	3	是
法人董事代表人	陳天賜	110/10/15	110/10/15	中華公司治理協會	氣候緊張時代的法治暨公司治理下的法律風險管控	3	是
		110/04/15	110/04/15	中華公司治理協會	網路威脅發展趨勢與防禦策略	3	是
法人董事代表人	陳昌益	110/11/12	110/11/12	中華公司治理協會	氣候變遷與TCFD	3	是
		110/04/15	110/04/15	中華公司治理協會	網路威脅發展趨勢與防禦策略	3	是
法人董事代表人	張衍鈞	110/11/12	110/11/12	中華公司治理協會	氣候變遷與TCFD	3	是
		110/10/15	110/10/15	中華公司治理協會	氣候緊張時代的法治暨公司治理下的法律風險管控	3	是
董事	張能傑	110/10/15	110/10/15	中華公司治理協會	氣候緊張時代的法治暨公司治理下的法律風險管控	3	是
		110/04/15	110/04/15	中華公司治理協會	網路威脅發展趨勢與防禦策略	3	是
獨立董事	游勝福	110/10/15	110/10/15	中華公司治理協會	氣候緊張時代的法治暨公司治理下的法律風險管控	3	是
		110/04/15	110/04/15	中華公司治理協會	網路威脅發展趨勢與防禦策略	3	是
獨立董事	何美玥	110/11/12	110/11/12	證券暨期貨市場發展基金會	氣候變遷與淨零排政策對企業經營的風險與機會	3	是
		110/10/15	110/10/15	中華公司治理協會	氣候緊張時代的法治暨公司治理下的法律風險管控	3	是
		110/07/27	110/07/27	中華公司治理協會	海外控股公司組織重整-遷冊評估暨全球最低稅制對跨國企業之影響	3	是
		110/05/14	110/05/14	證券暨期貨市場發展基金會	企業升級與轉型之策略與管理	3	是
		110/04/27	110/04/27	證券暨期貨市場發展基金會	員工獎勵策略與工具運用探討	3	是
		110/04/15	110/04/15	中華公司治理協會	網路威脅發展趨勢與防禦策略	3	是
獨立董事	翁文祺	110/11/22	110/11/22	證券暨期貨市場發展基金會	後疫情下的全球風險趨勢	3	是
		110/11/22	110/11/22	證券暨期貨市場發展基金會	後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值	3	是
		110/10/15	110/10/15	中華公司治理協會	氣候緊張時代的法治暨公司治理下的法律風險管控	3	是

附表2：最近年度及截至年報刊印日止之經理人進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄				
資深副總經理暨集團會計長	郭宏銘	110/06/17	110/06/18	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12	是
集團行政長暨公司治理主管	汪渡村	110/10/15	110/10/15	中華公司治理協會	氣候緊張時代的法治暨公司治理下的法律風險管控	3	是
		110/09/01	110/09/01	金融監督管理委員會	第十三屆台北公司治理論壇	6	是
		110/04/16	110/04/16	中華公司治理協會	直指公司治理的唯二保險-資安保險	3	是
		110/04/15	110/04/15	中華公司治理協會	網路威脅發展趨勢與防禦策略	3	是
		110/03/23	110/03/23	中華公司治理協會	110年董事會股東會應注意事項	3	是
		110/03/09	110/03/09	中華公司治理協會	公司治理之幕後推手：公司治理人員運作實務	3	是

(四) 薪資報酬委員會其組成及運作情形：

本公司為落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，於民國107年4月30日依證券交易法第十四條之六及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法設立薪資報酬委員會，該委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之。該委員會成員業依相關法令規定，過半數成員由獨立董事擔任，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席，對外代表該委員會。該委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：

- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 檢視子公司所呈報經其董事會決議通過之董事、監察人及經理人薪資報酬制度與董事、監察人及經理人薪資報酬備查資料，並向本公司董事會提報檢視意見。

本屆薪資報酬委員會成員資料：

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	游勝福 (召集人)	請參閱第7頁1.3董事資料相關內容	· 本公司薪資報酬委員會成員本人、配偶及二親等以內之親屬並未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 · 本公司薪資報酬委員會成員除游勝福之配偶及未成年子女持有本公司股份2,388股外，其餘薪資報酬委員會成員本人、配偶及二親等以內之親屬皆未持有本公司股份。 · 本公司薪資報酬委員會成員並未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 · 本公司薪資報酬委員會成員除取得其擔任薪酬委員之報酬外，最近2年並無因提供本公司或關係企業其他商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	1
獨立董事	翁文祺	請參閱第7頁1.3董事資料相關內容		2
其他	谷小瑛	· 日月光半導體製造(股)公司薪資報酬委員會委員 · 日月光半導體製造(股)公司核心人力開發與管理專案顧問 · 日月光半導體製造(股)公司人資處處長 · 華泰電子人資高級專員		1

薪酬委員會成員參與薪資報酬委員會運作情形資訊

110年度截至年報刊印日止，薪資報酬委員會開會3次(A)，本屆委員會任期：110年08月13日至113年08月12日，委員出席情形如下：

職稱	身分別	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註1)	備註
召集人	獨立董事	游勝福	3	0	100%	
委員	獨立董事	翁文祺	1	0	100%	新任(註2)
委員	其他	谷小瑛	3	0	100%	
委員	獨立董事	徐大麟	2	0	100%	任期屆滿(註3)

註1：實際出席率(%)以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：110.08.13新任，最近年度截至年報刊印日可出席薪資報酬委員會開會次數為1次。

註3：110.08.12任期屆滿，本年度可出席薪資報酬委員會開會次數為2次。

其他應記載事項：

- 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
- 本公司揭露薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會日期期別	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
110.03.16 第2屆第8次薪資報酬委員會議	擬請檢視子公司日月光半導體製造股份有限公司所呈報經其董事會決議通過之董事、監察人及經理人薪資報酬之備查資料。 擬請檢視子公司矽品精密工業股份有限公司所呈報經其董事會決議通過之董事、監察人及經理人薪資報酬之備查資料。 擬訂定本公司「經理人薪資酬勞辦法」。 擬訂定本公司民國一〇九年度之董事酬勞。	本案於列席人員均離席後，經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	因無成員提出意見，故未有進一步處理。
110.07.23 第2屆第9次薪資報酬委員會議	擬請檢視子公司日月光半導體製造股份有限公司所呈報經其董事會決議通過之經理人薪資報酬制度與董事及監察人薪資報酬之備查資料。 擬訂定本公司一〇九年度之經理人工酬勞分配明細。 擬訂定本公司一〇九年度之董事酬勞分配明細。		
110.09.16 第3屆第1次薪資報酬委員會議	擬請檢視子公司日月光半導體製造股份有限公司所呈報經其董事會決議通過之董事、監察人及經理人薪資報酬之備查資料。 擬訂定本公司民國一一〇年度限制員工權利新股授予具員工身分之本公司董事或經理人之獲配名單及數量。		

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司由董事及高階管理階層組成「永續發展委員會」，負責指引及督導日月光投控在全球環境、社會及治理策略上的發展，每年定期向董事會報告，並設置「企業永續處」作為負責推動企業社會責任之單位，負責評估全公司之永續議題與永續績效、協調及促動公司目標之擬訂以及推動永續發展行動計畫之執行，並直接向該委員會報告。主要永續發展推動計畫分為六大主軸，分別為公司治理、環境永續、員工關懷與發展、供應鏈發展、企業公民與社會參與及利害關係人議合與資訊揭露。本公司永續發展專職單位之治理架構、運作及執行績效等詳細資訊，請參考本公司永續報告書及網站 https://www.aseglobal.com/ch/csr/ 。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司設置「永續發展委員會」作為推動永續發展專職單位，依重大性原則進行與公司營運相關之環境、社會及治理議題之風險評估，鑑別出可能對經營目標產生影響的風險事件。本公司亦於董事會下設置「風險管理委員會」綜理本公司整體之風險管理，針對風險執行管理決策、協調及推動跨組織風險管控方案，並通過「風險管理政策與程序辦法」作為本公司風險管理之最高指導原則。本公司與風險相關等詳細資訊，請參考本公司永續報告書及網站。
三、環境議題			
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司責成各子公司於環境保護業務上的執行，除了符合法令及相關規範的規定外，同時並應建立ISO 14001環境管理系統。除應定期查核符合法令要求外，每年亦訂定污染防治與設備改善推動計劃，並設立年度目標，以有效降低污染排放並適時檢討環境管理制度。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		本公司責成各子公司規劃能源使用效率的管理機制與生態效益評估並以永續製造原則，持續精進供應設施效率提升或模組最佳化的改善，以遵守「企業永續發展與企業公民政策」以及「企業社會責任實務守則」，期達到資源使用效率最大化，實踐產品價值提升同時降低環境衝擊。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		本公司在既有的企業風險管理(ERM)系統架構下，同步參考金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB)所發布氣候相關財務揭露建議書(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)之架構，進行氣候變遷風險與機會的管理。將氣候變遷的各種不確定因素，配合情境分析模擬可能產生之結果，盡可能地將風險控制在預期可接受範圍內，以確保和促進公司整體利益實現。本公司針對氣候風險與機會及相關因應措施等詳細資訊，請參考本公司永續報告書及網站。
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		本公司責成各子公司改善生態效益並保護環境，向各子公司收集和統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量之相關數據，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水，以及廢棄物管理之相關政策，減量成果每年揭露於永續報告書。
四、社會議題			
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司已訂定「企業永續發展與企業公民政策」、「商業行為與道德準則」及「企業社會責任實務守則」，承諾尊重基本勞動人權、遵守政府勞動法規、保障員工工作環境、健康安全等相關權益。為更進一步保護與促進人權，支持並尊重「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」第一與第二條原則、「聯合國企業與人權指導原則」、國際勞工組織「工作基本原則與權利宣言」與當地法令規範，本公司制定「人權政策」以及人權保障管理原則來保護員工，並要求我們的供應商亦恪遵此原則以維護人權。人權管理相關準則之內容，請詳本公司網站。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司薪酬考核制度重視公平及平等，所有的正職員工皆享有一致性的薪酬福利，並每年檢視廠區在地基本薪酬水平，以確保員工的基本工資具有競爭力。本公司設有激勵獎金及年度分紅獎金，現金激勵獎金依公司營收達成之成果，提供給績效優異的員工，而年度分紅獎金則依員工個別的貢獻度及績效來分派給員工，請詳本公司網站 https://www.aseglobal.com/ch/csr/inclusive-workplace/talent-attraction-retention/ 。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		為提供員工符合安衛法規且健康的最佳作業場所，本公司責成各子公司導入ISO 45001職業安全衛生管理系統，定期進行危害鑑別及風險評估，採取適當的改善措施，降低工作環境的危害風險，並舉辦員工工作安全衛生教育訓練與健康促進活動。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司責成各子公司依照各職務訓練需求及職涯能力發展需求進行年度訓練課程規劃，並依規畫進行課程舉辦；包括新人訓練、通識教育、專業培訓、基層管理、中階管理及人才發展等。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司為確保客戶的意見能有效的傳達與處理，以及促進與客戶的即時互動，責成各子公司制定設立客戶溝通的管理程序，設有客戶服務專業專責團隊，定期檢視客戶的滿意度，提供相關客戶的意見反應與溝通服務。本公司於永續發展委員會之下成立資安管理分組，綜理投控整體資安策略發展，制定「資訊安全政策」並責成各子公司建立界定機密資訊程序以具體規範員工在日常作業程序中需遵守的規則，確保客戶專有資訊的機密性和完整性。本公司責成各子公司遵循台灣貿易法相關條文包括輸出入戰略性高科技貨品之規定，對於服務之行銷及標示，均依照客戶需求與法規運作。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司已訂定「採購與供應鏈發展政策」與「供應商行為準則」，並揭露於本公司網站 https://www.aseglobal.com/ch/csr/responsible-procurement/supply-chain-management-framework/ 。本公司責成子公司每年定期進行供應商「永續發展問卷」調查，透過問卷、現場/遠端稽核或文件稽核調查供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等執行情形。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	√		本公司永續報告書依循GRI和SASB準則之核心選項進行編製，並由勤業眾信聯合會計師事務所，依財團法人中華民國會計研究發展基金會頒布之確信準則公報第一號(參考ISAE 3000 Revised之相關規定訂定)「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」，進行獨立有限確信(Limited Assurance)。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司於107年參酌「上市上櫃公司永續發展實務守則」(原稱：上市上櫃公司企業社會責任實務守則)訂定永續發展實務守則，經董事會通過頒布並揭露於本公司網站，實際運作與守則規定並無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
- 本公司長期致力於回饋社會，透過「日月之光慈善事業基金會」與「日月光文教基金會」，投入與參與社區和社會公益活動，亦於2020年設立「日月光環保永續基金會」，推動環保永續公益方案與活動。 - 本公司員工透過善款或專業技能等，協助解決急難救助、學童教育等問題，為履行社會參與承諾之最大支柱。在社區營造，本公司期許藉由長期的合作及溝通，產生信任、互助及融洽的關係，創造積極正面並對社會有益的商業環境。 - 積極投入環保公益活動：子公司日月光公司於102年12月20日承諾並履行持續30年每年至少投入新台幣一億元(目前已實際執行九年)，以長期規劃及多面向推動的角度，持續穩定地投入台灣環保相關工作。目前，已透過「日月光環保永續基金會」規劃並執行諸多環保公益活動，重要執行主軸如下： 1. 節能減碳 2. 自然生態 3. 環境教育 4. 循環經濟 5. 環境保護 - 其他推動永續發展執行情形，請參考本公司永續報告書。				

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	√		本公司董事會已通過頒布誠信經營相關規章，包括「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「商業行為與道德準則」、「公平競爭暨反托拉斯法遵循政策」及「反貪腐防範辦法」等政策規範，並於本公司網站詳細說明誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之情形，請詳本公司網站 https://www.aseglobal.com/ch/csr_business_conduct_ethics.html 。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	√		本公司制定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「商業行為與道德準則」、「公平競爭暨反托拉斯法遵循政策」及「反貪腐防範辦法」等政策規範，明定嚴格禁止董事、經理人及受僱人等進行下列不誠信行為，並透過內部稽核程序查核及監控，藉以建立誠信之營業行為： 一、行賄及收賄。 二、提供非法政治獻金。 三、不當慈善捐贈或贊助。 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。 六、從事不公平競爭之行為。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√		本公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「商業行為與道德準則」、「公平競爭暨反托拉斯法遵循政策」及「反貪腐防範辦法」等規範內，明訂其作業程序、行為指南及申訴制度以防範不誠信行為，並在工作規則中訂定道德規範及違規之懲戒措施等事宜，以督促所有員工確實遵守，且依據法規更新狀態，檢討修正上述規範與防範方案。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信記錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	√		本公司於商業往來前，會先對商業往來對象進行徵信，排除有不誠信行為記錄之對象，並於商業契約中明訂誠信行為條款。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		本公司由董事及高階管理階層組成「永續發展委員會」作為商業行為與道德的最高管理組織，負責統籌集團誠信經營政策規範之制定、監督與執行，定期每年檢視其推動與遵循狀況，並向董事會報告。本公司旗下三大子公司並設置隸屬於各子集團永續發展委員會之「公司治理團隊」負責推動誠信經營政策規範至日月光全球營運據點，以達成健全公司治理之目的。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		本公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「商業行為與道德準則」明定防止利益衝突政策，並依相關規範設置適當之陳述及諮詢管道。 此外，本公司董事秉持高度自律，對董事會議案與其自身有利害關係，致有害於公司利益之虞者，討論及表決時應予迴避，董事間亦不得不當相互支援。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司設有健全之會計制度及內部控制制度，不允許有外帳或保留秘密帳戶，為確保該制度之設計及執行持續有效，由內部稽核人員擬訂稽核計畫不定期查核前項制度遵循情形。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司及各子公司每年除舉辦對高階管理階層之誠信相關教育訓練以及對供應商之誠信商業行為進行宣導外，亦設計線上課程，對員工展開商業行為與道德相關政策與規範之教育訓練。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形。				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		本公司已設置檢舉管道(包括商業行為與道德遵循舉報系統/信箱以及違反會計、內控或審計事項舉報信箱等)，並於「誠信經營作業程序及行為指南」及「會計、內部會計控制或審計事項之舉報政策及程序」中訂定具體檢舉制度。關於本公司檢舉管道與制度相關資訊，請詳本公司網站 https://www.aseglobal.com/ch/csr_business_conduct_ethics.html 。 https://ir.aseglobal.com/c/ir_doc.php 。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「違反誠信經營檢舉案件處理辦法」，明確規範受理檢舉後之標準處理程序、調查後之措施及處分，與相關保密機制。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司誠信經營作業程序及行為指南第二十一條以及違反誠信經營檢舉案件處理辦法明定，公司處理檢舉情事之相關人員應對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
四、加強資訊揭露				
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已將誠信經營相關政策與規範公開揭露於本公司網站，請詳本公司網站 https://ir.aseglobal.com/c/ir_doc.php 。未來並將本公司誠信經營之運作情形與推動成效於本公司網站及永續報告書中詳細說明。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司誠信經營守則，經本公司董事會通過頒布並揭露於本公司網站，實際運作與守則規定並無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形)：本公司參酌本公司商業行為與道德準則及電子行業公民聯盟之行為準則訂定「日月光投控供應商行為準則」，要求供應商於勞工、健康與安全、環境、商業道德及管理體系等各方面之商業行為確實符合本準則，並且完全遵守經營所在國家/地區的法律和法規，以確保供應鏈具備安全的工作環境，其員工受到尊重並享有尊嚴，且其營運對環境負責並符合商業道德。				

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：本公司訂有「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」等之相關規章，揭露於公司網站。

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：無。

(九)内部控制制度執行狀況

1. 内部控制聲明書

日月光投資控股股份有限公司

内部控制制度聲明書



日期：一一一年二月二十五日

本公司民國一一〇年度之内部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護内部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、内部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之内部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，内部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之内部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之内部控制制度有效性之判斷項目，判斷内部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之内部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將内部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述内部控制制度判斷項目，評估内部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一〇年十二月三十一日的内部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的内部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一一年二月二十五日董事會通過，出席董事十二人中，有〇人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

日月光投資控股股份有限公司

董事長：張虔生



總經理：張洪本



2. 委託會計師專案審查内部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

股東會之重要決議

召開日期	重要決議	執行情形
110.08.12 召開110年股東常會	1. 通過承認本公司一〇九年度決算表冊案。	不適用。
	2. 通過承認本公司一〇九年度盈餘分派案。	訂定110年9月12日為除息基準日，110年9月30日為現金股利發放日，共發放新台幣18,389,855,534元。
	3. 通過修訂本公司「公司章程」案。	於110年9月2日獲經濟部核准登記並公告於公司網站。
	4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	已依修訂後之辦法執行相關作業並公告於公司網站。
	5. 通過本公司發行限制員工權利新股案。	於110年9月7日經金管會核准並訂定110年10月1日為增資基準日。
	6. 全面改選本公司董事。 選舉結果： 法人董事：香港商微電子國際公司；法人董事代表人：張虔生、張洪本、蔡祺文、吳田玉、董宏忠、羅瑞榮、陳天賜、陳昌益、張衍鈞。 個人董事：張能傑。 獨立董事：游勝福、何美玥、翁文祺。	於110年9月2日獲經濟部核准登記並公告於公司網站。
	7. 通過同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 解除新任董事競業禁止之名單為 法人董事(香港商微電子國際公司)代表人： 張虔生(本公司董事長)、張洪本(本公司副董事長及總經理)、蔡祺文、吳田玉(集團營運長)、董宏忠(集團財務長)、羅瑞榮、陳天賜、陳昌益、張衍鈞。 個人董事：張能傑。 獨立董事：游勝福、何美玥、翁文祺。	已公告於公開資訊觀測站。

董事會之重要決議

開會日期	重要決議
110.02.25	1. 決議通過本公司及日月光半導體製造股份有限公司(含子公司)民國一一〇年度簽證會計師公費審查案。 2. 決議通過本公司民國一〇九年度合併財務報告暨個體財務報告案。 3. 決議通過出具本公司民國一〇九年度內部控制制度聲明書案。
110.03.26	1. 決議通過本公司「經理人薪資酬勞辦法」案。 2. 決議通過分派本公司民國一〇九年度之員工酬勞案。 3. 決議通過分派本公司民國一〇九年度之董事酬勞案。 4. 決議通過本公司民國一〇九年度營業報告書案。 5. 決議通過本公司民國一〇九年度盈餘分派議案。 6. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。 8. 決議通過本公司董事任期屆滿改選案。 9. 決議通過解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 10. 決議通過本公司民國一一〇年股東常會召開之日期、地點及議程案。
110.05.06	1. 決議通過本公司持股1%以上股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 2. 決議通過本公司「資源整合暨決策委員會組織規程」，並敦聘該委員會主任委員案。 3. 決議通過本公司發行限制員工權利新股案。 4. 決議通過修改本公司民國一一〇年股東常會之議程，於討論事項增列「討論本公司發行限制員工權利新股案」。
110.07.13	決議通過依金融監督管理委員會指示，決議變更本公司民國一一〇年股東常會召開日期案。
110.08.05	1. 決議通過訂定本公司一〇九年度之經理人員工酬勞分配明細案。 2. 決議通過訂定本公司一〇九年度之董事酬勞分配明細案。
110.08.13	1. 決議通過選任本公司董事長及副董事長案。 2. 決議通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。
110.09.30	1. 決議通過委任本公司第二屆風險管理委員會委員案。 2. 決議通過就本公司民國一一〇年度限制員工權利新股發行辦法相關條款訂定附註解釋案。 3. 決議通過訂定本公司民國一一〇年度限制員工權利新股之增資基準日、發行股數及獲配員工名單、數量案。
110.11.05	決議通過本公司為維護公司信用及股東權益，擬依相關法令規定買回本公司股份並辦理銷除案。

開會日期	重要決議
110.12.01	決議通過本公司出售間接持有之海外子公司GAPT Holding Limited股份及大陸投資事業日月光半導體(昆山)有限公司股權案。
110.12.23	決議通過訂定本公司一一一年度稽核計畫案。
111.02.25	1. 決議通過本公司及日月光半導體製造股份有限公司(含子公司)民國一一一年度簽證會計師公費審查案。 2. 決議通過本公司民國一一〇年度合併財務報告暨個體財務報告案。 3. 決議通過出具本公司民國一一〇年度內部控制制度聲明書案。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

(十四) 智財管理計畫與執行情形：

智慧財產管理政策與目標

為維持全球技術領導地位，本公司持續投入研發創新工作，擬定符合公司營運暨研發策略的智財管理策略，建立一套運用智慧財產權來促進各種商業利益的運作模式，以妥善保護公司研發成果，提升公司競爭力，確保公司營運的自由，為股東帶來最大收益。

智慧財產管理制度

為落實智慧財產政策與目標，本公司依據公司營運藍圖以及相關最新法令規劃創新活動，建立並持續強化智慧財產管理制度，經由健全妥善的智財管理確保研發成果成為智慧財產權，獲得完善有效的保護，並整合運用高價值的智慧財產權促進各種商業利益，以持續提升競爭力並增強防禦力。

A. 專利

本公司的智財管理策略著重於專利數量、品質與價值三者並重。除了針對關鍵技術提早全面布局外，更透過不斷的評估和創新，讓專利權去蕪存菁，達到品質持續提升的目標，亦持續強化專利權加值活化的運用，極大化研發投資的收益。除此之外，本公司亦與產業技術領導者合作，共同研發、布局申請或取得必要專利授權，以確保公司在技術上能全方位地增強防禦力和維持競爭力。

B. 營業秘密

本公司的營業秘密是成本優勢、技術領先、精細製造、智慧工廠、客戶信賴等企業競爭力的基礎。本公司藉資訊安全制度、觀念宣導、全廠培訓、系統化管理等措施，確保營業秘密各保護要件皆能滿足，當必要時，可有效援引營業秘密相關法令制止他人不正當取得、揭露或使用本公司資訊資產，保障投資並捍衛權益。

C. 商標

為了使本公司專屬產品或服務與他人的類似產品或服務區隔，本公司已註冊並取得若干商標權。當行銷推廣產品或服務時，本公司可以使用註冊的商標彰顯公司產品或服務的品質與特色。若他人不當使用近似標記造成客戶或消費者混淆誤認時，本公司可主張商標權以捍衛商譽或鞏固市占率。

有關智慧財產權之風險與因應措施

持續研發創新、強化智慧財產管理是本公司營運成功的重要因素之一，基此本公司不斷積極地研發並保護自身的智慧財產權。為防範公司的獨有技術、營業秘密或專利被他人剽竊或侵害的風險，本公司加強建立全體同仁的智財意識並要求落實保護措施於日常工作中。除定期以線上或開辦課程的方式舉辦智權相關的教育訓練外，亦不定期舉辦各式演練活動，提升同仁對智權保護的認知。此外，本公司亦透過資訊設備管制、電子郵件管制及以廠區管制等管控措施，強化公司安全管理，降低洩密的風險。本公司並已建立應變機制與流程，對於智慧財產權遭受侵害的風險能及時啟動調查蒐證的程序，必要時亦會透過法律行動，排除他人的侵權行為，捍衛本公司的智慧財產權。

本公司同時也尊重他人合法的智慧財產權，但無法保證公司獨立開發之技術，或在不知情的狀況下，是否可能有與他人的智慧財產權相衝突之疑慮。此外，公司在某種程度上需倚賴他人的技術及專利授權。當無法以合理條件取得授權時，公司

可能有被第三方主張侵權的賠償責任或聲請法院禁制令的風險，或是客戶依合約請求及主張本公司負擔或賠償客戶因第三方侵權主張所遭受之損害，因而公司會策略性取得某些特定技術的必要授權，並同時盤點整備公司具備的優質專利作為防禦訴訟或交互授權之用，確保公司的營運自由。

執行情形

截至2022年1月31日，本公司擁有6,038件專利，布局主要在各種封裝測試技術和電子製造服務技術，其包括2,473件台灣專利，1,836件美國專利，1,695件中華人民共和國專利，9件歐洲專利和25件其他國家專利。截至2022年1月31日，我們共擁有1,631件專利申請案，其包括175件台灣專利申請案，572件美國專利申請案，852件中華人民共和國專利申請案，15件歐洲專利申請案和17件其他國家專利申請案。

本公司目前已在台灣、美國、中國及歐盟申請並註冊若干商標，其中如“日月光”、“ASE”、“aCSP”、“a-EASI”、“a-fcCSP”、“aQFN”、“a-QFN”、“a-S³”、“a-TiV”、“aWLP”、“a-WLP”、“iSiP”、“iWLP”、“aSiM”、“SiP-id”、“SPIL”、“ ”、“環電”、“ ”、“環旭”、“环旭”、“環鴻”、“环鴻”、“HSiP”、“ ”、“ ”、“ ”、“XnBay”、“Emerald”及“ ”已在台灣獲得註冊，惟此清單為一未盡羅列之本公司商標清單，任何經本公司使用於或併入其服務但未明示於前述清單之名稱、服務標章或標誌並不構成本公司放棄該名稱或標誌之商標或其他智慧財產權之權利。

在營業秘密管理部分，本公司透過每年度全廠區線上營業秘密教育訓練課程，持續宣導人員落實機密資訊保護，並已於人員離職程序加強建置法務離職訪談機制，提醒人員離職後仍應遵循保密責任，降低資訊外流風險。針對影響產業領導地位之重要關鍵技術，本公司將與子公司共同研議集團的保護策略，訂立統一管理方針，以持續維護本公司競爭力並保護股東之最大利益。

本公司每年至少一次將上述智慧財產管理計畫及執行情形向董事會進行報告，並針對董事之建議提出改善措施。最近一次提報日期為2021年10月15日。

本公司旗下子公司日月光公司於2021年11月15日通過台灣智慧財產管理系統(TIPS)之驗證，證書有效期間至2022年12月31日。

五、會計師公費資訊：

會計師公費資訊級距表

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費 (附註1)	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	吳世宗	郭麗園	110.01.01~110.12.31	16,788	8,914	25,702	

附註1：非審計公費之服務內容，包括稅務簽證、員工認股權憑證及限制員工權利新股發行之複核公費、企業社會責任確信查核及其他等。

(一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費減少金額及原因：不適用。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

六、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師：

更換日期	一〇九年八月七日		
更換原因及說明	本公司簽證會計師原委由勤業眾信聯合會計師事務所吳世宗及江佳玲兩位會計師為之，因該事務所內部職務調整，故改委由該所之吳世宗及郭麗園兩位會計師續為之。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情 況	(不適用)	
	主動終止委任		
	不再接受(繼續)委任		
最近兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無		
	說明：不適用		
其他揭露事項 (依公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師：

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	吳世宗、郭麗園
委任之日期	一〇九年八月七日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第10條第6款第1目及第2目之3事項復函：無。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業之期間：不適用。

八、董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 持股及設質股數變動情形

職稱	姓 名	一一〇年底止		一一一年截至二月底止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事本人及大股東	香港商微電子國際公司	—	—	—	—
董事之法人代表人	張虔生(董事長兼資源整合暨決策委員會主任委員)	(4,836,678)	—	—	—
	張洪本(副董事長)	—	—	—	—
	蔡祺文	1,200,000	—	—	—
	吳田玉(集團營運長)	—	—	—	—
	董宏忠(集團財務長)	—	—	—	—
	羅瑞榮	—	—	—	—
	陳天賜	—	—	—	—
	陳昌益	—	—	—	—
	張衍鈞	940,000	—	—	—

職稱	姓 名	一〇一〇年底止		一一一一年截至二月底止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事本人	張能傑	—	—	—	—
獨立董事	游勝福	—	—	—	—
獨立董事	何美玥	—	—	—	—
獨立董事	翁文祺	—	—	—	—
集團幕僚長	潘士華	—	—	—	—
集團行政長	汪渡村	40,000	—	—	—
資深副總經理	李柏練	—	—	—	—
資深副總經理 暨集團會計長	郭宏銘	—	—	—	—
資深副總經理	張淑琴	24,000	—	(24,000)	—
副總經理	沈貝俐	5,000	—	—	—
副總經理	張聲華	—	—	—	—
副總經理	項世傑	(395,000)	—	—	—

(二) 股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(三) 股權質押之相對人為關係人資訊：無。

九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

111年01月21日(註) 單位：股：%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或 為配偶、二親等以內之親屬關係 者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股 比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係	
香港商微電子國際公司	684,327,886	15.525	—	—	—	—	—	—	—
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證	282,242,372	6.403	—	—	—	—	—	—	—
匯豐商業銀行受託保管價值投資公司 投資專戶	265,024,820	6.012	—	—	—	—	—	—	—
匯豐商銀股份有限公司受託保管卓越 資本獲利有限公司專戶	120,640,482	2.737	—	—	—	—	—	—	—
新制勞工退休基金	70,995,298	1.611	—	—	—	—	—	—	—
國泰人壽保險股份有限公司	69,800,918	1.583	—	—	—	—	—	—	—
台灣銀行股份有限公司公教保險部	55,762,976	1.265	—	—	—	—	—	—	—
花旗台灣商銀保管科威特投資處 投資專戶	50,878,469	1.154	—	—	—	—	—	—	—
舊制勞工退休基金	47,366,465	1.075	—	—	—	—	—	—	—
摩根託管梵加德新興市場股票指數基金 專戶	47,021,723	1.067	—	—	—	—	—	—	—

註：持股比率總股數之計算基礎係以截至110年12月31日止計入本公司員工因行使員工認股權增加之股數(即以111年1月21日辦理變更登記後之流通在外股數)。

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數

綜合持股比例

110年12月31日 單位：股：％

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接 控制事業之投資		綜合投資	
	股 數	持股比例	股 數	持股比例	股數	持股比例
日月光半導體(股)公司	5,994,143,764	100.00%	—	—	5,994,143,764	100.00%
矽品精密工業(股)公司	3,651,748,878	100.00%	—	—	3,651,748,878	100.00%
環電(股)公司	2,717,514,202	100.00%	—	—	2,717,514,202	100.00%

註：係公司採用權益法之長期投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

股份種類

110年12月31日

股份種類	核定股本					備註
	流通在外股份			未發行股份	合計	
	已上市	未上市	合計			
普通股	4,408,018,732股	0股	4,408,018,732股	1,091,981,268股	5,500,000,000股	

(一)股本來源

單位：股/新台幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	核准日期與文號
107.04	10	5,000,000,000	50,000,000,000	4,318,391,882	43,183,918,820	設立	無	民國107年04月30日 經加三商字第10700043490號
107.07	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,319,237,132	43,192,371,320	員工認股權憑證轉換 8,452,500	無	民國107年07月25日 經加三商字第1070007833號
107.10	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,320,148,632	43,201,486,320	員工認股權憑證轉換 9,115,000	無	民國107年10月22日 經加三商字第1070010894號
108.01	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,321,629,382	43,216,293,820	員工認股權憑證轉換 14,807,500	無	民國108年01月25日 經加三商字第1080001176號
108.04	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,322,625,732	43,226,257,320	員工認股權憑證轉換 9,963,500	無	民國108年04月23日 經加三商字第1080004252號
108.07	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,323,767,932	43,237,679,320	員工認股權憑證轉換 11,422,000	無	民國108年07月30日 經加三商字第1080008019號
108.10	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,325,402,582	43,254,025,820	員工認股權憑證轉換 16,346,500	無	民國108年10月30日 經加三商字第1080011193號
109.01	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,329,883,632	43,298,836,320	員工認股權憑證轉換 44,810,500	無	民國109年01月21日 經加三商字第1090000662號
109.04	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,334,711,132	43,347,111,320	員工認股權憑證轉換 48,275,000	無	民國109年04月24日 經加三商字第1090003707號
109.07	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,338,345,132	43,383,451,320	員工認股權憑證轉換 36,340,000	無	民國109年07月23日 經加三商字第1090007154號
109.10	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,338,531,132	43,385,311,320	員工認股權憑證轉換 1,860,000	無	民國109年10月26日 經加三商字第1090010269號
110.01	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,350,675,482	43,506,754,820	員工認股權憑證轉換 121,443,500	無	民國110年01月26日 經加三商字第1100000985號
110.04	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,379,428,032	43,794,280,320	員工認股權憑證轉換 287,525,500	無	民國110年04月21日 經加三商字第1100004091號
110.07	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,382,932,382	43,829,323,820	員工認股權憑證轉換 35,043,500	無	民國110年07月27日 經加三商字第1100007888號
110.10	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,397,932,382	43,979,323,820	發行限制員工權利新股 150,000,000	無	民國110年10月14日 經加三商字第1100010745號
110.10	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,403,414,582	44,034,145,820	員工認股權憑證轉換 54,822,000	無	民國110年10月29日 經加三商字第1100011304號
111.01	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,408,018,732	44,080,187,320	員工認股權憑證轉換 46,041,500	無	民國111年01月21日 經加三商字第1110000852號

(二)股東結構

111年01月21日(註1)

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外國人	合計(註2)
人數(人)	3	1	531	149,145	1,659	151,339
持有股數(股)	124,798,401	23,274,713	592,902,714	424,439,169	3,242,603,735	4,408,018,732
持股比例(%)	2.831	0.528	13.451	9.629	73.561(註3)	100

註1：係股務代理機構所提供最近期之資料。

註2：包含一一〇年十二月三十一日止，因員工行使認股權於一一一年一月二十一日辦理變更登記後所發行之股數。

註3：其中陸資持股比例為0.005%。

(三)股權分散情形

1. 普通股股權分散情形

每股面額十元：111年01月21日(註4)

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例(%)
1~999	85,499	17,824,406	0.404
1,000~5,000	51,583	102,631,906	2.328
5,001~10,000	7,077	51,501,641	1.169
10,001~15,000	2,068	25,462,707	0.578
15,001~20,000	1,216	21,484,079	0.487
20,001~30,000	1,041	25,755,503	0.584
30,001~40,000	518	18,291,675	0.415
40,001~50,000	351	16,007,616	0.363
50,001~100,000	671	47,497,485	1.078
100,001~200,000	396	55,593,470	1.261
200,001~400,000	255	74,501,887	1.690
400,001~600,000	134	66,752,274	1.514
600,001~800,000	91	64,084,315	1.454
800,001~1,000,000	51	45,824,754	1.040
1,000,001以上	388	3,774,805,014	85.635
合計	151,339	4,408,018,732	100.000

註4：係股務代理機構所提供最近期之資料。

2. 特別股股權分散情形：不適用。

(四)主要股東名單

111年01月21日(註)

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
香港商微電子國際公司		684,327,886	15.525
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證		282,242,372	6.403
匯豐商業銀行受託保管價值投資公司投資專戶		265,024,820	6.012
匯豐商銀股份有限公司受託保管卓越資本獲利有限公司專戶		120,640,482	2.737
新制勞工退休基金		70,995,298	1.611
國泰人壽保險股份有限公司		69,800,918	1.583
台灣銀行股份有限公司公教保險部		55,762,976	1.265
花旗台灣商銀保管科威特投資處投資專戶		50,878,469	1.154
舊制勞工退休基金		47,366,465	1.075
摩根託管梵加德新興市場股票指數基金專戶		47,021,723	1.067

註：持股比例總股數之基礎係依本公司員工截至110年12月31日止因行使員工認股權增加之股數(即以111年1月21日辦理變更登記後之流通在外股數)。

(五)每股市價、淨值、盈餘及股利資料

單位：新台幣元

年度			一〇九年度	一一〇年度	一一一年截至年報刊印日止
項目					
每股市價	追溯前	最高	83.80	133.50	112.00
		最低	49.95	81.80	98.30
	追溯後	最高	83.80	註1	註1
		最低	49.95	註1	註1
	平均		68.38	109.03	103.60
每股淨值	分配前		54.75	64.13	註5
	分配後		50.45	註1	註5
每股盈餘	加權平均股數		4,288,633,865股	4,365,667,867股	4,318,355,122股
	每股盈餘(稀釋)	追溯前	6.31	14.40	註5
		追溯後	6.31	註1	註5
每股股利	現金股利		4.19149913	註1	—
	無償配股	盈餘配股	—	註1	—
		資本公積配股	—	註1	—
	累積未付股利		—	—	—
投資報酬分析	本益比(註2)		10.84	7.57	註5
	本利比(註3)		16.31	註1	—
	現金股利殖利率(註4)		0.06	註1	—

註1：俟股東會決議後定案。

註2：本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

註3：本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註4：現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

註5：尚未完成盈餘結算。

(六)公司股利政策及執行狀況

1. 公司之股利政策：

本公司於民國一〇七年二月十二日經股東會通過訂定之股利政策如下：

本公司正處於企業穩定成長階段，為因應目前及未來業務擴展之資金需求，並滿足股東對現金流入之需求，本公司之股利政策係採取剩餘股利政策分派股利，其中現金股利發放之比例不低於股利總額百分之三十，餘額則配發股票股利，並由董事會擬具盈餘分派案，經股東會決議後辦理。

2. 本次董事會決議股利分派之情形：

(1) 本次現金股利之配發依本公司之公司章程規定由董事會決議辦理，並於股東會報告之。

(2) 本公司董事會於111年3月31日決議本次分派股東紅利新台幣30,501,980,824元，全部以現金發放，暫定每股配發現金股利7元。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明分配之情形：不適用。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

不適用。(依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無需公開民國一一一年度財務預測資訊。)

(八)員工及董事酬勞

1. 本公司公司章程經民國一〇八年六月二十七日股東常會決議後所載員工、董事酬勞之成數或範圍如下：

依本公司章程第二十三條規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之零點零一(含)以上，百分之一(含)以下為員工酬勞，並提撥百分之零點七五(含)以下為董事酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

本公司經前項董事會決議以股票方式發給員工酬勞者，得同次決議以發行新股或收買自己之股份為之。

前三項所稱之員工，其對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件由董事會訂定之。

依本公司章程第二十四條規定，本公司每屆決算所得純益，依下列順序分派之。

- (1) 彌補虧損。
- (2) 提存百分之十為法定盈餘公積。
- (3) 依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。

其餘併同以前年度未分配盈餘，由董事會擬定盈餘分派案，再提請股東會決議之；但盈餘分派以現金發放時，得由董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

一一〇年度應付員工酬勞及董事酬勞之估列金額分別為新台幣121,934,561元及195,095,298元，分別按稅前淨利之0.19%及0.30%計算。其差異金額之處理：年度合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司111年3月31日董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形如下：

擬議分派員工酬勞新台幣122,000,000元(全數以現金發放)及董事酬勞金額新台幣194,000,000元。上述擬配發金額與原已估列之員工酬勞121,934,561元及董事酬勞195,095,298元，差異數共計1,029,859元。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司110年3月26日董事會通過109年度盈餘分派案及實際配發情形：

- (1) 實際配發員工酬勞新台幣54,909,000元及董事酬勞金額新台幣109,000,000元。
- (2) 上述擬配發金額與原已估列之員工酬勞54,909,211元及董事酬勞109,818,423元，差異數共計818,634元。

差異原因：會計估計調整。

處理情形：差異金額已於董事會通過時以會計估計變動認列。

(九) 公司買回本公司股份情形(已執行完畢)：

111年2月28日

買回期次	第 1 次(期)
買回目的	維護公司信用及股東權益
買回期間(實際)	110年11月09日至110年12月30日
買回區間價格(實際)	100.50~107.50元
已買回股份種類及數量	普通股 55,000,000股
已買回股份金額	NT\$ 5,734,863,012元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100 %
已辦理銷除及轉讓之股份數量	55,000,000股
累積持有本公司股份數量	0股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%

二、公司債辦理情形：

公司債發行情形

111年截至年報刊印日止

公司債種類		一〇八年度第1期無擔保普通公司債	一〇八年度第2期無擔保國際普通公司債
發行日期		民國108年4月26日	民國108年10月3日
面額		新台幣100萬元	美金100萬元
發行及交易地點		中華民國櫃檯買賣中心	中華民國櫃檯買賣中心
發行價格		依票面金額十足發行	依票面金額十足發行
總額		新台幣100億元 (甲類65億元，乙類35億元)	美金3億元 (甲類2億元，乙類1億元)
利率		甲類：固定年利率0.90% 乙類：固定年利率1.03%	甲類：固定年利率2.15% 乙類：固定年利率2.50%
期限		甲類5年，到期日：113年4月26日 乙類7年，到期日：115年4月26日	甲類3年，到期日：111年10月3日 乙類5年，到期日：113年10月3日
保證機構		無	無
受託人		台北富邦商業銀行股份有限公司信託部	台北富邦商業銀行股份有限公司
承銷機構		台新綜合證券股份有限公司	富邦綜合證券股份有限公司
簽證律師		一誠聯合法律事務所	一誠聯合法律事務所
簽證會計師		勤業眾信聯合會計師事務所	勤業眾信聯合會計師事務所
償還方法		甲乙類均為到期一次還本	甲乙類均為到期一次還本
未償還本金		新台幣100億元	美元3億元
贖回或提前清償之條款		無	無
限制條款		僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人	僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 評等日期：107年9月11日 評等等級：A+(twn)	澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 評等日期：108年9月4日 評等等級：A+(twn)
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	無
交換標的委託保管機構名稱		無	無

111年截至年報刊印日止

公司債種類		一〇九年度第1期無擔保普通公司債	一〇九年度第2期無擔保普通公司債
發行日期		民國109年4月22日	民國109年8月13日
面額		新台幣100萬元	新台幣100萬元
發行及交易地點		中華民國櫃檯買賣中心	中華民國櫃檯買賣中心
發行價格		依票面金額十足發行	依票面金額十足發行
總額		新台幣100億元	新台幣100億元 (甲類30億元，乙類50億元，丙類20億元)
利率		固定年利率0.90%	甲類：固定年利率0.72% 乙類：固定年利率0.85% 丙類：固定年利率0.95%
期限		到期日：114年4月22日	甲類3年，到期日：112年8月13日 乙類5年，到期日：114年8月13日 丙類7年，到期日：116年8月13日
保證機構		無	無
受託人		台北富邦商業銀行股份有限公司	台北富邦商業銀行股份有限公司
承銷機構		元大證券股份有限公司	元大證券股份有限公司
簽證律師		一誠聯合法律事務所	一誠聯合法律事務所
簽證會計師		勤業眾信聯合會計師事務所	勤業眾信聯合會計師事務所
償還方法		為到期一次還本	甲乙丙類均為到期一次還本
未償還本金		新台幣100億元	新台幣100億元
贖回或提前清償之條款		無	無
限制條款		僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人	僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 評等日期：109年3月10日 評等等級：A+(twn)	澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 評等日期：109年3月10日 評等等級：A+(twn)

公司債種類		一〇九年度第1期無擔保普通公司債	一〇九年度第2期無擔保普通公司債
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	無
交換標的委託保管機構名稱		無	無

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：

111年截至年報刊印日止 單位：美金元

原日月光公司發行(辦理)日期		89 年 9 月	92 年 6 月
項目			
發行(辦理)日期		民國89年9月	民國92年6月
發行及交易地點		美國紐約證券交易所	美國紐約證券交易所
發行總金額		美金140,000仟元	美金86,808仟元
單位發行價格		每單位美金7元	每單位美金2.65元
發行單位總數(註)		20,000,000單位，每單位表彰日月光公司普通股5股	32,757,600單位，每單位表彰日月光公司普通股5股
表彰有價證券之來源		日月光公司現金增資發行之普通股	日月光公司股東所持有本公司已發行之普通股
表彰有價證券之數額		日月光公司普通股100,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整	日月光公司普通股163,788,000股，每股面額新台幣壹拾元整
存託憑證持有人之權利與義務		享有與本公司普通股股東相同之權利義務	
受託人		無	
存託機構		花旗銀行	
保管機構		花旗銀行台北分行	
未兌回餘額		迄年報刊印日止，海外存託憑證流通在外餘額為157,164,186單位，表彰本公司普通股314,328,372股。	
發行及存續期間相關費用之分攤方式		無	
存託契約及保管契約之重要約定事項		無	
每單位市價	110年度	最高	9.62
		最低	5.92
		平均	7.68
	111年截至年報刊印日止	最高	8.15
		最低	6.53
		平均	7.16

註：每1單位表彰5股日月光公司普通股之日月光公司美國存託憑證，現將換發為1.25單位日月光投控美國存託憑證；每1單位表彰2股日月光投控普通股之日月光投控美國存託憑證。

五、員工認股權憑證辦理情形(含限制員工權利新股辦理情形)：

(一) 員工認股權憑證辦理情形：

本公司為吸引並留任公司所需之專業人才，激勵員工及提昇員工向心力，業經主管機關於一〇七年八月核准發行第一次員工認股權憑證150,000,000單位，每單位得認購本公司普通股一股，並以發行日當日之普通股股票收盤價為認股價格。

依共同轉換股份協議第十二條之12.3，日月光公司業經主管機關於九十九年四月及一〇四年四月核准所發行之認股權憑證，於股份轉換基準日起，由本公司承受日月光公司之履行義務，將依換股比例調整執行價格及數量，並依第二條之2.1.4所載，本公司已發行尚未被執行之員工認股權憑證列示如下：

1. 尚未屆期之員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

111年截至年報刊印日止

員工認股權憑證種類	承受原日月光公司 第五次員工認股權憑證(註1)	日月光投控(本公司) 第一次員工認股權憑證	
		第一次發行	第二次發行
申報生效日期	104/04/17	107/08/23	
發行(辦理)日期	104/09/10	107/09/27	107/11/23
董事會決定發行單位數	36,535,000單位	150,000,000單位	
發行得認購股數佔發行時已發行股份總數比率	0.85%	0.01%	3.05%
認股存續期間	本認股權憑證之存續期間為十年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同棄權，認股權人不得再行主張其認股權利。		
履約方式	由本公司發行普通股新股交付。		
限制認股期間及比率(%)	認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程及比例行使認股。		
	認股權憑證授予期間	累積最高可行使認股比例	
	屆滿2年	40%	
	屆滿2.5年	50%	
	屆滿3年	60%	
	屆滿3.5年	70%	
	屆滿4年	80%	
	屆滿4.5年	90%	
	屆滿5年	100%	
已執行取得股數	21,661,500股	0股	33,805,100股
已執行認股金額	1,581,289,500元	0元	1,779,537,440元
未執行認股數量	14,873,500股	620,000股	98,057,400股
未執行認股者其每股認購價格(目前執行價格)	新台幣73.0元	新台幣66.9元	新台幣51.0元
未執行認股數量佔年報刊印日已發行股份總數比率(%)	0.34%	0.01%	2.22%
已失效認股數量	0股	620,000股(註2)	0股
對股東權益影響	本認股權憑證於發行日屆滿二年後，分三年執行，對原股東權益逐年稀釋，其稀釋效果尚屬有限。		

註1：每單位認股權憑證得認購本公司普通股1股，依共同轉換股份協議規定本公司將承受日月光公司已發行之員工認股權憑證，每單位得認購之股數及價格將依換股比例(日月光公司：本公司=1：0.5)調整之。

註2：共111位員工已於107年離職或退休，股數亦全數已收回。

2. 取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

111年02月28日

	職稱	姓名	發行日	取得 認股數量	取得認 股數量 佔已發 行股份 總數比 率	已執行				未執行			
						認股數量	認股價格	認股金額	認股數量 佔已發行 股份總數 比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量 佔已發行 股份總數 比率
經 理 人	董事長兼資源 整合暨決策委 員會主任委員	張虔生	100.04.15 104.09.10 107.11.23	12,750,000	0.29%	250,000	49.44	12,360,000	0.01%	12,500,000	51.18	639,700,000	0.29%
	總經理	張洪本											
	集團營運長	吳田玉											
	集團財務長	董宏思											
	集團幕僚長	潘士華											
	集團行政長	汪渡村											
	資深副總經理	李柏練											
	資深副總經理 暨集團會計長	郭宏銘											
	資深副總經理	張淑琴											
	副總經理	沈貝俐											
	副總經理	張聲華											
	副總經理	項世傑											
取 得 認 股 權 憑 證 可 認 股 數 前 十 大 員 工	蔡祺文	100.04.15 104.09.10 107.11.23	9,750,000	0.22%	3,390,000	52.72	178,708,500	0.08%	6,360,000	51.00	324,360,000	0.15%	
	張衍鈞												
	羅曉餘												
	羅瑞榮												
	陳天賜												
	陳昌益												
	簡坤義												
	李俊哲												
	張欣晴												
曹燕傑													

(二) 限制員工權利新股辦理情形：

本公司為吸引及留任所需專業人才與達成公司中、長期目標，期激勵同仁全力以赴共同達成公司營運目標，爰擬依據公司法第267條及主管機關金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行民國一一〇年度限制員工權利新股；業經主管機關於一一〇年十月核准發行第一次限制員工權利新股15,000,000股，無償發行配發予員工，本公司已發行尚未被執行之限制員工權利新股列示如下：

1. 尚未屆期之限制員工權利新股截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

111年2月28日

限制員工權利新股種類	第1次(期)限制員工權利新股		
申報生效日期	110年9月7日		
發行日期	110年10月1日		
已發行限制員工權利新股股數	普通股15,000,000股		
發行價格	無償發行配發予員工		
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.34%		
限制員工權利新股之既得條件	(1) 員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反本公司勞動契約、工作規則、競業禁止與保密協議或與本公司間合約約定等情事，並達成公司所設定「個人績效評核指標」與「公司營運目標」者，於發行日後三個年度內，各年度既得日可既得之最高股份總數為獲配股份總數之三分之一(下稱「既得股份上限」)。 可既得之實際股份總數須再依個人績效與公司營運目標達成度所設定之既得比例計算，並由本公司與個別員工約定之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。 (2) 個人績效評核指標為既得期間屆滿之最近一年度績效考核等第至少為B(含)以上、工作成果達成本公司所設定之個人績效標準，並由本公司與個別員工約定之。 公司營運目標以繼續營業單位之半導體封裝及測試業務(包含基板(材料)業務；下統稱「封測業務」)之合併營收、合併毛利及毛利率、合併營業利益及營業利益率(下合稱「業績指標」)，以及本公司環境、社會及公司治理成果(下稱「ESG成果指標」)為四項指標。業績指標部分再分別設定A、B兩項目標條件(詳下表)，達成其一目標條件即視為達成該項指標。前述三項業績指標達成任一項者，該年度可既得股份總數為既得股份上限之50%；三項業績指標達成任二項者，該年度可既得股份總數為既得股份上限之70%；三項業績指標全數達成者，該年度可既得股份總數為既得股份上限之90%；業績指標達成且 ESG成果指標亦同時達成者，前述該年度可既得股份總數分別調整為既得股份上限之60%、80%及100%。 達成業績指標與水準之判定，原則上應以既得期間屆滿之最近一年度，經會計師核閱之本公司封測業務下相關子公司聯合財務報表為基礎；但於既得期間內，如本公司或子公司因合併、收購或買實而取得或處分其他應併入或已併入本公司合併財務報表之營業單位、部門或子公司股權者(下合稱「變動營業單位」)，該等變動營業單位之營收、毛利、營業利益、溫室氣體排放密集度及取水密集度，不列入前述各項營運指標之計算。 達成ESG成果指標與水準之判定，原則上應以既得期間屆滿之最近一年度，本公司封測業務下相關子公司聯合經第三方公正機構查證之報告書為基礎。		
	營運指標	目標條件A	目標條件B
	合併營收	高於本公司封測業務前一年合併營收且成長率高於邏輯性半導體產業之成長率。邏輯性半導體產業之成長率以國際研究及顧問機構Gartner所出具之報告為準。	高於本公司封測業務前三年合併營收平均值且成長率高於邏輯性半導體產業之成長率。邏輯性半導體產業之成長率以國際研究及顧問機構Gartner所出具之報告為準。
	合併毛利及毛利率	本公司封測業務合併毛利總額高於封測業務前一年合併毛利總額或高於封測業務前三年合併毛利總額之平均值。	本公司封測業務合併毛利率高於前一年封測業務合併毛利率或高於封測業務前三年合併毛利率之平均值。
	合併營業利益及營業利益率	本公司封測業務合併營業利益總額高於封測業務前一年合併營業利益總額或高於封測業務前三年營業利益總額之平均值。	本公司封測業務合併營業利益率高於封測業務前一年合併營業利益率或高於封測業務前三年合併營業利益率之平均值。
	ESG成果指標	(a)溫室氣體排放密集度(溫室氣體排放量/營收)： 2021年：減少6%以上(以2015年為基準) 2022年：減少7%以上(以2015年為基準) 2023年：減少8%以上(以2015年為基準) (b)取水密集度(總取水量/營收)： 2021年：減少6%以上(以2015年為基準) 2022年：減少7%以上(以2015年為基準) 2023年：減少8%以上(以2015年為基準)	

限制員工權利新股種類	第1次(期)限制員工權利新股
限制員工權利新股之受限制權利	(1) 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 (2) 員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等權利，與本公司已發行之普通股相同，且依信託保管契約執行之。 (3) 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。 (4) 本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第165條第3項所訂股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約或相關法規規定執行之。
限制員工權利新股之保管情形	限制員工權利新股發行後，須立即交付信託保管。且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	既得期間內員工除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
已收回或收買限制員工權利新股股數	0股
已解除限制權利新股之股數	0股
未解除限制權利新股之股數	15,000,000股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0.34%
對股東權益影響	以目前本公司已發行股數計算，暫估民國110年~113年每股盈餘最大可能減少金額為新台幣 0.08元、0.20元、0.09元及0.03元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

2. 取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大員工姓名及取得情形。

111年02月28日

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人	董事長兼資源整合暨決策委員會主任委員	張虔生	4,080,000	0.09%	—	—	—	0.00%	4,080,000	—	—	0.09%
	總經理	張洪本										
	集團營運長	吳田玉										
	集團財務長	董宏思										
	集團幕僚長	潘士華										
	集團行政長	汪渡村										
	資深副總經理	李柏練										
	資深副總經理暨集團會計長	郭宏銘										
	資深副總經理	張淑琴										
	副總經理	沈貝俐										
取得限制員工權利新股前十大員工	副總經理	張聲華	6,240,000	0.14%	—	—	—	0.00%	6,240,000	—	—	0.14%
	副總經理	項世傑										
		羅瑞榮										
		蔡祺文										
		陳天賜										
		陳昌益										
		張衍鈞										
		李俊哲										
		簡坤義										
		張能傑										
		張能超										
		周光春										
		洪松井										
		唐瑞文										

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

(一) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股：無。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

七、資金運用計畫執行情形：

截至年報刊印日止已募集完成但尚未執行完畢之計畫：無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 本公司(日月光投控)暨旗下子公司(以下合稱「本集團」)所營業務範圍以各子公司負責業務範疇不同，主要區分為以下四大類：

(1) 投資業：

一般投資業務項目。

(2) 封測業：IC服務

封裝：封裝及模組設計、IC封裝、多晶片封裝、微型及混合型模組、記憶體封裝。

測試：前段測試、晶圓針測、成品測試。

材料：基板設計、製造。

(3) 電子製造服務業：

所營業務主要係為國內外的品牌廠商提供通訊類、消費電子類、電腦類、存儲類、工業類、汽車電子類及其他類電子產品的開發設計、物料採購、生產製造、物流、維修及其他售後服務等一系列專業服務。

(4) 其他：

房地產開發、建設、房屋銷售物業管理及商場出租業務。

2. 本集團目前產品項目及其營業比重：

單位：新台幣仟元

主要產品項目	——○年度	
	營收金額	營業比重
封裝服務	272,543,899	47.81%
測試服務	49,978,736	8.77%
電子產品構裝技術暨製造服務	239,488,267	42.02%
其他	7,986,231	1.40%
總計	569,997,133	100.00%

(二) 產業概況

1. 投資業：

本公司以投資控股方式統整集團內部之經營策略及營運目標，期能藉由投資控股之型態，經由各事業群獨立發展，將集團資源做最有效之運用，以提升整體營運績效及市場競爭力。

2. 封測業：

(1) 產業之現況與發展

新冠肺炎(COVID-19)病毒不停變種造成疫情反覆延燒，且中美貿易摩擦仍在，迫使全球航運與供應鏈中斷時間較預期還要長。而且在疫情前，終端廠商為了降低備貨成本壓力，實施低庫存水位，加上疫情所帶動的科技宅經濟應用大爆發，對半導體產能的需求量飆升，皆使疫情爆發後，半導體上游晶片與後段封裝所需的載板陸續出現缺貨潮。在供不應求的狀況下，也讓消費者物價迅速攀升，在供不應求的情勢下，全球大鬧晶片荒。各國皆因經濟前景風險增加，而使政策權衡變得更為複雜，紛紛將半導體產能視為重要戰略物資，在地製造成為迫切目標。

儘管疫情未見停歇，全球經濟仍在不斷變種的病毒威脅下持續復甦，但受到疫情反覆爆發所拖累，加上累積的通貨膨脹壓力爆發，以及貨物塞港持續惡化導致運輸費用飆上新高價、晶片及載板缺料、交期延長等諸多因素影響，造成供應鏈無法順暢運行而中斷數次，整體半導體供需市況依舊混沌不明，連帶影響成長動能。

由國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, IMF)於2021年10月在《世界經濟展望報告》中，預測全球2021年經濟成長率為5.9%，較2021年7月預測數字6.0%稍微下修0.1個百分點，而2022年可達到4.9%，和2021年7月預測數字4.9%一致。

除了供應鏈瓶頸和晶片短缺的影響之外，智慧手機產業如今還面臨其他製造和物流挑戰。更嚴格的檢疫政策導致運輸延遲，中國電力供應限制衝擊關鍵零件製造。由於市場需求強勁，預計供應面問題可能要等到2022年才會有所緩解。

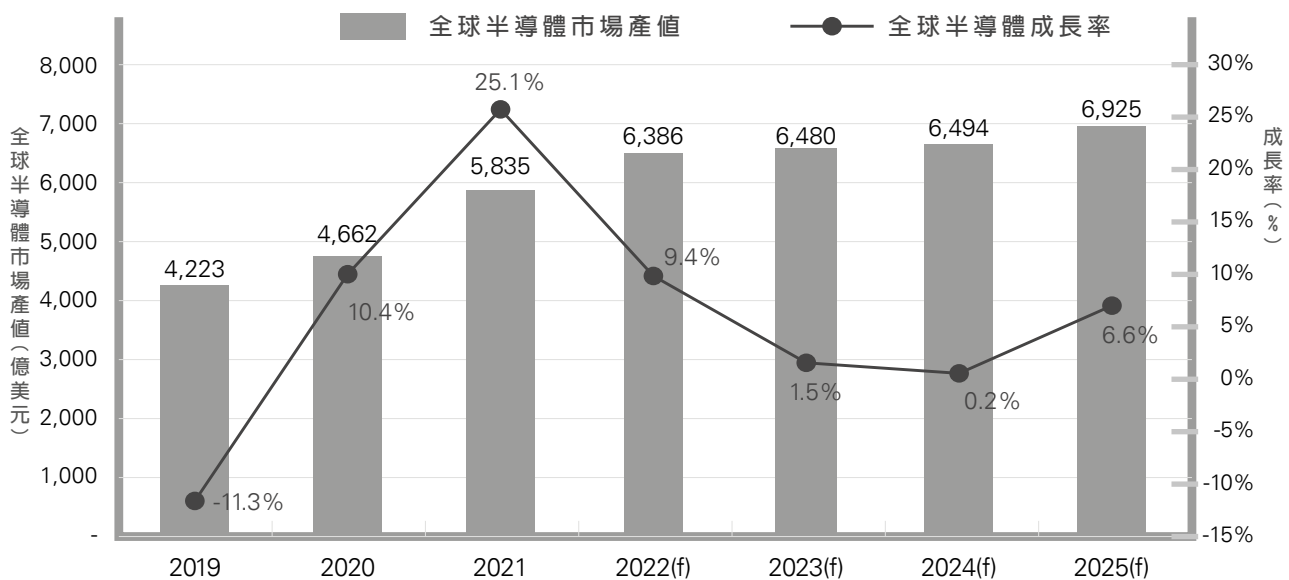
在全球COVID-19疫苗普遍施打之際，全球經濟逐漸恢復至正常水準，全球經濟在2021年持續感受到宅經濟帶來的市場商機，帶動電腦類產品呈現非預期的高度正成長態勢，宅經濟所帶動的電腦類與智慧型手機之市場需求，正將逐漸緩慢降溫並恢復到以往正常成長動能水準。

受惠宅經濟驅動的電腦與網通手機等需求持續強勁、世界各國5G快速發展、車用市場復甦等因素下，Gartner¹ 估計全球半導體市場2021年總銷售值達5,835億美元，較去年成長25.1%，這也反映出2020年全球爆發COVID-19疫情以來，對全球半導體產業供應鏈造成的衝擊，以及隨之而來的需求大爆發，和晶圓製造及封測產業積極擴張新產能，因應需求遽增的全球晶片供不應求市況。相較2019年的全球IC產業才剛經歷年衰退達11.3%急遽下降市況景象，到2020年便拉升至10.4%的年增幅度，2021年的年成長率更大幅成長至25.1%，凸顯全球IC產業仍相當具彈性的現象。

自從新冠肺炎自2020年在全球各地爆發疫情之後，已逐漸改變消費者行為，渴望更智慧的生活與工作，例如在家工作(Work from Home)、遠端教育、網路購物趨勢，從而帶動消費者科技使用力不斷升級。疫情大幅改變全球的日常生活運作方式，企業、個人、教育工作者及政府機關等，都逐漸轉向數位化運作方式，成為帶動近期全球IC銷售強勁成長的動能。在需求強勁且加上廣泛的供應鏈中斷所導致的產品平均價格攀升的趨勢下，都帶動2021年全球IC市場營收年增率達到25.1%成長率之譜。

據2021年11月WSTS統計，半導體整體市場成長25.6%。據2022年1月Prismark統計，成長更可達27%。

全球半導體市場預測

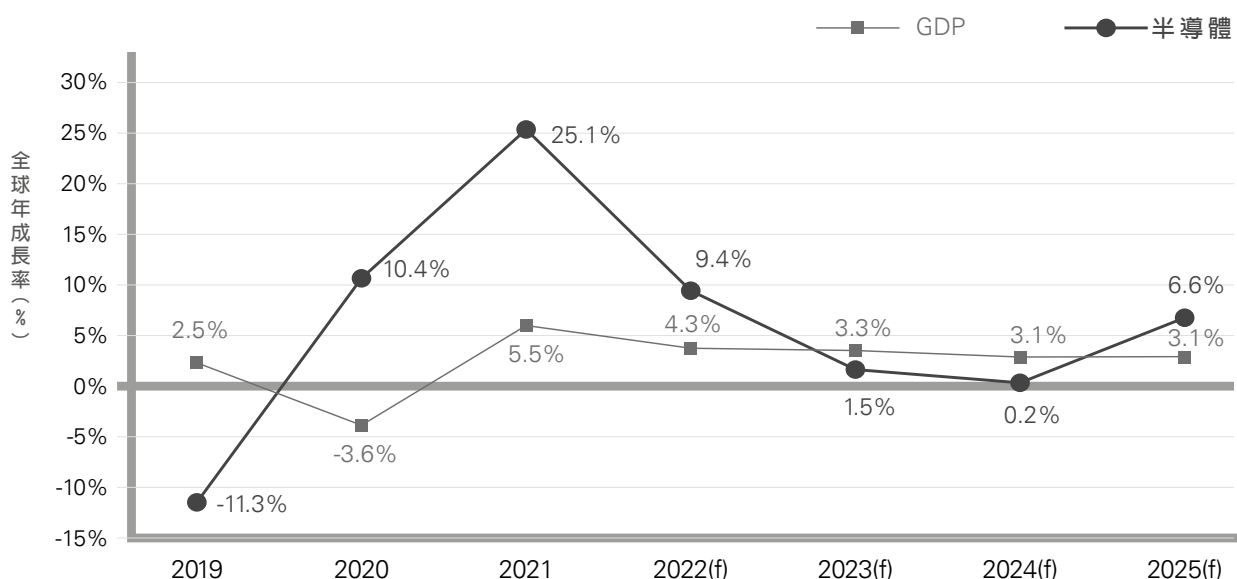


資料來源：Chart created by ASE Technology Holding Co., Ltd. based on Gartner Research: Gartner "Semiconductor Forecast Database, Worldwide, 4Q21 Update", By Ben Lee, Nolan Reilly, Andrew Norwood, Jon Erensen, Joseph Unsworth, Masatsune Yamaji, Tim Mahon, Roger Sheng, Anushree Verma, Bill Ray, Alan Priestley, Juhí Gupta, Kanishka Chauhan, Rajeev K Rajput, Nikita Singh, Stacey Yin December 2021. Calculations performed by ASE Technology Holding Co., Ltd.

The Gartner content described herein, (the "Gartner Content") represent(s) research opinion or viewpoints published, as part of a syndicated subscription service, by Gartner, Inc. ("Gartner"), and are not representations of fact. Gartner Content speaks as of its original publication date (and not as of the date of this annual report) and the opinions expressed in the Gartner Content are subject to change without notice.

¹ Source: Gartner "Semiconductor Forecast Database, Worldwide, 4Q21 Update", By Ben Lee, Nolan Reilly, Andrew Norwood, Jon Erensen, Joseph Unsworth, Masatsune Yamaji, Tim Mahon, Roger Sheng, Anushree Verma, Bill Ray, Alan Priestley, Juhí Gupta, Kanishka Chauhan, Rajeev K Rajput, Nikita Singh, Stacey Yin December 2021. The Gartner content described herein, (the "Gartner Content") represent(s) research opinion or viewpoints published, as part of a syndicated subscription service, by Gartner, Inc. ("Gartner"), and are not representations of fact. Gartner Content speaks as of its original publication date (and not as of the date of this annual report) and the opinions expressed in the Gartner Content are subject to change without notice.

全球GDP、半導體成長率



資料來源：Chart created by ASE Technology Holding Co., Ltd. based on Gartner Research: "Forecast: Semiconductor Capital Spending, Wafer Fab Equipment and Capacity, Worldwide, 4Q21 Update", By Bob Johnson, Gaurav Gupta and Samuel Wang, December 2021. Calculations performed by ASE Technology Holding Co., Ltd.

The Gartner content described herein, (the "Gartner Content") represent(s) research opinion or viewpoints published, as part of a syndicated subscription service, by Gartner, Inc. ("Gartner"), and are not representations of fact. Gartner Content speaks as of its original publication date (and not as of the date of this annual report) and the opinions expressed in the Gartner Content are subject to change without notice.

台灣半導體產業景氣之動向：受疫情影響，台灣經濟在2021年呈現內、外有別的局面，在內需部分，於2021年五月下旬疫情在台蔓延擴散，政府採取嚴格防疫措施，衝擊內需服務業的表現。不過在外貿出口方面，則受惠於疫情帶動5G、IoT與電動車等需求，且世界主要經濟體皆陸續重啟經濟活動，美、中、歐等地的經濟相繼復甦，甚至進入擴張態勢，帶動商品需求並進而推升台灣出口表現。主計總處預測2021年台灣全年經濟成長6.09%，在民間投資力道強勁，隨著全球景氣復甦，台灣主要半導體領導廠商持續推動資本支出計畫，供應鏈深化在地投資的群聚效應也逐漸顯現，成為拉抬台灣2021全年經濟成長率突破6%的關鍵所在。

因疫情的影響，再加上從美中貿易戰延伸的科技戰短期難解，且地緣政治詭譎多變的情勢下，市場對新興科技領域，讓半導體的中長期結構性的需求不減反增，連帶引起全球產業生態鏈的重新排列組合，諸多情勢皆讓台灣半導體面臨的經營環境呈現利多、利空因素交雜的態勢。

量能的部分，以疫情所反映的現象最為明顯，半導體在健康照護需求的醫療及數位生活轉型上產生新價值且需求量大增。質變的部分，則是由區域政治、系統複雜化、綠色製造、人力資源等因素所左右。

關於綠色製造議題，全球為因應氣候暖化與極端氣候的威脅，各國大廠將「淨零碳排(Net Zero Carbon Emissions)」視為綠色復甦趨勢的共同目標，將形成新生態鏈、新商業模式和新布局的機會。能源轉型不只是環保、永續的議題，更是攸關產業競爭力的生存戰。而綠色永續經營也成為CES 2022展會重點，包括在製造上選擇低環境衝擊的設計、技術、材料等，在產品設計環節，採用再生能源(例如太陽能遙控器Solar Cell Remote，將待機功率降低至近零，減少能源浪費)。

雖然企業淨零碳排轉型不易，但面對氣候議題，每個人都無法置身事外。台灣已立下「2050年淨零排放」達標計畫，淨零碳排並不是增加企業成本，而是永續性的投資，若今天不行動，未來一定會在低碳轉型的浪潮下，被遠遠地拋在後頭。在綠色經濟的道路上，企業不只共好還要共生，落實零碳行動力，並透過創新攜手邁向零碳，將永續力化為競爭力，就能抓住淨零商機。

在瞬息萬變新世界局勢下。台灣半導體產業發展至今，已成為全球高科技創新研發的重要夥伴與後盾。台灣IC產業上下游產業鏈完整，從上游IC設計到下游IC製造與IC封測，專業分工模式獨步全球，總IC產值全球排名第二，僅次於美國，超越韓國。

2021年台灣IC產業產值(含設計、製造、封測)達新台幣40,820億元，較去年成長26.7%，其中IC設計業產業產值達新台幣12,147億元，較去年成長42.4%；IC製造業產業產值達新台幣22,289億元，較去年成長22.4%，其中晶圓代工業為19,410億元，較去年成長19.1%；記憶體製造業為2,879億元，較去年成長51.0%。IC封測產業產值為新台幣6,384億元，較去年成長16.3%，其中IC封裝業產業產值達新台幣4,354億元，較去年成長15.3%，而IC測試產業產值為新台幣2,030億元，較去年成長18.4%。

下表係2021年台灣IC設計、製造、封測業，表列如下：

2022年台灣半導體產業產值預估

單位：新台幣億元

	2018	2019	2020	2021	2021成長率	2022(e)
台灣IC產業產值	26,199	26,656	32,222	40,820	26.7%	48,062
台灣IC設計業	6,413	6,928	8,529	12,147	42.4%	13,848
台灣IC製造業	14,856	14,721	18,203	22,289	22.4%	27,264
晶圓代工	12,851	13,125	16,297	19,410	19.1%	24,076
記憶體製造	2,005	1,596	1,906	2,879	51.0%	3,188
台灣IC封測業	4,930	5,007	5,490	6,384	16.3%	6,950
IC封裝業	3,445	3,463	3,775	4,354	15.3%	4,750
IC測試業	1,485	1,544	1,715	2,030	18.4%	2,200

資料來源：工研院產科國際所、本公司整理 (2022/3)

台灣IC產業產值調升變動因素，在於5G智慧手機滲透率加速、高效能運算(High Performance Computing, HPC)相關應用增加、智慧家庭、Wi-Fi 6/6E、真無線藍芽耳機(TWS)及顯示驅動IC等應用蓬勃發展，及高效能運算與車用產品需求有明顯成長，成長動能強勁。

另外，遠距工作教學拉升面板驅動IC需求，手機、車用ADAS對於影像感測器需求大增，再加上物聯網、車電、醫療用MCU需求也逐步攀升。台灣IC封測業在全球疫情反覆，而持續帶動居家辦公及遠距教學模式需求帶動下，從雲端到終端電子產品需求暢旺，加上5G高頻通訊換機潮，對高階系統級封裝需求強勁的帶動下，台灣封測業2021年產值為新台幣6,384億元，較2020全年正成長16.3%。

車輛電子化程度越來越高，也使得電子元件溝通更為複雜。為加速電子運算與控制的能力，車輛將會加裝HPC晶片，以強化電子化程度與數據處理能力更為強大，帶動市場對於HPC的需求越來越高。

(2) 產業上、中、下游之關聯性

2021年應用端加速創新引發晶片需求擴大，引爆半導體供應鏈重分配議題，既有IT應用產品規格對半導體先進製程需求增加，但市場受限於缺料、交期延長，加上物流問題，為整體供應帶來重大挑戰。整體而言，創新應用加上疫情肆虐，更加劇半導體供應分配的議題。有鑑於此在2021年9月，美國總統拜登與澳大利亞總理莫里森、印度總理莫迪和日本總理菅義偉，在白宮參加首次「四方安全對話」(Quadilateral Security Dialogue, QUAD)領導人面對面峰會。QUAD峰會的半導體議題聚焦在確保半導體供應鏈，其共識為：彈性、多樣化和安全的硬體、軟體和服務技術供應鏈的共同利益至關重要。而非法轉讓或竊取技術是共同挑戰，這些行為破壞全球技術發展的基礎，技術不應該被專制體制誤用或濫用於監視、壓迫等活動。

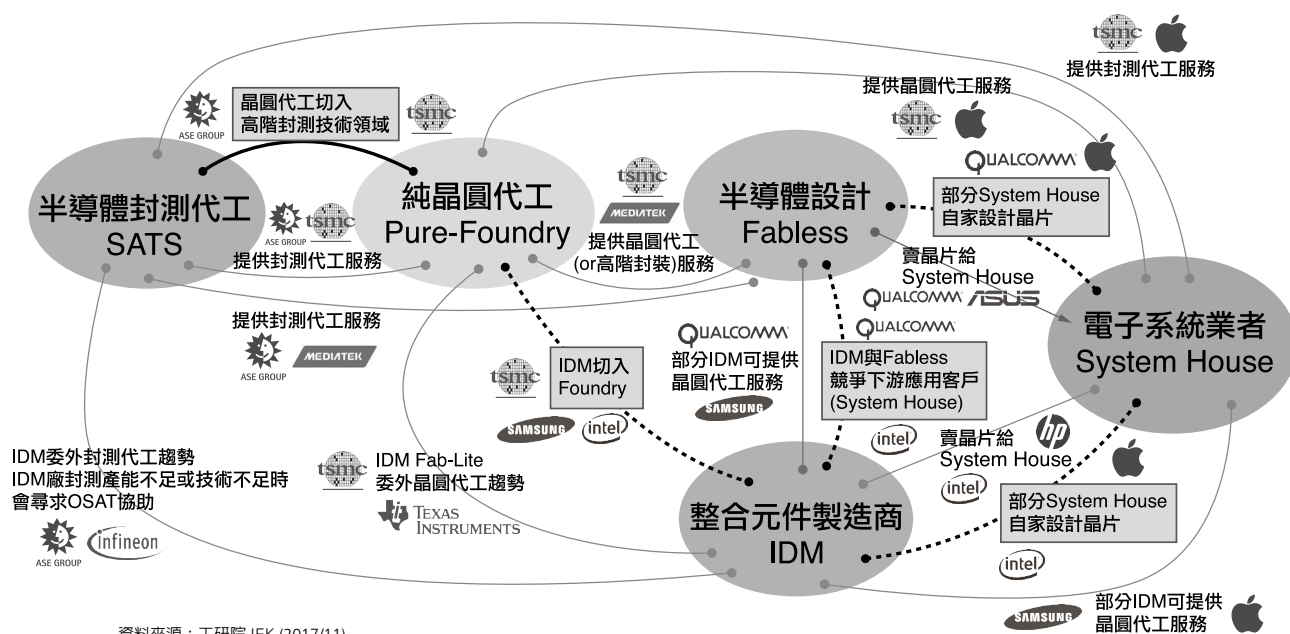
在各國政策變動方面，世界局勢風雲變幻，美國透過與印太盟友的合縱連橫及相關政策，持續壓制中國在半導體先進製程技術的演進。因半導體供應分配議題延燒，主要國家從全球化分工轉向保護主義，開始嘗試建構自有半導體生產據點。

5G智慧手機與相關通訊設備所需的半導體種類與數量大幅成長，對先進與成熟製程半導體需求同步暴增。QUAD峰會共識認為未來5G通訊基礎設施，必須確保「安全、開放和透明的網路」，因此QUAD成員將使用開放型無線通訊網路「Open LAN」的技術促進標準化，來抑制中國在5G市場的佔有率，明確的將中國視為競爭對手，需要QUAD成員合作對抗。

台灣半導體產業的關鍵成功在於以科學園區為核心驅動角色，進而形成完整上中下游科技廊帶群聚。在後疫情時代，仍應善用其半導體產業群聚優勢，聚焦下世代創新產品與應用服務，帶動半導體產業多元發展。

綜觀全局，全球半導體產業呈現競合的產業關係，各種應用場景百花齊放的新世代，封測產業量、質皆已轉變，先進製程節點及先進封裝技術，在成長性與趨勢性上具有潛在可觀效益，具有持續投入研發之必要性。

半導體次產業間之競合示意圖



半導體產業不論是出口產值、附加價值、就業人數、產業關聯效益，都是台灣重要的經濟命脈，更是國家重要戰略產業，政府在推動5+2產業創新計畫－「智慧機械」、「亞洲．矽谷」、「綠能科技」、「生技醫藥」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」的產業創新基礎上，打造六大核心戰略產業－「資訊及數位」、「資安卓越」、「台灣精準健康」、「綠電及再生能源」、「國防及戰略」、「民生及戰備」等六大產業，即強化資訊與數位產業，利用半導體和資通訊產業優勢，搶佔供應鏈核心地位，透過產業超前部署，讓台灣在後疫情時代，掌握全球供應鏈重組先機。

六大核心戰略係以5+2產業創新為基礎，皆與半導體發展關係密切



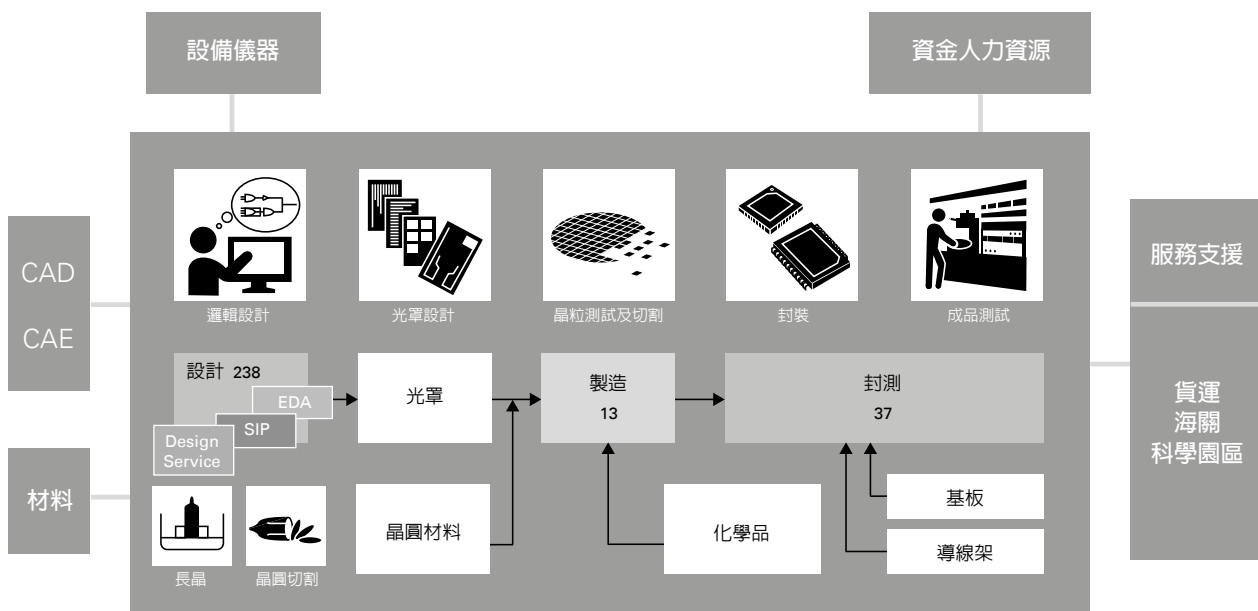


資料來源：國家發展委員會 (2021/5)

根據工研院產科國際所對台灣半導體產業結構家數之統計顯示，台灣IC設計業者有238家、13家晶圓製造公司、37家封裝測試公司，光罩公司、基板廠商、導線架廠商、晶圓材料廠商以及各種不同應用的系統組裝業，使得上、中、下游的產業鏈關係密不可分，進而提升客戶產品上市的即時性，成本競爭力，使台灣半導體產業居領導角色。

而在半導體產業供應鏈中，本集團之封測業務主要負責中游之封裝測試和下游之封裝材料供應。本集團提供客戶晶片封裝及測試之半導體製造服務，主要晶圓大都為國際知名半導體公司所提供，長期與本公司保持良好的業務關係。本集團並透過策略聯盟與合作夥伴藉由垂直及水平分工，進而提昇彼此的競爭實力。

我國半導體產業結構圖



資料來源：工研院產科國際所 (2021/5)

註：圖中數字代表台灣主要廠商家數

CAD：Computer Aided Design CAE：Computer Aided Engineering

(3) 產品之發展趨勢

隨著智慧時代的來臨，衍生出許多新興科技領域，包括5G、6G、AI、IoT、高效能運算、智慧家庭、智慧汽車、工業4.0、智慧城市、生技醫療、低軌衛星、元宇宙等都將成為未來半導體業需求主要的驅動力之熱門領域。為了驅使新興科技終端領域的發展，更先進的無線通訊技術(如6G、Wi-Fi 6)需求高漲，連帶讓各類電子產品銷售量提升，電子終端產品朝向更加智慧化也更強調服務與使用者體驗。

為滿足市場需求，半導體產業中IC設計、IC製造、IC封測產業持續推進新設計與新技術，以高效能IC設計晶片；最高階IC製程技術；再結合異質整合封裝技術，實現更智慧化的電子產品問世，帶動先進封裝技術同步提升，半導體製程持續微縮，對封裝技術要求也愈高，具備高度晶片整合能力的異質整合(Heterogeneous Integration)封裝技術，被視為後摩爾時代下延續半導體產業發展的動能。為了迎接異質整合時代來臨，SEMICON Taiwan 2021展會聚焦高效能運算技術與應用，串聯IC設計、製造、封裝與終端系統應用呈現小晶片技術(Chiplet)、3D堆疊技術發展趨勢。

以HPC和聯網終端產品為例，為提升訓練(Training)與推論(Inference)效能，應用於資料中心(Data Center)、深度學習(Deep Learning)與挖礦(Mining)等需求中，除了本身須具備優異CPU、GPU、FPGA處理器晶片製造能力之外，如何運用封裝技術，將處理器晶片與記憶體之間進行更有效率的傳輸與溝通，會是最大挑戰。因此高階2.5D/3D IC與Chiplet封裝技術將是重點。

工廠製造體系加速導入智慧製造，快速、精準且彈性已是自動化系統整合與生產流程最佳化工廠所必備的特質。結合AI決策系統、邊緣及雲端運算計算以達到生產數據可視化、數位分身(Digital Twins)、虛擬工廠、設備節電管理、品質及缺陷預警分析及診斷維護等強化企業數位韌性已是大勢所趨。

隨著車輛電子化程度越來越高，也使得電子元件溝通更為複雜。為加速電子運算與控制的能力，車輛將會加裝高效能運算(High Performance Computing, HPC)晶片，以強化電子化程度與數據處理能力更為強大，帶動市場對HPC的需求越來越高。在車輛產業鏈中，國際Tier 1領導廠商將所有駕駛艙區域集中管理整個人機界面(Human Machine Interface, HMI)將視覺、聽覺和觸覺融合在一台功能強大的「駕駛艙HPC」，它可以最大限度地為駕駛員和乘客提供個性化服務，同時也為汽車製造商在整個車輛生命週期中降低成本和複雜度。

神經型態運算將打造更像生物大腦功能的晶片，期望在有廣泛的邊緣應用，包含機器手臂、神經型態皮膚和嗅覺感知，讓沒有感測器的晶片，藉由神經運算功能，達到觸覺與嗅覺的感知能力，從視覺、語音和手勢辨識和搜尋檢索、機器人和數學領域的受限最適化，以及在能源效率、運算速度和學習效率，提供更快速的計算力，更可擴展半體晶片的應用。

現今物聯網(Internet of Things, IoT)更結合感測器、軟體應用與其他技術互連，使更多物體及裝置能有傳輸與接收功能。也因資料量不斷日益增加，故對資料的傳輸速度的要求也越來越高，而這些必須仰賴強大的網路及雲端連線能力，才能夠順利傳輸與接收資訊。而物聯網應用範圍廣，包括工業製造、城市、交通、家居、醫療、零售、能源各種面向。車聯網(Internet of Vehicle, IoV)是物聯網在交通領域的應用，使車輛連接網路，運用感測器、無線通訊、數據處理器等裝置與技術，達到對車輛、道路、行人及交通號誌等靜、動態資訊進行偵測、判斷，以提供相關資訊給駕駛人，另也廣泛應用於交通服務、交通安全、智慧運輸等方面。物聯網應用情境當中，以車用電子成長性最高，每輛車都是一個物聯網裝置，車內所有裝置系統和資訊都要即時進行溝通，甚至未來將透過V2X技術與其他汽車或交通號誌，進行外部溝通，以便即時做分析與判斷。

當大量運算、傳輸、功耗等問題逐漸不再是AI技術進入生活應用的高牆，萬物聯網加入了AI人工智慧進入AIoT時代。自駕車和許多新興應用開始興起和逐漸普及。由於AI的進入，未來的智慧汽車將從架構開始變革為超大型電子產品，也可能會像智慧手機一樣，衍伸許多新興應用並成為強大的載具。汽車產業過去屬於較為封閉的領域不易進入，多為Tier 1的廠商才能帶來改變。在汽車業典範轉移的這個時代，台灣廠商可以積極尋找相關機會，以半導體及電子業的強項思考，跳脫過往汽車市場的窠臼，把握這個擁有巨大潛力的新世代智慧載具。

影像一直是AI崛起後的熱門議題，隨著AI應用邊緣化，影像AI晶片將扮演重要角色。在物聯網應用中，與影像相關的應用非常多，透過物聯網裝置所產生的影像資料也非常龐大，過去非結構化的大量影像資料無法在裝置端進行有效處理，現在影像相關的AI晶片則有很大的機會找出這些數據背後的潛在價值。需要處理大量資料的伺服器與資料中心終端應用，對HPC晶片的後市需求看漲，帶動AI訓練與推論使用場景逐漸擴張，2.5D/3D IC封裝架構與散熱機制再設計，能夠提升晶片運算效能。

大致上來說，目前先進封裝發展趨勢，主要焦點分為三大類型(一)HPC高速運算電腦的2.5D/3D IC封裝技術；(二)大面積同時進行後段封裝的FOPLP面板及封裝應用；(三)有效縮減分散式零組件封裝體積的SiP。

然而異質整合SiP在體積微縮及訊號傳輸上，難與同質整合SoC晶片相比，但考慮良率、成本與毛利後，目前多數手機晶片仍選擇SiP技術進行後段封裝。面對未來產品功能持續升級，雙面SiP封裝或將再次成為微縮解決方案。SiP技術可涵蓋傳統及先進封裝，例如Flip Chip、Wire Bond、Embedded、Bumping、FOWLP與被動元件等。由於SiP封裝可微縮體積的特性，驅使對終端產品體積與電池容量要求甚高的續航力穿戴裝置(Wearable Device)採用SiP封裝技術的需

求，因此除了智慧手機應用，無線藍牙耳機、智慧手錶等穿戴裝置，也是SiP的主要應用領域。

面對產品功能持續升級，但是體積持續微縮的趨勢下，原本的SiP封裝技術會因為零組件使用空間不足而遭遇瓶頸時，雙面SiP封裝(Double Side SiP)技術可再次微縮空間。雙面SiP封裝較單面SiP能縮減大於四成以上體積，有效降低開發成本，擁有較佳產品性能，縮短產品開發時程等諸多好處。然而，因元件放置距離較近而產生相互電磁干擾、元件蓄熱問題仍是挑戰所在。

SiP的應用除了手機及穿戴裝置之外，其異質整合(Heterogeneous Integration)微縮體積的技術特點，也可將應用領域跨足自駕車(V2X)、智慧城市(Smart City)、健康照護(Healthcare)、工業4.0(Industry 4.0)、智慧家庭(Smart Home)等領域，從擴大SiP封裝技術應用範圍來實現未來智慧生活願景。其中IoT模組成為支援上述場景的關鍵零組件，因為IoT模組本身只做資料收集與遠端通訊傳輸(如Bluetooth、NB-IoT、ZigBee協定)，與小型電池整合後，所需體積較其他主流半導體尺寸，已減少許多，又因為屬低功耗元件，可延長產品壽命年限。因為SiP的異質整合架構與高集中化特性，利用整體結構將射頻前端(RF Front End Module, RFFEM)、記憶體、GPS整合在同一封裝體，使IoT模組系統具備低功耗元件、嵌入式軟體與通訊傳輸等需求，進而滿足集中化、低成本、微型化與便利性，SiP將有助於延伸IoT模組的產品設計與應用場景。

展望未來，由工研院產業科技國際策略研究所歸納堪稱全球年度科技風向球之美國消費型電子展International Consumer Electronics Show, CES 2022總體觀察重點，包含AI人工智慧、數位永續、智慧移動以及半導體科技發展動向。展會歸納五項重點主軸，包括：一、永續創新與氣候友善科技崛起：科技大廠持續追求永續發展對抗氣候變遷挑戰，建立產品永續旅程。二、21世紀新物流帶動全新運輸科技蓬勃發展：致力零碰撞、零排放、零擁塞三大願景。三、新興顯示科技持續進入智慧家庭與IoT各應用場域：跳脫傳統消費電子局限。四、聯網智慧邊緣裝置倍數成長與無線技術進化：5G / 毫米波科技與無線串聯應用半導體同步成長。五、更深入廣泛的運算及AI人工智慧創新應用：高算力 / 低功耗處理器架構、新機器視覺、自然語言處理 / 對話式AI人工智慧、機器學習內容生成模擬科技等衍生創新應用百花齊放。在創新科技持續往前邁進，可望衝破疫情阻礙，帶領市場續創成長新動能。

由此可知2022年將延續後疫情新常態，大廠續朝建構數位生態鏈，並融入永續經營思維布局，碳排減量是大前提，不論產品如何定位，眾多車廠都有志一同以減少碳排為最大發展前提，決戰電動車市場。

疫情正在重塑消費者行為，整體消費需求由資料經濟驅動更多數位接觸點與數位平台服務，使下一波科技浪潮走向網實融合的實體數位化(Phygital = Physical + Digital)情境，數位與實體共感出新數位經濟生態系。新興應用則朝向元宇宙(Metaverse)遠景佈局，元宇宙是一個將網路和真實環境融合的情境，使用者可以更自然、直覺的方式進入網路環境並體驗和享受其中。然而元宇宙概念尚未成形，沒有明確定義，但帶來的想像空間和未來可能的商機吸引各大科技巨擘、企業、新創的注意，紛紛投入生態系的布建。元宇宙關鍵技術以web3.0及非同質化代幣(Non-Fungible Token, NFT)建構區塊鏈(Blockchain)的數位交易與新型態高速網路，期待能帶來開放、公平、安全的創作者經濟。

在後疫情時代，混合作模式興起，加速新媒體影音串流、娛樂、遊戲、遠距辦公、線上學習、健身領域的智慧生活應用趨勢發展，體現在元宇宙沉浸式科技的呈現上。元宇宙讓可攜式穿戴裝置蓬勃發展，沉浸式體驗或許將成為線上辦公的最終型態，持續增加使用者體驗是元宇宙的發展重點。

在高速且低延遲的5G網路已逐漸成熟下，加上終端電子裝置聯網的興起，傳統裝置正轉變成連網裝置，其背後所搭載的半導體技術基礎，將進一步加速智慧家庭、智慧穿戴、智慧製造、智慧城市與自駕車等各種領域的興起。此外在車聯網、AR / VR / XR等需要影像傳輸及低延遲網路以提高安全性及互動性裝置中，逐漸看到5G網路扮演的重要性。

晶片業者除了展示新一代處理器，包括在架構升級、採用更先進製程技術，以及AI人工智慧協助下，進一步於資源調度與能耗管理進行強化，帶來更強的效能與更好的功耗表現；也可看到多數系統業者已開始實際運用AI人工智慧技術於各領域。

再將部分產品發展趨勢列示如下：

A. 終端電子產品的應用分析：

- AI人工智慧：從2020 CES展可得知AI已深入人類生活並強調人機流暢協作，在聲音應用方面，語音助理系統需求持續成長，非語音應用如人聲IP應用，智慧聽診器也逐漸深入日常生活所需。影像應用部分，如智慧眼鏡，製造用機械手臂與家用機器人展現高協作流暢度，且應用情境開始趨向實用性。未來AI將整合加速晶片，雲端運算與大數據發展出智慧醫療，智慧製造，智慧城市與自駕車等一系列AI相關產業的應用。

國際固態電路會議(International Solid-State Circuits Conference, ISSCC)預測AI運算晶片的效能與面積效率，以每二年10倍的速度成長，未來6G、AI、IoT可達500億個裝置。在AI晶片創新應用能加速實現自動駕駛升級方面，由CES 2022展會可知，未來智慧車在注入AI技術之後，將加速實現自駕車升級Level 4情境，車輛AI語音助理結合AI自動駕駛功能，為行車體驗帶來革命性的改變，可強化車內用戶的個人化體驗。AI技術實現人們對智慧物聯網(Artificial Intelligent Internet of Things, AIoT)大未來的想像，包含智慧機器，包含無人車、無人機、機器人等能自主判斷與學習的機器。在AI優化智慧家居新體驗方面，CES 2022展出搭載更強大的AI影音處理晶片，可運用深度學習強化場景檢測、增強8K影像技術、虛擬5.1.2聲道、平衡音效等功能的智慧電視，帶來更高層次沉浸式遊戲體驗。AI應用領域也擴及家用攝影機，可偵測受照顧者的身體狀況，AI技術導入更可進階判斷危險情況並發出警示，及時通知照顧者。

- 雲端與終端運算：雲端資料中心，車用ADAS與安防監控系統技術的需求使得DNN (Deep Neural Networks)深度神經網路晶片對於高運算力，低延遲的需求增加，其中關鍵技術包含對於運算效率的優化，如 Google TPU、更快的記憶體存取速度與更大的頻寬，如HBM記憶體與3D封裝及高速互連技術與協定，如NVLink與CXL等；因而造成晶片業者透過併購與結盟提升競爭優勢。

隨著雲端AI與資料中心應用範圍普及後，IT系統耗電問題逐漸受到重視，下一步重點不僅是比AI速度或學習能力，而是比省電能力。AI可協助晶片增強運算力且降低能耗，晶片時脈最高可達5GHz，延長電池續航力達70%。

- 5G行動通訊：5G手機需求量持續成長，根據Prismark估計2022年預估可達到7.5億支的需求量，占智慧手機的滲透率達到46%。另一方面，5G技術也大量帶動了行動影音應用的推動，如影音分享與串流服務，行動網路的效能提升與新興影音格式與應用的出現，如UHD，360度影音與AR/VR應用。

在高速、低延遲的5G網路開枝散葉，終端電子裝置聯網的興起，萬物連結的智慧家庭與智慧城市正逐漸成形。以CES 2022四大重點趨勢觀察，在「移動」趨勢中，可見車輛電子化程度越高，車廠與晶片廠都加入雲端下載技術(Over-the-air, OTA)功能，提供更方便的系統修正與更新，Gartner估計車用半導體2025年市場規模將達到825億美元，年複合成長率達16.3%。在「通訊」趨勢中，在疫情肆虐下，人們更依賴網路來建立人與人的連結，除了各廠頻頻推出各式5G智慧手機，5G網路佈建與周邊基礎建設也都持續進行中，Gartner估計無線通訊半導體在2025年市場規模將達到1,863億美元，年複合成長率達7.2%。在「永續」趨勢中，消費型電子產品跟更多電子產品串聯在一起，擁有大規模物聯網系統，支撐消費型半導體市場。領導大廠預計於2022年推出智慧家庭共同標準Matter(前身為Project Connected Home over IP, Project CHIP)，以降低用戶建置成本，提供智慧家庭裝置的相容性與便利性，Gartner估計消費型半導體在2025年市場規模將達到735億美元，年複合成長率達8.8%。在「健康」趨勢中，穿戴裝置在聯網趨勢下開枝散葉，從智慧手錶、智慧口罩、電子導盲背心、微型智慧助聽器等，未來在5G網路更加普及之下，高階健康穿戴裝置朝向高精準度目標發展，並跨入醫療器材認證發展，Gartner估計醫療健康半導體在2025年市場規模將達到75億美元，年複合成長率達6%。

- 個人電腦PC(包含筆記型電腦、桌上型電腦、平板電腦)：由於COVID-19疫情造成居家辦公與宅經濟強勁需求，使2021年個人電腦需求旺盛，創下近十年最高紀錄。Gartner分析師指出在疫情期間，出貨成長同時受到平均售價提高的支撐，獲得更多營收，整體市場更為健康。因此預期全球PC出貨量至少兩到三年內，不會跌回疫前水準。
- 消費性電子：穿戴裝置、耳機、智慧音箱與遊戲機的需求持續提升，估計在2022年有8%的成長率。

B. 在終端電子產品有高密度、高異質整合與體積日益縮小但功能性日增的趨勢下，公司技術研發將持續朝系統級封裝(SiP Module)、2.5D/3D IC、扇出型(Fan-Out)晶圓級封裝及微型化發展。

C. 對高階封裝需求提升：因應晶片日趨複雜化及系統單晶片之高I/O腳數、細間距的方向發展下，晶片對高散熱性及穩定的電氣特性均有高度需求，故未來晶片封裝將持續朝高階技術發展，如下：

- 晶圓銅柱凸塊技術
- 多層數金屬重佈層技術，1um線寬與線距
- 晶片導通孔訊號連線封裝技術
- 整合型被動元件技術

- 超薄晶圓研磨及封裝技術
- 7/5/3nm晶圓封裝、測試技術
- 扇外型-晶圓級封裝技術
 - ◆ 扇外型封裝層疊技術
 - ◆ 扇外型多晶片組技術
 - ◆ 扇外型嵌入式橋接多晶片技術
- 薄型化高頻寬封裝層疊封裝技術
- 系統封裝技術
- 2.5D/3D高階整合封裝技術

(4) 競爭情形

2021年因疫情影響而使得居家上班、遠距上課等宅經濟爆發，連番帶動電子產品應用端加速創新，使得半導體需求缺口逐漸擴大，遂而引爆產業鏈供應重新分配議題。國際大廠紛紛感受到半導體對於國家供應與安全之重要性，造成全球化分工模式逐漸轉向為保護主義，紛紛規劃在地建構自主半導體產業鏈，廠商間開始透過策略聯盟、交叉持股或併購方式來穩固供應鏈，此波各國對於半導體產業的政策佈局，勢必會對全球半導體產業鏈造成影響。

在半導體產業全球化的競爭下，廠商透過併購取得關鍵技術與產品，切入新市場與新客戶、擴大產業規模已是常態，以類比晶片來說，大者恆大的趨勢更加明顯。2021年超過30億美元的半導體併購案大多與類比晶片、電源管理晶片有關，例如ADI、Renesas分別完成併購Maxim、Dialog來擴張電源管理晶片技術；TI以9億美元收購Micron的Lehi 12吋晶圓廠，用以提高類比晶片產能、降低生產成本。

2021年仍有些不確定的併購案，像是2021年夏天傳出英特爾(Intel)有意以300億美元收購格羅方德(GlobalFoundries)，傳聞SanDisk母公司－威騰電子(Western Digital)對原東芝記憶體部門－鎧俠(KIOXIA)可能200多億美元NAND快閃記憶體合併案，但該案已暫停。目前格羅方德和鎧俠似乎正轉向在今年第四季透過IPO(首次公開募股)上市的目標努力。

各IDM大廠除了透過自家產品鞏固既有市場，對多項業務也互有合作，甚至直接併購整間公司，為自家產品組合打造堅實的供應鏈與客戶群，提升併購綜效的規模，以及在半導體市場的影響力。

另一方面，近年來受到美中貿易戰影響，大環境不確定性因素高，除了供應鏈加速擺脫對中國市場的依賴，分散生產基地佈局外，觀察近年來的半導體產業併購案，非中國半導體廠之間也加速整合，構築越難以撼動的技術壁壘，以穩固產業領先地位。

3. 電子製造服務業：

經專業市場調研機構2021年的報告顯示，2021年全球電子製造服務收入達6440億美元，預計2025年全球電子製造服務收入可達8,000億美元以上，2020年至2025年均複合增長率約為8.2%。整體市場呈現穩定成長之趨勢。

(三)技術及研發概況

本集團最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	109年度	110年度	111年截至2月底
營業收入	476,978,710	569,997,133	92,404,496
研發支出金額	19,302,418	21,053,633	3,510,827
研發支出佔營業收入之比率	4.05%	3.69%	3.80%

1. 投資業：本公司主要營業項目為長期投資，並無研發需求。

2. 封測業：

(1) 開發成功之技術或產品：

A. 開發成功之新產品

封裝技術

New Package	
3D系統封裝 (3D SiP)	a. 2.5D晶圓穿導孔矽材基板系統封裝(2.5D Through Silicon Via Interposer System in Package) b. 3D晶圓穿導孔堆疊系統封裝(3D Through Silicon Via Stacking System in Package) c. Panel Level覆晶PoP(aMAP Flip Chip PoP) d. Panel Level鐸線PoP(aMAP Wire Bond PoP) e. 整合被動元件QFN封裝(Integrated Passive Device Integrated QFN Package) f. 基板內埋主被動元件技術(Embedded Active/ Passive Laminate Substrate) g. 微間距晶片-晶圓堆疊系統技術(Fine Pitch Die-to-Wafer Stacking Technology) h. 玻璃晶片封裝解決方案(6L SESUB_Glass Die Packaging Challenge & Solution) i. 開發應用於毫米波相關產品之高介電塑封材料與三維結構塑封技術(High Dk EMC Material with 3D Structure Technology Development for Application on mmWave Product) j. 毫米波封裝天線AOP模組—天線元件於第二表面構裝技術(mmWave Antenna on Package (AoP) with Antenna Component on 2nd Surface Mount Technology)
光電封裝 (OEP)	a. 高功率LED構裝(High Power LED Package) b. 電子羅盤磁感應器封裝技術(eCompass Magnetic Sensor Package) c. 矽光封裝技術(Si-Photonic Packaging)
晶圓級封裝 (WLCSP)	a. 整合電阻被動元件技術(Integrated Resistor Passive Device) b. 雙層PI晶圓RDL電鍍銅技術(2-layer PI, Cu-Plated RDL Technology) c. 疊層晶圓之薄化技術(Bonded Wafer Thinning Technology) d. 線路重佈製程與保護層疊層技術開發(BoT aCSP) e. 線路重佈製程線寬線距2um/2um技術開發(RDL 2/2um) f. 晶圓級晶片尺寸封裝產品薄晶片技術開發(WLCSP Thin Die Development) g. 扇外型PoP晶片產品開發(FOPoP PKG Development) h. 橋接晶粒扇外型產品開發(Advanced Fan out with Bridge Die, HDCL) i. 先進扇外型堆疊封裝(FXPoP (PoP: Package on Package))
面板級封裝(PLCSP)	扇外型面板封裝產品開發(FOPLP PKG Development)
覆晶封裝 (Flip Chip)	a. 7奈米銅製程/超低介電係數晶圓之無鉛覆晶封裝(7 nm Cu/ELK Lead Free FC Solution) b. 40微米微間距覆晶及鐸線混合堆疊(40 um Fine Pitch FC & WB Hybrid Stacked Chips Package) c. 超高密度條狀基板排列製程(Ultra High Density Substrate Strip) d. 覆晶封裝之封膠Only產品(Flip Chip Package with Mold Only Process) e. 覆晶封裝之穿越封膠層孔產品(Flip Chip Through Mold Via Package) f. 單層板內嵌式線路基板封裝研發(1 Layer Embedded Trace Package)
鐸線封裝 (Wire Bond Package)	a. 16奈米銅製程/超低介電係數晶圓之鐸線封裝(16 nm Cu/ULK Wafer Wire Bond Package) b. 銅線BGA/ Lead Frame封裝開發(Cu Wire Bond BGA/ Lead Frame Package) c. 鋁墊對鋁墊銅線打線技術(Cu Wire Pad to Pad Bonding) d. 低成本、高效能aS3 / aQFN封裝方案(Low Cost & High Performance aS3 / aQFN) e. 四方平面無引腳產品於車用電子(FC QFN For ATV) f. 高散熱材料評估(High Thermal HS Evaluation) g. 第二代先進整合元件內埋封裝技術開發(aEASI P2) h. 移動式記憶體技術開發(Mobile DRAM) i. 高I/O三排腳四方平面無引腳封裝評估(Adv. QFN (13.8x15.6mm) Evaluate)
微機電封裝 (MEMS Packaging)	晶圓級微機電封裝技術(Wafer Level MEMS Packaging)
無線射頻模組 (Wireless Module)	a. 低功耗藍芽系統與加速度模組完整方案(BTLE+Accelerator SiP Module Application Solution) b. 高頻寬Wi-Fi系統模組完整方案(Wi-Fi 11n 2x2 Channel SiP Module Total Solution) c. 非圓柱覆晶式功率放大器封裝結構(Irregular FC Cu-Pillar PA SiP Module Solution) d. 雙面薄化無線通訊模組技術(Ultra Thin Double Side Wireless Module Technology) e. 薄型化內外元件屏蔽封裝技術(Thin mold compartment with Internal Shielding)
無線通訊模組 (Wireless Communication Module)	a. 高整合度多模多頻3G通訊模組完整方案(Highly Integrated Multi- Modes Multi-Bands Communication Module Solution) b. 高整合度SiP封裝通訊LTE模組方案(Highly Integrated SiP Module Packaged LTE Module Solution) c. 整合微控制器、低功耗藍芽與天線(MCU + BLE + AoP)系統模組完整方案(MCU Wireless Connection Module Total Solution) d. 5G天線封裝產品開發(5G AiP Development)
Bumping	
電鍍製程 (Plating)	低銀之錫銀無鉛電鍍晶圓凸塊技術(Low Ag of Sn/Ag Lead-Free Bump Plating Technology)

新測試產品

New Test Product	
晶圓測試 (Wafer Probing)	a. 高通道密度4線式VI Source模組(High Channel Density 4-Wire VI Source Module) b. 數位I/O & Per-Pin可程式化量測模組(Digital I/O & PPMU Module) c. 光纖模組控制卡(Fiber Module Control Card) d. 嵌入式元件基板Open/Short測試機(Embedded-Die Substrate Open/Short Tester) e. 多片晶圓堆疊測試分佈地圖分析軟體(Multiple Wafer Stacked Map Analysis Tool) f. 高速數位I/O模組(High Speed Pattern Module) g. 大電流VI source模組(High Current VI Source Module)
後段測試 (Final Testing)	a. 測試資料分析軟體系統(Test Data Analysis System) b. 測試良率監控軟體系統(Yield Monitor System) c. 開短路測試機(Open/Short Tester) d. 開短路測試機小型模組(Open/Short Tester Compact Module) e. 線上即時不良品自動分析報告產生系統(Online Real-time Fail Bin Analysis Report Generation System) f. ATVMCU測試解決方案(ATVMCU Testing Solution) g. 毫米波AiP (mmWave Antenna in Package) h. 毫米波前端模組(mmWave FEM) i. 毫米波天線(mmWave Antenna Substrate) j. Wi-Fi 6e系統級封裝(Wi-Fi 6e SiP) k. 全球衛星定位應用之系統級封裝(GNSS SiP)
測試設備開發 (Test Equipment Development)	a. 高密度通道共用轉換板(High Density Channel Sharing Board) b. 高動態時域量測模組(High Swing Time Measurement Module) c. 多通道射頻網路分析儀整合系統(Multi-Channel RF-VNA Integrated System) d. 多通道多功能多執行序之系統級封裝模組測試機開發(Multi-Channel Multi-Function and Multi-Process SiP Tester Development)

測試技術

New Test Technology	
後段測試 (Final Testing)	a. 系統級封裝-ARM+Memory模組元件系統級測試技術(SiP ARM+Memory Modules SLT Technology) b. 系統級封裝-GaN Power模組元件測試技術(SiP GaN Power Module Testing Technology) c. 系統級封裝-Computer Audio模組元件測試技術(SiP Computer Audio Module Testing Technology) d. 影像感應元件測試轉換解決方案(CIS Testing Development) e. 人臉辨識感測技術測試解決方案(Facial Recognition Sensor Testing Solution) f. 系統級封裝-SiP真無線藍芽耳機模組測試技術(SiP TWS Module Testing Technology) g. 系統級封裝-SiP 第六代無線網路傳輸模組(Wi-Fi 6 Module Test Technology)

B. 開發成功之新技術

封裝技術

Advanced Technology	
3D系統封裝 (3D SiP)	a. 2.5維晶圓穿導孔晶片堆疊封裝技術(2.5D TSV Stacking) b. 3維晶圓穿導孔晶片堆疊封裝技術(3D TSV Stacking) c. 整合被動元件封裝技術(Integrated Passive Device) d. 薄基板核層覆晶PoP堆疊技術(Thin Core FC PoP Technology) e. 微間距晶片-晶圓堆疊系統技術(Fine Pitch Die-to-Wafer Stacking Technology) f. 65奈米SRAM晶圓穿孔功能驗證(65 nm SRAM TSV Qualification) g. 分段式屏蔽技術(Compartment Shielding Technology) h. 選擇性區域封膠技術(Selective Molding Solution) i. 晶粒貼合晶圓製程技術(SiP COW) j. 壓力傳感器封裝技術(Pressure Sensor) k. 高介電塑封材料與三維結構塑封技術(3D Molded with High Dk EMC Material Technology) l. 低溫表面構裝技術(Low Temperature Surface Mount Technology) m. 2.5D IC 75mm x 60mm尺寸覆晶球柵陣列(2.5D 75 mm x 60 mm Size FCBGA) n. 改良式封裝層疊覆晶晶片尺寸式封裝-錫球凸塊/銅柱凸塊(Flip Chip Enhanced PoP(Solder Bump/Cu Pillar Bump)) o. 高頻寬封裝層疊覆晶晶片尺寸式封裝(High Bandwidth PoP) p. 薄片高頻寬封裝層疊覆晶晶片尺寸式封裝(Thin & High Bandwidth PoP) q. 大晶片尺寸高頻寬封裝層疊覆晶晶片尺寸式封裝(Large Die & High Bandwidth PoP) r. 九層堆疊式薄型微間距球柵陣列積體電路(9 Dices-Stacked) s. 多晶片組-鉚線-堆疊覆晶晶片尺寸式積體電路(銅柱凸塊/銅打線) (MCM-WB-SFCCSP (Cu Pillar Bump/ Cu Wire Bonding)) t. 面對面接合覆晶晶片尺寸式積體電路(F2F(Face to Face) Bonding FCCSP)

Advanced Technology	
3D系統封裝 (3D SiP)	u. 扇出型-封裝層疊整合被動元件封裝技術(FO-PoP(Fan Out PoP) with LSC(Land Side Capacitor) Technology) v. 改良式封裝層疊覆晶晶片尺寸式封裝-錫球凸塊/銅柱凸塊(FC Enhanced PoP)整合球面被動元件封裝技術(with LSC(Land Side Capacitor)) w. 裸晶式封裝層疊覆晶晶片尺寸式封裝-錫球凸塊/銅柱凸塊(FC Bare die PoP)整合球面被動元件封裝技術(with LSC(Land Side Capacitor)) x. 外露型改良式封裝層疊覆晶晶片尺寸式封裝結合無核心層基板-錫球凸塊/銅柱凸塊(FC Exposed Die Enhance PoP with Coreless Substrate)整合球面被動元件封裝技術(with LSC(Land Side Capacitor)) y. 扇出型-系統級封裝模組(FO-SiP(Fan Out SiP)) z. 整合各式主動元件之雙面系統構裝技術開發(Double Side SiP) - aa. 各式TMV製程技術開發(Solder via, Cu via and Interposer) - bb. PoP結構之毫米波天線AiP構裝技術開發(Package on Package of 5G mmWave Antenna in PKG Structure Technology Development) - cc. 多顆晶片之高整合性微型化的單面與雙面模壓Wi-Fi 6/6E模組(Multi-Die of High Integration and Miniaturization Solution for Single Side and Double Side SiP for Wi-Fi 6/6E) - dd. 鐳線-覆晶晶片尺寸式積體電路(銀打線/銅柱凸塊) (WB-FCCSP (Cu Pillar Bump/ Ag Wire Bonding))
光電封裝 (OEP)	a. 微型投影機顯示器功能驗證(Pico Projector Microdisplay Qualification) b. 高深寬比晶圓穿孔電鍍技術(High Aspect Ratio TSV Plating Technology) c. 低成本矽晶圓穿孔技術(Low Cost TSV Technology) d. VCSEL遠場量測技術(VCSEL Far-Field Measurement Technology) e. 雷射雜斑消除技術(Laser Speckle Elimination Technology) f. 雷射光輻射安全量測(Eyes Safety Test of Laser Product) g. 光學式眼球追蹤模組 (Optical Eye Tracking Module) h. 射頻前端雙面封膜封裝技術 (RFFE DSM Projects)
晶圓級封裝 (WLCSP)	a. 矽材基板內埋主動元件技術(Embedded Active Si Substrate) b. 200mm晶圓穿導孔晶圓50微米厚度CMP研磨技術(50 um Wafer CMP Grind Technology for 200mm TSV Wafer) c. 200mm穿導孔晶圓50微米厚度分離載具技術(50 um Wafer Carrier Release Technology for 200mm TSV Wafer) d. 大尺寸(8x8毫米)晶圓級晶片尺寸封裝之可靠度研究與優化(Reliability Research and Optimization of Large Size (8x8mm) for WLCSP) e. 線路重佈製程和無鉛錫銀電鍍製程層疊技術開發(RDL LF Bump) f. 線路重佈製程和銅柱製程層疊技術開發(RD Cu Pillar) g. 晶背貼合材料技術開發(IR Through BSL) h. 薄片晶背貼合能力技術開發(Advanced BSL) i. 降低切割製程風險技術開發(Advanced Laser Dicing) j. aWLP II (InFO-like)類InFO結構(aWLP II InFO-Like Class InFO Structure) k. 4層Polymer晶圓RDL電鍍銅技術(4-layer Polymer, Cu-Plated RDL Technology) l. 扇出型晶片無鉛凸塊之覆晶封裝(FOCoS) m. 扇出型30um晶片厚度研磨前切割技術(Fan Out DBG(Dicing Before Grinding) Technology) n. 8 Hi HBM CPD晶圓高精準度(+/- 2um)的研磨技術(CPD Wafer With 8 Hi HBM Grinding Technology) o. M-S 架構多晶片封裝技術(M-S Multi Dies (2 Dies)) p. 輕薄型先進晶圓級封裝技術(FI-aWLP M-Series Lite) q. 扇出型基板上晶片封裝先進技術(CF:先wafer後RDL單晶粒/多晶粒技術發展_FOCoS) (FOCoS-CL, FOCoS-CF-P) r. 極薄型晶圓級晶片尺寸式封裝(Extremely-Thin WLCSP) s. 模壓型式-晶圓級封裝(Molded Type WLCSP) t. 扇出型-多晶片組封裝(FO-MCM) u. 45um矽介層封裝技術(45um Si-Interposer Technology) v. 8*/12" 無鉛錫球直置式植球晶圓級封裝(8*/12" Ball On Trace WLCSP)
面板級封裝(PLCSP)	扇出型動態補償光罩之面板級封裝技術(FO-Adaptive Patterning PLCSP)

Advanced Technology	
覆晶封裝 (Flip Chip)	a. 微間距非導電覆晶薄膜底材(Fine Pitch NCF Under-Fill Technology) b. 28奈米超低介電係數晶圓，40 um Bump Pitch之覆晶封裝(40 um Pitch FC Solution for 28 nm ELK Wafer) c. 300mm晶圓50微米厚度研磨技術(300mm Wafer 50um Backgrind Technology) d. 壓合式晶圓級覆晶封裝技術(Laminated FC CSP) e. 28奈米超低介電系數晶圓與基板內埋式線路封裝產品(28nm Wafer Tech with Embedded Pattern Plating) f. 高頻寬層疊封裝技術(High Frequency Wide Stack Packaging Technology) g. 晶圓級覆晶封裝產品凸塊間距細微化結構發展研究計畫(Wafer-level Flip-Chip Package Product Bump Pitch Fine Structure Development Research Project) h. 2.5D先進封裝製程(2.5D Advanced IC Assembly) i. 銀合金線於混合式覆晶球格陣列式封裝技術(Silver Alloy Wire for Hybrid Flip Chip BGA Technology) j. 扇出型堆疊式封裝技術(FOPoP_W/I) k. 3mm x 3mm小尺寸覆晶晶片尺寸式積體電路(3 mm x 3 mm Size FCCSP) l. 覆晶式-內埋線路基板球面整合被動元件封裝(FC-ETS (Embedded Trace Substrate) with LSC(Land Side Capacitor)) m. 覆晶式-模壓型式內接線路球柵陣列(FC-MISBGA (Molded-Interconnection-System BGA)) n. 基板重組式覆晶晶片尺寸式積體電路(Recon (Reconstitution) FCCSP) o. 基板重組式-晶片外露型覆晶晶片尺寸式積體電路(Recon (Reconstitution) Exposed Die FCCSP) p. 散熱片外露式-覆晶片型覆晶晶片尺寸式封裝(EHS-ED-FCCSP) q. 覆晶晶片尺寸式封裝結合熱壓合技術(FCCSP with TCB (Thermal Compression Bonding)Technology) r. 覆晶晶片尺寸式封裝球面整合被動元件封裝技術(FCCSP with LSC(Land Side Capacitor)) s. 極薄型覆晶晶片尺寸式積體電路(Extreme-Thin FCCSP) t. 89 mm x 98 mm之大尺寸覆晶球柵陣列(89 mm x 89 mm Large Size FCBGA) u. 11 mm x 11 mm之小尺寸覆晶球柵陣列(11 mm x 11 mm Small Size FCBGA) v. 60GHZ天線整合型-覆晶球柵陣列(FCBGA with 60GHZ Antenna) w. 外露型散熱片覆晶球柵陣列結合超高散熱性能TIM(FCBGA with Ultrahigh Thermal Performance TIM(Thermal Interface Material)) x. 覆晶球柵陣列結合內埋被動元件基板(FCBGA with EPS (Embedded Passive Substrate)) y. 覆晶球柵陣列結合低耗損有機基板(FCBGA with Low Loss Organic Substrate) z. 覆晶球柵陣列整合球面被動元件封裝技術(FCBGA with LSC(Land Side Capacitor)) aa. 覆晶球柵陣列結合熱壓合技術(FCBGA with TCB (Thermal Compression Bonding) Technology) bb. 65mm x 65mm之大尺寸覆晶球柵陣列結合薄核心層基板(65mm x 65mm FCBGA with Thin Core Substrate) cc. 扇出型-多晶片組覆晶球柵陣列封裝(FO-MCM FCBGA) dd. 扇出型-嵌入式橋接多晶片組覆晶球柵陣列封裝結合高頻寬記憶體(FO-EB FCBGA) ee. 天線覆晶晶片尺寸式封裝整合球面覆晶封裝技術(Antenna FCBGA with LSD(Land Side Die)) ff. 超級薄型微間距球柵陣列封裝(Ultra-Thin CSP) gg. 覆晶式-四方平面無腳封裝(銅柱凸塊)(FC-QFN (Cu pillar Bump)) hh. 覆晶式指紋辨識感應器封裝技術(Flip Chip Finger Print Sensor Packaging Technology) ii. 超薄晶圓封裝技術8/12吋晶圓研磨至25um(Advanced Wafer Thinning Technologies - 25 um for 8" & 12" Wafer) jj. 超薄晶圓封裝技術12吋銅柱凸塊晶圓研磨至50um(Advanced Wafer Thinning Technologies - 50um for 12" Bumping Wafer) kk. 10/7/5奈米銅製程超低介電常數晶圓覆晶封裝技術(Flip Chip Tech. on 10/7/5nm ELK Wafer) ll. 130um無鉛凸塊間距覆晶封裝技術(Flip Chip with 130um Pitch Lead Free Bumping) mm. 40um銅柱凸塊間距覆晶封裝技術(40um Pitch Cu Pillar Bumping) nn. 熱壓合鐸接技術(TCB(Thermo-Compression-Bonding) Technology)
鐸線封裝 (Wire Bond Package)	a. 20奈米銅製程/超低介電係數晶圓之鐸線封裝(20 nm Ultra Low K Cu Wafer Wire Bond Package) b. 18微米線徑銅線打線封裝技術(18 um Cu Wire Bond Technology) c. 鋁墊對鋁墊銅線打線技術(Cu Wire Pad to Pad Bonding) d. 銅鐸線封裝技術(Cu Wire Bond Packaging Technology) e. 內埋式線路之基板其開發與應用(Development and Application of Substrates for Embedded) f. 高階四方平面無引腳封裝與測試技術(FCQFN Development) g. 細微間距鐸線技術(Fine Pitch Wire Bonding Technology) h. 雙面SMT封裝技術(Double-Sided SMT Packaging Technology) i. 壓力傳感器封裝技術(Pressure Sensor Packaging Technology) j. 被動元件直置die面封裝結構發展(Passive Components Direct on Die Assembly Structure Development) k. 薄型微間距球柵陣列封裝-單層板(Single Layer Substrate Package) l. 散熱片外露型薄型微間距球柵陣列(EHS-TFBGA) m. 多排可繞線型-四方平面無腳封裝(MR(Multi-Row-Routable)-QFN) n. 鐸線式指紋辨識感應器封裝技術(Wire Bond Finger Print Sensor Packaging Technology) o. 28/20nm銅製程低介電常數晶圓鐸線封裝技術(Wire Bonding Tech. on 28/20nm ULK/ELK Wafer) p. 45um間距直列式鐸墊銅線鐸線技術(45um Pitch, Linear Cu Wire Bonding) q. 40um晶片直列式鐸墊間距銅線打線技術(40um Linear Pitch, Cu Wire Bonding) r. 14nm銅製程低介電常數晶圓鐸線封裝技術(Wire Bond Technology on 14nm ELK Wafer) s. 被動元件整合四方平面無引腳封裝(Passive Integrated Mapped Quad Flat No Lead Packaging)
人工智慧視覺檢測技術 (AI-Based Visual Inspection)	智慧基板瑕疵檢測技術(Intelligent Substrate Defect Inspection Powered by Deep Learning and Computer Vision)

Advanced Technology	
綠色封裝 (Green Package)	a. QC080000 綠色環保系統認證(QC080000 Green System Certification)
	b. 化學實驗室通過TAF認證(RoHS Certification on Chemical Lab)
Bumping	
電鍍製程 (Plating)	a. 40微米微間距銅柱凸塊技術(40 um Fine Pitch Cu Pillar Bumping)
	b. 高深寬比銅柱電鍍凸塊技術(High Aspect Ratio Cu Pillar Bumping Plating)
	c. 15微米穿導孔填充技術(15um TSV Filling Plating)
	d. 扇外型晶片無鉛凸塊之覆晶封裝(Fan-Out Package for Lead-Free Bump)
	e. 無鉛(錫銀)積體電路晶圓凸塊技術(Lead Free (SnAg, SnCu) Wafer Bumping)
	f. 100um間距矩陣型積體電路晶圓錫鉛凸塊技術(100um Pitch Eutectic Bump)
	g. 100um間距矩陣型積體電路晶圓無鉛凸塊技術(100um Pitch Lead Free Bump)
	h. 40um間距矩陣型積體電路晶圓銅柱凸塊技術(40um Pitch Cu Pillar Bump)
	i. 10/7/5/4奈米銅製程低介電常數凸塊技術(Bumping on 10/7/5/4nm ULK/ELK Wafer)
	j. 超厚Cu導線(20 μm)無鉛錫球植球晶圓級封裝技術(Thick Cu Trace for WLCSP)

測試技術

New Test Technology	
晶圓測試 (Wafer Probing)	a. 系統級封裝-GaN Power晶圓測試技術(SiP-GaN Power Wafer Probing Testing Technology)
	b. 輔助駕駛光學感測器晶圓測試技術(ADAS Sensor Wafer Probing Test Technology)
	c. WLCSP RF-Switch高效率多工通道阻抗量測技術(High Efficiency Parallel Test of Multi-Channels' Resistance of WLCSP RF-Switch)
	d. 低成本電源管理元件晶圓測試技術(Low Cost PMIC Wafer Probing Testing Technology)
	e. 5G IC晶圓測試(5G IC Wafer Testing)
後段測試 (Final Testing)	a. 系統級封裝-產品應用測試技術(SiP-Product Application Testing Technology)
	b. 系統級封裝-EFA電性失效分析/產品檢測技術(SiP-EFA/Function Detectability)
	c. 系統級封裝-Design FMEA(SiP Design Failure Mode and Effect Analysis)
	d. 系統級封裝-系統級測試機台開發技術(SiP / SLT "System Level Testing" Technology)
	e. 系統級封裝-GaN Power產品應用測試技術(SiP-GaN Power Product Application Testing Technology)
	f. 光感控制元件測試方案(ALS+Prox. Sensor Test Solution)
	g. 軟板光學模組測試方案(FPCB Module Test Solution)
	h. 砷化鎵PD光學測試方案(InGaAs PD Test Solution)
	i. 長波段IR光源開發技術(Long-wavelength IR Light Source Technology)
	j. 光學元件之人眼安全測試解決方案(Optical Eye Safety Test Technology)
	k. 系統級封裝-SiP真無線藍芽耳機模組測試技術(SiP TWS Module Testing Technology)
	l. 系統級封裝-SiP GSM定位模組測試技術(SiP 2G-GPS Module Testing Technology)
	m. 系統級封裝-SiP真無線藍芽耳機模組測試技術, Audio & BT Test (SiP TWS Module Testing Technology,Audio & BT Test)
	n. 光學智慧眼鏡之環境光取樣偵測模組(Advanced ALS Testing for Smart Glasses)
	o. 無人駕駛光學感知測試解決方案(LiDAR Sensing Testing Solution)
	p. 輔助駕駛光學感測器測試解決方案(ADAS Sensing Testing Solution)
	q. 生物感測元件測試解決方案(Biometric Sensor Testing Solution)
	r. 人臉辨識感測技術(Facial Recognition Sensor Test Technology)
	s. 系統級封裝-SiP 第六代無線網路傳輸測試(Wi-Fi 6 module Test Technology)
	t. 線性霍爾傳感器測試技術(Linear Hall-effect Sensor Test Technology)
	u. 可控制之瞬間高電流雷管引線控制器測試技術(Controllable Instantaneous High Current Detonator Lead Controller Test Technology)
	v. 802.11ac射頻收發器最佳測試解決方案(Test Optimization of 802.11ac Transceiver)
	w. 穿戴式裝置系統級封裝模組測試技術(Wearable Device SiP Module Test Technology)
	x. 觸控感測試晶片高產出及低成本開斷路測試解決方法(Touch Sensor IC High UPH and Low Cost O/S Test Solution)
	y. 自動學習嵌入式元件產生開短路測試程式技術(Auto-Learn Embedded IC & Generate the Open/Short Test Program Technology)
	z. 電源管理元件高產出平行測試方法(PMIC High UPH Test Methodology)
	aa. Auto- Learn Open/Short測試技術開發(Auto-Learn Open/Short Testing Technology)
	bb. Auto- Learn Leakage測試技術開發(Auto-Learn Leakage Testing Technology)
	cc. 毫米波AiP功能測試方案(mmWave AiP Function Test Solution)
	dd. 平行多埠毫米波前端模組測試方案(Multisite, Multi-Ports mmWave FEM Test Solution)
	ee. 矽光子光纖收發器模組測試方案(SiPh Transceiver Module Test Solution)
	ff. 研發2um超細線路之測試載板(Develop 2um Ultra-Fine Pitch Test Substrate)

New Test Technology	
測試設備開發 (Test Equipment Development)	a. 非同步式指令傳遞自動化測試控制系統(Asynchronous Command Sending Auto-Testing Control System) b. 多模組共用整合系統(Multiple Functions and Modules Integration System) c. 可程式化V-I 量測模組混用控制介面(Programmable V-I Combo Source-Meter Control Interface) d. 串接式模組擴充整合架構(Cascade Data-Stream Extended Control Unit in the Integration Core System) e. 可程式化數位通道相位對準技術(Programmable I/O Channels Phase Delay Technology) f. 高效能數位測試模組開發(High Performance Digital Testing Module Development) g. 硬體模組控制整合平台暨共用測試機介面開發(Hardware Module Control Platform and Common Tester User Interface Development) h. 高通道密度系統級晶片測試機開發(High Channel Density SOC Tester Development)
測試資料分析 (Test Data Analysis)	a. Substrate疊圖分析-重心偏移偵出演算法(Center of Gravity Offset Detection Algorithm) b. Fast Shmoo-鄰近搜尋演算法(Nearby Searching Algorithm) c. Substrate疊圖分析-視覺化圖像識別失效偵出演算法(Visualized Image Recognition Failure Detection Algorithm) d. Substrate鍍銅線SECS/GEM Recipe &生產資料儲存自動比對上傳系統(SECSGEM Automation System for Recipe Ensuring & Production Data Storing at Substrate Cu Plating Line) e. IV- Curve產生器暨分析工具(IV-Curve Generator & Analysis Tool) f. BGA 腳位異常顯示輔助工具(BGA Ball Fail Highlight Tool)

其他技術

New Test Technology	
晶圓切割 (Wafer Saw)	a. 雷射隱形切割技術(SD(Stealth Dicing) Laser Technology) b. 電漿切割技術(Plas New Test Technology ma Dicing) c. 遠程電漿技術(Remote Plasma) d. SiC/GaN Wafer切割技術(SiC/GaN Wafer Die Saw Technology)

3.電子製造服務業：

(1) 開發成功之技術或產品：

A. 開發成功之新產品

無線通訊	a. 無線通信SiP模組，支援802.11ac 2x2 b. 無線通信SiP模組，支援802.11ax 2x2 with Dual-Core Bluetooth5.2 & a ScanRadio c. 無線通信SiP模組，支援802.15.4z 4-Antenna (1T+3R) d. 5G 微波AOP/AIP模組支援 band n257, n258, n259, n260, 低頻段天線 1x4, 高頻段天線 1x4 e. 5G 微波收發器模組支援 band n257, n258, n259, n260, RF 32-port f. 高頻寬Wi-Fi系統模組完整方案 g. 4G資料數據機模組隨3GPP發展符合機器到機器和物聯網相關應用 h. 系統級物聯網模組 i. 11ax企業等級存取點AP (Access Point)
存儲與電腦	a. 英特爾第十二代Core中央處理器之工作站主機板 b. 超微 Zen3 Ryzen中央處理器之超小型商用主機板 c. 超微第三代Ryzen Threadripper 中央處理器之工作站主機板 d. 音效電路系統級封裝 e. 網路儲存伺服器 f. 高密度機架伺服器 g. 邊緣伺服器 h. Intel Thunderbolt4 擴充基座 i. 子功能模組卡 j. 基于YMTC NAND的M.2固態硬碟
工業電子	a. OM9手持式銷售點管理終端機 b. PD-03 付款裝置 c. 新一代支援5G NR強固型手持裝置/輕薄型手持裝置/強固型平板裝置 d. 新一代支援LTE Android強固型/輕薄型手持裝置 e. LTE系統整合式模組 f. 可穿戴終端裝置 g. 智慧識別證 h. 指環掃描器 i. 私人購物助理 j. 5G Android 強固型智能手持裝置

消費電子	a. 真無線耳機系統封裝 b. 手寫筆 c. 無線充電裝置
汽車電子	a. 電動車On-board Charger電源模組 b. 車用顯示屏
微小化及自動化	a. 雙面塑封微小系統模組 b. TWS微小系統模組 c. 金屬框EMI屏蔽微小系統模組 d. 露元件膠膜塑封技術 e. 應用於穿戴式產品/手錶/手機內部之超薄主機板SiP f. 點膠和金屬框內部隔間EMI遮罩結合的模組產品結構

B. 開發成功之新技術

無線通訊	a. 雙面模組封裝結構技術 b. 隔間式屏蔽技術 c. 選擇性區域屏蔽技術 d. 利用造型填充技術提供更小尺寸的模組以符合客戶更彈性的應用 e. 系統級SOM物聯網模組 f. 降噪隔離技術 g. 射頻板載設計 h. 支持LTE-CATM1 和 NB-IoT的GPS低功耗設計
存儲與電腦	a. 支援5G網卡的商用主機板 b. 結合硬體保護與韌體保護的主機板BIOS安全防護技術 c. 整合5G和Wi-Fi之邊緣伺服器 d. 整合新的Intel Thunderbolt4高速傳輸技術，且符合標準USB4設計 e. 可溫控基於PCIe Gen4介面的測試平臺 f. 企業級SSD可靠性負荷JESD219A的實現 g. 高密度SSD併發生產測試技術
工業電子	a. 強固手持式裝置防水耐摔機構設計 b. 5G NR全頻段Android智能模組 c. 5G NR可調式天線設計 d. 具備5G NR(Sub-6GHz與毫米波)通訊之系統整合式模組
消費電子	a. 主動式靜電感應技術 b. 電磁技術 c. NFC無線充電技術 d. 新一代自行車衛星導航車錶
汽車電子	車載資通訊技術

微小化及自動化	a. 陶瓷電路基板的抗硫化結構及其製造方法 b. 治具切割槽設有能力做到0.25毫米 c. PCI 和 EMVCo 認證 d. 雷射及滾刀混合切割不規則形狀塑封模組技術 e. 真空印膠於極窄溝槽內實現EMI隔間屏蔽的技術 f. 噴膠形式實現塑封模組表面EMI屏蔽 g. 150微米間距WLCSP的塑封填充技術 h. 40微米極窄溝槽實現EMI隔間遮罩的技術 i. 多層次異種金屬鍍鍍實現EMI屏蔽 j. 被動元件雙層疊加 k. TMV(Through Mold Via) 製程 l. 露元件塑封技術 m. 雙面塑封技術 n. 雙面選擇性區域遮罩技術 o. 多臺階塑封技術 p. 鐳射蝕刻實現天線/傳感線裸露技術 q. 金屬框EMI遮罩技術 r. MUF SiP實現主動晶片球間距為150微米批量生產 s. 雙面塑封微小系統模組量產 t. 插入式連接器模塑成型後研磨漏出焊墊 u. 微型化SiP模組倒角模塑成型 v. SiP外觀六面檢查機 w. 整板級植球製程 x. 全水洗鐸料及製程 y. SMT Reel 線邊智能料架與物料管理系統 z. 自動Sorting and JEDEC Tray 轉 SiP Tray 機 - aa. Watch SiP 自動測試機 - bb. 修改 71 台GIT 單手背測試機並增加自動疊Tray 進料功能 - cc. 車電 Nissan EV2020 Excitation 自動組裝線 - dd. 車電 E-Power Module Automatic Assembly Line - ee. 張江廠關燈測試車間含AGV 搬運系統 - ff. 開發3個人工智慧技術應用於自動光學檢測技術AMR, SiP Misplacement and Algorithm for AE RFQ System - gg. 中央生產監測戰情中心 - hh. MTBA 系統開發 ii. SMT AOI 檢測逃脫回饋系統 - jj. 倉庫物料管理系統 - kk. 智慧手機/平板即時推撥系統 - ll. SMT機器工時自動計算系統
---------	---

(四)長、短期業務發展計畫

1. 短期計畫

- 鞏固既有客戶，並爭取更多IDM客戶
- 落實集團生產策略，取得最具優勢之配置
- 爭取高階封裝訂單，提昇實質獲利
- 提昇資源運用率並減少資源耗用與浪費
- 提昇環保產品之生產技術，加速產品轉換速度，以提昇市場機會
- 藉由試製開發達到量產
- 滿足目標客戶最關注的項目，提升市占率
- 開發符合市場趨勢的封測技術與加速Time to Market 的時間
- 持續擴充及整合海內外據點高階封裝、測試產能，滿足市場成長趨勢
- 鞏固既有客戶，並爭取更多EMS/ODM 客戶

2. 長期計畫

- 整合集團資源，提供客戶更趨完整之服務

- 改善成本結構，提供客戶更具競爭力之價格
- 落實客戶區隔，強化客戶滿意擴大整體生產規模，追求成本優勢，讓價格更具競爭力
- 確保技術領先以提高市占率
- 佈局產業發展趨勢下的新應用領域，持續成長動力，確保本公司於半導體封測之領導地位
- 從現有的DMS(設計製造服務)模式中把Miniaturized(微小化)與Solutions(解決方案)兩元素加入，也就是說在整個價值鏈過程中提供具有微小化與解決方案的設計製造服務D(MS)²

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

本集團一一〇年度主要商品之銷售地區

單位:新台幣千元

銷售地區	銷售金額	%
美國	353,500,361	62.02%
台灣	94,598,067	16.60%
歐洲	57,910,641	10.16%
亞洲及其他	63,988,064	11.22%
合計	569,997,133	100.00%

1. 市場占有率

(1) 封測業：

110及109年全球半導體委外封測服務市場占有率

根據110及109年封測合併營收占全球委外封裝及測試市場(註1)皆為28.6%。

註1：全球委外封裝及測試市場之計算係以該年度封測同業之營收公開資訊合併估計而得。

(2) 電子製造服務業：

子公司環電公司維持穩定之市占率。

110年電子代工營收為85億7,507萬美元，較109年成長約23%。估計占110年全球EMS/ODM市場(註2)約1.3%。

109年電子代工營收為69億7,175萬美元，較108年成長約30%。估計占109年全球EMS/ODM市場(註2)約1.3%。

註2：110及109年全球電子代工市場之計算係以NVR 110及109年之分析為基礎，再參考110及109年電子代工同業之營收公開資訊，合併估計而得。

2. 市場未來之供需狀況與成長性

雖然疫情帶動之宅經濟應用逐漸緩和，但中美貿易戰轉單效應仍持續，加上5G手機滲透率全面拉升，以及高效運算(HPC)及電動車市場需求帶動下，展望全球半導體封測產業趨勢，整合元件製造廠(IDM)仍會持續釋出封測訂單，封測專業代工(OSAT)產值也將持續成長。除了先進晶圓級封裝(Advanced Wafer Level Package)及系統級封裝(System in Package)仍是主要各大廠爭相投入資源的戰場外，打線封裝(Wire Bond Package)也意外成為兵家必爭之產品。111年全球半導體需求產值預估請參閱"前述產業之現況與發展"章節。

在EMS方面，全球電子產品外包需求呈現不斷增長的態勢，隨著電子製造服務模式日益成熟和服務能力的不斷提升，全球電子製造服務業服務領域越來越廣，代工總量逐年遞增。為了滿足品牌商日益增長的需求，電子製造服務的範圍不斷延伸，並逐步涵蓋產品價值鏈的高端環節，這種趨勢為子公司環電公司這類具備產品規劃、設計與研發能力的製造廠商提供了更廣闊的發展空間。根據市場分析報告及環電公司的統整分析，全球EMS/ODM市場均維持穩健成長的態勢，2020-2025年平均成長率約8%。

3. 競爭利基

新冠肺炎(COVID-19)病毒不停變種造成疫情反覆延燒，加上中美貿易戰並未停歇，迫使全球航運與供應鏈中斷時間較預

期還要長。然在5G快速發展、車用市場復甦等因素帶動下，電子供應鏈仍積極拉貨，再加上IDM大廠加速擴大委外，展望2022年，傳統打線封裝、先進封裝、測試代工、系統級封裝(SiP)全面成長，半導體供應鏈限制與封測產能將供不應求。本集團除了視發展情勢調整內部營運機制外，更針對電子產品智慧化發展趨勢，持續致力於先進封測技術之開發，化危機為轉機，期許在未來能再創佳績。我們所依賴之各項競爭優勢分析如下：

(1) 先進技術研發日月精進，高階產品技術及品質持續居領導地位

隨著手機5G行動通訊、物聯網(IoT)、智慧科技(AI)、數位消費電子及穿戴裝置(Wearable Device)應用產品發展，晶片須符合擴增的功能需求，並朝向低價格、多功能、高效能、高整合度、更低成本的演進趨勢、更先進的封裝技術與更複雜的晶片測試技術要求，本集團持續在高階封測技術2.5D & 3D IC、SiP、Fan-out/Fan-in WLP、Flip Chip、Bumping及Optical Package等領域研究開發，提供客戶新產品高品質之需求。

所以本集團每年提撥3~5%的營收在技術研發上，除了在市場佔有率領先競爭對手外，每年獲得超過百項專利，鞭策同仁也能在技術研發上維持領先同業。

(2) 掌握IDM大廠委外代工之脈動，積極佈局爭取

IDM大廠為維持半導體經營之效率，降低成本，必須朝向Fab Lite型態發展，已是多年來封裝委外代工比例增加的原因。而受到中美貿易戰影響，更迫使部分IDM大廠閉廠，將晶圓製造及封裝委外代工生產。本集團除了迎合不斷升溫的半導體委外代工趨勢，近年來的營運策略更為積極，接近客戶，接近市場，以充足的產能及領先的技術爭取潛在商機。如今本集團的佈局，已獲得更多IDM大廠合作封裝委外代工生產機會。

同時，本集團之封測事業群擁有先進的工程技術服務能力及彈性產能調配能力，再加上優越的供應鏈整合能力及穩定的人力資源，亦是本集團在封測產業上的競爭利基。

(3) 長期與國際大型品牌商建立了穩固的供應鏈合作夥伴關係，掌握市場需求變化及科技產業發展的主流趨勢

本集團已建立經驗豐富的專業管理團隊，具備先進的產品管理體系，取得各項國際標準認證。進而同時具備高效的供應鏈管理能力，可快速因應市場需求，建立成本競爭優勢。且產品組合豐富而平衡且科技含量較高，具備領先同業的工藝技術水準。

4. 發展遠景之有利/不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- 市場對新產品、新技術的需求逐漸增加，對一向在研發創新具備優勢的本集團而言是一大利多機會。
- IDM廠商的經營趨勢，持續釋出封測訂單，未來將持續帶給IC封裝測試產業更大的發揮空間與更多商機。
- 因應未來產品輕薄短小、高性能及高效率的需求，2.5D & 3D IC是非常重要的技術，而本集團早在幾年前已投入非常多的資源進行研發，相關的封裝技術更是領先同業。
- 身為台灣擁有基板產線的封測廠，擁有高階基板穩健的製造能力，不但可掌握高階封裝材料之關鍵，更可有效降低IC的整體製造成本，提高獲利能力。
- 除傳統之BGA、QFP、QFN封裝產品外，更多高階產品如晶片組、繪圖晶片、光電產品、無線通訊模組等相關晶片，以及潛在顧客等皆具有更大更深之市場可供開發。
- 未來幾年中國大陸對積體電路的需求仍會有大幅成長，基於群聚效應、供應鏈原則，本集團已在地理位置及資源運用方面之佈局作好準備，迎接這波成長及搶先商機。
- 維持技術先進、良率高而穩定的生產條件，將有利於承接封裝之業務。
- 由於對電子產品的可攜性和小型化的需求，客戶對微小化技術的需求逐漸增加，對一直在微小化技術方面持續投入研發和具備實際量產經驗優勢的子公司環電公司而言將有更多機會。
- 國際大型品牌廠商的經營趨勢，持續釋出代工訂單，未來將持續帶給電子代工產業更大的發揮空間與更多商機。

(2) 不利因素

- 本土同業競爭者對爭取客戶相當積極；另外，競爭者的聯盟機制亦有可能產生影響。
- 新技術的門檻逐漸下降，競爭者的模仿能力逐漸提升且產品的獲利週期逐漸縮短，對一向以技術取得優勢的本集團是一項外在威脅；由於新技術的研發需投入大量的資金與人力，因此在後續價格上的變動彈性相對較弱，在微利時

代下，實為一項挑戰。

- 客戶端對於IC後段封裝、測試之要求水準日益嚴苛，業務成長如要有顯著的表現就必須超越競爭對手及客戶的期待。
- 半導體後段的封裝、測試屬高資本密集產業，因而受到半導體市場景氣影響甚鉅，營運的優劣易受景氣所影響；IC封裝與測試產業需審慎評估投資計畫及人員、機台、資金與技術的規劃，以彈性因應景氣繁榮時所帶來大量的訂單以及不景氣時訂單減少的衝擊。
- 未來封測需求可望持續成長，然而資本市場、匯率、原物料價格等波動為未來之隱憂。面對中國對半導體產業的扶植，競爭將更加白熱化。因而，對於貿易保護主義所帶來的衝擊，也不容小覷。
- 客戶端對於電子製造服務之品質及成本之要求嚴苛，子公司環電公司需要更努力實現超越競爭對手並符合客戶期待的優異表現。

(3) 因應對策

- 利用整合優勢以提供一元化服務、整合集團資源、技術互享以創造更多附加價值及更大的經濟效益，強化競爭優勢以爭取未來市場蓬勃時更多商機。
- 藉由本集團特有的先進製程與彈性產能以及多元的生產線，滿足客戶更多新產品、新技術以及大量、即時的需求。
- 穩健的財務結構對於發展新技術、新產品所需的資金提供穩定及充足的資源。
- 利用技術優勢改進設計缺失，建立最佳化製程，提升製程穩定性，強化在成本和品質方面的競爭力，爭取最大的市場契機。
- 憑藉先進技術的優勢、資本優勢、資源整合優勢來深耕現有客戶以及爭取更多潛在客源，擴大業務版圖。
- 確切發揮跨廠區先進技術交流及跨部門協調之功能，提高綜效。
- 本集團在材料、封裝、測試及系統方面的垂直整合及橫向鏈結合作，除可鞏固競爭力、提供更完善的服務外，更具備最佳彈性以隨時調整與迎接外在多變的挑戰。
- 持續強化技術優勢，依客戶不同特性提供與滿足客戶多元的需求，提升服務品質的競爭力，同時建立專利防護網，鞏固競爭利基。
- 提升客戶對一元化服務的訂單比例，加快解決方案整合速度，以最完整的架構提供客戶最快速與滿意的服務。
- 強化業務行銷活動與客戶關係。
- 開發符合市場趨勢的封測技術與產品。
- 建構有利採購的供應環境降低採購成本。
- 改善產品的設計及材料規格。
- 藉由子公司環電公司特有的先進製程與彈性產能以及多元的生產線，滿足客戶更多新產品、新技術以及大量、即時的需求。
- 加快國際化擴張步伐，擴充中國大陸區域外的工廠產能。此外，通過企業併購方式，收購同業優秀公司，發揮企業整合綜效，實現外延式成長。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 投資業：不適用。

2. 封測業：

(1) 主要產品之重要用途：

封裝技術

主要產品	重要用途
• 塑膠立體型積體電路(PDIP)	◆ 主要用途在於家電用品、通訊設備、汽車元件、飛機、武器和太空梭等電腦遙控資訊系統、導航設備。

主要產品	重要用途
• 塑膠晶粒承載器積體電路(PLCC) • 平面型塑膠晶粒承載器積體電路(QFP) • 凸塊晶片承載器積體電路(BCC) • 覆晶(Flip Chip)封裝技術 • 超薄平面型塑膠晶粒承載器積體電路(LQFP、TQFP) • 球型陣格承載器積體電路(BGA、TFBGA、LBGA) • 覆晶式球型陣格承載器積體電路(FC BGA、HFC BGA) • 散熱增益球型陣格承載器積體電路(TE BGA) • 超薄球型陣格承載器積體電路(VF BGA) • 無引腳型陣格承載器積體電路(LGA) • 外露晶片四邊平面形積體電路(Exposed Pad QFP) • 散熱增益球型陣格承載器積體電路(HSBGA) • 扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(QFN) • 覆晶式晶片尺寸封裝(Flip Chip CSP)	◆ 個人電腦、筆記型電腦、平板電腦、智慧手機、智慧型手持式裝置等。 ◆ 電腦—繪圖/晶片卡、雲端運算伺服器、PCS&伺服器微處理器、電壓調節器、快速記憶卡、硬碟等週邊產品。 ◆ 微處理機、通訊設備、無線通訊網路等。 ◆ 網路通訊產品—廣域(WAN)與區域網路(LAN)伺服器、轉換器、交換器、路由器、蜂巢式基地台。 ◆ 消費性產品—攝錄影機、數位相機、DVD、電視遊樂器、數位電視機上盒、PDA、MID、資訊家電。 ◆ 其他產品—自動汽車元件、Telematics。
• 小型晶粒承載器積體電路(SOP、SOJ) • 超薄小型晶粒承載器積體電路(TSOP) • 晶片尺寸堆疊式球型陣格承載器積體電路(SCSP)	◆ 記憶體積體電路。 ◆ 個人電腦與週邊裝備等。
• 立體式晶片模組承載器積體電路(3D Package) • 立體式晶片模組承載器積體電路(2.5D Package) • 晶片堆疊式球狀陣格承載器積體電路(Stacked BGA) • 多晶片模組球狀陣格承載器積體電路(MCM BGA)	◆ 各種可移動式的資訊產品，例如：手機、IoT、物聯網元件等。 ◆ 高階與雲端運算伺服器，例如：圖形處理器、網路處理器等。 ◆ 筆記型電腦與個人電腦之硬碟等。
• 面板級晶片尺寸封裝(Panell Level CSP) • 晶圓級晶片尺寸封裝(Wafer Level CSP) • 覆晶式晶片尺寸封裝(Flip Chip CSP) • 晶圓穿導孔技術(TSV Technology) • 整合被動元件(IPD) • 矽質基板(Si Interposer) • 晶圓級微機電(Wafer Level MEMS) • 微間距晶片堆疊系統技術(Fine Pitch 3D Chip Stacking Technology) • 異質晶片整合系統封裝(Heterogeneous Chip Integration SiP) • 微間距面對面堆疊系統封裝(Fine Pitch CoC SiP Solution) • 基板內埋主、被動元件技術(Embedded Active / Passive Substrate) • 電子羅盤磁感應器封裝技術(eCompass Magnetic Sensor Package)	◆ 手機、NB、數位相機、IoT、物聯網元件、生醫照護等。 ◆ 穿戴式/可攜式消費性電子、Game Console遊戲機。 ◆ Network、Network Server、Server。
• 微機電型微顯示器(MEMS-Based Micro Display) • 安控感測元件 • DDR2 800記憶體(DDR2 800 Memory) • 外引腳式Map PoP堆疊技術(Fan-out Map PoP Technology) • 外引腳式WLP(Fan-out WLP) • 無線通訊模組(Wireless Connectivity SiP Module) • 無線通訊模組(Wireless Communication SiP Module) • 雙面封膠前端通訊模組(Double-Side Molded Front-end SiP Module) • 光通訊模組	◆ 投影機(Projector)、高解析數位電視(HDTV)。 ◆ 個人電腦、筆記型電腦、網路商業等安全辨識裝置。 ◆ 3C產品之記憶體。 ◆ 3C產品之系統封裝產品(ASIC + MCP Memory、BB+SDRAM)。 ◆ 可攜式消費電子、IoT。 ◆ 3C產品之無線通訊模組包括BT、Wi-Fi、GPS、DVB-H/T、智慧家庭、車用通訊、AR/VR裝置資料傳輸。 ◆ 筆記型電腦、個人平板、網通產品、IoT工業產品裝置之通訊應用。 ◆ 光收發模組、雲端伺服器、資料中心及高速運算伺服器之通訊應用。

測試技術

主要產品	重要用途
- 平面型塑膠晶粒承載器積體電路(QFP) - 凸塊晶片承載器積體電路(BCC) - 覆晶(Flip Chip)封裝技術 - 超薄平面型塑膠晶粒承載器積體電路(LQFP、TQFP) - 球型陣格承載器積體電路(BGA、TFBGA、LBGA) - 覆晶式球型陣格承載器積體電路(FC BGA、HFC BGA) - 散熱增益球型陣格承載器積體電路(TE BGA) - 超薄球型陣格承載器積體電路(VF BGA) - 無引腳型陣格承載器積體電路(LGA) - 外露晶片四邊平面形積體電路(Exposed Pad QFP) - 散熱增益球型陣格承載器積體電路(HSBGA) - 扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(QFN) - 進階陣格扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(aQFN) - 單層基板(Advance Single Sided Substrate) - 系統級封裝(System In Package)	◆ 主要用途在微處理器、通訊設備、自動汽車元件、個人電腦、手持式通訊模組、晶片組等。 ◆ 無線通訊網路、數位相機、資訊家電、液晶電視與智慧型行動電話等。 ◆ 個人電腦與筆記型電腦等。 ◆ 電視遊樂器、DVD、機上盒等。 ◆ 個人電腦、筆記型電腦、無線通訊網路、數位相機、資訊家電與智慧型行動電話等。 ◆ 手機晶片組、MP3 Processor。 ◆ 消費性產品—攝錄影機、數位相機、DVD、電視遊樂器、機上盒、PDA、MID。 ◆ 智慧型手機。 ◆ 穿戴式隨身產品。 ◆ 平板電腦。 ◆ 健康管理系統、醫療應用。 ◆ 商務應用、IoT 物聯網相關產品。 ◆ 車用安全系統。 ◆ 工業感測元件。
- 小型晶粒承載器積體電路(SOP、SOJ) - 超薄小型晶粒承載器積體電路(TSOP) - 晶片尺寸堆疊式球型陣格承載器積體電路(SCSP) - 光學扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(ODFN) - 光學無引腳型陣格承載器積體電路(OLGA)	◆ 主要用途在於記憶體積體電路。 ◆ 個人電腦與週邊設備等。 ◆ Power Management IC & Portable Device。 ◆ HPC Device。 ◆ 繪圖晶片組。

本集團主要製造服務(封裝及測試技術)重要用途涵蓋如下表：

主要製造服務	重要用途
整體性之積體電路封裝及測試服務	積體電路，廣泛應用於電腦、通訊、網路、消費性電子等產品，包括筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機、功能性手機、穿戴式裝置、智慧家電、機上盒、液晶電視、數位相機、遊戲機、物聯網、指紋辨識器、智能汽車、虛擬實境/擴增實境、人工智慧、無人機、語音助理等。

2. 產製過程：

主要製造服務之產製過程：



封裝技術

◆ 釘架類產品：

晶圓切割→粘晶粒→打金線→封模→正印→外腳成型→外觀檢驗→包裝

◆ 球陣列類產品：

晶圓切割→粘晶粒→打金線→封模→正印→植錫球→切割成型→外觀檢驗→包裝

◆ 覆晶類產品：

晶圓凸塊→晶圓切割→覆晶式粘晶粒→底膠充填→正印→植錫球→外觀檢驗→包裝

◆ 晶圓穿導孔類產品：

晶圓穿導孔→穿導孔絕緣層→穿導孔銅電鍍充填→穿孔晶圓薄化→雙面佈銅導線→植錫球→堆疊→外觀檢驗→包裝

◆ 無線通訊模組 (Wireless Connectivity SiP Module)：

錫膏印刷→元件置放→高溫迴焊→封膠製程→雷射正印→切割成型→抗電磁鍍膜→外觀檢驗→包裝

◆ 雙面封膠前端通訊模組(Double-Side Molded Front-end SiP Module)：

正面錫膏印刷→元件置放→高溫迴焊→正面封膠製程→雷射正印→背面錫膏印刷→元件置放→高溫迴焊→背面封膠製程→研磨薄化→切割成型→抗電磁鍍膜→外觀檢驗→包裝

測試技術

- 釘架類產品/球陣列類產品：

IC測試→產品老化測試(依客戶需求)→烘烤→產品外觀檢驗→捲帶包裝→成品包裝

- 高頻模組產品/電源管理模組產品：

測試系統選擇→開發程式→驗證及除錯→試產→量產

- 消費型真無線藍芽耳機模組：

測試原理建立→測試系統選擇→開發程式→驗證及除錯→試產→量產

- 光學感應產品/光學距離偵測模組：

測試原理建立→測試系統選擇→光學測試模組開發→開發程式→驗證及除錯→試產→量產

- 第六代無線網路測試模組：

測試原理建立→測試系統選擇→開發程式→驗證及除錯→試產→量產

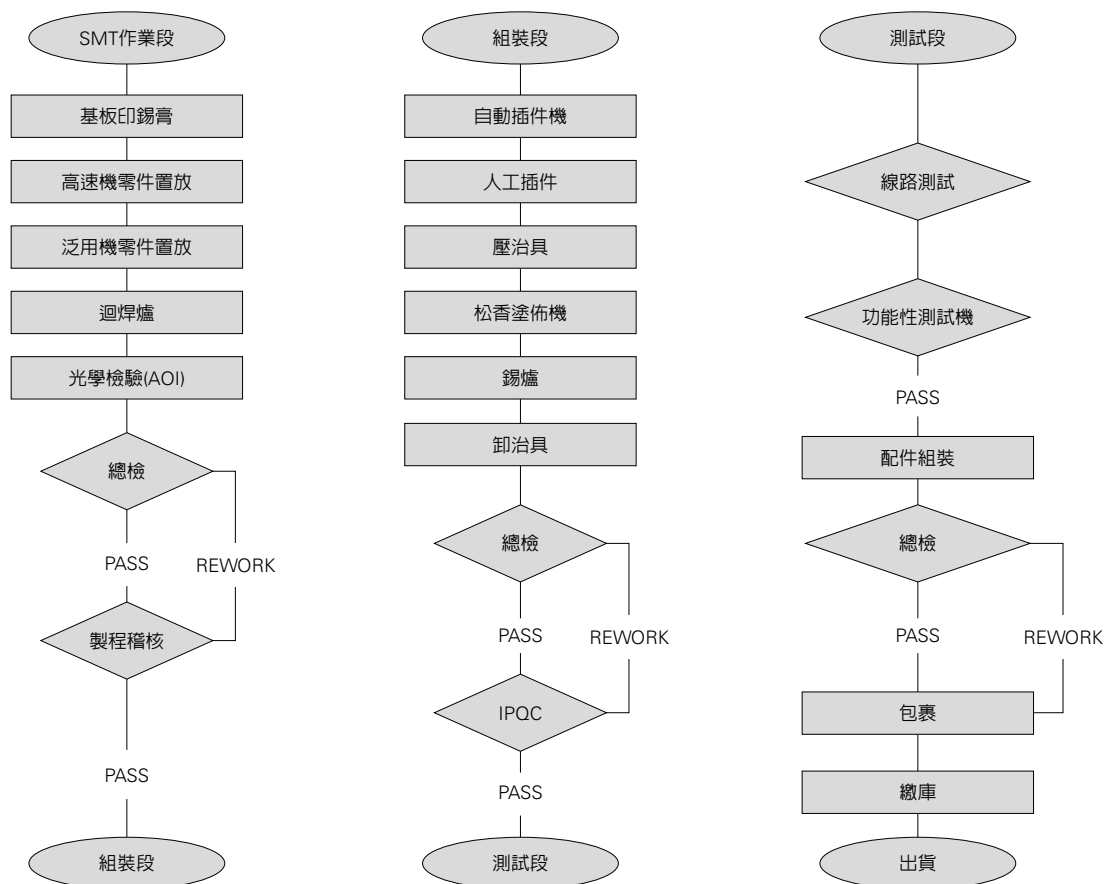
3. 電子製造服務業：

(1) 主要產品之重要用途：

主要產品	重要用途
無線通訊模組/SIP	手機、筆記型電腦、平板電腦、穿戴裝置
智能手持裝置	物流、零售行業用手持裝置
銷售時點情報系統(POS)	應用在零售業、餐飲業、旅館等行業的電子系統，主要功能在於統計商品的銷售、庫存與顧客購買行為
LCD控制板	液晶顯示器
固態硬碟(SSD)	個人電腦、筆記型電腦、伺服器
X-86主機板	桌上型PC及工作站和伺服器
車用LED照明系統	汽車照明

(2) 產製過程：

主要之產製過程則以SMT之應用為主：



(三) 主要原料之供應狀況

本集團係代客封裝之半導體製造業，主要晶圓由客戶提供，客戶大都為國際知名半導體公司，長期保持良好的業務關係。

封裝產業主要材料如：釘架、基板、金線、銅線、膠餅等，供應商皆為品管審查合格之績優廠商，尤其基板的主要供應來源為子公司日月光半導體(上海)有限公司(ASEMTL SH)、日月光電子(股)公司(ASEE)及其他基板製造公司等，使得材料的取得可完全掌握。

主要原物料名稱	供應來源	市場狀況	採購策略
基板 Substrate	ASEMTL SH/ ASEE /A公司/B公司/C公司	供需平衡/良好	長期配合廠商
釘架/導線架 Lead Frame	D公司/E公司/F公司/G公司/N公司	供需平衡/良好	長期配合廠商
金線 Gold Wire	H公司/I公司/O公司/M公司/O公司	供需平衡/良好	長期配合廠商
銅線 Copper Wire	J公司/Q公司/O公司/H公司/M公司	供需平衡/良好	長期配合廠商
膠餅/樹脂 Compound	D公司/K公司/L公司/N公司/P公司	供需平衡/良好	長期配合廠商

電子製造服務業主要原物料如下：印刷電路板、積體電路、記憶體、電腦機殼、陶瓷基板、油墨、半導體零件、機構零件、石英晶體等。供應商大多為ISO-9000認證合格之績優廠商，長期與子公司環電公司保持良好合作關係，同時依不同原物料採取不同的採購策略，以確保材料之取得具競爭的價格優勢，並採取分開供貨來源以分散取得風險，確保合理之成本、準確的交期與良好的品質。

(四) 最近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1. 本集團占銷貨百分之十以上之客戶名稱

單位：新台幣仟元

排名	110年度				109年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲公司	158,624,032	27.9	無	甲公司	145,952,908	30.6	無
	其他	411,373,101	72.1		其他	331,025,802	69.4	
	銷貨淨額	569,997,133	100.0		銷貨淨額	476,978,710	100.0	

增減變動原因：銷貨金額與比率變動主要隨客戶市占率變化而異。

2. 本集團占進貨百分之十以上之進貨廠商

單位：新台幣仟元

排名	110年度				109年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	AA公司	37,677,653	11.5	無	AA公司	30,878,253	11.0	無
2	BB公司	33,520,936	10.2	無				
	其他	256,931,833	78.3		其他	250,884,901	89.0	
	進貨淨額	328,130,422	100.0		進貨淨額	281,763,154	100.0	

(五) 本集團最近二年度生產量值表

單位：仟個/新台幣仟元

年度 生產量值 主要商品		110年度			109年度		
		產能	產量	產值	產能	產量	產值
封裝服務		78,923,123	71,819,623	202,558,435	63,646,546	57,805,373	175,414,411
測試服務(註1)		—	—	32,574,216	—	—	32,013,774
電子產品構裝技術暨製造服務		1,590,343	940,332	218,103,560	1,397,252	818,557	185,864,778
其他(註2)		—	—	6,392,145	—	—	5,701,479
合計		80,513,466	72,759,955	459,628,356	65,043,798	58,623,930	398,994,442

註1：係以測試時間為計價基礎，故擬不揭露數量。

註2：因數量單位不一致，亦不揭露數量。

(六) 本集團最近二年度銷售量值表

單位：仟個/新台幣仟元

年度 銷售量值 主要商品		110年度				109年度			
		內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
封裝服務		15,613,379	72,536,770	56,206,244	200,007,129	12,174,441	48,809,032	45,630,932	169,857,039
測試服務(註1)		—	7,510,403	—	42,468,333	—	3,520,849	—	43,750,225
電子產品構裝技術暨製造服務		80,760	11,137,619	859,572	228,350,648	83,290	9,301,496	735,267	195,389,173
其他(註2)		—	3,413,275	—	4,572,956	—	3,197,924	—	3,152,972
合計		15,694,139	94,598,067	57,065,816	475,399,066	12,257,731	64,829,301	46,366,199	412,149,409

註1：係以測試時間為計價基礎，故擬不揭露數量。

註2：因數量單位不一致，亦不揭露數量。

三、從業員工資料

(一) 組織

本集團基於能維持有利的競爭市場，培育優秀的工程人力資源，健全集團組織職能制度、確定組織功能及培養職務生涯等是刻不容緩的首要策略。

(二) 本集團最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

年度		109年度	110年度	111年2月28日
員工人數	技術職人員	29,070	28,094	28,226
	管理職人員	6,187	6,313	6,448
	事務職人員	7,937	6,825	6,880
	作業員	58,787	54,495	53,144
	合計	101,981	95,727	94,698
平均年歲		36.6	33.2	33.2
平均服務年資		7.6	7.1	7.2
學歷分布比率	博士	0.2	0.2	0.2
	碩士	7.9	7.7	7.9
	大專	47.5	47.8	48.5
	高中	35.2	33.5	32.4
	高中以下	9.2	10.8	11.0

四、環保支出資訊

(一) 說明最近年度及截至年報刊印日止，公司(本集團)因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)、處分之總額、未來因應對策及可能之支出。

- 111年度：截至年報刊印日止未有處分金額。
- 110年度：110年度處分之總額新台幣約16萬元。

子公司日月光公司：

K14B：高雄市政府環保局於110年4月22日來文(處分字號高市環局廢處字第40-110-030042號)說明永成環科股份有限公司於108年12月9日「取得甲級廢棄物處理機構同意設置變更暨試運轉計畫」同意核准收受67家事業產出事業廢棄物，惟查永成公司截止至109年7月1日收受非試運轉計畫核准事業共71家，與原核定之事業不符，另查子公司日月光公司自109年3月13日至109年3月17日共4筆聯單，廢棄物代碼為A-8801交由該公司處理，惟該公司係試營運階段，非合格之公民營處理機構，且子公司日月光公司亦非試運轉計畫核准事業，子公司日月光公司未委託合法處理機構處理，已違反廢棄物清理法第28條第1項規定。裁罰6萬。

未來因應對策：已於109年7月完成以下改善措施

- (1) 永成公司於4月24日向桃園市政府提出增補合作名單，並已將日月光納入，桃園市政府於109年7月7日審核通過。
- (2) 試運轉前先簽訂合作意向書。使廠商能有依據放入試運轉計畫。
- (3) 廢棄物合約簽訂針對試運轉計畫(處理廠商)提供完整試驗轉核可計畫書供審核。

子公司矽品公司：

項次	項目	案件一	案件二
1	違規廠區	中科廠	彰化廠
2	發文字號	中市環空字第1100096592號	彰環空字第1090073387號
3	違規日期	2020/10/15	2020/12/08
4	裁處日期	2021/09/13	2021/02/03
5	裁處主管機關	臺中市政府環境保護局	彰化縣政府環境保護局
6	違反法條	空氣污染防治法第22條第2項	空氣污染防治法第46條第1項

項次	項目	案件一	案件二
7	違反法規內容	公私場所經主管機關指定應自行或委託檢驗測定機構實施定期檢驗測定檢驗測定結果，應作成紀錄，並依規定向直轄市、縣(市)主管機關申報	黑煙不透光率排放標準：≤1.0m
8	處分內容	2019定期檢測未事前報備及事後登錄結果	黑煙不透光率超過法規標準
9	罰款/處分	罰鍰新臺幣100,000元	(1) 罰鍰新臺幣5,000元整 (2) 處環境講習1小時整
10	未來因應措施	(1) 將試車檢測數據登錄於定檢系統 (2) 建立控管機制：增加流程檢核表	(1) 排煙噴射系統定期保修 (2) 確保油量噴射及霧化狀況符合法規標準

(二) 說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來年度預計之重大環保資本支出。

子公司日月光公司：

項目	一一一年度	一一二年度
擬採行改善措施部分		
1. 改善計劃	(1) ISO14001環境管理系統持續驗證 (2) 持續配合ISO14064溫室氣體管理系統運作，進行溫室氣體減量 (3) 持續推行 ISO 50001 能源管理系統 (4) 持續推行產品碳足跡之盤查及查證 (5) ISO46001水資源效率管理系統驗證與教育訓練 (6) 持續推動搭乘大眾捷運系統減少耗能與CO ₂ 減量 (7) 節能產品導入與節能工程改善 (8) 廢水防治設備清理與改善，並強化廢水回收量與效益 (9) 鼓風機震動噪音改善工程 (10) 廢水處理砂塔、活性碳塔濾料更換 (11) 高效率污染防治設施建置 (12) 廢氣防制設備填充料更換與VOC減量 (13) 廢棄物減廢、減量與回收再利用 (14) 污泥減重、減量與金屬成份回收再利用 (15) 化學品使用量最佳化 (16) 周界臭味防範及噪音防制強化 (17) 緊急應變訓練與演練 (18) 環保月、節水節能月活動 (19) 新設廢氣洗滌塔 (20) 廢膠條回收再製二氧化碳 (21) 含錫廢液集中處理純化再製原料 (22) 空污防制最佳可行處理設備評估導入 (23) 新設廢水回收系統 (24) 包裝材重複使用 (25) 廢塑膠中心集中處理 (26) 既設冷凝水洗設備保養 (27) 既設沸石轉輪+旋轉式蓄熱燃燒爐保養 (28) 地下管路維護與管理 (29) 節水新技術導入與節水擴充工程 (30) 廢水處理廠監控儀器定期維護 (31) 洗滌塔自來水用水減量-使用冷卻水塔排放水 (32) 新設電漿設備妥善處理製程CF4廢氣 (33) 人員作業環境氣味改善的相關管路及設備建置 (34) 空污防治設備各項運轉指標連線監測與管控 (35) 水務化學槽車填裝驗收E化平台建置 (36) 廢塑膠再製垃圾袋回用 (37) 含銅廢液產品化 (38) 新設集塵機 (39) 既設廢氣洗滌塔填充料更換 (40) 新設製程廢水處理系統 (41) 相關廢水處理設施維護保養	(1) ISO14001環境管理系統持續驗證 (2) 持續配合ISO14064溫室氣體管理系統運作，進行溫室氣體減量 (3) 持續推行 ISO 50001 能源管理系統 (4) 持續推行產品碳足跡之盤查及查證 (5) 持續推行ISO46001水資源效率管理系統驗證與教育訓練 (6) 持續推動搭乘大眾捷運系統減少耗能與CO ₂ 減量 (7) 節能產品導入與節能工程改善 (8) 廢水防治設備清理與改善，並強化廢水回收量與效益 (9) 鼓風機震動噪音改善工程 (10) 廢水處理砂塔、活性碳塔濾料更換 (11) 高效率污染防治設施建置 (12) 廢氣防制設備填充料更換與VOC減量 (13) 廢棄物減廢、減量與回收再利用 (14) 污泥減重、減量與金屬成份回收再利用 (15) 化學品使用量最佳化 (16) 周界臭味防範及噪音防制強化 (17) 緊急應變訓練與演練 (18) 環保月、節水節能月活動 (19) 廢塑膠SRF應用 (20) HEPA濾網再生使用 (21) 洗滌塔自來水用水減量 (22) 空污防制最佳可行處理設備評估導入 (23) 新設廢水回收系統 (24) 包裝材重複使用 (25) 既設冷凝水洗設備保養 (26) 既設沸石轉輪+旋轉式蓄熱燃燒爐保養 (27) 地下管路維護與管理 (28) 廢水處理廠監控儀器定期維護 (29) 新設電漿設備妥善處理製程CF4廢氣 (30) 固定污染源空氣污染物連續自動監測設施 (31) 新設集塵機 (32) 既設廢氣洗滌塔填充料更換 (33) 相關廢水處理設施維護保養 (34) 新設製程廢水處理系統 (35) 新設廢氣洗滌塔

項目	一一一年度	一一二年度
2. 未來二年預計環保資本支出擬購置之污染設備或支出內容	(1) 各部門自發性改善方案推動 (2) 中水回收系統改善及擴充 (3) 廢水/廢氣防治設備新增與改善 (4) 低頻噪音防制工程 (5) 環保設備汰換 (6) 廢棄物回收推動及減量設備建置 (7) 使用省電燈具及綠色能源導入 (8) 能源管理監控系統設置 (9) 廢氣洗滌塔 (10) 廢水回收、過濾、蒸餾、燭式過濾設備 (11) 污泥乾燥設備 (12) 最佳空污防制可行處理設備 (13) 高級氧化處理設備 (14) 集塵器 (15) 既設沸石轉輪設備	(1) 各部門自發性改善方案推動 (2) 廢水/廢氣防治設備新增與改善 (3) 低頻噪音防制工程 (4) 環保設備汰換 (5) 廢棄物回收推動及減量設備建置 (6) 使用省電燈具及綠色能源導入 (7) 能源管理監控系統設置 (8) 廢氣洗滌塔 (9) 廢水回收、過濾、蒸餾、燭式過濾設備 (10) 污泥乾燥設備 (11) 最佳空污防制可行處理設備 (12) 高級氧化處理設備 (13) 集塵器 (14) 既設沸石轉輪設備
預計改善情形	(1) 減少耗能與CO ₂ 減量 (2) 防範周界臭味 (3) 延長設備使用壽命 (4) 廢水/廢棄物/空污污染減量及資源回收 (5) 降低周界噪音 (6) 減少能源耗用 (7) 提升工廠用水效率 (8) 水資源回收/減少用水量 (9) 污染預防及監控	(1) 減少耗能與CO ₂ 減量 (2) 防範周界臭味 (3) 延長設備使用壽命 (4) 廢水/廢棄物/空污污染減量及資源回收 (5) 降低周界噪音 (6) 減少能源耗用 (7) 提升工廠用水效率 (8) 水資源回收/減少用水量 (9) 污染預防及監控 (10) 廢水回收全廠>80%
支出金額	NT\$1,859,159仟元	NT\$1,841,803仟元
3. 改善後之影響		
對淨利之影響	企業社會責任與永續發展無法預估實際對淨利影響	企業社會責任與永續發展無法預估實際對淨利影響
對競爭地位之影響	企業社會責任與永續發展。對環境友善的環保政策提昇公司之企業形象，符合廣大投資人對於公司永續發展的目標。	企業社會責任與永續發展。對環境友善的環保政策提昇公司之企業形象，符合廣大投資人對於公司永續發展的目標。
未採取因應對策部分	不適用	不適用

子公司矽品公司：

項目	一一一及一一二年度
擬採行改善措施部分	
1. 改善計畫	(1) 空氣污染防治 a. 依廢氣屬性分別設置專有污染防制設備。 b. 依計畫執行定期保養維護，提昇設備穩定性，確保排氣符合法規要求。 c. 每年實施設備異常演練，降低設備異常造成之環境衝擊。 d. 由定期檢測結果顯示，各項污染物濃度均遠低於法規限值。 (2) 水污染防治與水資源回收再利用 a. 依廢水性質，分流收集處理，分別設置專有處理設備、提昇處理效率。 b. 訂定較放流水標準嚴格之警戒值，並定期進行廠內採樣自檢，以達到異常時早期預警的功能。 c. 放流水水質定期檢測結果顯示，各項污染物濃度均遠低於法規限值。 d. 子公司矽品公司除了訂有廢水處理異常應變程序外，也定期實施演練，以減少廢水處理異常對環境之衝擊。 e. 對於可回收再利用的排放水(如純水系統排放水、空調冷凝水、研磨及切單廢水等)皆設置回收系統來重複使用，以提高水資源之使用率。 (3) 廢棄物管理 a. 廢棄物處理原則：優先資源化及回收再利用為優先，次為焚化處理，使有效減少體積並能回收熱能發電。 b. 目前執行回收再利用的有：廢紙、廢玻璃、廢塑膠、廢鐵、廢樹脂屑、廢溶劑、下腳品、導線架包裝材、廢電鍍液及去光阻液等。 c. 訂定清理廠商稽核計畫及評分汰換制度，並定期或不定期進行法規符合度的稽核。 (4) 節能減碳管理 a. 不斷提升能源使用效率，以減少能源耗用，同時也降低溫室氣體(GHG)排放量。 b. 102年導入ISO 50001能源管理系統並通過驗證，期能更有效落實能源管理。 c. 每年持續推動節能方案。 (5) 安全衛生管理 a. 以安全與衛生法令規定為基礎，並導入國際安全衛生管理系統，進行安全與衛生管理。 b. 通過ISO 45001職業安全衛生管理系統、臺灣職業安全衛生管理系統(CNS 45001)驗證及績效認可，安全衛生管理已達到國際標準，提供員工健康、舒適，且安全無虞的工作環境保障。

項目	一一一及一一二年度
2. 預計支出金額	預計總支出為1,111,451仟元如下： (1) 111年因應生產線擴增，增設水回收設備及廢水處理設施、擴充廢氣處理設施，預計增加資本支出794,051仟元。 (2) 112年因應生產線擴增，增設廢水處理設施、新增及擴充廢氣處理設施，預計增加資本支出317,400仟元。
3. 改善後之影響	(1) 空氣污染防治方面110年減少約248噸之揮發性有機物(VOCs)排放。 (2) 水污染防治與水資源回收再利用方面110年水回收量達11,120,666噸以上。 (3) 廢棄物管理方面110年一般廢棄物回收再利用率達97%以上。 (4) 節能減碳管理方面110年實施管理措施產生約28,045仟度節電量約減少14,079噸CO ₂ 當量排放量。

子公司環電公司：

項目	一一一年度	一一二年度
擬採行改善措施部分		
1. 改善計畫	(1) ISO14001環境管理系統持續驗證 (2) 持續配合ISO14064溫室氣體管理系統運作，進行溫室氣體減量 (3) 持續推行ISO 50001能源管理系統 (4) 產品碳足跡認證 (5) 持續致力推動本公司永續發展 (6) 持續推動節能改善 (7) 廢水防治設備維護、清理與改善 (8) 廢氣防制設備維護與VOC減量 (9) 廢棄物減廢、減量與回收再利用 (10) 緊急應變訓練與演練及環境預案 (11) 噪音防制監控及強化 (12) 環保審批許可辦理 (13) 南崗廠區建置水電錶連線管理系統 (14) 南崗廠區域幫浦增加變頻器 (15) 中國廠區對於清洗劑、油墨及膠類含有的揮發性有機物質揮發量進行管制	(1) ISO14001環境管理系統持續驗證 (2) 持續配合ISO14064溫室氣體管理系統運作，進行溫室氣體減量 (3) 持續推行ISO 50001能源管理系統 (4) 產品碳足跡認證 (5) 持續致力推動本公司永續發展 (6) 持續推動節能改善 (7) 廢水防治設備維護、清理與改善 (8) 廢氣防制設備維護與VOC減量 (9) 廢棄物減廢、減量與回收再利用 (10) 緊急應變訓練與演練及環境預案 (11) 噪音防制監控及強化 (12) 環保審批許可辦理 (13) 南崗廠取得清潔生產認證及綠色工廠證書
2. 未來二年預計環保資本支出擬購置之污染設備或支出內容	(1) 各部門自發性改善方案推動 (2) 環保設備改善、維護及汰換 (3) 廢棄物回收推動及減量 (4) 使用再生能源或憑證購買 (5) 製程廢水回收再利用設備改善、維護及汰換 (6) 氣候相關財務揭露(TCFD)機制建置	(1) 各部門自發性改善方案推動 (2) 環保設備改善、維護及汰換，含： A. 張江廠計畫在A棟排氣筒內增加初效濾網以減少廠區顆粒物的排放 B. 南崗廠建置空氣污染防治設施 C. 草屯廠建置排氣管道集氣設備 (3) 廢棄物回收推動及減量 (4) 使用再生能源或憑證購買 (5) 製程廢水回收再利用設備改善、維護及汰換，包含： A. 張江廠增加B棟RO濃水回收系統 B. 南崗廠製程廢水回收再利用 (6) 節能設備汰換及改善，含： A. 昆山廠空壓系統改善計劃 B. 南崗廠冰水主機、空壓機、乾燥機、迴焊爐等設備汰換 C. 草屯二廠更換變頻真空機
預計改善情形	(1) 減少耗能與CO ₂ 減量 (2) 延長設備使用壽命 (3) 廢水/廢棄物/空污污染減量及資源回收 (4) 水資源回收/減少用水量 (5) 污染預防及監控	(1) 減少耗能與CO ₂ 減量 (2) 延長設備使用壽命 (3) 廢水/廢棄物/空污污染減量及資源回收 (4) 水資源回收/減少用水量 (5) 污染預防及監控
支出金額	NT\$ 111,754 仟元	NT\$ 255,530 仟元
3. 改善後之影響		
對淨利之影響	企業社會責任與永續發展無法預估實際對淨利影響	企業社會責任與永續發展無法預估實際對淨利影響
對競爭地位之影響	企業社會責任與永續發展。對環境友善的環保政策提昇公司之企業形象，符合廣大投資人對於公司永續發展的目標。	企業社會責任與永續發展。對環境友善的環保政策提昇公司之企業形象，符合廣大投資人對於公司永續發展的目標。
未採取因應對策部分	不適用	不適用

五、勞資關係

(一) 員工福利措施

本集團體認勞資一體的關係，全面加強福利文康設施，舉凡圖書館、社團活動、年度旅遊、文康競賽等，使得集團內員工均有調劑身心的機會，並加強有關員工福利及勞資關係的措施如下：

- 免費提供員工及眷屬團體醫療保險。
- 全面改善廠房的安全衛生以保持清潔舒適的環境。
- 定期或不定期勞資溝通會議及定期新人溝通會議。
- 成立廠區環境安全衛生委員會。
- 成立職工福利委員會辦理各項員工福利、推行自選式福利制度。
- 多樣化員工自助餐廳、提供優惠之便利商店及咖啡館。
- 結婚禮金、生育補助、喪葬津貼、住院慰問金及獎助學金。
- 員工急難救助。
- 完善的退休制度。
- 員工健康檢查。
- 股票及現金紅利。
- 三節福利金發放。
- 員工旅遊及多元商品選購。
- 因公出差員工享有旅行平安保險600萬元~1,500萬元不等。
- 國定假日免費供餐。
- 設有職工休閒健身中心。
- 設有員工健康診所及健檢中心，並定期舉辦健康檢查及健康促進活動，幫助同仁掌握自己的健康狀況並提升健康知識。
- 員工認股權憑證。
- 設置舒適且設備充足的女性員工集乳室。
- 多元社團活動，並舉辦藝文講座、音樂及電影欣賞、運動競賽、家庭日等系列親子活動，讓員工兼顧工作與生活平衡和樂趣。
- 員工按摩室。
- 員工關懷溫暖屋(含：個別諮商室、團體諮商空間、個案研討空間)。
- 軟性講座活動。
- 設置馬上辦系統，及時解決同仁對於公共設施、民生問題之意見。
- 員工上下班交通車、電動捷運接駁車、跨廠區移動電動接駁車。
- 設置綠能專用車位、電動共享機車、電動機車電池交換站、電動機車充電站。
- 提供功能齊全且溫馨舒適的員工宿舍。
- 推動特約商店給予員工優惠，並提供多樣之提貨券、禮券、餐券、文藝票券等供選擇。
- 提供多元駐廠服務如銀行、保險、旅遊、報稅、商品特賣會等。
- 與多所幼稚園簽訂特約，提供優惠及客製化的托兒服務。
- 提供汽/機車停車場，建置車牌辨識系統提升停車服務，解決員工停車問題並設有愛心車位提供懷孕、行動不便的同仁使用。
- 生產醫療用口罩，無償提供員工防疫使用，建構安心與舒適的生活職場環境。
- 高雄廠區建置三好幼兒園，提供優質的教保及托育服務，使員工安心工作及讓員工子女享受優質的托育學習環境。

(二) 員工進修及其實施情形

- 每年計劃性安排員工專屬的在職進修計畫，增強所需專業能力。
- 員工在職進修取得相關科系學歷者，可參加學歷升級考試，並予以實質調薪鼓勵。
- 提供員工建教合作學校管道，辦理「勞動部」雙軌訓練旗艦計劃。
- 提供員工終身學習管道，辦理「在職產碩專班」，擴展工程人才發展多元化。
- 為培育半導體人才並獎勵高雄地區優秀學子，提供「菁英培育獎學金」，作為獎助優秀學生努力向學，俾能減少其工讀時間，專心研讀促進學業進步。
- 提供「大四實習計劃」，推展實習合作教學與實務訓練，培訓科技專才。

(三) 員工訓練及其實施情形

- 積極提供現有人才之職涯管理、訓練，以培育人才未來發展，促進公司專業技術能力提升。
- 提供新進員工職前引導訓練、專業訓練及新人評鑑。落實新人訓練與照顧及展開各單位專業訓練、協助同仁勝任工作。已建置標準化訓練流程。
- 設計與執行主管管理技能訓練與職能發展，培養組織所需管理人才。
- 設計與執行工程師專業技術訓練。
- 提供在職人員專業技能與第二專長訓練。
- 培育公司內部專業講師與訓練師。
- 依公司目標、組織功能與個人職務需求建置訓練體系，提供核心課程、選修課程、年度策略課程及語文能力培訓課程。
- 規劃多元的線上學習環境，打破時間、空間的限制，讓同仁能依需求即時學習，激發同仁自主學習的精神，深耕人才競爭優勢。
- 建立員工自己的學習藍圖，遵循各子公司的培養策略。同仁可以依照其專業技能或等級而加入不同的課程。
- 各種學習模型和完善的訓練架構提供豐富的職場外教育訓練、在職教育訓練及自我發展。透過電子學習架構和系統，每個同仁都能夠參與及組織，創造最大的利益和價值。
- 設計與執行工安環保相關訓練。
- 提供員工參與外訓或研討會。
- 本公司訂定「外訓暨證照補助管理辦法」，提供員工外訓(部門派外受訓)以及證照(個人自主學習補助)之補助，目的為提高員工素質且鼓勵員工自主學習，於工作之餘進修培養專業技術，強化個人專業職能，充實業務相關技能，並利用外部訓練資源提升技能以彌補內訓之不足。除訂定審核與課後回饋機制，結合外訓與出差電子申請系統，以達有效管理與外訓制度之推行。
- 自主學習補助每人兩年內依職等補助金額最多2~10萬元，採課後補助原則。證照需求提出並核可後，員工考取證照即可檢具相關證明申請補助。
- 本集團旗下子公司日月光公司於104年正式加入責任商業聯盟(Responsible Business Alliance, RBA, 舊稱EICC)，該子公司秉持著RBA準則及永續經營的理念，也為推動日月光與供應商共創永續供應鏈，110年度持續執行人員供應鏈教育訓練，落實RBA準則。目前該子公司高雄廠區受過RBA訓練之人員已超過2萬人，並已建立每年複訓一次的機制，定期更新最新法規訊息予員工。子公司矽品公司亦遵循RBA行為準則，每年辦理新進及在職同仁RBA通識訓練，目前該子公司受訓人數亦超過2萬人。子公司環電公司亦遵循RBA行為準則，目前該子公司受過RBA訓練之人員也超過2千人。
- 本公司及旗下子公司日月光與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形如下：內部稽核人員取得會計師考試及格證書1人、國際內部稽核協會所核發之國際內部稽核師證書者5人、國際電腦稽核協會所核發之國際電腦稽核師證書者3人。
- 子公司矽品公司與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形如下：中華民國會計師(CPA) 3人、美國會計師(US CPA) 1人、中國註冊會計師(CICPA) 1人、中華民國記帳士2人、國際內部稽核師(CIA) 1人、股務人員4人、企業內部控制基本能力測試 1人。

- 本集團110年度員工訓練費用合計新台幣24,249,982元。
- 本集團110年度舉辦之課堂訓練開班數超過2,020班次以上(含數位課程)，參與訓練總人次約37.3萬人，訓練總人時積超過46.1萬小時。
- 本集團110年度提供之訓練課程類別如下：
 - 新進人員訓練：包括新進人員到職前之訓練、基礎訓練及到職引導。
 - 工程人員訓練：包含問題分析、工程量測等能力。
 - 管理人員訓練：包含幹部能力培訓、中高階管理能力、語文能力等。
 - 通識性訓練：係指政府法令規定、公司政策要求等之訓練課程。
 - 職能別訓練：係指公司各單位所需之專業技能之訓練。

(四) 退休制度及實施情形

- 本集團遵照勞動基準法訂定勞工退休辦法，為選擇舊制退休金辦法之員工及選擇適用新制退休金辦法之原有員工的舊制保留年資，按原員工退休辦法退休金給付標準計算提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶。符合退休資格人員之退休金計算方式，悉由勞工退休準備金監督委員會依勞基法之規定辦理。
- 本集團遵照勞工退休金條例訂定之勞工新制退休辦法，每月依員工薪資6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶中，另員工亦得在每月薪資6%範圍內，個人自願另行提繳退休金，勞工個人自願提繳部分，得自當年度個人綜合所得總額中全數扣除。勞工於年滿60歲即可於個人退休金專戶請領退休金。
- 集團內大陸子公司依大陸社保制度，每月依法提撥足額比例存入個人社保帳戶，保障同仁的退休養老、門診醫療、大病醫療、生育基金、失業保險及住房公積金。
- 集團內美國子公司之員工退休辦法依美國401K規定，員工可按法定限額及年度董事會決議提撥金額，自願性提存薪資於個人退休基金帳戶，公司亦依員工提存數之特定比例相對提撥於個人退休基金帳戶。
- 退休條件：本集團遵循勞動基準法規定訂定勞工退休條件，並依集團內各子公司個別考量提供各種優退方案。
- 為退休員工精心製作之退休紀念品，表達對員工多年貢獻的感謝之意。

(五) 勞資協議情形

- 本公司遵循相關法規，維護員工權益，設有書面及電子化員工溝通管道，由專人處理；且各廠均定期召開員工座談會，員工可透過上述管道與公司進行雙向溝通，以維持勞資雙方良好和諧之互動，並確保員工之各項權益獲得公平合理的處理，無重大勞資糾紛之情事。
- 定期召開勞資會議，聽取員工意見，並持續改善各項福利措施。

(六) 各項員工權益維護措施

- 本公司均依勞基法及各項勞動法規執行員工管理政策，並定期依據法令更新內部管理規定，保障員工權益。
- 依性別工作平等法，提供性別平權及無性騷擾的工作環境。
- 建立員工定期溝通機制，以維持勞資雙方良好之關係。
- 建立全方位的員工健康照護措施，守護同仁職場之健康。
- 建構職場的全人照護機制，集團旗下子公司日月光公司設置日月光員工診所，方便同仁於廠內接受專業的醫療諮詢服務。
- 日月光員工診所與高雄榮總合作，提供一般內、外科門診、身心減壓門診、職災門診及戒菸門診、職業專科醫師臨廠服務、健檢報告諮詢、疫苗接種等服務。亦提供子宮頸抹片檢查、成人健檢、口腔癌篩檢、大腸癌篩檢、超音波檢查(腹部、子宮卵巢、甲狀腺、乳房、心臟)等服務，服務對象擴及同仁眷屬、關係企業員工及承攬商等。
- 每年實施優於法規的年度健康檢查項目，並有專科醫師每週臨廠服務(人因評估、健康報告諮詢、復工評估等)，以多元健康照護方案，全方位守護同仁職場之健康。
- 定期舉辦多元性的健康促進與衛教宣導活動，如減重班、健康講座，提升同仁自我健康意識與作為。
- 傳染病防疫宣導與防治並成立企業快篩站與新冠疫苗注射服務。

- 規劃全球廠區防疫組織，積極建構AI 防疫科技管理系統。
- 生產醫療用口罩，無償提供予日月光投控旗下台灣地區之員工做為防疫之用，建構安心與舒適的防疫新生活職場環境。
- 於各廠區設置多間哺乳室，設備齊全並定期清潔維護，方便哺乳同仁就近使用。
- 廠內建置按摩室，配有視障按摩師，照顧同仁身體健康的同時亦提供視障者穩定的就業機會。
- 安排減壓團體提供專業諮商，並持續培訓種子關懷員，建立人際安全網。
- 針對同仁需求，舉辦各式大、小型軟性講座以及手作紓壓活動。
- 本集團110年度平均薪酬調整情形：本集團政策為每年持續穩定地為直間接員工年度調薪。
- 因應眾多的員工人數，為了能夠在第一時間關懷同仁、掌握同仁心理調適狀況，逐年擴大培訓的角色，於2021年增加外籍女宿「宿管師」的課程，在疫情的挑戰下，傾聽隻身來台的移工聲音，給予輔導與回饋。

(七) 工作環境與員工人身安全之保護措施(本公司為保護員工免於受職業傷害所做之措施)：

- Bumping/WB/FC/Test廠通過ISO22301:2019營運持續管理系統認證
- 完成防疫BCP/駭客入侵資訊中斷與啟動手動作業演練
- 整合及優化企業營運風險評估系統
- 關鍵風險先期指標(KRI)機制建立
- 機台硬體防護強化執行改善
- 廠區生產設備安全廠處長交叉稽核
- 既有廠房損防強化改善
- 廠區損防妥善度聯合防火管理人交叉稽核
- 廠房火災延燒防護改善
- 辦理機台安全競賽與業界安衛交流講座
- 承攬商現場安全管理能力提升
- 承攬商高風險作業安全管制強化
- 高風險化學品跨Site溝通平台與源頭卡控機制建立
- 既有生產製程高風險化學品取代推動
- 化學品作業人員危害認知強化教育訓練
- 人因工程風險評估與舒適度調查
- 完成廠區人因工程高風險站點改善
- 廠區機台安全風險地圖建立
- 封測業機台安全白皮書擬訂與推廣
- 廠區危害即時監控平台規劃與建立
 - ◆ 化學品有害物環境濃度即時監控
 - ◆ 公共危險物品儲區火災即早預警
 - ◆ 游離輻射作業環境劑量即時監控
 - ◆ 單人作業區域AI生理監控導入
- 行政廠區行動巡檢E化全面導入
- 呼吸防護具個人領用系統建置
- 呼吸防護具使用人員生理評估與防護具密合度測試展開
- 工安月活動辦理
- 夜間指揮官指揮能力訓練及抽測

- 安全文化診斷評估調查
- 高階主管聯合安全訪查
- ISO45001、TOSHMS、RBA管理系統持續驗證
- 落實各部門危害鑑別與風險評估及強化各部門安全衛生改善方案
- 廠區工傷損失率列為績效指標
- 廠區工安/環保緊急應變演練及鑑測
- 導入化學品雲資料庫管理系統
- 設備、設施變更前需事先申請評估，以確保變更後符合安全規範，降低工傷發生
- 定期執行安全衛生專案檢查
- 每季針對生產設備進行安全及防誤裝置檢查
- 安全生產標準化認證
- 完成及通過新版ISO14001及RBA驗證

(八) 各項員工工作守則及倫理原則

- 員工應切實遵守法令、勞動契約、及公司相關之管理規範，秉持誠信、廉潔之原則執行職務，且應善盡機密保護責任、恪守保密與競業禁止義務，並以本公司之商譽與利益為重，不得從事任何妨礙本公司之聲譽、管理及營運等不當行為。
- 與主管有不同看法時，以「對事不對人」的態度，選擇適當時間、地點，與主管誠懇的溝通，勿在訪客或他人面前強烈的表示不同的意見。
- 會議須準時參加，不克出席應事先請代理人出席，並說明需準備之文件資料，並同時知會會議主持人。
- 與廠商開會若有跨越中晚餐時間，可以幫廠商代訂便當，再向公司報帳，勿與廠商外出交際應酬。
- 嚴禁私自攜帶公司產品、零件、貨品出加工區，出廠區物品務須配合保稅放行單，未依規定辦理者，經查獲依相關法令處理。
- 尊重公司名譽，凡涉及公司任何事項，未經許可，不得擅自對外發佈個人意見。
- 培養誠實與負責任的文化，在公司所有的營業活動上應遵循最高道德標準的承諾。
- 從業倫理及道德規範。
- 迴避利益衝突規範。
- 饋贈與招待規範。
- 舉報之責任與義務。
- 反歧視/反報復政策。
- 日月光資訊安全規範。
- 推動『陽光法案』其目的在防止因少數人收受賄賂、索取回扣、濫權、自肥等的違法舞弊行為，而影響到公司以及大多數員工的聲譽和利益，也辜負了彼此的信任。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額及因應措施：

子公司環電公司：

發文字號	違規日期	裁處日期	裁處主管機關	違反法條	違規原因	罰款(原幣別)或其他裁罰/處分	因應措施
府社勞資字第1100287453	2021/04	2021/12/10	南投縣政府	勞動基準法第32條第2項	延長工作時間超過法令規定	處罰鍰新台幣5萬元整	1. 與主管重申法令 2. 重申系統查詢功能，主管可匯出單位加班申報狀況加以管控

六、資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

資通安全風險管理架構	本公司於永續發展委員會下成立「日月光投控資安管理分組」，由張洪本副董事長擔任資安專責董事，綜理投控整體資安策略發展與資安成熟度評量對標，主責整體資安風險管理、督導各子公司資安管理運作、協調溝通內外部技術資源與情資。並設置資安長(CISO)一職，主責指示日月光投控資安風險管理架構、定期溝通檢討各子公司資安管理方案與事件應變，並於每年第四季向董事會報告資安治理情況。另由投控永續處擔任執行秘書負責推動與執行資安相關工作，各子公司委派資安團隊擔任分組成員，負責執行資安管理分組決議之資訊安全作業。
資通安全政策	本公司從公司治理角度出發，訂立「日月光投控資安安全政策」作為最高管理依據，確保公司重要資訊財產之機密性、完整性及可用性，符合相關法規與規範要求，進而獲得客戶信賴、提升公司競爭優勢，確保營運與重要業務的永續運作。
具體管理方案	本公司鑑別內外部資安相關風險與制定因應對策，每年定期執行所有廠區的 NIST CSF 資安成熟度評量，持續推動國內外廠區網路安全規劃和改善方案，以提升資安不同面向的能量與整體成熟度。同時，我們透過實施全體員工資安教育訓練提升員工資安意識，避免重大資安事件發生。本公司亦透過國際資訊安全標準持續嚴格檢視與優化資安工作流程與管理措施，日月光高雄廠、中壢廠、矽品大豐廠、中山廠、中科廠、彰化廠、新竹廠及環電台灣廠、張江廠、昆山廠、金橋廠、深圳廠、墨西哥廠已針對關鍵基礎設施持續營運所需之重要資訊系統陸續取得 ISMS 資訊安全管理系統 ISO 27001 認證外，日月光高雄廠和矽品也為強化危機管理及災害應變的管理機制取得 BCMS 營運持續管理系統 ISO 22301 認證，並逐步擴大驗證範圍，建立全面之資安管理系統。
投入資源	本公司每季定期召開投控資安管理分組會議，報告與討論投控資安工作進度，並邀請外部專家分享資安趨勢與重要議題。

子公司日月光公司：

資通安全風險管理架構	本公司加入於日月光投控永續發展委員會下成立的「資安管理分組」，與矽品集團資安團隊、環電集團資安團隊、大陸地區資安平台、海外地區資安平台共同擔任分組成員，定期每季參與投控資安管理分組會議，遵循資安管理分組制訂之管理目標與政策，負責配合與執行資訊安全相關工作。
資通安全政策	本公司遵循「日月光投控資安安全政策」作為最高管理依據，確保公司重要資訊財產之機密性、完整性及可用性，符合相關法規與規範要求，進而獲得客戶信賴、提升公司競爭優勢，確保營運與重要業務的永續運作。
具體管理方案	本公司每年定期執行所有廠區的 NIST CSF 資安成熟度評量，持續推動國內外廠區網路安全規劃和改善方案，以提升資安不同面向的能量與整體成熟度。同時，我們透過實施全體員工資安教育訓練提升員工資安意識，避免重大資安事件發生。本公司亦透過國際資訊安全標準持續嚴格檢視與優化資安工作流程與管理措施，日月光高雄廠、中壢廠已針對關鍵基礎設施持續營運所需之重要資訊系統陸續取得 ISMS 資訊安全管理系統 ISO 27001 認證外，日月光高雄廠也為強化危機管理及災害應變的管理機制取得 BCMS 營運持續管理系統 ISO 22301 認證，並逐步擴大驗證範圍，建立全面之資安管理系統。
投入資源	本公司每季定期參與投控資安管理分組會議，討論與交流投控整體資安工作進度與規劃。

子公司矽品公司：

資通安全風險管理架構	1. 本公司資訊處成立資訊安全工作小組，下轄資訊安全執行分組、資訊安全緊急處理分組及資訊安全查核分組，由資訊處最高主管擔任資訊安全管理制度管理代表。 2. 透過ISO27001(資訊安全管理制度)導入，強化資訊安全事件之應變處理能力，保護公司與客戶資訊資產之安全。 3. 定期執行資訊安全風險評鑑，由管理代表審查風險水準與風險處置作為之適切性。 4. 每年實行資訊安全稽核作業，由資訊安全執行分組執行改善追蹤，藉以落實資訊安全管理控制措施。 5. 定期召開資訊安全管理審查會議檢討資訊安全管理制度執行情形。 6. 本公司已通過ISO27001(資訊安全管理制度)第三方公正單位之稽核驗證。
資通安全政策	1. 已制定發行資訊安全管理目標及政策，並定期檢討修訂。 2. 定期針對資訊安全目標進行有效性量測及矯正預防措施。
具體管理方案與投入資源	1. 每年辦理資訊安全教育訓練及宣導作業，新進人員皆須簽定資通安全保密協定。 2. 委外廠商須簽定保密協議，以確保使用本公司的提供資訊服務或執行相關資訊業務者，有責任及義務保護其所取得或使用本公司之資訊資產，以防止遭未經授權存取、擅改、破壞或不當揭露。 3. 關鍵系統已建置適當的備份、備援與災難復原機制並定期演練，以維持其可用性。 4. 個人電腦均安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權的軟體。 5. 要求同仁帳號、密碼與權限應盡善保管與使用責任並定期更換密碼。 6. 已制定資訊安全事件的回應及通報標準程序，由資訊安全緊急應變分組負責資訊安全事件處置，以適當對資訊安全事件做即時處理，避免損害擴大。 7. 配合營運持續管理機制，並定期執行資安測試演練，維持其適用性。 8. 每年定期實施內部稽核，以確保資訊安全管理制度及各式資訊安全內部控管作為之有效性。 9. 每年持續通過ISO27001(資訊安全管理制度)第三方公正單位之稽核驗證，維持本公司資安管理制度有效性。

子公司環電公司：

鑑於資訊安全乃維繫各項服務安全運作之基礎，為確保公司具備共識並落實資訊安全的使命，本公司之子公司環旭電子股份有限公司成立資訊安全管理委員會，由資訊長、財務長、資訊安全長及副總經理／處長級以上主管擔任委員會成員，委員會底下設有資安管理代表，協助資訊安全委員會執行資訊安全事務。公司已於2020年取得ISO 27001：2013資訊安全認證，進一步落實集團之資訊安全管理。

資安政策及目標：

資訊安全目標為確保核心系統管理業務之機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)、可用性(Availability)與適法性(Compliance)，並依各階層與職能定義及量測資訊安全績效之量化指標，以確認資訊安全管理系統實施狀況，並能夠達成資訊安全目標：

1. 保護公司重要資訊資產，包括USI及客戶產品、製程技術、研發資訊與服務等，並維持其機密性、完整性及可用性。
2. 加強USI員工對於公司及客戶資訊資產保護責任的認知。
3. 確保各項業務服務之執行須符合當地相關法令或法規之要求。
4. 建構安全便利的資訊網路環境，保障員工免受內外部資安威脅。
5. 建立資訊安全永續計畫，確保企業持續運作。
6. 深度評估現有環境的安全程度並提高整體資訊安全成熟度。

資訊網路安全宣導及訓練課程：

公司制定《企業網路資訊安全管理辦法》，並導入先進持續威脅系統(Advanced Persistent Threat, APT)，以強化資安防護能力；透過定期的公告，要求員工遵守相關網路資訊安全規定及使用合法軟體，且資訊部門會不定期抽查是否有非法使用之情形，如有違反則依規定進行懲處。為更進一步加強內部人員資安思維，公司開設線上教學課程，員工需接受「資訊安全通識基礎課程」並通過課程測驗。資訊部門也會不定期實施郵件社交工程演練(釣魚信件演練)，以加強員工對釣魚信件的資安意識。

有鑑於資訊人員為公司資安把關的重要人物，皆需接受相關專業訓練，並且取得資安系統相關驗證，以系統化方式確保資訊安全，應付各種資安狀況，確保資安組織設計之有效性。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司無發生重大資通安全事件，同時我們制定了投控層級資安事件等級、通報與應變流程供各子公司遵循，以掌握資安事件的影響範圍並且將資安情資即時分享給各子公司，並且每年執行一次資安事件演練，以將企業整體營運受到的損傷降到最低，進而達到資安聯防。

子公司環電公司：

本公司之子公司Asteelflash Group(以下簡稱"AFG集團")於2021年4月2日在其公司官網部落格(<https://blog.asteelflash.com/blog>)發佈有關網路安全事件的新聞。2021年3月下旬，AFG集團在IT團隊的例行檢查中發現部分伺服器感染REvil勒索軟體，其採取防禦措施避免進一步傳播擴散，造成網路停機。

AFG集團發現伺服器被感染後，及時啟動應急回應措施，避免進一步傳播擴散，部分生產據點的產能受到影響。經過IT人員和外部安全顧問的努力，目前AFG集團的資訊系統已恢復正常，受影響的生產據點已全部恢復正常運營。截至目前為止，沒有證據表明本次網路攻擊造成任何資料被洩露或披露，AFG集團正與相關客戶保持密切合作。

經確認，AFG集團已購買資訊安全和防範網路攻擊的保險，AFG集團已就該網路安全事件通報保險公司及當地相關政府部門。本次網路安全事件造成的直接損失(伺服器恢復費用、停工損失等)和間接損失(產品交付延遲的客戶索賠及其他可能的索賠等)尚在查核確認中。損失確認後，AFG集團將按照保險合同的約定向保險公司申請理賠。就目前已知的情况，本次網路安全事件對AFG集團的經營未造成重大不利影響。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
土地租賃契約	經濟部加工出口區管理處	2013.02.01~2061.08.01	土地租賃	於租約有效期間內，不得轉作與業務不相關之用，且依約執行付款
專利契約	FUJITSU LIMITED	1998.04.13~2023.04.12	專利授權	於合約終止或取消五年內，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	FLIP CHIP INTERNATIONAL, LLC. (FOC/RDL) (ULCSP)	2008.03.07~所授權專利技術屆期為止	專利授權	於合約期滿前，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	Infineon Technologies AG	2007.11.06~2022.11.05	專利授權	於合約期滿前，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	Infineon Technologies AG	2013.04.11~所授權專利屆期為止	專利授權	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	矽品精密工業股份有限公司暨其關係企業	2009.05.10~所授權專利屆期為止	專利授權	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
技術與專利契約	TDK Corporation	2015.12.03與TDK SESUB技術相關之專利權與專門知識均消滅為止	技術與專利契約	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
技術移轉與授權契約	DECA TECHNOLOGIES INC.	2016.01.13~2026.01.13	技術與專利契約	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
工程承攬	聖暉工程科技股份有限公司	2021.07~2023.06	空調工程等9案	無
工程承攬	中源機電顧問股份有限公司	2021.07~2023.06	機電工程等5案	無
工程承攬	麗明營造股份有限公司	2021.07~2023.01	土建工程等5案	無
工程承攬	勝義發營造股份有限公司	2020.12~2021.10	土建工程等1案	無
工程承攬	中國二十冶	2021.05~2021.12	矽科廠房新建、廠務機電工程等4案	無
維護合約	愛德萬測試(中國)管理有限公司	2021.01~2021.12	測試機軟體/硬體維護1案	無
設備租賃	美商捷威三井租賃事業股份有限公司台北分公司	2021.01~2022.09	測試設備租賃2案	無
設備租賃	全球資產	2021.07~2023.11	測試設備租賃8案	無
設備租賃	新加坡商逸科亞	2020.03~2022.03	測試設備租賃1案	無
租賃合約	顏OO	2021.07~2031.06	廠房租賃	無
專利授權	矽品科技(蘇州)有限公司	2017.01~任一方向終止	矽品授權矽科專利項目	無
借款合同	矽品科技(蘇州)有限公司	2021.08~2022.08	資金借貸	無
借款合同	日月光投資控股股份有限公司	2021.12~2022.12	資金借貸	無
借款合同	日月光集成電路製造(中國)有限公司	2021.07~2022.07	資金借貸	無
銀行授信	兆豐等8家銀行	2021.04~2023.04	衍生性金融商品交易	無
銀行授信	花旗等2家銀行	2021.03~2022.11	衍生性金融商品交易	無
銀行授信	花旗等2家銀行	2020.06~2022.11	短期借款	無
銀行授信	花旗等7家銀行	2021.03~2023.02	短期借款	無
銀行授信	兆豐等6家銀行	2019.07~2029.07	中長期借款	維持若干財務比率
銀行授信	兆豐等3家銀行	2020.04~2024.10	中長期借款	無
專利契約	QUALCOMM Incorporated	2012.05.18~所授權專利屆期為止	專利授權	不得洩漏合約條款與條件予第三者(保密條款)
土地租賃	DINH VU INDUSTRIAL ZONE JOINT STOCK COMPANY	2020.08.03~ 2058.06.23	土地租賃及基礎建設使用權	限符合設廠目的範圍內使用
工程承攬	L&K ENGINEERING VIETNAM CO., LTD.	2020.12.16~至工程完工驗收且保固期滿	廠房新建工程	無
設備買賣	L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED.及L&K ENGINEERING VIETNAM CO., LTD.	2021.12.29~至完成驗收且保固期滿	廠房設備	無

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

1. 簡明資產負債表及綜合損益表資料-IFRSs

(1)合併簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

項目		年度	最近五年度財務資料(註1)				
			110年	109年	108年	107年	106年
流動資產			292,357,728	224,086,842(註3)	202,001,118	201,558,875	144,938,272
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動			2,019,812	1,741,134	1,770,775	1,597,323	—
備供出售金融資產-非流動			—	—	—	—	1,123,006
採用權益法之投資			17,320,791	12,976,666	12,171,589	9,277,389	48,689,265
不動產、廠房及設備			239,867,550	234,365,397(註3)	232,093,327	214,592,588	135,168,406
無形資產			75,980,315	79,765,019(註3)	78,567,023	80,216,341	11,341,359
其他資產			45,388,089	30,731,774(註3)	30,050,451	26,128,687	22,597,478
資產總額			672,934,285	583,666,832(註3)	556,654,283	533,371,203	363,857,786
流動負債	分配前		210,927,730	171,896,666	152,264,636	156,298,736	105,620,958
	分配後		(註2)	190,286,522	160,932,967	167,105,190	182,488,333
非流動負債			187,373,830	177,507,613(註3)	190,042,968	156,401,923	54,235,348
負債總額	分配前		398,301,560	349,404,279(註3)	342,307,604	312,700,659	159,856,306
	分配後		(註2)	367,794,135	350,975,935	323,507,113	236,723,681
歸屬於母公司業主之權益			260,076,714	218,635,019	200,968,723	203,023,354	190,801,543
股本			44,086,502	43,515,920	43,305,287	43,217,144	87,380,787
資本公積	分配前		143,691,717	139,766,099	138,908,912	143,275,213	40,622,877
	分配後		(註2)	139,766,099	138,908,912	143,275,213	12,035,123
保留盈餘	分配前		91,318,899	46,881,134	31,561,328	25,392,886	76,406,530
	分配後		(註2)	28,491,278	22,892,997	14,586,432	28,126,909
其他權益			(11,532,042)	(9,569,027)	(10,847,697)	(6,902,782)	(6,316,138)
庫藏股票			(7,488,362)	(1,959,107)	(1,959,107)	(1,959,107)	(7,292,513)
非控制權益			14,556,011	15,627,534(註3)	13,377,956	17,647,190	13,199,937
權益總額	分配前		274,632,725	234,262,553(註3)	214,346,679	220,670,544	204,001,480
	分配後		(註2)	215,872,697	205,678,348	209,864,090	127,134,105

註1：a. 最近年度財務報告已由會計師查核簽證。

b. 最近年度未曾辦理資產重估。

c. 依日月光公司及矽品公司雙方董事會決議通過簽署之共同轉換股份協議，日月光投資控股公司被視為共同控制下之組織重組，實質上係日月光公司之延續，故107年以前年度之財務資料係以日月光公司合併財務報告之內容為並列揭露基礎。

註2：截至年報刊印日止，本公司——年盈餘分派之董事會尚未召開，是以分配後金額暫不填列。

註3：截至110年12月31日止，本集團已完成投資成本與所享有FAFG可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識，並追溯調整109年度財務報告。

(2)個體簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料(註1)				
		110年	109年	108年	107年	106年
流動資產		368,057	235,946	233,937	99,192	—
採用權益法之投資		338,834,820	298,439,139	294,010,046	296,976,191	190,801,543
無形資產		20,577	4,748	—	—	—
其他資產		7,929	—	—	—	—
資產總額		339,231,383	298,679,833	294,243,983	297,075,383	190,801,543
流動負債	分配前	19,234,131	25,887,250	36,753,547	44,152,029	—
	分配後	(註2)	44,277,106	45,421,878	54,958,483	—
非流動負債		59,920,538	54,157,564	56,521,713	49,900,000	—
負債總額	分配前	79,154,669	80,044,814	93,275,260	94,052,029	—
	分配後	(註2)	98,434,670	101,943,591	104,858,483	—
股本		44,086,502	43,515,920	43,305,287	43,217,144	87,380,787
資本公積		143,691,717	139,766,099	138,908,912	143,275,213	40,622,877
保留盈餘	分配前	91,318,899	46,881,134	31,561,328	25,392,886	76,406,530
	分配後	(註2)	28,491,278	22,892,997	14,586,432	28,126,909
其他權益		(11,532,042)	(9,569,027)	(10,847,697)	(6,902,782)	(6,316,138)
庫藏股票		(7,488,362)	(1,959,107)	(1,959,107)	(1,959,107)	(7,292,513)
權益總額	分配前	260,076,714	218,635,019	200,968,723	203,023,354	190,801,543
	分配後	(註2)	200,245,163	192,300,392	192,216,900	142,521,922

註1：a. 最近年度財務報告已由會計師查核簽證。

b. 最近年度未曾辦理資產重估。

c. 依日月光公司及矽品公司雙方董事會決議通過簽署之共同轉換股份協議，日月光投資控股公司被視為共同控制下之組織重組，實質上係日月光公司之延續，故107年以前年度之財務資料係以日月光公司個體財務報告之內容為並列揭露基礎。

註2：截至年報刊印日止，本公司——年盈餘分派之董事會尚未召開，是以分配後金額暫不填列。

(3)合併簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料(註3)				
		110年	109年	108年	107年	106年
營業收入		569,997,133	476,978,710	413,182,184	371,092,421	290,441,208
營業毛利		110,368,777	77,984,268	64,310,793	61,163,050	52,732,271
營業淨利		62,124,349	34,876,082	23,526,404	26,647,749	25,218,612
營業外收入及支出		18,211,058	857,597	(164,354)	5,399,689	5,710,286
稅前淨利		80,335,407	35,733,679	23,362,050	32,047,438	30,928,898
繼續營業單位本期淨利		66,013,581	29,276,780	18,053,124	26,463,839	24,667,366
本年度淨利		66,013,581	29,276,780	18,053,124	26,463,839	24,667,366
本年度其他綜合損益(稅後淨額)		646,142	851,503	(4,253,425)	(852,632)	(4,600,345)
本年度綜合損益總額		66,659,723	30,128,283	13,799,699	25,611,207	20,067,021
淨利歸屬於母公司業主		63,907,680	27,592,979	16,849,809	25,262,356	22,987,819
淨利歸屬於非控制權益		2,105,901	1,683,801	1,203,315	1,201,483	1,679,547
綜合損益總額歸屬於母公司業主		64,627,793	28,419,315	13,028,589	24,662,096	18,730,355
綜合損益總額歸屬於非控制權益		2,031,930	1,708,968	771,110	949,111	1,336,666
每股盈餘(稀釋)		14.40	6.31	3.86	5.84	5.23

註3：a. 最近年度財務報告已由會計師查核簽證。

b. 最近年度未曾辦理資產重估。

c. 依日月光公司及矽品公司雙方董事會決議通過簽署之共同轉換股份協議，日月光投資控股公司被視為共同控制下之組織重組，實質上係日月光公司之延續，故107年以前年度之財務資料係以日月光公司合併財務報告之內容為並列揭露基礎。

(4)個體簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	最近五年度財務資料(註)				
	110年	109年	108年	107年	106年
營業收入	65,091,179	28,564,437	18,540,038	19,026,512	22,987,819
營業毛利	65,091,179	28,564,437	18,540,038	19,026,512	22,987,819
營業淨利	64,328,807	27,984,239	18,051,211	18,821,044	22,987,819
營業外收入及支出	(606,591)	(694,800)	(956,447)	6,441,312	—
稅前淨利	63,722,216	27,289,439	17,094,764	25,262,356	22,987,819
繼續營業單位本期淨利	63,907,680	27,592,979	16,849,809	25,262,356	22,987,819
本期淨利	63,907,680	27,592,979	16,849,809	25,262,356	22,987,819
本期其他綜合(損)益(稅後淨額)	720,113	826,336	(3,821,220)	(600,260)	(4,257,464)
本期綜合損益總額	64,627,793	28,419,315	13,028,589	24,662,096	18,730,355
每股盈餘(稀釋)	14.40	6.31	3.86	5.84	5.23

註：a. 最近年度財務報告已由會計師查核簽證。

b. 最近年度未曾辦理資產重估。

c. 依日月光公司及矽品公司雙方董事會決議通過簽署之共同轉換股份協議，日月光投資控股公司被視為共同控制下之組織重組，實質上係日月光公司之延續，故107年以前年度之財務資料係以日月光公司個體財務報告之內容為並列揭露基礎。

最近五年度會計師查核意見

年度	會計師姓名	會計師姓名	查核意見
一一〇	吳世宗	郭麗園	無保留意見(其他事項)
一〇九	吳世宗	郭麗園	無保留意見(其他事項)
一〇八	吳世宗	江佳玲	無保留意見(強調事項或其他事項)
一〇七	江佳玲	郭政弘	無保留意見(強調事項或其他事項)
一〇六	江佳玲	吳秋燕	無保留意見

二、最近五年度財務分析

1. 最近五年度合併及個體財務分析－IFRSs

(1)合併財務分析

分析項目 \ 年度		最近五年度合併財務分析(註1)				
		110年	109年	108年	107年	106年
財務結構(%)	負債占資產比率	59.19	59.86(註3)	61.49	58.63	43.93
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	192.61	175.70(註3)	174.24	175.72	191.05
償債能力(%)	流動比率	138.61	130.36(註3)	132.66	128.96	137.22
	速動比率	102.31	92.67	100.83	97.46	103.58
	利息保障倍數	29.70	11.40	6.58	10.06	18.43
經營能力	應收款項週轉率(次)	5.50	5.59	5.22	5.51	5.46
	平均收現日數	66.36	65.29	69.92	66.24	66.84
	存貨週轉率(次)(註2)	7.87	9.66	9.87	10.15	10.38
	應付款項週轉率(次)	5.83	6.17	6.18	6.29	6.14
	平均銷貨日數	46.37	37.78	36.98	35.96	35.16
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	2.40	2.05	1.85	2.12	2.08
	總資產週轉率(次)	0.91	0.84	0.76	0.83	0.80

分析項目		年度	最近五年度合併財務分析(註1)				
			110年	109年	108年	107年	106年
獲利能力	資產報酬率(%)		10.86	5.62	3.93	6.53	7.24
	權益報酬率(%)		25.94	13.05	8.30	12.46	13.21
	稅前純益占實收資本額比率(%)		182.22	82.12	53.95	74.15	35.40
	純益率(%)		11.58	6.14	4.37	7.13	8.49
	每股盈餘(元)(稀釋)		14.40	6.31	3.86	5.84	5.23
現金流量(%)	現金流量比率		38.75	43.67	47.49	32.68	44.91
	現金流量允當比率		90.01	102.53	109.06	102.63	112.29
	現金再投資比率		7.57	8.38(註3)	8.24	5.80	7.34
槓桿度	營運槓桿度		1.89	2.49	3.17	2.66	2.21
	財務槓桿度		1.05	1.11	1.22	1.15	1.08

說明最近二年度各項財務比率變動原因：

- 1.平均銷貨日數增加：主要係因期末存貨增加所致。
- 2.利息保障倍數、資產報酬率、權益報酬率、稅前純益占實收資本額比率、純益率及每股盈餘增加：主要係因本年度營運狀況佳致使比率增加。
- 3.營運槓桿度減少：主要係因營業利益增加所致。

註1：a. 最近年度財務報告已由會計師查核簽證。

b. 請詳本年報P85~86之註4~註9。

註2：存貨週轉率計算不包含房地產開發部門之存貨－營運房地及其相關之營業成本。

註3：截至110年12月31日止，本集團已完成投資成本與所享有FAFG可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識，並追溯調整109年度財務報告。

(2)個體財務分析

分析項目		年度	最近五年度個體財務分析(註4)				
			110年	109年	108年	107年	106年
財務結構(%)	負債占資產比率		23.33	26.79	31.70	31.65	—
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		—	—	—	—	—
償債能力(%)	流動比率		1.91	0.91	0.64	0.22	—
	速動比率		1.74	0.82	0.60	0.19	—
	利息保障倍數		92.61	30.95	15.34	23.34	—
經營能力	應收款項週轉率(次)		—	—	—	—	—
	平均收現日數		—	—	—	—	—
	存貨週轉率(次)		—	—	—	—	—
	應付款項週轉率(次)		—	—	—	—	—
	平均銷貨日數		—	—	—	—	—
	不動產、廠房及設備週轉率(次)		—	—	—	—	—
	總資產週轉率(次)		0.20	0.10	0.06	0.07	0.13
	資產報酬率(%)		20.21	9.55	6.02	10.72	13.20
獲利能力	權益報酬率(%)		26.70	13.15	8.34	12.82	13.21
	稅前純益占實收資本額比率(%)		144.54	62.71	39.48	58.45	26.30
	純益率(%)		98.18	96.60	90.88	132.77	100.00
	每股盈餘(元)(稀釋)		14.40	6.31	3.86	5.84	5.23
	現金流量比率		117.68	80.09	55.25	85.14	—
現金流量(%)	現金流量允當比率		208.11	259.77	268.02	348.20	—
	現金再投資比率		1.33	4.42	3.69	10.59	—
槓桿度	營運槓桿度		1.01	1.02	1.03	1.01	1.00
	財務槓桿度		1.01	1.03	1.07	1.06	1.00

說明：日月光投資控股公司之設立視為共同控制下之組織重組，實質上係日月光公司之延續，部分106年之財務分析係以日月光公司個體財務報告之內容為基礎並列揭露。其餘財務分析因日月光投資控股公司並無相關交易或金額，106年日月光公司之資訊即不具比較基礎，故未予揭露。

註4：最近年度財務報告已由會計師查核簽證。

註5：財務分析項目之計算公式如下：

1. 財務結構
 - (1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。
 - (2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率 = (權益總額 + 非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額。
2. 償債能力
 - (1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。

- (2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。
(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3. 經營能力

- (1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
(2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。
(4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
(5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。
(6) 不動產、廠房及設備週轉率 = 銷貨淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。
(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額。

4. 獲利能力

- (1) 資產報酬率 = (稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)) / 平均資產總額。
(2) 權益報酬率 = 稅後損益 / 平均權益總額。
(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。
(4) 每股盈餘 = (歸屬於母公司業主之損益 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。(註3)

5. 現金流量

- (1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。
(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。
(3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (不動產、廠房及設備毛額 + 長期投資 + 其他非流動資產 + 營運資金)。(註4)

6. 槓桿度

- (1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益(註5)。
(2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

註6：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：

1. 以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
2. 凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
3. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
4. 若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註7：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

1. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
2. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
3. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
4. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
5. 不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

註8：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

註9：公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關占實收資本比率計算，則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

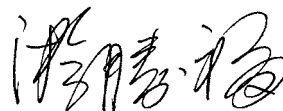
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

日月光投資控股股份有限公司

審計委員會召集人：

中華民國一一一年三月三十一日

四、最近年度財務報告：請詳閱本年報(二)財務報告。

五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告：請詳閱本年報(二)財務報告。

本公司依證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可並發布生效之國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)(以下簡稱Taiwan IFRS)編製合併財務報告並向台灣金管會證券期貨局申報。另本公司依國際會計準則理事會發布之IFRS、IAS、IFRIC及SIC(以下簡稱IFRS)編製合併財務報告並向美國證券交易委員會申報。

本公司適用Taiwan IFRS及IFRS編製之合併財務報告，其差異項目主係未分配盈餘加徵5%營利事業所得稅之認列時點不同以及未按持股比例認購關聯企業增發新股之會計處理不同所致。

詳細調節內容請參考本公司向美國證管會申報之2021年度英文合併財務報告。

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001122411/000119312522087341/d272809d20f.htm>

單位：新台幣仟元

差異調節項目	Taiwan IFRS	IFRS
(1) 歸屬於本公司業主之合併淨利	63,907,680	60,150,167
(2) 歸屬於非控制權益之合併淨利	2,105,901	2,099,830
(3) 歸屬於本公司業主之綜合損益總額	64,627,793	60,630,154
(4) 歸屬於非控制權益之綜合損益總額	2,031,930	2,025,859
(5) 基本每股盈餘(元)	14.84	13.97
(6) 稀釋每股盈餘(元)	14.40	13.54
(7) 資產總額	672,934,285	673,265,899
(8) 負債總額	398,301,560	405,094,839
(9) 歸屬於本公司業主之權益	260,076,714	253,626,645
(10) 非控制權益	14,556,011	14,544,415

六、公司及關係企業發生財務週轉困難情事之影響說明：無。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

(一) 流動資產與其他資產增加，主要係現金及約當現金、應收帳款、存貨及投資性不動產增加所致。

(二) 流動負債增加，主要係應付帳款增加所致。

(三) 保留盈餘增加，主要係因本年度淨利增加所致。

二、財務績效：最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

(一) 營業毛利及營業利益：營業毛利及營業利益增加，主要係因本年度營運狀況良好，營收成長所致。

(二) 所得稅費用：所得稅費用增加，主要係本年度獲利增加，致使本年度產生之所得稅費用增加。

(三) 營業外收入及支出：營業外收入增加，主要係處分子公司產生利益所致。

三、現金流量：最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析。

(一) 最近年度現金流量變動分析

1. 現金流量比率：110年存貨增加導致流動負債相對增加，致現金流量比率下降。
2. 現金流量允當比率：主係110年稼動率提升，資本支出及存貨增加，致現金流量允當比率下降。
3. 現金再投資比率：110年因營運資金相對大幅增加，致現金再投資比率下降。

(二) 現金不足額之補救措施：本公司最近年度並無流動性不足之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年初現金餘額①	預計全年來自營業活動 淨現金流量②	預計全年現金流出量③	預計現金剩餘(不足)數額 ① + ② - ③	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
\$76,073,345	\$115,549,335	\$150,936,520	\$40,686,160	—	—

1. 現金流量變動情形分析

- (1) 營業活動：預計111年度主係營業淨利增加、營業資產及負債淨變動所產生之淨現金流入增加所致。
- (2) 投資活動：預計111年度現金用途主係購置土地、擴建廠房及機器設備。
- (3) 籌資活動：預計111年度主係舉借、償還長短期負債及支付現金股利等盈餘分配項目。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形
				——年度
擴建廠房及土地	營運資金及銀行借款	111.12	27,730,743	27,730,743
購置機器設備	營運資金及銀行借款	111.12	62,897,968	62,897,968

本公司截至目前為止對於未來二至五年之資本支出及預計可能產生效益情況尚無法合理估計。

(二) 預計可能產生效益

1. 預計將增加之產銷量、值及毛利

單位：數量仟個 / 新台幣仟元

年度	項目	生產量	銷售量	銷售額	毛利
——	半導體製造封裝	4,602,440	4,602,440	27,079,450	7,560,870
——	半導體製造測試	(註2)	(註2)	10,105,082	4,012,651

註1：僅針對——年度重大之資本支出於——年度預計產生之效益估算。

註2：係以測試時間為計價基礎，故無法揭露數量。

2. 其他效益說明：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司之最近年度轉投資政策主要係以核心競爭力為主要考量並著眼於長期策略性目的，且對每一投資案皆經審慎評估後為之。目前本公司轉投資事業獲利，主因為轉投資事業之生產營運已達經濟規模並明確落實管理制度。

六、風險事項分析評估：

(一) 最近年度及截至年報刊印日止之利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司係以股份轉換方式成立，主要資產為長期投資，損益則來自對轉投資公司之損益認列。轉投資公司對利率、匯率變動及通貨膨脹均有其適當之因應措施，並維持彈性調度調整，尚不致對本公司產生重大影響。

1. 利率變動：

本集團因應營運活動所需之現金部位，在借款時已取得市場較優惠之借款利率條件並均已做適當的彈性調度調整。目前市場預期利率水準將上揚，未來將密切注意利率走勢，於籌資時視情況鎖定有利之利率條件，並隨時評估市場利率水準，運用低利率之融資工具，採用有利之利率條件，適時調整固定或浮動利率借款部位，以維持低融資成本及適足活絡之融資額度為主，並降低利率變動所造成之影響，規避營運上可能產生之利率風險。

2. 匯率變動：

本集團之避險策略係採取自然避險為原則，利用持有外幣負債平衡外幣資產部位，配置低風險、安全且避險性高之投資標的，以降低匯率變動風險，因而公司損益並無受匯率變動影響之疑慮。未來將持續關注國際經濟走勢及匯率變化，適時採用外幣衍生性金融商品合約，包括遠期外匯等，並以降低匯率變動風險為主要管理方向，同時亦審慎檢視公司資金配置，因應匯率變動造成之影響，期望可達有效管理之目標。

3. 通貨膨脹情形：

依國家主計處之統計數據顯示，110年之消費者物價指數年增率為2.62%，通貨膨脹之情況未對110年度營運結果產生重大影響。

本集團截至目前尚未有因通貨膨脹而對損益產生重大影響之情事。在升息的大環境之下，通貨膨脹將為必然之趨

勢。未來除密切注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，以適當調整產品售價及原物料庫存量，期能有效降低通貨膨脹之影響，同時將持續注意總體經濟環境的變化，評估對營運帶來的影響，以適時採取必要的措施。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本集團採取穩健保守操作策略，並未從事高風險、高槓桿之投資。已依據證期局相關法令及規定，訂定以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序，包括「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」。未來公司仍將嚴格遵守程序規範，所有交易均依相關規定辦理。另本公司轉投資之子公司亦採取穩健保守之操作策略，未從事高風險高槓桿之投資。

(三) 未來研發計畫及預計投入之進度與研發費用：

1. 投資業：本公司主要營業項目為長期投資，尚無研發需求。

2. 封測業：

(1) 未來研發計畫(包括正在進行中)

封裝技術

新技術(Advanced Technology)	
3D系統封裝 (3D SiP)	a. 矽光子系統封裝技術(Si Photonic SiP Technology) b. 薄基板核層覆晶PoP堆疊技術(Thin Core FC PoP Technology) c. 異質晶片整合系統封裝(Heterogeneous Chip Integration SiP) d. 2.nD微間距基板晶片堆疊封裝(2.nD Fine Line/Space Substrate Stacking) e. 2.5D封膠技術方案(2.5D Molding Solution) f. 先進扇出式多層堆疊技術方案(Advance Fan-Out Multi-Layer Stack Via Solution) g. 2.5D產品研磨技術(2.5D Package Grinding Tech) h. 晶圓級銅對銅，氧對氧混合焊接技術(D2W Hybrid Bonding Cu to Cu, Oxide to Oxide) i. 增強型雙面模組封裝結構(Double Side Molded Module Plus/DSM+ Structure) j. 3D系統級模組封裝(3D Stacking SiP Module) k. 次微米線路重佈製程(Sub-Micron RDL Technology) l. 晶圓級扇出式3維 PoP 堆疊混合焊接技術(FO 3D POP Hybrid Bond) m. 2~4 層晶片堆疊基板封裝技術(2~4 Die Stacking on Substrate) n. 液態矽膠與系統級晶片整合技術(LSR SiP Integration Technology) o. 撓性系統級封裝技術(Flexible SiP Assembly Technology) p. 高介電材料&結構製作毫米波產品的3D封膠技術 (3D Molding Technology for mmWave Product by High Dk EMC Material & High Dk EMC Structure) q. 背面被動晶片(IPD)結合高頻寬封裝層覆晶晶片尺寸式封裝 (IPD on High Bandwidth PoP) r. 扇出型-多晶片組覆晶球柵陣列封裝結合高頻寬記憶體(FO-MCM FCBGA with HBM(High Bandwidth Memory)) s. 扇出型-嵌入式橋接多晶片組具矽穿孔覆晶球柵陣列封裝結合高頻寬記憶體(FO-EB-T FCBGA with HBM) t. 3D積體電路結合覆晶晶片尺寸式封裝(3DIC on FCCSP) u. 扇出型-單晶片組覆晶球柵陣列封裝(FOSD-oS) v. 扇出型-封裝層疊整合記憶體(FO-PoP (Fan Out PoP) pre-stack Memory) w. 具分離式天線結構與具partial coating抗干擾能力之5G天線模組(Separated Antenna Structure with Partial Coating EMI Shielding of 5G mmWave Antenna Module) x. 多顆晶片之高整合性微型化的單面與雙面模壓Wi-Fi7模組(Multi-Die of High Integration and Miniaturization Solution for Single Side and Double Side SiP for Wi-Fi7) y. 薄基板模壓式結構且具Exposed die 結構之高散熱CPU+DDR模組(Molded Thin Substrate Structure with Exposed Die Structure for High Thermal of CPU+DDR Module)
光電封裝 (OEP)	a. 光感測元件封裝技術(Optical Sensor Packaging Solution) b. 光電整合傳導技術(Optical-Electronic Interconnection) c. 光電雷射焊接技術開發(Si-Photonics LD Module) d. Mini-LED封裝技術開發(Mini-LED Packaging) e. 光電光纖主動與被動對位封裝技術(Si-Photonics Fiber Active and Passive Alignment Packaging) f. 光學鏡片主動與被動對位封裝技術(Active and Passive Alignment Packaging for Si-Photonics Lens) g. PCB摺痕缺陷檢測技術(PCB Crease Defect Inspection Technology) h. 波前感測器主動對位測試技術(Wave-Front Sensor Active Alignment Technology)

新技術(Advanced Technology)	
面板級封裝 (Large Panel Fan out Package)	a. 面板級扇出式Chip First封裝(Panel Fan out Chip First Packaging 600x600mm) b. 面板級扇出式Chip Last封裝(Panel Fan out Chip Last Packaging 300x300mm) c. 面板級扇出式與電源效能整合封裝(Panel Fan Out With Power Integration) d. 面板級扇出式與基板整合封裝(Panel Fan Out With Substrate Integration Technology) e. 面板級內埋元件基板整合封裝(Panel Substrate With Embedded Component Integration Technology) f. 95x240mm條狀基板排版整合技術(95x240mm Integrate on 300mm Panel FO)
晶圓級封裝 (WLCSP)	a. 300mm二維扇出式晶圓級封裝(300mm Wafer 2D Fan-Out WLP) b. 三維扇出式晶圓級封裝(3D Fan-Out WLP) c. 細線RDL電鍍銅技術(Fine Line Cu-Plated RDL Technology) d. 低溫烘烤型Polymer晶圓RDL電鍍銅技術(Low Temperature Cure Polymer, Cu-Plated RDL Technology) e. 晶圓級封裝切割再測試專案(Sawn Wafer Probing) f. 多腳數/微型化之晶圓級晶片尺寸封裝產品技術開發計畫(High IO/Die Shrinkage WLCSP) g. 晶背貼合材料技術開發(IR Through BSL) h. 線路重部製程與保護層疊層技術開發(L/S Technology Development) i. 薄片晶背貼合能力技術開發(Development of Thin-Film Crystal Back Bonding Technology) j. 降低切割製程風險技術開發(Reduce Cutting Process Risk Technology Development) k. 5層Polymer晶圓RDL電鍍銅技術(5-layer Polymer, Cu-Plated RDL Technology) l. 晶圓級巨量轉移封裝技術(Wafer Level IC Mass Transfer Bonding Technology) m. 雙層與四層堆疊記憶體封膠技術開發(2-Hi and 4-Hi HBM MUF Technology Development) n. 雙層與四層堆疊記憶體底膠填充技術開發(2-Hi and 4-Hi HBM CUF Development)
覆晶封裝 (Flip Chip)	a. 20奈米超低介電係數晶圓之無鉛覆晶封裝(20 nm ELK Wafer Lead-Free FC) b. 300mm晶圓穿導孔晶圓50微米厚度CMP研磨技術(300mm TSV Wafer 50 um CMP Technology) c. 超低介電常數薄晶圓之隱匿式雷射切割技術(SD Laser Technology on Thin ELK Wafer) d. 核心嵌入式封膠製程封裝(Molded Core Embedded Package) e. 裸露晶體封裝(Exposed Mold UnderFill) f. 覆晶封裝產品之極微距銅柱距離(Very Fine Pitch Cu Pillar Flip Chip Product) g. 銅凸塊於內埋式線路基板之開發應用(16奈米以下之覆晶封裝技術) (Development and Application of Copper Bump in Embedded (Flip Chip Packaging Technology Below 16nm)) h. 高階覆晶封裝型四方平面無引腳構裝開發計畫(FC QFN Development) i. 2.1D 細線寬線距基板之大覆晶球柵陣列(2.1D FCBGA with L/S:2/2um) j. 雷射輔助接合技術(LAB(Laser Assisted Bonding)) k. 晶圓級熱壓合銲接技術(Wafer from TCB(Thermo-Compression-Bonding) Technology)
射頻模組 (RF Module)	a. 非圓柱覆晶式多模多頻射頻前端模組完整方案(Irregular FC Cu-Pillar Multi-Band Multi-Mode SiP Module Solution) b. 基板內埋被動元件通訊模組(Embedded Passive Substrate Wireless Module) c. 毫米波無線通訊模組(mmWave Module) d. 扇出型射頻模組整合方案FOSiP (Fan-Out System in Package) e. 毫米波封裝天線模組(mmWave Antenna in Package/AiP) f. 毫米波元件堆疊封裝模組(mmWave Antenna on Package/AoP)
鐸線封裝 (Wire Bond Package)	a. 14奈米銅製程/超低介電係數晶圓之鐸線封裝(14 nm Cu / ELK Wafer Wire Bond Solution) b. 新打線材料製程開發(New Wire Bonding Material Technology Development) c. 先進單層板的封裝技術開發(Single Layer Carrier Package Development) d. 四方平面無引腳產品於車用領域之應用(FC QFN for ATV Development) e. 高散熱材料評估(High Thermal_HS Evaluation) f. 被動元件應用研發(Cap on Die) g. 氣體感測模組(Gas Sensor) h. 晶圓級扇出式RDL打線封裝(Fan Out RDL Wire Bonding)
無線通訊模組 (Wireless Communication SiP Module)	a. 整合BB+RF(Multi-Bands) +DRAM+PMIC以及周邊被動元件複合式封裝SiP模組，偕同最新複合無線通訊技術通訊規格(Multiple Mode Communication SiP Module Solution) b. 超微小型高整合封裝功能模組(Highly Miniaturized and Integrated SiP Communication Function Module Solution) c. 低功耗4G通訊SiP封裝模組(LTE Cat.M Modem SiP Module) d. Wi-Fi通訊埋置式模組(Wi-Fi SESUB Module) e. 單層混合式基板天線(Hybrid SBT Antenna)
人工智慧視覺檢測技術 (AI-Based Visual Inspection)	a. 先進深度神經網路建模技術(Advanced Deep Neural Network Modeling Technology) b. 先進影像瑕疵識別建模技術(Advanced Image-based Novelty Recognition Modeling Technology)
凸塊(Bumping)	
電鍍製程 (Plating)	a. 低銀之錫銀無鉛電鍍晶圓微小型凸塊技術(Low Ag of Sn/Ag Lead-Free Micro Bump Plating Technology) b. 單層PI與單層銅RDL結構之晶圓級封裝技術(Single PI and Single RDL For WLCSP) c. 微小型銅柱凸塊技術(Micro Cu Pillar Bumping) d. 線路重佈製程和無鉛錫銀電鍍製程疊層技術開發(RDL+LF Bump) e. 線路重佈製程和銅柱製程疊層技術開發(RDL+Cu Pillar) f. 扇出型晶片無鉛凸塊之覆晶封裝(FOCoS_Cu Pillar) g. 超細Cu導線(1 μm線寬，1 μm線距)重分佈製程技術(RDL with L/S:1/1μm)

測試技術

新測試技術(New Test Technology)	
晶圓測試 (Wafer Probe)	a. 晶圓級封裝測試技術(Wafer Level Package Testing Technology) b. 高密度多工並列測試技術(High Parallel Site Test Solution) c. 氮化鎵(GaN)晶圓測試技術(GaN Wafer Probe Testing Technology) d. 光感控制元件測試方案(ALS+ Prox. Sensor Test Solution) e. 矽光通訊CoW測試技術(Silicon Photonics CoW Probe Testing Technology)
後段封裝測試 (Final Test)	a. 物聯網/穿戴式元件之低成本(Non-ATE)測試技術開發(Low Cost Non-ATE Test Methodology For Low I/O Count Device Test, IoT/Wearable Devices) b. 高產出電源管理元件測試機開發(High UPH Power Management IC Tester Development) c. 可程式化電源供應模組(Programmable Power Supply Module) d. 高腳數通道開/短路測試機開發(High Pins Channels Open/Short Tester Development) e. 直接定位測試頭設計(Direct Mount Test Head Design) f. 氮化鎵MOSFET高功率測試模組(GaN MOSFET High Power Test Module) g. 系統級封裝Ka-Band AiP遠近場自動化測試方案(Ka-band AiP Near/Far-field Automatic Test Solution) h. 平行暨多埠毫米波前端模組測試方案 (Multisite, Multi-ports mmWave FEM Test Solution) i. 嵌入式Lora+Sigfox系統級封裝測試方案(Embedded Lora+Sigfox SiP Test Solution) j. 嵌入式NB-IOT系統級封裝測試方案(Embedded NB-IOT SiP Test Solution) k. FMCW光學雷達感測模組測試方案(FMCW Lidar Sensor Module Test Solutions) l. 系統級封裝-FoCoS元件OS測試技術(SiP FoCoS Device OS Testing Technology) m. 系統級封裝-SiP Sub-6G Antenna OTA測試技術(SiP Sub-6G Antenna OTA Testing Technology) n. 系統級封裝-SiP Sub-6G Multi-Band測試技術(SiP Sub-6G Multi-Band Testing Technology) o. 系統級封裝-SiP Sub-6G RF OS測試技術(SiP Sub-6G RF OS Testing Technology) p. 系統級封裝-SiP Sub-6G射頻Front-End Module測試技術(SiP Sub-6G RF Front-End Module Testing Technology) q. 系統級封裝-SiP Computing ARM/MCU模組元件測試技術(SiP Computing ARM/MCU Module Testing Technology) r. 系統級封裝-SiP Hybrid RF(Front-End+Antenna)模組元件測試技術(SiP Hybrid RF(Front-End+Antenna) Module Testing Technology) s. 系統級封裝-SiP Hybrid IoT(ARM+Front-End)模組元件測試技術(SiP Hybrid IoT(ARM+Front-End) Module Testing Technology) t. 系統級封裝-SiP Hybrid AoP/AiP 模組元件測試技術(SiP Hybrid AoP/AiP Module Testing Technology) u. 光感控制元件測試方案(ALS+Prox. Sensor Test Solution) v. 氮化鎵(GaN)產品應用測試技術(GaN Product Application Testing Technology) w. 胎壓感知器量測技術(TPMS Test Technology) x. 生物感測元件測試(Biometric Sensor) y. 人臉辨識感測技術(Facial Recognition Sensor Test Technology) z. 3D感測(3D Sensing Test Technology) aa. 軟板光學模組感測技術(FPCB Module Test Technology) bb. 無人駕駛光學感知測試解決方案(LiDAR Sensing Testing Solution) cc. 生物感測元件測試解決方案(Biometric Sensor Testing Solution) dd. 3D感測測試解決方案(3D Sensing Testing Solution) ee. 氮化鎵(GaN)應用封裝測試技術(GaN Application Package Testing Technology) ff. 碲化鎵InGaAs PD光學測試方案(InGaAs PD Test Solution) gg. 長波段IR光源開發技術(Long-Wavelength IR Light Source Technology) hh. 光學元件之人眼安全測試解決方案(Optical Eye Safety Test Technology) ii. 系統級封裝-SiP真無線藍芽耳機模組測試技術(SiP TWS Module Testing Technology) jj. 系統級封裝-SiP GSM定位模組測試技術(SiP 2G-GPS Module Testing Technology) kk. 系統級封裝-SiP Sub-6G Multi-Band測試技術(SiP Sub-6G Multi-Band Testing Technology) ll. 飛時測距元件測試技術(ToF Component Test Technology) mm. 輔助駕駛光學感測器測試解決方案(ADAS Sensing Testing Solution) nn. CMOS影像感測器測試解決方案(CIS Sensor Testing Solution) oo. 虛擬實境眼鏡光感測器測試解決方案(AR/VR Glasses Test Technology) pp. OLED觸控式螢幕控制器測試技術(OLED Touchscreen Controller Test Technology) qq. 可程式化邏輯閘陣列測試技術(Field Programmable Gate Array Test Technology) rr. 系統級封裝-SiP MEMS麥克風測試技術(SiP MEMS Microphone Testing Technology) ss. 系統級封裝-SiP雷達手勢偵測測試技術(SiP Radar Gesture Detection Testing Technology) tt. 系統級封裝-SiP mmWave Antenna測試技術(SiP mmWave Antenna Testing Technology) uu. 開發應用於5G及車載產品之光通訊及毫米波測試技術(Develop the Optical Communication and Millimeter Wave Test Technology for Application of 5G and Automotive Products) vv. 自製崩應高功率散熱系統(> 600W)(Develop the High-Power Heat Dissipation(> 600W) Solution/System for Burn-In System)
測試資料分析 (Test Data Analysis)	晶圓失效模式自動判別(Automatic Identification of Defect Patterns in Wafer Maps)
應用軟體開發 (Application Software Development)	a. 巨量資料分析與探勘雛型系統建置(Big Data Analysis/Mining System Build) b. 製程資訊自動化管理暨深度學習系統(Process Information Automation Management & Deep Learning System) c. Data Cloud應用介面開發(Data Cloud Dashboard Development) d. 視覺化偵錯工具平台(Visualization Debug Tools Platform) e. ETL平台(ETL Platform)

(2) 預計再投入之進度與研發費用

封裝試產預計投入之研發費用為新台幣3,245,688仟元，另其他封裝研發費用預計投入新台幣4,383,376仟元。

測試試產預計投入之研發費用為新台幣1,193,106仟元，另其他測試研發費用預計投入新台幣379,673仟元。

(3) 未來研發得以成功之主要影響因素

- 大數據分析與製程資訊自動化
- 先進封裝技術能力的建立並與現有封裝技術整合
- 現有封裝及測試技術低成本最佳解決方案
- 流程、製程標準化暨產業鏈整合
- 關鍵新設備量產化驗證暨即時導入
- 封裝、測試、基板、模組、系統整合能力的建立與深耕
- 基板、元件、模組設計能力的建立與深耕
- 完善的產品研發流程及專案管理系統
- 結合產品開發和現有生產設備相容性以降低研發成本
- 客戶導向的組織設計與內部運作機制
- 充分掌握市場行銷之供需狀況，並依據市場動態與趨勢，先行開發先進封裝、基板、模組組裝技術與測試技術以確保技術領先地位，適時提供客戶新產品上市時程之最佳解決方案
- 研發人才培育機制之強化
- 知識管理系統之落實與強化
- 強化智慧財產權策略與管理
- 符合環保法規與綠色設計(Eco-Design)之產品設計、研發與製造
- 研發效益、研發風險、時程及人員能夠有效管控
- 與標竿客戶策略聯盟、降低研發成本與風險
- 晶片-封裝-系統一元化協同設計(IC-Package-System Co-Design)
- 測試程式開發能力的建立與深耕
- 研發核心技術能力的建立與深耕
- 依據市場分析結果，先行開發先進Substrate確保技術領先地位

3. 電子製造服務業：

(1) 未來研發計畫(包括正在進行中) 與未來研發得以成功之主要影響因素：

產品暨解決方案	未來研發計畫及未來研發得以成功的主要因素
無線通訊 (Wireless Communication)	a. Wi-Fi-6E 802.11ax 2x2 with Dual-Core BT5.2/UWB 802.15.4z 4-Antenna(1T3R)/5G mmWave收發器模組+AoP/AIP SIP Module開發 建立準確的模擬資料庫與產品的相關聯性驗證，最佳化與解決問題，可減少開發階段次數與成本。
	b. 系統模組 整合了大多數的系統功能並採用了微小化及強固設計技術來加速客戶終端產品的開發時間。
	c. 窄帶物聯網模組 開發窄帶物聯網模組可直接部署於LTE網路，是5G的前導技術與LPWA低功耗廣域網(Low Power Wide Area)中最好的解決方案。
	d. 車用通訊模組 積極與一線客戶合作並參與4G/5G車用通訊模組開發，提供製造技術與服務來加速客戶佈局未來車聯網市場所需的模組產品。
	e. Wi-Fi 6E 低價位企業用存取點AP
	i. Soc設計
	ii. 增加6GHz頻段
	iii. 有IoT模組設計，同時支援BLE和Zigbee
	iv. 僅支援內置天線設計
	f. MCU 家庭安全產品
	g. UWB 超寬頻模組開發 客製化模組for 近場測距及定位相關應用
	h. Wi-Fi 6E 模組開發 支援6G/7G 頻段模組開發

產品暨解決方案	未來研發計畫及未來研發得以成功的主要因素
存儲與電腦 (Storage & Computer)	a. 邊緣運算伺服器/標準機架伺服器 整合伺服器，無線網路/5G和網路交換器技術，並應用虛擬化軟體(Virtualization Technology)以實現互聯網及都市自動化應用並符合電信網路設備建構系統規範(NEBS，Network Equipment Building System)。 b. USB4 擴充基座 USB4 新規格整合了 Intel Thunderbolt3 技術，數據傳輸速率支援到40 Gbps，也支援 DisplayPort 和 PCI Express 隧道，運用此技術達到更多高速資料與影像傳輸的需要及運用。 c. 高效能運算之工作站 為因應大數據應用的需要，運算設備也需要更高的數據頻寬。UGSI以第五代PCI Express(PCIe Gen5)與DDR5記憶體技術為基礎，極力打造高效能且高性價比的工作站平台，以滿足市場需求。 d. PCIe Gen4全閃存陣列 隨著閃存技術的不斷發展，以及伺服器對存儲要求的不斷提高，全閃存陣列產品將成為外接式存儲產品的主流。UGSI以第四代PCI Express(PCIe Gen4)為基礎，憑藉十多年對存儲產品的專業經驗，極力打造通用且高性價比的存儲陣列，以滿足市場需求。 e. PCIe Gen.4 通用量產測試平臺 隨著PCIe Gen.4逐漸成為主流產品採用的介面，USI自研的量產測試機台將同步升級為此介面，旨在為客戶提供靈活的，高性價比的量產測試解決方案。 f. 網路附接儲存裝置，支援USB 3.2 Gen 2
工業電子 (Industrial Products)	a. 5G NR智能裝置產品研發 相較於傳統的4G連網技術，新一代5G連網技術應用上提供了更多的附加價值，5G的高傳輸速度和低延遲將為新的裝置提供嶄新的應用，USI目前致力於研發5G平台與裝置來幫助我們的客戶在5G行動運算市場上取得領先。 2022年我們將以Qualcomm 5G IoT QCM6490平台為開發重點，此平台具備較長生命週期，始能贏得未來的產品開發專案以及完成產品開發工作。基於市場與客戶需求，將以下列三種產品線為開發主軸： i. 強固型手持裝置：強固與高等級防塵防水。 ii. 輕薄型手持裝置：輕薄、攜帶方便但仍具高可靠度。 iii. 強固型平板裝置：針對車用，防震耐摔。 b. 運動健身消費性產品 USI設計團隊於2021年成功量產新客戶之GPS自行車車錶，並成功贏得客戶的信任與肯定，藉由打入主流運動健身品牌之ODM廠商之經驗，USI已具備完整且有經驗的軟硬體以及無線運動健身產品的生產能力。基於過去的成果，USI在2022年已確定贏得客戶下一代GPS自行車車錶的產品專案，本年度專案重點除了加速開發時程並確保能滿足客戶的出貨時程外，並期許在新專案中能夠累積更多的相關設計經驗，以此來贏得未來更多潛在產品ODM專案的機會。 c. 新無線射頻設計能力建置計畫 我們2021年度以Qualcomm SM7225與SDM660平台為5G和4G產品的開發主軸，隨著時間過去與技術的演進，IoT行動裝置平台推陳出新，為了能確保USI的開發能力能夠滿足客戶的產品Roadmap，我們2022年度計畫以Qualcomm QCM6490與QCM4290平台為開發重點，以確保技術能力跟上市場需求與具備足夠生命週期，始能贏得未來的產品開發專案以及完成產品開發工作。 d. 建立生物識別模組(指紋辨識/臉部辨識/眼球虹膜辨識)系統整合設計能力 因應消費型手持式裝置的市場需求，建立生物識別模組整合應用能力，協助應用於工控類手持式裝置的開發準備。 e. AIO (All In One) 收銀機 早期和Intel討論適合的CPU方案，並採用Intel最新TigerLake-U CPU於開發平台。 對USB-C高速介面及其應用有深入了解並整合於產品中，其應用能符合各種付款裝置需求。 該系統不但能提供高效能及穩定的系統外，也進行資料備份來保護交易資訊。 研發團隊具備完整的軟硬體及系統整合開發能力及經驗，所開發的產品能應付各種店家下訂收款的使用條件，也提供高度彈性的合作模式提供客戶設計服務，以因應不同客制化的需求。
消費電子 (Consumer)	a. 穿戴式系統多晶元整合封裝解決方案 整合不同功能的晶元封裝在一顆晶片裏並開發生產測試程式，大幅減少零件面積，將系統空間做最佳化並在有限的空間放進更多的功能。 b. 助聽器無線充電解決方案 提供高集中度、小功率無線充電方案，以環形線圈之特殊結構，發射高集中度之電磁磁通給內建在助聽器中之接收端微小線圈，以達成無線充電的目的。
汽車電子 (Car Electronics)	a. ADAS 應用於自適應頭燈控制器(ADB, Adaptive Driving Beam ECU)之軟硬體設計開發 透過ADB控制器演算法及LED頭燈控制演算法搭配，完成行車時自適應頭燈避光控制系統，提升對向及前方車輛行車安全。 b. 高精準度LED置件製程能力 LED頭燈的滲透率在2021年達到60%，其中新能源車達到90%，開發LED頭燈需要建立高精準度LED置件製程能力，可取得更多訂單的機會。 c. 電動車用電源模組製程技術開發 車用電源模組主要分成雙面冷卻和單面冷卻的設計，對應開發製程技術如下，未來不論客戶哪一種設計都可以有對應技術可以滿足。 i. 雙面塑封技術 ii. 銅載帶焊接技術 iii. DBC基板與歧片散熱板真空焊接 iv. 銀燒結著晶

產品暨解決方案	未來研發計畫及未來研發得以成功的主要因素
微小化及自動化 (Miniaturization & Automation)	a. 微小化技術開發 新型設備及材料，輔以模擬運算，實現新製程技術開發。如： i. 高效的選擇性EMI遮罩技術 ii. 晶元加工處理後與模組整合的技術 iii. 3D 銅網印刷技術 iv. 噴塗實現隔間遮罩技術 v. SESUB 埋芯片基板導入 vi. ABF基板導入SiP module vii. DB/WB技術導入SiP module viii. 超薄銅板助焊劑整板印刷用於更緊密的貼裝技術 ix. 超細粒徑錫膏印刷用於超密錫球中心距晶片貼裝技術 b. 智慧製造技術開發 i. 利用雲端技術與感測器資料更新，輔以歷史運行數據，實現數字雙生(Digital Twin)概念，並利用人工智慧做最佳化與解決問題。 ii. 開發通用性之自動化平台與資訊自動化模組並平行展開到各Site，加速提升各廠區符合工業4.0 的智能製造工廠水準。

(2) 預計再投入之研發費用：

2022預計投入之研發費用約新台幣45億元。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

1. 已發布之國際財務報導準則、國際會計準則及解釋，但尚未生效之新 / 修正 / 修訂準則及解釋，其對合併財務報告之影響，本公司將依照金管會所列時程持續評估並於預計時程內完成。
2. 一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法(用電大戶條款)：用電大戶條款於110年1月1日正式生效，該條款規定用電契約容量5,000瓩以上之用戶，應使用10%再生能源，並於五年緩衝期內設有獎勵措施(如用電大戶於三年內達標，可享有此後再生能源比例門檻降為8%之優惠；四年內達成門檻，則可降為9%)，如未達標，則須繳納怠金。本公司符合用電大戶條款之子公司已與售電業者簽署再生能源售電合約，以符合新法規定。
3. 中國大陸於西元2021年8月20日通過個人信息保護法，並自西元2021年11月1日起正式實施。該法全面規範大陸地區之個人信息處理活動規則，並訂有高額罰款規定及相應法律責任，大陸各子公司正研擬精進措施，以符合新法規定。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

1. 全球總體經濟的不確定性與不連續性為半導體產業的一大挑戰。因應措施是透過與客戶及廠商的共同開發來符合客戶需求與降低成本及風險、持續觀察市場的脈動以及與客戶之間更緊密的互動來掌握客戶的需求與變化，並強化市場資訊的蒐集與分析來降低產品需求改變對科技所造成的影響。
2. 客戶市場競爭力與上市時程是新技術研發是否順利上市之關鍵。因應措施為充分掌握市場行銷趨勢與供需動態之狀況，並依據市場趨勢方向與標竿客戶產品藍圖，先行開發關鍵技術暨專利以確保技術領先地位，結合產品開發和現有生產設備相容性以降低研發成本，提供客戶新產品上市時程之最佳解決方案。
3. 新技術研發創新的經驗中，開發經費與關鍵新設備扮演極為重要一環。因應措施為確保新技術和本集團未來藍圖發展一致，並積極和客戶策略聯盟，落實資源共享，以降低研發風險。定期拜訪產業領先地位之客戶並透過技術研討會與標竿客戶共同規劃產品藍圖與產品規範，確保研發技術能符合客戶上市需求。
4. 半導體產業的技術世代交替迅速，本公司透過市場資訊的收集與分析，與客戶密切互動來掌握客戶需求及其變化，適時完成技術開發及商品化，來降低科技改變對公司營運所帶來的影響。
 半導體產業是一個隨景氣循環而波動的產業，任何景氣下滑都有可能對產業帶來負面影響，本集團經營團隊隨時密切注意產業變動，適時採取相關預防措施，來降低產業變化對公司營運所帶來的影響。
5. 面對資安弱點與威脅層出不窮、駭客攻擊手法日益精進的環境下，子公司矽品公司以ISO27001管理制度之風險評鑑識別出資通安全風險，採取相關預防措施，降低對公司營運所帶來的影響。
6. 全球資安事件頻傳，勒索病毒仍是2021年最主要的網路資安威脅，面對此一威脅本集團將深度評估現有環境的安全程度並提高整體資訊安全成熟度，除透過定期的公告，要求員工遵守相關網路資訊安全規定外，我們更進一步要求同仁完成資訊安全意識教育訓練課程，並不定期實施郵件社交工程演練。公司資訊安全團隊也將隨時密切注意各種資安事件，適時採取相關預防措施，來降低資通安全風險對公司營運造成的影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

有關本集團推動永續發展及企業形象運作情形，請參閱本年報第23~24頁。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

由於半導體市場成長前景樂觀，預計本集團封測事業群之成長幅度會超越市場成長率。至於投資部分，鑒於落實現有產能之充分及有效利用，除了因應市場的龐大需求與穩固佔有率而加速完成新廠房之興建並積極展開生產基地之開發外，前幾年在產能上之擴充已能滿足部分成長之訂單，為提昇實質報酬率並降低投資風險，對於市場之成長乃以現有產能與設備為主。新設備之投資案，將密切觀察市場之動態暨強化客戶關係來穩定訂單的變化，確保產能利用率之有效利用，並以市場實際需求之必要性再做新投資的考量。

另由於看好電子代工市場未來成長前景，及客戶需求增加，旗下公司將在落實充分利用既有產能的原則下，規劃投資新產能和新設備。並持續監控市場的實際需求，彈性調整投資，以提昇實質報酬率並降低投資風險。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本集團旗下之子公司進貨或銷貨並無過度集中之情形。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二) 訴訟或非訟事件：

1. 本公司董事暨營運長吳田玉於106年8月6日因涉及違反證券交易法遭高雄地方檢察署起訴乙案，高雄地方法院於109年2月5日宣判，吳田玉獲判無罪；109年3月20日經高雄地方檢察署提出上訴後，台灣高等法院高雄分院於110年6月9日駁回上訴；110年7月2日經高雄高等檢察分署提出上訴後，最高法院於111年1月6日撤銷二審判決，將本案發回台灣高等法院高雄分院審理，現由台灣高等法院高雄分院審理中。
2. 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(「投保中心」)於107年10月26日依證券投資人及期貨交易人保護法，對本公司及本公司董事暨營運長吳田玉提起董事解任訴訟，橋頭地方法院審理後，於109年8月25日判決駁回原告投保中心之起訴。投保中心不服提起上訴，經台灣高等法院高雄分院審理後，於110年9月29日駁回投保中心之上訴。投保中心續於110年10月20日向最高法院提出上訴，本案現由最高法院審理中。
3. 投保中心於110年7月2日依證券投資人及期貨交易人保護法，代投資人對本公司董事暨營運長吳田玉及前述刑事案件其他三名共同被告求償，提起團體訴訟，本案現由智慧財產及商業法院審理中。
4. 本公司大陸子公司之五名員工與廢棄物供應商於107年間因涉嫌違犯污染環境罪，遭當地人民檢察院起訴，於法院審理過程中，當地檢察院認為應當追加起訴單位犯罪，致該子公司於108年10月接獲檢察院追加、變更起訴決定書。當地一審法院於109年6月判處子公司罰金人民幣400仟元，並追繳違法所得人民幣344仟元。由於該案有共同被告提出上訴，依當地法令規定視為全部上訴，經當地二審法院審理後，於110年4月駁回上訴，全案終結。

(十三) 其他重要風險及因應措施：

風險管理組織架構

為使本公司能事先發現內外部營運風險，並經適當評估及處理程序後，能將風險有效預防並減低損失，同時即時掌握營運風險，本公司已於董事會下設置風險管理委員會並通過風險管理委員會組織規程，由兩名獨立董事及一位委員所組成本委員會，董事會為風險管理之最高決策單位，依經營策略及環境變化，核定與風險管理有關之重大決策。風險管理委員會負責綜理本公司整體之風險管理、執行董事會風險管理決策、協調及促進跨組織之風險管控方案、督導及管理本公司及各子公司整體風險管控改善機制、審查並整合各風險管控報告，每年定期向董事會提出報告，並適時向董事會反應風險管理執行情形，提出必要之改善建議。另為使本公司所面臨之企業新興風險的有效管理，使營運持續不中斷並永續發展，本公司於110年指派風險管理委員會委員暨本公司行政長汪渡村先生擔任風險長，以俾更有效整合風險委員會及各子公司之風險管理能量。

本公司亦要求各子集團成立集團級風險管理單位，負責集團旗下各子公司風險管理，並對本公司風險管理委員會負責。本公司及各子公司透過建立預防、預警、應變、危機管理和營運持續計畫，來減輕、轉移或規避風險，藉由完善的管理方案，本公司已經將各種風險情境有效納入管控。

本公司風險管理過程如下：首先，鑑別企業層面和營運層面的風險，排序記錄於風險登錄表(Risk Register)；接著，根據風險等級與控制有效性來評估主要風險，並且將其繪製對應於風險地圖上。此外，我們採用相關性分析(Correlation Analysis)檢視主要風險因子間是否存在有高度關聯性，必要時將制訂進一步的風險減緩計畫來降低剩餘風險，主要風險則會隨同因應計畫呈報給高階管理階層，並定時監控進展。

風險管理政策與程序辦法

本公司董事會於109年通過「風險管理政策與程序辦法」，以作為本公司風險管理之最高指導原則；本公司經營管理階層應具備風險管理意識，並將風險管理融入經營策略與組織文化，每年定期評估風險，並針對主要風險擬定管理方案，涵蓋管理目標、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等機制並落實執行，以有效辨識、衡量、監督及控制本公司之各項風險，將因業務活動所產生的風險控制在可承受的範圍。

風險辨識及管理

本公司導入兼具自上而下及自下而上的企業風險管理方法，加強高階管理階層與各組織部門的風險管理連結，並確保集團層級風險的合理管理。本公司並由高階管理階層鑑別重要之關鍵風險，再交由各風險職責單位評估檢視，藉此將企業風險管理轉變為增強組織整體決策的有效作為。

本公司對於日常經營活動所面對之各項風險，就其發生之可能性及影響性綜合評估，採取適當之對策，以持續改善及降低企業風險。本公司之經營風險，大約可歸納為營運風險、策略風險、市場風險、作業風險、法令遵循風險、資訊安全風險、環境風險、氣候變遷風險、財務風險及其他與經營有關風險等。為確保各項風險控制在可容忍範圍內，本公司訂有各類風險之彙總及管理指標，由各風險職責單位定期監控。

本公司鑑別出可能對經營目標產生影響的風險及事件，經評估後決定適當的應對措施，同時，本公司亦將新興風險的識別和管理納入企業風險管理計劃。

新興風險

本公司高階管理階層於110年所辨識出之關鍵風險，包含資訊安全、地域政治、能源管理與替代能源及關鍵人才等四項，本公司經觀察評估後將資訊安全、能源管理與替代能源、地域政治列為新興風險，本公司認為前揭風險為長期性且風險仍有持續增加的趨勢，故已請各子集團風險管理委員會進行充分討論與評估，了解對未來營運的潛在不利影響以採行適當的風險管理措施來降低或移轉風險。

在資安管理風險方面，本公司已建立資訊安全風險管理架構：包含制定資訊安全政策、於企業永續發展委員會之公司治理團隊下成立資安管理分組、定期檢討資訊安全管理現況與策略並定期向董事會報告等。

本公司將資訊安全風險管理列為重要營運事項，確保本公司重要資訊財產之機密性、完整性及可用性，並符合相關法規或法令之要求，進而獲得客戶之信賴，以防止及降低資訊安全事件所帶來之衝擊，將企業風險與損失降至最低、提升公司競爭優勢，確保營運及重要業務永續運作。因應遠距上班及自動化(智慧)工廠之工作型態，網路使用的安全性更顯重要，如若企業發生資安事件，可能使工廠營運受到嚴重影響，因而降低或喪失公司之競爭力。因此，本公司就資安管理已在前期的鑑別、保護、偵測階段，加強防禦佈建包括編列資安預算及提升產品效率等，並安排教育訓練以提升技術能力；在中後期的回應、復原階段，則以強化應變機制，並定期執行災難復原演練，確保本公司在關鍵時刻能發揮應變能力，維持資訊系統營運不中斷。此外，也將再提升全球各廠區ISO27001的涵蓋率，並導入IEC62443工業自動化和控制系統的資安標準教育訓練，提升防護力。110年由投控永續處邀集各子公司資安團隊組成資安平台，除訂定資安事故等級及風險通報機制外，也藉由資安平台整合加強各子公司資安保護力道，並委請資安廠商至各子公司進行營運技術資安健檢，以落實管控資安風險。

在能源管理與替代能源風險方面，全球推動淨零碳排放及使用再生能源已成為企業應正面面對的議題，部分國家亦開始制定相關法令要求繳交碳費或課徵碳稅，或訂定再生能源使用規範。其中台灣用電大戶條款已於110年1月公告，新法規定契約容量達5,000瓩以上的用電大戶，應在五年內完成設置10%綠電(或四年內完成設置9%或三年內完成設置8%)，也可用儲能、購買再生能源憑證、繳納代金代替。因應前揭風險，本公司於110年由財務、行政、永續、採購及台灣各子公司團隊組成綠電平台，經評選後，已選定再生能源供應商簽署合作意向書，並由各子公司依用電大戶需求與供應商簽署電力採購

協議，於110年底已初步達成台灣用電大戶法規需求，後續將考量再生能源市場趨勢並即時加強再生能源採購數量以符合永續指標以及邁向淨零排放的需求。

地域政治風險，因中美貿易戰持續中，各國藉由法律的制訂或修訂的手段來影響商業活動，不論美國的出口管制條例或中國大陸新頒布的「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」等，均會增加企業法遵成本，然而本公司為避免前述風險，已由法遵部門及法務部門隨時注意各國法令變化，並即時向各子公司發出法遵提醒並進行遵法調查，以確保能即時做出回應。此外，有鑑於世界上少數區域仍有一定的政治風險，因此本公司亦隨時關注並即時因應之。

於其他重要風險部分，關鍵人才部分，面對國內及國外企業均大舉招募人才，加上疫情影響人才流通風險，為使本公司之關鍵人才得以持續留任，本公司已透過建立關鍵人才資料庫建構及維持有效的管理機制，並持續強化留才及徵才機制，並透過有效激勵員工、管理員工輪調、控管離職率等風險，以符合法規面、客戶要求，並達成投資人與評比機構指標及標竿企業等目標。

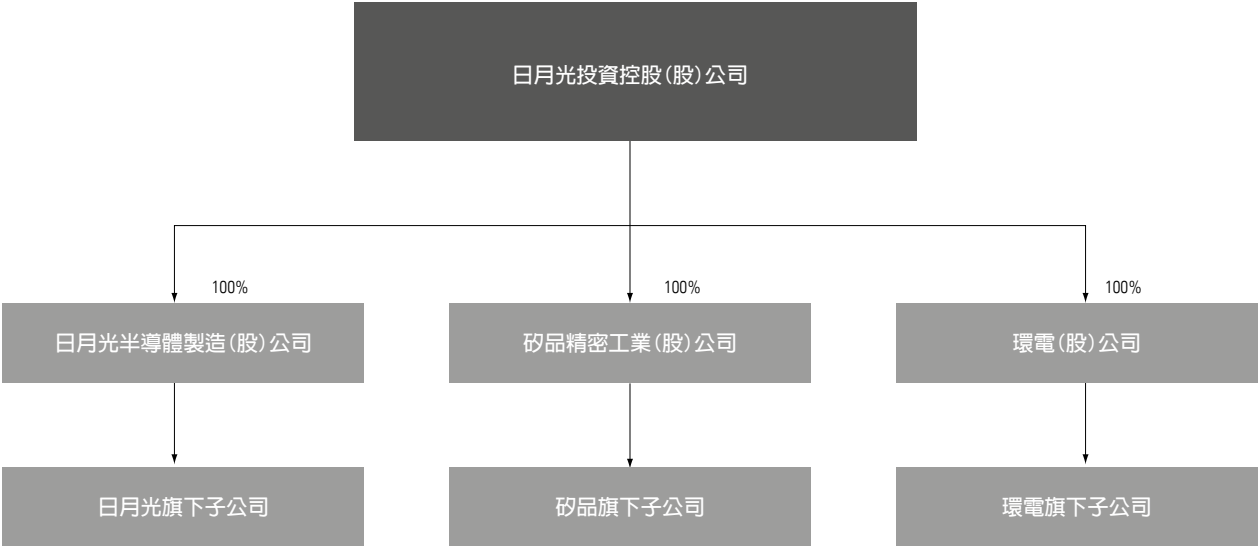
在COVID-19疫情方面，於110年疫情尚未止歇，因此本公司於疫情爆發之初超前佈置所建置之醫療口罩產線仍持續運作，並無償提供台灣子公司員工做為防疫之用。另於疫情爆發之際，也配合政府政策設置企業自主快篩站，以確保員工、客戶、廠商之健康並確保生產不會因疫情而中斷。

七、其他重要事項：無。

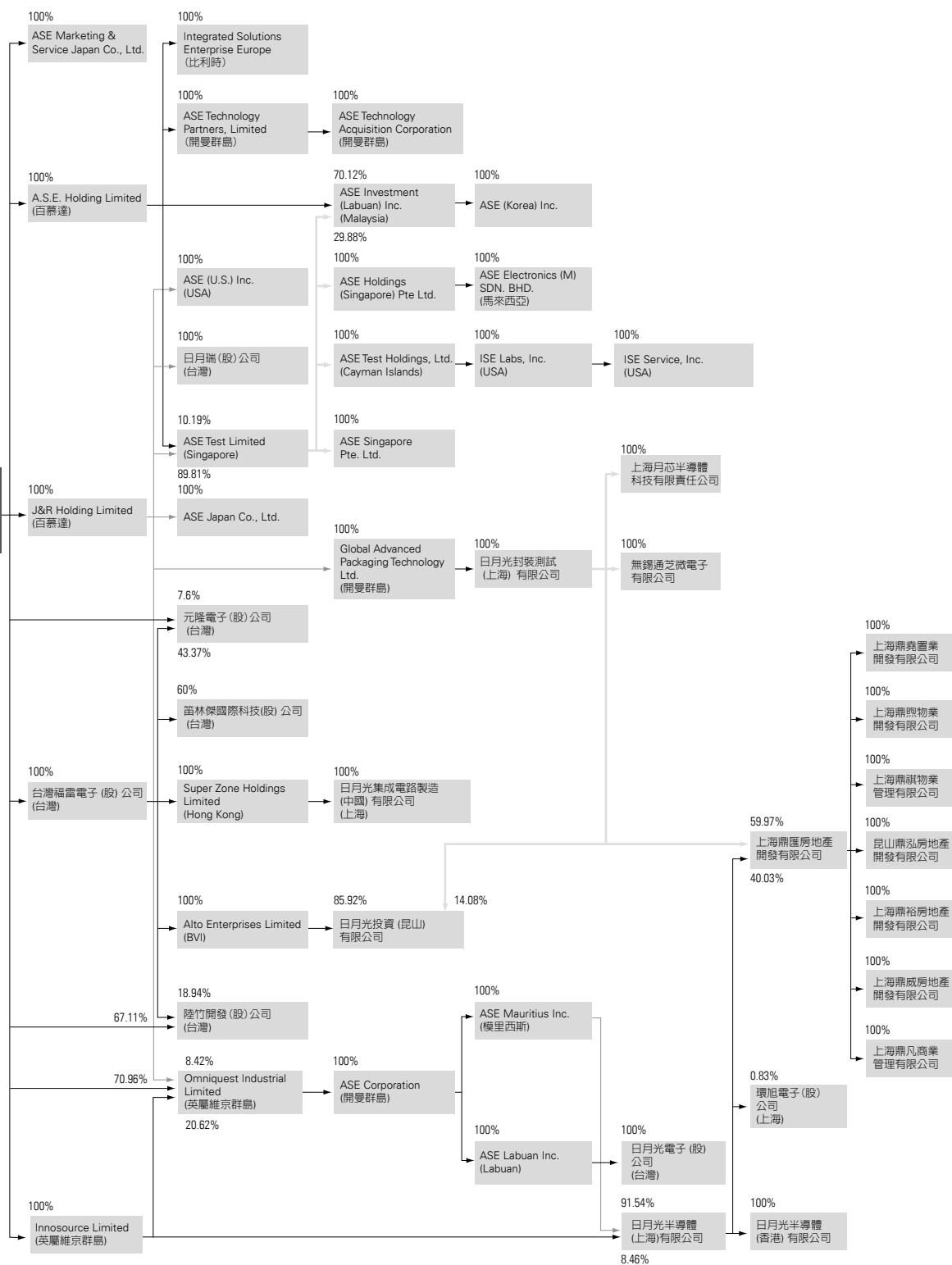
捌、特別記載事項

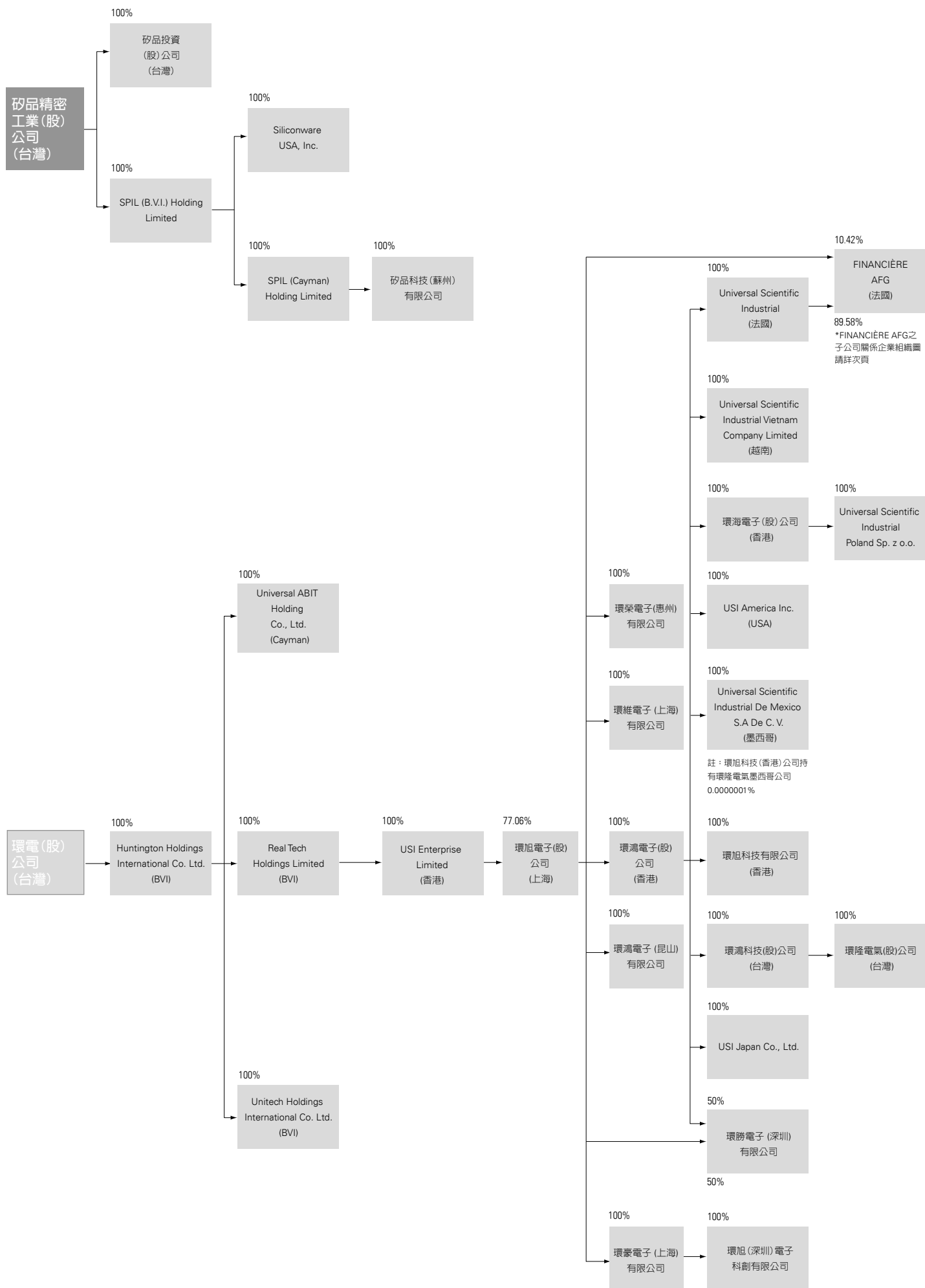
一、關係企業相關資料

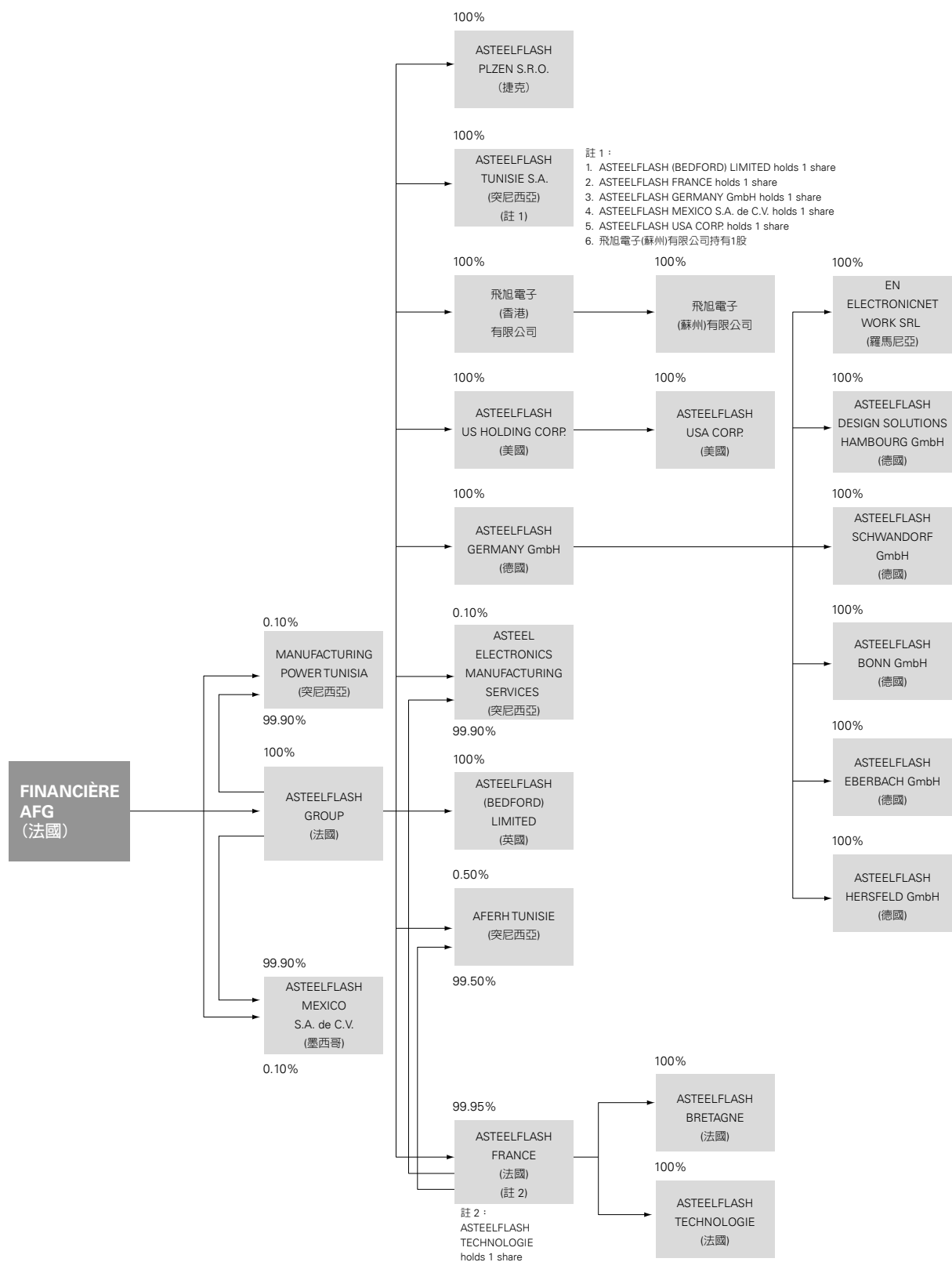
(一) 關係企業組織圖 (110.12.31)



日月光半導體
製造(股)公司
(台灣)







(二) 各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
日月光投資控股股份有限公司	107年4月	高雄市楠梓區經三路26號	NT\$44,086,502千元	從事專業性投資
日月光半導體製造股份有限公司	73年3月	高雄市楠梓區經三路26號	NT\$59,941,438千元	半導體之製造、組合、加工、測試及銷售
矽品精密工業股份有限公司	73年5月	台中市潭子區大豐里大豐路3段123號	NT\$36,517,489千元	各項積體電路構裝之製造、加工、買賣及測試等有關業務
環電股份有限公司	104年4月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT\$27,175,142千元	從事專業性投資活動
J&R Holding Limited	84年12月	Victoria Place, 5th Floor 31 Victoria Street Hamilton HM, Bermuda	US\$435,128千元	從事專業性投資
A.S.E. Holding Limited	79年2月	Victoria Place, 5th Floor 31 Victoria Street Hamilton HM, Bermuda	US\$243,966千元	從事專業性投資
Innosource Limited	90年6月	Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands	US\$86,100千元	從事專業性投資
Omniquest Industrial Limited	89年9月	Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands	US\$358,804千元	從事專業性投資
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	92年11月	Sumitomo Fudosan Shinyokohama Bldg., 10F, 2-5-5, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan 222-0033	JPY60,000千元	從事市場行銷及顧客服務等業務
元隆電子股份有限公司	76年6月	新竹市科學工業園區研發二路18號	NT\$4,381,456千元	晶圓積體電路代工
台灣福雷電子股份有限公司	76年12月	高雄市楠梓區西五街10號	NT\$11,314,525千元	半導體產品測試服務
陸竹開發股份有限公司	93年12月	台北市信義區基隆路1段333號19樓	NT\$2,163,282千元	房地產開發業務
笛林傑國際科技股份有限公司	89年12月	台北市信義區光復南路475號5樓	NT\$35,318千元	資訊軟體服務業務
Alto Enterprises Limited	99年3月	Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands	US\$188,000千元	從事專業性投資活動
Super Zone Holdings Limited	97年6月	1408 World-Wide House, 19 Des Voeux Road Central, Hong Kong	US\$100,000千元	從事專業性投資活動
日月光投資(昆山)有限公司	101年5月	江蘇省昆山市千燈鎮黃浦路497號2號房	CNY894,226千元	從事專業性投資活動
日月光集成電路製造(中國)有限公司	99年7月	上海市浦東新區華東路5001號T3-10-202室	CNY665,973千元	從事半導體封裝測試、售後服務、諮詢及廠房出租等業務
ASE Investment (Labuan) Inc.	88年6月	Lot 2 & 3, Level 3, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan, 87000 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia	US\$241,947千元	從事專業性投資
ASE Test Limited	84年12月	1 Marina Boulevard #28-00 One Marina Boulevard, Singapore (018989)	US\$27,356千元	從事專業性投資
ASE (Korea) Inc.	56年3月	76, Saneopdanji-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea	US\$97,976千元	半導體產品封裝測試服務
日月瑞股份有限公司	88年4月	高雄市楠梓區內環北路107號	NT\$42,074千元	從事租賃及投資業務
ASE Japan Co., Ltd.	93年5月	1863, Iryuda, Takahata-machi, Higashiokitama-gun, Yamagata, 992-0324, Japan	JPY100,000千元	半導體產品封裝測試服務
ASE (U.S.) Inc.	72年12月	1255 E. Arques Ave. Sunnyvale, CA 94085, USA	US\$20千元	從事市場行銷及顧客服務等業務
Global Advanced Packaging Technology Limited	89年10月	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands	US\$376,041千元	從事專業性投資
日月光半導體(上海)有限公司	90年12月	上海張江高科技園區金科路2300號	CNY1,174,568千元	發光二極體及二極體顯器製造、印刷電路板產銷
ASE Corporation	95年3月	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands	US\$356,284千元	從事專業性投資
ASE Mauritius Inc.	95年4月	Ebene Esplanade, 24 Cybercity, Ebene, Mauritius	US\$217,800千元	從事專業性投資
ASE Labuan Inc.	95年3月	Lot 2 & 3, Level 3, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan, 87000 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia	US\$126,184千元	從事專業性投資
上海鼎匯房地產開發有限公司	94年8月	上海市浦東新區郭守敬路351號2號樓602A-04室	CNY3,600,000千元	房地產項目開發、物業管理
上海鼎祺物業管理有限公司	104年1月	上海市徐匯區漕寶路33號九層01部位B9-03-2室	CNY1,000千元	房地產經紀、物業管理
日月光半導體(香港)有限公司	97年4月	Room 2702-3, 27th Floor, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong	US\$1,000千元	從事貿易活動
上海鼎威房地產開發有限公司	98年10月	上海市徐匯區漕寶路33號	CNY1,798,000千元	房地產開發經營、物業管理
上海鼎裕房地產開發有限公司	99年3月	上海市寶山區滬太路1933號	CNY1,100,000千元	房地產開發經營、物業管理
上海鼎凡商業管理有限公司	105年7月	上海市徐匯區漕寶路33號九層01部位B9-03-1室	CNY2,000千元	商業綜合體管理服務及百貨貿易等相關業務
昆山鼎泓房地產開發有限公司	101年2月	江蘇省昆山市千燈鎮聖祥東路25號2號房	CNY670,000千元	房地產開發經營、物業管理
上海鼎煦物業管理有限公司	106年6月	上海自由貿易試驗區盛夏路169號、張東路1658號1幢750室	CNY5,000千元	物業管理、房地產經紀等業務
上海鼎堯置業發展有限公司	105年7月	上海市寶山區滬太路1933號四層C-400	CNY10,000千元	房地產物業管理服務

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
日月光電子股份有限公司	95年3月	高雄市楠梓區開發路73號	NT\$3,989,819千元	電子材料批發業、電子材料零售業、國際貿易業
ASE Test Holdings, Ltd.	88年4月	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands	US\$5千元	從事專業性投資
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	83年12月	10, Hoe Chiang Road, #17-02 Keppel Towers, Singapore	SG\$71,429千元	從事專業性投資
ASE Singapore Pte. Ltd.	87年2月	2 Woodlands Loop Singapore 738074	US\$30,056千元	半導體產品封裝測試服務
ISE Labs, Inc.	72年11月	46800 Bayside Parkway Fremont, CA94538, U.S.A	US\$26千元	半導體產品測試服務
ISE Services, Inc.	103年4月	1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801	US\$1千元	晶圓代購及客戶產品管理服務
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	80年2月	Plot 20, Phase IV, Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Bayan Lepas, Penang	US\$62,260千元	半導體產品封裝測試服務
日月光封裝測試(上海)有限公司	89年12月	上海自由貿易試驗區盛夏路169號、張東路1658號10幢6樓	CNY771,667千元	半導體產品封裝測試服務
上海月芯半導體科技有限責任公司	107年10月	上海自由貿易試驗區盛夏路169號、張東路1658號1幢309室	CNY100,000千元	半導體產品測試服務
無錫通芝微電子有限公司	99年3月	江蘇省無錫市新區閩江路21號52地塊29-B廠房	CNY73,461千元	半導體產品封裝及測試業務
SPIL (B.V.I.) Holding Limited	89年12月	Flemming House, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US\$199,400千元	從事專業性投資
矽品投資股份有限公司	104年11月	台北市大安區敦化南路2段105號9樓	NT\$1,162,413千元	從事專業性投資
Siliconware USA, Inc.	85年3月	1735 Technology Drive, #300, San Jose, CA 95110, USA	US\$1,250千元	北美地區行銷業務服務
SPIL (Cayman) Holding Limited	91年1月	89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands	US\$201,200千元	從事專業性投資
矽品科技(蘇州)有限公司	90年12月	中國江蘇省蘇州市蘇州工業園鳳凰里街288號	CNY1,478,828千元	封裝及測試服務
Huntington Holdings International Co. Ltd.	85年10月	P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, B.V. I.	US\$255,857千元	控股公司
Unitech Holdings International Co. Ltd.	85年10月	P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, B.V. I.	US\$3,000千元	控股公司
Real Tech Holdings Litimted	89年3月	Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110	US\$149,151千元	控股公司
Universal ABIT Holding Co., Ltd.	95年2月	The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P. O. Box 32052, Grand Cayman, KY1-1208, Cayman Islands	US\$28,125千元	控股公司
USI Enterprise Limited	96年11月	Unit A, 7/F, Yuen Long Hi Tech Centre, 11 Wang Yip Street West, Yuen Long, New Territories	US\$210,900千元	投資諮詢服務及倉儲管理服務
環旭電子股份有限公司	92年1月	上海市浦東新區張江高科技園區張東路1558號	CNY2,210,173千元	提供電子產品設計製造服務，生產及加工新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件等
環鴻電子股份有限公司	97年3月	Unit A, 7/F, Yuen Long Hi Tech Centre, 11 Wang Yip Street West, Yuen Long, New Territories	US\$372,500千元	控股公司
環鴻電子(昆山)有限公司	100年8月	江蘇省昆山市千燈鎮黃浦路497號4棟	CNY550,000千元	提供電子產品設計及製造服務
環維電子(上海)有限公司	102年9月	上海市浦東新區金橋出口加工區龍桂路501號	CNY1,330,000千元	電子產品的研發及製造，新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件、移動通信產品及模塊、零配件的加工及維修，電子產品、通訊產品及零配件的銷售，第三方物流服務，從事貨物及技術的進出口業務
環豪電子(上海)有限公司	103年5月	中國(上海)自由貿易試驗區張東路1558號1幢1樓	CNY50,000千元	電子元器件、計算機軟硬件、通訊設備及配件的銷售，第三方物流服務，從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易，區內企業間貿易及貿易代理
環旭科技有限公司	98年10月	Rooms 2702-3, 27th Floor, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong	US\$11,000千元	貿易及投資控股公司

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
環鴻科技股份有限公司	98年12月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT\$1,980,000千元	電子通信器材、汽車及其零件製造、產品設計及研究發展服務
USI America Inc.	89年10月	1255 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085	US\$9,500千元	新型主機板組裝與製作、無線通訊產品製作及維修服務
Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	86年9月	Anillo Periferico Manuel Gomez Morin 656 Jardines Santa Isabel CP44300, Guadalajara, Jalisco, Mexico	US\$63,963千元	主機板及電腦系統組裝
USI Japan Co., Ltd.	89年3月	Sumitomo Fudosan Shin-yokohama Bldg. 10F 2-5-5. Shin-yokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, Japan	JPY95,000千元	電腦資訊之週邊設備、積體電路、電子零件等之製造買賣
環勝電子(深圳)有限公司	89年7月	廣東省深圳市南山區西麗街道高新技術園北區北環大道9028號環旭電子園	CNY585,624千元	生產經營電腦主機板、其他相關電腦週邊設備及通訊工業控制等產品之設計、製造及銷售
環海電子股份有限公司	106年12月	Rooms 2702-3, 27th Floor, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong	US\$51,000千元	接單並委外加工，銷售電子產品，提供技術諮詢服務
環隆電氣股份有限公司	63年2月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT\$1,399,727千元	從事各種電腦及週邊設備之製造、加工維修及銷售
Universal Scientific Industrial (France)	108年8月	95 rue La Boetie 75008 Paris	EUR321,375千元	控股公司
環榮電子(惠州)有限公司	108年4月	惠州大亞灣石化大道中科技路1號創新大廈8樓	CNY460,000千元	研發及生產經營新型電子元器件、通信類、電腦類及其他電子產品，從事電子類產品維修檢測及進出口等配套服務
Universal Scientific Industrial Poland Sp. z o.o.	96年7月	Biskupice Podgórne, ul. Innowacyjna 455-040 Kobierzyce Poland	PLN80,852千元	提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器件等業務
Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited	109年6月	越南海防市海安郡東海2坊 Dinh Vu 工業區CN4.1H 號地塊	US\$80,000千元	穿戴電子設備晶片製造和組裝
環旭(深圳)電子科創有限公司	109年9月	深圳市南山區西麗街道松坪山社區北環路高新北區環旭電子廠101	CNY10,000千元	電子產品設計、技術服務及技術諮詢；電子產品、通訊產品及相關零配件的批發、經營進出口業務；物業管理等
FINANCIÈRE AFG	103年3月	6 rue Van Gogh 93360 NEUILLY PLAISANCE	EUR183,650千元	控股公司
ASTEELFLASH GROUP	94年10月	6 rue Van Gogh 93360 NEUILLY PLAISANCE	EUR99,887千元	控股公司
ASTEELFLASH (BEDFORD) LIMITED	76年5月	Units 1 & 2, St Martins Business Centre ST Martins Road Bedford, Bedfordshire MK42 0LF	GBP53千元	從事電子產品的設計、製造及加工
ASTEELFLASH FRANCE	88年2月	6 rue Van Gogh 93360 NEUILLY PLAISANCE	EUR11,858千元	從事電子產品的設計、製造及加工
ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	99年12月	104 avenue de l'UMA 2045 La Soukra	EUR8,272千元	從事電子產品的設計、製造及加工
飛旭電子(香港)有限公司	93年12月	9/F TUNG NING BLDG 249-253 DES VOEUX RD CENTRAL HK	US\$23,682千元	控股公司
ASTEELFLASH MEXICO S.A. de C.V.	100年12月	Av. Produccion 5-B Parque Industrial FINSA - Tijuana B.C.N	MXN100千元	從事電子產品的設計、製造及加工
ASTEELFLASH GERMANY GmbH	102年4月	Konrad-Zuse-Straße 19-21 36251 Bad Hersfeld	EUR1,000千元	從事電子產品的設計、製造及加工
MANUFACTURING POWER TUNISIA	95年2月	104 avenue de l'UMA 2045 La Soukra	EUR4千元	從事電子產品的設計、製造及加工
ASTEELFLASH US HOLDING CORP	100年9月	1679 S. Dupont Highway, Suite 100, City of Dover, County of Kent, Delaware 19901	US\$16,509千元	控股公司
ASTEELFLASH TECHNOLOGIE	94年1月	Rue de Gatel ZI Nord BP26 61250 VALFRAMBERT	EUR3,150千元	從事塑膠射出及工業零組件的設計、製造及加工
ASTEELFLASH BRETAGNE	91年6月	Zone Industrielle de Lannugat 29100 Douarnenez	EUR38千元	從事電子產品的設計、製造及加工
ASTEEL ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES	96年12月	Elisant domicile a Rue des fonderies Megrine Riadh Ben Arous	TND20千元	從事電子產品的設計、製造及加工
AFERH TUNISIE	97年10月	Nahj Al-Mashabak, P.O. headquarters, Riyadh, 2014, Ben Arous	TND20千元	從事組織與人力資源的管理、培訓及諮詢
飛旭電子(蘇州)有限公司	91年2月	吳江經濟技術開發區古塘路2號	US\$18,000千元	從事電子產品的設計、製造及加工
ASTEELFLASH HERSFELD GmbH	84年9月	Konrad-Zuse-Straße 19-21 36251 Bad Hersfeld	EUR5,034千元	從事電子產品的設計、製造及加工
ASTEELFLASH EBERBACH GmbH	91年1月	Neuer Weg-Nord 49 69412 Eberbach	EUR1,225千元	從事電子產品的設計、製造及加工
ASTEELFLASH BONN GmbH	94年3月	Allerstrasse 31 53332 Bornheim - Hersel	EUR500千元	從事電子產品的設計、製造及加工
ASTEELFLASH SCHWANDORF GmbH	105年12月	Allerstraße 31, 53332 Bornheim. Germany	EUR25千元	從事電子產品的設計、製造及加工
ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH	86年9月	Meiendorfer Straße 205 22145 Hamburg	EUR128千元	從事電子產品的設計、製造及加工
ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.	100年4月	Building BP 8, industrial complex of City park Plzen, cadastral area Skvrnany	EUR5,017千元	從事電子產品的設計、製造及加工

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
EN ELECTRONICNETWORK SRL	101年9月	Municipiul Oradea, Strada REPUBLICII, Nr. 10/A, Etaj 1, Ap. 8, Judet Bihor	RON200元	從事電子產品的設計、製造及加工
ASTEELFLASH USA CORP.	100年11月	4211 Starboard Drive CA 94538	US\$21,465千元	從事電子產品的設計、製造及加工
Integrated Solutions Enterprise Europe	94年7月	Rue de la Fauvette 1 1180 Uccle	EUR12千元	從事貿易業務
ASE Technology Partners, Limited	110年7月	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands	US\$320千元	從事專業性投資
ASE Technology Acquisition Corporation	110年7月	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands	US\$575元	從事專業性投資

(三) 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情形。

(四) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

1. 本公司整體關係企業經營業務所涵蓋之行業包括電子製造業、電子服務業、投資業、租賃業及建設業。
2. 本集團長久以來主要專注於提供半導體客戶完整之半導體封裝及測試服務，包括晶片前段測試及晶圓針測至後段之封裝材料及性能測試之服務。此外，客戶也可透過子公司環電(股)公司獲得完善的電子製造服務整體解決方案。
3. 大體而言本公司各關係企業間所經營業務互有關聯，其往來分工情形係透過技術、產能、行銷以及服務之相互支援，以發揮集團最大競爭實力，創造最大綜效，鞏固本公司在業界的領導地位。

(五) 各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
日月光投資控股股份有限公司	董事	香港商微電子國際公司	684,327,886 股	15.52 %
	董事長	張虔生	—	—
	副董事長及總經理	張洪本	—	—
	董事(代表人)	蔡祺文	—	—
	董事(代表人)	吳田玉	—	—
	董事(代表人)	董宏思	—	—
	董事(代表人)	羅瑞榮	—	—
	董事(代表人)	陳天賜	—	—
	董事(代表人)	陳昌益	—	—
	董事(代表人)	張衍鈞	—	—
	董事	張能傑	1,577,647 股	0.04 %
	獨立董事	游勝福	—	—
	獨立董事	何美玥	—	—
	獨立董事	翁文祺	—	—
日月光半導體製造股份有限公司	董事及監察人	日月光投資控股(股)公司	5,994,143,764 股	100.00 %
	董事長	張虔生	—	—
	董事(代表人)	張能傑	—	—
	董事(代表人)	羅瑞榮	—	—
	董事(代表人)	陳天賜	—	—
	董事(代表人)	陳昌益	—	—
	董事(代表人)	張能超	—	—
	董事(代表人)	唐瑞文	—	—
	董事(代表人)	汪渡村	—	—
	董事(代表人)	李柏練	—	—
	監察人(代表人)	張淡堯	—	—
	監察人(代表人)	周家佩	—	—
	監察人(代表人)	李俊哲	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
矽品精密工業股份有限公司	董事及監察人	日月光投資控股(股)公司	3,651,748,878股	100.00%
	董事長	蔡祺文	—	—
	副董事長	張衍鈞	—	—
	董事(代表人)	簡坤義	—	—
	董事(代表人)	羅曉餘	—	—
	董事(代表人)	顧永川	—	—
	董事(代表人)	曾維楨	—	—
	董事(代表人)	張益豐	—	—
	董事(代表人)	張明山	—	—
	董事(代表人)	于有志	—	—
	監察人(代表人)	許清裕	—	—
	監察人(代表人)	林玉猛	—	—
環電股份有限公司	董事及監察人	日月光投資控股(股)公司	2,717,514,202股	100%
	董事長	陳昌益	—	—
	董事(代表人)	吳田玉	—	—
	董事(代表人)	魏鎮炎	—	—
	董事(代表人)	張能傑	—	—
	董事(代表人)	張能超	—	—
	董事(代表人)	潘士華	—	—
	董事(代表人)	李俊哲	—	—
	董事(代表人)	李柏練	—	—
	董事(代表人)	魏振隆	—	—
	董事(代表人)	石孟國	—	—
	董事(代表人)	劉丹陽	—	—
	監察人(代表人)	唐瑞文	—	—
	監察人(代表人)	俞旭濱	—	—
	監察人(代表人)	曾元一	—	—
	監察人(代表人)	簡文祥	—	—
	監察人(代表人)	林潔興	—	—
J&R Holding Limited	董事	Jason C. S. Chang	—	—
	董事	Richard H. P. Chang	—	—
	董事	Joseph Tung	—	—
A.S.E Holding Limited	董事	Jason C. S. Chang	—	—
	董事	Richard H. P. Chang	—	—
	董事	Joseph Tung	—	—
Innosource Limited	董事	Jason C. S. Chang	—	—
	董事	Richard H. P. Chang	—	—
	董事	Joseph Tung	—	—
Omniquest Industrial Limited	董事	Richard H. P. Chang	—	—
	董事	Joseph Tung	—	—
	董事	Jeffrey Chen	—	—
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	董事長	Tien Wu	—	—
	董事	David Pan	—	—
	董事	Chih-Hsiao Chung	—	—
	監察人	Joseph Tung	—	—
元隆電子股份有限公司	董事	日月光半導體製造(股)公司	33,308,452 股	7.60%
	董事	榮大投資(股)公司	24,963,367 股	5.70%
	董事長	陳清忠	—	—
	董事(代表人)兼總經理	陳弘元	—	—
	董事(代表人)	李柏練	—	—
	董事(代表人)	潘士華	—	—
	獨立董事	George Yen	—	—
	獨立董事	陳志明	—	—
	獨立董事	楊有龍	5,290 股	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
台灣福雷電子股份有限公司	董事及監察人	日月光半導體製造(股)公司	1,131,452,502 股	100.00%
	董事長	張虔生	—	—
	董事(代表人)兼總經理	羅瑞榮	—	—
	董事(代表人)	潘士華	—	—
	董事(代表人)	張能傑	—	—
	董事(代表人)	陳天賜	—	—
	董事(代表人)	李柏練	—	—
	董事(代表人)	陳昌益	—	—
	董事(代表人)	鄭天正	—	—
	董事(代表人)	張能超	—	—
	董事(代表人)	李俊哲	—	—
	董事(代表人)	張淑琴	—	—
	監察人(代表人)	唐瑞文	—	—
	監察人(代表人)	郭宏銘	—	—
	監察人(代表人)	曾元一	—	—
陸竹開發股份有限公司	董事	日月光半導體製造(股)公司	145,178,015 股	67.11%
	監察人	台灣福雷電子(股)公司	40,981,245 股	18.94%
	董事長	潘士華	—	—
	董事(代表人)	陳天賜	—	—
	董事(代表人)	郭宏銘	—	—
	董事(代表人)	李柏練	—	—
	董事(代表人)	董宏思	—	—
	監察人(代表人)	俞旭濤	—	—
	監察人(代表人)	張聲華	—	—
笛林傑國際科技股份有限公司	董事	台灣福雷電子(股)公司	2,119,080 股	60%
	董事長	潘士華	—	—
	董事	林世玲	617,720股	17.49%
	董事兼總經理	董宏思	366,000股	10.36%
	董事(代表人)	李柏練	—	—
	董事(代表人)	劉珠玲	—	—
	監察人	劉詩亮	—	—
Alto Enterprises Limited	董事	Jason Chang	—	—
	董事	Richard Chang	—	—
	董事	Joseph Tung	—	—
Super Zone Holdings Limited	董事	張虔生	—	—
	董事	張洪本	—	—
	董事	陳昌益	—	—
日月光投資(昆山)有限公司	董事長	張虔生	—	—
	董事兼總經理	張能傑	—	—
	董事	徐世康	—	—
	監事	鄭世欣	—	—
日月光集成電路製造(中國)有限公司	董事長兼總經理	汪渡村	—	—
	董事	陳慶華	—	—
	董事	俞旭濤	—	—
	監事	李柏練	—	—
ASE Investment (Labuan) Inc.	董事	A.S.E Holding Limited	—	—
	董事	Chau Siew Ha	—	—
	董事	ASE Test Limited	—	—
ASE Test Limited	董事	Jason C.S. Chang	—	—
	董事	Richard H.P. Chang	—	—
	董事	Lee Kwai Mun	—	—
	董事	Jeffrey Chen	—	—
	董事	Po Lien Li	—	—
ASE (Korea) Inc.	董事	Gichol Lee	—	—
	董事	Tien Wu	—	—
	董事	Joseph Tung	—	—
	監察人	Jeffrey Chen	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
日月瑞股份有限公司	董事及監察人	J&R Holding Limited	4,207,353股	100%
	董事長	張虔生	—	—
	董事(代表人)	張洪本	—	—
	董事(代表人)	董宏思	—	—
	監察人(代表人)	馮美珍	—	—
ASE Japan Co., Ltd.	董事長	Chih-Hsiao Chung	—	—
	董事	Tien Wu	—	—
	董事	David Pan	—	—
	監察人	Joseph Tung	—	—
ASE (U.S.) Inc.	董事	Kenneth Shih-Jye Hsiang	—	—
Global Advanced Packaging Technology Limited	董事	Richard H. P. Chang	—	—
	董事	Tien-Yue Wu	—	—
日月光半導體(上海)有限公司	董事長	吳田玉	—	—
	董事	李俊哲	—	—
	董事兼總經理	林鐘	—	—
	監事	陳昌益	—	—
ASE Corporation	董事	Jason Chang	—	—
	董事	Joseph Hung Szu Tung	—	—
ASE Mauritius Inc.	董事	Jason Chang	—	—
	董事	Chettensingh Awotarsing	—	—
	董事	Pharvis Sadaful	—	—
	董事	Li, Po-Lien	—	—
ASE Labuan Inc.	董事	Jason Chang	—	—
	董事	Joseph Hung-Szu Tung	—	—
	董事	Chau Siew Ha	—	—
上海鼎匯房地產開發有限公司	董事長	張虔生	—	—
	董事	Madeline D Chang	—	—
	董事	陳昌益	—	—
	董事兼總經理	鄭世欣	—	—
	董事	Andrew Robert Tang	—	—
	監事	彭國強	—	—
上海鼎祺物業管理有限公司	董事長	張虔生	—	—
	董事	陳駿霆	—	—
	董事	陳昌益	—	—
	總經理	蘇震南	—	—
	監事	彭國強	—	—
日月光半導體(香港)有限公司	董事長	張洪本	—	—
	董事	陳昌益	—	—
	董事	鄭世欣	—	—
上海鼎威房地產開發有限公司	董事長	張虔生	—	—
	董事	陳昌益	—	—
	董事兼總經理	陳駿霆	—	—
	董事	Madeline D Chang	—	—
	董事	Andrew Robert Tang	—	—
	監事	彭國強	—	—
上海鼎裕房地產開發有限公司	董事長	張虔生	—	—
	董事	陳昌益	—	—
	董事兼總經理	陳駿霆	—	—
	董事	Madeline D Chang	—	—
	董事	Andrew Robert Tang	—	—
	監事	彭國強	—	—
上海鼎凡商業管理有限公司	董事長	張虔生	—	—
	董事	陳昌益	—	—
	董事兼總經理	陳駿霆	—	—
	監事	彭國強	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
昆山鼎泓房地產開發有限公司	董事長	張虔生	—	—
	董事兼總經理	鄭世欣	—	—
	董事	陳昌益	—	—
	監事	彭國強	—	—
上海鼎煦物業管理有限公司	董事長	張虔生	—	—
	董事兼總經理	謝鵬	—	—
	董事	陳昌益	—	—
	監事	彭國強	—	—
上海鼎堯置業發展有限公司	董事長	張虔生	—	—
	董事兼總經理	陳駿霆	—	—
	董事	陳昌益	—	—
	監事	彭國強	—	—
日月光電子股份有限公司	董事及監察人	ASE Labuan Inc.	398,981,900 股	100%
	董事長	吳田玉	—	—
	董事(代表人)兼總經理	李俊哲	—	—
	董事(代表人)	陳昌益	—	—
	監察人(代表人)	潘士華	—	—
ASE Test Holdings, Ltd.	董事	Jason C. S. Chang	—	—
	董事	David Pan	—	—
	董事	Joseph Tung	—	—
	董事	Jeffrey Chen	—	—
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	董事	Hsiang De Way	—	—
	董事	Choong Lai Heng	—	—
	董事	Jeswant Singh s/o Darshan Singh	—	—
ASE Singapore Pte. Ltd.	董事長	Wu, Tien-Yue	—	—
	董事	Lee Kwai Mun	—	—
	董事	Kenneth Hsiang Shih-Jye	—	—
	董事	Fan Jui Ying	—	—
ISE Labs, Inc.	董事長	Tien Wu	—	—
	董事	Ken Hsiang	—	—
	董事	Jui Ko	—	—
	董事	Vincent Sy	—	—
	董事	Jeff Thompson	—	—
ISE Services, Inc.	董事	Ken Hsiang	—	—
	董事	Vincent Sy	—	—
	董事	Jeff Thompson	—	—
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	董事長	Tien Wu	—	—
	董事	Lee Kwai Mun	—	—
	董事	Hsiang, De-Way	—	—
	董事	Joseph Tung	—	—
	董事	Choong Lai Heng	—	—
日月光封裝測試(上海)有限公司	董事長	Tien-Yue Wu	—	—
	董事	李柏練	—	—
	董事兼總經理	汪渡村	—	—
	監事	陳昌益	—	—
上海月芯半導體科技有限責任公司	董事長	吳田玉	—	—
	董事	Kenneth Shih-Jye Hsiang	—	—
	董事兼總經理	陳有源	—	—
	監事	徐世康	—	—
無錫通芝微電子有限公司	董事長	吳田玉	—	—
	董事兼總經理	鐘智孝	—	—
	董事	陳昌益	—	—
	監事	董宏思	—	—
SPL (B.V.I.) Holding Limited	董事	蔡祺文	—	—
矽品投資股份有限公司	董事及監察人	矽品精密工業(股)公司	109,523,000股	100%
	董事長	蔡祺文	—	—
	董事(代表人)	張衍鈞	—	—
	董事(代表人)	黃忠傑	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Siliconware USA, Inc.	董事	蔡祺文	—	—
	董事	張啓斌	—	—
	董事兼總經理	Randy Hsiao-Yu Lo	—	—
SPL (Cayman) Holding Limited	董事	蔡祺文	—	—
矽品科技(蘇州)有限公司	董事	蔡祺文	—	—
	董事兼總經理	游志文	—	—
	董事	葉積暉	—	—
	監事	陳淑芬	—	—
Huntington Holdings International Co. Ltd.	董事	陳昌益	—	—
	董事	魏鎮炎	—	—
	董事	石孟國	—	—
	董事	魏振隆	—	—
Unitech Holdings International Co. Ltd	董事	魏鎮炎	—	—
	董事	石孟國	—	—
Real Tech Holdings Limited	董事	陳昌益	—	—
	董事	石孟國	—	—
	董事	魏鎮炎	—	—
Universal ABIT Holding Co., Ltd	董事	魏振隆	—	—
	董事	何弘	—	—
	董事	林大毅	—	—
	董事	石孟國	—	—
	董事	吳國相	—	—
USI Enterprise Limited	董事	劉丹陽	—	—
	董事	石孟國	—	—
	董事	魏鎮炎	—	—
環旭電子股份有限公司	董事長	陳昌益	—	—
	董事	Gilles Benhamou	—	—
	董事	Rutherford Chang	—	—
	董事兼總經理	魏鎮炎	—	—
	董事	汪渡村	—	—
	董事	Neng Chao Chang	—	—
	獨立董事	儲一昀	—	—
	獨立董事	湯雲為	—	—
	獨立董事	鐘依華	—	—
	監事	Andrew Robert Tang	—	—
	監事	石孟國	—	—
	監事	黃添一	—	—
環鴻電子股份有限公司	董事	陳昌益	—	—
	董事	魏鎮炎	—	—
	董事	劉丹陽	—	—
	董事	石孟國	—	—
環鴻電子(昆山)有限公司	董事長	陳昌益	—	—
	董事兼總經理	林大毅	—	—
	董事	魏鎮炎	—	—
	監事	石孟國	—	—
環維電子(上海)有限公司	董事長	陳昌益	—	—
	董事	魏鎮炎	—	—
	董事	魏振隆	—	—
	總經理	Jing Cao	—	—
	監事	石孟國	—	—
環豪電子(上海)有限公司	董事長	陳昌益	—	—
	董事兼總經理	魏鎮炎	—	—
	董事	石孟國	—	—
	監事	劉丹陽	—	—
環旭科技有限公司	董事	陳昌益	—	—
	董事	魏鎮炎	—	—
	董事	石孟國	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
環鴻科技股份有限公司	董事及監察人	環鴻電子(股)公司	198,000,000股	100%
	董事長	魏鎮炎	—	—
	董事(代表人)	陳昌益	—	—
	董事(代表人)	石孟國	—	—
	監察人(代表人)	劉丹陽	—	—
USI America Inc.	董事	魏鎮炎	—	—
	董事	陳麗華	—	—
	董事	石孟國	—	—
Universal Scientific Industrial De Mexico S.A De C.V.	董事	魏鎮炎	—	—
	董事	侯爵	—	—
	董事	林大毅	—	—
	董事	石孟國	—	—
	董事	Ignacio Montes Arias	—	—
	總經理	Bernardo Santos Balderrama	—	—
USI Japan Co., Ltd.	董事	魏鎮炎	—	—
	董事	魏振隆	—	—
	董事	侯爵	—	—
	董事	鐘智孝	—	—
	監察人	石孟國	—	—
環勝電子(深圳)有限公司	董事長	魏鎮炎	—	—
	董事	侯爵	—	—
	董事	魏振隆	—	—
	董事	陳昌益	—	—
	董事	林大毅	—	—
	總經理	林岳明	—	—
	監事	石孟國	—	—
環海電子股份有限公司	董事	陳昌益	—	—
	董事	魏鎮炎	—	—
	董事	石孟國	—	—
	董事	劉丹陽	—	—
環隆電氣股份有限公司	董事(代表人)	環鴻科技(股)公司	139,972,740 股	100%
	董事長	魏鎮炎	—	—
	董事(代表人)	陳昌益	—	—
	董事(代表人)	石孟國	—	—
	監察人(代表人)	劉丹陽	—	—
Universal Scientific Industrial (France)	董事長	陳昌益	—	—
	董事兼總經理	魏鎮炎	—	—
	董事	石孟國	—	—
環榮電子(惠州)有限公司	董事長	陳昌益	—	—
	董事	魏鎮炎	—	—
	董事	林大毅	—	—
	總經理	林岳明	—	—
	監事	石孟國	—	—
Universal Scientific Industrial Poland Sp. z o.o.	董事長	石孟國	—	—
	董事	連晉階	—	—
	董事	陳銘昌	—	—
Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited	董事長	魏鎮炎	—	—
	董事	魏振隆	—	—
	董事兼總經理	劉惠民	—	—
	總經理	桂春吉	—	—
環旭(深圳)電子科創有限公司	董事長	陳昌益	—	—
	董事兼總經理	魏鎮炎	—	—
	董事	魏振隆	—	—
	監事	石孟國	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
FINANCIÈRE AFG	董事(代表人)	環鴻電子(股)公司	—	—
	董事(代表人)	Universal Scientific Industrial (France)	—	—
	董事(代表人)	ASDI Assistance Direction	—	—
	董事(代表人)	SPFH Holding Korlatolt Felelossegu Tarsasag	—	—
	董事長	陳昌益	—	—
	董事(代表人)	魏鑽炎	—	—
	董事(代表人)	Gilles Benhamou	—	—
	董事(代表人)	Pierre Guilbault	—	—
	董事	Malcolm Stewart	—	—
ASTEELFLASH GROUP	董事(代表人)	FINANCIÈRE AFG	—	—
	董事(代表人)	Universal Scientific Industrial (France)	—	—
	董事長	陳昌益	—	—
	董事(代表人)	Gilles Benhamou	—	—
	董事(代表人)	魏鑽炎	—	—
ASTEELFLASH (BEDFORD) LIMITED	董事	Neil Stuart Mincher	—	—
	董事	Gilles Benhamou	—	—
	董事	Felix Timmerman	—	—
	董事	李志成	—	—
ASTEELFLASH FRANCE	董事(代表人)	Asteelflash Group	—	—
	董事(代表人)	Asteelflash Technologie	—	—
	董事(代表人)	Universal Global Technology Co. Limited	—	—
	董事(代表人)	Universal Scientific Industrial (France)	—	—
	董事長	Gilles Benhamou	—	—
	董事(代表人)	Nicolas Denis	—	—
	董事(代表人)	Aurelie Preulier	—	—
	董事(代表人)	李志成	—	—
	董事(代表人)	Ying Huang	—	—
ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	董事(代表人)	Asteelflash Group	—	—
	董事(代表人)	Universal Scientific Industrial (France)	—	—
	董事(代表人)	Asteelflash France	—	—
	董事長	Gilles Benhamou	—	—
	董事(代表人)	Ridha Bouras	—	—
	董事(代表人)	李志成	—	—
	董事(代表人)	Nicolas Denis	—	—
飛旭電子(香港)有限公司	董事	Gilles Benhamou	—	—
	董事	吳英斌	—	—
	董事	劉丹陽	—	—
ASTEELFLASH MEXICO S.A. de C.V.	董事	Gilles Benhamou	—	—
	董事	Claude Savard	—	—
	董事	侯爵	—	—
ASTEELFLASH GERMANY GmbH	Managing Director	Gilles Benhamou	—	—
	Managing Director	Felix Timmermann	—	—
MANUFACTURING POWER TUNISIA	總經理	Gilles Benhamou	—	—
ASTEELFLASH US HOLDING CORP.	董事	Gilles Benhamou	—	—
	董事	吳新宇	—	—
	董事	陳逢達	—	—
ASTEELFLASH TECHNOLOGIE	法定代表人	Asteelflash France	—	—
	法定代表人(代表人)	Gilles Benhamou	—	—
ASTEELFLASH BRETAGNE	法定代表人	Gilles Benhamou	—	—
ASTEEL ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES	總經理	Alain EUSEBI	—	—
AFERH TUNISIE	總經理	Gilles Benhamou	—	—
飛旭電子(蘇州)有限公司	董事長	Gilles Benhamou	—	—
	董事兼總經理	吳英斌	—	—
	董事	劉丹陽	—	—
	監察人	吳新宇	—	—
	Managing Director	Gilles Benhamou	—	—
ASTEELFLASH HERSFELD GmbH	Managing Director	Gilles Benhamou	—	—
	Managing Director	Felix Timmermann	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
ASTEELFLASH EBERBACH GmbH	Managing Director	Gilles Benhamou	—	—
	Managing Director	Felix Timmermann	—	—
ASTEELFLASH BONN GmbH	Managing Director	Gilles Benhamou	—	—
	Managing Director	Felix Timmermann	—	—
ASTEELFLASH SCHWANDORF GmbH	Managing Director	Albert Buckers	—	—
	Managing Director	Claude Savard	—	—
ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBURG GmbH	Managing Director	Gilles Benhamou	—	—
	Managing Director	Felix Timmermann	—	—
ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.	董事(代表人)	Asteelflash Group	—	—
	董事(代表人)	Asteelflash Germany GmbH	—	—
	董事(代表人)	Universal Scientific Industrial (France)	—	—
	董事(代表人)	Felix Timmermann	—	—
	董事(代表人)	Gilles Benhamou	—	—
	董事(代表人)	李志成	—	—
EN ELECTRONICNETWORK SRL	Administrator	Claude Savard	—	—
	Administrator	Hans-Dieter Magon	—	—
ASTEELFLASH USA CORP	董事	Gilles Benhamou	—	—
	董事	吳新宇	—	—
	董事	陳逢達	—	—
Integrated Solutions Enterprise Europe	Administrator	Juliette Handwerker	—	—
ASE Technology Partners, Limited	董事	Jason Chang	—	—
	董事	Tien Wu	—	—
	董事	Po Lien Li	—	—
ASE Technology Acquisition Corporation	董事	Andrew Robert Tang	—	—

(六)各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元/每股盈餘為新台幣元

企業名稱	資本額 (註一)	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益(稅後)	每股盈餘(稅後)
日月光投資控股股份有限公司	44,086,502	339,231,383	79,154,669	260,076,714	65,091,179	64,328,807	63,907,680	14.40
日月光半導體製造股份有限公司	59,941,438	303,864,885	156,371,162	147,493,723	151,869,321	25,401,502	47,416,682	7.78
矽品精密工業股份有限公司	36,517,489	132,917,571	39,091,184	93,826,387	89,273,008	17,890,541	17,716,074	4.78
環電股份有限公司	27,175,142	50,376,687	16,850,458	33,526,229	0 (241,763)	4,848,627	4,848,627	1.78
J&R Holding Limited	12,044,343	85,345,824	5,053,762	80,292,062	0 (77,592)	20,543,503	20,543,503	47,212.55
A.S.E. Holding Limited	6,752,988	17,569,147	345	17,568,802	0 (3,552)	1,422,290	1,422,290	5,829.87
Innosource Limited	2,383,248	4,596,016	0	4,596,016	0	0	152,007	1.77
Omniquest Industrial Limited	9,931,697	17,161,818	0	17,161,818	0	0	593,050	2.08
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	14,430	102,377	64,732	37,645	72,759	4,758	2,520	2,100.00
元隆電子股份有限公司	4,381,456	1,753,215	1,565,542	187,673	1,602,799	118,103	103,768	0.24
台灣福雷電子股份有限公司	11,314,525	38,261,507	9,588,590	28,672,917	16,464,928	5,643,725	4,470,543	3.95
陸竹開發股份有限公司	2,163,282	2,186,623	2,400	2,184,223	0 (1,514)	871	871	0.00
笛林傑國際科技股份有限公司	35,318	66,985	5,062	61,923	19,146	7,906	6,608	1.87
Alto Enterprises Limited	5,203,840	4,211,817	722	4,211,095	0	0 (208,394)	(208,394)	(1.11)
Super Zone Holdings Limited	2,768,000	3,025,215	0	3,025,215	0	0	64,079	0.64
日月光投資(昆山)有限公司	3,882,267	3,224,230	3,399	3,220,831	0	0 (139,843)	(139,843)	不適用
日月光集成電路製造(中國)有限公司	2,891,309	3,035,334	10,224	3,025,110	0 (69,951)	64,079	64,079	不適用
ASE Investment (Labuan) Inc.	6,697,090	18,047,456	0	18,047,456	0 (262)	1,670,192	1,670,192	6.90
ASE Test Limited	757,215	32,337,590	2,335,092	30,002,498	0 (3,652)	2,191,322	2,191,322	20.03
ASE (Korea) Inc.	2,711,989	21,263,301	3,426,076	17,837,225	16,039,563	1,350,933	1,663,411	80.20
日月瑞股份有限公司	42,074	46,617	534	46,083	0 (412)	(115)	(115)	(0.03)
ASE Japan Co., Ltd.	24,050	2,560,596	759,057	1,801,539	1,425,340 (69,497)	(85,786)	(85,786)	(11,914.72)
ASE (U.S) Inc.	554	755,861	178,242	577,619	1,365,528	72,085	48,893	48,893.00
Global Advanced Packaging Technology Limited	10,408,813	47,499,562	1,561,470	45,938,092	0 (4,778)	18,132,012	18,132,012	48.22

企業名稱	資本額 (註一)	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益(稅後)	每股盈餘(稅後)
日月光半導體(上海)有限公司	5,099,366	13,695,185	1,225,171	12,470,014	4,927,065	365,686	351,259	不適用
ASE Corporation	9,861,943	17,152,280	109	17,152,171	0	(226)	593,035	1.66
ASE Mauritius Inc.	6,028,704	13,204,714	999	13,203,715	0	(390)	215,514	0.99
ASE Labuan Inc.	3,492,775	3,852,540	0	3,852,540	0	(265)	377,728	2.99
上海鼎匯房地產開發有限公司	15,629,343	19,554,700	82,604	19,472,096	1,687	(206,771)	(726,181)	不適用
上海鼎祺物業管理有限公司	4,341	134,011	144,363	(10,352)	267,943	(14,450)	(11,345)	不適用
日月光半導體(香港)有限公司	27,680	387,723	103,196	284,527	639,134	(26,207)	1,780	0.23
上海鼎威房地產開發有限公司	7,805,988	11,946,657	6,035,586	5,911,071	806,634	(11,295)	(258,048)	不適用
上海鼎裕房地產開發有限公司	4,775,632	9,969,771	5,457,008	4,512,763	167,224	(57,511)	(141,862)	不適用
上海鼎凡商業管理有限公司	8,683	2,989	93	2,896	0	(1,288)	(1,299)	不適用
昆山鼎泓房地產開發有限公司	2,908,794	3,588,579	754,230	2,834,349	0	(8,560)	(85,149)	不適用
上海鼎熙物業管理有限公司	21,707	49,159	11,988	37,171	56,235	3,970	4,643	不適用
上海鼎堯置業發展有限公司	43,415	3,172,733	3,386,474	(213,741)	100,326	(196,510)	(228,687)	不適用
日月光電子股份有限公司	3,989,819	5,281,503	1,444,035	3,837,468	4,991,322	476,274	377,970	0.95
ASE Test Holdings, Ltd.	0(註二)	2,968,632	0	2,968,632	0	0	55,231	(註四)
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	1,461,435	6,340,212	1,331,540	5,008,672	5,498,239	734,206	662,058	9.27
ASE Singapore Pte. Ltd.	831,959	7,630,053	1,364,258	6,265,795	3,518,230	756,622	787,906	26.18
ISE Labs, Inc.	727	2,676,414	279,275	2,397,139	1,009,827	36,587	55,231	2.10
ISE Services, Inc.	0(註三)	349,619	338,984	10,635	69,955	2,715	2,048	2,048.00
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	1,723,362	6,340,212	1,331,540	5,008,672	5,498,239	734,206	662,058	4.15
日月光封裝測試(上海)有限公司	3,350,179	41,832,870	29,063,229	12,769,641	(1,297)	(210,189)	(23,637)	不適用
上海月芯半導體科技有限責任公司	434,148	733,124	306,128	426,996	276,502	(10,737)	2,359	不適用
無錫通芝微電子有限公司	318,930	500,112	97,401	402,711	417,244	11,641	11,823	不適用
SPIL (B.V.I.) Holding Limited	6,592,246	16,487,411	0	16,487,411	0	(136)	2,203,874	11.05
矽品投資股份有限公司	1,162,413	10,262,677	65	10,262,612	0	(174)	110,484	0.95
Siliconware USA, Inc.	34,600	456,262	183,892	272,370	463,726	33,703	22,786	18.23
SPIL (Cayman) Holding Limited	6,581,666	16,208,158	0	16,208,158	0	(387)	2,171,588	10.79
矽品科技(蘇州)有限公司	6,420,310	31,796,811	15,950,487	15,846,324	18,708,847	2,456,527	2,181,493	不適用
Huntington Holdings International Co. Ltd.	7,082,117	50,843,262	0	50,843,262	0	(86)	5,224,257	20.42
Unitech Holdings International Co. Ltd	83,040	348,274	355	347,919	0	(4,490)	(18,824)	(6.27)
Real Tech Holdings Limited	4,128,500	50,347,369	0	50,347,369	0	(76)	5,228,739	35.06
Universal ABIT Holding Co., Ltd	778,500	460	111	349	0	0	0	0
USI Enterprise Limited	5,837,712	57,411,644	8,330,399	49,081,245	19,462	(303,488)	5,454,881	25.86
環旭電子股份有限公司	9,595,430	91,248,598	34,412,383	56,836,215	79,462,809	3,584,862	8,035,727	3.64
環鴻電子股份有限公司	9,065,200	38,136,951	15,924,995	22,211,956	56,951	(150,149)	1,378,551	0.54
環鴻電子(昆山)有限公司	2,387,816	14,153,764	7,955,257	6,198,507	25,208,604	1,495,164	1,329,863	不適用
環維電子(上海)有限公司	5,774,174	16,667,270	8,857,204	7,810,066	35,946,530	1,506,934	1,415,572	不適用
環豪電子(上海)有限公司	217,074	271,048	699	270,349	0	(167)	10,389	不適用
環旭科技有限公司	304,480	8,540,093	8,145,043	395,050	19,725	17,599	17,634	0.21
環鴻科技股份有限公司	1,980,000	29,726,640	21,086,560	8,640,080	54,308,182	1,213,051	1,209,845	6.11
USI America Inc.	262,960	226,060	33,618	192,442	153,479	8,829	4,352	17.41
Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	1,770,492	8,599,786	6,651,173	1,948,613	9,258,368	(149,737)	(216,402)	(0.17)
USI Japan Co., Ltd.	22,847	35,507	3,889	31,618	19,495	2,328	2,587	404.22
環勝電子(深圳)有限公司	2,542,476	11,910,640	5,891,934	6,018,706	17,904,843	1,021,150	1,049,730	不適用
環海電子股份有限公司	1,411,680	1,530,562	302	1,530,260	0	(447)	197,529	3.87
環隆電氣股份有限公司	1,399,727	7,656,661	4,376,670	3,279,991	19,611,735	175,718	186,668	1.33
Universal Scientific Industrial (France)	10,075,222	12,169,058	1,688,181	10,480,877	0	(17,605)	187,814	0.58
環榮電子(惠州)有限公司	1,997,083	2,546,988	608,205	1,938,783	48,822	(72,778)	(42,074)	不適用

企業名稱	資本額(註一)	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益(稅後)	每股盈餘(稅後)
Universal Scientific Industrial Poland Sp. z o.o.	551,705	1,109,108	143,762	965,346	973,199	181,470	183,250	113.32
Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited	2,214,400	5,147,840	3,134,171	2,013,669	2,146,837	(184,724)	(187,582)	不適用
環旭(深圳)電子科創有限公司	43,415	68,367	19,657	48,710	34,829	4,838	4,986	不適用
FINANCIÈRE AFG	5,757,483	7,759,600	197,778	7,561,822	0	(38,859)	1,668	0.02
ASTEELFLASH GROUP	3,131,499	6,919,196	2,092,254	4,826,942	0	92,635	54,141	0.54
ASTEELFLASH (BEDFORD) LIMITED	1,963	524,085	431,579	92,506	817,340	14,391	13,537	257.21
ASTEELFLASH FRANCE	371,747	4,213,486	2,395,454	1,818,032	4,340,392	152,953	155,163	199.55
ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	259,330	2,901,939	2,445,555	456,384	3,128,887	118,088	56,004	5.73
ASTEELFLASH HONG KONG LIMITED	655,519	681,794	21,708	660,086	186,558	4,020	3,763	(註四)
ASTEELFLASH MEXICO S.A. de C.V.	134	93,741	56,441	37,300	209,618	34,016	23,215	7,738.33
ASTEELFLASH GERMANY GmbH	31,350	557,745	91,684	466,061	1,833	(34,857)	(17,384)	(註四)
MANUFACTURING POWER TUNISIA	137	36,022	547	35,475	0	(43)	760	760.00
ASTEELFLASH US HOLDING CORP.	456,977	600,915	3,306	597,609	0	0	0	0
ASTEELFLASH TECHNOLOGIE	98,754	527,727	183,956	343,771	717,444	95,239	71,209	158.24
ASTEELFLASH BRETAGNE	0	0	0	0	0	0	0	0
ASTEEL ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES	0	0	0	0	0	0	0	0
AFERH TUNISIE	0	0	0	0	0	0	0	0
ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD.	498,240	6,805,755	2,226,921	4,578,834	7,317,062	767,624	648,058	不適用
ASTEELFLASH HERSFELD GmbH	157,818	947,901	843,923	103,978	1,386,323	(63,972)	(69,590)	(註四)
ASTEELFLASH EBERBACH GmbH	38,404	494,024	403,974	90,050	772,860	738	(3,780)	(註四)
ASTEELFLASH BONN GmbH	15,675	487,656	514,741	(27,085)	558,440	(54,117)	(54,486)	(註四)
ASTEELFLASH SCHWANDORF GmbH	784	5,167	965	4,202	0	(140)	(343)	(註四)
ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH	4,013	239,801	124,949	114,852	255,065	(5,602)	(5,720)	(註四)
ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.	157,280	577,770	467,995	109,775	704,657	(10,676)	(20,623)	(註四)
EN ELECTRONICNETWORK SRL	0	0	0	0	0	0	0	0
ASTEELFLASH USA CORP	594,159	1,516,880	1,068,451	448,429	1,731,594	(184,783)	(175,809)	(1,758,090.00)
Integrated Solutions Enterprise Europe	389	124,186	48,046	76,140	75,221	(1,766)	(4,593)	(24,693.55)
ASE Technology Partners, Limited	8,858	8,163	192	7,971	0	(543)	(891)	(2.78)
ASE Technology Acquisition Corporation	16	13,430	5,470	7,960	0	(348)	(348)	(0.06)

註一：關係企業如為外國公司，以報告日之兌換匯率換算新台幣列示。

註二：設立資本額為美金5元。

註三：設立資本額為美金1元。

註四：設立資本股數小於5股，不予揭露每股盈餘。

(七) 關係企業合併財務報表：詳本年報(二)財務報告第3頁之說明。

(八) 本公司業已於本年報(二)合併財務報告第105-116頁、第125-128頁及個體財務報告第35-37頁、第41-44頁揭露所有關係企業從事衍生性商品交易資訊、背書保證及資金貸與他人，其他未列示之關係企業即無從事上述之交易。

二、私募有價證券辦理情形：無。

三、子公司持有或處分本公司股票情形：

111年02月28日 單位：新台幣仟元(除另有註明者外)：股：%

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司持股比例	取得或處分日期	取得股數及金額	處分股數及金額	投資(損)益	截至年報刊印日止持有股數及金額	設定質權情形	本公司為子公司背書保證金額	本公司貸與子公司金額
台灣福雷電子(股)公司	11,314,525	日月光合併日月宏及日月欣三合一換股及盈餘分配取得	100%	93年8月取得暨99~101年度無償配股；99年2月處分部分持股	— —	— —	—	截至110年12月31日止： 5,489,388股 帳面金額\$584,620 轉列庫藏股金額\$196,677	—	—	—
				本年度截至年報刊印日止	— —	— —	—	5,489,388股 帳面金額\$391,393 轉列庫藏股金額\$196,677	—	—	—
ASE Test Ltd.	659,075	日月光合併日月宏及日月欣三合一換股及盈餘分配取得	100%	93年8月取得暨99~101年度無償配股；99年2月處分部分持股	— —	— —	—	截至110年12月31日止： 44,100,236股(註) 帳面金額\$4,696,675 轉列庫藏股金額\$1,380,721	—	—	—
				本年度截至年報刊印日止	— —	— —	—	44,100,236股(註) 帳面金額\$3,144,347 轉列庫藏股金額\$1,380,721	—	—	—
J&R Holding Ltd.	13,907,259	日月光合併日月宏及日月欣三合一換股及盈餘分配取得	100%	93年8月取得暨99~101年度無償配股；99年2月處分部分持股	— —	— —	—	截至110年12月31日止： 23,351,881股 帳面金額\$2,486,975 轉列庫藏股金額\$381,709	—	—	—
				本年度截至年報刊印日止	— —	— —	—	23,351,881股 帳面金額\$1,664,989 轉列庫藏股金額\$381,709	—	—	—

註：ASE Test Ltd. 持有本公司股票44,100,236股，則全數以非保留運用決定權信託專戶保管。

四、其他必要補充說明事項：無。

玖、其他事項

最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

日月光投資控股股份有限公司
一一〇年度年報(二)
財務報告

日月光投資控股股份有限公司
及子公司

合併財務報告暨會計師查核報告
民國110及109年度

地址：高雄市楠梓區經三路26號

電話：(07)3617131

§ 目 錄 §

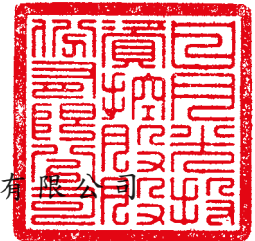
項	目	頁	次	財 務 報 告 附 註 編 號
一、	封 面	1		-
二、	目 錄	2		-
三、	關係企業合併財務報告聲明書	3		-
四、	會計師查核報告	4~8		-
五、	合併資產負債表	9~10		-
六、	合併綜合損益表	11~12		-
七、	合併權益變動表	13		-
八、	合併現金流量表	14~15		-
九、	合併財務報告附註			
	(一) 公司沿革	16		一
	(二) 通過財務報告之日期及程序	16		二
	(三) 新發布及修訂準則及解釋之適用	17~21		三
	(四) 重大會計政策之彙總說明	21~49		四
	(五) 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	49		五
	(六) 重要會計項目之說明	49~116		六~三四
	(七) 關係人交易	116~117		三五
	(八) 質抵押之資產	118		三六
	(九) 重大或有負債及未認列之合約承諾	118~119		三七
	(十) 重大之災害損失	-		-
	(十一) 重大之期後事項	-		-
	(十二) 其 他	119~120		三八~三九
	(十三) 附註揭露事項			
	1. 重大交易事項相關資訊	121		四十
	2. 轉投資事業相關資訊	121		四十
	3. 大陸投資資訊	121~122		四十
	4. 主要股東資訊	121		四十
	(十四) 部門資訊	122~124		四一

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 110 年度（自 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：日月光投資控股股份有限公司



董事長：張 虔 生



中 華 民 國 111 年 2 月 25 日

會計師查核報告

日月光投資控股股份有限公司 公鑒：

查核意見

日月光投資控股股份有限公司（以下稱「日月光控股公司」）及其子公司（以下稱「日月光集團」）民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 110 及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達日月光集團民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 110 及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與日月光集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對日月光集團民國 110 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體

及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對日月光集團民國 110 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

商譽減損評估

日月光集團針對商譽減損評估，涉及估計每一子公司所屬營運部門之使用價值並與其帳面價值相比。日月光集團係使用現金流量折現法來估計集團中各營運部門之使用價值，過程中對於折現率之使用以及未來營業收入之預測，皆需要管理階層作出重大估計及假設。若相關估計或假設發生變動，將對所估計之使用價值或商譽減損金額產生重大影響。日月光集團於民國 110 年 12 月 31 日之商譽金額計新台幣（以下同）51,416,608 千元，其中分攤予封裝部門及測試部門之商譽分別為 34,849,069 千元及 13,211,590 千元。估計封裝部門及測試部門之使用價值皆超過其帳面價值，因此，日月光集團於民國 110 年度就分攤予封裝部門及測試部門之商譽未認列任何減損損失。

因全球經濟走勢將主導半導體產業需求，有鑑於封裝部門及測試部門之營運深受全球需求影響，且管理階層需運用重大之估計及假設，方能推算各該營運部門之使用價值。本會計師在執行評估管理階層選用折現率及對封裝部門及測試部門未來營業收入預測所使用之估計及假設合理性等之查核程序時，必須運用高度之專業判斷，以及擴大查核範圍，包含評估使用評價專家之必要性。

與商譽減損評估相關之會計政策、會計估計及假設不確定性之主要來源暨攸關揭露資訊，請參閱合併財務報告附註四(十一)、五及十八。

本會計師針對管理階層用以推估封裝部門及測試部門使用價值，所使用之折現率及未來營業收入預測，執行主要查核程序如下：

- 一、測試與商譽減損相關之內部控制，包含管理階層用以決定封裝部門、及測試部門使用價值相關之控制，如折現率之決定，以及未來營業收入預測之合理性評估等。
- 二、按照封裝部門及測試部門以前年度營業收入實際達成情形，以評估管理階層準確預測未來營業收入之能力。
- 三、執行敏感度分析，以評估若重要假設變動對商譽產生減損之風險。

四、採用評價專家之協助，執行下列程序以評估管理階層計算結果及所使用折現率之合理性：

(一) 測試決定折現率過程中所使用之原始資料，並重新驗算折現率。

(二) 獨立發展折現率合理區間，並與管理階層所使用的折現率比較，測試其是否落於區間之內。

其他事項

列入日月光集團民國 110 及 109 年度合併財務報告之子公司中，有關矽品精密工業股份有限公司（以下稱「矽品公司」）之合併財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關矽品公司合併財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。矽品公司民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之資產總額分別占合併資產總額之 22%及 22%，民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入分別占合併營業收入之 19%及 21%。

日月光控股公司業已編製民國 110 及 109 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見及其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估日月光集團繼續經營之能力、相關事項之揭露、以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算日月光集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

日月光集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實

表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對於查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對日月光集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使日月光集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致日月光集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於日月光集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成日月光集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對日月光集團民國 110 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 世 宗



吳世宗

會計師 郭 麗 園



郭麗園

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 111 年 2 月 25 日

日月光投資控股股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	110年12月31日		109年12月31日 (追溯調整後)	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 76,073,345	11	\$ 51,538,071	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產				
	－流動	2,933,446	-	4,342,605	1
1140	合約資產－流動	5,607,209	1	4,782,904	1
1170	應收帳款淨額	115,462,210	17	91,833,989	16
1200	其他應收款	13,732,607	2	3,693,936	1
1220	本期所得稅資產	542,180	-	702,820	-
1310	存貨	67,832,981	10	48,590,434	8
1320	存貨－營建房地	5,412,114	1	13,471,645	2
1476	其他金融資產－流動	140,857	-	551,655	-
1479	其他流動資產	4,620,779	1	4,578,783	1
11XX	流動資產合計	<u>292,357,728</u>	<u>43</u>	<u>224,086,842</u>	<u>39</u>
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產				
	－非流動	2,502,834	-	2,180,978	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	2,019,812	-	1,741,134	-
1550	採用權益法之投資	17,320,791	3	12,976,666	2
1600	不動產、廠房及設備	239,867,550	36	234,365,397	40
1755	使用權資產	10,680,262	2	8,741,807	2
1760	投資性不動產	22,144,787	3	12,538,083	2
1805	商譽	51,416,608	8	52,053,248	9
1821	其他無形資產	24,563,707	4	27,711,771	5
1840	遞延所得稅資產	5,369,010	1	5,477,373	1
1980	其他金融資產－非流動	1,416,123	-	530,345	-
1990	其他非流動資產	3,275,073	-	1,263,188	-
15XX	非流動資產合計	<u>380,576,557</u>	<u>57</u>	<u>359,579,990</u>	<u>61</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 672,934,285</u>	<u>100</u>	<u>\$ 583,666,832</u>	<u>100</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	負 債 及 權 益	110年12月31日		109年12月31日 (追溯調整後)	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 34,319,464	5	\$ 31,290,839	5
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債				
	－流動	417,660	-	1,537,208	-
2126	避險之金融負債－流動	6,716,965	1	5,277,325	1
2170	應付帳款	84,470,284	13	73,268,234	13
2219	其他應付款	46,696,900	7	39,415,623	7
2230	本期所得稅負債	10,044,739	1	3,818,837	1
2280	租賃負債－流動	809,536	-	774,444	-
2321	一年內到期之應付公司債	9,902,710	2	6,999,951	1
2322	一年內到期之長期借款	4,526,683	1	2,250,121	-
2399	其他流動負債	13,022,789	2	7,264,084	1
21XX	流動負債合計	<u>210,927,730</u>	<u>32</u>	<u>171,896,666</u>	<u>29</u>
	非流動負債				
2511	避險之金融負債－非流動	4,780,931	1	5,910,919	1
2530	應付公司債	42,364,627	6	49,253,603	8
2540	長期借款	117,164,876	17	102,259,378	18
2570	遞延所得稅負債	7,114,529	1	6,805,443	1
2580	租賃負債－非流動	6,590,348	1	5,101,386	1
2640	淨確定福利負債	5,864,071	1	6,466,794	1
2670	其他非流動負債	3,494,448	1	1,710,090	-
25XX	非流動負債合計	<u>187,373,830</u>	<u>28</u>	<u>177,507,613</u>	<u>30</u>
2XXX	負債總計	<u>398,301,560</u>	<u>60</u>	<u>349,404,279</u>	<u>59</u>
	歸屬於本公司業主之權益				
	股 本				
3110	普通股股本	44,034,146	7	43,385,311	7
3140	預收股本	52,356	-	130,609	-
3100	股本總計	<u>44,086,502</u>	<u>7</u>	<u>43,515,920</u>	<u>7</u>
3200	資本公積	<u>143,691,717</u>	<u>21</u>	<u>139,766,099</u>	<u>24</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	6,300,198	1	3,901,384	1
3320	特別盈餘公積	9,569,027	1	10,847,697	2
3350	未分配盈餘	75,449,674	11	32,132,053	6
3300	保留盈餘總計	<u>91,318,899</u>	<u>13</u>	<u>46,881,134</u>	<u>9</u>
3400	其他權益	(11,532,042)	(2)	(9,569,027)	(2)
3500	庫藏股票	(7,488,362)	(1)	(1,959,107)	-
31XX	歸屬於本公司業主之權益總計	<u>260,076,714</u>	<u>38</u>	<u>218,635,019</u>	<u>38</u>
36XX	非控制權益	<u>14,556,011</u>	<u>2</u>	<u>15,627,534</u>	<u>3</u>
3XXX	權益合計	<u>274,632,725</u>	<u>40</u>	<u>234,262,553</u>	<u>41</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 672,934,285</u>	<u>100</u>	<u>\$ 583,666,832</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 25 日查核報告)

董事長：張虔生



經理人：張洪本



會計主管：郭宏銘



日月光投資控股股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 110 及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		110年度		109年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 569,997,133	100	\$ 476,978,710	100
5000	營業成本	459,628,356	81	398,994,442	84
5900	營業毛利	110,368,777	19	77,984,268	16
	營業費用				
6100	推銷費用	6,386,763	1	5,605,464	1
6200	管理費用	20,804,032	3	18,200,304	4
6300	研究發展費用	21,053,633	4	19,302,418	4
6000	營業費用合計	48,244,428	8	43,108,186	9
6900	營業淨利	62,124,349	11	34,876,082	7
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	1,910,872	-	1,628,229	-
7020	其他利益及損失	18,157,637	3	2,176,386	-
7050	財務成本	(2,831,307)	-	(3,459,511)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	973,856	-	512,493	-
7000	營業外收入及支出合計	18,211,058	3	857,597	(1)
7900	稅前淨利	80,335,407	14	35,733,679	6
7950	所得稅費用	14,321,826	3	6,456,899	1
8200	本年度淨利	66,013,581	11	29,276,780	5
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	51,167	-	(594,778)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	202,092	-	(166,239)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		110年度		109年度	
		金 額	%	金 額	%
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	\$ 3,675,236	1	\$ 2,775,696	1
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(19,319)	-	114,559	-
8310		<u>3,909,176</u>	<u>1</u>	<u>2,129,238</u>	<u>1</u>
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(4,094,565)	(1)	(831,784)	-
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益	63,722	-	(2,136)	-
8368	避險工具之損益	738,600	-	(574,824)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	29,209	-	131,009	-
8360		<u>(3,263,034)</u>	<u>(1)</u>	<u>(1,277,735)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>646,142</u>	<u>-</u>	<u>851,503</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 66,659,723</u>	<u>11</u>	<u>\$ 30,128,283</u>	<u>6</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 63,907,680	11	\$ 27,592,979	5
8620	非控制權益	2,105,901	-	1,683,801	-
8600		<u>\$ 66,013,581</u>	<u>11</u>	<u>\$ 29,276,780</u>	<u>5</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 64,627,793	11	\$ 28,419,315	6
8720	非控制權益	2,031,930	-	1,708,968	-
8700		<u>\$ 66,659,723</u>	<u>11</u>	<u>\$ 30,128,283</u>	<u>6</u>
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 14.84</u>		<u>\$ 6.47</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 14.40</u>		<u>\$ 6.31</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 25 日查核報告)

董事長：張虔生

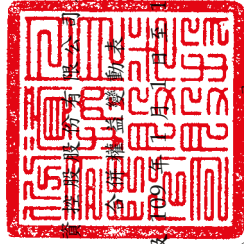


經理人：張洪本



會計主管：郭宏銘





日月光投 有限公司及子公司

合併財務報告

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	說明	資產負債表										損益表										現金流量表									
		109年12月31日	110年12月31日	109年12月31日	110年12月31日	109年12月31日	110年12月31日	109年12月31日	110年12月31日	109年12月31日	110年12月31日	109年12月31日	110年12月31日	109年12月31日	110年12月31日	109年12月31日	110年12月31日	109年12月31日	110年12月31日	109年12月31日	110年12月31日	109年12月31日	110年12月31日	109年12月31日	110年12月31日	109年12月31日	110年12月31日	109年12月31日	110年12月31日	109年12月31日	110年12月31日
A1	109年1月1日餘額	4,351,592	4,351,592	138,908,912	138,908,912	2,203,895	2,203,895	6,902,782	6,902,782	22,454,651	22,454,651	31,561,328	31,561,328	85,912	85,912	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265
B1	108年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	其他資本公積變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	109年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	109年度稅前其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M3	處分採用權益法之投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O1	子公司現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O1	子公司員工認股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	109年12月31日餘額	4,351,592	4,351,592	139,766,099	139,766,099	3,901,384	3,901,384	10,847,697	10,847,697	32,132,053	32,132,053	46,881,134	46,881,134	2,501,278	2,501,278	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265
B1	109年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	其他資本公積變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	110年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	110年度稅前其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O1	子公司現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O1	子公司員工認股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	110年12月31日餘額	4,408,650	4,408,650	143,691,717	143,691,717	6,300,198	6,300,198	9,569,027	9,569,027	25,842	25,842	46,881,134	46,881,134	2,501,278	2,501,278	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265	429,265

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 25 日查核報告)



董事長：張虔生



經理人：張洪本



會計主管：郭宏銘

日月光投資控股股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 110 及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		110年度	109年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 80,335,407	\$ 35,733,679
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	50,470,157	47,525,688
A20200	攤銷費用	4,054,120	3,733,377
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失	1,490,005	71,848
A20900	財務成本	2,831,307	3,459,511
A21200	利息收入	(542,329)	(520,783)
A21300	股利收入	(289,852)	(150,715)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	699,211	955,575
A22300	採用權益法之關聯企業及合資 損益之份額	(973,856)	(512,493)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(71,770)	(460,868)
A23200	處分採用權益法之投資利益	-	(91,297)
A23500	金融資產減損損失	4,718	-
A23600	金融資產減損迴轉利益	-	(56,950)
A23700	非金融資產減損損失	774,712	2,486,066
A29900	處分子公司利益	(17,340,418)	(802,753)
A29900	廉價購買利益	(33,114)	-
A29900	匯兌損益	(1,668,522)	(2,543,821)
A29900	其他項目	(74,356)	(295,859)
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31115	強制透過損益按公允價值 衡量之金融資產	2,174,012	2,188,285
A31125	合約資產	(1,345,069)	1,113,950
A31150	應收帳款	(27,957,812)	(9,396,304)
A31180	其他應收款	(354,849)	(773,411)
A31200	存 貨	(23,325,588)	(13,559,192)
A31240	其他流動資產	(819,252)	366,237
A31990	其他營業資產	(785,204)	(14,396)
A32110	持有供交易之金融負債	(3,814,095)	(2,763,864)
A32150	應付帳款	13,654,819	14,032,779
A32180	其他應付款	5,938,081	3,601,102
A32230	其他流動負債	5,552,277	23,520
A32990	其他營業負債	2,017,904	(301,838)
A33000	營運產生之現金流入	90,600,644	83,047,073
A33100	收取之利息	527,551	479,900
A33200	收取之股利	655,537	512,287
A33300	支付之利息	(2,625,883)	(3,442,545)
A33500	支付之所得稅	(7,423,947)	(5,536,077)
AAAA	營業活動之淨現金流入	81,733,902	75,060,638

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		110年度	109年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 32,246)	(\$ 259,168)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產價款	672	20,686
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	14,201	84,186
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	26,531	-
B01800	取得採用權益法投資之關聯企業	(226,560)	(186,071)
B01900	處分採用權益法之投資	-	2,271,618
B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現 金)	(180,718)	(8,745,638)
B02300	處分子公司價款	23,941,276	3,717,039
B02400	採用權益法之被投資公司退回股款	-	125,005
B02700	取得不動產、廠房及設備	(70,905,659)	(62,077,446)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,605,002	4,449,113
B04500	取得無形資產	(1,069,866)	(982,655)
B04600	處分無形資產價款	1,421	8,353
B05350	取得使用權資產	(956,218)	(118,354)
B05400	取得投資性不動產	-	(6,352)
B06500	其他金融資產增加	(372,091)	(822,959)
B06600	其他金融資產減少	447,665	1,083,934
B06700	其他非流動資產增加	(1,416,675)	(1,338,269)
B06800	其他非流動資產減少	324,270	1,244,650
B07700	支付之所得稅	(570,700)	-
B09900	處分使用權資產價款	278,126	585,902
B09900	其他投資活動	-	123
BBBB	投資活動之淨現金流出	(49,091,569)	(60,946,303)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	10,043,398	-
C00200	短期借款減少	-	(1,502,323)
C01200	發行公司債	3,280,943	19,967,149
C01300	償還公司債	(7,000,000)	(250,000)
C01600	舉借長期借款	190,192,666	180,020,420
C01700	償還長期借款	(174,173,841)	(206,520,559)
C04020	租賃負債本金償還	(907,403)	(844,357)
C04500	發放現金股利	(18,082,500)	(8,520,982)
C04800	員工執行認股權	2,727,915	1,934,530
C04900	庫藏股票買回成本	(5,529,255)	-
C05800	非控制權益變動	(6,400,212)	(6,291,089)
C09900	其他籌資活動	(22,557)	11,867
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(5,870,846)	(21,995,344)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,236,213)	(711,795)
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)	24,535,274	(8,592,804)
E00100	年初現金及約當現金餘額	51,538,071	60,130,875
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 76,073,345	\$ 51,538,071

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 25 日查核報告)

董事長：張虔生



經理人：張洪本



會計主管：郭宏銘



日月光投資控股股份有限公司及子公司

合併財務報告附註

民國 110 及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(除另註明外，金額以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

日月光投資控股股份有限公司（以下稱本公司）於 107 年 4 月 30 日設立於高雄楠梓科技產業園區。本公司及子公司（以下統稱本集團）所營業務主要為半導體、基板、電腦週邊設備及電子零配件之製造、組合、加工、測試及銷售。

本公司之子公司日月光半導體製造股份有限公司（股票代碼「2311」，以下稱日月光）於 107 年 4 月 30 日申請設立本公司，並與矽品精密工業股份有限公司（股票代碼「2325」，以下稱矽品）共同以股份轉換方式由本公司取得日月光及矽品 100% 股權，日月光及矽品於同日成為本公司 100% 持股之子公司並終止股票上市買賣，由本公司之普通股股票自同日起以股票代碼「3711」上市買賣。另日月光於 89 年 9 月發行之美國存託憑證（ADR）在紐約證券交易所掛牌上市，亦自 107 年 4 月 30 日起轉換為本公司之 ADR，代號仍為 ASX。

子公司環旭電子公司於 101 年 2 月在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼為 601231。

本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告於 111 年 2 月 25 日經董事會通過後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

- (一) 首次適用金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）認可並發布生效之國際財務報導準則（IFRS）、國際會計準則（IAS）、解釋（IFRIC）及解釋公告（SIC）（以下稱「IFRSs」）

除下列說明外，適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRSs 將不致造成本集團會計政策之重大變動：

IFRS 16 之修正「2021 年 6 月 30 日後之新型冠狀病毒肺炎相關租金減讓」

本集團選擇適用該修正，將實務權宜作法之適用條件展延至 111 年 6 月 30 日以前到期之給付，實務權宜作法相關會計政策請參閱附註四。

本集團自 110 年 1 月 1 日開始適用該修正。

- (二) 111 年適用之金管會認可之 IFRSs

<u>新發布／修正／修訂準則及解釋</u>	<u>國際會計準則理事會（IASB）發布之生效日</u>
「IFRSs 2018~2020 之年度改善」	2022 年 1 月 1 日（註 1）
IFRS 3 之修正「對觀念架構之引述」	2022 年 1 月 1 日（註 2）
IAS 16 之修正「不動產、廠房及設備：達到預定使用狀態前之價款」	2022 年 1 月 1 日（註 3）
IAS 37 之修正「虧損性合約－履行合約之成本」	2022 年 1 月 1 日（註 4）

註 1：IFRS 9 之修正適用於 2022 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間所發生之金融負債之交換或條款修改。

註 2：收購日在年度報導期間開始於 2022 年 1 月 1 日以後之企業合併適用此項修正。

註 3：於 2021 年 1 月 1 日以後始達管理階層預期運作方式之必要地點及狀態之廠房、不動產及設備適用此項修正。

註 4：於 2022 年 1 月 1 日尚未履行所有義務之合約適用此項修正。

1. IAS 16 之修正「不動產、廠房及設備：達到預定使用狀態前之價款」

該修正規定，為使不動產、廠房及設備達到能符合管理階層預期運作方式之必要地點及狀態而產出之項目之銷售價款，不宜作為該資產之成本減項。前述產出項目應按 IAS 2「存貨」衡量，並按所適用之準則將銷售價款及成本認列於損益。

該修正適用於 110 年 1 月 1 日以後始達管理階層預期運作方式之必要地點及狀態之廠房、不動產及設備。

2. IAS 37 之修正「虧損性合約－履行合約之成本」

該修正明訂，於評估合約是否係虧損性時，「履行合約之成本」應包括履行合約之增額成本（例如，直接人工及原料）及與履行合約直接相關之其他成本之分攤（例如，履行合約所使用之不動產、廠房及設備項目之折舊費用分攤）。

除上述影響外，截至本合併財務報告通過發布日止，本集團評估其他準則及解釋之修正將不致對財務狀況與財務績效造成重大影響。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	I A S B 發 布 之 生 效 日 (註 1)
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未 定
IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」	2023 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「會計政策之揭露」	2023 年 1 月 1 日 (註 2)
IAS 8 之修正「會計估計之定義」	2023 年 1 月 1 日 (註 3)
IAS 12 之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	2023 年 1 月 1 日 (註 4)

註 1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間推延適用此項修正。

註 3：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間所發生之會計估計變動及會計政策變動適用此項修正。

註 4：除於 2022 年 1 月 1 日就租賃及除役義務之暫時性差異認列遞延所得稅外，該修正係適用於 2022 年 1 月 1 日以後所發生之交易。

1. IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」

該修正係釐清判斷負債是否分類為非流動時，應評估本集團於報導期間結束日是否具有遞延清償期限至報導期間後至少 12 個月之權利。若本集團於報導期間結束日具有該權利，無論本集團是否預期將行使該權利，負債係分類為非流動。該修正並釐清，若本集團須遵循特定條件始具有遞延清償負債之權利，本集團必須於報導期間結束日已遵循特定條件，即使貸款人係於較晚日期測試本集團是否遵循該等條件亦然。

該修正規定，為負債分類之目的，前述清償係指移轉現金、其他經濟資源或本集團之權益工具予交易對方致負債之消滅。惟若負債之條款，可能依交易對方之選擇，以移轉本集團之權益工具而導致其清償，且若該選擇權依 IAS 32「金融工具：表達」之規定係單獨認列於權益，則前述條款並不影響負債之分類。

2. IAS 1 之修正「會計政策之揭露」

該修正明訂本集團應依重大之定義，決定應揭露之重大會計政策資訊。若會計政策資訊可被合理預期將影響一般用途財務報表之主要使用者以該等財務報表為基礎所作之決策，則該會計政策資訊係屬重大。該修正並釐清：

- 與不重大之交易、其他事項或情況相關之會計政策資訊係屬不重大，本集團無需揭露該等資訊。
- 本集團可能因交易、其他事項或情況之性質而判斷相關會計政策資訊屬重大，即使金額不重大亦然。

- 並非與重大交易、其他事項或情況相關之所有會計政策資訊皆屬重大。

此外，該修正並舉例說明若會計政策資訊係與重大交易、其他事項或情況相關，且有下列情況時，該資訊可能屬重大：

- (1) 本集團於報導期間改變會計政策，且該變動導致財務報表資訊之重大變動；
- (2) 本集團自準則允許之選項中選擇其適用之會計政策；
- (3) 因缺乏特定準則之規定，本集團依 IAS 8「會計政策、會計估計變動及錯誤」建立之會計政策；
- (4) 本集團揭露其須運用重大判斷或假設所決定之相關會計政策；或
- (5) 涉及複雜之會計處理規定且財務報表使用者仰賴該等資訊方能了解該等重大交易、其他事項或情況。

3. IAS 8 之修正「會計估計之定義」

該修正明訂會計估計係指財務報表中受衡量不確定性影響之貨幣金額。本集團於適用會計政策時，可能須以無法直接觀察而必須估計之貨幣金額衡量財務報表項目，故須使用衡量技術及輸入值建立會計估計以達此目的。衡量技術或輸入值之變動對會計估計之影響若非屬前期錯誤之更正，該等變動係屬會計估計變動。

4. IAS 12 之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」

該修正釐清，原始認列時產生相同金額之應課稅及可減除暫時性差異之交易，不適用 IAS 12 原始認列之豁免規定。本集團將於 111 年 1 月 1 日就與租賃及除役義務有關之所有可減除及應課稅暫時性差異認列遞延所得稅資產（若很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異使用）及遞延所得稅負債，並於該日將累積影響數認列為保留盈餘初始餘額之調整。對租賃及除役義務以外之交易則自 111

年 1 月 1 日以後發生者推延適用該修正。

除上述影響外，截至本合併財務報告通過發布日止，本集團仍持續評估其他準則及解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之 IFRSs 編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具及按確定福利義務現值減除計畫資產公允價值認列之淨確定福利負債外，本合併財務報告係依歷史成本基礎編製。

公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第 1 等級至第 3 等級：

1. 第 1 等級輸入值：係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價（未經調整）。
2. 第 2 等級輸入值：係指除第 1 等級之報價外，資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）之可觀察輸入值。
3. 第 3 等級輸入值：係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及約當現金、主要為交易目的而持有之資產及預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產，但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受有限制者。流動負債包括主要為交易目的而持有之負債、於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債（即使於資產負債表日後至通過發布財務報告前已完成長期性之再融資或重新安排付款協議，亦屬流動負債），以及不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少 12 個月之負債（惟負債之條款可能依交易對方

之選擇，以發行權益工具而導致其清償者，並不影響分類）。非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

另從事房地產開發之子公司，其營業週期長於 1 年，是以與房地產開發業務相關之資產及負債，係按正常營業週期作為劃分流動或非流動之標準。

(四) 合併基礎

本合併財務報告係包含本公司及由本公司所控制個體（子公司）之財務報告。合併綜合損益表已納入被收購或被處分子公司於當期自收購日起或至處分日止之營運損益。子公司之財務報告已予調整，以使其會計政策與本集團之會計政策一致。於編製合併財務報告時，各個體間之交易、帳戶餘額、收益及費損已全數予以銷除。子公司之綜合損益總額係歸屬至本公司業主及非控制權益，即使非控制權益因而成為虧損餘額。

當本集團對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者，係作為權益交易處理。本集團及非控制權益之帳面金額已予調整，以反映其於子公司相對權益之變動。非控制權益之調整金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額，係直接認列為權益且歸屬於本公司業主。

當本集團喪失對子公司之控制時，處分損益係為下列兩者之差額：(1)所收取對價之公允價值與對前子公司之剩餘投資按喪失控制日之公允價值合計數，以及(2)前子公司之資產（含商譽）與負債及非控制權益按喪失控制日之帳面金額合計數。本集團對於其他綜合損益中所認列與該子公司有關之所有金額，其會計處理係與本集團直接處分相關資產或負債所必須遵循之基礎相同。

子公司明細、持股比例及營業項目如下：

投 資 公 司 名 稱	子 公 司 名 稱	主 要 業 務	設 立 及 營 運 地 點	所 持 股 權 百 分 比 (%)	
				110年 12月31日	109年 12月31日
本 公 司	日 月 光	從事半導體封裝測試業務	台 灣	100.0	100.0
	環 電	控股公司	台 灣	100.0	100.0
	矽 品	各項積體電路構裝之製造、加工、買賣及測試等業務	台 灣	100.0	100.0
日 月 光	A.S.E. Holding Limited	控股公司	百 慕 達	100.0	100.0
	J & R Holding Limited (J&R Holding)	控股公司	百 慕 達	100.0	100.0
	Innosource Limited	控股公司	英屬維京群島	100.0	100.0
	Omniquet Industrial Limited	控股公司	英屬維京群島	71.0	71.0
	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	從事市場行銷及客戶服務業務	日 本	100.0	100.0
	台灣福雷電子公司 (台灣福雷)	從事半導體測試服務	台 灣	100.0	100.0
	陸竹開發公司	從事房地產開發業務	台 灣	67.1	67.1
	元隆電子公司 (元隆)	晶圓積體電路代工	台 灣	7.6	7.6
	台灣福雷	Alto Enterprises Limited	英屬維京群島	100.0	100.0
	Super Zone Holdings Limited	控股公司	香 港	100.0	100.0
台灣福雷	陸竹開發公司	從事房地產開發業務	台 灣	19.0	19.0
	苗林傑國際科技公司	從事資訊軟體服務業務	台 灣	60.0	60.0
	明豐資訊公司	清算中 (已於111年2月完成清算)	台 灣	100.0	100.0
	元 隆	晶圓積體電路代工	台 灣	43.4	43.4
	ASE Investment (Labuan) Inc.	控股公司	馬來西亞	70.1	70.1
	ASE Test Limited (ASE Test)	控股公司	新 加 坡	10.2	10.2
	ASE Technology Partners, Limited	控股公司，設立於110年8月	英屬開曼群島	100.0	-
	Integrated Solutions Enterprise Europe (ITGEU)	貿易公司，於110年10月取得控制力 (附註二九)	比 利 時	100.0	-
	J & R Holding	ASE Test	新 加 坡	89.8	89.8
	Omniquet Industrial Limited	控股公司	英屬維京群島	8.4	8.4
A.S.E. Holding Limited	日月瑞公司	從事租賃及投資業務	台 灣	100.0	100.0
	ASE Japan Co., Ltd.	從事半導體封裝測試業務	日 本	100.0	100.0
	ASE (U.S.) Inc.	從事市場行銷支援及客戶服務業務	美 國	100.0	100.0
	Global Advanced Packaging Technology Limited	控股公司	英屬開曼群島	100.0	100.0
	Anstock Limited	已於110年6月清算完結	英屬開曼群島	-	100.0
	Anstock II Limited	已於110年6月清算完結	英屬開曼群島	-	100.0
	蘇州日月新半導體有限公司 (蘇州日月新)	從事半導體封裝測試業務 (於110年9月以換股方式組織調整予 Global Advanced Packaging Test (Hongkong) Limited)	中國大陸蘇州	-	100.0
	Innosource Limited	Omniquet Industrial Limited	英屬維京群島	20.6	20.6
	日月光半導體 (上海) 有限公司	從事半導體材料製造業務	中國大陸上海	8.5	8.5

(接 次 頁)

(承 前 頁)

投 資 公 司 名 稱	子 公 司 名 稱	主 要 業 務	設 立 及 營 運 地 點	所 持 股 權 百 分 比 (%)	
				110年	109年
				12月31日	12月31日
Omniquest Industrial Limited	ASE Corporation	控股公司	英屬開曼群島	100.0	100.0
Alto Enterprises Limited	日月光半導體（昆山）有限公司 （日月光昆山）	從事半導體封裝測試業務	中國大陸昆山	（註2）	22.9
	日月光投資（昆山）有限公司	控股公司	中國大陸昆山	85.9	85.9
Super Zone Holdings Limited	日月光集成電路製造（中國）有限公司	從事半導體封裝測試、售後服務、諮詢及廠房出租	中國大陸上海	100.0	100.0
ASE Investment (Labuan) Inc.	ASE (Korea) Inc.	從事半導體封裝測試業務	韓 國	100.0	100.0
ASE Technology Partners, Limited	ASE Technology Acquisition Corporation	控股公司，設立於110年8月	英屬開曼群島	100.0	-
ASE (Korea) Inc.	日月光半導體（威海）有限公司	從事半導體封裝測試業務 （於110年10月處分子 J & R Holding，J & R Holding 以換股方式組織 調整予Global Advanced Packaging Test (Hongkong) Limited）	中國大陸山東	-	100.0
ASE Test	ASE Test Holdings, Ltd.	控股公司	英屬開曼群島	100.0	100.0
	ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	控股公司	新 加 坡	100.0	100.0
	ASE Investment (Labuan) Inc.	控股公司	馬來西亞	29.9	29.9
	ASE Singapore Pte. Ltd.	從事半導體封裝測試業務	新 加 坡	100.0	100.0
ASE Test Holdings, Ltd.	ISE Labs, Inc.	從事半導體測試服務	美 國	100.0	100.0
ISE Labs, Inc.	ISE Services, Inc.	晶圓代購及客戶產品管理服務	美 國	100.0	100.0
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	從事半導體封裝測試業務	馬來西亞	100.0	100.0
Global Advanced Packaging Technology Limited	日月光封裝測試（上海）有限公司 （日月光上海封測）	從事半導體封裝測試業務 及廠房出租業務	中國大陸上海	100.0	100.0
	日榮半導體（上海）有限公司	從事半導體封裝測試業務 （於110年11月處分子蘇州 日月新半導體有限公司）	中國大陸上海	-	100.0
GAPT Holding Limited	GAPT Holding Limited	控股公司，設立於110年8月	英屬維京群島	（註2）	-
	Global Advanced Packaging Test (Hongkong) Limited	貿易公司，設立於110年8月	香 港	（註2）	-
Global Advanced Packaging Test (Hongkong) Limited	蘇州日月新半導體有限公司（蘇州日月新）	從事半導體封裝測試業務 （於110年9月以換股方式組織調整向J & R Holding取得）	中國大陸蘇州	（註2）	-
	日月光半導體（威海）有限公司	從事半導體封裝測試業務 （於110年10月以換股方式組織調整向J & R Holding取得）	中國大陸山東	（註2）	-
蘇州日月新	日榮半導體（上海）有限公司	從事半導體封裝測試業務 （於110年11月向Global Advanced Packaging Technology Limited取得）	中國大陸上海	（註2）	-

(接 次 頁)

(承前頁)

投資公司名稱	子公司名稱	主要業務	設立及營運地點	所持股權百分比(%)	
				110年 12月31日	109年 12月31日
日月光上海封測	日月光投資(昆山)有限公司	控股公司	中國大陸昆山	14.1	14.1
	無錫通芝微電子有限公司	從事半導體封裝測試業務	中國大陸無錫	100.0	100.0
	上海月芯半導體科技有限責任公司	從事半導體測試服務	中國大陸上海	100.0	100.0
	上海鼎匯房地產開發有限公司(上海鼎匯)	從事房地產開發、建設及房屋銷售物業管理	中國大陸上海	60.0	60.0
上海鼎匯	上海鼎祺物業管理有限公司	從事房地產物業管理服務	中國大陸上海	100.0	100.0
	上海鼎威房地產開發有限公司(上海鼎威)	從事房地產開發、建設及商場出租業務	中國大陸上海	100.0	100.0
	上海鼎裕房地產開發有限公司	從事房地產開發、建設及商場出租業務	中國大陸上海	100.0	100.0
	昆山鼎泓房地產開發有限公司	從事房地產開發、建設及商場出租業務	中國大陸昆山	100.0	100.0
	上海鼎煦物業管理有限公司	從事房地產物業管理服務	中國大陸上海	100.0	100.0
	上海鼎堯置業發展有限公司	從事房地產物業管理服務	中國大陸上海	100.0	100.0
	上海鼎凡商業管理有限公司	從事房地產租賃及物業管理服務(於109年11月向上海鼎威取得)	中國大陸上海	100.0	100.0
日月光投資(昆山)有限公司	日月光昆山	從事半導體封裝測試業務	中國大陸昆山	(註2)	49.3
ASE Corporation	ASE Mauritius Inc.	控股公司	模里西斯	100.0	100.0
	ASE Labuan Inc.	控股公司	馬來西亞	100.0	100.0
ASE Mauritius Inc.	日月光昆山	從事半導體封裝測試業務	中國大陸昆山	(註2)	27.8
	日月光半導體(上海)有限公司	從事半導體材料製造業務	中國大陸上海	91.5	91.5
ASE Labuan Inc.	日月光電子公司	從事半導體材料製造業務	台灣	100.0	100.0
日月光半導體(上海)有限公司	日月光半導體(香港)有限公司	貿易公司	香港	100.0	100.0
	上海鼎匯	從事房地產開發、建設及房屋銷售物業	中國大陸上海	40.0	40.0
	環旭電子公司(環旭上海)	提供各種電子產品設計、製造及銷售	中國大陸上海	0.8	0.8
環電	Huntington Holdings International Co. Ltd.	控股公司	英屬維京群島	100.0	100.0
Huntington Holdings International Co. Ltd.	Unitech Holdings International Co. Ltd.	控股公司	英屬維京群島	100.0	100.0
	Real Tech Holdings Limited	控股公司	英屬維京群島	100.0	100.0
	Universal ABIT Holding Co., Ltd.	清算中	英屬開曼群島	100.0	100.0
Real Tech Holdings Limited	USI Enterprise Limited(環誠)	投資諮詢服務及倉儲管理服務	香港	100.0	95.9
環誠	環旭上海	提供各種電子產品設計、製造及銷售	中國大陸上海	77.1	76.6
環旭上海	Universal Global Technology Co., Limited	控股公司	香港	100.0	100.0
	環鴻電子(昆山)有限公司(環鴻昆山)	提供電子產品設計及製造服務	中國大陸昆山	100.0	100.0
	環維電子(上海)有限公司	電子產品、通訊產品及零配件之加工及銷售，及貨物及技術之進出口業務	中國大陸上海	100.0	100.0

(接次頁)

(承前頁)

投資公司名稱	子公司名稱	主要業務	設立及營運地點	所持股權百分比(%)	
				110年 12月31日	109年 12月31日
Universal Global Technology Co., Limited	環豪電子(上海)有限公司	電子元器件、計算機軟硬體、通訊設備及配件之銷售	中國大陸上海	100.0	100.0
	環勝電子(深圳)有限公司(環勝電子)	主機板和相關電腦週邊設備及通訊和工業控制等產品之設計、製造及銷售	中國大陸深圳	50.0	50.0
	環榮電子(惠州)有限公司	研發及生產經營新型電子元器件、通信類、電腦類及其他電子產品，及從事電子類產品維修檢測及進出口等配套服務	中國大陸惠州	100.0	100.0
	FINANCIERE AFG (FAFG)	控股公司	法國	10.4	10.4
	環旭科技有限公司	製造、貿易及投資公司	香港	100.0	100.0
	環鴻科技公司(環鴻科技)	電子通信器材、汽車及其零件製造、產品設計及研究發展服務	台灣	100.0	100.0
	USI America Inc.	新型主機板組裝與製作、無線通訊產品製作及維修服務	美國	100.0	100.0
	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	主機板及電腦系統組裝	墨西哥	100.0	100.0
	USI Japan Co., Ltd.	電腦資訊之週邊設備、積體電路、電子零件等之製造買賣	日本	100.0	100.0
	環勝電子	主機板和相關電腦週邊設備及通訊和工業控制等產品之設計、製造及銷售	中國大陸深圳	50.0	50.0
環旭科技有限公司	環海電子公司(環海電子)	接單並委外加工，銷售電子產品，提供技術諮詢服務	香港	100.0	100.0
	Universal Scientific Industrial (France)	投資公司	法國	100.0	100.0
	Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited	電子設備晶片製造及組裝，設立於109年7月	越南	100.0	100.0
	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	主機板及電腦系統組裝	墨西哥	(註1)	(註1)
	環隆電氣公司(環隆電氣)	從事各種電腦及週邊設備之製造、加工維修及銷售	台灣	100.0	100.0
環海電子	Universal Scientific Industrial Poland Sp. z o.o. (USIPL)	提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器件等業務	波蘭	100.0	100.0
環豪電子(上海)有限公司	環旭(深圳)電子科創有限公司	電子產品設計、技術服務及技術諮詢；電子產品、通訊產品及相關零配件的批發、經營進出口業務；物業管理等，設立於109年11月	中國大陸深圳	100.0	100.0
Universal Scientific Industrial (France)	FAFG	控股公司	法國	89.6	89.6
	ASTEELFLASH GROUP	控股公司 (於110年10月處分予FAFG)	法國	-	(註1)

(接次頁)

(承 前 頁)

投 資 公 司 名 稱	子 公 司 名 稱	主 要 業 務	設 立 及 營 運 地 點	所 持 股 權 百 分 比 (%)	
				110年 12月31日	109年 12月31日
FAFG	ASTEELFLASH GROUP	控股公司 (於110年10月向 Universal Scientific Industrial (France) 取得1股)	法 國	100.0	100.0
ASTEELFLASH GROUP	MANUFACTURING POWER TUNISIA	從事電子產品的設計、 製造及加工	突尼西亞	0.1	0.1
	ASTEELFLASH MEXICO S.A. de C.V.	從事電子產品的設計、 製造及加工	墨 西 哥	0.1	0.1
	ASTEELFLASH (BEDFORD) LIMITED	從事電子產品的設計、 製造及加工	英 國	100.0	100.0
	ASTEELFLASH FRANCE	從事電子產品的設計、 製造及加工	法 國	99.9	99.9
	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	從事電子產品的設計、 製造及加工	突尼西亞	100.0	100.0
	ASTEELFLASH HONG KONG LIMITED	控股公司	香 港	100.0	100.0
	ASTEELFLASH MEXICO S.A. de C.V.	從事電子產品的設計、 製造及加工	墨 西 哥	99.9	99.9
	ASTEELFLASH GERMANY GmbH	從事電子產品的設計、 製造及加工	德 國	100.0	100.0
	MANUFACTURING POWER TUNISIA	從事電子產品的設計、 製造及加工	突尼西亞	99.9	99.9
	ASTEELFLASH US HOLDING CORP.	控股公司	美 國	100.0	100.0
	ASTEEL ELECTRONIQUE FOUCHANA	從事電子產品的設計、 製造及加工 (於110年6月 處分予ASTEELFLASH TUNISIE S.A.)	突尼西亞	-	(註1)
	AFERH TUNISIE	從事組織與人力資源的 管理、培訓及諮詢	突尼西亞	0.5	0.5
	ASTEEL ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES	從事電子產品的設計、 製造及加工	突尼西亞	0.1	0.1
	ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.	從事電子產品的設計、 製造及加工 (於110年 4月向ASTEELFLASH GERMANY GmbH 取 得)	捷 克	100.0	-
	ASTEELFLASH (BEDFORD) LIMITED	從事電子產品的設計、 製造及加工	突尼西亞	(註1)	(註1)
	ASTEELFLASH TECHNOLOGIE	從事電子產品的設計、 製造及加工	法 國	(註1)	(註1)
	ASTEELFLASH FRANCE	從事不動產的持有、 使用和管理 (於110年 7月清算完結)	法 國	-	100.0
	AFERH	從事組織與人力資源的 管理、培訓及諮詢 (於 110年7月清算完結)	法 國	-	100.0
	ASTEEL ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES	從事電子產品的設計、 製造及加工	突尼西亞	99.9	99.9
	ASTEEL ELECTRONIQUE FOUCHANA	從事電子產品的設計、 製造及加工 (於110年6月 處分予ASTEELFLASH TUNISIE S.A.)	突尼西亞	-	94.2
	ASTEELFLASH TECHNOLOGIE	從事塑膠射出及工業零組 件的設計、製造及加工	法 國	100.0	100.0

(接 次 頁)

(承前頁)

投資公司名稱	子公司名稱	主要業務	設立及營運地點	所持股權百分比 (%)	
				110年 12月31日	109年 12月31日
ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	ASTEELFLASH BRETAGNE	從事電子產品的設計、 製造及加工	法 國	100.0	100.0
	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	從事電子產品的設計、 製造及加工	突尼西亞	(註1)	(註1)
	ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE	從事電子產品的設計、 製造及加工 (於110年12 月被ASTEELFLASH TUNISIE S.A.吸收合併)	突尼西亞	-	100.0
	ASTEEL ELECTRONIQUE FOUCHANA	從事電子產品的設計、 製造及加工 (於110年6月 向ASTEELFLASH GROUP、ASTEELFLASH FRANCE、飛旭電子 (蘇州)有限公司及 ASTEELFLASH USA CORP.取得,並於110年 12月被ASTEELFLASH TUNISIE S.A.吸收合併)	突尼西亞	-	(註1)
AFERH	AFERH TUNISIE	從事組織與人力資源的 管理、培訓及諮詢	突尼西亞	99.5	99.5
ASTEELFLASH HONG KONG LIMITED	飛旭電子(蘇州)有 限公司	從事電子產品的設計、 製造及加工	中國大陸蘇州	100.0	100.0
飛旭電子(蘇州)有 限公司	ASTEEL ELECTRONIQUE FOUCHANA	從事電子產品的設計、 製造及加工 (於110年6月 處分予ASTEELFLASH TUNISIE S.A.)	突尼西亞	-	(註1)
ASTEELFLASH GERMANY GmbH	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	從事電子產品的設計、 製造及加工	突尼西亞	(註1)	(註1)
	ASTEELFLASH HERSFELD GmbH	從事電子產品的設計、 製造及加工	德 國	100.0	100.0
	ASTEELFLASH EBERBACH GmbH	從事電子產品的設計、 製造及加工	德 國	100.0	100.0
	ASTEELFLASH BONN GmbH	從事電子產品的設計、 製造及加工	德 國	100.0	100.0
ASTEELFLASH MEXICO S.A. de C.V.	ASTEELFLASH SCHWANDORF GmbH	從事電子產品的設計、 製造及加工	德 國	100.0	100.0
	ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.	從事電子產品的設計、 製造及加工 (於110年4月 處分予ASTEELFLASH GROUP)	捷 克	-	100.0
	ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBURG GmbH	從事電子產品的設計、 製造及加工	德 國	100.0	100.0
	EN ELECTRONICNETWORK SRL	從事電子產品的設計、 製造及加工	羅馬尼亞	100.0	100.0
ASTEELFLASH HOLDING CORP. ASTEELFLASH USA CORP.	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	從事電子產品的設計、 製造及加工	突尼西亞	(註1)	(註1)
	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	從事電子產品的設計、 製造及加工	突尼西亞	(註1)	(註1)
	ASTEELFLASH USA CORP.	從事電子產品的設計、 製造及加工	美 國	100.0	100.0
	ASTEEL ELECTRONIQUE FOUCHANA	從事電子產品的設計、 製造及加工 (於110年6月 處分予ASTEELFLASH TUNISIE S.A.)	突尼西亞	-	(註1)
	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	從事電子產品的設計、 製造及加工	突尼西亞	(註1)	(註1)

(接次頁)

(承前頁)

投資公司名稱	子公司名稱	主要業務	設立及營運地點	所持股權百分比(%)	
				110年 12月31日	109年 12月31日
矽品	SPIL (B.V.I.) Holding Limited	投資公司	英屬維京群島	100.0	100.0
SPIL (B.V.I.) Holding Limited	矽品投資公司	投資公司	台灣	100.0	100.0
	Siliconware USA, Inc.	北美地區行銷業務服務	美國	100.0	100.0
	SPIL (Cayman) Holding Limited	投資公司	英屬開曼群島	100.0	100.0
SPIL (Cayman) Holding Limited	矽品科技(蘇州)有限公司	從事半導體封裝測試業務	中國大陸蘇州	100.0	100.0

註 1：持有股數為 1 股或 3 股，所持股權百分比未達 0.1%。

註 2：本公司董事會於 110 年 12 月決議處分該等子公司 100% 股權，並已於 110 年 12 月完成交易並喪失對上述子公司之控制，處分子公司相關揭露，參閱附註三十。

(五) 企業合併

企業合併係採收購法處理。收購相關成本於成本發生及勞務取得當期列為費用。

商譽係按移轉對價之公允價值、被收購者之非控制權益金額以及收購者先前已持有被收購者之權益於收購日之公允價值之總額，超過收購日所取得可辨認資產及承擔負債之淨額衡量。倘於重評估後，收購日所取得可辨認資產及承擔負債之淨額仍超過移轉對價、被收購者之非控制權益以及收購者先前已持有被收購者之權益於收購日公允價值之總數，則該差額為廉價購買利益，並立即認列為損益。

當本集團於企業合併所移轉之對價包括因或有對價約定而產生之資產或負債時，或有對價係以收購日之公允價值衡量，並作為交換被收購者而支付移轉對價之一部分。或有對價公允價值之變動若屬衡量期間之調整，係追溯調整收購成本並相對調整商譽。衡量期間之調整係指於「衡量期間」（自收購日起不得超過一年）內因取得於收購日已存在事實與情況之額外資訊所產生之調整。

非屬衡量期間調整之或有對價公允價值變動，其後續處理將取決於或有對價之分類。非為權益之或有對價於後續資產負

債表日依公允價值衡量，公允價值變動認列於損益。

分階段達成之企業合併係以收購日之公允價值再衡量本集團先前已持有被收購者之權益，若因而產生任何利益或損失，則認列為損益或其他綜合損益。因先前已持有被收購者之權益而於收購日前已認列於其他綜合損益之金額，係按與本集團若直接處分其先前已持有權益之相同基礎認列。

因企業合併所取得可辨認資產及承擔負債之衡量若尚未完成，於資產負債表日係以暫定金額認列，並於衡量期間進行追溯調整或認列額外之資產或負債，以反映所取得有關收購日已存在事實與情況之新資訊。

本集團未採用收購法處理組織重組下之企業合併，而係採用帳面價值法。子公司間基於共同控制下之組織重組，本集團選擇不重編前期比較資訊。

(六) 外 幣

各個體編製財務報告時，以個體功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。除為規避部分匯率風險而進行避險交易所產生之兌換差額外，因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當期認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當期損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

於編製合併財務報告時，本集團國外營運機構（包含營運所在國家或使用之貨幣與本公司不同之子公司及關聯企業）之資產及負債以每一資產負債表日匯率換算為新台幣；收益及費損項目係以當年度各月份之平均匯率換算並累計，所產生之兌

換差額認列於其他綜合損益，並分別歸屬予本公司業主及非控制權益。

若本集團處分國外營運機構之所有權益，或處分國外營運機構之子公司部分權益但喪失控制，或處分國外營運機構之關聯企業後之保留權益係金融資產並按金融工具之會計政策處理，所有可歸屬於本公司業主且與該國外營運機構相關之累計兌換差額將重分類至損益。

若部分處分國外營運機構之子公司未導致喪失控制，係按比例將累計兌換差額重新歸屬予該子公司之非控制權益，而不認列為損益。在其他任何部分處分國外營運機構之情況下，累計兌換差額則按處分比例重分類至損益。

因收購國外營運機構產生之商譽及因收購國外營運機構對資產及負債帳面金額所作之公允價值調整，係視為該國外營運機構之資產及負債，並以每一資產負債表日之收盤匯率換算，所產生之兌換差額認列於其他綜合損益。

(七) 存貨及存貨－營建房地

存貨包括原料、物料、在製品、製成品及在途原物料。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入及完成出售所需之估計成本後之餘額。原料及物料成本按移動平均法計價，在製品及製成品成本按標準成本計價。

存貨－營建房地包括待售房地、在建房地及營建用地。預計開發之土地於取得所有權後列為營建用地；在建房地於積極進行土地開發及建造房屋期間，就已支付在建房地成本所必須負擔之利息，予以資本化列為在建房地成本，俟工程完工則轉列為待售房地。待售房地、在建房地及營建用地以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值係以個別項目為基礎。待售房地及在建房地預售所收取之款項先列入預收房地款。俟工程完工後，就已銷售房地交付予客戶完成交屋程序並

移轉控制時，轉列當期營建收入，待售房地依出售面積比例轉為當期營業成本。

(八) 投資關聯企業及合資

關聯企業係指本集團具有重大影響，但非屬子公司或合資之企業。合資係本集團與他公司具有聯合控制且對淨資產具有權利之聯合協議。

本公司對投資關聯企業及合資係採用權益法。

權益法下，投資關聯企業及合資原始依成本認列，取得日後帳面金額係隨本集團所享有之關聯企業及合資損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外，針對關聯企業權益及合資之變動係按持股比例認列。

取得成本超過本集團於取得日所享有關聯企業及合資可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽，該商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷；本集團於取得日所享有關聯企業及合資可辨認資產及負債淨公允價值份額超過取得成本之數額列為當期損益。

關聯企業及合資發行新股時，本集團若未按持股比例認購，致使持股比例發生變動，並因而使投資之股權淨值發生增減時，其增減數調整資本公積—採權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數及採用權益法之投資。惟若未按持股比例認購或取得致使對關聯企業及合資之所有權權益減少者，於其他綜合損益中所認列與該關聯企業及該合資有關之金額按減少比例重分類，其會計處理之基礎係與關聯企業及合資若直接處分相關資產或負債所必須遵循之基礎相同；前項調整如應借記資本公積，而採用權益法之投資所產生之資本公積餘額不足時，其差額借記保留盈餘。

當本集團對關聯企業及合資之損失份額等於或超過其在該關聯企業及合資之權益（包括權益法下投資關聯企業及合資之帳面金額及實質上屬於本集團對該關聯企業及該合資淨投資組成部分之其他長期權益）時，即停止認列進一步之損失。本集

團僅於發生法定義務、推定義務或已代關聯企業及合資支付款項之範圍內，認列額外損失及負債。

本集團於評估減損時，係將投資之整體帳面金額（含商譽）視為單一資產比較可回收金額與帳面金額，進行減損測試，所認列之減損損失不分攤至構成投資帳面金額組成部分之任何資產，包括商譽。減損損失之任何迴轉，於該投資之可回收金額後續增加之範圍內予以認列。

本集團自其投資不再為關聯企業及合資之日停止採用權益法，其對原關聯企業及原合資之保留權益以公允價值衡量，該公允價值及處分價款與停止採用權益法當日之投資帳面金額之差額，列入當期損益。此外，於其他綜合損益中所認列與該關聯企業及該合資有關之所有金額，其會計處理之基礎係與關聯企業及合資若直接處分相關資產或負債所必須遵循之基礎相同。若對關聯企業之投資成為合資之投資，或對合資之投資成為對關聯企業之投資，本集團係持續採用權益法而不對保留權益作再衡量。

本集團與關聯企業及本集團與合資間之逆流、順流及側流交易所產生之損益，僅在與本集團對關聯企業權益及對合資權益無關之範圍內，認列於合併財務報告。

(九) 不動產、廠房及設備

除土地以成本計價外，土地以外之不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

建造中之不動產、廠房及設備係以成本減除累計減損損失後之金額認列。成本包括專業服務費用及符合資本化條件之借款成本。該等資產於完工並達預期使用狀態時，分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

自有土地不提列折舊。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎，對於每一重大部分單獨提列折舊。本集團至少於每一年度結束日對估計

耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(十) 投資性不動產

投資性不動產係為賺取租金或資本增值或兩者兼具而持有之不動產（包含符合投資性不動產定義而處於建造過程中之不動產及使用權資產）。

自有之投資性不動產原始以成本（包括交易成本）衡量，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

租賃取得之投資性不動產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付、原始直接成本及復原標的資產之估計成本，減除收取之租賃誘因）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。

所有投資性不動產採直線基礎提列折舊。

建造中之投資性不動產係以成本減除累計減損損失後之金額認列。成本包括專業服務費用，及符合資本化條件之借款成本。該等資產於達預期使用狀態時開始提列折舊。

投資性不動產係以開始轉供自用日之帳面金額轉列不動產、廠房及設備或使用權資產。

不動產、廠房及設備及使用權資產之不動產係以結束自用時之帳面金額轉列投資性不動產。

帳列存貨之不動產係以成立營業租賃出租時之帳面金額轉列投資性不動產。

投資性不動產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(十一) 商 譽

企業合併所取得之商譽係依收購日所認列之商譽金額作為成本，後續以成本減除累計減損損失後之金額衡量。

為減損測試之目的，商譽分攤至本集團預期因該合併綜效而受益之各現金產生單位或現金產生單位群組（簡稱「現金產生單位」）。

受攤商譽之現金產生單位每年（及有跡象顯示該單位可能已減損時）藉由包含商譽之該單位帳面金額與其可回收金額之比較，進行該單位之減損測試。若分攤至現金產生單位之商譽係當年度企業合併所取得，則該單位應於當年度結束前進行減損測試。若受攤商譽之現金產生單位之可回收金額低於其帳面金額，減損損失係先減少該現金產生單位受攤商譽之帳面金額，次就該單位內其他各資產帳面金額之比例減少各該資產帳面金額。任何減損損失直接認列為當期損失。商譽減損損失不得於後續期間迴轉。

（十二）其他無形資產

1. 單獨取得

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損損失後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷，本集團至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。

2. 企業合併取得

企業合併所取得之無形資產係以收購日之公允價值認列，並與商譽分別認列，後續衡量方式與單獨取得之無形資產相同。

3. 除 列

無形資產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當期損益。

（十三）不動產、廠房及設備、使用權資產、投資性不動產及無形資產（商譽除外）之減損

本集團於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示不動產、廠房及設備、使用權資產、投資性不動產及無形資產（商

譽除外)可能已減損。若有任一減損跡象存在,則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額,本集團估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。共用資產係依合理一致基礎分攤至個別現金產生單位。可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者,個別資產或現金產生單位之可回收金額若其低於帳面金額時,則將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額,減損損失係認列於損益。

當減損損失於後續迴轉時,該資產或現金產生單位之帳面金額調增至修訂後之可回收金額,惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額(減除折舊或攤銷)。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十四) 金融工具

金融資產與金融負債於本集團成為該工具合約條款之一方時認列於合併資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時,若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者,係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本,則立即認列為損益。

1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交割日會計認列及除列。

(1) 衡量種類

本集團所持有之金融資產種類為透過損益按公允價值衡量之金融資產、按攤銷後成本衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資與透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資。

A. 透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公允價值衡量之金融資產係強制透

過損益按公允價值衡量及指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。強制透過損益按公允價值衡量之金融資產包括本集團未指定透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，及不符合分類為按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資。

透過損益按公允價值衡量之金融資產係按公允價值衡量，其股利及利息係認列於其他收入，再衡量利益或損失係認列於其他利益或損失。

公允價值之決定方式請參閱附註三四。

B. 按攤銷後成本衡量之金融資產

本集團投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

- a. 係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產以收取合約現金流量；及
- b. 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產（包括現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之應收帳款、其他應收款及其他金融資產）於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

除下列兩種情況外，利息收入係以有效利率乘以金融資產總帳面金額計算：

- a. 購入或創始之信用減損金融資產，利息收入係以信用調整後有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。
- b. 非屬購入或創始之信用減損，但後續變成信用減損之金融資產，應自信用減損後之次一報導期間起以有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算利息

收入。

信用減損金融資產係指發行人或債務人已發生重大財務困難、違約、債務人很有可能聲請破產或其他財務重整或由於財務困難而使金融資產之活絡市場消失。

約當現金包括自取得日起 3 個月內、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款及附買回債券，係用於滿足短期現金承諾。

C. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資

本集團投資債務工具若同時符合下列兩條件，則分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產：

- a. 係於某經營模式下持有，該模式之目的係藉由收取合約現金流量及出售金融資產達成；及
- b. 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資係按公允價值衡量，帳面金額之變動中屬以有效利息法計算之利息收入、外幣兌換損益與減損損失或迴轉利益係認列於損益，其餘變動係認列於其他綜合損益，於投資處分時重分類為損益。

D. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

本集團於原始認列時，可作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易且非企業合併收購者所認列或有對價之權益工具投資，指定透過其他綜合損益按公允價值衡量。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資係按公允價值衡量，後續公允價值變動列報於其他綜合損益，並累計於其他權益中。於投資處分時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為

損益。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資之股利於本集團收款之權利確立時認列於損益中，除非該股利明顯代表部分投資成本之回收。

(2) 金融資產及合約資產之減損

本集團於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）、透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資及合約資產之減損損失。

應收帳款及合約資產均按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。12 個月預期信用損失係代表金融工具於報導日後 12 個月內可能違約事項所產生之預期信用損失，存續期間預期信用損失則代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，惟透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資之備抵損失係認列於其他綜合損益，並不減少其帳面金額。

(3) 金融資產之除列

本集團僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資整體除列

時，其帳面金額與所收取對價加計已認列於其他綜合損益之任何累計利益或損失之總和間之差額係認列於損益。透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資整體除列時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

2. 權益工具

本集團發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

再取回本公司本身之權益工具係於權益項下認列與減除。購買、出售、發行或註銷本公司本身之權益工具不認列於損益。

3. 金融負債

(1) 後續衡量

所有金融負債係以有效利息法按攤銷後成本衡量或透過損益按公允價值衡量。

透過損益按公允價值衡量之金融負債係持有供交易之金融負債。持有供交易之金融負債係按公允價值衡量，相關利益或損失係認列於其他利益或損失。

公允價值之決定方式請參閱附註三四。

(2) 金融負債之除列

除列金融負債時，其帳面金額與所支付對價（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）間之差額認列為損益。

4. 衍生工具

本集團簽訂之衍生工具包括遠期外匯合約、換匯合約及目標可贖回遠期契約等，用以管理本集團之利率及匯率風險。

衍生工具於簽訂衍生工具合約時，原始以公允價值認列，後續於資產負債表日按公允價值再衡量，後續衡量產生之利益或損失直接列入損益，然指定且為有效避險工具之衍生工具，其認列於損益之時點則將視避險關係之性質而定。當衍生工具之公允價值為正值時，列為金融資產；公允價值為負值時，列為金融負債。

衍生工具若嵌入於 IFRS 9「金融工具」範圍內之資產主契約，係以整體合約決定金融資產分類。衍生工具若嵌入於非 IFRS 9 範圍內之資產主契約（如嵌入於金融負債主契約），而嵌入式衍生工具若符合衍生工具之定義，其風險及特性與主契約之風險及特性並非緊密關聯，且混合合約非透過損益按公允價值衡量時，該衍生工具係視為單獨衍生工具。

5. 子公司轉換公司債

子公司發行之複合金融工具（轉換公司債）係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義，於原始認列時將其組成部分分別分類為金融負債及權益。

原始認列時，負債組成部分之公允價值係以類似之不可轉換工具當時市場利率估算，並於執行轉換或到期日前，以有效利息法計算之攤銷後成本衡量。屬嵌入非權益衍生工具之負債組成部分則以公允價值衡量。

分類為權益之轉換權係等於該複合工具整體公允價值減除經單獨決定之負債組成部分公允價值之剩餘金額，並認列為非控制權益，後續不再衡量。轉換公司債之轉換權若於到期日仍未被執行，該認列於非控制權益之轉換權將轉列資本公積—認列對子公司所有權權益變動數。

發行轉換公司債之相關交易成本，係按分攤總價款之比例分攤至該工具之負債（列入負債帳面金額）及權益組成部分（列入非控制權益）。

(十五) 避險會計

本集團指定部分避險工具（包括衍生工具、嵌入式衍生工具及規避匯率風險之非衍生工具）進行公允價值避險或現金流量避險。

1. 公允價值避險

指定且符合公允價值避險之避險工具利益及損失，及被避險項目歸因於被規避風險而產生之公允價值變動，係立即認列於損益，並於合併綜合損益表中認列於與被避險項目相關之項目下。

本集團僅於避險關係不再符合避險會計之要件時推延停止避險會計，此包括避險工具已到期、出售、解約或行使。

2. 現金流量避險

指定且符合現金流量避險之避險工具，其利益及損失屬有效避險部分係認列於其他綜合損益；屬避險無效部分則立即認列於損益。

當被避險項目認列於損益時，原先認列於其他綜合損益之金額將於同一期間重分類至損益，並於合併綜合損益表認列於與被避險項目相關之項目下。然而，當預期交易之避險將認列非金融資產或非金融負債時，原先認列於其他綜合損益之金額，將自權益轉列為該非金融資產或非金融負債之原始成本。

本集團僅於避險關係不再符合避險會計之要件時推延停止避險會計，此包括避險工具已到期、出售、解約或行使。先前於避險有效期間已認列於其他綜合損益之金額，於預期交易發生前仍列於權益，當預期交易不再預期發生時，先前認列於其他綜合損益之金額將立即認列於損益。

3. 國外營運機構淨投資避險

國外營運機構淨投資避險之會計處理與現金流量避險類似。避險工具之利益及損失屬有效避險部分，係認列於

其他綜合損益並累計列入國外營運機構財務報表換算之兌換差額；屬避險無效部分則立即認列為損益。

屬避險有效而累計列入國外營運機構財務報表換算之兌換差額之金額，係於處分或部分處分國外營運機構時重分類至損益。

(十六) 收入認列

本集團於客戶合約辨認履約義務後，將交易價格分攤至各履約義務，並於滿足各履約義務時按合約約定固定價格並考量數量折扣之期望值後決定收入認列金額。

移轉商品或勞務與收取對價之時間間隔在 1 年以內之合約，其重大財務組成部分不予調整交易價格。

本集團之客戶合約預期存續期間未超過 1 年，且無客戶合約之對價未計入交易價格中，故適用實務權宜作法而無須對履約義務揭露(1)至報導期間結束日尚未滿足或部分滿足之履約義務所分攤之交易價格之彙總金額，以及(2)預期何時認列為收入。

本集團營業收入包括商品及勞務之銷售、房地產開發銷售及商場出租收入。

當商品於製造時即由客戶控制，因投入之成本與履約義務之完成程度直接相關，本集團係採用投入法按已投入成本佔預計總成本之比例衡量完成進度並認列收入及合約資產，再依照與客戶之約定於商品製造完成時或交運商品時將合約資產轉列應收帳款。

當商品交運時或運抵客戶指定地點時，客戶始對該商品擁有訂定價格與使用之權利且負有再銷售之主要責任，並承擔商品陳舊過時風險者，本集團係於該時點認列收入及應收帳款。

房地產開發銷售收入係於客戶購買商品房並完成交屋程序後認列房產銷售收入，而商場出租之租金收入係按直線基礎於租賃期間內認列為收入。

(十七) 租賃

本集團於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

對於包含租賃及非租賃組成部分之合約，本集團選擇將租賃與非租賃組成部分整體適用租賃會計處理。

1. 本集團為出租人

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人，則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

本集團於轉租使用權資產時，係以使用權資產（而非標的資產）判斷轉租之分類。惟若主租賃係本集團適用認列豁免之短期租賃時，該轉租分類為營業租賃。

營業租賃下，減除租賃誘因後之租賃給付係按直線基礎於相關租賃期間內認列為收益。因取得營業租賃所發生之原始直接成本，係加計至標的資產之帳面金額，並按直線基礎於租賃期間內認列為費用。

2. 本集團為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。除符合投資性不動產定義者，使用權資產係單獨表達於合併資產負債表。符合投資性不動產定義之使用權資產之認列與衡量，參閱前述投資性不動產會計政策。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。若租賃期間屆滿時將取得標的資產所有權，或若使用權資產之成本反映購買選擇權之行使，則自租賃開始日起至標的資產耐用年限屆滿時提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付（包含固定給付、實質固定給付、取決於指數或費率之變動租賃給付、殘值保證下承租人預期支付之金額、合理確信將行使之購買選擇權之行使價格，及已反映於租賃期間之租賃終止罰款，減除收取之租賃誘因）之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間、殘值保證下預期支付金額、標的資產購買選擇權之評估或用於決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動，本集團再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。對於不以單獨租賃處理之租賃修改，因減少租賃範圍之租賃負債再衡量係調減使用權資產，並認列租賃部分或全面終止之損益；因其他修改之租賃負債再衡量係調整使用權資產。租賃負債係單獨表達於合併資產負債表。

本集團與出租人進行新型冠狀病毒肺炎直接相關之租金協商，調整 111 年 6 月 30 日以前到期之租金致使租金減少，該等租金協商並未重大變動其他租約條款。本集團選擇採實務權宜作法處理符合前述條件之所有租金協商，不評估該協商是否為租賃修改，而係將租賃給付之減少於減讓事件或情況發生時認列於損益（帳列變動租賃給付費用減項），並相對調減租賃負債。

租賃協議中非取決於指數或費率之變動租金於發生當期認列為費用。

(十八) 借款成本

直接可歸屬於取得、建造或生產符合要件之資產之借款成本，係作為該資產成本之一部分，直到該資產達到預定使用或出售狀態之幾乎所有必要活動已完成為止。

特定借款如於符合要件之資本支出發生前進行暫時投資而賺取之投資收入，係自符合資本化條件之借款成本中減除。

除上述外，其他借款成本係於發生當期認列為損益。

(十九) 政府補助

政府補助僅於可合理確信本集團將遵循政府補助所附加之條件，且將可收到該項補助時，始予以認列。

與收益有關之政府補助係於其意圖補償之相關成本於本集團認列為費用之期間內，按有系統之基礎認列於其他收入。以本集團應購買、建造或以其他方式取得非流動資產為條件之政府補助係認列為遞延收入，並以合理且有系統之基礎於相關資產耐用年限期間轉列損益。

若政府補助係用於補償已發生之費用或損失，或係以給與本集團立即財務支援為目的且無未來相關成本，則於其可收取之期間認列於損益。

本集團所取得低於市場利率之政府補助貸款，其收取之貸款金額與依當時市場利率計算之貸款公允價值兩者間之差額係認列為政府補助。

(二十) 員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本（含服務成本、淨利息及再衡量數）係採預計單位福利法精算。服務成本（含當期服務成本及前期服務成本）及淨確定福利負債（資產）淨利息於發生時認列為員工福利費用。再衡量數（含精算損益及扣除利息後之計畫資產報酬）於發生時認列於其他綜合損益並列入保留盈餘，後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債（資產）係確定福利退休計畫之提撥短絀（剩餘）。淨確定福利資產不得超過從該計畫退還提撥金或可減少未來提撥金之現值。

（二一）股份基礎給付協議

員工認股權及限制員工權利股票係按給與日權益工具之公允價值與預期既得之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並分別同時調整資本公積—員工認股權或非控制權益（子公司發行之員工認股權）及其他權益（員工未賺得酬勞）或非控制權益（子公司發行之限制員工權利股票）。若其於給與日立即既得，係於給與日全數認列費用。本公司辦理現金增資保留員工認購，係以確認員工認購股數之日為給與日。

本集團發行限制員工權利股票時，係於給與日認列其他權益（員工未賺得酬勞），並同時調整資本公積—限制員工權利股票。

本集團於每一資產負債表日修正預期既得之員工認股權及限制員工權利股票估計數量。若有修正原估計數量，其影響數係認列為損益，使累計費用反映修正之估計數，並相對調整資本公積—員工認股權、資本公積—限制員工權利股票或非控制權益（子公司發行之員工認股權）及其他權益（員工未賺得酬勞）或非控制權益（子公司發行之限制員工權利股票）。

（二二）所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

本集團依各所得稅申報轄區所制定之法規決定當期所得（損失），據以計算應付（可回收）之所得稅。

依中華民國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依本集團內各個體之帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。非屬企業合併之資產及負債原始認列當時既不影響課稅所得亦不影響會計利潤，其產生之暫時性差異不認列遞延所得稅資產及負債。此外，原始認列商譽產生之應課稅暫時性差異不認列遞延所得稅負債。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異、虧損扣抵或相關資本支出所產生之所得稅抵減使用時認列。

與投資子公司及關聯企業相關之應課稅暫時性差異皆認列為遞延所得稅負債，惟本集團若可控制暫時性差異迴轉之時點，且該暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。與此類投資有關之可減除暫時性差異，僅於其很有可能有足夠課稅所得用以實現暫時性差異，且於可預見之未來預期將迴轉的範圍內，予以認列遞延所得稅資產。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本集團於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

若當期所得稅或遞延所得稅係自企業合併所產生，其所得稅影響數納入企業合併之會計處理。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本集團於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

本集團將新型冠狀病毒肺炎疫情近期在我國之發展及對經濟環境可能之影響，納入對現金流量推估、成長率、折現率、獲利能力等相關重大會計估計之考量，管理階層將持續檢視估計與基本假設。若估計之修正僅影響當年度，則於修正當年度認列；若會計估計之修正同時影響當年度及未來年度，則於修正當年度及未來年度認列。

商譽減損評估

決定商譽是否減損時，須估計分攤到商譽之現金產生單位之使用價值。為計算使用價值，管理階層應估計預期自現金產生單位所產生之未來現金流量，並決定計算現值所使用之適當折現率。若實際現金流量少於預期，或事實與情況發生改變致未來現金流量向下修正或折現率向上修正，可能會產生重大減損損失。

六、現金及約當現金

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
庫存現金	\$ 5,638	\$ 6,073
銀行支票存款及活期存款	47,094,687	48,734,866
約當現金（原始到期日在 3 個月以內之定期存款及附買回債券）	28,973,020	2,797,132
	<u>\$ 76,073,345</u>	<u>\$ 51,538,071</u>

七、透過損益按公允價值衡量之金融工具

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日 (追溯調整後)
強制透過損益按公允價值衡量之 金融資產		
衍生工具（未指定避險）		
換匯合約	\$ 85,629	\$ 99,312
遠期外匯合約	23,373	122,511
轉換公司債贖回賣回權	8,463	-
目標可贖回遠期契約	500	-
非衍生金融資產		
上市（櫃）公司普通股	2,683,193	4,064,438
私募基金	1,322,686	1,124,754
非上市（櫃）公司特別 股	583,270	385,440
或有對價（附註二九）	394,943	387,790
基金受益憑證	334,223	339,338
	<u>5,436,280</u>	<u>6,523,583</u>
減：透過損益按公允價值衡量之 金融資產－流動	<u>2,933,446</u>	<u>4,342,605</u>
透過損益按公允價值衡量之 金融資產－非流動	<u>\$2,502,834</u>	<u>\$2,180,978</u>
持有供交易之金融負債		
衍生工具（未指定避險）		
換匯合約	\$ 360,797	\$1,448,972
遠期外匯合約	56,863	9,020
目標可贖回遠期契約	-	79,216
透過損益按公允價值衡量之金融 負債－流動	<u>\$ 417,660</u>	<u>\$1,537,208</u>

（一）於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之換匯合約如下：

幣 別	到 期 期 間	合 約 金 額 （ 千 元 ）
110 年 12 月 31 日		
人民幣兌美金	111.01	RMB2,617,518／USD409,000
新台幣兌美金	111.01～111.12	NTD52,916,127／USD1,903,000
美金兌人民幣	111.02	USD54,415／RMB349,800
美金兌日幣	111.01	USD17,671／JPY2,000,000
美金兌韓圀	111.01	USD37,500／KRW44,418,750
美金兌新台幣	111.01～111.04	USD570,130／NTD15,845,090

（接次頁）

(承前頁)

幣別	到期期間	合約金額 (千元)
109年12月31日		
新台幣兌美金	110.01~110.12	NTD51,140,082/USD1,755,000
美金兌人民幣	110.01~110.02	USD59,793/RMB395,742
美金兌港幣	110.02	USD13,804/HKD107,000
美金兌日幣	110.01	USD41,630/JPY4,300,000
美金兌韓圓	110.01	USD30,000/KRW33,066,000
美金兌新台幣	110.01~110.02	USD675,240/NTD19,073,846

(二) 於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之遠期外匯合約如下：

幣別	到期期間	合約金額 (千元)
110年12月31日		
人民幣兌日幣	111.01	RMB35,127/JPY630,000
人民幣兌美金	111.01	RMB727,645/USD114,000
新台幣兌美金	111.01~111.03	NTD3,465,805/USD125,000
美金兌人民幣	111.01~111.06	USD265,000/RMB1,701,695
美金兌歐元	111.01	USD460/EUR407
美金兌日幣	111.01~111.02	USD94,747/JPY10,789,851
美金兌馬幣	111.01~111.02	USD8,000/MYR33,430
美金兌新台幣	111.01	USD10,000/NTD277,735
美金兌新加坡幣	111.01~111.02	USD16,900/SGD22,925
109年12月31日		
人民幣兌美金	110.01	RMB756,946/USD116,093
港幣兌美金	110.01	HKD4,100/USD529
新台幣兌美金	110.01~110.02	NTD2,667,230/USD95,000
美金兌人民幣	110.01~110.04	USD363,000/RMB2,385,500
美金兌歐元	110.01	USD1,607/EUR1,320
美金兌日幣	110.01~110.04	USD100,076/JPY10,405,845
美金兌韓圓	110.01	USD16,000/KRW17,575,300
美金兌馬幣	110.01~110.04	USD24,000/MYR98,737
美金兌新台幣	110.01~110.02	USD27,470/NTD776,867
美金兌新加坡幣	110.01~110.04	USD18,500/SGD24,868

(三) 於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之目標可贖回遠期契約如下：

幣別	到期期間	合約金額 (千元)
110年12月31日		
歐元兌美金	111.04~111.06	EUR2,982/USD3,475
109年12月31日		
歐元兌美金	111.04~111.06	EUR23,279/USD27,475

上述子公司持有之目標可贖回遠期契約係每周結算，結算時若市場匯率低於執行匯率，該等契約依名目本金交割，若市場匯率高於執行匯率時，則該等契約以槓桿名目本金（二倍名目本金）交割，直至美金部位之名目本金全數交割完畢。惟當每周比價後，市場匯率低於執行匯率之累計匯差達到約定門檻時，該等契約自動提前終止。

八、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	\$ 943,354	\$ 728,398
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資	<u>1,076,458</u>	<u>1,012,736</u>
	<u>\$2,019,812</u>	<u>\$1,741,134</u>

(一) 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
非上市（櫃）公司普通股	\$820,779	\$567,377
上市（櫃）公司普通股	102,124	-
非上市（櫃）公司特別股	11,245	151,329
有限合夥	<u>9,206</u>	<u>9,692</u>
	<u>\$943,354</u>	<u>\$728,398</u>

(二) 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
無擔保次順位公司債	<u>\$1,076,458</u>	<u>\$1,012,736</u>

上述無擔保次順位公司債係每張面額 1,000 千元，共計 1,000 張之無到期日累積次順位公司債，票面利率及有效利率分別為 3.5% 及 3.2%。

九、債務工具投資之信用風險管理

本集團投資之無擔保次順位公司債屬信用評等為投資等級以上（含）且於減損評估屬信用風險低之債務工具。

該等債務工具自原始認列後信用風險未顯著增加而導致利率或條款有所變動，亦未預期有影響履行債務能力之顯著經營變動，故尚無預期信用損失。本集團持續追蹤外部評等資訊以監督其信用風險變化，並定期檢視債券殖利率曲線及債務人重大訊息等其他資訊，以評估該投資自原始認列後存續期間之預期信用損失是否顯著增加。

十、應收帳款淨額

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$109,473,101	\$ 91,304,934
減：備抵損失	<u>103,353</u>	<u>97,358</u>
	109,369,748	91,207,576
透過其他綜合損益按公允價值衡 量		
	<u>6,092,462</u>	<u>626,413</u>
	<u>\$115,462,210</u>	<u>\$ 91,833,989</u>

(一) 應收帳款

1. 按攤銷後成本衡量之應收帳款

本集團之主要授信期間為 30～90 天，參考歷史經驗、考量個別客戶財務狀況、新型冠狀病毒肺炎影響、所處產業、競爭優勢與其未來展望，以評估信用損失發生之風險及機率，於資產負債表日逐一複核應收帳款之可回收金額以確保無法回收之應收帳款已提列適當減損損失。據此，本集團管理階層認為本集團之信用風險已顯著減少。

本集團按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢及展望。因本集團之信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態不同，因此準備矩陣進一步區分客戶群，並以應收帳款逾期天數訂定預期信用損失率。

若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本集團無法合理預期可回收金額，本集團直接沖銷相關應收帳款，惟仍會持續追索活動，因追索回收之金額則認列於損益。

本集團依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下：

110 年 12 月 31 日

預期信用損失率	未逾 0%	逾期 1 ~ 30 天 0%~10%	逾期 31 ~ 90 天 0%~70%	逾期 91 天以上 1%~100%	個別辨識	合計
總帳面金額	\$ 105,538,390	\$ 3,136,438	\$ 609,695	\$ 99,118	\$ 89,460	\$ 109,473,101
備抵損失 (存續期間預期信用損失)	(18,062)	(1,811)	(22,785)	(46,337)	(14,358)	(103,353)
	<u>\$ 105,520,328</u>	<u>\$ 3,134,627</u>	<u>\$ 586,910</u>	<u>\$ 52,781</u>	<u>\$ 75,102</u>	<u>\$ 109,369,748</u>

109 年 12 月 31 日

預期信用損失率	未逾 0%	逾期 1 ~ 30 天 0%~10%	逾期 31 ~ 90 天 0%~70%	逾期 91 天以上 1%~100%	個別辨識	合計
總帳面金額	\$ 86,820,792	\$ 3,823,249	\$ 557,487	\$ 92,873	\$ 10,533	\$ 91,304,934
備抵損失 (存續期間預期信用損失)	(18,911)	(2,053)	(20,629)	(45,232)	(10,533)	(97,358)
	<u>\$ 86,801,881</u>	<u>\$ 3,821,196</u>	<u>\$ 536,858</u>	<u>\$ 47,641</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 91,207,576</u>

應收帳款備抵損失之變動資訊如下：

	110 年度	109 年度
年初餘額	\$ 97,358	\$136,497
本年度提列 (迴轉)	17,078	(55,742)
本年度重分類	-	(6,970)
由企業合併取得	-	32,460
本年度沖銷	(399)	(3,944)
處分子公司	(4,637)	-
外幣換算差額	(6,047)	(4,943)
年底餘額	<u>\$103,353</u>	<u>\$ 97,358</u>

2. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之應收帳款

針對特定客戶之應收帳款，本集團視營運資金情況決定以無追索權之方式讓售予銀行或不予讓售。本集團管理此類應收帳款之經營模式，係藉由收取合約現金流量及出售金融資產達成目的，故此類應收帳款係透過其他綜合損益按公允價值衡量。

本集團依準備矩陣衡量透過其他綜合損益按公允價值衡量之應收帳款之備抵損失如下：

110 年 12 月 31 日

預期信用損失率	未逾 0%	逾 期 1 ~ 3 0 天 0%	逾 期 逾 31 ~ 90 天 0%	逾 期 逾 91 天 0%	逾 期 以 上 0%	個 別 辨 識 合 計
總帳面金額	\$ 5,991,543	\$ 9,415	\$ 91,493	\$ 11	\$ -	\$ 6,092,462
備抵損失（存續期間 預期信用損失）	-	-	-	-	-	-
	<u>\$ 5,991,543</u>	<u>\$ 9,415</u>	<u>\$ 91,493</u>	<u>\$ 11</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6,092,462</u>

109 年 12 月 31 日

預期信用損失率	未逾 0%	逾 期 1 ~ 3 0 天 0%	逾 期 逾 31 ~ 90 天 0%	逾 期 逾 91 天 0%	逾 期 以 上 0%	個 別 辨 識 合 計
總帳面金額	\$ 613,968	\$ 9,874	\$ 2,571	\$ -	\$ -	\$ 626,413
備抵損失（存續期間 預期信用損失）	-	-	-	-	-	-
	<u>\$ 613,968</u>	<u>\$ 9,874</u>	<u>\$ 2,571</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 626,413</u>

3. 透過損益按公允價值衡量之應收帳款

本集團部分子公司將所有應收帳款以無追索權之方式讓售予銀行，且未來於讓售時將移轉應收帳款之幾乎所有風險及報酬，故將導致其自資產負債表除列。子公司管理此類應收帳款之經營模式，並非以收取合約現金流量為目的或藉由收取合約現金流量及出售金融資產達成目的，故此類應收帳款係透過損益按公允價值衡量。截至 110 年 12 月 31 日止，透過損益按公允價值衡量之應收帳款皆已以無追索權之方式讓售予銀行。

(二) 金融資產移轉資訊

本集團尚未到期之應收帳款進行讓售之相關資訊如下：

交 易 對 象	讓 售 金 額	轉 列 至 其 他 應 收 款 金 額	尚 可 預 支 金 額	已 預 支 金 額	年 利 率
110 年 12 月 31 日					
法國巴黎銀行	EUR 12,115	EUR 12,081	EUR 11,475	EUR 34	0.80%
第一銀行	\$ 8,565	\$ -	\$ -	\$ 8,565	1.95%
109 年 12 月 31 日					
法國巴黎銀行	EUR 16,691	EUR 15,315	EUR 14,481	EUR 1,376	0.80%
匯豐銀行	EUR 6,773	EUR 6,456	EUR 5,779	EUR 317	1.45%
花旗銀行	USD 94,471	USD -	USD -	USD 94,471	0.84%~0.95%
渣打銀行	USD 53,800	USD -	USD -	USD 53,800	0.91%
第一銀行	\$ 6,879	\$ -	\$ -	\$ 6,879	1.95%

依讓售合約之規定，因商業糾紛（如銷貨退回或折讓等）而產生之損失由本集團承擔，因信用風險而產生之損失則由該

銀行承擔，本集團於 110 年及 109 年 12 月 31 日已提供美金 2,000 千元之商業本票予花旗銀行用以補償可能發生之商業糾紛損失。截至合併財務報告通過發布日止，本集團並未發生重大商業糾紛，於可預見之未來亦預期不會發生重大商業糾紛。

十一、存 貨

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日 (追溯調整後)
製成品	\$ 8,454,783	\$ 8,822,632
在製品	7,950,743	6,856,405
原料	46,978,647	29,428,008
物料	3,339,042	2,691,779
在途原物料	<u>1,109,766</u>	<u>791,610</u>
	<u>\$ 67,832,981</u>	<u>\$ 48,590,434</u>

110 及 109 年度與存貨相關之營業成本分別為 458,345,579 千元及 398,068,260 千元，其中分別包括存貨減損損失 647,946 千元及 1,493,793 千元。

十二、存貨－營建房地

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
待售房地	\$ 667,630	\$ 625,791
在建房地	2,956,958	11,058,328
營建用地	<u>1,787,526</u>	<u>1,787,526</u>
	<u>\$ 5,412,114</u>	<u>\$ 13,471,645</u>

在建房地主係位於上海滬太路段及昆山利都路段；利息資本化資訊請參閱附註二五。

上海滬太路段之在建房地因自 110 年度完工並從事商場出租業務，故將原帳列存貨－營建房地項下之建築物及土地使用權轉列投資性不動產 9,722,579 千元。

截至 110 年及 109 年 12 月 31 日，預期超過 12 個月以後回收之存貨分別為 5,412,114 千元及 13,471,645 千元。

本集團設定抵押作為借款擔保之存貨－營建房地金額，請參閱附註三六。

十三、其他金融資產

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
存出保證金	\$1,007,651	\$ 516,505
質押之定期存款（附註三六）	415,065	367,550
原始到期日超過 3 個月之定期存款	60,499	35,988
其 他（附註三六）	73,765	161,957
	1,556,980	1,082,000
減：列為流動資產	140,857	551,655
列為非流動資產	<u>\$1,416,123</u>	<u>\$ 530,345</u>

十四、採用權益法之投資

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
投資關聯企業	\$ 16,824,861	\$ 12,505,232
投資合資	495,930	471,434
	<u>\$ 17,320,791</u>	<u>\$ 12,976,666</u>

（一）投資關聯企業

1. 本集團採用權益法之個別不重大關聯企業投資列示如下：

被投資公司名稱	主 要 業 務	營 運 地 點	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
焱元投資公司（焱元）	從事投資活動	台 灣	\$ 10,164,945	\$ 6,835,967
南茂科技公司（南茂）	從事半導體封裝測試業務	台 灣	2,730,466	2,405,597
M-Universe Investments Pte. Ltd. (MU)	投資公司	新 加 坡	1,859,542	1,848,588
宏璟建設公司（宏璟）	委託營造廠商興建大樓及出租業務等	台 灣	1,848,929	1,358,067
宏錦光公司（宏錦光）	經營辦公大樓及攤位出租業務	台 灣	258,757	270,087
Chipletz, Inc. (CHIPLETZ)	從事無晶圓廠基板設計	美 國	210,937	-
Deca Technologies Inc. (DECA)	控股公司，集團從事半導體封裝技術之研發	美 國	51,434	87,075
			17,125,010	12,805,381
	減：以土地作價投資之未實現利益		300,149	300,149
			<u>\$ 16,824,861</u>	<u>\$ 12,505,232</u>

2. 資產負債表日本集團各子公司對關聯企業直接持有之股權百分比合計如下：

被投資公司名稱	110年12月31日	109年12月31日
焱元	29.45%	32.21%
南茂	10.85%	10.85%
MU	42.23%	42.23%
宏璟	26.22%	26.22%
宏錦光	27.31%	27.31%
CHIPLETZ	20.82%	-
DECA	17.85%	17.85%

3. 子公司 ISE Labs, Inc.於 110 年 3 月投資美金 8,000 千元取得 CHIPLETZ 之 20.82% 股權，對 CHIPLETZ 具有重大影響力。
4. 子公司矽品於 110 年 6 月未按比例認購焱元現金增資，致使本集團對焱元持股比例降低為 29.45%。
5. 關聯企業具公開市場報價之第 1 等級公允價值資訊如下：

	110年12月31日	109年12月31日
南茂	<u>\$ 3,835,045</u>	<u>\$ 2,710,572</u>
宏璟	<u>\$ 2,141,249</u>	<u>\$ 1,317,692</u>

6. 本集團個別不重大之關聯企業之彙總性財務資訊

	110年度	109年度
本集團享有之份額		
本年度淨利	\$ 946,853	\$ 510,714
其他綜合損益	<u>3,704,445</u>	<u>2,902,824</u>
綜合損益總額	<u>\$ 4,651,298</u>	<u>\$ 3,413,538</u>

(二) 投資合資

1. 本集團採用權益法之個別不重大之合資投資列示如下：

被投資公司名稱	主要業務	營運地點	110年 12月31日	109年 12月31日
中科泓泰電子有限公司 (中科泓泰)	電子產品設計及製造	中國大陸	\$495,930	\$471,434

2. 資產負債表日本集團各子公司對合資直接持有之股權百分比合計如下：

被投資公司名稱	110年12月31日	109年12月31日
中科泓泰	49.00%	49.00%

3. 子公司環鴻昆山於108年3月與中科可控信息產業有限公司簽署合資協議共同出資成立中科泓泰，取得中科泓泰49.00%股權。依據聯合協議係由出資雙方共同主導中科泓泰相關營運活動，因此本集團對中科泓泰係採用權益法。

4. 本集團個別不重大之合資彙總性財務資訊

	110年度	109年度
本集團享有之份額		
本年度淨利	\$ 27,003	\$ 1,780
其他綜合損益	-	3,881
綜合損益總額	<u>\$ 27,003</u>	<u>\$ 5,661</u>

十五、不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備每一類別之帳面金額如下：

	110年12月31日	109年12月31日 (追溯調整後)
土地	\$ 11,530,540	\$ 10,457,960
建築物及附屬設備	79,273,937	82,813,857
機器設備	128,202,516	122,539,797
其他設備	3,928,284	4,700,318
未完工程及待驗設備	<u>16,932,273</u>	<u>13,853,465</u>
	<u>\$239,867,550</u>	<u>\$234,365,397</u>

110年度

	土	地	建	築	物	及	機	器	設	備	其	他	設	備	未	完	工	程	及	待	驗	設	備	合	計
成本																									
110年1月1日餘額(追溯調整後)	\$	10,457,960	\$	158,812,500	\$	416,368,479	\$	16,870,978	\$	13,853,465	\$	616,363,382													
增添		1,126,012		2,718,507		1,332,497		135,439		69,105,086		74,417,541													
處分	(	2,400)	(	659,833)	(	10,999,274)	(	2,144,766)	(	32,960)	(	13,839,233)													
處分子公司(附註三十)		-	(	12,344,067)	(	33,309,236)	(	1,247,326)	(	1,237,431)	(	48,138,060)													
重分類		393		5,038,562		53,856,444		1,181,455		64,884,288)		4,807,434)													
由企業合併取得(附註二九)		-		5,284		28,282		3,108		4,852		41,526													
淨兌換差額	(	51,425)	(	929,254)	(	3,788,594)	(	197,844)		123,549	(	4,843,568)													
110年12月31日餘額	\$	<u>11,530,540</u>	\$	<u>152,641,699</u>	\$	<u>423,488,598</u>	\$	<u>14,601,044</u>	\$	<u>16,932,273</u>	\$	<u>619,194,154</u>													

(接次頁)

(承前頁)

	土	地	建 築 物 及 附 屬 設 備	機 器 設 備	其 他 設 備	未 完 工 程 及 待 驗 設 備	合 計
累 計 折 舊 及 減 損							
110 年 1 月 1 日餘額	\$	-	\$ 75,998,643	\$ 293,828,682	\$ 12,170,660	\$	\$ 381,997,985
折舊費用		-	7,620,561	39,147,076	1,836,523	-	48,604,160
減損損失		-	15,915	105,815	5,036	-	126,766
處 分		-	(565,551)	(10,151,428)	(2,065,174)	-	(12,782,153)
處分子公司 (附註三十)		-	(5,369,867)	(24,974,206)	(1,100,858)	-	(31,444,931)
重 分 類		-	(3,924,490)	142,234	(18,218)	-	(3,800,474)
由企業合併取得 (附註二九)		-	241	1,067	2,452	-	3,760
淨兌換差額		-	(407,690)	(2,813,158)	(157,661)	-	(3,378,509)
110 年 12 月 31 日餘額	\$	-	\$ 73,367,762	\$ 295,286,082	\$ 10,672,760	\$	\$ 379,326,604

109 年度 (追溯調整後)

	土	地	建 築 物 及 附 屬 設 備	機 器 設 備	其 他 設 備	未 完 工 程 及 待 驗 設 備	合 計
成 本							
109 年 1 月 1 日餘額	\$	10,333,822	\$ 153,972,960	\$ 376,745,448	\$ 18,755,116	\$ 16,637,561	\$ 576,444,907
增 添		-	86,409	695,561	47,137	58,195,094	59,024,201
處 分		-	(365,758)	(12,818,849)	(2,419,423)	(126,605)	(15,730,635)
處分子公司 (附註三十)		-	(3,665,811)	(3,223,448)	(445,506)	(792,543)	(8,127,308)
重 分 類		-	7,367,875	52,980,977	222,066	(60,032,844)	538,074
由企業合併取得 (附註二九)		167,136	1,680,497	4,445,789	722,490	53,828	7,069,740
淨兌換差額	(	42,998)	(263,672)	(2,456,999)	(10,902)	(81,026)	(2,855,597)
109 年 12 月 31 日餘額	\$	10,457,960	\$ 158,812,500	\$ 416,368,479	\$ 16,870,978	\$ 13,853,465	\$ 616,363,382
累 計 折 舊 及 減 損							
109 年 1 月 1 日餘額	\$	-	\$ 68,563,380	\$ 263,748,778	\$ 12,039,422	\$	\$ 344,351,580
折舊費用		-	7,401,223	36,373,712	2,241,613	-	46,016,548
減損損失		-	-	981,535	10,738	-	992,273
處 分		-	(300,832)	(8,306,990)	(2,398,756)	-	(11,006,578)
處分子公司 (附註三十)		-	(153,002)	(345,834)	(82,059)	-	(580,895)
重 分 類		-	3,462	497,230	(188,844)	-	311,848
由企業合併取得 (附註二九)		-	548,190	3,049,895	588,935	-	4,187,020
淨兌換差額		-	(63,778)	(2,169,644)	(40,389)	-	(2,273,811)
109 年 12 月 31 日餘額	\$	-	\$ 75,998,643	\$ 293,828,682	\$ 12,170,660	\$	\$ 381,997,985

經考量未來營運計畫及現有產能規劃，本集團評估部分封裝部門及測試部門之廠房及設備不符生產需求，於 110 及 109 年度分別認列減損損失 126,766 千元及 992,273 千元，並列入其他利益及損失項下 (附註二五)。本集團評估已減損之設備之可回收金額，部分係依據當時二手市場中相似機齡及使用狀況之資產報價或與交易對手議定之處分價格減處分成本衡量，因二手市場之交易並不活絡，而處分價格係與交易對手議定，故係屬第 3 等級之公允價值。餘係以資產之使用價值衡量，本集團並預期該等資產僅具短期或無經濟效益，且折現影響並不重大。

本集團之不動產、廠房及設備係以直線基礎按下列耐用年數計提折舊：

建築物及附屬設備	
廠房主建物	10 至 55 年
無塵室工程	10 至 20 年
其 他	3 至 20 年
機器設備	2 至 10 年
其他設備	2 至 20 年

利息資本化資訊請參閱附註二五。

十六、租賃協議

(一) 使用權資產

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日 (追溯調整後)
使用權資產帳面金額		
土 地	\$ 6,093,518	\$ 5,961,974
建築物及附屬設備	3,663,682	2,548,838
機器設備	880,443	181,065
其他設備	42,619	49,930
	<u>\$ 10,680,262</u>	<u>\$ 8,741,807</u>
	110 年度	109 年度
使用權資產之增添	<u>\$ 3,239,770</u>	<u>\$ 702,996</u>
使用權資產之折舊費用		
土 地	\$ 217,674	\$ 214,682
建築物及附屬設備	509,746	370,458
機器設備	356,052	335,039
其他設備	31,478	26,701
	<u>\$ 1,114,950</u>	<u>\$ 946,880</u>

上述使用權資產相關金額，未包含符合投資性不動產定義之使用權資產。

(二) 租賃負債

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
租賃負債帳面金額		
流 動	<u>\$ 809,536</u>	<u>\$ 774,444</u>
非 流 動	<u>\$ 6,590,348</u>	<u>\$ 5,101,386</u>

本集團租賃負債主係來自土地、建築物及附屬設備，該等租賃負債之年化折現率區間如下：

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
土 地	0.54%~8.00%	0.54%~8.00%
建築物及附屬設備	0.45%~8.84%	0.54%~8.84%

(三) 重要承租活動及條款

本集團承租若干土地及建築物做為廠房及辦公室使用，土地及建築物剩餘租賃期間分別為 1~53 年及 1~29 年。位於台灣之土地租賃，租期屆滿時得予續約，政府得依該土地公告地價調整租金，並得於若干條件下終止租約。本集團對所租賃之土地及建築物並無優惠承購權，並約定未經出租人同意，不得將租賃標的之全部或一部轉租或轉讓。

(四) 轉 租

除已於附註十七「投資性不動產」說明外，本集團並無其他轉租交易。

(五) 其他租賃資訊

	110 年度	109 年度
短期租賃費用	\$ 814,235	\$ 682,142
低價值資產租賃費用	\$ 5,080	\$ 5,433
不計入租賃負債衡量中之變動		
租賃給付費	\$ 61,141	\$ 43,112
租賃之現金流出總額	\$2,909,157	\$1,854,456

本集團選擇對符合短期租賃及符合低價值資產租賃者適用認列之豁免，不對該等租賃認列相關使用權資產及租賃負債。

十七、投資性不動產

110 年度

成 本	土 地	建 築 物 及 附 屬 設 備	使 用 權 資 產	合 計
110 年 1 月 1 日餘額	\$ 35,965	\$ 7,822,805	\$ 6,738,913	\$14,597,683
處 分	-	(5,350)	-	(5,350)
處分子公司(附註三十)	-	(1,290,187)	(87,412)	(1,377,599)
重 分 類(附註十二)	(393)	9,818,133	3,398,139	13,215,879
淨兌換差額	-	30,697	(6,962)	23,735
110 年 12 月 31 日餘額	\$ 35,572	\$16,376,098	\$10,042,678	\$26,454,348

(接次頁)

(承前頁)

	土	地	建 築 物 及 附 屬 設 備	使 用 權 資 產	合 計
累 計 折 舊					
110 年 1 月 1 日餘額	\$	-	\$ 1,342,467	\$ 717,133	\$ 2,059,600
折舊費用		-	482,625	268,422	751,047
處 分		-	(3,671)	-	(3,671)
處分子公司 (附註三十)		-	(570,403)	(19,946)	(590,349)
重 分 類		-	2,014,201	78,914	2,093,115
淨兌換差額		-	6,927	(7,108)	(181)
110 年 12 月 31 日餘額	\$	-	\$ 3,272,146	\$ 1,037,415	\$ 4,309,561
110 年 12 月 31 日淨額	\$	35,572	\$ 13,103,952	\$ 9,005,263	\$ 22,144,787

109 年度

	土	地	建 築 物 及 附 屬 設 備	使 用 權 資 產	合 計
成 本					
109 年 1 月 1 日餘額	\$	35,965	\$ 7,710,369	\$ 6,567,792	\$ 14,314,126
增 添		-	6,352	-	6,352
處 分		-	(1,902)	-	(1,902)
重 分 類		-	(3,884)	46,201	42,317
淨兌換差額		-	111,870	124,920	236,790
109 年 12 月 31 日餘額	\$	35,965	\$ 7,822,805	\$ 6,738,913	\$ 14,597,683
累 計 折 舊					
109 年 1 月 1 日餘額	\$	-	\$ 972,571	\$ 487,484	\$ 1,460,055
折舊費用		-	353,048	209,212	562,260
處 分		-	(1,293)	-	(1,293)
重 分 類		-	(1,498)	10,617	9,119
淨兌換差額		-	19,639	9,820	29,459
109 年 12 月 31 日餘額	\$	-	\$ 1,342,467	\$ 717,133	\$ 2,059,600
109 年 12 月 31 日淨額	\$	35,965	\$ 6,480,338	\$ 6,021,780	\$ 12,538,083

投資性不動產中之使用權資產主係本集團以營業租賃方式轉租位於上海之土地使用權。

投資性不動產之租賃期間為 1 至 20 年，並賦予承租人展延租期之選擇權。承租人於行使續租權時，約定依市場租金行情調整租金。承租人於租賃期間結束時不具有投資性不動產之優惠承購權。

除固定租賃給付外，若干出租合約亦約定承租人每月銷售額超過一定金額後，應按特定百分比給付變動租賃給付。

以營業租賃出租投資性不動產未來將收取之租賃給付總額如下：

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
第 1 年	\$1,693,659	\$ 880,929
第 2 年	1,405,450	688,123
第 3 年	1,210,891	471,966
第 4 年	1,019,498	383,307
第 5 年	929,609	335,706
超過 5 年	<u>3,241,525</u>	<u>664,259</u>
	<u>\$9,500,632</u>	<u>\$3,424,290</u>

本集團之投資性不動產係以直線基礎按下列耐用年數計提折舊：

主 建 物	10 至 40 年
使用權資產	10 至 50 年

110 及 109 年因新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重影響市場經濟，本集團部分子公司同意無條件將租金調降，該租金減讓係於租賃期間內調整相關收入，於 110 及 109 年度之租金減讓金額分別為 3,865 千元及 54,139 千元。

投資性不動產之公允價值主係由獨立評價公司於各資產負債表日以第 3 等級輸入值衡量。該評價係採用比較法及收益法，所採用之重要不可觀察輸入值為折現率，評價所得公允價值如下：

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
公允價值	<u>\$36,158,216</u>	<u>\$19,799,714</u>

設定作為借款擔保之投資性不動產金額，請參閱附註三六。

十八、商 譽

110 年度

	成	本 累 計 減 損	帳 面 價 值
110 年 1 月 1 日餘額（追溯調整後）	\$ 54,467,361	\$ 2,414,113	\$ 52,053,248
處分子公司（附註三十）	(310,711)	-	(310,711)
淨兌換差額	(325,929)	-	(325,929)
110 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 53,830,721</u>	<u>\$ 2,414,113</u>	<u>\$ 51,416,608</u>

109 年度（追溯調整後）

	成	本	累 計 減 損	帳 面 價 值
109 年 1 月 1 日餘額	\$ 51,956,744		\$ 2,414,113	\$ 49,542,631
由企業合併取得（附註二九）	2,567,842		-	2,567,842
淨兌換差額	(57,225)		-	(57,225)
109 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 54,467,361</u>		<u>\$ 2,414,113</u>	<u>\$ 52,053,248</u>

（一）分攤商譽至現金產生單位

本集團並未基於內部管理而監管商譽，僅係為財務報導目的選擇於營運部門層級監管商譽之減損，因此於減損測試時，商譽係分攤至封裝部門、測試部門、電子組裝部門及其他部門共計四個現金產生單位群組。分攤至現金產生單位群組之商譽帳面金額如下：

現 金 產 生 單 位	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
封裝部門	\$ 34,849,069	\$ 35,140,270
測試部門	13,211,590	13,272,618
電子組裝部門（附註二九）	3,207,848	3,492,259
其 他	<u>148,101</u>	<u>148,101</u>
	<u>\$ 51,416,608</u>	<u>\$ 52,053,248</u>

（二）減損評估

本集團於各年度結束日對商譽進行減損評估，並以使用價值作為營運部門可回收金額之計算基礎。使用價值係以本集團管理階層預估未來 5 年現金流量，再使用年折現率予以計算，超過五年之現金流量以持平之成長率推估。110 年及 109 年 12 月 31 日所使用之稅前折現率分別為 10.27%~15.76%及 10.39%~14.71%。基於此分析結果，本集團 110 及 109 年度皆未認列任何商譽之減損損失。本集團用以計算營運部門使用價值之關鍵假設尚包括營收成長率，係參考本集團及相關行業增長預測及歷史經驗予以評估。

有關營運部門之使用價值評估，本集團管理階層相信前述關鍵假設之變動並無相當可能使各該營運部門之帳面金額重大超過其可回收金額。

十九、其他無形資產

其他無形資產每一類別之帳面金額如下：

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日 (追溯調整後)
客戶關係	\$ 7,990,956	\$ 9,120,300
電腦軟體	2,779,723	2,795,873
專利權及專門技術	13,730,404	15,720,213
其 他	62,624	75,385
	<u>\$ 24,563,707</u>	<u>\$ 27,711,771</u>

110 年度

	客 戶 關 係	電 腦 軟 體	專 利 權 及 專 門 技 術	其 他	合 計
成 本					
110 年 1 月 1 日餘額 (追溯調整後)	\$ 11,890,283	\$ 6,966,449	\$ 21,319,179	\$ 179,860	\$ 40,355,771
增 添	-	1,193,060	2,000	37,959	1,233,019
處分或除列	(102,637)	(150,670)	-	(71,014)	(324,321)
處分子公司 (附註三十)	-	(789,998)	(5,401)	(6,243)	(801,642)
由企業合併取得 (附註二九)	-	622	-	-	622
淨兌換差額	(83,041)	(167,769)	(537)	(7,036)	(258,383)
110 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 11,704,605</u>	<u>\$ 7,051,694</u>	<u>\$ 21,315,241</u>	<u>\$ 133,526</u>	<u>\$ 40,205,066</u>
累 計 攤 銷					
110 年 1 月 1 日餘額	\$ 2,769,983	\$ 4,170,576	\$ 5,598,966	\$ 104,475	\$ 12,644,000
攤銷費用	1,049,759	971,190	1,991,641	41,530	4,054,120
處分或除列	(102,637)	(139,907)	-	(67,741)	(310,285)
處分子公司 (附註三十)	-	(626,338)	(5,288)	(3,067)	(634,693)
由企業合併取得 (附註二九)	-	222	-	-	222
淨兌換差額	(3,456)	(103,772)	(482)	(4,295)	(112,005)
110 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 3,713,649</u>	<u>\$ 4,271,971</u>	<u>\$ 7,584,837</u>	<u>\$ 70,902</u>	<u>\$ 15,641,359</u>

109 年度 (追溯調整後)

	客 戶 關 係	電 腦 軟 體	專 利 權 及 專 門 技 術	其 他	合 計
成 本					
109 年 1 月 1 日餘額	\$ 11,000,001	\$ 4,606,878	\$ 21,318,696	\$ 68,300	\$ 36,993,875
增 添	-	951,439	171	31,045	982,655
處分或除列	-	(55,413)	-	(14,594)	(70,007)
處分子公司 (附註三十)	-	(38,125)	-	-	(38,125)
由企業合併取得 (附註二九)	885,565	1,567,508	-	114,269	2,567,342
淨兌換差額	4,717	(65,838)	312	(19,160)	(79,969)
109 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 11,890,283</u>	<u>\$ 6,966,449</u>	<u>\$ 21,319,179</u>	<u>\$ 179,860</u>	<u>\$ 40,355,771</u>
累 計 攤 銷					
109 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,666,668	\$ 2,677,339	\$ 3,600,173	\$ 25,303	\$ 7,969,483
攤銷費用	1,000,000	729,330	1,998,554	5,493	3,733,377
處分或除列	-	(47,345)	-	(5,044)	(52,389)
處分子公司 (附註三十)	-	(10,688)	-	-	(10,688)
由企業合併取得 (附註二九)	102,768	843,746	-	79,673	1,026,187
淨兌換差額	547	(21,806)	239	(950)	(21,970)
109 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 2,769,983</u>	<u>\$ 4,170,576</u>	<u>\$ 5,598,966</u>	<u>\$ 104,475</u>	<u>\$ 12,644,000</u>

上述無形資產係以直線基礎按下列耐用年數計提攤銷費用：

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
客戶關係	11 至 16 年	11 至 16 年
電腦軟體	2 至 10 年	2 至 10 年
專利權及專門技術	5 至 17 年	5 至 17 年
其 他	5 至 10 年	5 至 32 年

二十、借 款

(一) 短期借款

主係銀行週轉性借款、信用狀借款及銀行透支：

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
擔保借款－110 年及 109 年 12 月 31 日年利率均為 0.90%～1.87%	\$ 203,127	\$ 300,495
無擔保借款－110 年及 109 年 12 月 31 日年利率分別為 0.40%～3.75% 及 0.58%～3.83%	40,833,302	34,297,362
	41,036,429	34,597,857
減：避險之金融負債－流動(附註三四)	6,716,965	3,307,018
	<u>\$ 34,319,464</u>	<u>\$ 31,290,839</u>

(二) 長期借款

1. 銀行借款

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
(1) 週轉性借款		
銀行團聯貸－將於 111 年 1 月償還， 年利率 110 年及 109 年 12 月 31 日 分別為 1.08% 及 1.15%～1.17%(附註三六)	\$ 2,562,926	\$ 12,536,424

(接次頁)

(承前頁)

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
其他－將陸續於 111 年 1 月至 118 年 7 月償還，年利率 110 年及 109 年 12 月 31 日分別為 0.40%～4.00% 及 0.56%～4.15%	\$107,383,417	\$ 84,146,125
(2) 質抵押借款		
將陸續於 111 年 3 月至 122 年 12 月償還，年利率 110 年及 109 年 12 月 31 日分別為 2.32%～4.55% 及 1.90%～4.90%	8,031,142	10,813,997
	117,977,485	107,496,546
減：未攤銷發行成本	3,642	104,323
	117,973,843	107,392,223
減：一年內到期之銀行借款	4,526,683	2,250,121
避險之金融負債－流動（附註三四）	-	1,970,307
避險之金融負債－非流動（附註三四）	4,780,931	5,910,919
	<u>\$108,666,229</u>	<u>\$ 97,260,876</u>

上述部分週轉性借款尚規定子公司以經會計師查核或核閱之年度或半年度合併財務報告為計算基礎，於貸款存續期間內，應維持約定之若干財務比率，子公司均符合財務比率之約定。

2. 長期應付票券

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
中華票券金融公司，將於 112 年 3 月至 112 年 12 月償還，年利率 110 年及 109 年 12 月 31 日分別為 0.65% 及 0.65%~0.90%	\$ 2,500,000	\$ 2,000,000
大慶票券金融公司，將於 112 年 1 月至 112 年 3 月償還，年利率 110 年及 109 年 12 月 31 日分別為 0.65% 及 0.91%	2,500,000	1,000,000
兆豐票券金融公司，將於 112 年 3 月償還，年利 率 110 年及 109 年 12 月 31 日分別為 0.65% 及 0.92%~0.93%	2,000,000	2,000,000
國際票券金融公司，將於 112 年 3 月償還，年利 率 110 年 12 月 31 日 為 0.65%	1,500,000	-
	8,500,000	5,000,000
減：未攤銷折價	1,353	1,498
	<u>\$ 8,498,647</u>	<u>\$ 4,998,502</u>

二一、應付公司債

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
國內無擔保公司債		
期間 5 年，每年付息，年利率 1.30%，已於 110 年 1 月到期一 次償還	\$ -	\$ 7,000,000
期間 7 年，將於 112 年 1 月到期一 次償還，每年付息，年利率 1.50%	2,000,000	2,000,000
期間 5 年，將於 111 年 1 月到期一 次償還，每年付息，年利率 1.25%	3,700,000	3,700,000
期間 7 年，將於 113 年 1 月到期一 次償還，每年付息，年利率 1.45%	4,300,000	4,300,000

(接次頁)

(承前頁)

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
期間 5 年，將於 113 年 4 月到期一次償還，每年付息，年利率 0.90%	\$ 6,500,000	\$ 6,500,000
期間 7 年，將於 115 年 4 月到期一次償還，每年付息，年利率 1.03%	3,500,000	3,500,000
期間 5 年，將於 114 年 4 月到期一次償還，每年付息，年利率 0.90%	10,000,000	10,000,000
期間 3 年，將於 112 年 8 月到期一次償還，每年付息，年利率 0.72%	3,000,000	3,000,000
期間 5 年，將於 114 年 8 月到期一次償還，每年付息，年利率 0.85%	5,000,000	5,000,000
期間 7 年，將於 116 年 8 月到期一次償還，每年付息，年利率 0.95%	2,000,000	2,000,000
海外無擔保公司債		
美金 200,000 千元(新台幣計價)，期間 3 年，將於 111 年 10 月到期一次償還，每三個月付息，年利率 2.15%	6,204,800	6,204,800
美金 100,000 千元(新台幣計價)，期間 5 年，將於 113 年 10 月到期一次償還，每三個月付息，年利率 2.50%	3,102,400	3,102,400
海外無擔保轉換公司債		
人民幣 779,801 千元，期間 6 年，將於 116 年 3 月到期一次償還，每年付息，年利率第 1 年 0.10%、第 2 年 0.20%、第 3 年 0.60%、第 4 年 1.30%、第 5 年 1.80%、第 6 年 2.00%	3,385,381	-
	52,692,581	56,307,200
減：應付公司債折價	425,244	53,646
	52,267,337	56,253,554
減：一年內到期之應付公司債	9,902,710	6,999,951
	<u>\$ 42,364,627</u>	<u>\$ 49,253,603</u>

(一) 子公司元隆於 106 年 12 月發行國內第五次有擔保轉換公司債，發行總額計 250,000 千元，票面利率 0%，發行期限 3 年。公司債持有人有權於發行日後屆滿 3 個月之次日起至到期日止請求依當時轉換價格轉換為子公司元隆之普通股。發行時轉換價格為每股 4.8 元，後續轉換價格遇有反稀釋條款之情況，將依轉換辦法規定予以調整。109 年 9 月 30 日之轉換價格為每股 4.8 元。發行滿 3 個月之翌日起至到期日前 40 日止，若子公司元隆普通股於櫃買中心之收盤價格連續 30 個營業日超過當時轉換公司債價格達 30% 以上、或轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額 10%，子公司元隆得提前贖回部分或全部債券。子公司元隆已於 109 年 12 月償還該公司債。

(二) 子公司環旭上海於 110 年 3 月發行海外無擔保轉換公司債，發行總額計人民幣 3,450,000 千元，每張面額為人民幣 100 元。期滿後 5 個交易日內，環旭上海將按面額 108% (含最後一期利息) 的價格贖回全部未轉換的轉換公司債。

此轉換公司債於發行時，由子公司環誠及日月光半導體(上海)有限公司認購面額計人民幣 2,670,199 千元。由於該轉換公司債係屬 IFRS 9 下之混合工具，子公司環誠及日月光半導體(上海)有限公司將其分類為強制透過損益按公允價值衡量之金融資產。子公司環旭上海、環誠及日月光半導體(上海)有限公司分別對上述轉換公司債所承擔之合約義務及所享有之合約權利於經濟實質上即已消滅，本集團就子公司環誠及日月光半導體(上海)有限公司認購之部分，於編製合併財務報告時將與該轉換公司債相關之資產及負債全數沖銷。

轉換公司債持有人有權於發行結束之日起滿 9 個月後第 1 個交易日起至到期日止(轉換期間)，請求依當時轉換價格轉換為環旭上海之普通股。發行時轉換價格為每股人民幣 20.25 元，後續轉換價格遇有反稀釋條款之情況，將依轉換辦法規定予以調整，110 年 12 月 31 日轉換價格為人民幣 19.75 元，截至 110 年 12 月 31 日止，轉換公司債累計面額人民幣 26 千元已執

行轉換為環旭上海之普通股 1 千股。轉換公司債存續期間，當環旭上海普通股於上海證券交易所在任意連續 30 個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價低於當期轉換價格的 80% 時，環旭上海董事會有權提出轉換價格向下修正方案並提交環旭上海股東大會審議表決。

於轉換期間內，若環旭上海普通股於上海證券交易所連續 30 個交易日中至少有 20 個交易日的收盤價格不低於當期轉換價格的 130%（含 130%），或未轉換餘額不足人民幣 30,000 千元時，環旭上海董事會有權決定按照債券面額加計當期應計利息之價格贖回全部或部分未轉換之轉換公司債。

於最後兩個計息年度，若環旭上海普通股於上海證券交易所任何連續 30 個交易日的收盤價格低於當期轉換價格的 70% 時；或於存續期內，若根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途時，公司債持有人有權將其持有轉換公司債之全部或部分按債券面額加上當期應計利息賣回。此外，公司債持有人亦得於轉換公司債發行滿 3 年時將其持有之全部或部分按面額之 102.00%（含第三年利息）賣回。

於發行日此轉換公司債包括主債務契約（列入應付公司債項下）及轉換權（係屬子公司發行之轉換公司債權益組成部分，列入非控制權益項下）、贖回權及賣回權（列入透過損益按公允價值衡量之金融資產項下）。於本合併財務報告中，主債務契約原始認列之有效利率為 4.2989%，轉換權原始認列之金額為 404,026 千元，贖回權與賣回權原始認列之公允價值為 6,756 千元。

二二、其他應付款

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
應付設備款	\$ 13,607,664	\$10,013,971
應付薪資及獎金	12,217,011	12,448,548
應付員工酬勞及董監事酬勞	7,711,445	4,405,981
應付員工保險費	1,204,387	1,105,122
應付水電費	581,662	536,491
其 他	11,374,731	10,905,510
	<u>\$ 46,696,900</u>	<u>\$ 39,415,623</u>

二三、退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

1. 本集團中之本公司及國內子公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資 6% 提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。
2. 本集團之其他子公司，亦依當地法令規定，提撥並繳付相關單位。

(二) 確定福利計畫

1. 本集團中之本公司及國內子公司所適用我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前 6 個月平均工資計算。該等公司按員工每月薪資總額之一定比率提撥退休金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶，年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，次年度 3 月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理，本公司及國內子公司並無影響投資管理策略之權利。
2. 本集團之部份子公司依規定服務滿約定年數以上之員工於退休或離職時，得按服務年資及退休或離職時所約定薪資水準之一定比例領取退休金。

3. 日月光、矽品、台灣福雷及日月光電子另提列委任經理人退休金準備，110 及 109 年度分別認列退休金成本 32,836 千元及 11,184 千元（列入淨確定福利負債項下），110 年並支付經理人退休金 26,144 千元。截至 110 年及 109 年 12 月 31 日止，屬委任經理人之應計退休金負債分別為 369,999 千元及 346,015 千元。
4. 除經理人退休金外，本集團列入合併資產負債表之確定福利計畫金額列示如下：

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
確定福利義務之現值	\$ 11,424,860	\$ 12,159,145
計畫資產公允價值	(5,863,264)	(5,962,305)
提撥短絀	5,561,596	6,196,840
列入其他應付款	(67,524)	(102,367)
列入其他非流動資產	-	26,306
淨確定福利負債	<u>\$ 5,494,072</u>	<u>\$ 6,120,779</u>

淨確定福利負債變動如下：

	確 定 福 利 計 畫 資 產 義 務 現 值	公 允 價 值	淨 確 定 福 利 負 債 (資 產)
110 年 1 月 1 日	\$ 12,159,145	(\$ 5,962,305)	\$ 6,196,840
服務成本			
當期服務成本	173,307	-	173,307
前期服務成本及清償			
利益	(10,284)	-	(10,284)
利息費用 (收入)	78,501	(59,761)	18,740
認列於損益	<u>241,524</u>	<u>(59,761)</u>	<u>181,763</u>
再衡量數			
計畫資產報酬 (除包 含於淨利息之金額 外)	-	(42,636)	(42,636)
精算 (利益) 損失			
財務假設變動	(418,542)	-	(418,542)
經驗調整	242,896	-	242,896
人口統計假設變 動	<u>160,156</u>	<u>-</u>	<u>160,156</u>
認列於其他綜合損益	<u>(15,490)</u>	<u>(42,636)</u>	<u>(58,126)</u>
雇主提撥	-	(542,584)	(542,584)

(接 次 頁)

(承前頁)

	確 定 福 利 義 務 現 值	計 畫 資 產 公 允 價 值	淨 確 定 福 利 負 債 (資 產)
福利支付數			
計畫資產	(\$ 556,419)	\$ 562,442	\$ 6,023
雇 主	(80,603)	-	(80,603)
企業合併承擔	46,291	-	46,291
國外退休計畫之兌換差額	(369,588)	181,580	(188,008)
110 年 12 月 31 日	<u>\$11,424,860</u>	<u>(\$ 5,863,264)</u>	<u>\$ 5,561,596</u>
109 年 1 月 1 日	\$10,668,574	(\$ 5,742,178)	\$ 4,926,396
服務成本			
當期服務成本	193,693	-	193,693
前期服務成本及清償			
利益	(25,891)	-	(25,891)
利息費用 (收入)	119,314	(81,114)	38,200
認列於損益	<u>287,116</u>	<u>(81,114)</u>	<u>206,002</u>
再衡量數			
計畫資產報酬 (除包			
含於淨利息之金額			
外)	-	(109,616)	(109,616)
精算 (利益) 損失			
財務假設變動	465,433	-	465,433
經驗調整	281,661	-	281,661
人口統計假設變			
動	(36,627)	-	(36,627)
認列於其他綜合損益	<u>710,467</u>	<u>(109,616)</u>	<u>600,851</u>
雇主提撥	-	(620,433)	(620,433)
福利支付數			
計畫資產	(552,430)	603,137	50,707
雇 主	(14,520)	-	(14,520)
確定福利計畫結束退還計			
畫資產	-	11,910	11,910
企業合併承擔	1,018,480	-	1,018,480
國外退休計畫之兌換差額	41,458	(24,011)	17,447
109 年 12 月 31 日	<u>\$12,159,145</u>	<u>(\$ 5,962,305)</u>	<u>\$ 6,196,840</u>

5. 計畫資產之主要類別於資產負債表日之公允價值如下：

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
現金	\$2,267,223	\$2,236,340
權益工具	2,334,180	2,459,708
債務工具	1,039,412	1,092,115
其他	<u>222,449</u>	<u>174,142</u>
	<u>\$5,863,264</u>	<u>\$5,962,305</u>

6. 本集團因我國「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險：

(1) 投資風險

勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式，將勞工退休基金分別投資於國內（外）權益證券與債務證券及銀行存款等標的，惟本公司及國內子公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行 2 年定期存款利率計算而得之收益。

(2) 利率風險

政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加，惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加，兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。

(3) 薪資風險

確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

7. ASE (Korea) Inc. 依當地法規規定應管理基金資產及決定投資策略，並負有基金資產不足支付確定福利義務時之責任；其計畫資產係投資於銀行存單。

8. 確定福利計畫應認列之確定福利成本及淨確定福利負債係使用預計單位福利法進行精算評價。本集團之確定福利義務現值（不含經理人）係由合格精算師進行精算。衡量日之重大假設如下：

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
折 現 率	0.05%~3.31%	0.00%~2.77%
薪資預期增加率	1.00%~4.02%	1.00%~4.06%

若重大精算假設分別發生合理可能之變動，在所有其他假設維持不變之情況下，將使確定福利義務現值增加（減少）之金額如下：

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
折 現 率		
增加 0.5%	<u>(\$548,265)</u>	<u>(\$617,803)</u>
減少 0.5%	<u>\$593,980</u>	<u>\$600,451</u>
薪資預期增加率		
增加 0.5%	<u>\$538,689</u>	<u>\$611,217</u>
減少 0.5%	<u>(\$503,700)</u>	<u>(\$565,555)</u>

由於精算假設可能彼此相關，僅單一假設變動之可能性不大，故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動情形。

9. 未折現之退休金福利支付到期分析

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
1 年 內	\$ 561,812	\$ 498,092
超過 1 年但未超過 5 年	2,593,560	2,553,522
超過 5 年	<u>12,600,192</u>	<u>12,325,576</u>
	<u>\$ 15,755,564</u>	<u>\$ 15,377,190</u>

本集團於 110 年及 109 年 12 月 31 日預期 1 年內對確定福利計畫提撥之金額分別為 595,871 千元及 513,781 千元。

截至 110 年及 109 年 12 月 31 日，本集團確定福利義務平均到期期間均約為 9 年~16 年。

二四、權益

(一) 股本

普通股股本

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
額定股數 (千股)	<u>5,500,000</u>	<u>5,500,000</u>
保留股數 (千股)		
員工認股權	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>
額定股本	<u>\$ 55,000,000</u>	<u>\$ 55,000,000</u>
保留股本		
員工認股權	<u>\$ 4,000,000</u>	<u>\$ 4,000,000</u>
已發行且已收足股款之 股數 (千股)	<u>4,408,650</u>	<u>4,351,592</u>

發行海外存託憑證

本公司發行 ADR，每單位表彰本公司普通股 2 股。截至 110 年及 109 年 12 月 31 日止，流通在外之 ADR 分別為 157,164 千單位及 107,964 千單位，折合本公司普通股分別約 314,328 千股及 215,927 千股。

(二) 資本公積

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
得用以彌補虧損、發放現金 或撥充股本 (註 1)		
股票發行溢價	\$ 16,049,286	\$ 13,548,426
企業合併股本溢價	117,693,658	117,693,658
實際取得或處分子公司股 權價格與帳面價值差額	3,240,987	3,240,987
員工認股權執行	2,362,951	1,617,254
庫藏股票交易	816,186	510,449
認股權失效 (附註二八)	<u>645,903</u>	<u>645,903</u>
	<u>140,808,971</u>	<u>137,256,677</u>
僅得用以彌補虧損		
採權益法認列關聯企業資 本公積之變動數	10,706	41,239
股東逾時效未領取股利及 發放不足一元畸零現金 股利	<u>5,183</u>	<u>3,550</u>
	<u>15,889</u>	<u>44,789</u>

(接次頁)

(承前頁)

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
<u>不得作為任何用途</u>		
員工認股權	\$ 1,442,132	\$ 1,894,952
限制員工權利股票	1,193,782	-
其他(註2)	230,943	569,681
	<u>2,866,857</u>	<u>2,464,633</u>
	<u>\$ 143,691,717</u>	<u>\$ 139,766,099</u>

註1：此類資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

註2：此類資本公積係員工認股權憑證執行時，相關會計科目帳面金額超過面額部分而截至資產負債表日尚未辦妥變更登記者。

(三) 保留盈餘及股利政策

依本公司章程規定，每年度有純益時，依下列順序分派之：

1. 彌補虧損。
2. 提存百分之十為法定盈餘公積。
3. 依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
4. 其餘併同以前年度未分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議之；但盈餘分派以現金發放時，得由董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司章程規定之員工酬勞及董事酬勞分派政策，請參閱附註二五(七)員工酬勞及董事酬勞。

本公司正處於企業穩定成長階段，為因應目前及未來業務擴展之資金需求，並滿足股東對現金流入之需求，本公司之股利政策係採取剩餘股利政策分派股利，其中現金股利發放之比例不低於股利總額 30%，餘額則配發股票股利，並由董事會擬具盈餘分配案，經股東會決議後辦理。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25%之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

本公司依金管證發字第 1090150022 號令及「採用國際財務報導準則（IFRSs）後，提列特別盈餘公積之適用疑義問答」規定提列及迴轉特別盈餘公積。

本公司於 110 年 8 月及 109 年 6 月舉行股東常會分別決議 109 及 108 年度盈餘分配案如下：

	盈 餘 分 配 案		每 股 股 利 (元)	
	109 年度	108 年度	109 年度	108 年度
法定盈餘公積	\$ 2,398,814	\$ 1,697,489		
特別盈餘公積（迴轉）	(1,278,670)	3,944,915		
現金股利	<u>18,389,856</u>	<u>8,668,331</u>	\$ 4.2	\$ 2.0
	<u>\$19,510,000</u>	<u>\$14,310,735</u>		

(四) 其他權益項目

1. 國外營運機構財務報表換算之兌換差額

	110 年度	109 年度
年初餘額	(\$ 11,641,040)	(\$ 10,761,785)
當年度產生		
國外營運機構財務報表換算差額	(3,203,730)	(1,173,204)
採用權益法之關聯企業及合資之份額	21,307	101,038
重分類調整		
處分採用權益法之關聯企業及合資之份額	-	29,971
處分國外營運機構	(<u>569,284</u>)	<u>162,940</u>
年底餘額	<u>(\$ 15,392,747)</u>	<u>(\$ 11,641,040)</u>

2. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益

	110 年度	109 年度
年初餘額	\$2,501,278	(\$ 85,912)
當年度產生未實現損益		
債務工具	63,722	(2,136)
權益工具	151,413	(167,560)
採用權益法之關聯 企業及合資之份 額	3,679,745	2,774,300
重分類調整		
處分採用權益法之 關聯企業及合資 之份額	-	1,094
本年度其他綜合損益	<u>3,894,880</u>	<u>2,605,698</u>
處分權益工具累計損益 移轉至保留盈餘	33,258	16,383
採用權益法之關聯企業 及合資處分權益工具 累計損益移轉至保留 盈餘	(<u>1,525,553</u>)	(<u>34,891</u>)
年底餘額	<u>\$4,903,863</u>	<u>\$2,501,278</u>

3. 避險工具之損益－國外營運機構淨投資避險

	110 年度	109 年度
年初餘額	(\$ 429,265)	\$ -
當年度產生		
匯率風險－銀行外幣 借款	<u>551,098</u>	(<u>429,265</u>)
年底餘額	<u>\$ 121,833</u>	(<u>\$ 429,265</u>)

4. 員工未賺得酬勞

本公司於 110 年 8 月經股東會決議通過發行限制員工權利新股，相關說明請參閱附註二八。

	110 年度
年初餘額	\$ -
本年度發行	(1,343,782)
認列股份基礎給付費用	<u>178,791</u>
年底餘額	(<u>\$ 1,164,991</u>)

(五) 庫藏股票

收	回	原	因	買回以註銷 (千 股)	子 公 司 持 有 母 公 司 股 票 (千 股)	合 計 (千 股)
110 年 1 月 1 日 股 數				-	72,941	72,941
本 年 度 增 加				53,067	-	53,067
110 年 12 月 31 日 股 數				<u>53,067</u>	<u>72,941</u>	<u>126,008</u>
109 年 12 月 31 日 股 數				<u>-</u>	<u>72,941</u>	<u>72,941</u>

本公司於 110 年 11 月經董事會決議自 110 年 11 月 8 日至 111 年 1 月 7 日止，以每股 90~150 元之價格，買回本公司股份不超過 55,000 千股並辦理銷除，以維護公司信用及股東權益。當公司股價低於買回區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。截至 110 年 12 月 31 日止，本公司提前執行完畢已實際買回 55,000 千股，並分別於 110 年 12 月 31 日前及 111 年 1 月間分別交割 53,067 千股及 1,933 千股，實際買回平均價格分別為每股 104.2 元及 106.4 元。另本公司於 111 年 2 月經董事會決議以 111 年 2 月 25 日為減資基準日，辦理註銷此庫藏股票。

子公司於資產負債表日持有本公司普通股之相關資訊如下：

	持 有 股 數 (千 股)	帳 面 金 額	公 允 價 值
110 年 12 月 31 日			
ASE Test	44,100	\$ 1,380,721	\$ 4,696,675
J&R Holding	23,352	381,709	2,486,975
台灣福雷	5,489	196,677	584,620
	<u>72,941</u>	<u>\$ 1,959,107</u>	<u>\$ 7,768,270</u>
109 年 12 月 31 日			
ASE Test	44,100	\$ 1,380,721	\$ 3,585,349
J&R Holding	23,352	381,709	1,898,508
台灣福雷	5,489	196,677	446,287
	<u>72,941</u>	<u>\$ 1,959,107</u>	<u>\$ 5,930,144</u>

上述公允價值係屬具公開市場報價之第 1 等級公允價值。

本公司持有之庫藏股票，依證券交易法規定不得質押，亦不得享有股利之分派及表決權等權利。子公司持有本公司股票視同庫藏股票處理，除不得參與本公司之現金增資及無表決權外，其餘與一般股東權利相同。

(六) 非控制權益

	110 年度	109 年度 (追溯調整後)
年初餘額 (追溯調整後)	\$ 15,627,534	\$ 13,377,956
本年度淨利	2,105,901	1,683,801
本年度其他綜合損益		
國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(321,551)	178,480
透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具未實 現評價利益	50,679	1,321
避險工具之損益	187,502	(145,559)
確定福利計畫精算 損益	1,497	(9,075)
採權益法之關聯企 業其他綜合損益 之份額	7,902	-
取得或處分子公司所增 加之非控制權益 (附 註二九)	-	298
收購子公司非控制權益 (附註三一)	-	(116,738)
子公司發行新股(附註二 九)	-	1,711,453
子公司買回已發行流通 在外之股數 (附註三 一)	(2,748,521)	(2,299,533)
子公司發行之轉換公司 債權益組成部分	393,199	-
子公司員工持有之流通 在外既得認股權相關 非控制權益	314,398	1,591,904
發放予非控制權益之現 金股利	(1,062,529)	(346,774)
年底餘額	<u>\$ 14,556,011</u>	<u>\$ 15,627,534</u>

二五、稅前淨利

(一) 其他收入

	110 年度	109 年度
利息收入		
銀行存款	\$ 529,132	\$ 520,783
客戶合約	13,197	-
政府補助收入	767,918	803,049
股利收入	289,852	150,715
授權收入	135,400	-
租金收入	175,373	153,682
	<u>\$1,910,872</u>	<u>\$1,628,229</u>

(二) 其他利益及損失

	110 年度	109 年度
強制透過損益按公允價值衡量之金融工具利益	\$ 1,199,065	\$ 3,211,125
持有供交易之金融工具損失	(2,689,070)	(3,282,973)
處分子公司利益(附註三十)	17,340,418	802,753
外幣兌換利益	1,395,054	1,005,374
減損損失(附註十五)	(126,766)	(992,273)
廉價購買利益(附註二九)	33,114	-
處分不動產、廠房及設備利益	71,770	460,868
處分採用權益法之投資利益	-	91,297
其他	934,052	880,215
	<u>\$18,157,637</u>	<u>\$ 2,176,386</u>

(三) 財務成本

	110 年度	109 年度
租賃負債之利息	\$ 105,159	\$ 88,026
銀行借款及公司債利息	<u>2,790,368</u>	<u>3,498,999</u>
按攤銷後成本衡量之金融負債之利息費用總額	2,895,527	3,587,025

(接次頁)

(承前頁)

	110 年度	109 年度
減：列入符合要件資產 成本之金額		
列入存貨－營建房地 項下	(\$ 71,011)	(\$ 95,589)
列入不動產、廠房及 設備項下	(25,581)	(54,208)
	2,798,935	3,437,228
其他財務成本	32,372	22,283
	<u>\$2,831,307</u>	<u>\$3,459,511</u>

利息資本化年利率如下：

	110 年度	109 年度
存貨－營建房地	4.20%～4.35%	4.20%～4.75%
不動產、廠房及設備	0.48%～1.08%	0.49%～3.47%

(四) 折舊及攤銷

	110 年度	109 年度
不動產、廠房及設備	\$ 48,604,160	\$ 46,016,548
使用權資產	1,114,950	946,880
投資性不動產	751,047	562,260
其他無形資產	4,054,120	3,733,377
	<u>\$ 54,524,277</u>	<u>\$ 51,259,065</u>
折舊費用依功能別彙總		
營業成本	\$ 46,880,267	\$ 44,017,839
營業費用	3,589,890	3,507,849
	<u>\$ 50,470,157</u>	<u>\$ 47,525,688</u>
攤銷費用依功能別彙總		
營業成本	\$ 2,443,870	\$ 2,231,060
營業費用	1,610,250	1,502,317
	<u>\$ 4,054,120</u>	<u>\$ 3,733,377</u>

(五) 投資性不動產之直接營運費用

	110 年度	109 年度
產生租金收入之投資性 不動產之直接營運費 用	<u>\$1,422,463</u>	<u>\$1,121,854</u>

(六) 員工福利費用

	110 年度	109 年度
退職後福利		
確定提撥計畫	\$ 3,489,642	\$ 2,979,167
確定福利計畫	<u>214,599</u>	<u>217,186</u>
	3,704,241	3,196,353
權益交割之股份基礎給付	699,210	955,575
其他員工福利	<u>90,412,118</u>	<u>76,648,412</u>
	<u>\$ 94,815,569</u>	<u>\$ 80,800,340</u>
依功能別彙總		
營業成本	\$ 61,555,562	\$ 52,526,164
營業費用	<u>33,260,007</u>	<u>28,274,176</u>
	<u>\$ 94,815,569</u>	<u>\$ 80,800,340</u>

(七) 員工酬勞及董事酬勞

本公司依章程規定，皆係按當年度扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之稅前利益分別以 0.01%～1.00% 及 0.75% 以下提撥員工酬勞及董事酬勞。

	110 年度		109 年度	
	估列比例	估列金額	估列比例	估列金額
員工酬勞	0.19%	\$ 121,935	0.20%	\$ 54,909
董事酬勞	0.30%	195,095	0.40%	109,818

年度合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

本公司於 110 年 3 月及 109 年 3 月董事會分別決議以現金配發 109 及 108 年度員工酬勞及董事酬勞，其與前一年度合併財務報告認列金額之差異分別為 818 千元及 3 千元，主要係估計改變，分別調整為 110 及 109 年度之損益。

	109 年度		108 年度	
	員工酬勞	董事酬勞	員工酬勞	董事酬勞
董事會決議配發金額	<u>\$ 54,909</u>	<u>\$ 109,000</u>	<u>\$ 34,400</u>	<u>\$ 68,800</u>
年度財務報告認列金額	<u>\$ 54,909</u>	<u>\$ 109,818</u>	<u>\$ 34,400</u>	<u>\$ 68,803</u>

有關本公司董事會決議之員工酬勞及董事酬勞資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

二六、所得稅

本公司之營利事業所得稅暨未分配盈餘之結算申報係與本公司之子公司日月光、矽品及環電採行連結稅制合併辦理。

(一) 認列於損益之所得稅

所得稅費用之主要組成項目如下：

	110 年度	109 年度
當年度所得稅		
當年度產生者	\$ 14,533,570	\$ 6,807,882
未分配盈餘加徵	62,192	20,650
以前年度之調整	(<u>129,152</u>)	(<u>472,512</u>)
	<u>14,466,610</u>	<u>6,356,020</u>
遞延所得稅		
當年度產生者	(95,906)	212,338
稅率變動	18,337	-
以前年度之調整	16,625	(103,021)
兌換差額	(<u>83,840</u>)	(<u>8,438</u>)
	(<u>144,784</u>)	<u>100,879</u>
	<u>\$ 14,321,826</u>	<u>\$ 6,456,899</u>

會計所得與所得稅費用之調節如下：

	110 年度	109 年度
稅前淨利	<u>\$ 80,335,407</u>	<u>\$ 35,733,679</u>
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅費用	\$ 33,726,064	\$ 16,900,880
稅上不可減除（加計）之項目	329,608	323,643
免稅所得	(14,578,355)	(387,212)
未分配盈餘加徵	62,192	20,650
所得稅抵減	(1,654,821)	(1,191,387)
暫時性差異之產生及迴轉	78,544	(6,033,652)
以前年度所得稅調整	(112,527)	(472,512)
與投資相關且未認列遞延所得稅負債之暫時性差異	(6,135,120)	(2,616,917)

（接次頁）

(承前頁)

	110 年度	109 年度
未認列之虧損扣抵	\$ 288,025	\$ -
吸收合併子公司之已實 現投資損失	-	(138,890)
扣繳稅款	87,175	52,296
土地增值稅	117,341	-
資本利得稅	2,113,700	-
	<u>\$ 14,321,826</u>	<u>\$ 6,456,899</u>

本集團依台財稅字 10904558730 號令，將 109 年分配之股利或盈餘金額中屬因首次適用 IFRS 9 及 IFRS 15 致 107 年度產生之期初保留盈餘淨增加數者，列為 107 年度未分配盈餘之減除項目。

(二) 直接認列於權益之所得稅

	110 年度	109 年度
遞延所得稅 與員工認股權有關	(\$ 9)	(\$ 1,159)

(三) 認列於其他綜合損益之所得稅

	110 年度	109 年度
遞延所得稅 與確定福利計畫再 衡量數有關	(\$ 19,319)	\$ 114,559

(四) 本期所得稅資產與負債

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
本期所得稅資產		
應收退稅款	\$ 207,272	\$ 303,265
預付所得稅	334,908	399,555
	<u>\$ 542,180</u>	<u>\$ 702,820</u>
本期所得稅負債		
應付所得稅	<u>\$ 10,044,739</u>	<u>\$ 3,818,837</u>

(五) 遞延所得稅資產與負債

本集團將若干符合互抵條件之遞延所得稅資產及負債予以互抵。

遞延所得稅資產及負債之變動如下：

110 年度

	年 初 餘 額 (追溯調整後)	認 列 於 損 益	認 列 於 直 接 其他綜合損益	認 列 於 權 益	兌 換 差 額	處 分 子 公 司	年 底 餘 額
<u>遞 延 所 得 稅 資 產</u>							
暫時性差異							
不動產、廠房及設備	\$ 629,702	(\$ 186,443)	\$ -	\$ -	(\$ 7,178)	(\$ 345,104)	\$ 90,977
確定福利計畫	1,370,455	(115,707)	(19,319)	-	(47,276)	-	1,188,153
透過損益按公允價值衡量 之金融商品	112,259	77,593	-	-	(502)	-	189,350
其 他	2,407,910	679,492	-	(7)	52,399	(269,080)	2,870,714
	4,520,326	454,935	(19,319)	(7)	(2,557)	(614,184)	4,339,194
虧損扣抵	527,666	187,981	-	-	(31,077)	(45,788)	638,782
投資抵減	429,381	(15,549)	-	-	(22,798)	-	391,034
	<u>\$ 5,477,373</u>	<u>\$ 627,367</u>	<u>(\$ 19,319)</u>	<u>(\$ 7)</u>	<u>(\$ 56,432)</u>	<u>(\$ 659,972)</u>	<u>\$ 5,369,010</u>
<u>遞 延 所 得 稅 負 債</u>							
暫時性差異							
不動產、廠房及設備	\$ 5,980,387	\$ 165,628	\$ -	\$ -	(\$ 42,437)	(\$ 186,834)	\$ 5,916,744
透過損益按公允價值衡量 之金融商品	6,317	6,274	-	-	(11)	-	12,580
其 他	818,739	310,681	-	2	69,848	(14,065)	1,185,205
	<u>\$ 6,805,443</u>	<u>\$ 482,583</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ 27,400</u>	<u>(\$ 200,899)</u>	<u>\$ 7,114,529</u>

109 年度 (追溯調整後)

	年 初 餘 額	認 列 於 損 益	認 列 於 直 接 其他綜合損益	認 列 於 權 益	兌 換 差 額	合 併 取 得	處 分 子 公 司	年 底 餘 額
<u>遞 延 所 得 稅 資 產</u>								
暫時性差異								
不動產、廠房及設備	\$ 544,844	\$ 4,632	\$ -	\$ -	\$ 12,435	\$ 81,773	(\$ 13,982)	\$ 629,702
確定福利計畫	1,078,583	(36,633)	114,559	-	1,005	212,941	-	1,370,455
透過損益按公允價值衡量之金融商品	259,507	(138,045)	-	-	(7)	2,085	(11,281)	112,259
其 他	1,744,949	679,197	-	(999)	(45,169)	150,291	(120,359)	2,407,910
	3,627,883	509,151	114,559	(999)	(31,736)	447,090	(145,622)	4,520,326
虧損扣抵	542,781	(44,651)	-	-	(915)	183,045	(152,594)	527,666
投資抵減	537,040	(86,100)	-	-	(21,559)	-	-	429,381
	<u>\$ 4,707,704</u>	<u>\$ 378,400</u>	<u>\$ 114,559</u>	<u>(\$ 999)</u>	<u>(\$ 54,210)</u>	<u>\$ 630,135</u>	<u>(\$ 298,216)</u>	<u>\$ 5,477,373</u>
<u>遞 延 所 得 稅 負 債</u>								
暫時性差異								
不動產、廠房及設備	\$ 5,206,617	\$ 427,465	\$ -	\$ -	(\$ 29,248)	\$ 375,553	\$ -	\$ 5,980,387
透過損益按公允價值衡量之金融商品	9,192	(2,942)	-	-	67	-	-	6,317
其 他	478,304	54,755	-	160	(1,060)	287,375	(795)	818,739
	<u>\$ 5,694,113</u>	<u>\$ 479,278</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 160</u>	<u>(\$ 30,241)</u>	<u>\$ 662,928</u>	<u>(\$ 795)</u>	<u>\$ 6,805,443</u>

(六) 未於合併資產負債表中認列遞延所得稅資產之可減除暫時性差異、未使用虧損扣抵及未使用投資抵減稅額

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
虧損扣抵	\$1,340,849	\$1,497,056
投資抵減	44,244	49,611
可減除暫時性差異	241,249	377,242
	<u>\$1,626,342</u>	<u>\$1,923,909</u>

未認列之虧損扣抵將陸續至 119 年度到期。

(七) 未使用虧損扣抵與投資抵減、免稅及其他租稅減免之相關資訊

截至 110 年 12 月 31 日止，虧損扣抵相關資訊如下：

尚未扣抵稅額	最後扣抵年度
\$ 243,136	111 年
192,254	112 年
171,664	113 年
185,524	114 年
<u>1,187,051</u>	115 年及以後
<u>\$1,979,629</u>	

截至 110 年 12 月 31 日止，依各國相關租稅獎勵法規享有之投資抵減相關資訊如下：

抵減項目	尚未抵減稅額	最後抵減年度
機器設備	\$370,360	115 年
其他	<u>64,918</u>	115 年及以後
	<u>\$435,278</u>	

截至 110 年 12 月 31 日止，日月光及部分子公司之下列增資擴展產生之所得可享受 5 年免稅：

公司名稱	增資擴展案	免稅期間
台灣福雷	98 年增資擴展案	107.01~111.12

另部分中國子公司依據當地稅法規定享有高新技術企業 15% 優惠稅率及課稅所得扣除研發費用若干倍數等之所得稅優惠。

(八) 與投資相關且未認列遞延所得稅負債之暫時性差異彙總稅額

截至 110 年及 109 年 12 月 31 日止，與投資子公司相關且未認列為遞延所得稅負債之應課稅暫時性差異分別為 39,480,927 千元及 33,474,725 千元。

(九) 所得稅核定情形

本公司及台灣子公司之營利事業所得稅結算申報案件，業經台灣稅捐稽徵機關分別核定至 107 至 108 年度。

二七、每股盈餘

用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下：

本年度淨利

	110 年度	109 年度
歸屬於本公司業主之淨利	\$ 63,907,680	\$ 27,592,979
具稀釋作用潛在普通股之影響		
子公司潛在普通股之影響	(1,056,778)	(521,073)
用以計算稀釋每股盈餘之盈餘	<u>\$ 62,850,902</u>	<u>\$ 27,071,906</u>

股 數

單位：千股

	110 年度	109 年度
用以計算基本每股盈餘之普通股		
加權平均股數	4,305,348	4,265,732
具稀釋作用潛在普通股之影響		
員工認股權	58,113	22,086
員工酬勞	1,264	815
限制員工權利新股	<u>943</u>	<u>-</u>
用以計算稀釋每股盈餘之普通股		
加權平均股數	<u>4,365,668</u>	<u>4,288,633</u>

本集團得選擇以股票或現金發放員工酬勞，於計算稀釋每股盈餘時，須假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度董事會決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

二八、股份基礎給付協議

(一) 本公司員工認股權計畫

本公司及子公司日月光為吸引並留任公司所需之專業人才，激勵員工並提昇員工向心力而發行員工認股權憑證，如附註一所述，日月光於共同轉換股份協議簽署前業已發行且給與之認股權憑證自 107 年 4 月 30 日起已由本公司概括承受履行義務，並將尚未執行之每單位員工認股權憑證轉換為 0.5 單位，轉

換後每單位員工認股權得認購本公司普通股 1 股，行使價格並依換股比率調整。本公司發行及概括承受之員工認股權憑證給與對象包含本集團之全職正式員工，且存續期間為 10 年，不得轉讓，持有認股權憑證之員工自被給與後屆滿 2 年才可行使被給與之一定比例之認股權。本公司概括承受之認股權，發行後遇有本公司普通股股份發生變動時，認股權執行價格依規定公式予以調整。本公司發行之認股權憑證，發行後遇有本公司普通股股份發生變動時，或發放普通股現金股利且每股發放金額占每股時價之比率超過 1.5% 者，認股權行使價格依規定公式予以調整。

110 及 109 年度，本公司發行及概括承受之員工認股權憑證相關資訊如下：

	110 年度		109 年度	
	加 權 平 均 行 使 價 格	單 位 (千)	加 權 平 均 行 使 價 格	單 位 (千)
認 股 權 憑 證	(元)		(元)	
年初流通在外	\$ 56.9	144,767	\$ 57.0	170,786
本年度逾期失效	-	-	40.8	(1,006)
本年度沒收	52.3	(5,907)	58.0	(3,949)
本年度行使	61.4	(42,058)	49.2	(21,064)
年底流通在外	53.3	96,802	56.9	144,767
年底可行使	55.5	49,696	61.4	67,388

110 及 109 年度執行之員工認股權憑證，其於執行日之加權平均股價分別為 108.8 元及 68.5 元。

截至資產負債表日止，流通在外之員工認股權憑證相關資訊如下：

	執 行 價 格 剩 餘 合 約 之 範 圍 (元)	期 限 (年)
110 年 12 月 31 日		
日月光第 5 次員工認股權憑證	\$ 73.0	3.7
本公司第 1 次員工認股權憑證	51.0	6.9
109 年 12 月 31 日		
日月光第 4 次員工認股權憑證	45.2	0.3
日月光第 5 次員工認股權憑證	73.0	4.7
本公司第 1 次員工認股權憑證	52.9	7.9

(二) 本公司限制員工權利新股

本公司為吸引並留任本集團所需之專業人才，激勵員工及提昇員工向心力，於 110 年 8 月經股東常會決議通過發行 110 年度限制員工權利新股，並以 110 年 10 月 1 日為增資基準日發行新股 15,000 千股，每股面額 10 元，每股發行價格為新台幣 0 元（即無償發行）。給與日限制員工權利新股之公允價值為每股 92.4 元。

員工既得股份之數額採分年結算及辦理發放，自 110 年 10 月 1 日起分三個年度既得，於各年度屆滿前達到特定之績效目標後方可既得所給與股份總數之三分之一。於達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分；有關股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等權利，及其他權利包括但不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，則與本公司已發行之普通股股份相同。上述所給與之限制員工權利新股於既得條件達成前須一併交付信託。

給與限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司無償收回並予以註銷。對於未既得之限制員工權利新股所配發之股利（包括現金股利、股票股利，以及以法定公積及資本公積配發之現金及股票）及所衍生之孳息，應於該等未既得股份經本公司無償收回並辦理註銷時，由信託保管機構全數返還予本公司。

(三) 子公司員工認股權計畫

環 誠

環誠發行之員工認股權憑證之持有人於 109 年第 1 季執行轉換，致使本集團對環誠之持股比例降低，此交易並未改變本集團對子公司環誠之控制，本集團採權益交易處理之，並分別認列資本公積及保留盈餘減少 1,120,111 千元及 392,447 千元。截至 109 年 12 月 31 日止，該員工認股權已全數執行完畢。

環旭上海

環旭上海原發行之員工認股權憑證每單位得認購環旭上海普通股 1 股。該認股權憑證給與對象為該公司員工，存續期間 10 年，不得轉讓，持有認股權憑證之員工自被給與後屆滿 2 年及達到特定之績效目標後方可行使被給與之一定比例之認股權。認股權發行後，遇有環旭上海流通在外普通股股份發生變動時，認股權行使價格依規定公式予以調整。

環旭上海於 108 年 11 月發行第 1 次股票期權計畫並給與 17,167 千單位之股票期權，每單位得認購環旭上海普通股 1 股。該股票期權給與對象為該公司員工，存續期間分別為 3 年、4 年及 5 年，持有股票期權之員工自被給與後分別屆滿 2 年、3 年及 4 年且各該既得期間內達到特定之績效目標後方可於屆滿翌日起 12 個月內行使被給與之一定比例之股票期權。股票期權發行後，遇有環旭上海資本公積轉增股本、派發股票紅利、配股、派息等情事時，股票期權單位或行使價格將依規定公式予以調整。

環旭上海再於 109 年 9 月發行第 2 次股票期權計畫並給與 1,140 千單位之股票期權，發行條件與第 1 次股票期權計畫相同，惟存續期間分別為 2.2 年、3.2 年及 4.2 年，而既得期間則分別為 1.2 年、2.2 年及 3.2 年。

環旭上海發行之員工認股權憑證及股票期權計畫相關資訊如下：

	110 年度		109 年度	
	加 權 平 均 行 使 價 格	單 位 (千)	加 權 平 均 行 使 價 格	單 位 (千)
認 股 權 憑 證 單 位 (千)	(人 民 幣 元)		(人 民 幣 元)	
年初流通在外	31,266	\$ 14.6	35,077	\$ 14.5
本年度給與	-	-	1,140	21.7
本年度沒收	(952)	14.5	(636)	14.0
本年度行使	(828)	13.8	(4,315)	15.5
年底流通在外	29,486	14.2	31,266	14.6

(接 次 頁)

(承前頁)

	110 年度		109 年度	
	加 權 平 均 行 使 價 格	單 位 (千)	加 權 平 均 行 使 價 格	單 位 (千)
認 股 權 憑 證	(人 民 幣 元)		(人 民 幣 元)	
年底可行使		<u>19,249</u>		<u>13,416</u>
本年度給與之認 股權公允價值 (人 民 幣 元)	\$	<u>-</u>	\$	<u>7.03~8.93</u>

截至資產負債表日止，環旭上海發行之流通在外之員工認股權憑證相關資訊如下：

	執行價格之範圍 (人 民 幣 元)	剩 餘 合 約 期 限 (年)
110 年 12 月 31 日		
員工認股權憑證	\$ 15.5	3.9
第 1 次股票期權計畫	12.7	2.9
第 2 次股票期權計畫	21.2	2.9
109 年 12 月 31 日		
員工認股權憑證	15.5	4.9
第 1 次股票期權計畫	13.3	3.9
第 2 次股票期權計畫	21.7	3.9

(三) 子公司限制員工權利新股

環旭上海於 108 年 11 月發行第 1 次核心員工持股計畫並給與 6,156 千股，並於 109 年 4 月經董事會決議調整為給與 6,403 千股，其餘條件不變。該持股計畫自 108 年度起每一年為一期，共計三期，給與對象為該公司董事（不含獨立董事）、監事及員工。每期存續期間分別為 4.5 年、3.5 年及 2.5 年，於各期屆滿前達到特定之績效目標後方可於得認購總股數之一定比例內認購環旭上海之普通股，存續期間屆滿前 1 個月得視股票給與之情形提前終止或延長存續期間。且依據該持股計畫，每期所認購普通股之閉鎖期為 1 年。該持股計畫發行後，遇有環旭上海資本公積轉增股本、派發股票紅利、配股、派息等情事時，行使價格將依規定予以調整。

環旭上海再於 109 年 9 月發行第 2 次核心員工持股計畫並給與 425 千股，發行條件與第 1 次核心員工持股計畫相同，惟存續期間 2 年，所認購普通股之閉鎖期則為 1.3 年。

環旭上海於 110 年 9 月發行第 3 次核心員工持股計畫並給與 281 千股，給與對象為派駐海外員工。發行條件與第 2 次核心員工持股計畫相同。

環旭上海發行之限制員工權利新股相關資訊如下：

	110 年度		109 年度	
	單位 (千)	加權平均 行使價格 (人民幣元)	單位 (千)	加權平均 行使價格 (人民幣元)
限制員工權利新股				
年初流通在外	5,547	\$ 12.2	6,156	\$ 13.3
本年度給與	281	-	672	4.9
本年度行使	(1,780)	12.7	(1,281)	13.2
本年度沒收	(483)	12.1	-	-
年底流通在外	<u>3,565</u>	10.2	<u>5,547</u>	12.2
年底可行使	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
本年度給與之認股 權公允價值 (人 民幣元)	\$ <u>11.78</u>		\$ <u>18.55</u>	

截至資產負債表日止，環旭上海發行之流通在外之限制員工權利新股相關資訊如下：

	執行價格之範圍 (人民幣元)	剩餘合約期限 (年)
110 年 12 月 31 日		
第 1 次核心員工持股計畫	\$ 12.7	2.3
第 2 次核心員工持股計畫	-	0.7
第 3 次核心員工持股計畫	-	1.7
109 年 12 月 31 日		
第 1 次核心員工持股計畫	13.2	3.3
第 2 次核心員工持股計畫	-	1.7

上述員工認股權憑證經持有人行使後，致使本集團 110 及 109 年度對環旭上海之持股比例降低。此交易並未改變本集團對子公司環旭上海之控制，本集團採權益交易處理之，並分別認列資本公積增加 58,448 千元及 1,010,219 千元。

(四) 公允價值資訊

有關環旭上海於 110 及 109 年度所發行獎酬計畫於給與日之公允價值，股票期權計畫係採用三項式模型衡量，核心員工持股計畫則因考量閉鎖期而採 Black-Scholes 模型衡量，評價模型所採用之參數分別如下：

股票期權計畫

	109 年發行給與
給與日股價	人民幣 21.55 元／股
行使價格	人民幣 21.65 元／股
預期波動率	48.14%~53.57%
預期存續期間	2.2 年~4.2 年
預期股利率	-
無風險利率	2.80%~2.99%

核心員工持股計畫

	110 年發行給與	109 年發行給與	109 年修正給與
給與日股價	人民幣 14.65 元／股	人民幣 24.30 元／股	人民幣 16.60 元／股
行使價格	(註)	(註)	人民幣 13.34 元／股
預期波動率	47.15%	56.97%	57.21%
閉鎖期	1.3 年	1.3 年	1 年
預期股利率	-	-	-
無風險利率	2.34%	2.63%	1.55%

註：此核心員工持股計畫係於存續期間屆滿前達到特定績效後無償轉讓。

預期波動率係參考預期存續期間環旭上海之歷史股價波動年化標準差計算之。

本公司及子公司於 110 及 109 年度認列上述股份基礎給付計畫之酬勞成本分別為 699,210 千元及 955,575 千元。

二九、企業合併

(一) 收購子公司

子 公 司	主 要 營 運 活 動	收 購 日	收購後具表 決權之所有 權權益(%)	移 轉 對 價
FAFG	控股公司，該集團 主係從事電子產 品之設計、製造 及加工	109年12月1日	100.00	\$ 12,443,637

(接次頁)

(承前頁)

子 公 司	主 要 營 運 活 動	收 購 日	收購後具表 決權之所有 權權益(%)	移 轉 對 價
ITGEU	貿易公司	110年10月21日	100.00	\$ 50,368
SER	提供電子產品的設 計、製造加工服 務	110年11月2日	100.00	\$ 217,919

(二) 移轉對價

	ITGEU	SER	FAFG
現 金	\$ 50,368	\$ 217,919	\$ 11,094,802
發行權益工具	-	-	1,734,570
或有對價協議	-	-	(385,735)
	<u>\$ 50,368</u>	<u>\$ 217,919</u>	<u>\$ 12,443,637</u>

本集團於 109 年 12 月分別透過子公司 Universal Scientific Industrial (France) 支付 10,800,558 千元 (美金 368,753 千元) 及環旭上海發行新股 25,940 千股，完成收購法商 FAFG 100% 股權。另依據併購協議，若 FAFG 於 110 年及 111 年稅後淨利達成合約所訂定之績效目標，子公司 Universal Scientific Industrial (France) 將依約定於 112 年額外支付總計不超過美金 42,805 千元之或有對價。Universal Scientific Industrial (France) 因而於 109 年 12 月預先支付 294,244 千元 (美金 10,122 千元) 至信託帳戶中。依據或有對價公允價值的估值報告，或有對價於收購日之公允價值為 385,735 千元，Universal Scientific Industrial (France) 預計可收回信託帳戶 294,244 千元，並額外收回 91,491 千元。

子公司 ASTEELFLASH FRANCE 於 110 年 11 月收購 SER 100% 之股權，並取得對該公司之控制。子公司 ASTEELFLASH FRANCE 再於 110 年 11 月經董事會決議吸收合併 SER，合併基準日為 110 年 12 月 28 日並業已完成。

(三) 收購日取得之資產及承擔之負債

	ITGEU	SER	FAFG
資 產			
現金及約當現金	\$ 68,719	\$ 18,850	\$ 2,349,164
應收帳款及其他應收款	41,832	40,671	4,434,296
存 貨	-	375,912	4,836,819
不動產、廠房及設備	94	37,672	2,882,720
無形資產	32	368	1,541,155
其 他	2,828	186,377	1,919,118
負 債			
應付帳款及其他應付款	(29,165)	(214,883)	(4,575,720)
借款及應付公司債	-	-	(356,417)
其 他	(858)	(227,048)	(3,155,051)
取得可辨認淨資產之公允價值	<u>\$ 83,482</u>	<u>\$ 217,919</u>	<u>\$ 9,876,084</u>

(四) 非控制權益

FAFG 之非控制權益係以被收購者可辨認淨資產已認列金額所享有之比例份額衡量。

(五) 因收購產生之商譽或廉價購買利益

	ITGEU	SER	FAFG
移轉對價	\$ 50,368	\$ 217,919	\$ 12,443,637
加：非控制權益	-	-	289
減：所取得可辨認淨資產之公允價值	(83,482)	(217,919)	(9,876,084)
因收購產生之商譽（廉價購買利益）	<u>(\$ 33,114)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,567,842</u>

收購產生之商譽主要係來自控制溢價。此外，合併所支付之對價係包含預期產生之收入成長及未來市場發展。惟該等效益不符合可辨認無形資產之認列條件，故不單獨認列。

因合併所產生之商譽，預期不可作為課稅減除項目。

(六) 取得子公司之淨現金流出（入）

	ITGEU	SER	FAFG
現金支付之對價	\$ 50,368	\$ 217,919	\$ 11,094,802
減：取得子公司之現金及約當現金餘額	(68,719)	(18,850)	(2,349,164)
取得子公司之淨現金流出（入）	<u>(\$ 18,351)</u>	<u>\$ 199,069</u>	<u>\$ 8,745,638</u>

(七) 企業合併對經營成果之影響

自收購日起，來自被收購公司之經營成果如下：

	ITGEU (110年10月21日至12月31日)	SER (110年11月2日至12月31日)	FAFG (109年12月1日至12月31日)
營業收入	\$ 75,221	\$ 225,017	\$ 2,043,440
本期淨利(損)	(\$ 4,593)	(508)	\$ 91,179

倘 FAFG、ITGEU 及 SER 合併係發生於收購日所屬之會計年度開始日，110 年度本集團擬制營業收入及擬制淨利將分別為 570,363,380 千元及 66,041,297 千元。109 年度本集團擬制營業收入及擬制淨利將分別為 497,146,285 千元及 29,458,796 千元。該等金額無法反映若企業合併於收購當年度開始日完成時，本集團實際可產生之收入及營運結果，亦不應作為預測未來營運結果之用。

於編製假設本集團自收購日所屬之會計年度開始日即收購各該子公司之擬制營業收入及淨利時，應按企業合併原始會計處理時之不動產、廠房及設備及無形資產公允價值作為折舊及攤銷之計算基礎，而非依收購前財務報告認列之帳面金額計算折舊及攤銷。

(八) 截至 110 年 12 月 31 日止，本集團已完成投資成本與所享有 FAFG 可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識，並追溯調整合併財務報告。109 年 12 月 31 日合併資產負債表之調整項目如下：

合併資產負債表	追 溯 調 整 後	追 溯 調 整 前
109 年 12 月 31 日		
存 貨	\$ 48,590,434	\$ 48,516,459
透過損益按公允價值 衡量之金融資產－ 非流動	\$ 2,180,978	\$ 1,793,188
不動產、廠房及設備	\$ 234,365,397	\$ 233,207,324
使用權資產	\$ 8,741,807	\$ 8,620,612
商 譽	\$ 52,053,248	\$ 54,121,634
其他無形資產	\$ 27,711,771	\$ 26,808,668
遞延所得稅負債	\$ 6,805,443	\$ 6,235,649
非控制權益	\$ 15,627,534	\$ 15,621,578

三十、處分子公司

子公司 SPIL (Cayman) Holding Limited 董事會於 109 年 9 月決議以人民幣 966,000 千元處分子公司矽品電子（福建）有限公司（以下稱「矽電」）100%股權予深圳市海威系統有限公司，並已於 109 年 10 月完成交易並喪失控制。

本公司董事會於 110 年 12 月決議處分子公司 GAPT Holding Limited（及其子公司）及日月光昆山（以下稱「GAPT Holding 及日月光昆山」）100%股權，並已於 110 年 12 月完成交易並喪失控制。

（一）對喪失控制之資產及負債之分析

	110 年度 (GAPT Holding 及日月光昆山)	109 年度 (矽 電)
流動資產		
現金及約當現金	\$ 2,625,715	\$ 200,347
應收帳款及其他應收款	4,505,531	318,425
存 貨	2,284,880	239,865
其他流動資產	1,215,992	111,913
非流動資產		
不動產、廠房及設備	16,693,129	7,546,413
使用權資產	181,855	812,861
投資性不動產	787,250	-
商 譽	310,711	-
遞延所得稅資產	659,972	298,217
其他非流動資產	308,500	43,482
流動負債		
短期借款	(2,443,005)	-
應付帳款及其他應付款	(5,949,592)	(1,739,330)
一年內到期之長期借款	-	(1,746,000)
其他流動負債	(647,027)	(24,564)
非流動負債		
長期借款	-	(2,947,682)
遞延所得稅負債	(200,899)	(796)
租賃負債—非流動	(8,150)	-
其他非流動負債	(156,863)	-
處分之淨資產	<u>\$ 20,167,999</u>	<u>\$ 3,113,151</u>

(二) 處分子公司之利益

	110 年度 (GAPT Holding 及日月光昆山)	109 年度 (矽 電)
收取之對價 (現金)	\$ 36,939,133	\$ 4,078,844
處分子公司之淨資產	(20,167,999)	(3,113,151)
子公司之淨資產因喪失對子公司 之控制自權益重分類至損益之 累積兌換差額	569,284	(162,940)
處分利益	<u>\$ 17,340,418</u>	<u>\$ 802,753</u>

(三) 處分子公司之淨現金流入

	110 年度 (GAPT Holding 及日月光昆山)	109 年度 (矽 電)
以現金及約當現金收取之對價	\$ 36,939,133	\$ 4,078,844
減：處分之現金及約當現金餘額 其他應收款 (註) (應收取對價之尾款並扣除 相關支出)	(2,625,715) (10,533,600)	(200,347) (161,458)
	<u>\$ 23,779,818</u>	<u>\$ 3,717,039</u>

註：處分矽電之款項已於 110 年度全數收取。

三一、與非控制股權之權益交易

(一) 環旭上海

本集團之子公司環旭上海於 110 年 9 月以每股人民幣 13.86 ~14.95 元買回已發行流通在外之普通股計 16,042 千股，致本集團對子公司環旭上海之持股比例上升。此交易並未改變本集團對子公司環旭上海之控制，本集團係採權益交易處理之，並分別認列資本公積及保留盈餘減少 11,277 千元及 436,927 千元。

(二) USIPL

子公司環海電子董事會於 109 年 5 月決議以人民幣 24,500 千元購入昶虹電子(蘇州)有限公司所持有之子公司 USIPL 40% 股權。前述交易將使本集團對子公司 USIPL 之持股比例由 60% 上升至 100%，因未改變本集團對子公司之控制，故採權益交易

處理之，並於 109 年第 2 季認列資本公積減少 13,502 千元。

(三) 環 誠

109 年 9 月本集團之子公司環誠經股東會決議，以每股美金 19.47 元買回已發行流通在外之普通股計 10,308 千股，致本集團對子公司環誠之持股比例由 95.00% 上升至 99.62%。此交易並未改變本集團對子公司環誠之控制，本集團係採權益交易處理之，並於 109 年度認列資本公積及保留盈餘分別減少 780,533 千元及 2,760,175 千元。子公司環誠再於 109 年 9 月經董事會決議以 109 年 9 月 15 日為減資基準日，將其買回之股份予以註銷。

110 年 12 月本集團之子公司環誠經股東會決議，以每股美金 17.20 元買回已發行流通在外之普通股計 9,137 千股，致本集團對子公司環誠之持股比例由 95.85% 上升至 100.00%。此交易並未改變本集團對子公司環誠之控制，本集團係採權益交易處理之，並於 110 年第 4 季認列資本公積及保留盈餘分別減少 47,171 千元及 2,093,787 千元。子公司環誠再於 110 年 12 月經董事會決議以 110 年 12 月 22 日為減資基準日，將其買回之股份予以註銷。

三二、現金流量資訊

(一) 非現金交易

除其他附註所述外，本集團於 110 及 109 年度進行下列同時影響現金及非現金項目之投資活動：

	110 年度	109 年度
不動產、廠房及設備增加數	\$ 74,417,541	\$ 59,024,201
其他非流動資產增加	1,184,927	78,291
其他應付款減少（增加）	(4,671,228)	3,029,162
支付之資本化利息	(25,581)	(54,208)
購買不動產、廠房及設備支付現金數	<u>\$ 70,905,659</u>	<u>\$ 62,077,446</u>

（接次頁）

(承前頁)

	110 年度	109 年度
出售不動產、廠房及設備 價款	\$ 1,128,850	\$ 5,184,925
其他非流動資產增加	(134,760)	-
其他應收款(減少)增加	<u>610,912</u>	<u>(735,812)</u>
出售不動產、廠房及 設備收取現金數	<u>\$ 1,605,002</u>	<u>\$ 4,449,113</u>

(二)來自籌資活動之負債變動

110 年度

	短期借款 (包含避險之 金融負債)	應付公司債	長期借款 (包含避險之 金融負債)	租賃負債	合計
110年1月1日餘額	\$ 34,597,858	\$ 56,253,554	\$ 112,390,724	\$ 5,875,830	\$ 209,117,966
籌資活動之淨現金 流量	10,043,398	(3,719,057)	16,018,825	(907,403)	21,435,763
列入營業活動之利 息	-	-	-	800	800
列入營業活動之租 金	-	-	-	(184)	(184)
可轉換公司債拆分 權益組成及嵌入 非權益衍生工具 之負債組成部分	-	(399,955)	-	-	(399,955)
非現金之變動					
新增租賃	-	-	-	2,037,665	2,037,665
折價及發行成 本攤銷	-	126,283	224,979	-	351,262
子公司發行之 可轉換公司 債轉換為子 公司普通股	-	(102)	-	-	(102)
租賃修改	-	-	-	(58,799)	(58,799)
收購子公司(附 註二九)	-	-	-	180,745	180,745
處分子公司(附 註三十)	(2,443,005)	-	-	(32,655)	(2,475,660)
重分類	-	-	-	380,292	380,292
淨兌換差額	<u>(1,161,822)</u>	<u>6,614</u>	<u>(2,162,038)</u>	<u>(76,407)</u>	<u>(3,393,653)</u>
110年12月31日餘 額	<u>\$ 41,036,429</u>	<u>\$ 52,267,337</u>	<u>\$ 126,472,490</u>	<u>\$ 7,399,884</u>	<u>\$ 227,176,140</u>

109 年度

	短期借款 (包含避險之 金融負債)	應付公司債	長期借款	租賃負債	合計
109年1月1日餘額	\$ 40,572,329	\$ 36,522,155	\$ 141,078,598	\$ 5,808,924	\$ 223,982,006
籌資活動之淨現金 流量	(1,502,323)	19,717,149	(26,500,139)	(844,357)	(9,129,670)
列入營業活動之利 息	-	-	-	111	111
列入營業活動之租 金	-	-	-	(7,729)	(7,729)

(接次頁)

(承前頁)

	短期借款 (包含避險之 金融負債)	應付公司債	長期借款	租賃負債	合計
非現金之變動					
新增租賃	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 584,642	\$ 584,642
折價及發行成 本攤銷	-	14,250	156,982	-	171,232
租賃修改	-	-	-	(289,687)	(289,687)
短期借款轉列					
長期借款	(3,850,000)	-	3,850,000	-	-
政府補助貸款 利息調整	-	-	41,650	-	41,650
收購子公司(附 註二九)	356,417	-	-	633,606	990,023
處分子公司(附 註三十)	-	-	(4,693,682)	(670)	(4,694,352)
淨兌換差額	(978,565)	-	(1,542,685)	(9,010)	(2,530,260)
109年12月31日餘 額	<u>\$ 34,597,858</u>	<u>\$ 56,253,554</u>	<u>\$ 112,390,724</u>	<u>\$ 5,875,830</u>	<u>\$ 209,117,966</u>

三三、資本風險管理

本集團資本結構係由淨債務及權益組成，而資本管理的目標是保障本集團能夠持續經營，並進而藉由將債務及權益餘額最適化，以使股東報酬極大化，是以定期檢視內容包括考量各類資本之成本及相關風險，並藉由支付股利、發行新股、買回股份及發行新債或償付舊債等方式平衡其整體資本結構。

除附註二十所述外，本集團尚無其他外部資本規定。

三四、金融工具

(一) 公允價值資訊－非按公允價值衡量之金融工具

1. 帳面金額與公允價值有重大差異之金融負債

除以攤銷後成本衡量之應付公司債外，本集團管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近其公允價值。110年及109年12月31日應付公司債之帳面金額及公允價值如下：

資產負債表日	帳面金額	公允價值
110年12月31日	\$ 56,267,337	\$ 52,429,758
109年12月31日	56,253,554	56,448,769

2. 公允價值衡量層級

上述應付公司債之公允價值屬第 3 等級公允價值，係按現金流量折現分析決定之，其中重大不可觀察輸入值為反映信用風險之折現率。

(二) 公允價值資訊－以重複性基礎按公允價值衡量之金融工具

1. 公允價值層級

110 年 12 月 31 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合計
<u>透過損益按公允價值 衡量之金融資產</u>				
<u>衍生金融資產</u>				
換匯合約	\$ -	\$ 85,629	\$ -	\$ 85,629
遠期外匯合約	-	23,373	-	23,373
轉換公司債贖回與賣 回權	-	8,463	-	8,463
目標可贖回遠期契約	-	500	-	500
<u>非衍生金融資產</u>				
上市（櫃）公司普通 股	2,683,193	-	-	2,683,193
私募基金	-	-	1,322,686	1,322,686
非上市（櫃）公司特 別股	-	-	583,270	583,270
或有對價	-	-	394,943	394,943
基金受益憑證	334,223	-	-	334,223
	<u>\$3,017,416</u>	<u>\$ 117,965</u>	<u>\$2,300,899</u>	<u>\$5,436,280</u>
<u>透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產</u>				
<u>權益工具投資</u>				
非上市（櫃）公司普 通股	\$ -	\$ -	\$ 820,779	\$ 820,779
上市（櫃）公司普通 股	102,124	-	-	102,124
非上市（櫃）公司特 別股	-	-	11,245	11,245
有限合夥	-	-	9,206	9,206
<u>債務工具投資</u>				
無擔保次順位公司債	-	-	1,076,458	1,076,458
應收帳款淨額	-	-	6,092,462	6,092,462
	<u>\$ 102,124</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$8,010,150</u>	<u>\$8,112,274</u>
<u>透過損益按公允價值 衡量之金融負債</u>				
<u>衍生金融負債</u>				
換匯合約	\$ -	\$ 360,797	\$ -	\$ 360,797
遠期外匯合約	-	56,863	-	56,863
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 417,660</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 417,660</u>

109 年 12 月 31 日（追溯調整後）

	第 1 等 級	第 2 等 級	第 3 等 級	合 計
<u>透過損益按公允價值 衡量之金融資產</u>				
衍生金融資產				
遠期外匯合約	\$ -	\$ 122,511	\$ -	\$ 122,511
換匯合約	-	99,312	-	99,312
非衍生金融資產				
上市（櫃）公司普通股	4,064,438	-	-	4,064,438
私募基金	-	-	1,124,754	1,124,754
或有對價	-	-	387,790	387,790
非上市（櫃）公司特別 股	-	-	385,440	385,440
基金受益憑證	339,338	-	-	339,338
	<u>\$4,403,776</u>	<u>\$ 221,823</u>	<u>\$1,897,984</u>	<u>\$6,523,583</u>
<u>透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產</u>				
權益工具投資				
非上市（櫃）公司普通 股	\$ -	\$ -	\$ 567,377	\$ 567,377
非上市（櫃）公司特別 股	-	-	151,329	151,329
有限合夥	-	-	9,692	9,692
債務工具投資				
無擔保次順位公司債	-	-	1,012,736	1,012,736
應收帳款淨額	-	-	626,413	626,413
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$2,367,547</u>	<u>\$2,367,547</u>
<u>透過損益按公允價值 衡量之金融負債</u>				
衍生金融負債				
換匯合約	\$ -	\$1,448,972	\$ -	\$1,448,972
目標可贖回遠期契約	-	79,216	-	79,216
遠期外匯合約	-	9,020	-	9,020
	<u>\$ -</u>	<u>\$1,537,208</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$1,537,208</u>

110 及 109 年度無第 1 等級與第 2 等級公允價值衡量間
移轉之情形。

2. 金融資產以第 3 等級公允價值衡量之調節

110 年度

	透過損益按公允價值衡量 之金融資產		透過其他綜合損益 按公允價值衡量之 金融資產		合 計
金融資產	權益工具	債務工具	權益工具	債務工具	
年初餘額（追溯調整後）	\$ 1,897,984	\$ -	\$ 728,398	\$ 1,639,149	\$ 4,265,531
認列於損益	131,276	-	-	-	131,276
認列於其他綜合損益					
未實現評價利益	-	-	129,726	63,722	193,448
淨兌換差額	(79,614)	-	(4,508)	-	(84,122)
應收帳款淨增加	-	3,269,782	-	14,940,539	18,210,321
應收帳款讓售	-	(3,269,782)	-	(9,474,490)	(12,744,272)
購 買	459,046	-	32,246	-	491,292

（接次頁）

(承前頁)

	透過損益按公允價值衡量之金融資產		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		合計
	權益工具	債務工具	權益工具	債務工具	
處分	(\$ 107,793)	\$ -	(\$ 14,873)	\$ -	(\$ 122,666)
轉出第3等級	-	-	(29,758)	-	(29,758)
年底餘額	\$ 2,300,899	\$ -	\$ 841,231	\$ 7,168,920	\$ 10,311,050

109 年度

	透過損益按公允價值衡量之金融資產		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		合計
	權益工具	債務工具	權益工具	債務工具	
年初餘額	\$ 1,005,714	\$ -	\$ 755,903	\$ 3,044,562	\$ 4,806,179
認列於損益	(17,941)	-	-	-	(17,941)
認列於其他綜合損益					
未實現評價損失	-	-	(149,856)	(2,136)	(151,992)
淨兌換差額	(15,455)	-	(15,562)	-	(31,017)
應收帳款淨增加	-	370,110	-	5,635,706	6,005,816
應收帳款讓售	-	(370,110)	-	(7,038,983)	(7,409,093)
購買	893,234	-	259,168	-	1,152,402
處分	(329,370)	-	(121,255)	-	(450,625)
買權執行	(25,988)	-	-	-	(25,988)
年底餘額	\$ 1,510,194	\$ -	\$ 728,398	\$ 1,639,149	\$ 3,877,741

3. 衡量公允價值所採用之評價技術及假設

(1) 第2等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

金融工具類別	評價技術及輸入值
衍生工具－換匯合約及遠期外匯合約	現金流量折現法：按資產負債表日之可觀察遠期匯率及合約所訂匯率估計未來現金流量，並以可反映各交易對方信用風險之折現率分別折現。
衍生工具－轉換公司債贖回與賣回權	選擇權定價模式：納入現值技術並反映贖回與賣回權之時間價值及內含價值
目標可贖回遠期契約	以評價日即期匯價、選擇權執行價格、匯價波動率、合約到期期間及由合約到期期間之報價無風險利率推算。

(2) 第3等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

無活絡市場之非上市(櫃)公司普通股及特別股、有限合夥投資或私募基金係以市場法參考可比較公司之評價乘數或採資產法衡量其公允價值。所採用之重大不可觀察輸入值係流動性折減率 10%~30%。當其他輸入值維持不變之情況下，若流動性折減率增加 1%

時，該等投資於 110 年及 109 年 12 月 31 日之公允價值將分別減少約 19,300 千元及 9,700 千元。

無擔保次順位公司債之公允價值係採收益法按現金流量折現方式決定之，其中重大不可觀察輸入值為反映交易對方信用風險之折現率。當其他輸入值維持不變之情況下，若折現率增加 0.1%，將使 110 年及 109 年 12 月 31 日之公允價值分別減少約 4,000 千元及 5,000 千元。

本集團持有之透過其他綜合損益按公允價值衡量之應收帳款，其公允價值係依可反映交易對方信用風險之估計未來現金流量衡量之。因折現影響並非重大，本集團係按原始金額衡量公允價值。

或有對價之公允價值係採用蒙地卡羅模擬法估算之，估計稅後淨利未達成合約所訂定之績效目標，將依約定收回或有對價，請參閱附註二九。

(三) 金融工具之種類

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日 (追溯調整後)
<u>金 融 資 產</u>		
透過損益按公允價值衡量		
強制透過損益按公允價值衡量	\$ 5,436,280	\$ 6,523,583
按攤銷後成本衡量（註 1）	200,732,680	147,521,583
透過其他綜合損益按公允價值衡量		
權益工具投資	943,354	728,398
債務工具投資	1,076,458	1,012,736
應收帳款淨額	6,092,462	626,413
<u>金 融 負 債</u>		
透過損益按公允價值衡量		
持有供交易	417,660	1,537,208
避險之金融負債	11,497,896	11,188,244
按攤銷後成本衡量（註 2）	339,445,544	304,737,749

註 1：餘額係包含現金及約當現金、應收帳款淨額、其他應收款及其他金融資產等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註 2：餘額係包含短期借款、應付帳款、其他應付款、應付公司債及長期借款等按攤銷後成本衡量之金融負債。

(四) 財務風險管理目的與政策

本集團從事衍生金融工具交易之經營避險策略，主要係以確保公司穩健、安全經營為原則。從事衍生金融商品交易時，應依其交易目的區分為「避險性」及「非避險性」兩種交易，除依規定分別適用不同部位限制外，以避險為目的之交易其商品的選擇應以規避本集團業務經營所產生之收入、支出、資產或負債等風險為主，持有之幣別必須與公司實際進出口交易之外幣需求相符。

風險管理部門係為監督風險以減輕暴險之單位，每月就持有部位、交易餘額及損益狀況對財務長提出報告。

1. 市場風險

本集團之營運活動使本集團承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險以及利率變動風險。從事各式衍生金融工具以管理所承擔之外幣匯率及利率風險，因此匯率變動產生之損益大致會與被避險項目之損益相抵銷，而利率風險亦因預期之資金成本已固定，故市場價格風險並不重大。

本集團有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

本集團從事外幣計價之進銷貨交易及融資活動，因而產生匯率變動暴險。為避免因匯率變動造成外幣資產或負債價值波動，本集團使用衍生及非衍生金融工具來規避匯率風險。此類衍生及非衍生金融工具之使用，可協助本集團減少但仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。

本集團於資產負債表日具重大影響之非功能性貨幣計價之金融資產及負債（包含合併財務報告中已沖銷之非功能性貨幣項目）以及具匯率風險暴險之衍生工具外幣合約金額，參閱附註三九。

本集團主要受到美金及日幣兌新台幣、人民幣或歐元匯率波動之影響。本集團內部向主要管理階層報告匯率風險時所使用之敏感度比率為1%，敏感度分析之範圍包括主要之金融資產、金融負債，及集團內部交易所產生之應收應付款項。當資產負債表日美金及日幣兌新台幣、人民幣或歐元變動1%時，110及109年度稅前淨利影響數將分別約為38,000千元及35,000千元。上述稅前淨利影響數業已考量避險合約及被避險項目之影響，惟資產負債表日之外幣暴險無法反映年度中暴險情形。

避險會計

本集團之避險策略係以舉借外幣借款規避外幣權益工具投資（列入透過損益按公允價值衡量之金融資產項下）及對子公司 Universal Scientific Industrial (France)（功能性貨幣為歐元）淨投資之匯率暴險，並分別指定為公允價值避險及國外營運機構淨投資避險。避險調整數係外幣權益工具及國外營運機構評價時，將其中來自於匯率暴險之外幣兌換損益予以抵銷。

避險關係之避險無效性係來自於本集團舉借外幣借款金額與外幣權益工具投資及國外營運機構原始投資成本有重大差異所致。於避險期間並未出現避險無效性之其他來源。

110 年 12 月 31 日

避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額
／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資
公允價值避險		
銀行外幣借款／避險之金融負債－	\$ -	\$ 2,954,921
透過損益按公允價值衡量之金融資產		
國外淨投資避險	避險之金融負債－	- 3,762,044
	流動	
國外淨投資避險	避險之金融負債－	- 4,780,931
	非流動	

避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額
／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資
公允價值避險							
銀行外幣借款／透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 94,145	(\$ 94,145)	\$ -	\$ -	\$ 2,318,517	(\$ 236,362)	
國外淨投資避險	(738,600)	738,600	163,776	-	-	-	

109 年 12 月 31 日

避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額
／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資
公允價值避險		
銀行外幣借款／避險之金融負債－	\$ -	\$ 3,307,018
透過損益按公允價值衡量之金融資產		
國外淨投資避險	避險之金融負債－	- 1,970,307
	流動	
國外淨投資避險	避險之金融負債－	- 5,910,919
	非流動	

避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額	避險工具資產負債表帳面金額
／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資	／被避險項目單行項目資
公允價值避險							
銀行外幣借款／透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 157,842	(\$ 157,842)	\$ -	\$ -	\$ 2,859,132	(\$ 142,217)	
國外淨投資避險	574,824	(574,824)	(574,824)	-	-	-	

(2) 利率風險

本集團除發行固定利率之公司債及舉借固定利率之借款外，主係以浮動利率借入資金，因而產生利率

暴險，市場利率變動將使借款之有效利率隨之變動，而產生未來現金流量之波動。本集團將運用低利率之融資工具，採用有利之利率條件，以維持低融資成本及適足活絡之融資額度為主，規避營運上可能產生之利率風險。

本集團於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
具公允價值利率風險		
金融資產	\$ 5,474,105	\$ 5,049,005
金融負債	76,206,394	56,599,417
具現金流量利率風險		
金融資產	69,654,969	45,489,788
金融負債	165,557,225	131,715,366

對於浮動利率之資產及負債，本集團內部向主要管理階層報告利率風險時所使用之變動率為 100 個基點，若資產負債表日利率變動 100 個基點（1%），在所有其他變數維持不變之情況下，本集團 110 及 109 年度之稅前淨利將分別增減約 959,000 千元及 862,000 千元。上述稅前淨利影響數業已考量避險合約及被避險項目之影響，惟資產負債表日之利率暴險無法反映年度中暴險情形。

(3) 其他價格風險

本集團持有之部分透過損益按公允價值衡量之非衍生金融資產及透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資受權益價格暴險之影響。若資產負債表日權益價格變動 1%，110 及 109 年度稅前淨利將增減分別約 49,000 千元及 59,000 千元，稅前其他綜合損益皆將增減分別約 9,000 千元及 7,000 千元。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成本集團財務損失之風險。本集團之信用風險，主要係來自於現金及約當現金、應收款項、其他應收款及其他金融資產等。最大之信用風險暴險與合併資產負債表上之金融資產帳面價值相同。

110年及109年12月31日，前五大客戶之應收帳款餘額占本集團應收帳款餘額之百分比分別為33%及27%，餘因客戶群廣大且相互間無關連，故信用風險之集中度不高。

3. 流動性風險

本集團透過管理適當之營運資金及融資額度以支應集團營運及資本支出之現金流量需求，另亦監督銀行融資額度使用狀況並確保借款合約條款之遵循，故未有因無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

本集團可被要求立即清償之金融負債，係列於下表中最早之期間內，不考慮交易對手立即執行該權利之機率；其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

以浮動利率支付之利息現金流量，其未折現之利息金額係依據資產負債表日之利率做為估計未來利息現金流量之基礎。

110年12月31日

非 衍 生 金 融 負 債	要 求 即 付 或				
	短 於 1 個 月	1 至 3 個 月	3 個 月 至 1 年	1 至 5 年	超 過 5 年
無附息負債	\$ 52,353,176	\$ 48,140,652	\$ 10,216,253	\$ 291,480	\$ 114,201
租賃負債	84,978	157,710	687,144	2,585,624	4,929,602
浮動利率工具	12,565,548	5,180,527	13,416,893	112,493,242	7,494,670
固定利率工具	10,262,781	3,093,668	12,978,593	43,555,458	5,479,867
	<u>\$ 75,266,483</u>	<u>\$ 56,572,557</u>	<u>\$ 37,298,883</u>	<u>\$ 158,925,804</u>	<u>\$ 18,018,340</u>

上述金融負債到期分析之進一步資訊如下：

	短 於 1 年	1 ~ 5 年	5 ~ 10 年	10 ~ 15 年	15 ~ 20 年	20 年 以 上
租賃負債	<u>\$ 929,832</u>	<u>\$ 2,585,625</u>	<u>\$ 1,731,995</u>	<u>\$ 883,335</u>	<u>\$ 802,765</u>	<u>\$ 1,511,507</u>

109 年 12 月 31 日

非 衍 生 金 融 負 債	要 求 即 付 或				
	短 於 1 個 月	1 至 3 個 月	3 個 月 至 1 年	1 至 5 年	超 過 5 年
無附息負債	\$ 43,111,390	\$ 44,122,659	\$ 8,223,684	\$ 319,510	\$ 176,536
租賃負債	103,734	151,921	619,908	1,779,041	4,088,301
浮動利率工具	13,792,596	8,190,076	10,214,154	102,253,481	7,999,130
固定利率工具	<u>11,895,281</u>	<u>528,290</u>	<u>3,349,614</u>	<u>46,900,450</u>	<u>5,631,522</u>
	<u>\$ 68,903,001</u>	<u>\$ 52,992,946</u>	<u>\$ 22,407,360</u>	<u>\$ 151,252,482</u>	<u>\$ 17,895,489</u>

上述金融負債到期分析之進一步資訊如下：

	短 於 1 年	1 ~ 5 年	5 ~ 10 年	10 ~ 15 年	15 ~ 20 年	20 年 以 上
租賃負債	<u>\$ 875,563</u>	<u>\$ 1,779,041</u>	<u>\$ 1,422,331</u>	<u>\$ 776,735</u>	<u>\$ 674,446</u>	<u>\$ 1,214,789</u>

上述非衍生金融負債之浮動利率工具金額，將因浮動利率與資產負債表日所估計之利率不同而改變。

下表詳細說明本集團針對衍生金融工具所作之流動性分析，就採淨額交割之衍生金融工具，係以未折現之合約淨現金流入及流出為基礎編製；就採總額交割之衍生金融工具，係以未折現之總現金流入及流出為基礎編製。當應付或應收金額不固定時，揭露之金額係依資產負債表日殖利率曲線所推估之預計利率決定。

110 年 12 月 31 日

淨 額 交 割	要 求 即 付 或		
	短 於 1 個 月	1 至 3 個 月	3 個 月 至 1 年
遠期外匯合約	(\$ 21,379)	(\$ 1,410)	\$ -
總 額 交 割			
遠期外匯合約			
流 入	\$ 2,382,315	\$ 6,817,411	\$ 531,596
流 出	(2,380,359)	(6,784,689)	(525,920)
	<u>1,956</u>	<u>32,722</u>	<u>5,676</u>
換匯合約			
流 入	23,759,435	21,272,450	37,841,805
流 出	(23,814,701)	(21,314,442)	(37,965,438)
	<u>(55,266)</u>	<u>(41,992)</u>	<u>(123,633)</u>
目標可贖回遠期契約			
流 入	19,376	43,596	33,216

(接 次 頁)

(承前頁)

流 出	要 求 即 付 或		
	短 於 1 個 月	1 至 3 個 月	3 個 月 至 1 年
	(\$ 18,845)	(\$ 42,401)	(\$ 32,243)
	531	1,195	973
	(\$ 52,779)	(\$ 8,075)	(\$ 116,984)

109 年 12 月 31 日

淨 額 交 割	要 求 即 付 或			
	短 於 1 個 月	1 至 3 個 月	3 個 月 至 1 年	1 年 以 上
遠期外匯合約	\$ 30,514	\$ 18,429	\$ -	\$ -
總 額 交 割				
遠期外匯合約				
流 入	\$ 8,862,682	\$ 5,565,137	\$ 531,336	\$ -
流 出	(8,798,238)	(5,518,153)	(526,880)	-
	64,444	46,984	4,456	-
換匯合約				
流 入	\$19,311,999	\$17,179,871	\$36,739,200	\$ -
流 出	(19,524,820)	(17,486,997)	(37,495,172)	-
	(212,821)	(307,126)	(755,972)	-
目標可贖回遠期契約				
流 入	42,720	96,120	416,520	227,128
流 出	(44,471)	(100,060)	(433,595)	(236,081)
	(1,751)	(3,940)	(17,075)	(8,953)
	(\$ 150,128)	(\$ 264,082)	(\$ 768,591)	(\$ 8,953)

三五、關係人交易

本集團間之交易、帳戶餘額、收益及費損於合併時已銷除，故未揭露於本附註。本集團與其他關係人間之交易如下：

(一) 關係人之名稱及關係

除附註十四所述外，其他關係人之名稱及關係如下：

關 係 人 名 稱	與 合 併 公 司 之 關 係
財團法人日月光文教基金會（日月光文教基金會）	實質關係人
財團法人日月光環保永續基金會（日月光環保基金會）	實質關係人

(二) 對關係人之捐贈

關係人類別／名稱	110 年度	109 年度
實質關係人		
日月光文教基金會	\$ 10,000	\$ -
日月光環保基金會	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>
	<u>\$110,000</u>	<u>\$100,000</u>

(三) 子公司日月光於 110 年第 3 季向宏璟購入不動產，價款為 2,362,000 千元，係參酌獨立專業機構出具之鑑價報告議定之，且業已付訖。

(四) 子公司日月光與宏璟於 109 年 6 月依合建精神簽署合作開發契約書，約定由宏璟租地自建廠房，廠房興建完成後將由子公司日月光及其關係企業優先承購，並於購買價格中減除由專家估價之合建分配比例作為最終成交價格。

(五) 子公司日月光及日月光電子與宏璟於 110 年 8 月分別簽署合建分屋契約，約定由子公司日月光與日月光電子及宏璟分別提供部份廠房用地與承租之土地及資金，採合建分屋模式共同興建廠房，並洽專業估價機構進行合建權利價值分配比例之評估，廠房興建完成後子公司日月光與日月光電子及其關係企業對於宏璟依合建分配比例所取得之產權有優先承購權。

(六) 如附註三一所述，子公司環誠於分別於 110 年 12 月及 109 年 9 月買回已發行流通在外之普通股，其中向本集團主要管理階層買回之股數分別計 2,271 千股及 2,685 千股，計約 1,081,214 千元及 1,520,976 千元。

(七) 對主要管理階層之獎酬

	110 年度	109 年度
短期員工福利	\$1,744,903	\$1,264,980
退職後福利	3,505	2,007
股份基礎給付	<u>163,697</u>	<u>153,774</u>
	<u>\$1,912,105</u>	<u>\$1,420,761</u>

董事及其他主要管理階層之薪酬係依照個人績效及市場趨勢決定。

三六、質抵押之資產

本集團已提供下列資產，作為銀行借款之擔保品、進口原物料之關稅擔保品、履約擔保品或保證金：

	110年12月31日	109年12月31日
存貨－營建房地	\$ 2,587,110	\$ 10,564,873
不動產、廠房及設備	114,390	124,124
投資性不動產	20,796,862	11,847,145
其他金融資產（流動與非流動）	444,358	460,890
	<u>\$ 23,942,720</u>	<u>\$ 22,997,032</u>

本集團除上述資產外，於109年12月31日亦以子公司FAFG之89.6%股權質押予銀行作為銀行團聯貸之擔保。

三七、重大或有負債及未認列之合約承諾

除已於其他附註所述者外，本集團於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項：

- (一) 截至110年及109年12月31日止，本集團已開立未使用之信用狀金額分別約74,000千元及2,000千元。
- (二) 截至110年及109年12月31日止，本集團為進出口貨物需要，以銀行給予之融資額度由銀行出具保證函予海關之金額分別約738,628千元及671,721千元。
- (三) 截至110年及109年12月31日止，本集團已承諾購置之不動產、廠房及設備金額分別約52,678,554千元及32,627,411千元，其中已支付金額分別為3,761,120千元及1,968,779千元。另截至110年及109年12月31日止，本集團因房地產開發建設業務已簽約尚未支付之工程款金額分別約59千元及602,548千元。
- (四) 本集團與供應商簽訂長期原物料進貨合約，其中約定本集團需購買之相關最低數量。
- (五) 本集團與客戶簽訂長期合約，其中約定本集團需向其銷售或向供應商採購原物料之最低數量。
- (六) 本集團於110年12月經董事會決議提撥20,000千元予日月光文教基金會，以從事相關公益性文教活動，善盡企業社會責任。

(七) 本集團為善盡環境保護之社會責任，於 102 年 12 月經子公司日月光董事會決議通過預計未來將捐獻每年至少 1 億元、至少 30 年、總金額至少 30 億元以推動台灣環保相關工作。本集團已於 110 年 12 月經子公司日月光董事會決議捐贈 100,000 千元予日月光環保基金會。

三八、其 他

- (一) 本集團一大陸子公司之五名員工與廢棄物供應商於 107 年間因涉嫌違犯污染環境罪，遭當地人民檢察院起訴。於法院審理過程中，當地檢察院認為應當追加起訴單位犯罪，致該子公司於 108 年 10 月接獲當地檢察院追加、變更起訴決定書。本案已於 109 年 6 月經一審判處子公司罰金人民幣 400 千元，另追繳違法所得人民幣 344 千元，子公司已認列損失於其他利益及損失項下。本案因有共同被告上訴，依當地法令規定視為全部上訴。二審法院業於 110 年 4 月 7 日裁定上訴駁回，維持一審判決，本案終結。
- (二) 高雄市政府環境保護局（以下稱「環保局」）於 102 年 12 月 20 日以子公司日月光違反水污染防治法裁處子公司日月光 102,014 千元之罰鍰（以下稱「原處分」）。嗣子公司日月光對原處分提起行政救濟，最高行政法院於 106 年 6 月 8 日判決原處分撤銷確定，命環保局應返還子公司日月光已繳納之罰鍰，環保局於 108 年 12 月 27 日將 55,062 千元返還予子公司日月光。109 年 2 月 10 日環保局重為裁處，對子公司日月光處以 46,952 千元罰鍰（以下稱「更新處分」），並與剩餘應返還子公司日月光之 46,952 千元全額抵銷，故子公司日月光無需再行繳納更新處分之罰鍰。對於更新處分，經子公司日月光提起訴願後，高雄市政府訴願審議委員會於 109 年 12 月 15 日撤銷更新處分，命環保局另為適法之處分。

三九、具重大影響之外幣資產及負債資訊

以下資訊係按本集團各個體功能性貨幣以外之外幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重大影響之外幣資產及負債如下：

110 年 12 月 31 日		外 幣 (千 元)	匯 率	新 台 幣 (千 元)
貨幣性金融資產				
美 金		\$ 4,885,163	USD1=NTD27.68	\$ 135,221,324
美 金		1,718,314	USD1=RMB6.3757	47,562,940
美 金		42,250	USD1=EUR0.8829	1,169,492
日 幣		12,584,942	JPY1=NTD0.2405	3,026,677
日 幣		551,496	JPY1=USD0.0087	132,635
貨幣性金融負債				
美 金		4,899,633	USD1=NTD27.68	135,621,853
美 金		1,503,606	USD1=RMB6.3757	41,619,803
美 金		88,741	USD1=EUR0.8829	2,456,363
日 幣		14,078,075	JPY1=NTD0.2405	3,385,776
日 幣		990,667	JPY1=USD0.0087	238,255
109 年 12 月 31 日				
貨幣性金融資產				
美 金		4,269,075	USD1=NTD28.48	121,583,265
美 金		1,527,381	USD1=RMB6.5249	43,499,803
美 金		41,643	USD1=EUR0.8143	1,185,984
日 幣		13,544,360	JPY1=NTD0.2763	3,742,306
日 幣		1,174,208	JPY1=USD0.0097	324,434
港 幣		174,765	HKD1=NTD3.6730	641,912
貨幣性金融負債				
美 金		4,439,915	USD1=NTD28.48	126,448,786
美 金		1,517,568	USD1=RMB6.5249	43,220,325
美 金		20,896	USD1=EUR0.8143	595,128
日 幣		13,657,967	JPY1=NTD0.2763	3,773,695
日 幣		1,188,650	JPY1=USD0.0097	328,424
港 幣		18,814	HKD1=NTD3.6730	69,103

具重大影響之外幣兌換損益如下：

功 能 性 貨 幣	110 年度		109 年度	
	功 能 性 貨 幣 兒 表 達 貨 幣	淨 兒 換 (損) 益	功 能 性 貨 幣 兒 表 達 貨 幣	淨 兒 換 (損) 益
美 元	USD1=NTD27.68	\$ 132,582	USD1=NTD28.48	(\$ 143,804)
新 台 幣		1,413,969		1,382,067
人 民 幣	RMB1=NTD4.3415	(85,675)	RMB1=NTD4.3648	(181,624)
		<u>\$ 1,460,876</u>		<u>\$ 1,056,639</u>

四十、附註揭露事項

(一) 重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊

1. 資金貸與他人：詳附表一。
2. 為他人背書保證：詳附表二。
3. 年底持有有價證券情形：詳附表三。
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20%以上者：詳附表四。
5. 取得不動產之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20%以上者：詳附表五。
6. 處分不動產之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20%以上者：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣 1 億元或實收資本額 20%以上者：詳附表六。
8. 應收關係人款項達新台幣 1 億元或實收資本額 20%以上者：詳附表七。
9. 從事衍生工具交易：詳附註七。
10. 其他：母子公司間及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額：詳附表十。
11. 被投資公司資訊（對非屬大陸地區之被投資公司直接或間接具重大影響、控制或聯合控制者）：詳附表八。
12. 主要股東資訊：股權比例達 5%以上之股東名稱、持股數額及比例：詳附表十一。

(三) 大陸投資資訊

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、本期損益及認列之投資損益、年底投資帳面價值、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額：詳附表九。
2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，及其價格、付款條件、未實現損益：

- (1) 進貨金額及百分比與相關應付款項之年底餘額及百分比：詳附表六。
- (2) 銷貨金額及百分比與相關應收款項之年底餘額及百分比：詳附表六。
- (3) 財產交易金額及其所產生之損益數額：無重大交易。
- (4) 票據背書保證或提供擔保品之年底餘額及其目的：無。
- (5) 資金融通之最高餘額、年底餘額、利率區間及當期利息總額：詳附表一。
- (6) 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項，如勞務之提供或收受等：無。

四一、部門資訊

本集團應報導部門分為封裝部門、測試部門及電子組裝部門，分別從事半導體封裝服務、測試服務、電子產品、通訊產品及主機板等設計、組裝、製造及銷售等。另有未達量化門檻之其他部門，主要從事半導體材料製造及房地產開發、銷售及商場出租等業務。

本集團營運部門之會計政策與附註四所述之重要會計政策彙總說明並無重大不一致。營運部門損益係以部門稅前淨利衡量，並作為評估績效之基礎。

(一) 部門收入與營運結果

	封 裝 部 門	測 試 部 門	電 子 組 裝 部 門	其 他	調 整 及 沖 銷	合 併
110 年度						
外部客戶收入	\$ 272,543,899	\$ 49,978,736	\$ 239,488,267	\$ 7,986,231	\$ -	\$ 569,997,133
集團內部收入（註1）	7,244,889	339,619	27,825,073	7,527,260	(42,936,841)	-
部門收入	279,788,788	50,318,355	267,313,340	15,513,491	-	612,933,974
利息收入	61,141	88,874	301,072	91,242	-	542,329
利息費用	(1,604,107)	(405,648)	(629,584)	(159,596)	-	(2,798,935)
折舊與攤銷	(34,384,500)	(13,819,080)	(4,336,266)	(1,984,431)	-	(54,524,277)
採用權益法認列之關聯企業及合資之損益之份額	803,510	74,403	95,943	-	-	973,856
減損損失	(86,997)	(39,769)	-	-	-	(126,766)
部門稅前淨利	41,704,042	12,017,660	8,528,675	18,085,030	-	80,335,407
部門之資本支出	48,531,368	16,773,513	7,654,560	1,458,100	-	74,417,541
110 年 12 月 31 日						
採用權益法認列之關聯企業及合資之投資餘額	13,021,206	1,944,113	2,355,472	-	-	17,320,791
合約資產	4,735,181	872,028	-	-	-	5,607,209

109 年度	封 裝 部 門	測 試 部 門	電 子 組 裝 部 門	其 他	調 整 及 沖 銷	合 併
外部客戶收入	\$ 218,666,071	\$ 47,271,074	\$ 204,690,669	\$ 6,350,896	\$ -	\$ 476,978,710
集團內部收入（註 1）	10,436,168	435,587	21,472,775	7,234,303	(39,578,833)	-
部門收入	229,102,239	47,706,661	226,163,444	13,585,199	-	516,557,543
利息收入	133,160	79,821	275,766	32,036	-	520,783
利息費用	(2,244,280)	(564,269)	(443,519)	(185,160)	-	(3,437,228)
折舊與攤銷	(32,333,229)	(14,189,024)	(2,877,546)	(1,859,266)	-	(51,259,065)
採用權益法認列之關聯企業及合資之損益之份額	333,241	93,443	85,809	-	-	512,493
減損損失	(218,600)	(773,673)	-	-	-	(992,273)
部門稅前淨利	17,447,548	10,271,533	8,438,766	(424,168)	-	35,733,679
部門之資本支出	38,643,303	14,275,397	5,614,409	491,092	-	59,024,201
109 年 12 月 31 日						
採用權益法認列之關聯企業及合資之投資餘額	9,287,344	1,369,301	2,320,022	-	-	12,976,666
合約資產	3,641,244	1,141,660	-	-	-	4,782,904

註 1：集團內部收入業已於編製合併報告時銷除。

註 2：本集團客戶合約收入細分之商品或勞務之類型與上述部門資訊之應報導部門分類一致。

(二) 主要產品及勞務之收入

	110 年度	109 年度
封裝服務	\$272,543,899	\$218,666,071
測試服務	49,978,736	47,271,074
電子產品構裝技術暨製造服務	239,488,267	204,690,669
其他	7,986,231	6,350,896
	<u>\$569,997,133</u>	<u>\$476,978,710</u>

(三) 地區別資訊

本集團來自外部客戶之收入依客戶集團營運總部所在地區及非流動資產按資產所在地區之資訊列示如下：

1. 來自外部客戶之收入

地 區	110 年度	109 年度
美 國	\$353,500,361	\$297,117,001
台 灣	94,598,067	64,829,301
亞 洲	62,523,167	74,447,091
歐 洲	57,910,641	39,477,306
其 他	1,464,897	1,108,011
	<u>\$569,997,133</u>	<u>\$476,978,710</u>

2. 非流動資產

地 區	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日 (追溯調整後)
台 灣	\$251,869,571	\$238,698,173
中國大陸	65,375,423	66,253,694
其 他	<u>34,702,992</u>	<u>31,875,938</u>
	<u>\$351,947,986</u>	<u>\$336,827,805</u>

非流動資產不包括金融工具、退職後福利資產及遞延所得稅資產。

(四) 主要客戶資訊

除 110 及 109 年度營業收入總額中分別有 158,624,032 千元及 145,952,908 千元係來自封裝及電子組裝部門之某一客戶外，110 及 109 年度無其他來自單一客戶之營業收入達本集團收入總額之 10% 以上。

日月光投資控股股份有限公司及子公司
資金貸與他人

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表一

單位：新台幣千元

編號	貸金與他人 公司名稱	貸與對象	往來項目	是否為關係人	本半年度最高額度 \$	年 底 額 度 \$	年 底 實 際 動 支 餘 額 \$	利率區間 (%)	資金貸與性質	業務往來金額 \$	有短期融通 資金必要之原因	提列備抵呆帳金額 \$	擔 保 名 稱	品 借 價 值 \$	對 金 額 \$	象 與 對 象 期 限	貸 金 與 最 高 金 額 \$
1	日月光	本公司	其他應收款－關係人	是	20,600,000	10,000,000	-	0.77~0.79	短期融通	-	營運需要	-	-	-	\$ 58,997,490 (註1)	(註1)	58,997,490 (註2)
2	台灣瑞豐電子公司	本公司 元暨電子公司	其他應收款－關係人 其他應收款－關係人	是 是	7,650,000 100,000	4,680,000	1,325,000	0.59 3.50	短期融通 短期融通	- -	營運需要 營運需要	- -	- -	- -	11,469,166 (註1) 11,469,166 (註1)	(註1) (註1)	11,469,166 (註2) 11,469,166 (註2)
3	日月光電子公司	本公司	其他應收款－關係人	是	1,000,000	1,000,000	780,000	0.59	短期融通	-	營運需要	-	-	-	1,534,987 (註1)	(註1)	1,534,987 (註2)
4	A.S.E. Holding Limited	ASE Test Limited	長期應收款－關係人	是	1,597,960	1,503,024	1,503,024	-	短期融通	-	營運需要	-	-	-	17,568,802 (註1)	(註1)	17,568,802 (註3)
5	J&R Holding Limited	ASE Test Limited	長期應收款－關係人	是	256,815	-	-	-	短期融通	-	營運需要	-	-	-	80,292,062 (註1)	(註1)	80,292,062 (註3)
6	ASE Test Limited	日 月 光 J&R Holding Limited USI Enterprise Limited	長期應收款－關係人 長期應收款－關係人 其他應收款－關係人	是 是 是	9,778,560 3,892,000 6,200,460	1,503,024 3,875,200 4,290,400	- 3,847,520 4,124,320	0.59~0.68 0.49 0.48~1.09	短期融通 短期融通 短期融通	- - -	營運需要 營運需要 營運需要	- - -	- - -	- - -	30,002,498 (註1) 30,002,498 (註1) 30,002,498 (註1)	(註1) (註1) (註1)	30,002,498 (註3) 30,002,498 (註3) 30,002,498 (註3)
7	Global Advanced Packaging Technology Limited	日 月 光 USI Enterprise Limited	長期應收款－關係人 其他應收款－關係人	是 是	885,760 2,768,000	885,760 2,768,000	885,760 2,768,000	- -	短期融通 短期融通	- -	營運需要 營運需要	- -	- -	- -	45,938,092 (註1) 45,938,092 (註1)	(註1) (註1)	45,938,092 (註3) 45,938,092 (註3)
8	ISE Labs, Inc.	日 月 光 ASE Test Limited	長期應收款－關係人 其他應收款－關係人/長期應收款－關係人	是 是	856,050 567,800	830,400 332,160	830,400 332,160	0.60~0.68 0.57~0.64	短期融通 短期融通	- -	營運需要 營運需要	- -	- -	- -	2,397,139 (註1) 2,397,139 (註1)	(註1) (註1)	2,397,139 (註3) 2,397,139 (註3)
9	ASE (Korea) Inc.	日 月 光	其他應收款－關係人	是	8,201,000	8,165,600	8,027,200	2.08~2.14	短期融通	-	營運需要	-	-	-	17,837,225 (註1)	(註1)	17,837,225 (註3)
10	ASE Japan Co., Ltd.	日 月 光 ASE Test Limited ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	其他應收款－關係人 其他應收款－關係人 其他應收款－關係人	是 是 是	814,800 353,080 51,060	481,000 - 48,100	481,000 - 48,100	0.53~0.54 0.48~0.49 0.48~0.49	短期融通 短期融通 短期融通	- - -	營運需要 營運需要 營運需要	- - -	- - -	- - -	1,801,539 (註1) 1,801,539 (註1) 1,801,539 (註1)	(註1) (註1) (註1)	1,801,539 (註3) 1,801,539 (註3) 1,801,539 (註3)
11	ASE Singapore Pte. Ltd.	日 月 光	其他應收款－關係人/長期應收款－關係人	是	1,483,820	-	-	0.60~0.68	短期融通	-	營運需要	-	-	-	6,265,794 (註1)	(註1)	6,265,794 (註3)
12	ASE (U.S) Inc.	ASE Test Limited J&R Holding Limited	長期應收款－關係人 長期應收款－關係人	是 是	798,980 1,195,400	498,240 1,190,240	498,240 1,190,240	0.48~0.54 0.49	短期融通 短期融通	- -	營運需要 營運需要	- -	- -	- -	6,265,794 (註1) 6,265,794 (註1)	(註1) (註1)	6,265,794 (註3) 6,265,794 (註3)
13	日月光半導體 (昆山)有限公司 (註15)	日月光投資 (昆山) 有限公司 矽品科技(蘇州) 有限公司 蘇州日月新半導體 有限公司 (註15)	其他應收款－關係人 其他應收款－關係人 其他應收款－關係人	是 是 是	1,994,745 1,974 1,096,834	193,760 - -	193,760 - -	0.60~0.68 2.90 3.24	短期融通 短期融通 短期融通	- - -	營運需要 營運需要 營運需要	- - -	- - -	- - -	577,619 (註1) 6,100,524 (註1) 6,100,524 (註1)	(註1) (註1) (註1)	577,619 (註3) 6,100,524 (註3) 6,100,524 (註3)
14	上海鼎匯房地產開發有限公司	上海鼎匯房地產開發有限公司 上海鼎匯房地產開發有限公司 上海鼎匯置業發展有限公司 昆山鼎匯房地產開發有限公司 日月光封裝測試 (上海) 有限公司	其他應收款－關係人 其他應收款－關係人 其他應收款－關係人 其他應收款－關係人 其他應收款－關係人	是 是 是 是 是	438,733 3,704,110 131,020 348,022 1,307,333	434,148 1,953,668 130,245 347,319 1,302,445	434,148 1,953,668 130,245 347,319 -	4.35 4.35 4.35 4.35 4.90	短期融通 短期融通 短期融通 短期融通 短期融通	- - - - -	營運需要 營運需要 營運需要 營運需要 營運需要	- - - - -	- - - - -	- - - - -	19,472,095 (註1) 19,472,095 (註1) 19,472,095 (註1) 19,472,095 (註1) 19,472,095 (註1)	(註1) (註1) (註1) (註1) (註1)	19,472,095 (註3) 19,472,095 (註3) 19,472,095 (註3) 19,472,095 (註3) 19,472,095 (註3)
15	日月光集成電路製造 (中國) 有限公司	矽品科技(蘇州) 有限公司 蘇州日月新半導體有限公司 (註15)	其他應收款－關係人 其他應收款－關係人	是 是	1,797,705 87,747	913,440 -	913,440 -	0.54~0.68 3.20	短期融通 短期融通	- -	營運需要 營運需要	- -	- -	- -	3,025,109 (註1) 3,025,109 (註1)	(註1) (註1)	3,025,109 (註3) 3,025,109 (註3)

(接次頁)

(承前頁)

編號	貸 金 公 司 名 稱	貸 金 與 他 人 者	貸 金 與 對 象	往 來 表 項 目	是否為關係人	本 年 度 最 高 額 度 餘 額	年 底 額 度 餘 額	年 底 實 際 動 支 餘 額	利率區間 (%)	資金管見性質	票 務 往 來 金 額	有 組 期 融 通 資 金 必 要 之 原 因	提 別 備 註 票 務 金 額	擔 保 條 件	品 對 價 金	細 別 對 象 限 期 限	資 金 貨 與 最 額
			日 月 光 科 技 (港 山) 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	2,048	2,040	2,040	3.00	短期融通	\$ -	資金需要	\$ -	-	\$ -	3,025,109 (註3)	\$ 3,025,109 (註3)
			日 月 光 科 技 測 試 (上 海) 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	1,307,333	1,302,445	1,202,591	3.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	3,025,109 (註3)	3,025,109 (註3)
16	日 月 光 半 導 體 (蘇 州) 有 限 公 司 (註 5)	砂 品 科 技 (蘇 州) 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	1,623,314	-	-	-	3.24	短期融通	-	營運需要	-	-	-	4,476,325 (註3)	4,476,325 (註3)
			蘇 州 日 月 新 半 導 體 有 限 公 司 (註 5)	其他應收款－關係人	是	1,960,999	1,953,668	1,758,301	3.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	4,476,325 (註3)	4,476,325 (註3)
17	日 榮 半 導 體 (上 海) 有 限 公 司 (註 5)	日 月 光 半 導 體 (上 海) 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	175,493	-	-	-	3.20	短期融通	-	營運需要	-	-	-	3,671,567 (註3)	3,671,567 (註3)
			日 月 光 科 技 測 試 (上 海) 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	1,575,053	-	-	2.85	短期融通	-	營運需要	-	-	-	3,671,567 (註3)	3,671,567 (註3)
			蘇 州 日 月 新 半 導 體 有 限 公 司 (註 5)	其他應收款－關係人	是	2,091,733	2,083,912	1,845,131	3.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	3,671,567 (註3)	3,671,567 (註3)
18	無 錫 通 微 電 子 有 限 公 司	日 月 光 科 技 測 試 (上 海) 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	217,889	217,074	195,367	-	3.69	短期融通	-	營運需要	-	-	-	402,711 (註3)	402,711 (註3)
19	USI Enterprise Limited	日 月 光 環 旭 電 子 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	4,826,300	2,491,200	-	-	0.60-0.68	短期融通	-	營運需要	-	-	-	19,631,795 (註1)	19,631,795 (註2)
			環 旭 電 子 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	3,337,200	1,660,800	1,660,800	0.60-0.68	短期融通	-	營運需要	-	-	-	19,631,795 (註1)	19,631,795 (註2)
20	Huntington Holdings International Co. Ltd.	日 月 光 環 旭 電 子 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	170,340	-	-	-	-	短期融通	-	營運需要	-	-	-	20,337,305 (註1)	20,337,305 (註2)
21	Real Tech Holdings Limited	日 月 光 環 旭 電 子 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	1,476,280	-	-	-	-	短期融通	-	營運需要	-	-	-	20,138,244 (註1)	20,138,244 (註2)
			USI Enterprise Limited	其他應收款－關係人	是	1,483,320	1,079,520	1,079,520	-	短期融通	-	營運需要	-	-	-	20,138,244 (註1)	20,138,244 (註2)
22	環 旭 電 子 (深 圳) 有 限 公 司	環 旭 電 子 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	3,427,320	888,297	-	-	0.60-1.75	短期融通	-	營運需要	-	-	-	2,407,482 (註1)	2,407,482 (註2)
23	Universal Global Technology Co., Limited	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	其他應收款－關係人	是	1,426,750	1,107,200	1,107,200	-	0.53-0.60	短期融通	-	營運需要	-	-	-	22,211,955 (註3)	22,211,955 (註3)
			環 旭 科 技 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	2,980,950	553,600	553,600	0.60-0.68	短期融通	-	營運需要	-	-	-	8,884,782 (註1)	8,884,782 (註2)
			環 旭 電 子 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	1,537,800	1,522,400	1,522,400	0.60-0.64	短期融通	-	營運需要	-	-	-	8,884,782 (註1)	8,884,782 (註2)
			Universal Scientific Industrial (France)	其他應收款－關係人	是	1,716,391	1,661,570	1,661,570	0.60	短期融通	-	營運需要	-	-	-	22,211,955 (註3)	22,211,955 (註3)
			ASTELFLASH USA CORP. ASTELFLASH GROUP	其他應收款－關係人	是	279,600	276,800	193,760	0.69-0.72	短期融通	-	營運需要	-	-	-	22,211,955 (註3)	22,211,955 (註3)
			ASTELFLASH GROUP	長期應收款－關係人	是	2,499,615	2,499,615	1,245,600	1.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	22,211,955 (註3)	22,211,955 (註3)
24	環 旭 電 氣 有 限 公 司	環 旭 科 技 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	1,100,000	900,000	900,000	-	0.59	短期融通	-	營運需要	-	-	-	1,311,996 (註1)	1,311,996 (註2)
25	環 旭 電 子 (上 海) 有 限 公 司	Universal Global Technology Co., Limited	其他應收款－關係人	是	1,220,770	-	-	-	0.60	短期融通	-	營運需要	-	-	-	3,124,026 (註1)	3,124,026 (註2)
			環 旭 電 子 子 公 司	其他應收款－關係人	是	1,284,075	1,107,200	-	0.60	短期融通	-	營運需要	-	-	-	3,124,026 (註1)	3,124,026 (註2)
			環 旭 電 子 (港 山) 有 限 公 司	其他應收款－關係人	是	871,555	868,297	868,297	1.75	短期融通	-	營運需要	-	-	-	3,124,026 (註1)	3,124,026 (註2)
26	環 旭 電 子 子 公 司	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	其他應收款－關係人	是	1,426,750	1,384,000	-	-	0.53-0.55	短期融通	-	營運需要	-	-	-	22,734,486 (註1)	22,734,486 (註2)
			Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited	其他應收款－關係人	是	2,282,800	2,214,400	1,882,240	0.51-0.52	短期融通	-	營運需要	-	-	-	22,734,486 (註1)	22,734,486 (註2)
27	Universal Scientific Industrial (France)	ASTELFLASH HERSFELD GmbH	長期應收款－關係人	是	343,700	313,504	285,288	-	1.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	10,480,877 (註3)	10,480,877 (註3)
			ASTELFLASH FRANCE	其他應收款－關係人	是	777,234	736,734	736,734	1.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	4,192,351 (註1)	4,192,351 (註2)
			ASTELFLASH TUNISE S.A.	其他應收款－關係人/長期應收款－關係人	是	453,386	438,905	398,150	1.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	10,480,877 (註3)	10,480,877 (註3)
			ASTELFLASH FLZEN S.R.O.	長期應收款－關係人	是	103,110	94,051	94,051	1.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	10,480,877 (註3)	10,480,877 (註3)

(接次頁)

(承前頁)

編號	資金貸與他人者 公司名稱	貸與對象	往來項目	是否為關係人	本年度最高額度餘額 \$	本年度實際動支餘額 \$	利率區間(%)	資金貸與性質	業務往來金額 \$	有短期融通 資金必要之原因	擔保 名稱	品評價值	個別對價金額	集資期限	資金貸與最高額
28	ASTEELFLASH GROUP	ASTEELFLASH (BEDFORD) LIMITED	其他應收款－關係人	是	140,753	126,537	1.25~1.75	短期融通	-	營業週轉	-	-	1,930,776 (註1)	\$	1,930,776 (註2)
		ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	其他應收款－關係人	是	652,270	595,657	1.25~1.75	短期融通	-	營業週轉	-	-	1,930,776 (註1)		1,930,776 (註2)
		ASTEELFLASH GERMANY GmbH	其他應收款－關係人	是	206,220	28,215	1.00~1.75	短期融通	-	營業週轉	-	-	1,930,776 (註1)		1,930,776 (註2)
		ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.	其他應收款－關係人	是	191,237	191,237	1.00	短期融通	-	營業週轉	-	-	1,930,776 (註1)		1,930,776 (註2)
		ASTEELFLASH EBERBACH GmbH	其他應收款－關係人	是	109,726	109,726	1.00	短期融通	-	營業週轉	-	-	1,930,776 (註1)		1,930,776 (註2)
29	FINANCIERE AFG	ASTEELFLASH BONN GmbH	其他應收款－關係人	是	47,026	47,026	1.00	短期融通	-	營業週轉	-	-	1,930,776 (註1)		1,930,776 (註2)
		ASTEELFLASH GROUP	其他應收款－關係人	是	102,293	65,090	1.25~1.75	短期融通	-	營運需要	-	-	3,024,728 (註1)		3,024,728 (註2)
		ASTEELFLASH GROUP SER(註6)	其他應收款－關係人	是	273,264	249,256	1.25	短期融通	-	營運需要	-	-	727,213 (註1)		727,213 (註2)
		ASTEELFLASH FRANCE	其他應收款－關係人	是	442,248	-	1.00	短期融通	-	營運需要	-	-	727,213 (註1)		727,213 (註2)
		ASTEELFLASH TECHNOLOGIE	其他應收款－關係人	是	51,555	-	1.25	短期融通	-	營運需要	-	-	137,508 (註1)		137,508 (註2)
30	ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE (註7)	ASTEEL ELECTRONIQUE FOUCHANA (註7)	其他應收款－關係人	是	134,980	-	1.25	短期融通	-	營運需要	-	-	182,554 (註1)		182,554 (註2)
		ASTEELFLASH GROUP	其他應收款－關係人	是	1,294,075	-	2.00	短期融通	-	營運需要	-	-	1,831,617 (註1)		1,831,617 (註2)
31	砂地電子(蘇州)有限公司	Universal Global Technology Co., Limited	其他應收款－關係人	是	1,253,250	1,245,600	1.00	短期融通	-	營運需要	-	-	1,831,617 (註1)		1,831,617 (註2)
		ASTEELFLASH EBERBACH GmbH	其他應收款－關係人	是	79,051	72,106	1.25~1.75	短期融通	-	營運需要	-	-	186,424 (註1)		186,424 (註2)
32	ASTEELFLASH GERMANY GmbH	ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBURG GmbH	其他應收款－關係人	是	30,933	28,215	1.25~1.75	短期融通	-	營運需要	-	-	186,424 (註1)		186,424 (註2)
		砂品科技(蘇州) 有限公司	其他應收款－關係人	是	1,392,500	1,384,000	0.63~3.49	短期融通	-	營運需要	-	-	37,530,555 (註1)		37,530,555 (註2)
33	砂品	砂地電子(蘇州)有限公司	其他應收款－關係人	是	10,000,000	10,000,000	0.59	短期融通	-	營運需要	-	-	37,530,555 (註1)		37,530,555 (註2)

註 1：子公司對個別對象資金貸與限額為不超過該貸出資金之公司淨值之百分之四十。

註 2：因公司間或與行號間有短期融通資金之必要而將資金貸與他人之總額度為該貸出資金之公司淨值之百分之四十。

註 3：有關本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間或本公司之國內公開發行子公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對該國內公開發行子公司從事資金貸與，其資金貸與總額及個別對象之限額，以不超過貸出企業最近期財務報表淨值之百分之百為限。

註 4：已於編製合併報告時沖銷。

註 5：編號 13、15、16 和 17：本集團於 110 年 12 月將日月光半導體（昆山）有限公司、日月光半導體（威海）有限公司、日榮半導體（上海）有限公司及蘇州日月新半導體有限公司處分子北京智路資產管理有限公司之指定從屬公司，自 110 年 12 月起不納入本集團合併個體。

註 6：編號 30 之貸出資金之公司 ASTEELFLASH FRANCE 已於 110 年 12 月吸收合併貸與對象 SER 公司。

註 7：編號 32 之貸出資金之公司 ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE 及貸與對象 ASTEEL ELECTRONIQUE FOUCHANA，均已於 110 年 12 月由其母公司 ASTEELFLASH TUNISIE S.A.(Tunisia)吸收合併。其資金貸與總額及個別對象之限額，以其母公司淨值計算表達。

日月光投資控股股份有限公司及子公司
為他人背書保證

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表二

單位：新台幣千元

編號	背書保證者名稱	被背書公司名稱	保單號碼	證對對象	單一企業背書保證金額 (註1)	本年度最高年度餘額	底年度餘額	實際支餘額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率 (%)	背書保證最高金額 (註2)	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證
1	USI Enterprise Limited	Universal Scientific Industrial (France)		間接持有表決權股份超過50%之子公司	\$ 68,711,282	\$ 1,221,428	\$ 1,184,830	\$ 1,184,830	\$ -	2.41	\$ 73,619,231	是	否	否
2	元隆電子公司	元隆電子公司		(註3)	262,742	103,500	-	-	-	-	281,510	否	否	否
3	ASTEELFLASH GROUP	ASTEELFLASH USA CORP.		間接持有表決權股份超過50%之子公司	6,757,717	142,675	138,400	138,400	-	2.87	7,240,412	是	否	否
		ASTEELFLASH GERMANY GmbH		直接持有表決權股份超過50%之子公司	6,757,717	223,405	203,777	203,777	-	7.09	7,240,412	是	否	否
		ASTEELFLASH HERSFELD GmbH		間接持有表決權股份超過50%之子公司	6,757,717	223,405	203,777	203,777	-	7.09	7,240,412	是	否	否
		ASTEELFLASH BONN GmbH		間接持有表決權股份超過50%之子公司	6,757,717	223,405	203,777	203,777	-	7.09	7,240,412	是	否	否
		ASTEELFLASH EBERBACH GmbH		間接持有表決權股份超過50%之子公司	6,757,717	223,405	203,777	203,777	-	7.09	7,240,412	是	否	否
		ASTEELFLASH TUNISIES S.A.		直接持有表決權股份超過50%之子公司	6,757,717	134,980	125,401	125,401	-	9.69	7,240,412	是	否	否
		ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.		直接持有表決權股份超過50%之子公司	6,757,717	101,235	94,051	-	-	11.64	7,240,412	是	否	否
4	FINANCIERE AFG	ASTEELFLASH FRANCE		間接持有表決權股份超過50%之子公司	10,586,548	236,215	219,453	-	-	2.90	11,342,730	是	否	否
		ASTEELFLASH GROUP		直接持有表決權股份超過50%之子公司	10,586,548	236,215	219,453	-	-	2.90	11,342,730	是	否	否
		ASTEELFLASH HERSFELD GmbH		間接持有表決權股份超過50%之子公司	10,586,548	236,215	219,453	-	-	5.80	11,342,730	是	否	否
		ASTEELFLASH EBERBACH GmbH		間接持有表決權股份超過50%之子公司	10,586,548	236,215	219,453	-	-	5.80	11,342,730	是	否	否
		ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH		間接持有表決權股份超過50%之子公司	10,586,548	236,215	219,453	-	-	5.80	11,342,730	是	否	否
5	飛旭電子(蘇州)有限公司	Universal Scientific Industrial (France)		間接對公司持有表決權之股份超過50%之公司	6,410,660	1,653,506	-	-	-	-	6,868,565	否	是	否
6	ASTEELFLASH USA CORP.	Universal Scientific Industrial (France)		間接對公司持有表決權之股份超過50%之公司	627,507	642,676	-	-	-	-	672,329	否	是	否
7	ASTEELFLASH EBERBACH GmbH	Universal Scientific Industrial (France)		間接對公司持有表決權之股份超過50%之公司	126,071	201,066	-	-	-	-	135,077	否	是	否
8	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	Universal Scientific Industrial (France)		間接對公司持有表決權之股份超過50%之公司	638,938	455,912	-	-	-	-	684,576	否	是	否

註 1： 依本公司「背書保證作業程序」，子公司對單一企業之背書保證額度以不超過該公司最近期財務報表淨值之百分之一百四十為限。

註 2： 依本公司「背書保證作業程序」，子公司背書保證責任總額以不超過該公司最近期財務報表淨值之百分之一百五十為限。

註 3： 元隆電子公司背書保證之原因係為融資之目的而開立本票予非金融事業作擔保。

日月光投資控股股份有限公司及子公司
年底持有有價證券情形明細表
民國 110 年 12 月 31 日

附表三

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

持 有 之 公 司	票 種 類 及 名 稱	與 有 價 證 券 發 行 人 之 關 係	帳 列 科 目	年 股 數 ／ 單 位	帳 面 金 額	持 股 比 率 (%)	公 允 價 值	備 註
日月光	神通資訊科技公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	2,521	\$	-	\$	30
	亞太新興產業創業投資公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,814,200		7		30,757
	晶錫科技公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	333,334		6		-
	有線合夥 Ripley Cable Holdings I, L.P.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	-		4		-
台灣福雷電子公司	最 終 母 公 司		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	5,489,388		-		584,620
	寶德電化材料科技公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	33,560,184		2		-
	神通資訊科技公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	680,017		-		8,006
	Ainos Inc.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	100,000,000		15		203,787
	新展資本公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	20,000,000		17		133,978
	匯豐控股有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	400,000		-		66,579
	騰訊控股有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	194,000		-		305,284
	中國工商銀行公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	11,000,000		-		172,162
	中國平安保險（集團）公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	1,000,000		-		199,809
	中國建設銀行公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	10,402,000		-		199,350
	友邦保險控股有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	300,000		-		84,271
	招商銀行公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	2,200,000		-		472,372
	中國人壽保險公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	1,000,000		-		45,782
	中銀香港（控股）有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	1,900,000		-		172,623
	中國移動通信集團公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	600,000		-		100,188

(接次頁)

(承前頁)

持 有 之 公 司	有 價 證 券 種 類 及 名 稱	與 有 價 證 券 發 行 人 之 關 係	帳 列 科 目	年 度		持 股 比 率 (%)	公 允 價 值 備 註
				股 數 / 單 位 數	帳 面 金 額		
陸竹開發公司	長江和記實業有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	200,000	\$ 36,342	-	36,342
	中國農業銀行公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	16,300,000	155,613	-	155,613
	中國銀行公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	16,700,000	167,729	-	167,729
	阿里巴巴集團控股有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	360,000	140,413	-	140,413
	特 別 股 漢通創業投資公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	25,000,000	275,000	25	275,000
	公 司 債 南山人壽保險股份有限公司105年度第一期無到期日累積次順位公司債	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	1,000	1,076,458	-	1,076,458
	基 金 元大高股息優質龍頭基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	5,000,000	71,350	-	71,350
	股 票 力晶科技公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	1,016,060	37,118	-	37,118
	力晶積成電子製造公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	1,434,320	102,124	-	102,124
	元隆電子公司	股 票 聯華電子公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	89,659	5,828	-
A.S.E. Holding Limited	鴻海精密工業公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	568	59	-	59
	華邦電子公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	5,893	200	-	200
	股 票 SiPhoton, Inc.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	544,800	-	4	-
	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	37,766	880千元	-	880千元
J & R Holding Limited	股 票 本 公 司	最終母公司	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	23,351,881	89,847千元	1	89,847千元
有限合夥	Crimson Velocity Fund, L.P.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	-	333千元	-	333千元
私募基金	Wise Road Industry Investment Fund I, L.P.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	-	22,315千元	6	22,315千元

(接次頁)

(承前頁)

持 有 之 公 司	有 限 公 司	票 本 公 司	有 價 證 券 種 類 及 名 稱	與 有 價 證 券 發 行 人 之 關 係	帳 列 科 目	股 數 / 單 位 數	帳 面 金 額 (%)	持 股 比 率 (%)	公 允 價 值	備 註
ASE Test Limited		股 本 公 司	最 終 母 公 司	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 非 流 動	44,100,236 (註)	美金	169,678千元	1	美金	169,678千元
		特 別 股	SVXR, Inc.	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 非 流 動	8,831,377		-	13		-
		特 別 股	寶 蜂 計 算 (香 港) 公 司	透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 流 動	1,630,444	美金	3,000千元	4	美金	3,000千元
ASE Corporation		債 券	環 旭 電 子 子 公 司 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 券	透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 流 動	283,970	人民幣	34,508千元	1	人民幣	34,508千元
		股 票	全 球 創 業 投 資 公 司	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 非 流 動	6,200,000	\$	35,408	5	\$	35,408
環電公司		行 動 檢 測 服 務 公 司	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 非 流 動	275,000			-	4		-
		威 力 嗎 公 司	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 非 流 動	500,744			13,188	1		13,188
		精 磁 科 技 公 司	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 非 流 動	733,000			-	2		-
		特 別 股	愛 微 科 公 司	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 非 流 動	180,000		95	1		95
Huntington Holdings International Co. Ltd.		股 票	Superactive Group Company Limited	透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 流 動	5,548,800	美金	144千元	-	美金	144千元
			Cadence Design SYS Inc.	透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 流 動	9,633	美金	1,795千元	-	美金	1,795千元
			Solid Gain Investments Ltd.	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 非 流 動	1,291,400	美金	474千元	20	美金	474千元
		特 別 股	Techgains I Corporation	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 非 流 動	518,316	美金	170千元	10	美金	170千元
Unitech Holdings International Co., Ltd.			Techgains II Corporation	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 非 流 動	653,998	美金	114千元	4	美金	114千元
		股 票	Superactive Group Company Limited	透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 流 動	5,613,600	美金	146千元	-	美金	146千元
			Wacom Co., Ltd.	透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 非 流 動	1,200,000	美金	9,550千元	1	美金	9,550千元
			Sequans Communications SA	透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 非 流 動	370,554	美金	439千元	-	美金	439千元
			Asia Global Venture Co., Ltd.	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 非 流 動	445,740	美金	565千元	10	美金	565千元

(接次頁)

持 有 之 公 司	有 價 證 券 種 類 及 名 稱	與 有 價 證 券 發 行 人 之 關 係	目 錄 科 別	年 度			
				股 數 / 單 位 數	帳 面 金 額 (%)	持 股 比 率 (%)	公 允 價 值 備 註
USI Enterprise Limited	特別股 MoBagel, Inc.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	391,318	美金	2	美金 119千元
	私募基金 All-Stars Investment Private Partners Fund L.P.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	-	美金	2	美金 10,706千元
	基金 JPM環球債券收益 (美元)－A股	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	1,048,218	美金	-	美金 9,497千元
	債券 環旭電子公司無擔保可轉換公司債券	子公司	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	26,418,020	美金	77	美金 503,524千元
環旭電子公司	私募基金 蘇州耀途股權投資合夥企業	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	-	人民幣	4	人民幣 1,000元
環海電子公司	股票 蘇州速通半導體科技有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	257,937	人民幣	1	人民幣 20,000元
環鴻科技公司	私募基金 PHI FUND, L.P.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	-	美金	29	美金 14,607元
環鴻科技公司	股票 士鼎創業投資公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	29,285,000	\$	5	\$ 329,767
Universal Global Technology Co., Limited	特別股 氮化鎵有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	589,622	美金	1	美金 5,000千元

註：ASE Test Limited 持有本公司股票 44,100,236 股，係全數以非保留運用決定權信託專戶保管。

日月光投資控股股份有限公司及子公司
重大累積買進或賣出同一有價證券明細表

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表四

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

買、賣之公司名稱	有價證券類別及名稱	交易對象	交易日期	種類	交易科目	集結對象	集結股數／單位數	金額 (註 1)	初買股數／單位數	初買金額	入庫期股數／單位數	出售股數／單位數	賣出金額 (註 1)	未處分金額	未處分股數	金額 (註 1)	單位
J&R Holding Limited	股票 Global Advanced Packaging Technology Limited			採權益法之長期股權投資	註3、註4	-	207,370,000	美金 581,630千元	168,670,939	美金 440,014千元	-	美金	-	美金	-	美金 1,660,891千元	美金
廣神忠證 蘇州日月光半導體有限公司 日月光半導體（威海）有限公司	採權益法之長期股權投資	註4	採權益法之長期股權投資	註4	採權益法之長期股權投資	-	-	美金 231,121千元	-	美金 162,805千元	-	美金	254,788千元	美金 259,163千元	-	美金	-
Global Advanced Packaging Technology Limited	股票 GAFT Holding Limited	-	採權益法之長期股權投資	註3、註4	採權益法之長期股權投資	-	-	美金 430,247,551	430,247,551	美金 440,014千元	-	美金	1,228,000千元	美金 483,999千元	-	美金	-
GAFT Holding Limited	股票 Global Advanced Packaging Test (Hongkong) Limited	-	採權益法之長期股權投資	註4、註5	採權益法之長期股權投資	-	-	美金 117,509千元	-	美金	-	美金	139,248千元	美金 143,350千元	-	美金	-
Global Advanced Packaging Test (Hongkong) Limited	股票 蘇州日月光半導體有限公司	-	採權益法之長期股權投資	註3、註4	採權益法之長期股權投資	-	-	美金 429,995,184	429,995,184	美金 439,764千元	-	美金	註4、註5	美金	-	美金	-
Alto Enterprises Limited	股票 日月光半導體（威海）有限公司	-	採權益法之長期股權投資	註4	採權益法之長期股權投資	-	-	美金 162,805千元	-	美金 162,805千元	-	美金	162,805千元	美金 165,601千元	-	美金	-
ASE Investment (Kunshan) Limited	股票 日月光半導體（昆山）有限公司	-	採權益法之長期股權投資	註4、註5	採權益法之長期股權投資	-	-	美金 54,498千元	-	美金	-	美金	註4、註5	美金 57,406千元	-	美金	註4、註5
ASE Mauritius Inc.	股票 日月光半導體（昆山）有限公司	-	採權益法之長期股權投資	註4、註5	採權益法之長期股權投資	-	-	美金 117,222千元	-	美金	-	美金	註4、註5	美金 106,094千元	-	美金	註4、註5
蘇州日月光半導體有限公司	股票 日發半導體（上海）有限公司	-	採權益法之長期股權投資	註4、註5	採權益法之長期股權投資	-	-	美金 66,053千元	-	美金	-	美金	註4、註5	美金 69,572千元	-	美金	註4、註5
ASE (Korea) Inc.	股票 日月光半導體（威海）有限公司	-	採權益法之長期股權投資	註4	採權益法之長期股權投資	-	-	美金 140,623千元	-	美金	-	美金	162,805千元	美金 165,601千元	-	美金	-
USI Enterprise Limited	債券 理旭電子股份有限公司無擔保可轉換公司債券	子公司	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動	理旭電子公司	-	-	-	美金 26,418,020	26,418,020	美金 408,238千元	-	美金	-	美金	-	美金	503,524千元
理旭電子公司	股票 Universal Global Technology Co., Limited	-	採權益法之長期股權投資	註3	理旭電子公司	-	2,044,111,775	人民幣 4,309,681千元	505,636,530	人民幣 421,086千元	-	人民幣	-	人民幣	-	人民幣	人民幣 5,116,197千元

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券名稱及編號	類別	目交易對象	本會計期間	初 買			入 賣			出 年			處
					金額	股數／單位數	金	金額	股數／單位數	金	本處分	溢	股數／單位數	金額
Universal Global Technology Co., Limited	環球電子(惠州)有限公司	採權益法之長期股權投資	註3	-	人民幣 131,263千元	325,000,000	人民幣 325,000千元	-	-	人民幣	-	-	460,000,000	人民幣 446,215千元
	普 費 Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited	採權益法之長期股權投資	註3	-	美金 39,493千元	40,000,000	美金 40,000千元	-	-	美金	-	-	80,000,000	美金 72,748千元
	普 費 Universal Scientific Industrial (France)	採權益法之長期股權投資	註3	-	美金 302,611千元	70,000,000	美金 85,232千元	-	-	美金	-	-	321,374,822	美金 378,644千元
矽 品	股 票 SPTL(B.V.I.) Holding Limited	採權益法之長期股權投資	註2、註3	-	\$ 17,648,701	15,000,000	\$ 424,650	-	135,000,000	\$	3,843,450	-	199,400,000	\$ 16,340,566
SPTL(B.V.I.) Holding Limited	股 票 SPTL(Cayman) Holding Limited	採權益法之長期股權投資	註2、註3	-	17,489,648	15,000,000	424,650	-	135,000,000	-	3,843,450	-	201,200,000	16,102,196
SPTL(Cayman) Holding Limited	股 權證 矽品科技(蘇州)有限公司	採權益法之長期股權投資	註3	-	13,274,459	-	424,650	-	-	-	-	-	-	15,740,362

註 1：採權益法之長期股權投資金額係包括權益法認列之投資損益及股東權益相關調整項目等。透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動則包括以公平價值衡量之評價調整數。

註 2：係辦理減資匯回。

註 3：係辦理現金增資。

註 4：係以股份交換方式進行集團組織架構調整。

註 5：本公司董事會於 110 年 12 月決議處分子公司 GAPTHolding Limited（及其子公司）及日月光半導體（昆山）有限公司 100%股權，並已於 110 年 12 月完成交易並移轉控制。

日月光投資控股股份有限公司及子公司

取得不動產之金額達新台幣 3 億或實收資本額 20%以上

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表五

單位：新台幣千元

取得不動產公司	財產名稱	事實發生日期	交易金額 (未稅)	價支 (金額)	款付情形	交易對象	關係	交易對象為關係人者，其前次移轉資料			價格決定之參考	取得之目的及用途	其他約定事項
								所有權人	與發行人之關係	移轉日期	金額		
日月光	高雄廠及中壢廠設備及工程等	110.01.01 ~ 110.12.31	\$ 973,001	尚餘145,102千元將於驗收後付款	已付訖	帆宣系統科技公司	無	-	-	-	\$ -	依營業用之廠務設備及工程擴充	無
	大社區5筆土地	110.08.04	1,070,031	已付訖	已付訖	建昌工業公司	無	-	-	-	-	因應未來產能擴充之需求及提升生產製造之支援效能	無
	楠梓科技產業園區第2園區科技路2及6號	110.07.23	2,362,000	已付訖	已付訖	宏環建設公司	關聯企業	-	-	-	-	因應未來產能擴充之需求及提升生產製造之支援效能	無
	高雄廠供營業用之廠務設備及工程等	110.01.01 ~ 110.12.31	343,180	尚餘50,725千元將於驗收後付款	已付訖	長頂工程有限公司	無	-	-	-	-	依營業用之廠務設備及工程擴充	無
環泰電子(惠州)有限公司	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	888,038	依雙方合約約定之付款條件支付對價	已付訖	龍海建設集團有限公司	無	-	-	-	-	供營業使用	無
	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	922,617	依雙方合約約定之付款條件支付對價	已付訖	L&K ENGINEERING VIETNAM CO., LTD.	無	-	-	-	-	供營業使用	無
	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	2,519,183	依雙方訂購單約定之付款條件支付對價	已付訖	麗明營造公司	無	-	-	-	-	供營業使用	無
	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	2,033,433	依雙方訂購單約定之付款條件支付對價	已付訖	中源機電顧問公司	無	-	-	-	-	供營業使用	無
矽品	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	1,823,218	依雙方訂購單約定之付款條件支付對價	已付訖	聖暉工程科技公司	無	-	-	-	-	供營業使用	無
	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	833,555	依雙方訂購單約定之付款條件支付對價	已付訖	勝義發營造公司	無	-	-	-	-	供營業使用	無
	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	1,232,695	依雙方訂購單約定之付款條件支付對價	已付訖	中國二十冶集團有限公司	無	-	-	-	-	供營業使用	無
	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	1,232,695	依雙方訂購單約定之付款條件支付對價	已付訖	中國二十冶集團有限公司	無	-	-	-	-	供營業使用	無

日月光投資控股股份有限公司及子公司

重大與關係人進、銷貨明細表

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表六

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

進 (銷) 貨 之 公 司	交 易 對 象	關 係	交 易 內 容	交 易 之 情 形	估 價 之 基 準	估 價 之 比 率	信 用 期 限	應 收 (付) 票 據	應 收 票 據 之 帳 款 之 比 率 (%)	註
日月光	日月光半導體(上海)有限公司	子公司	進	貨	\$	2	月結60天	297,217	(2)	註
	日月光電子公司	子公司	進	貨	2,287,840	4	月結60天	644,578	(4)	註
	台灣福雷電子公司	子公司	進	貨	119,396	-	月結60天	-	-	註
	環隆電氣公司	合併子公司	銷	貨	4,983,863	3	月結60天	818,677	3	註
日 榮 半 導 體 (上 海) 有 限 公 司	環鴻科技公司	合併子公司	銷	貨	1,605,789	1	月結60天	670,697	2	註
	日月光半導體(上海)有限公司	合併子公司	進	貨	144,249	20	月結60天	-	-	註
	日月光半導體(香港)有限公司	母 公 司	進	貨	606,020	100	月結90天	53,347	(100)	註
	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	合併子公司	進	貨	342,264	15	發票日後60天	87,160	(20)	註
日 月 光 半 導 體 (上 海) 有 限 公 司	日月光	母 公 司	銷	貨	1,161,007	24	月結60天	309,642	26	註
	日 榮 半 導 體 (上 海) 有 限 公 司	合併子公司	銷	貨	144,249	3	發票日後60天	-	-	註
	日月光半導體(香港)有限公司	子 公 司	銷	貨	606,020	12	月結90天	55,537	5	註
	日 月 光	母 公 司	銷	貨	2,287,840	46	月結60天	693,989	48	註
日 月 光 電 子 公 司	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	合併子公司	銷	貨	342,264	7	發票日後60天	87,597	6	註
	砂 朥 越	合併子公司	銷	貨	511,676	10	月結60天	152,253	11	註
台灣福雷電子公司	日 月 光	母 公 司	銷	貨	252,304	2	月結60天	2,925,929	64	註
	環隆電氣公司	合併子公司	進	貨	4,983,863	27	月結60天	817,727	(36)	註
環 旭 電 子 公 司	環鴻科技公司	母 公 司	進	貨	227,466	2	75天	24,878	(1)	註
	環 鼎 電 子 (上 海) 有 限 公 司	子 公 司	銷	貨	752,855	1	75天	148,625	1	註
	環鴻科技公司	子 公 司	進	貨	313,769	-	75天	-	-	註
	環鴻科技公司	子 公 司	銷	貨	1,418,806	2	75天	-	-	註
環 鴻 電 子 (昆 山) 有 限 公 司	環鴻科技公司	合併子公司	進	貨	221,717	1	75天	-	-	註
	泰德興精密電子(昆山)有限公司	合併子公司	銷	貨	17,565,672	70	75天	-	-	註
	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	採權益法之長投—合資子公司	進	貨	144,970	1	月結120天	79,386	(1)	註
	環旭電子公司	合併子公司	銷	貨	111,358	-	75天	4,648	-	註
環 鼎 電 子 (上 海) 有 限 公 司	環旭電子公司	母 公 司	進	貨	752,855	2	75天	148,625	(2)	註
	環鴻科技公司	合併子公司	進	貨	227,435	1	75天	-	-	註
環 隆 電 子 (深 圳) 有 限 公 司	環隆電氣公司	合併子公司	銷	貨	8,617,408	48	75天	-	-	註
	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	合併子公司	銷	貨	479,785	3	75天	78,621	2	註

(接 次 頁)

日月光投資控股股份有限公司及子公司

重大應收關係人款項明細表

民國 110 年 12 月 31 日

附表七

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

帳列應收款項之公司	交易對象	名稱	編制	關係人	應收帳款金額	應收帳款餘額	關聯額	係屬(註1)	人週轉率(次) (註2)	逾期應收金額	應收關係人款項(註1)	應收後收	關係人款項金額	列帳	抵備金額
本公司	日月光			子公司	\$	213,161		(註5)	-	\$	-	\$	-	\$	-
日月光	環隆電氣公司			合併子公司		818,677		(註5)	3		持續催收		152,621		-
	環鴻科技公司			合併子公司		670,807		(註5)	2	24,553 30,477	持續催收		149,912		-
日月光電子公司	日月光			母公司		702,275		(註5)	4	5,020	持續催收		159,202		-
	矽品			合併子公司		152,253		(註5)	4	-	-		49,386		-
	本公司			最終母公司		780,000		(註3及5)	-	-	-		130,000		-
ASE Singapore Pte. Ltd.	J&R Holding Limited			母公司		1,190,240		(註3及5)	-	-	-		-		-
	ASE Test Limited			母公司		498,240		(註3及5)	-	-	-		359,840		-
ISE Labs. Inc.	日月光			母公司		840,146		(註3及5)	5	-	-		-		-
	ASE Test Limited			母公司		332,160		(註3及5)	-	-	-		-		-
A.S.E. Holding Limited	ASE Test Limited			子公司		1,503,024		(註3及5)	-	-	-		-		-
台灣福雷電子公司	日月光			母公司		2,991,826		(註4及5)	-		持續催收		934,767		-
	本公司			最終母公司		1,525,000		(註3及5)	-	9,923	-		544,000		-
ASE Test Limited	USI Enterprise Limited			合併子公司		4,124,320		(註3及5)	-	-	-		276,800		-
	J&R Holding Limited			母公司		3,847,520		(註3及5)	-	-	-		83,040		-
ASE (U.S.) Inc.	日月光			母公司		283,537		(註3及5)	11	-	-		55,385		-
ASE (Korea) Inc.	日月光			母公司		8,073,241		(註3及5)	-	-	-		8,027,200		-
Global Advanced Packaging Technology	日月光封裝測試(上海)有限公司			子公司		22,199,570		(註5)	-	-	-		-		-
	日月光			母公司		885,760		(註3及5)	-	-	-		-		-
	USI Enterprise Limited			合併子公司		2,768,000		(註3及5)	-	-	-		-		-
ASE Japan Co., Ltd.	日月光			母公司		481,000		(註3及5)	-	-	-		-		-
ASE Mauritius Inc.	日月光封裝測試(上海)有限公司			合併子公司		1,251,955		(註5)	-	-	-		-		-
日月光投資(昆山)有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司			合併子公司		1,906,603		(註5)	-	1,906,603	持續催收		-		-
Alto Enterprises Limited	日月光封裝測試(上海)有限公司			合併子公司		1,032,862		(註5)	-	-	-		-		-
日月光半導體(上海)有限公司	日月光			母公司		309,642		(註5)	3	-	-		11,443		-
無錫通芝微電子有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司			母公司		198,936		(註3及5)	-	-	-		-		-
日月光集成電路製造(中國)有限公司	矽品科技(蘇州)有限公司			合併子公司		916,060		(註3及5)	-	-	-		-		-
	日月光封裝測試(上海)有限公司			合併子公司		1,209,139		(註3及5)	-	-	-		-		-
上海鼎匯房地產開發有限公司	上海鼎成房地產開發有限公司			子公司		1,964,437		(註3及5)	-	-	-		-		-
	昆山鼎泓房地產開發有限公司			子公司		354,390		(註3及5)	-	-	-		6,109		-
	上海鼎裕房地產開發有限公司			子公司		440,582		(註3及5)	-	-	-		-		-
	上海鼎堯置業發展有限公司			子公司		136,085		(註3及5)	-	-	-		6,109		-

(接次頁)

(承前頁)

帳列應收款項之公司	交易對象	名稱	編制	應收帳款	應收項餘額	關係人	人週轉率(次)	逾期應收金額	應收關係人款項	應收後收	關係人款項金額	提列帳	抵備金額
				\$		(註3及5)	(註2)	\$	方式	\$		\$	
Real Tech Holdings Limited	USI Enterprise Limited				1,079,520	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
USI Enterprise Limited	環電公司				1,661,982	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
環隆電氣公司	環鴻科技公司				901,652	(註3及5)	-	-	-	-	404,859	-	-
環勝電子(深圳)有限公司	環泰電子(惠州)有限公司				155,114	(註5)	1	-	-	-	-	-	-
環旭科技有限公司	環旭科技有限公司				1,958,870	(註5)	-	-	-	-	693,211	-	-
	環鴻科技公司				5,931,095	(註5)	-	-	-	-	1,892,110	-	-
	環勝電子(深圳)有限公司				407,021	(註5)	-	20,589	持續催收	-	152,529	-	-
Universal Global Technology Co., Limited	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.				1,107,200	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
	環鴻電子(昆山)有限公司				451,195	(註5)	-	216,013	持續催收	-	64,463	-	-
	環旭電子公司				812,385	(註5)	-	330,765	持續催收	-	189,667	-	-
	環鴻科技公司				553,600	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
	環隆電氣公司				1,522,400	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
	Universal Scientific Industrial (France)				1,661,570	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
	ASTEELFLASH USA CORP.				193,760	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
	ASTEELFLASH GROUP				1,248,783	(註3及5)	-	-	-	-	1,245,600	-	-
環鴻電子(昆山)有限公司	環旭科技有限公司				4,506,391	(註5)	-	-	-	-	1,556	-	-
環旭電子公司	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED				1,882,240	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
	環鴻電子(上海)有限公司				148,625	(註5)	4	42,668	持續催收	-	42,668	-	-
	環旭科技有限公司				852,834	(註5)	-	-	-	-	334,968	-	-
	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.				832,409	(註3及5)	-	-	-	-	326	-	-
環電公司	環鴻科技公司				230,733	(註5)	-	-	-	-	12,395	-	-
環鴻電子(上海)有限公司	環鴻電子(昆山)有限公司				875,265	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
Universal Scientific Industrial (France)	ASTEELFLASH FRANCE				736,734	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.				398,150	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
	ASTEELFLASH HERSFELD GmbH				285,288	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	ASTEELFLASH FRANCE				104,511	(註5)	5	1,983	持續催收	-	818	-	-
ASTEELFLASH GROUP	ASTEELFLASH (BEDFORD) LIMITED				132,290	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
	ASTEELFLASH PILZEN S.R.O.				133,578	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
	ASTEELFLASH EBERBACH GmbH				117,456	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.				614,893	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
飛旭電子(蘇州)有限公司	Universal Global Technology Co., Limited				1,245,600	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
ASTEELFLASH FRANCE	ASTEELFLASH GROUP				261,711	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-
砂品	砂品科技(蘇州)有限公司				1,555,900	(註3及5)	2	4,241	持續催收	-	36,887	-	-
	本公司				10,000,000	(註3及5)	-	-	-	-	-	-	-

(接次頁)

(承前頁)

註 1：係包含應收帳款及其他應收款。

註 2：不含其他應收款。

註 3：主係應收融資款（詳附表一說明）或設備款。

註 4：主係 Turnkey 代收代付。

註 5：已於編製合併報表時沖銷。

日月光投資控股股份有限公司及子公司
被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表八

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

投資公司名稱	編號	所在地區	主要營業項目	原始年	投資年度	資金來源	期末應收帳款	持股比例	持面金額	被投資公司本年度(損)益	本公司本年度認列之損益(註1)	備註
本公司	日月光砂	台灣	從事半導體封裝測試業各項精電路構裝之製造、加工、買賣及測試等有關業務	\$ 183,660,039	\$ 183,660,039	\$ 183,660,039	5,994,143,764	100	\$ 139,413,170	\$ 47,416,682	\$ 47,216,357	子公司
環電公司		台灣	從事專業性投資活動	33,362,556	33,362,556	\$ 33,362,556	2,717,514,202	100	\$ 34,735,115	4,848,627	4,764,407	子公司
ASE Holding Limited		百慕達群島	從事專業性投資活動	283,966千元	283,966千元	美金	243,966	100	\$ 17,568,802	1,422,290	註2	子公司
J & R Holding Limited		百慕達群島	從事專業性投資活動	479,693千元	479,693千元	美金	435,128	100	\$ 81,574,503	20,543,503	註2	子公司
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.		日本	從事半導體封裝及測試之市場行銷及客戶服務等業務	60,000千元	60,000千元	日幣	1,200	100	\$ 37,645	2,520	註2	子公司
Onniquet Industrial Limited		英屬維京群島	從事專業性投資活動	254,604千元	254,604千元	美金	254,604,067	71	\$ 11,920,261	593,050	註2	子公司
Innosource Limited		英屬維京群島	從事專業性投資活動	86,100千元	86,100千元	美金	86,100,000	100	\$ 4,565,652	152,007	註2	子公司
宏錫光公司		台灣	自有剩餘攤位及辦公大樓出租	390,470	390,470	\$ 390,470	35,497,273	27	\$ 258,757	41,487	註2	被投資公司
宏源建設公司		台灣	委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租業務、買賣各種建材及其進出口業務、房屋租售之介紹業務、室內設計裝潢工程	2,845,913	2,845,913	\$ 2,845,913	68,629,782	26	\$ 1,848,929	1,635,584	註2	被投資公司
台灣瑞電電子公司		台灣	半導體產品測試服務	20,698,867	20,698,867	美金	1,131,452,502	100	\$ 28,678,856	4,470,543	註2	子公司
隆竹開發公司		台灣	從事土地及建築開發業務	1,366,238	1,366,238	美金	145,178,015	67	\$ 1,465,884	871	註2	子公司
Deqa Technologies, Inc.		美國	控股公司，集團從事半導體封裝技術之研發	54,402千元	54,402千元	美金	8,592,129	18	\$ 51,434	2,541	註2	被投資公司
元隆電子公司		台灣	晶圓精體電路代工	178,861	178,861	\$ 178,861	33,308,452	8	\$ 67,105	103,768	註2	子公司
Alto Enterprises Limited		英屬維京群島	從事專業性投資活動	188,000千元	188,000千元	美金	188,000,000	100	\$ 4,211,095	208,394	註2	子公司
Super Zone Holdings Limited		香港	從事專業性投資活動	100,000千元	100,000千元	美金	100,000,000	100	\$ 3,023,215	64,079	註2	子公司
隆竹開發公司		台灣	從事土地及建築開發業務	372,504	372,504	\$ 372,504	40,981,245	19	\$ 413,692	871	註2	子公司
鼎林隆公司		台灣	從事資訊軟體服務業務	89,998	89,998	美金	2,119,080	60	\$ 56,087	6,608	註2	子公司
明豐資訊公司		台灣	從事資訊軟體服務業務	-	30,000	美金	3,000,000	100	\$ 3,299	103,768	註2	子公司
元隆電子公司		台灣	晶圓精體電路代工	475,000	475,000	美金	190,000,000	43	\$ 278,707	103,768	註2	子公司
ASE Test Limited		新加坡	從事專業性投資活動	84,889千元	84,889千元	美金	11,148,000	10	\$ 119,015千元	78,432千元	註2	子公司
ASE Investment (Labuan) Inc.		馬來西亞	從事專業性投資活動	169,643千元	169,643千元	美金	169,642,842	70	\$ 457,185千元	59,734千元	註2	子公司
ASE Technology Partners, Limited		開曼群島	從事專業性投資活動	320千元	320千元	美金	320,001	100	\$ 288千元	32千元	註2	子公司
Integrated Solutions Enterprise Europe		比利時	從事貿易業務	3,002千元	3,002千元	美金	186	100	\$ 2,751千元	166千元	註2	子公司
ASE Technology Partners, Limited		開曼群島	從事專業性投資活動	300千元	300千元	美金	5,750,000	100	\$ 288千元	12千元	註2	子公司
J & R Holding Limited		新加坡	從事專業性投資活動	964,524千元	964,524千元	美金	98,276,087	90	\$ 1,164,812千元	78,432千元	註2	子公司
Onniquet Industrial Limited		英屬維京群島	從事專業性投資活動	30,200千元	30,200千元	美金	30,200,000	8	\$ 52,205千元	21,237千元	註2	子公司
日月光公司		台灣	各式精體電路封裝測試用機器設備及引線架機器設備之租賃等	16,886千元	16,886千元	美金	4,207,353	100	\$ 1,665千元	4千元	註2	子公司
ASE Japan Co., Ltd.		日本	精體電路之封裝及製造	25,606千元	25,606千元	美金	7,200	100	\$ 65,805千元	3,043千元	註2	子公司
ASE (U.S) Inc.		美國	從事市場行銷支援及客戶服務等業務	4,600千元	4,600千元	美金	1,000	100	\$ 21,351千元	1,749千元	註2	子公司
Global Advanced Packaging Technology Limited		開曼群島	從事專業性投資活動	647,384千元	207,370千元	美金	376,040,939	100	\$ 1,660,891千元	653,893千元	註2	子公司
Anstock Limited		開曼群島	從事專業性投資活動	-千元	10千元	美金	10千元	-	\$ -千元	-千元	註2	子公司
Anstock II Limited		開曼群島	從事專業性投資活動	-千元	10千元	美金	-	-	\$ -千元	-千元	註2	子公司
GAPTT Holding Limited		英屬維京群島	從事專業性投資活動	-千元	-千元	美金	-	-	\$ -千元	36,897千元	註2	子公司
Global Advanced Packaging Technology Limited		香港	從事貿易業務	-千元	-千元	美金	-	-	\$ -千元	46,486千元	註2	子公司
GAPTT Holding Limited		香港	從事貿易業務	-千元	-千元	美金	-	-	\$ -千元	59,491千元	註2	子公司
ASE Investment (Labuan) Inc.		南 韓	電子零組件-通信機器器材製造	160,000千元	160,000千元	美金	20,741,363	100	\$ 651,120千元	美金	註2	子公司
ASE Test Limited		新加坡	從事專業性投資活動	65,520千元	65,520千元	美金	71,428,902	100	\$ 180,949千元	23,699千元	註2	子公司
ASE Test Holdings, Ltd.		開曼群島	從事專業性投資活動	222,999千元	222,999千元	美金	5	30	\$ 107,488千元	1,970千元	註2	子公司
ASE Investment (Labuan) Inc.		馬來西亞	從事專業性投資活動	72,304千元	72,304千元	美金	72,304,040	100	\$ 194,819千元	59,734千元	註2	子公司
ASE Singapore Pte. Ltd.		新加坡	半導體產品測試服務	55,815千元	55,815千元	美金	30,100,000	100	\$ 226,365千元	28,198千元	註2	子公司

(接次頁)

(承前頁)

投資公司名稱	被投資公司名稱	稱所 在 地 區	主 要 營 業 項 目	原 本 年 初 年 度 投 資 金 額	截至年底止	持 有 面 額	截至年底止	被 投 資 公 司 本 年 度 總 投資 (捐 款)	註
ASE Test Holdings, Ltd.	ISE Labs, Inc.	美國	半導體產品測試服務	美金 221,145千元	美金 221,145千元	美金 26,250,000	100	美金 1,970千元	子公司
ISE Labs, Inc.	ISE Services, Inc.	美國	晶圓代購及客戶產品管理服務	美金 0,001千元	美金 0,001千元	1,000	100	美金 384千元	子公司
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	Chipletz, Inc.	美國	從事晶圓廠廠板設計	美金 8,000千元	美金 8,000千元	3,245,436	21	美金 1,822千元	子公司
	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	馬來西亞	各型精確電路之製造、組合、加工、測試及銷售	美金 60,000千元	美金 60,000千元	159,715,000	100	美金 23,699千元	子公司
Omniquest Industrial Limited	ASE Corporation	開曼群島	從事專業性投資活動	美金 356,284千元	美金 356,284千元	356,284,067	100	美金 21,236千元	子公司
ASE Corporation	ASE Mauritus Inc.	模里西斯	從事專業性投資活動	美金 217,800千元	美金 217,800千元	217,800,000	100	美金 7,681千元	子公司
	ASE Labuan Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動	美金 126,184千元	美金 126,184千元	126,184,067	100	美金 13,562千元	子公司
ASE Labuan Inc.	日月星電子公司	台灣	電子材料批發業、電子材料零售業及國際貿易業	美金 125,813千元	美金 125,813千元	398,981,900	100	美金 13,571千元	子公司
Imosource Limited	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動	美金 74,000千元	美金 74,000千元	74,000,000	21	美金 21,237千元	子公司
日月光半導體 (上海) 有限公司	日月光半導體 (香港) 有限公司	香港	從事貿易相關業務活動	美金 1,000千元	美金 1,000千元	-	100	美金 61千元	子公司
環電公司	Huntington Holdings International Co. Ltd.	英屬維京群島	控股公司	\$ 8,370,606	\$ 8,370,606	255,856,840	100	\$ 5,224,257	子公司
Huntington Holdings International Co. Ltd.	Unitech Holdings International Co. Ltd.	英屬維京群島	控股公司	美金 3,000千元	美金 3,000千元	3,000,000	100	(美金 633千元)	子公司
	Real Tech Holdings Limited	英屬維京群島	控股公司	美金 149,151千元	美金 149,151千元	149,151,000	100	美金 1,818,908千元	子公司
	Universal ABIT Holding Co., Ltd.	開曼群島	控股公司	美金 28,125千元	美金 28,125千元	90,000,000	100	美金 13千元	子公司
Real Tech Holdings Limited	USI Enterprise Limited	香港	投資諮詢服務及倉儲管理服務	美金 210,900千元	美金 210,900千元	210,900,000	100	美金 1,773,166千元	子公司
環電電子公司	Universal Global Technology Co., Limited	香港	控股公司	人民幣 2,189,946千元	人民幣 1,768,860千元	2,549,748,125	100	人民幣 318,449千元	子公司
	Financiere AFG	法國	控股公司	人民幣 393,342千元	人民幣 393,342千元	8,317,462	10	人民幣 136,175千元	子公司
Universal Global Technology Co., Limited	環旭科技公司	香港	貿易及投資控股公司	美金 11,000千元	美金 11,000千元	85,800,000	100	美金 14,272千元	子公司
	環海電子公司	香港	接單並委外加工、銷售電子產品、提供技術諮詢服務	美金 51,000千元	美金 47,000千元	51,000,000	100	美金 55,284千元	子公司
	M-Univers Investments Pte. Ltd.	新加坡	控股公司	美金 58,688千元	美金 58,688千元	59,157,419	42	美金 67,180千元	子公司
	環海科技公司	台灣	有線通信機械器材、無線通信機械器材、電子零組件、電腦及其週邊設備、汽車及其零件製造業、產品設計業及研究發展服務業	美金 62,235千元	美金 62,235千元	198,000,000	100	美金 312,142千元	子公司
USI Japan Co., Ltd.	USI Japan Co., Ltd.	日本	電腦資訊之週邊設備、電腦電路、電子零件等之製造買賣	美金 885千元	美金 885千元	6,400	100	美金 92千元	子公司
Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	墨西哥	主機板及電腦系統組裝	美金 63,963千元	美金 63,963千元	1,258,077,325	100	(美金 7,677千元)	子公司
USI America Inc.	USI America Inc.	美國	新製主機板組裝與製作、無線通訊產品製作、維修服務	美金 9,500千元	美金 9,500千元	250,000	100	美金 157千元	子公司
Universal Scientific Industrial (France)	Universal Scientific Industrial (France)	法國	服務	美金 372,200千元	美金 286,968千元	321,374,822	100	美金 6,793千元	子公司
Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited	Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited	越南	穿戴電子設備晶片製造和組裝	美金 80,000千元	美金 40,000千元	80,000,000	100	(美金 6,745千元)	子公司
環旭科技有限公司	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	墨西哥	主機板及電腦系統組裝	美金 -千元	美金 -千元	1	-	(美金 7,677千元)	子公司
環鴻科技公司	環隆電氣公司	台灣	從事各種電腦及週邊設備之製造、加工、維修及銷售	\$ 1,791,208	\$ 1,791,208	139,972,740	100	\$ 186,668	子公司
環海電子公司	Universal Scientific Industrial Poland Sp. z o.o.	波蘭	提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器件等業務	美金 34,656千元	美金 34,656千元	1,617,046	100	美金 6,549千元	子公司
Universal Scientific Industrial (France)	Financiere AFG	法國	控股公司	歐元 318,899千元	歐元 318,899千元	71,530,174	90	歐元 17,799千元	子公司
矽品	SPIL (B.V.) Holding Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動	美金 199,400千元	美金 319,400千元	199,400,000	100	\$ 2,133,271	子公司
	矽品投資公司	台灣	從事專業性投資活動	\$ 2,401,000	\$ 2,401,000	116,241,300	100	\$ 10,262,612	子公司
	南茂科技公司	台灣	半導體產品封裝及測試服務	1,309,699	1,309,699	78,910,390	11	美金 2,730,466	子公司
	Vertical Circuits, Inc.	美國	封裝服務	美金 5,000千元	美金 5,000千元	15,710,000	31	-	子公司
矽品投資公司	茂元投資公司	台灣	從事專業性投資活動	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	48,000,000	29	美金 373,486	子公司
SPIL (B.V.) Holding Limited	Siliconware USA, Inc.	美國	北美地區行銷業務服務	美金 1,250千元	美金 1,250千元	1,250,000	100	美金 32,604	子公司
	SPIL (Cayman) Holding Limited	開曼群島	從事專業性投資活動	美金 201,200千元	美金 321,200千元	201,200,000	100	美金 2,100,984	子公司

(接次頁)

(承前頁)

註 1：本年度認列之投資（損）益業已考量公司間交易之未實現損益之影響數。

註 2：該被投資公司之損益業已包含於其投資公司，為避免混淆，於此不再另行表達。

註 3：請參閱公開資訊觀測站。

日月光投資控股股份有限公司及子公司

大陸投資資訊

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表九

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式 (註1)	本 年 自 籌 募 資 金 總 額	本 年 度 匯 出 或 收 回 投 資 金 總 額	本 年 度 匯 出 資 金 總 額	自 籌 募 資 金 總 額	被 投 資 公 司 本 年 度 盈 損	本公司直接 或間接持股比例 (%)	本 年 度 認 股 認 購 金 額 (美金)	本 年 度 認 股 認 購 金 額 (美金)	年 底 面 值 (美金)	投 資 價 值 (美金)	青 島 至 本 年 底 已 匯 回 投資收益
大陸被投資公司名稱 日月光半導體(上海)有限公司	從事半導體材料製造業務	\$ 4,349,312 (美金 148,496千元) (註7)	1.(1)	\$ 4,782,216 (美金 149,800千元) (註7)	-	\$ 4,782,216 (美金 149,800千元) (註7)	-	\$ 351,259 (美金 12,591千元) (註3)	100	\$ 351,259 (美金 12,591千元) (註3)	\$ 351,259 (美金 12,591千元) (註3)	\$ 12,470,014 (美金 450,506千元)	-	無
日月光半導體(昆山)有限公司	從事半導體材料製造及半導體產品之封裝測試業務	- (註11)	1.(2)	\$ 8,350,204 (美金 268,000千元) (註8)	-	\$ 8,350,204 (美金 268,000千元) (註8)	-	\$ 80,889 (美金 -2,990千元) (註2)	-	\$ 80,889 (美金 -2,990千元) (註2)	\$ 80,889 (美金 -2,990千元) (註2)	-	-	無
日月光封裝測試(上海)有限公司	半導體產品封裝測試業務及廠房出租業務	\$ 3,117,117 (美金 103,580千元) (註10)	1.(3)	\$ 2,574,458 (美金 80,000千元) (註10)	-	\$ 2,574,458 (美金 80,000千元) (註10)	-	\$ 23,637 (美金 -895千元) (註2)	100	\$ 23,637 (美金 -895千元) (註2)	\$ 23,637 (美金 -895千元) (註2)	\$ 12,769,641 (美金 461,331千元)	-	無
蘇州日月新半導體有限公司	從事半導體封裝測試及技術諮詢服務業務	- (註11)	1.(4)	\$ 711,180 (美金 21,600千元)	-	\$ 711,180 (美金 21,600千元)	-	\$ 209,040 (美金 -7,883千元) (註3)	-	\$ 209,040 (美金 -7,883千元) (註3)	\$ 209,040 (美金 -7,883千元) (註3)	-	-	無
日月光半導體(威海)有限公司	一般類之分離式元器件封裝及測試業務	- (註11)	1.(4)	\$ 1,295,307 (美金 40,000千元)	-	\$ 1,295,307 (美金 40,000千元)	-	\$ 489,687 (美金 17,407千元) (註3)	-	\$ 489,687 (美金 17,407千元) (註3)	\$ 489,687 (美金 17,407千元) (註3)	-	-	無
上海鼎匯房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理	\$ 16,345,070 (人民幣 3,600,000千元)	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	\$ 726,181 (人民幣 -167,600千元) (註3)	100	\$ 726,181 (人民幣 -167,600千元) (註3)	\$ 726,181 (人民幣 -167,600千元) (註3)	\$ 19,572,037 (人民幣 4,508,144千元)	-	無
上海鼎威房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理	\$ 8,061,489 (人民幣 1,798,000千元)	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	\$ 258,048 (人民幣 -59,433千元) (註3)	100	\$ 258,048 (人民幣 -59,433千元) (註3)	\$ 258,048 (人民幣 -59,433千元) (註3)	\$ 5,911,071 (人民幣 1,361,532千元)	-	無
上海鼎裕房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理	\$ 4,956,538 (人民幣 1,100,000千元)	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	\$ 141,862 (人民幣 -32,799千元) (註3)	100	\$ 141,862 (人民幣 -32,799千元) (註3)	\$ 141,862 (人民幣 -32,799千元) (註3)	\$ 4,512,763 (人民幣 1,039,452千元)	-	無
昆山鼎泓房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理	\$ 3,139,662 (人民幣 670,000千元)	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	\$ 85,149 (人民幣 -19,607千元) (註3)	100	\$ 85,149 (人民幣 -19,607千元) (註3)	\$ 85,149 (人民幣 -19,607千元) (註3)	\$ 2,834,349 (人民幣 652,853千元)	-	無
日月光集成電路製造(中國)有限公司	從事半導體封裝測試、售後服務、諮詢及廠房出租	\$ 3,149,000 (美金 100,000千元)	1.(5)	\$ 3,149,000 (美金 100,000千元)	-	\$ 3,149,000 (美金 100,000千元)	-	\$ 64,079 (美金 2,312千元) (註2)	100	\$ 64,079 (美金 2,312千元) (註2)	\$ 64,079 (美金 2,312千元) (註2)	\$ 3,025,109 (美金 109,289千元)	-	無
日月光投資(昆山)有限公司	從事投資控股業務	\$ 4,312,518 (美金 142,000千元) (註9)	1.(6)	\$ 3,717,318 (美金 122,000千元) (註8)	-	\$ 3,717,318 (美金 122,000千元) (註8)	-	\$ 139,843 (美金 -5,080千元) (註2)	100	\$ 139,843 (美金 -5,080千元) (註2)	\$ 139,843 (美金 -5,080千元) (註2)	\$ 3,201,832 (美金 116,360千元)	-	無
無錫通芝微電子有限公司	半導體產品封裝及測試業務	\$ 356,682 (人民幣 73,461千元)	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	\$ 11,823 (人民幣 2,766千元) (註2)	100	\$ 11,823 (人民幣 2,766千元) (註2)	\$ 11,823 (人民幣 2,766千元) (註2)	\$ 402,711 (人民幣 92,759千元)	-	無
上海鼎鼎物業管理有限公司	物業管理、房地產經紀等業務	\$ 5,078 (人民幣 1,000千元)	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	\$ 11,345 (人民幣 -2,632千元) (註3)	100	\$ 11,345 (人民幣 -2,632千元) (註3)	\$ 11,345 (人民幣 -2,632千元) (註3)	\$ 10,352 (人民幣 -2,384千元)	-	無
上海鼎凡商業管理有限公司	商業綜合體管理服務及百貨貿易等相關業務	\$ 9,487 (人民幣 2,000千元)	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	\$ 1,299 (人民幣 -299千元) (註3)	100	\$ 1,299 (人民幣 -299千元) (註3)	\$ 1,299 (人民幣 -299千元) (註3)	\$ 2,897 (人民幣 667千元)	-	無

(接次頁)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式 (註1)	本 年 初 自 台 灣 匯 出 金 額	本 年 度 匯 出 或 收 回 投 資 金 額	本 年 度 自 台 灣 匯 出 投 資 金 額	本 年 底 自 台 灣 匯 出 累 計 金 額	被 投 資 公 司 本 年 度 (捐 出)	本公司直接或間接投資之持股比例 (%)	本年度認列投資損益 (捐出)	年底投資面	截至本年底已匯回投資收益
大陸被投資公司 上海鼎鼎物業管理有限公司	物業管理、房地產經紀等業務	\$ 22,860 (人民幣 5,000千元)	2	- (註1.2)	-	-	- (註1.2)	\$ 4,643 (人民幣 1,065千元) (註3)	100	\$ 4,643 (人民幣 1,065千元) (註3)	\$ 37,170 (人民幣 8,562千元)	無
上海月芯半導體科技有限責任公司	半導體科技領域內之技術開發及測試設備之研發等業務	432,703 (人民幣 100,000千元)	2	- (註1.2)	-	-	- (註1.2)	2,359 (人民幣 526千元) (註2)	100	2,359 (人民幣 526千元) (註2)	426,996 (人民幣 98,352千元)	無
上海鼎壹置業發展有限公司	從事物業管理業務	42,142 (人民幣 10,000千元)	2	- (註1.2)	-	-	- (註1.2)	228,687 (人民幣 -52,926千元) (註3)	100	203,772 (人民幣 -47,157千元) (註3)	188,696 (人民幣 -43,464千元)	無
日榮半導體(上海)有限公司	從事半導體產品封裝及測試業務	- (註11)	2	3,218,072 (美金 100,000千元) (註10)	-	-	3,218,072 (美金 100,000千元) (註10)	339,847 (美金 12,107千元) (註2)	-	339,847 (美金 12,107千元) (註2)	- (註11)	無
環鼎電子(深圳)有限公司	生產經營電腦主機板、其他相關電腦週邊設備及通訊工業控制等產品之設計、製造及銷售	2,270,625 (美金 75,000千元)	1.(7)	1,180,746	-	-	1,180,746	1,049,730 (人民幣 242,220千元) (註4)	78	764,158 (美金 27,336千元) (註4)	4,626,591 (美金 167,146千元)	\$ 1,842,387 (美金 62,297千元)
環鼎電子公司	提供電子產品設計製造服務，生產及加工新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件等	10,798,199 (人民幣 2,210,173千元)	1.(7)	1,668,233	-	-	1,668,233	8,035,732 (美金 288,149千元) (註4)	78	5,982,492 (美金 214,525千元) (註4)	44,269,728 (美金 1,599,340千元)	349,290 (美金 10,955千元)
環鼎電子(昆山)有限公司	提供電子產品設計及製造服務	2,489,323 (人民幣 550,000千元)	2	- (註1.2)	-	-	- (註1.2)	1,329,863 (人民幣 306,802千元) (註4)	78	988,811 (人民幣 228,130千元) (註4)	4,823,532 (人民幣 1,111,029千元)	無
環鼎電子(上海)有限公司	電子產品的研發及製造，新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件、移動通信產品及模塊、零配件的加工及銷售，電子產品、通訊產品及零配件的銷售，第三方物流服務，從事貨物及技術的進出口業務	6,652,140 (人民幣 1,330,000千元)	2	- (註1.2)	-	-	- (註1.2)	1,415,572 (人民幣 327,208千元) (註4)	78	1,057,590 (人民幣 244,454千元) (註4)	6,083,283 (人民幣 1,401,194千元)	無
環鼎電子(上海)有限公司	電子元器件、計算機軟硬件、通訊設備及配件的銷售，第三方物流服務，從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易、區內企業間貿易及貿易代理	240,850 (人民幣 50,000千元)	2	- (註1.2)	-	-	- (註1.2)	10,389 (人民幣 2,405千元) (註4)	78	7,739 (人民幣 1,792千元) (註4)	210,575 (人民幣 48,503千元)	無
中科泓泰電子有限公司	伺服器及其主機板類產品製造、加工、維修服務等	963,033 (人民幣 220,000千元)	2	- (註1.2)	-	-	- (註1.2)	55,110 (人民幣 12,700千元)	38	20,221 (人民幣 4,660千元)	386,281 (人民幣 88,974千元)	無
環鼎電子(惠州)有限公司	研發及生產經營新型電子元器件、通信類、電腦類及其他電子產品，從事電子類產品維修檢測及進出口等配套服務	2,005,773 (人民幣 460,000千元)	2	- (註1.2)	-	-	- (註1.2)	42,074 (人民幣 -9,692千元) (註4)	78	31,405 (人民幣 -7,500千元) (註4)	1,598,919 (人民幣 347,557千元)	無
環鼎(深圳)電子科技有限公司	電子產品設計、技術服務及技術諮詢；電子產品、通訊產品及相關零配件的批發、經營進出口業務；物業管理等	43,687 (人民幣 10,000千元)	2	- (註1.2)	-	-	- (註1.2)	4,986 (人民幣 1,158千元) (註4)	78	3,720 (人民幣 864千元) (註4)	37,940 (人民幣 8,739千元)	無

(承前頁)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	投資方式 (註1)	本年年初 自台灣匯出 累積投資金額	本年度匯出或收回投資金額	本年度自 台灣匯出 投資金額	被投資公司 本年度損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例 (%)	本年度認列投資 損益	年底 資產負債表	截至本年底 已匯回投資收益
大地被投資公司 (蘇州)有限公司	從事電子產品之設計、製造及加工	3	\$ 512,640 (美金 18,000千元)	\$ -	\$ -	\$ 634,994 (美金 22,827千元) (註13)	78	\$ 472,295 (美金 16,979千元) (註13)	\$ 3,566,453 (美金 128,846千元)	無
矽品科技(蘇州)有限公司	封裝及測試服務	1.(8)	\$ 6,916,682 (美金 204,577千元)	\$ 424,650 (美金 15,000千元)	\$ 2,562,300 (美金 90,000千元) (註14)	\$ 2,181,493 (美金 77,451千元) (註13)	100	\$ 2,110,889 (美金 77,451千元) (註13)	\$ 15,740,362	無

投資公司名稱	本年年初 自台灣匯出 累積投資金額	經濟部投資審議會核准投資金額	本公司赴大陸地區投資限額
日月光	\$ 15,203,097 (美金 471,400千元)	\$ 26,215,010 (美金 828,745千元) (註7)	\$ - (註5)
台灣福雷電子公司	\$ 8,878,838 (美金 288,000千元)	\$ 8,878,838 (美金 288,000千元)	\$ 17,203,750 (註6)
環電公司	\$ 2,848,979	\$ 32,402,388 (美金 1,027,237千元)	\$ - (註5)
矽品	\$ 6,774,513 (美金 195,000千元)	\$ 6,857,960 (美金 224,577千元) (註12)	\$ - (註5)

註 1：投資方式說明如下：

1. 係透過第三地區再投資大陸公司，第三地區之投資公司如下：

- (1) ASE Mauritius Inc.、ASE Corporation、Omniquest Industrial Limited、Innosource Limited、J&R Holding Limited。
- (2) ASE Mauritius Inc.、Alto Enterprises Limited、Innosource Limited、ASE Corporation、Omniquest Industrial Limited、J&R Holding Limited。
- (3) Global Advanced Packaging Technology Limited、J&R Holding Limited。
- (4) Global Advanced Packaging Test (Hongkong) Limited、GAPT Holding Limited、Global Advanced Packaging Technology Limited、J&R Holding Limited。
- (5) Super Zone Holdings Limited。
- (6) Alto Enterprises Limited。
- (7) Real Tech Holdings Limited、Huntington Holdings International Co. Ltd.。
- (8) SPIL (Cayman) Holding Limited。

2. 係由大陸地區現有公司再投資。

3. 其他方式。

(接次頁)

(承前頁)

註 2：依經台灣母公司簽證會計師查核之財務報告揭露。

註 3：依經與中華民國會計師事務所所有合作關係之國際性會計師事務所查核之財務報告揭露。

註 4：依經台灣母公司簽證會計師所屬事務所之其他會計師查核之財務報告揭露。

註 5：依經濟部投審會規定，本公司赴大陸地區投資投資限額係依經濟部 97 年 8 月 29 日經審字第 09704604680 號令修正發布並自同年 8 月 1 日生效之「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」第參點，取得經經濟部工業局核發符合營運總部營業範圍證明文件並具跨國企業條件之公司，是以對大陸地區投資金額無上限之規定。

註 6：茲將台灣福雷電子子公司赴大陸地區投資投資限額計算如下： $\$28,672,916 \times 60\% = 17,203,750$

註 7：經濟部投審會核准投資金額與累計自台灣匯出投資金額之差異總計美金 357,345 千元，係包括：

(1) ASE (Korea) Inc. 直接匯出美金 100,000 千元。

(2) ASE (Korea) Inc. 借予日月光半導體（威海）有限公司之債權轉作為股本美金 25,000 千元。

(3) ASE Mauritius Inc. 向日月光封裝測試（上海）有限公司與日月光電子元器件（上海）有限公司買入日月光半導體（上海）有限公司股權及日月光半導體（上海）有限公司吸收合併日月光電子元器件（上海）有限公司，投審會認定因股權移轉而增加之淨投資分別為美金 707 千元及美金 6,777 千元。

(4) J&R Holding Limited 以美金 127,113 千元購入 NXP B.V. 所持有之蘇州日月新 40% 股權並於 107 年 5 月 30 日經投審會核准在案。

(5) J&R Holding Limited 以美金 97,748 千元購入北京紫光資本管理有限公司所持有之蘇州日月新 30% 股權並於 108 年 10 月 30 日經投審會核准在案。

註 8：係同一筆資金由台灣福雷電子公司透過第三地區間接增資日月光投資（昆山）有限公司再轉增資日月光半導體（昆山）有限公司之投資金額。

註 9：日月光封裝測試（上海）有限公司新增轉投資日月光投資（昆山）有限公司再轉投資日月光半導體（昆山）有限公司美金 2,000 萬元。

註 10：日月光封裝測試（上海）有限公司分割減少資本美金 1 億元予 Global Advanced Packaging Technology Limited 設立之子公司日榮半導體（上海）有限公司。

註 11：本集團於 110 年 12 月將日月光半導體（昆山）有限公司、日月光半導體（威海）有限公司、日榮半導體（上海）有限公司及蘇州日月新半導體有限公司處分子北京智路資產管理有限公司之指定從屬公司，自 110 年 12 月起不納入本集團合併個體。

註 12：經濟部投審會核准投資金額與累計自台灣匯出投資金額之差異總計美金 29,577 千元，係為盈餘轉增資美金 29,577 千元。

註 13：依經其他簽證會計師查核之財務報告揭露。

註 14：本年度自子公司 SPIL(B.V.I.) Holding Limited 之轉投資公司 SPIL(Cayman) Holding Limited 收回減資款美金 135,000 千元，其中美金 90,000 千元係歸屬於矽品科技（蘇州）有限公司，美金 45,000 千元係歸屬於民國 109 年 10 月已處分之矽品電子（福建）有限公司。

日月光投資控股股份有限公司及子公司
 母子公司間業務關係及重要交易往來情形
 民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表十

單位：新台幣千元
 （除另予註明者外）

編 號	交 易 人 名 稱	交 易 往 來 對 象	與 交 易 人 之 關 係	交 易 目 的	往 來		情 形
					金 額	交 易 條 件	
0	本公司	台灣福雷電子公司 日月光電子公司 矽 品 日 月 光	母公司對子公司 母公司對子公司 母公司對子公司 母公司對子公司	其他應付款 其他應付款 其他應付款 其他應收款	\$ 1,525,000 780,000 10,000,000 213,161	— — — —	— — 1 —
1	日 月 光	台灣福雷電子公司 環隆電氣公司 環鴻科技公司 日月光半導體（上海）有限公司 ASE (U.S.) Inc. 日月光電子公司 ASE (Korea) Inc. ASE Japan Co., Ltd. ISE Labs, Inc. Global Advanced Packaging Technology Limited	子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司	其他應付款 購置固定資產 營業成本 應收帳款 營業收入 應收帳款 營業收入 應付帳款 營業成本 營業費用 其他應付款 應付帳款 營業成本 其他應付款 其他應付款 其他負債 其他負債	2,991,486 244,740 118,849 818,677 4,983,863 670,697 1,605,789 297,217 1,161,007 856,119 193,760 644,578 2,287,840 8,040,069 481,000 830,400 880,760	— — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — 1 — — — — — — — 1 — — — —
2	日 月 光 電 子 公 司	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd. 矽 品	子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司	營業收入 營業收入 應收帳款	341,930 511,676 152,253	— — —	— — —
3	日 月 光 半 導 體 (上 海) 有 限 公 司	日月光半導體（香港）有限公司 環旭電子公司	子公司對子公司 子公司對子公司	營業收入 透過損益按公允價值衡量 之金融資產－流動	606,020 149,816	— —	— —
4	日 月 光 封 裝 測 試 (上 海) 有 限 公 司	日榮半導體（上海）有限公司 日榮半導體（上海）有限公司	子公司對子公司 子公司對子公司	營業收入 租金收入 出售固定資產	144,249 539,645 332,471	— — —	— — —

（接次頁）

(承前頁)

編 號	交 易 人 名 稱	交 易 往 來 對 象	與 交 易 人 之 關 係	交 易 目 的	往 來 金 額 (註 2)	交 易 條 件 (註 1)	情 形	
							估 合 併 總 營 收 或 總 資 產 之 比 率 (%)	形
		無錫通芝微電子有限公司 日月光集成電路製造(中國)有限公司 Alto Enterprises Limited 日月光投資(昆山)有限公司 ASE Mauritius Inc. Global Advanced Packaging Technology Limited	子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司	其他應付款 其他應付款 其他應付款 其他應付款 其他應付款 其他應付款	\$ 198,936 1,209,139 1,031,437 1,906,603 1,251,955 22,199,570	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — 3
5	A.S.E. Holding Limited	ASE Test Limited	子公司對子公司	其他資產	1,503,024	—	—	—
6	ASE Singapore Pte. Ltd.	ASE Test Limited J&R Holding Limited	子公司對子公司 子公司對子公司	其他資產 其他資產	498,240 1,190,240	— —	— —	— —
7	ISE Labs, Inc.	ASE Test Limited	子公司對子公司 子公司對子公司	其他應收款 其他資產	110,720 221,400	— —	— —	— —
8	Global Advanced Packaging Technology Limited	USI Enterprise Limited	子公司對子公司	其他應收款	2,768,000	—	—	—
9	ASE Test Limited	USI Enterprise Limited J&R Holding Limited	子公司對子公司 子公司對子公司	其他應收款 其他資產	4,124,320 3,847,520	— —	— —	1 1
10	ASE (Korea) Inc.	ASE (U.S.) Inc.	子公司對子公司	營業費用	100,159	—	—	—
11	環誠科技有限公司	ASE (U.S.) Inc.	子公司對子公司	營業費用	107,936	—	—	—
12	日月光半導體(昆山)有限公司	環鴻電子(昆山)有限公司	子公司對子公司	租金收入	105,210	—	—	—
13	上海鼎匯房地產開發有限公司	上海鼎裕房地產開發有限公司 上海鼎威房地產開發有限公司 上海鼎堯置業發展有限公司 昆山鼎泓房地產開發有限公司	子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司	其他應收款 其他應收款 其他應收款 其他應收款	440,582 1,964,437 136,085 354,390	— — — —	— — — —	— — — —
14	上海鼎裕房地產開發有限公司	上海鼎堯置業發展有限公司	子公司對子公司	營業收入	155,293	—	—	—
15	日月光集成電路製造(中國)有限公司	矽品科技(蘇州)有限公司	子公司對子公司	其他應收款	916,060	—	—	—
16	環電公司	環鴻科技公司 USI Enterprise Limited	子公司對子公司 子公司對子公司	其他應收款 其他應付款	230,733 1,660,800	— —	— —	— —
17	環旭電子公司	環旭科技有限公司 環鴻科技公司	子公司對子公司 子公司對子公司	應收帳款 營業收入	852,834 1,418,806	— —	— —	— —

(接次頁)

(承前頁)

編 號	交 易 人 名 稱	交 易 往 來 對 象	與 交 易 人 之 關 係	交 易 目 的	金 額 (註 2)	交 易 條 件 (註 1)	情 形	
							估 合 併 總 營 收 或 總 資 產 之 比 率 (%)	形
		Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V. 環維電子 (上海) 有限公司	子公司對子公司	其他應收款	\$ 830,400	—	—	—
		Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited Universal Global Technology Co., Limited	子公司對子公司	營業收入 應收帳款 其他應收款	752,855 148,625 1,882,240	— — —	— — —	— — —
		環勝電子 (深圳) 有限公司	子公司對子公司	應付帳款	793,009	—	—	—
18	環旭科技有限公司	環勝電子 (深圳) 有限公司	子公司對子公司	應收帳款	406,576	—	—	—
		環鴻科技公司	子公司對子公司	應付帳款	1,956,946	—	—	—
		環鴻電子 (昆山) 有限公司	子公司對子公司	應收帳款	5,878,047	—	—	1
			子公司對子公司	應付帳款	4,456,358	—	—	1
19	Universal Global Technology Co., Limited	環隆電氣公司 環鴻科技公司 Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司	其他應收款 其他應收款 其他應收款	1,522,400 553,600 1,107,200	— — —	— — —	— — —
		環勝電子 (昆山) 有限公司	子公司對子公司	應收帳款	450,642	—	—	—
		Universal Scientific Industrial (France) ASTELFLASH USA CORP. ASTELFLASH GROUP	子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司	其他應收款 其他應收款 其他應收款	1,661,570 193,760 1,248,783	— — —	— — —	— — —
20	環鴻科技公司	環隆電氣公司 環勝電子 (深圳) 有限公司 環旭電子公司 環鴻電子 (昆山) 有限公司	子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司 子公司對子公司	營業收入 營業收入 營業收入 營業收入	227,466 227,435 313,769 221,717	— — — —	— — — —	— — — —
21	環勝電子 (深圳) 有限公司	環鴻科技公司 Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	子公司對子公司 子公司對子公司	營業收入 營業收入	8,617,408 479,785	— —	— —	2 —
22	環勝電子 (昆山) 有限公司	環鴻科技公司 Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	子公司對子公司 子公司對子公司	營業收入 營業收入	17,565,672 111,358	— —	— —	3 —
23	環維電子 (上海) 有限公司	環鴻電子 (昆山) 有限公司	子公司對子公司	其他應收款	875,265	—	—	—
24	環隆電氣公司	環鴻科技公司	子公司對子公司	其他應收款	901,652	—	—	—

(接次頁)

(承前頁)

編號	交易人名稱	交易往來對象	交易對象	交易往來對象	交易科目	往來金額		交易條件 (註1)	合併總資產或總負債之比率 (%)	情形
						目金額	(註2)			
25	USI Enterprise Limited	環旭電子公司	環旭電子公司	子公司對子公司	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 13,937,544		—	2	
26	USI America Inc.	Real Tech Holdings Limited	Real Tech Holdings Limited	子公司對子公司	其他應收款	1,079,520		—	—	
27	Universal Scientific Industrial (France)	Universal Global Technology Co., Limited	Universal Global Technology Co., Limited	子公司對子公司	營業收入	153,459		—	—	
28	飛旭電子(蘇州)有限公司	ASTEELFLASH FRANCE	ASTEELFLASH FRANCE	子公司對子公司	其他應收款	736,734		—	—	
29	ASTEELFLASH GROUP	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	子公司對子公司	其他應收款	398,150		—	—	
30	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	ASTEELFLASH HERSFELD GmbH	ASTEELFLASH HERSFELD GmbH	子公司對子公司	其他應收款	285,288		—	—	
31	ASTEELFLASH FRANCE	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	子公司對子公司	其他應收款	1,245,600		—	—	
32	ASTEELFLASH MEXICO S.A. de C.V.	ASTEELFLASH FRANCE	ASTEELFLASH FRANCE	子公司對子公司	營業收入	239,087		—	—	
33	ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.	ASTEELFLASH GROUP	ASTEELFLASH GROUP	子公司對子公司	其他應收款	126,134		—	—	
34	矽品	矽品科技(蘇州)有限公司	矽品科技(蘇州)有限公司	子公司對子公司	其他應收款	128,537		—	—	
				子公司對子公司	其他應收款	109,726		—	—	
				子公司對子公司	其他應收款	592,100		—	—	
				子公司對子公司	應收帳款	100,761		—	—	
				子公司對子公司	營業收入	477,866		—	—	
				子公司對子公司	其他應收款	249,423		—	—	
				子公司對子公司	營業收入	210,425		—	—	
				子公司對子公司	營業收入	178,528		—	—	
				子公司對子公司	營業收入	137,754		—	—	
				子公司對子公司	其他應收款	1,525,131		—	—	
				子公司對子公司	其他收入	205,381		—	—	
				子公司對子公司	營業收入	127,528		—	—	
				子公司對子公司	購置固定資產	697,894		—	—	
				子公司對子公司	出售固定資產	129,258		—	—	
				子公司對子公司	營業費用	463,329		—	—	

註1：母子公司間銷貨之交易價格與收款條件與一般銷貨並無重大差異，其餘交易因無相關同類交易可循，其交易條件係由雙方協商決定。

註2：已於編製合併報告時沖銷。

日月光投資控股股份有限公司及子公司

主要股東資訊

民國 110 年 12 月 31 日

附表十一

主	要	股	東	名	稱	股 持	有	股	數	(	股	)	持	股	比	份 例
香港商微電子國際公司						684,327,886	15.52%									
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證						314,328,372	7.13%									
匯豐商業銀行受託保管價值投資公司投資專戶						265,024,820	6.01%									

註 1：本表主要股東資訊係由集保公司以每季最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付（含庫藏股）之普通股及特別股合計達 5% 以上資料。本公司合併財務報告所記載股本與實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

註 2：上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過 10% 之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

日月光投資控股股份有限公司

個體財務報告暨會計師查核報告

民國110及109年度

地址：高雄市楠梓區經三路26號

電話：(07)3617131

§ 目 錄 §

項	目 頁	次	財 務 報 告 附 註 編 號
一、封 面	1		-
二、目 錄	2		-
三、會計師查核報告	3~7		-
四、個體資產負債表	8		-
五、個體綜合損益表	9		-
六、個體權益變動表	10		-
七、個體現金流量表	11		-
八、個體財務報告附註			
(一) 公司沿革	12		一
(二) 通過財務報告之日期及程序	12		二
(三) 新發布及修訂準則及解釋之適用	12~16		三
(四) 重大會計政策之彙總說明	16~21		四
(五) 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	21~22		五
(六) 重要會計項目之說明	22~37		六~十六
(七) 關係人交易	37~38		十七
(八) 質抵押之資產	-		-
(九) 重大或有負債及未認列之合約承諾	-		-
(十) 重大之災害損失	-		-
(十一) 重大之期後事項	-		-
(十二) 其 他	-		-
(十三) 附註揭露事項			
1. 重大交易事項相關資訊	39		十八
2. 轉投資事業相關資訊	39		十八
3. 大陸投資資訊	39~40		十八
4. 主要股東資訊	40		十八
(十四) 部門資訊	-		-
九、重要會計項目明細表	65~70		-

會計師查核報告

日月光投資控股股份有限公司 公鑒：

查核意見

日月光投資控股股份有限公司（以下稱「日月光控股公司」）民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 110 及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達日月光控股公司民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 110 及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與日月光控股公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對日月光控股公司民國 110 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對日月光控股公司民國 110 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

投資子公司之商譽減損評估

日月光控股公司針對包含於採用權益法之對子公司投資之商譽減損評估，涉及估計每一子公司所屬營運部門之使用價值並與其帳面價值相比。日月光控股公司係使用現金流量折現法來估計集團中各營運部門之使用價值，過程中對於折現率之使用以及未來營業收入之預測，皆需要管理階層作出重大估計及假設。若相關估計或假設發生變動，將對所估計之使用價值或商譽減損金額產生重大影響。日月光控股公司於民國 110 年 12 月 31 日包含於採用權益法之對子公司投資之商譽金額計新台幣（以下同）51,416,608 千元，其中分攤予封裝部門及測試部門之商譽分別為 34,849,069 千元及 13,211,590 千元。估計封裝部門及測試部門之使用價值皆超過其帳面價值，因此，日月光控股公司於民國 110 年度就分攤予封裝部門及測試部門之商譽未認列任何減損損失。

因全球經濟走勢主導半導體產業需求，有鑑於封裝部門及測試部門之營運深受全球需求影響，且管理階層需運用重大之估計及假設，方能估計各該營運部門之使用價值。本會計師在執行評估管理階層選用折現率及對封裝部門及測試部門未來營業收入預測所使用之估計及假設合理性等之查核程序時，必須運用高度之專業判斷，以及擴大查核範圍，包含評估使用評價專家之必要性。

與投資子公司之商譽減損評估相關之會計政策、會計估計及假設不確定性之主要來源暨攸關揭露資訊，請參閱個體財務報告附註四(四)及五。

本會計師針對管理階層用以推估封裝部門及測試部門使用價值，所使用之折現率及未來營業收入預測，執行主要查核程序如下：

- 一、測試與商譽減損相關之內部控制，包含管理階層用以決定封裝部門及測試部門使用價值相關之控制，如折現率之決定，以及未來營業收入預測之合理性評估等。
- 二、按照封裝部門及測試部門以前年度營業收入實際達成情形，以評估管理階層準確預測未來營業收入之能力。

三、執行敏感度分析，以評估若重要假設變動對商譽產生減損之風險。

四、採用評價專家之協助，執行下列程序以評估管理階層計算結果及所用折現率之合理性：

(一) 測試決定折現率過程中所使用之原始資料並重新驗算折現率。

(二) 獨立發展折現率合理區間，並與管理階層所決定的折現率比較，測試其是否落於區間之內。

其他事項

列入日月光控股公司民國 110 及 109 年度個體財務報告之採用權益法之子公司中，有關矽品精密工業股份有限公司（以下稱「矽品公司」）之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關矽品公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 110 年及 109 年 12 月 31 日對矽品公司採用權益法之投資餘額分別占資產總額 49%及 53%；民國 110 及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對矽品公司採用權益法認列淨利份額分別占投資收益 20%及 23%。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估日月光控股公司繼續經營之能力、相關事項之揭露、以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算日月光控股公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

日月光控股公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟

決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對於查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對日月光控股公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使日月光控股公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致日月光控股公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於日月光控股公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成日月光控股公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對日月光控股公司民國 110 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 世 宗

吳世宗



會計師 郭 麗 園

郭麗園



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 111 年 2 月 25 日

日月光投資控股股份有限公司

個體資產負債表

民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	110年12月31日		109年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金	\$ 121,304	-	\$ 113,427	-
1210	其他應收款—關係人（附註十一）	213,161	-	99,287	-
1479	其他流動資產	33,592	-	23,232	-
11XX	流動資產合計	368,057	-	235,946	-
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註五及六）	338,834,820	100	298,439,139	100
1821	其他無形資產	20,577	-	4,748	-
1990	其他非流動資產	7,929	-	-	-
15XX	非流動資產合計	338,863,326	100	298,443,887	100
1XXX	資 產 總 計	\$ 339,231,383	100	\$ 298,679,833	100
	流動負債				
2219	其他應付款	\$ 541,434	-	\$ 357,692	-
2220	其他應付款—關係人（附註十七）	12,305,219	4	25,470,176	9
2230	本期所得稅負債	182,289	-	58,300	-
2321	一年內到期之應付公司債（附註八）	6,202,753	2	-	-
2399	其他流動負債	2,436	-	1,082	-
21XX	流動負債合計	19,234,131	6	25,887,250	9
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註八）	33,069,658	10	39,258,910	13
2540	長期借款（附註七）	26,844,021	8	14,898,654	5
2670	其他非流動負債	6,859	-	-	-
25XX	非流動負債合計	59,920,538	18	54,157,564	18
2XXX	負債總計	79,154,669	24	80,044,814	27
	歸屬於本公司業主之權益（附註九）				
	股 本				
3110	普通股股本	44,034,146	13	43,385,311	15
3140	預收股本	52,356	-	130,609	-
3100	股本總計	44,086,502	13	43,515,920	15
3200	資本公積	143,691,717	42	139,766,099	47
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	6,300,198	2	3,901,384	1
3320	特別盈餘公積	9,569,027	3	10,847,697	4
3350	未分配盈餘	75,449,674	21	32,132,053	10
3300	保留盈餘總計	91,318,899	26	46,881,134	15
3400	其他權益	(11,532,042)	(3)	(9,569,027)	(3)
3500	庫藏股票	(7,488,362)	(2)	(1,959,107)	(1)
3XXX	權益總計	260,076,714	76	218,635,019	73
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 339,231,383	100	\$ 298,679,833	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 25 日查核報告）

董事長：張虔生



經理人：張洪本



會計主管：郭宏銘



日月光投資控股股份有限公司

個體綜合損益表

民國 110 及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每

股盈餘為新台幣元

代 碼		110年度		109年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	投資收益	\$ 65,091,179	100	\$ 28,564,437	100
5900	營業毛利	65,091,179	100	28,564,437	100
	營業費用（附註十）				
6200	管理費用	762,372	1	580,198	2
6900	營業淨利	64,328,807	99	27,984,239	98
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	111	-	171	-
7020	其他利益（附註十）	93,210	-	216,606	1
7050	財務成本（附註十）	(699,912)	(1)	(911,577)	(3)
7000	營業外收入及支出合計	(606,591)	(1)	(694,800)	(2)
7900	稅前淨利	63,722,216	98	27,289,439	96
7950	所得稅利益（附註十一）	185,464	-	303,540	1
8200	本年度淨利	63,907,680	98	27,592,979	97
	其他綜合損益（附註九及十一）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8320	採用權益法認列之子公司				
	其他綜合損益之份額	3,873,106	6	2,025,758	7
8349	與不重分類之項目相				
	關之所得稅	(16,106)	-	111,234	-
		3,857,000	6	2,136,992	7
8360	後續可能重分類至損益之				
	項目				
8370	採用權益法認列之子公司				
	其他綜合損益之份額	(3,136,887)	(5)	(1,310,656)	(5)
8300	本年度其他綜合損益				
	（稅後淨額）	720,113	1	826,336	2
8500	本年度綜合損益總額	\$ 64,627,793	99	\$ 28,419,315	99
	每股盈餘（附註十二）				
9750	基本每股盈餘	\$ 14.84		\$ 6.47	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 14.40		\$ 6.31	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 25 日查核報告）

董事長：張虔生

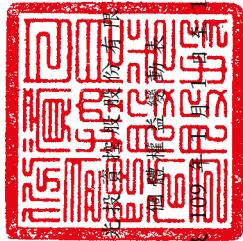


經理人：張洪本



會計主管：郭宏銘





光投資控股份有限公司

個體權益變動表

民國 110 及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

124

2月31日

單位：新台幣千元

代碼	股數 (千股)	其 他 權 益 項 目											
		本 額	資 本	公 積	保 積	留 存	盈 餘	總 計	國 外 營 運 機 構 之 財 務 報 表 換 算 之 差 額	透 過 其 他 公 司 之 金 融 現 報 損 益	應 收 工 具 之 損 益	員 工 未 賺 得 之 酬 金	合 計
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
A1	4,330,528	\$ 43,305,287	\$ 138,908,912	\$ 2,203,895	\$ 2,203,895	\$ 6,902,782	\$ 22,454,651	\$ 31,561,328	\$ 10,761,785	\$ 85,912	\$ 1,959,107	\$ 200,968,723	\$ 200,968,723
B1	-	-	-	-	1,697,489	-	(1,697,489)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	-	3,944,915	(3,944,915)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	(8,668,331)	(8,668,331)	-	-	-	(8,668,331)	(8,668,331)
C7	-	-	-	-	1,697,489	3,944,915	(14,310,735)	(8,668,331)	-	-	-	22,774	22,774
C17	-	-	22,774	-	-	-	-	-	-	-	-	1,608	1,608
D1	-	-	1,608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	27,592,979	27,592,979	-	-	-	-	-
D5	-	-	-	-	-	-	(469,748)	(469,748)	2,604,604	(429,265)	-	1,296,084	1,296,084
D8	-	-	-	-	-	-	27,123,231	27,123,231	2,604,604	(429,265)	-	826,336	826,336
M1	-	-	145,741	-	-	-	-	-	-	-	-	145,741	145,741
M3	-	-	2,199	-	-	-	(980)	(980)	-	-	-	2,313	2,313
M5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,094	-	-	-	-
M7	-	-	(13,502)	-	-	-	(2,760,175)	(2,760,175)	-	-	-	(13,502)	(13,502)
N1	-	-	780,533	-	-	-	-	-	-	-	-	3,540,708	3,540,708
O1	21,064	210,633	1,588,792	-	-	-	(392,447)	(392,447)	-	-	-	1,799,425	1,799,425
Q1	-	-	(109,892)	-	-	-	-	-	-	-	-	(502,339)	(502,339)
Z1	4,351,592	\$ 43,515,920	\$ 139,766,099	\$ 3,901,384	\$ 3,901,384	\$ 10,847,697	\$ 32,132,053	\$ 46,881,134	\$ 11,641,040	\$ 2,501,278	\$ 429,265	\$ 9,569,027	\$ 9,569,027
A1	4,351,592	\$ 43,515,920	\$ 139,766,099	\$ 3,901,384	\$ 3,901,384	\$ 10,847,697	\$ 32,132,053	\$ 46,881,134	\$ 11,641,040	\$ 2,501,278	\$ 429,265	\$ 9,569,027	\$ 9,569,027
B1	-	-	-	-	2,398,814	(1,278,670)	(2,398,814)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	-	-	(18,389,856)	(18,389,856)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	(19,510,000)	(18,389,856)	-	-	-	-	-
C7	-	-	-	-	2,398,814	(1,278,670)	(19,510,000)	(382,572)	-	(450,054)	-	(450,054)	(450,054)
C17	-	-	(30,533)	-	-	-	382,572	382,572	-	-	-	-	-
D1	-	-	1,633	-	-	-	-	-	-	-	-	1,633	1,633
D3	-	-	-	-	-	-	63,907,680	63,907,680	-	-	-	63,907,680	63,907,680
D5	-	-	-	-	-	-	25,842	25,842	3,894,880	551,098	-	720,113	720,113
D8	-	-	-	-	-	-	63,933,522	63,933,522	3,894,880	551,098	-	64,627,793	64,627,793
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1	-	-	305,737	-	-	-	-	-	-	-	-	305,737	305,737
M7	-	-	58,448	-	-	-	(2,530,714)	(2,530,714)	-	-	-	(2,589,162)	(2,589,162)
N1	57,038	570,582	3,648,781	-	-	-	-	-	-	-	(1,164,991)	3,054,372	3,054,372
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,448	58,448
Z1	4,408,630	\$ 44,086,502	\$ 143,691,717	\$ 6,300,198	\$ 6,300,198	\$ 9,569,027	\$ 75,449,674	\$ 91,318,899	\$ 15,392,747	\$ 4,903,863	\$ 121,833	\$ 7,488,362	\$ 7,488,362
	-	-	-	-	-	-	1,042,241	1,042,241	-	(1,042,241)	-	(1,042,241)	(1,042,241)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-												

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國111年2月25日查核報告)

經理人：張洪本

會計主理：郭宏銘

董事長：張虔生

- 10 -



日月光投資控股股份有限公司

個體現金流量表

民國 110 及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		110年度	109年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 63,722,216	\$ 27,289,439
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	887	-
A20200	攤銷費用	6,361	41
A20900	財務成本	699,912	911,577
A21200	利息收入	(111)	(171)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	65,842	41,530
A22300	採用權益法之子公司損益之份額	(65,091,179)	(28,564,437)
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31240	其他流動資產	(10,361)	(9,585)
A32180	其他應付款項	182,120	53,211
A32190	其他應付款－關係人	43	(35)
A32230	其他流動負債	528	(1,815)
A33000	營運產生之現金流出	(423,742)	(280,245)
A33100	收取之利息	112	177
A33200	收取之股利	23,500,000	21,800,000
A33300	支付之利息	(636,665)	(829,295)
A33500	退還之所得稅	195,579	43,687
AAAA	營業活動之淨現金流入	22,635,284	20,734,324
投資活動之現金流量			
B04500	取得無形資產	(22,190)	(4,789)
B06700	其他非流動資產增加	(311)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(22,501)	(4,789)
籌資活動之現金流量			
C01200	發行公司債	-	19,967,149
C01600	舉借長期借款	66,487,243	37,304,052
C01700	償還長期借款	(54,590,000)	(63,027,000)
C03700	其他應付款－關係人減少	(13,165,000)	(7,410,000)
C04020	租賃負債本金償還	(820)	-
C04500	發放現金股利	(18,389,778)	(8,668,331)
C04800	員工執行認股權	2,582,704	1,035,462
C04900	庫藏股票買回成本	(5,529,255)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(22,604,906)	(20,798,668)
EEEE	本年度現金淨增加（減少）	7,877	(69,133)
E00100	年初現金餘額	113,427	182,560
E00200	年底現金餘額	\$ 121,304	\$ 113,427

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 25 日查核報告）

董事長：張虔生



經理人：張洪本



會計主管：郭宏銘



日月光投資控股股份有限公司

個體財務報告附註

民國 110 及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(除另註明外，金額以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

日月光投資控股股份有限公司（以下稱本公司）於 107 年 4 月 30 日設立於高雄楠梓科技產業園區。本公司係產業投資控股公司。

本公司之子公司日月光半導體製造股份有限公司（股票代碼「2311」，以下稱日月光）於 107 年 4 月 30 日申請設立本公司，並與矽品精密工業股份有限公司（股票代碼「2325」，以下稱矽品）共同以股份轉換方式由本公司取得日月光及矽品 100% 股權，日月光及矽品於同日成為本公司 100% 持股之子公司並終止股票上市買賣，由本公司之普通股股票自同日起以股票代碼「3711」上市買賣。另日月光於 89 年 9 月發行之美國存託憑證（ADR）在紐約證券交易所掛牌上市，亦自 107 年 4 月 30 日起轉換為本公司之 ADR，代號仍為 ASX。

本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告於 111 年 2 月 25 日經董事會通過後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

- (一) 首次適用金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）認可並發布生效之國際財務報導準則（IFRS）、國際會計準則（IAS）、解釋（IFRIC）及解釋公告（SIC）（以下稱「IFRSs」）

適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRSs 將不致造成本公司會計政策之重大變動。

(二) 111 年適用之金管會認可之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會（IASB）發布之生效日
「IFRSs 2018~2020 之年度改善」	2022 年 1 月 1 日(註 1)
IFRS 3 之修正「對觀念架構之引述」	2022 年 1 月 1 日(註 2)
IAS 16 之修正「不動產、廠房及設備：達到預定使用狀態前之價款」	2022 年 1 月 1 日(註 3)
IAS 37 之修正「虧損性合約－履行合約之成本」	2022 年 1 月 1 日(註 4)

註 1：IFRS9 之修正適用於 2022 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間所發生之金融負債之交換或條款修改。

註 2：收購日在年度報導期間開始於 2022 年 1 月 1 日以後之企業合併適用此項修正。

註 3：於 2021 年 1 月 1 日以後始達管理階層預期運作方式之必要地點及狀態之廠房、不動產及設備適用此項修正。

註 4：於 2022 年 1 月 1 日尚未履行所有義務之合約適用此項修正。

截至本個體財務報告通過發布日止，本公司評估上述準則、解釋之修正將不致對財務狀況與財務績效造成重大影響。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日（註 1）
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未 定
IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」	2023 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「會計政策之揭露」	2023 年 1 月 1 日(註 2)
IAS 8 之修正「會計估計之定義」	2023 年 1 月 1 日(註 3)
IAS12 之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	2023 年 1 月 1 日(註 4)

註 1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間推延適用此項修正。

註 3：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間所發生之會計估計變動及會計政策變動適用此項修正。

註 4：除於 2022 年 1 月 1 日就租賃及除役義務之暫時性差異認列遞延所得稅外，該修正係適用於 2022 年 1 月 1 日以後所發生之交易。

1. IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」

該修正係釐清判斷負債是否分類為非流動時，應評估本公司於報導期間結束日是否具有遞延清償期限至報導期間後至少 12 個月之權利。若本公司於報導期間結束日具有該權利，無論本公司是否預期將行使該權利，負債係分類為非流動。該修正並釐清，若本公司須遵循特定條件始具有遞延清償負債之權利，本公司必須於報導期間結束日已遵循特定條件，即使貸款人係於較晚日期測試本公司是否遵循該等條件亦然。

該修正規定，為負債分類之目的，前述清償係指移轉現金、其他經濟資源或本公司之權益工具予交易對方致負債之消滅。惟若負債之條款，可能依交易對方之選擇，以移轉本公司之權益工具而導致其清償，且若該選擇權依 IAS 32「金融工具：表達」之規定係單獨認列於權益，則前述條款並不影響負債之分類。

2. IAS 1 之修正「會計政策之揭露」

該修正明訂本公司應依重大之定義，決定應揭露之重大會計政策資訊。若會計政策資訊可被合理預期將影響一般用途財務報表之主要使用者以該等財務報表為基礎所作之決策，則該會計政策資訊係屬重大。該修正並釐清：

- 與不重大之交易、其他事項或情況相關之會計政策資訊係屬不重大，本公司無需揭露該等資訊。
- 本公司可能因交易、其他事項或情況之性質而判斷相關會計政策資訊屬重大，即使金額不重大亦然。

- 並非與重大交易、其他事項或情況相關之所有會計政策資訊皆屬重大。

此外，該修正並舉例說明若會計政策資訊係與重大交易、其他事項或情況相關，且有下列情況時，該資訊可能屬重大：

- (1) 本公司於報導期間改變會計政策，且該變動導致財務報表資訊之重大變動；
- (2) 本公司自準則允許之選項中選擇其適用之會計政策；
- (3) 因缺乏特定準則之規定，本公司依 IAS 8「會計政策、會計估計變動及錯誤」建立之會計政策；
- (4) 本公司揭露其須運用重大判斷或假設所決定之相關會計政策；或
- (5) 涉及複雜之會計處理規定且財務報表使用者仰賴該等資訊方能了解該等重大交易、其他事項或情況。

3. IAS 8 之修正「會計估計之定義」

該修正明訂會計估計係指財務報表中受衡量不確定性影響之貨幣金額。本公司於適用會計政策時，可能須以無法直接觀察而必須估計之貨幣金額衡量財務報表項目，故須使用衡量技術及輸入值建立會計估計以達此目的。衡量技術或輸入值之變動對會計估計之影響若非屬前期錯誤之更正，該等變動係屬會計估計變動。

4. IAS 12 之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」

該修正釐清，原始認列時產生相同金額之應課稅及可減除暫時性差異之交易，不適用 IAS 12 原始認列之豁免規定。本公司將於 111 年 1 月 1 日就與租賃及除役義務有關之所有可減除及應課稅暫時性差異認列遞延所得稅資產（若很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異使用）及遞延所得稅負債，並於該日將累積影響數認列為保留盈餘初始餘額之調整。對租賃及除役義務以外之交易則自 111

年 1 月 1 日以後發生者推延適用該修正。

除上述影響外，截至本個體財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估上述準則及解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本個體財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具外，本個體財務報告係依歷史成本基礎編製。

公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第 1 等級至第 3 等級：

1. 第 1 等級輸入值：係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價（未經調整）。
2. 第 2 等級輸入值：係指除第 1 等級之報價外，資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）之可觀察輸入值。
3. 第 3 等級輸入值：係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

本公司於編製個體財務報告時，對投資子公司係採權益法處理。為使本個體財務報告之本年度損益、其他綜合損益及權益與本公司合併財務報告中歸屬於本公司業主之本年度損益、其他綜合損益及權益相同，個體基礎與合併基礎下若干會計處理差異係調整「採用權益法之投資」、「採用權益法之子公司損益份額」、「採用權益法之子公司其他綜合損益份額」暨相關權益項目。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產，但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償

負債而受有其他限制者。流動負債包括預期於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債（即使於資產負債表日後至通過發布財務報告前已完成長期性之再融資或重新安排付款協議，亦屬流動負債），以及不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少 12 個月之負債（惟負債之條款可能依交易對方之選擇，以發行權益工具而導致其清償者，並不影響分類）。非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

（四）投資子公司

本公司採用權益法處理對子公司之投資。子公司係指本公司具有控制之個體。

權益法下，投資原始依成本認列，取得日後帳面金額係隨本公司所享有之子公司損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外，針對本公司可享有子公司其他權益之變動係按持股比例認列。

當本公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者，係作為權益交易處理。投資帳面金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額，係直接認列為權益。

取得成本超過本公司於取得日所享有構成業務之子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽，該商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷；本公司於取得日所享有構成業務之子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額超過取得成本之數額列為當年度收益。

本公司評估減損時，係以財務報告整體考量現金產生單位並比較其可回收金額與帳面金額。嗣後若資產可回收金額增加時，將減損損失之迴轉認列為利益，惟資產於減損損失迴轉後之帳面金額，不得超過該項資產在未認列減損損失之情況下，減除應提列攤銷後之帳面金額。歸屬於商譽之減損損失不得於後續期間迴轉。

本公司與子公司之順流交易未實現損益於個體財務報告予以銷除。本公司與子公司之逆流及側流交易所產生之損益，僅

在與本公司對子公司權益無關之範圍內，認列於個體財務報告。

(五) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊後之金額衡量。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎，對每一重大部分單獨提列折舊。本公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。

(六) 無形資產

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損損失後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷，本公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。

(七) 租賃

本公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

本公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於個體資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付（包含固定給付、實質固定給付、取決於指數或費率之變動租賃給付、殘值保證下承租人預期支付之金額、合理確信將行使之購買選擇權之行使價格，及已反

映於租賃期間之租賃終止罰款，減除收取之租賃誘因）之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間、殘值保證下預期支付金額、標的資產購買選擇權之評估或用於決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動，本公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係單獨表達於個體資產負債表。

(八) 借款成本

借款成本係於發生當年度認列為損益。

(九) 員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

(十) 股份基礎給付協議

員工認股權及限制員工權利股票係按給與日權益工具之公允價值及預期既得之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並同時調整資本公積—員工認股權及其他權益（員工未賺得酬勞）。若其於給與日立即既得，係於給與日全數認列費用。本公司辦理現金增資保留員工認購係以確認員工認購股數之日為給與日。

本公司發行限制員工權利股票時，係於給與日認列其他權益（員工未賺得酬勞），並同時調整資本公積—限制員工權利股票。

本公司於每一資產負債表日修正預期既得之員工認股權及

限制員工權利股票估計數量。若有修正原估計數量，其影響數係認列為損益，使累計費用反映修正之估計數，並相對調整資本公積－員工認股權及資本公積－限制員工權利股票。

本公司給與子公司員工以本公司權益工具交割之員工認股權及限制員工權利股票，係視為對子公司之資本投入，並以給與日權益工具之公允價值衡量，於既得期間內認列為對子公司投資帳面金額之增加，並相對調整資本公積－員工認股權及資本公積－限制員工權利股票。

(十一) 所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

依中華民國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

非屬企業合併之資產及負債原始認列當時既不影響課稅所得亦不影響會計利潤，其產生之暫時性差異不認列遞延所得稅資產及負債。此外，原始認列於投資子公司之商譽產生之應課稅暫時性差異不認列遞延所得稅負債。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能課稅所得以供可減除暫時性差異及虧損扣抵使用時認列。

與投資子公司相關之應課稅暫時性差異皆認列遞延所得稅負債，惟本公司若可控制暫時性差異迴轉之時點，且該暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。與此類投資有關之可減除暫時性差異，僅於其很有可能足夠課稅所得用以實現暫時性差異，且於可預見之未來預期將迴轉的範圍內，予以認列遞延所得稅資產。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能具有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

若當期所得稅或遞延所得稅係自企業合併所產生，其所得稅影響數納入企業合併之會計處理。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

本公司將新型冠狀病毒肺炎疫情近期在我國之發展及對經濟環境可能之影響，納入對現金流量推估、成長率、折現率、獲利能力等相關重大會計估計之考量，管理階層將持續檢視估計與基本假設。若估計之修正僅影響當年度，則於修正當年度認列；若會計估計之修正同時影響當年度及未來年度，則於修正當年度及未來年度認列。

投資子公司之商譽減損評估

本公司取得子公司成本超過取得日所享有構成業務之子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽，係包含於該投資之帳面

金額且不得攤銷，並於每年度進行該商譽減損測試。本公司於決定該商譽是否減損時，須估計分攤到該商譽之現金產生單位之使用價值，計算使用價值過程中對於折現率之使用以及未來營業收入之預測，皆需要管理階層作出重大估計及假設。若相關估計或假設發生變動，將對所估計之使用價值或商譽減損金額產生重大影響。

六、採用權益法之投資

本公司採用權益法之投資皆係投資子公司：

	110 年 12 月 31 日		109 年 12 月 31 日	
	帳 面 金 額	股 權 %	帳 面 金 額	股 權 %
日 月 光	\$ 139,413,170	100.0	\$ 106,873,386	100.0
矽 品	164,686,535	100.0	158,563,245	100.0
環電股份有限公司（環電）	34,735,115	100.0	33,002,508	100.0
	<u>\$ 338,834,820</u>		<u>\$ 298,439,139</u>	

七、借 款

(一) 銀行借款

<u>週 期 性 借 款</u>	<u>110 年 12 月 31 日</u>	<u>109 年 12 月 31 日</u>
將陸續於 112 年 4 月至 112 年 12 月償還，年 利率 110 年及 109 年 12 月 31 日分別為 0.72% ~ 0.88% 及 0.70%~0.85%	<u>\$ 19,845,000</u>	<u>\$ 10,400,000</u>

(二) 長期應付票券

	<u>110 年 12 月 31 日</u>	<u>109 年 12 月 31 日</u>
兆豐票券金融公司，將於 112 年 3 月償還，年利率 分別為 0.65%及 0.92% ~0.93%	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
中華票券金融公司，將於 112 年 3 月償還，年利率 分別為 0.65%及 0.90%	2,000,000	1,500,000

(接次頁)

(承 前 頁)

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
大慶票券金融公司，將於 112 年 3 月償還，年利率 分別為 0.65%及 0.91%	\$ 1,500,000	\$ 1,000,000
國際票券金融公司，將於 112 年 3 月償還，年利率 為 0.65%	<u>1,500,000</u>	<u>-</u>
	7,000,000	4,500,000
減：未攤銷折價	<u>979</u>	<u>1,346</u>
	<u>\$ 6,999,021</u>	<u>\$ 4,498,654</u>

八、應付公司債

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
國內無擔保公司債		
期間 5 年，將於 113 年 4 月到期一 次償還，每年付息，年利率 0.90%	\$ 6,500,000	\$ 6,500,000
期間 7 年，將於 115 年 4 月到期一 次償還，每年付息，年利率 1.03%	3,500,000	3,500,000
期間 5 年，將於 114 年 4 月到期一 次償還，每年付息，年利率 0.90%	10,000,000	10,000,000
期間 3 年，將於 112 年 8 月到期一 次償還，每年付息，年利率 0.72%	3,000,000	3,000,000
期間 5 年，將於 114 年 8 月到期一 次償還，每年付息，年利率 0.85%	5,000,000	5,000,000
期間 7 年，將於 116 年 8 月到期一 次償還，每年付息，年利率 0.95%	2,000,000	2,000,000
海外無擔保公司債		
美金 200,000 千元(新台幣計價)， 期間 3 年，將於 111 年 10 月到 期一次償還，每三個月付息，年 利率 2.15%	6,204,800	6,204,800

(接 次 頁)

(承前頁)

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
美金 100,000 千元(新台幣計價)， 期間 5 年，將於 113 年 10 月到 期一次償還，每三個月付息，年 利率 2.50%	<u>\$ 3,102,400</u>	<u>\$ 3,102,400</u>
	39,307,200	39,307,200
減：應付公司債折價	<u>34,789</u>	<u>48,290</u>
	39,272,411	39,258,910
減：一年內到期之應付公司債	<u>6,202,753</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 33,069,658</u>	<u>\$ 39,258,910</u>

九、權益

(一) 股本

普通股股本

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
額定股數(千股)	<u>5,500,000</u>	<u>5,500,000</u>
保留股數(千股)		
員工認股權	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>
額定股本	<u>\$ 55,000,000</u>	<u>\$ 55,000,000</u>
保留股本		
員工認股權	<u>\$ 4,000,000</u>	<u>\$ 4,000,000</u>
已發行且已收足股款之 股數(千股)	<u>4,408,650</u>	<u>4,351,592</u>

發行海外存託憑證

本公司發行 ADR，每單位表彰本公司普通股 2 股。截至 110 年及 109 年 12 月 31 日止，流通在外之 ADR 分別為 157,164 千單位及 107,964 千單位，折合本公司普通股分別約 314,328 千股及 215,927 千股。

(二) 資本公積

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本（註 1）		
股票發行溢價	\$ 16,049,286	\$ 13,548,426
企業合併股本溢價	117,693,658	117,693,658
實際取得或處分子公司 股權價格與帳面價值 差額	3,240,987	3,240,987
員工認股權執行	2,362,951	1,617,254
庫藏股票交易	816,186	510,449
認股權失效	645,903	645,903
	<u>140,808,971</u>	<u>137,256,677</u>
僅得用以彌補虧損		
採權益法認列關聯企業 資本公積之變動數	10,706	41,239
股東逾時效未領取及發 放不足一元之畸零現 金股利	5,183	3,550
	<u>15,889</u>	<u>44,789</u>
不得作為任何用途		
員工認股權	1,442,132	1,894,952
限制員工權利股票	1,193,782	-
其他（註 2）	230,943	569,681
	<u>2,866,857</u>	<u>2,464,633</u>
	<u>\$143,691,717</u>	<u>\$139,766,099</u>

註 1：此類資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

註 2：此類資本公積係員工認股權憑證執行時，相關會計科目帳面金額超過面額部分而截至資產負債表日尚未辦妥變更登記者。

（三）保留盈餘及股利政策

依本公司章程規定，每年度有純益時，依下列順序分派之：

1. 彌補虧損。
2. 提存百分之十為法定盈餘公積。

3. 依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
4. 其餘併同以前年度未分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議之；但盈餘分派以現金發放時，得由董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司章程規定之員工酬勞及董事酬勞分派政策，請參閱附註十(四)員工酬勞及董事酬勞。

本公司正處於企業穩定成長階段，為因應目前及未來業務擴展之資金需求，並滿足股東對現金流入之需求，本公司之股利政策係採取剩餘股利政策分派股利，其中現金股利發放之比例不低於股利總額 30%，餘額則配發股票股利，並由董事會擬具盈餘分配案，經股東會決議後辦理。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25%之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

本公司依金管證發字第 1090150022 號令及「採用國際財務報導準則（IFRSs）後，提列特別盈餘公積之適用疑義問答」規定提列及迴轉特別盈餘公積。

本公司於 110 年 8 月及 109 年 6 月舉行股東常會分別決議 109 及 108 年度盈餘分配案如下：

	盈 餘 分 配 案		每 股 股 利 (元)	
	109 年度	108 年度	109 年度	108 年度
法定盈餘公積	\$ 2,398,814	\$ 1,697,489		
特別盈餘公積(迴轉)	(1,278,670)	3,944,915		
現金股利	<u>18,389,856</u>	<u>8,668,331</u>	\$ 4.2	\$ 2.0
	<u>\$19,510,000</u>	<u>\$14,310,735</u>		

(四) 其他權益項目

1. 國外營運機構財務報表換算之兌換差額

	110 年度	109 年度
年初餘額	(\$11,641,040)	(\$ 10,761,785)
當年度產生		
採用權益法之子公司之份額	(3,751,707)	(909,226)
重分類調整		
處分採用權益法之子公司之份額	-	29,971
年底餘額	<u>(\$15,392,747)</u>	<u>(\$ 11,641,040)</u>

2. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益

	110 年度	109 年度
年初餘額	\$2,501,278	(\$ 85,912)
當年度產生未實現損益		
採用權益法之子公司之份額	<u>3,894,880</u>	<u>2,604,604</u>
本年度其他綜合損益	<u>3,894,880</u>	<u>2,604,604</u>
採用權益法之子公司處分權益工具累計損益		
移轉至保留盈餘	(<u>1,492,295</u>)	(<u>17,414</u>)
年底餘額	<u>\$4,903,863</u>	<u>\$2,501,278</u>

3. 避險工具之損益－國外營運機構淨投資避險

	110 年度	109 年度
年初餘額	(\$ 429,265)	\$ -
當年度產生		
採用權益法之子公司之份額	<u>551,098</u>	(<u>429,265</u>)
年底餘額	<u>\$ 121,833</u>	<u>(\$ 429,265)</u>

4. 員工未賺得酬勞

本公司於 110 年 8 月經股東會決議通過發行限制員工權利新股，相關說明參閱附註十三。

	110 年度
年初餘額	\$ -
本年度發行	(1,343,782)
採用權益法之子公司之份額	130,159
認列股份基礎給付費用	<u>48,632</u>
年底餘額	<u>(\$ 1,164,991)</u>

(五) 庫藏股票

收	回	原	因	買回以註銷 (千 股)	子 公 司 持 有 母 公 司 股 票 (千 股)	合 計 (千 股)
110 年 1 月 1 日股數				-	72,941	72,941
本年度增加				<u>53,067</u>	-	<u>53,067</u>
110 年 12 月 31 日股數				<u>53,067</u>	<u>72,941</u>	<u>126,008</u>
109 年 12 月 31 日股數				<u>-</u>	<u>72,941</u>	<u>72,941</u>

本公司於 110 年 11 月經董事會決議自 110 年 11 月 8 日至 111 年 1 月 7 日止，以每股 90~150 元之價格，買回本公司股份不超過 55,000 千股並辦理銷除，以維護公司信用及股東權益。當公司股價低於買回區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。截至 110 年 12 月 31 日止，本公司提前執行完畢已實際買回 55,000 千股，並分別於 110 年 12 月 31 日前及 111 年 1 月間分別交割 53,067 千股及 1,933 千股，實際買回平均價格分別為每股 104.2 元及 106.4 元。另本公司於 111 年 2 月經董事會決議以 111 年 2 月 25 日為減資基準日，辦理註銷此庫藏股票。

子公司於資產負債表日持有本公司普通股之相關資訊如下：

110 年 12 月 31 日	持 有 股 數 (千 股)	帳 面 金 額	公 允 價 值
ASE Test Limited	44,100	\$ 1,380,721	\$ 4,696,675

(接 次 頁)

(承前頁)

	持 有 股 數 (千 股)	帳 面 金 額	公 允 價 值
110 年 12 月 31 日			
J & R Holding Limited	23,352	\$ 381,709	\$ 2,486,975
台灣福雷電子股份有限公司	<u>5,489</u>	<u>196,677</u>	<u>584,620</u>
	<u>72,941</u>	<u>\$ 1,959,107</u>	<u>\$ 7,768,270</u>
109 年 12 月 31 日			
ASE Test Limited	44,100	\$ 1,380,721	\$ 3,585,349
J & R Holding Limited	23,352	381,709	1,898,508
台灣福雷電子股份有限公司	<u>5,489</u>	<u>196,677</u>	<u>446,287</u>
	<u>72,941</u>	<u>\$ 1,959,107</u>	<u>\$ 5,930,144</u>

上述公允價值係屬具公開市場報價之第 1 等級公允價值。

本公司持有之庫藏股票，依證券交易法規定不得質押，亦不得享有股利之分派及表決權等權利。子公司持有本公司股票視同庫藏股票處理，除不得參與本公司之現金增資及無表決權外，其餘與一般股東權利相同。

十、稅前淨利

(一) 其他利益

	110 年度	109 年度
子公司董監酬勞收入	\$ -	\$ 137,591
其 他	<u>93,210</u>	<u>79,015</u>
	<u>\$ 93,210</u>	<u>\$ 216,606</u>

(二) 財務成本

	110 年度	109 年度
公司債利息	\$ 492,114	\$ 411,894
銀行借款利息	164,852	319,510
關係人借款利息	38,513	179,786
租賃負債之利息	<u>66</u>	<u>-</u>
按攤銷後成本衡量之金融負債之利息費用總額	695,545	911,190
其他財務成本	<u>4,367</u>	<u>387</u>
	<u>\$ 699,912</u>	<u>\$ 911,577</u>

(三) 員工福利費用

	110 年度	109 年度
退職後福利		
確定提撥計畫	\$ 3,596	\$ 2,728
權益交割之股份基礎給付	65,842	41,530
其他員工福利	<u>551,172</u>	<u>412,798</u>
	<u>\$ 620,610</u>	<u>\$ 457,056</u>
依功能別彙總		
營業費用	<u>\$ 620,610</u>	<u>\$ 457,056</u>

(四) 員工酬勞及董事酬勞

本公司依章程規定，皆係按當年度扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之稅前利益分別以 0.01%～1.00%及 0.75%以下提撥員工酬勞及董事酬勞。

	110 年度		109 年度	
	估列比例	估列金額	估列比例	估列金額
員工酬勞	0.19%	\$121,935	0.20%	\$ 54,909
董事酬勞	0.30%	195,095	0.40%	109,818

年度個體財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

本公司於 110 年 3 月及 109 年 3 月董事會分別決議以現金配發 109 及 108 年度員工酬勞及董事酬勞，其與前一年度個體財務報告認列金額之差異分別為 818 千元及 3 千元，主要係估計改變，分別調整為 110 及 109 年度之損益。

	109 年度		108 年度	
	員工酬勞	董事酬勞	員工酬勞	董事酬勞
董事會決議配發金額	<u>\$ 54,909</u>	<u>\$109,000</u>	<u>\$ 34,400</u>	<u>\$ 68,800</u>
年度財務報告認列金額	<u>\$ 54,909</u>	<u>\$109,818</u>	<u>\$ 34,400</u>	<u>\$ 68,803</u>

有關本公司董事會決議之員工酬勞及董事酬勞資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

十一、所得稅

本公司之營利事業所得稅暨未分配盈餘之結算申報係與本公司之子公司日月光、矽品及環電採行連結稅制合併辦理，並於 110 及 109 年度分別認列應收連結稅制款 213,161 千元及 99,287 千元（帳列其他應收款－關係人）。

（一）認列於損益之所得稅

所得稅利益之主要組成項目如下：

	110 年度	109 年度
當期所得稅		
本年度產生者	(\$ 185,221)	(\$ 75,909)
以前年度調整	(243)	(227,631)
	<u>(\$ 185,464)</u>	<u>(\$ 303,540)</u>

會計所得與所得稅利益之調節如下：

	110 年度	109 年度
稅前淨利	<u>\$ 63,722,216</u>	<u>\$ 27,289,439</u>
	110 年度	109 年度
稅前淨利按法定稅率計算之所得		
稅費用	\$ 12,744,443	\$ 5,457,888
稅上不可減除之項目	78,450	170,756
免稅所得	(13,018,236)	(5,712,887)
暫時性差異之產生及迴轉	808	542
不可扣抵扣繳稅款	9,314	7,792
以前年度之當期所得稅費用於本年度之調整	(243)	(227,631)
	<u>(\$ 185,464)</u>	<u>(\$ 303,540)</u>

（二）認列於其他綜合損益之所得稅

	110 年度	109 年度
遞延所得稅		
採用權益法之子公司及關聯企業其他綜合損益份額	<u>(\$ 16,106)</u>	<u>\$ 111,234</u>

（三）所得稅核定情形

本公司 107 年度營利事業所得稅結算申報案件，業經稅捐稽徵機關之核定。

十二、每股盈餘

用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下：

本年度淨利

	110 年度	109 年度
淨 利	\$ 63,907,680	\$ 27,592,979
具稀釋作用潛在普通股之影響		
子公司潛在普通股之影響	(1,056,778)	(521,073)
用以計算稀釋每股盈餘之盈餘	<u>\$ 62,850,902</u>	<u>\$ 27,071,906</u>

股 數

單位：千股

	110 年度	109 年度
用以計算基本每股盈餘之普通股		
加權平均股數	4,305,348	4,265,732
具稀釋作用潛在普通股之影響		
員工認股權	58,113	22,086
員工酬勞	1,264	815
限制員工權利新股	943	-
用以計算稀釋每股盈餘之普通股		
加權平均股數	<u>4,365,668</u>	<u>4,288,633</u>

本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，於計算稀釋每股盈餘時，須假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度董事會決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

十三、股份基礎給付協議

(一) 本公司員工認股權計畫

本公司及子公司日月光為吸引並留任公司所需之專業人才，激勵員工並提昇員工向心力而發行員工認股權憑證，如附註一所述，日月光於共同轉換股份協議簽署前業已發行且給與之認股權憑證自 107 年 4 月 30 日起已由本公司概括承受履行義務，並將尚未執行之每單位員工認股權憑證轉換為 0.5 單位，轉

換後每單位員工認股權得認購本公司普通股 1 股，行使價格並依換股比率調整。本公司發行及概括承受之員工認股權憑證給與對象包含本公司及子公司之全職正式員工，且存續期間為 10 年，不得轉讓，持有認股權憑證之員工自被給與後屆滿 2 年才可行使被給與之一定比例之認股權。本公司概括承受之認股權，發行後遇有本公司普通股股份發生變動時，認股權執行價格依規定公式予以調整。本公司發行之認股權憑證，發行後遇有本公司普通股股份發生變動時，或發放普通股現金股利且每股發放金額占每股時價之比率超過 1.5% 者，認股權行使價格依規定公式予以調整。

110 及 109 年度本公司發行及概括承受之員工認股權憑證相關資訊如下：

認股權憑證單位 (千)	110 年度		109 年度	
	加權平均執行價格 (元)	單位 (千)	加權平均執行價格 (元)	單位 (千)
年初流通在外	144,767	\$ 56.9	170,786	\$ 57.0
本年度逾期失效	-	-	(1,006)	40.8
本年度沒收	(5,907)	52.3	(3,949)	58.0
本年度行使	(42,058)	61.4	(21,064)	49.2
年底流通在外	<u>96,802</u>	53.3	<u>144,767</u>	56.9
年底可行使	<u>49,696</u>	55.5	<u>67,388</u>	61.4

110 及 109 年度執行之員工認股權憑證，其於執行日之加權平均股價分別為 108.8 元及 68.5 元。

截至資產負債表日止，流通在外之員工認股權憑證相關資訊如下：

	執行價格 之範圍 (元)	加權平均剩餘 合約期限 (年)
110 年 12 月 31 日		
日月光第 5 次員工認股權憑證	\$ 73.0	3.7
本公司第 1 次員工認股權憑證	51.0	6.9
109 年 12 月 31 日		
日月光第 4 次員工認股權憑證	45.2	0.3
日月光第 5 次員工認股權憑證	73.0	4.7
本公司第 1 次員工認股權憑證	52.9	7.9

(二) 限制員工權利新股

本公司為吸引並留任本集團所需之專業人才，激勵員工及提昇員工向心力，於 110 年 8 月經股東常會決議通過發行 110 年度限制員工權利新股，並以 110 年 10 月 1 日為增資基準日發行新股 15,000 千股，每股面額 10 元，每股發行價格為新台幣 0 元（即無償發行）。給與日限制員工權利新股之公允價值為每股 92.4 元。本公司之員工獲配之股數為 4,080 千股。

員工既得股份之數額採分年結算及辦理發放，自 110 年 10 月 1 日起分三個年度既得，於各年度屆滿前達到特定之績效目標後方可既得所給與股份總數之三分之一。於達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分；有關股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等權利，及其他權利包括但不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，則與本公司已發行之普通股股份相同。前述所給與之限制員工權利新股於既得條件達成前須一併交付信託。

給與限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司無償收回並予以註銷。對於未既得之限制員工權利新股所配發之股利（包括現金股利、股票股利，以及以法定公積及資本公積配發之現金及股票）及所衍生之孳息，應於該等未既得股份經本公司無償收回並辦理註銷時，由信託保管機構全數返還予本公司。

本公司於 110 及 109 年度認列上述股份基礎給付計畫之酬勞成本分別為 65,842 千元及 41,530 千元。

十四、現金流量資訊

來自籌資活動之負債變動

110 年度

	應付公司債	長期借款	其他應付款－ 關係人	租賃負債	合計
年初餘額	\$ 39,258,910	\$ 14,898,654	\$ 25,470,176	\$ -	\$ 79,627,740
籌資活動之現金流量	-	11,897,243	(13,165,000)	(820)	(1,268,577)
非現金之變動					
新增租賃	-	-	-	8,505	8,505
折價攤銷	13,501	48,124	-	-	61,625
其 他	-	-	43	-	43
年底餘額	<u>\$ 39,272,411</u>	<u>\$ 26,844,021</u>	<u>\$ 12,305,219</u>	<u>\$ 7,685</u>	<u>\$ 78,429,336</u>

109 年度

	應付公司債	長期借款	其他應付款－ 關係人	合計
年初餘額	\$ 19,281,866	\$ 40,562,555	\$ 32,880,211	\$ 92,724,632
籌資活動之現金流量	19,967,149	(25,722,948)	(7,410,000)	(13,165,799)
非現金之變動				
折價攤銷	9,895	59,047	-	68,942
其 他	-	-	(35)	(35)
年底餘額	<u>\$ 39,258,910</u>	<u>\$ 14,898,654</u>	<u>\$ 25,470,176</u>	<u>\$ 79,627,740</u>

十五、資本風險管理

本公司資本結構係由淨債務及權益組成，而資本管理的目標是保障本公司能夠持續經營，並進而藉由將債務及權益餘額最適化，以使股東報酬極大化，是以定期檢視內容包括考量各類資本之成本及相關風險，並藉由支付股利、發行新股、買回股份及發行新債或償付舊債等方式平衡其整體資本結構。

十六、金融工具

(一) 金融工具之種類

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
<u>金 融 資 產</u>		
按攤銷後成本衡量（註 1）	\$ 334,465	\$ 212,715
<u>金 融 負 債</u>		
按攤銷後成本衡量（註 2）	78,963,085	79,985,432

註 1：餘額係為現金及其他應收款－關係人等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註 2：餘額係包含其他應付款（含關係人）、應付公司債（含一年內到期）及長期借款等以攤銷後成本衡量之金融負債。

(二) 財務風險管理目的與政策

本公司係產業投資控股公司，有關本公司及子公司之財務風險管理目的與政策，請參閱本公司 110 年度合併財務報告附註三四。

1. 市場風險－利率風險

本公司除發行固定利率之公司債及舉借固定利率之借款外，主係以浮動利率借入資金，因而產生利率暴險，市場利率變動將使借款之有效利率隨之變動，而產生未來現金流量之波動。本公司將運用低利率之融資工具，採用有利之利率條件，以維持低融資成本及適足活絡之融資額度為主，規避營運上可能產生之利率風險。

本公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
具公允價值利率風險		
金融資產	\$ 141	\$ -
金融負債	39,314,885	40,758,910
具現金流量利率風險		
金融資產	121,304	113,427
金融負債	39,150,219	38,868,830

對於浮動利率之資產及負債，本公司內部向主要管理階層報告利率風險時所使用之變動率為 100 個基點，若資產負債表日利率變動 100 個基點（1%），在所有其他變數維持不變之情況下，本公司 110 及 109 年度之稅前淨利將分別增減約 391,000 千元及 388,000 千元。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成本公司財務損失之風險。本公司之信用風險，主要係來自於現金。最大之信用風險暴險與個體資產負債表上之金融資產帳面價值相同。

3. 流動性風險

本公司透過管理適當之融資額度以支應公司營運之現金流量需求，另亦監督銀行融資額度使用狀況並確保借款合同條款之遵循，故未有因無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

本公司可被要求立即清償之金融負債，係列於下表中最早之期間內，不考慮交易對手立即執行該權利之機率；其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

以浮動利率支付之利息現金流量，其未折現之利息金額係依據資產負債表日之利率做為估計未來利息現金流量之基礎。

110 年 12 月 31 日

	要求即付或 短於 1 個月	1 至 3 個月	3 個 月 至 1 年	1 至 5 年	超過 5 年
非 衍 生 金 融 負 債					
無附息負債	\$ 29,833	\$ 5,235	\$ 163,891	\$ -	\$ -
租賃負債	74	148	664	3,543	3,543
浮動利率工具	10,267,490	34,555	2,210,612	26,957,154	-
固定利率工具	52,741	-	6,630,672	32,013,820	2,019,000
	<u>\$10,350,138</u>	<u>\$ 39,938</u>	<u>\$ 9,005,839</u>	<u>\$58,974,517</u>	<u>\$ 2,022,543</u>

上述金融負債到期分析之進一步資訊如下：

	短 於 1 年	1 ~ 5 年	5 ~ 10 年
租賃負債	<u>\$ 886</u>	<u>\$ 3,543</u>	<u>\$ 3,543</u>

109 年 12 月 31 日

	要求即付或 短於 1 個月	1 至 3 個月	3 個 月 至 1 年	1 至 5 年	超過 5 年
非 衍 生 金 融 負 債					
無附息負債	\$ 6,459	\$ 4,484	\$ 166,278	\$ -	\$ -
浮動利率工具	23,489	9,646,979	16,007,139	13,481,511	-
固定利率工具	41,009	82,019	369,085	36,490,031	5,543,683
	<u>\$ 70,957</u>	<u>\$ 9,733,482</u>	<u>\$16,542,502</u>	<u>\$49,971,542</u>	<u>\$ 5,543,683</u>

上述非衍生金融負債之浮動利率工具金額，將因浮動利率與資產負債表日所估計之利率不同而改變。

十七、關係人交易

本公司與關係人間之重大交易如下：

(一) 關係人之名稱及關係

關 係 人 名 稱	與 本 公 司 之 關 係
日 月 光	子 公 司
矽 品	子 公 司
台灣福雷電子股份有限公司 (台灣福雷)	子 公 司
日月光電子股份有限公司 (日月光電子)	子 公 司
日月瑞股份有限公司 (日月瑞)	子 公 司

(二) 向關係人借款 (帳列其他應付款－關係人)

關 係 人 類 別 / 名 稱	110 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日
子 公 司		
矽 品	\$ 10,000,000	\$ 9,500,000
台灣福雷	1,525,000	5,420,000
日 月 光	-	9,600,000
其 他	780,000	950,000
	<u>\$ 12,305,000</u>	<u>\$ 25,470,000</u>

利息費用

關 係 人 類 別 / 名 稱	110 年 度	109 年 度
子 公 司		
日 月 光	\$ 12,695	\$139,992
台灣福雷	13,862	20,245
矽 品	8,226	11,761
其 他	3,730	7,788
	<u>\$ 38,513</u>	<u>\$179,786</u>

本公司向關係人借款之借款利率與市場利率相當，且皆為無擔保借款。

(三) 對主要管理階層之獎酬

	110 年 度	109 年 度
短期員工福利	\$331,999	\$142,039
股份基礎給付	73,729	36,695
	<u>\$405,728</u>	<u>\$178,734</u>

董事及其他主要管理階層之薪酬係依照個人績效及市場趨勢決定。

十八、附註揭露事項

(一) 重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊

1. 資金貸與他人：詳附表一。
2. 為他人背書保證：詳附表二。
3. 年底持有有價證券情形：詳附表三。
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20%以上者：詳附表四。
5. 取得不動產之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20%以上者：詳附表五。
6. 處分不動產之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20%以上者：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣 1 億元或實收資本額 20%以上者：詳附表六。
8. 應收關係人款項達新台幣 1 億元或實收資本額 20%以上者：詳附表七。
9. 從事衍生工具交易：詳合併財務報告附註七。
10. 被投資公司資訊（對非屬大陸地區之被投資公司直接或間接具重大影響、控制或聯合控制者）：詳附表八。

(三) 大陸投資資訊

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、本年度損益及認列之投資損益、年底投資帳面價值、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額：詳附表九。
2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，及其價格、付款條件、未實現損益：
 - (1) 進貨金額及百分比與相關應付款項之年底餘額及百分比：詳附表六。
 - (2) 銷貨金額及百分比與相關應收款項之年底餘額及百分比：詳附表六。
 - (3) 財產交易金額及其所產生之損益數額：無重大交易。
 - (4) 票據背書保證或提供擔保品之年底餘額及其目的：無。

(5) 資金融通之最高餘額、年底餘額、利率區間及當年度利息總額：詳附表一。

(6) 其他對當年度損益或財務狀況有重大影響之交易事項，如勞務之提供或收受等：無。

(四) 主要股東資訊：股權比例達 5% 以上之股東名稱、持股數額及比例。（附表十）

日月光投資控股股份有限公司及轉投資公司
資金貸與他人

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表一

單位：新台幣千元

編號	資金貸與他人名稱	貸與對象	貸與科目	是否集團內人	本年度最高額度餘額 \$	年底餘額 \$	資產實際動支餘額 \$	資產實際動支金額 \$	利率區間(%)	資金管理性質	業務往來金額	有短期融通 資金必要之原因	提列備抵呆帳金額	總 名	帳 價	估 價	品 類	個 數	別 類	對 象	實 收 金 額	貸 與 金 額	最高 額
1	日月光	本公司	其他應收款-關係人	是	20,600,000	10,000,000	-	-	0.77~0.79	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	58,997,490 (註1)	58,997,490 (註1)	58,997,490 (註2)	
2	台灣福雷電子公司	本公司	其他應收款-關係人	是	7,650,000	4,680,000	1,525,000	1,525,000	0.59	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	11,469,166 (註1)	11,469,166 (註1)	11,469,166 (註2)	
3	元隆電子公司	本公司	其他應收款-關係人	是	1,000,000	1,000,000	-	-	3.50	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	11,469,166 (註1)	11,469,166 (註1)	11,469,166 (註2)	
4	日月光電子公司	本公司	其他應收款-關係人	是	1,000,000	1,000,000	780,000	780,000	0.59	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	1,534,987 (註1)	1,534,987 (註1)	1,534,987 (註2)	
5	A.S.E. Holding Limited	ASE Test Limited	長期應收款-關係人	是	1,597,960	1,503,024	-	1,503,024	-	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	17,568,802 (註1)	17,568,802 (註1)	17,568,802 (註2)	
6	日月光	ASE Test Limited	長期應收款-關係人	是	256,815	-	-	-	-	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	80,292,062 (註1)	80,292,062 (註1)	80,292,062 (註2)	
7	Global Advanced Packaging Technology Limited	日月光	長期應收款-關係人	是	9,778,560	1,503,024	0	1,503,024	0.59~0.68	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	30,002,498 (註1)	30,002,498 (註1)	30,002,498 (註2)	
8	ISE Labs, Inc.	日月光	長期應收款-關係人	是	3,892,000	3,875,200	3,847,520	3,847,520	0.49	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	30,002,498 (註1)	30,002,498 (註1)	30,002,498 (註2)	
9	ASE (Korea) Inc.	日月光	其他應收款-關係人	是	6,200,460	4,290,400	4,124,520	4,124,520	0.48~1.09	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	30,002,498 (註1)	30,002,498 (註1)	30,002,498 (註2)	
10	ASE Japan Co., Ltd.	日月光	長期應收款-關係人	是	885,760	885,760	885,760	885,760	-	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	45,938,092 (註1)	45,938,092 (註1)	45,938,092 (註2)	
11	ASE Singapore Pte. Ltd.	日月光	其他應收款-關係人	是	2,768,000	2,768,000	2,768,000	2,768,000	-	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	45,938,092 (註1)	45,938,092 (註1)	45,938,092 (註2)	
12	ASE (U.S.) Inc.	日月光	長期應收款-關係人	是	856,050	830,400	830,400	830,400	0.60~0.68	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	2,397,139 (註1)	2,397,139 (註1)	2,397,139 (註2)	
13	日月光半導體 (昆山) 有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	567,800	332,160	332,160	332,160	0.57~0.64	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	2,397,139 (註1)	2,397,139 (註1)	2,397,139 (註2)	
14	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	8,201,000	8,165,600	8,027,200	8,027,200	2.08~2.14	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	17,857,225 (註1)	17,857,225 (註1)	17,857,225 (註2)	
15	日月光集成電路製造 (中國) 有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	814,800	481,000	481,000	481,000	0.53~0.54	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	1,801,539 (註1)	1,801,539 (註1)	1,801,539 (註2)	
16	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	353,080	-	-	-	0.48~0.49	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	1,801,539 (註1)	1,801,539 (註1)	1,801,539 (註2)	
17	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	51,060	48,100	48,100	48,100	0.48~0.49	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	1,801,539 (註1)	1,801,539 (註1)	1,801,539 (註2)	
18	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	1,483,820	-	-	-	0.60~0.68	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	6,265,794 (註1)	6,265,794 (註1)	6,265,794 (註2)	
19	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	長期應收款-關係人	是	798,980	498,240	498,240	498,240	0.48~0.54	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	6,265,794 (註1)	6,265,794 (註1)	6,265,794 (註2)	
20	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	長期應收款-關係人	是	1,195,400	1,190,240	1,190,240	1,190,240	0.49	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	6,265,794 (註1)	6,265,794 (註1)	6,265,794 (註2)	
21	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	199,745	193,760	193,760	193,760	0.60~0.68	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	577,619 (註1)	577,619 (註1)	577,619 (註2)	
22	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	1,974	-	-	-	2.90	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	6,100,524 (註1)	6,100,524 (註1)	6,100,524 (註2)	
23	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	1,096,834	-	-	-	3.24	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	6,100,524 (註1)	6,100,524 (註1)	6,100,524 (註2)	
24	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	871,555	781,467	312,587	312,587	3.0~3.2	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	6,100,524 (註1)	6,100,524 (註1)	6,100,524 (註2)	
25	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	438,733	434,148	434,148	434,148	4.35	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	19,472,095 (註1)	19,472,095 (註1)	19,472,095 (註2)	
26	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	3,704,110	1,953,668	1,953,668	1,953,668	4.35	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	19,472,095 (註1)	19,472,095 (註1)	19,472,095 (註2)	
27	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	131,620	130,245	130,245	130,245	4.35	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	19,472,095 (註1)	19,472,095 (註1)	19,472,095 (註2)	
28	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	348,622	347,319	347,319	347,319	4.35	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	19,472,095 (註1)	19,472,095 (註1)	19,472,095 (註2)	
29	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	1,307,333	1,302,445	-	-	4.90	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	19,472,095 (註1)	19,472,095 (註1)	19,472,095 (註2)	
30	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	1,797,705	913,440	913,440	913,440	0.54~0.68	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	3,025,109 (註1)	3,025,109 (註1)	3,025,109 (註2)	
31	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	87,747	-	-	-	3.20	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	3,025,109 (註1)	3,025,109 (註1)	3,025,109 (註2)	
32	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	2,048	2,040	2,040	2,040	3.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	-	-	-	3,025,109 (註1)	3,025,109 (註1)	3,025,109 (註2)	
33	上海鼎匯房地產開發有限公司	日月光	其他應收款-關係人	是	1,307,333	1,302,445	1,302,445	1,302,445	3.00	短期融通	-	營運週轉	-	-	-	-	-	-	-	3,025,109 (註1)	3,025,109 (註1)	3,025,109 (註2)	

(接次頁)

(承前頁)

編號	貸 金 公 司 名 稱	貸 金 對 象	往 來 表 項 目	是否為關係人	本 年 度 最 高 額 度 餘 額	年 底 額 度	年 底 實 際 動 支 餘 額	利率區間 (%)	資金管見性質	票 務 往 來 金 額	有 組 期 融 通 資 金 必 要 之 原 因	擔 保 條 件	品 對 價	細 別 貸 款 金 額	對 別 限 期 限	象 資 金 限 期 限	金 貨 與 最 額
					\$	\$	\$			\$			\$	\$		\$	
16	日月光半導體(威海)有限公司(註5)	日月光投資(昆山)有限公司 日月光封裝測試(上海)有限公司 砂品科技(蘇州)有限公司 蘇州日月新半導體有限公司(註5)	其他應收款－關係人	是	2,048	2,040	2,040	3.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	3,025,109 (註3)	3,025,109 (註3)
			其他應收款－關係人	是	1,307,333	1,302,445	1,202,591	3.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	3,025,109 (註3)	3,025,109 (註3)
			其他應收款－關係人	是	1,623,314	-	-	3.24	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	4,476,325 (註3)	4,476,325 (註3)
			其他應收款－關係人	是	1,960,999	1,953,668	1,758,301	3.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	4,476,325 (註3)	4,476,325 (註3)
17	日榮半導體(上海)有限公司(註5)	日月光半導體(上海)有限公司 日月光封裝測試(上海)有限公司 蘇州日月新半導體有限公司(註5)	其他應收款－關係人	是	175,493	-	-	3.20	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	3,671,567 (註3)	3,671,567 (註3)
			其他應收款－關係人	是	1,575,053	-	-	2.85	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	3,671,567 (註3)	3,671,567 (註3)
			其他應收款－關係人	是	2,091,733	2,083,912	1,845,131	3.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	3,671,567 (註3)	3,671,567 (註3)
			其他應收款－關係人	是	217,889	217,074	195,367	3.69	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	402,711 (註3)	402,711 (註3)
19	USI Enterprise Limited	日 月 光 環電公司	其他應收款－關係人	是	4,826,300	2,491,200	-	0.60~0.68	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	19,631,795 (註1)	19,631,795 (註2)
			其他應收款－關係人	是	3,337,200	1,660,800	1,660,800	0.60~0.68	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	19,631,795 (註1)	19,631,795 (註2)
20	Huntington Holdings International Co. Ltd.	日 月 光 環電公司	其他應收款－關係人	是	170,340	-	-	-	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	20,337,305 (註1)	20,337,305 (註2)
			其他應收款－關係人	是	1,476,280	-	-	-	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	20,138,244 (註1)	20,138,244 (註2)
21	Roal Tech Holdings Limited	USI Enterprise Limited	其他應收款－關係人	是	1,483,320	1,079,520	1,079,520	-	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	20,138,244 (註1)	20,138,244 (註2)
			其他應收款－關係人	是	3,427,320	888,297	-	0.60~1.75	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	2,407,482 (註1)	2,407,482 (註2)
23	Universal Global Technology Co., Limited	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V. 環鴻科技公司 環發電子公司 環發電子(深圳)有限公司	其他應收款－關係人	是	1,426,750	1,107,200	1,107,200	0.53~0.60	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	22,211,955 (註3)	22,211,955 (註3)
			其他應收款－關係人	是	2,980,950	553,600	553,600	0.60~0.68	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	8,884,782 (註1)	8,884,782 (註2)
			其他應收款－關係人	是	1,537,800	1,522,400	1,522,400	0.60~0.64	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	8,884,782 (註1)	8,884,782 (註2)
			其他應收款－關係人	是	1,716,391	1,661,570	1,661,570	0.60	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	22,211,955 (註3)	22,211,955 (註3)
24	環發電子公司	ASTELFLASH USA CORP. ASTELFLASH GROUP	其他應收款－關係人	是	279,600	276,800	193,760	0.69~0.72	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	22,211,955 (註3)	22,211,955 (註3)
			其他應收款－關係人/長期應收款－關係人	是	2,499,615	2,499,615	1,245,600	1.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	22,211,955 (註3)	22,211,955 (註3)
			其他應收款－關係人	是	1,100,000	900,000	900,000	0.59	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	1,311,996 (註1)	1,311,996 (註2)
			其他應收款－關係人	是	1,220,770	-	-	0.60	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	3,124,026 (註1)	3,124,026 (註2)
26	環鴻電子(上海)有限公司	環鴻電子公司 環鴻電子(昆山)有限公司	其他應收款－關係人	是	1,284,075	1,107,200	-	0.60	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	3,124,026 (註1)	3,124,026 (註2)
			其他應收款－關係人	是	871,555	868,297	868,297	1.75	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	3,124,026 (註1)	3,124,026 (註2)
			其他應收款－關係人	是	1,426,750	1,384,000	830,400	0.53~0.55	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	22,734,486 (註1)	22,734,486 (註2)
			其他應收款－關係人	是	2,282,800	2,214,400	1,882,240	0.51~0.52	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	22,734,486 (註1)	22,734,486 (註2)
27	Universal Scientific Industrial (France) GmbH	ASTELFLASH HERSELD GmbH ASTELFLASH FRANCE ASTELFLASH TUNISE S.A. ASTELFLASH FLZEN S.R.O.	長期應收款－關係人	是	343,700	313,504	285,288	1.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	10,480,877 (註3)	10,480,877 (註3)
			其他應收款－關係人	是	777,234	736,734	736,734	1.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	4,192,351 (註1)	4,192,351 (註2)
			其他應收款－關係人/長期應收款－關係人	是	453,386	438,905	398,150	1.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	10,480,877 (註3)	10,480,877 (註3)
			長期應收款－關係人	是	103,110	94,051	94,051	1.00	短期融通	-	營運需要	-	-	-	-	10,480,877 (註3)	10,480,877 (註3)

(接次頁)

(承前頁)

編號	資金貸與他人名稱	貸與對象	往來項目	是否為關係人	本年度及最高期末總額 \$	本年度及最高期末總額 \$	利息週轉率(%)	資金使用性質	業務往來金額	有無必要之原因	提供擔保品名稱	擔保金額	對價金額	償還期限	資金貸與最高額	資金貸與最高額
28	ASTEELFLASH GROUP	ASTEELFLASH (OHIO) LIMITED ASTEELFLASH TUNISIE S.A. ASTEELFLASH GERMANY GmbH ASTEELFLASH TIZEN S.R.O. ASTEELFLASH EBERBACH GmbH ASTEELFLASH RONNI GmbH	其他應收款－關係人 其他應收款－關係人 其他應收款－關係人 其他應收款－關係人 其他應收款－關係人 其他應收款－關係人	是 是 是 是 是 是	140,753 652,270 206,220 191,237 109,726 47,026	128,537 595,657 28,215 191,237 109,726 47,026	1.25-1.75 1.25-1.75 1.00-1.75 1.00 1.00 1.00	短期融通 短期融通 短期融通 短期融通 短期融通 短期融通	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	1,930,776 (註1) 1,930,776 (註1) 1,930,776 (註1) 1,930,776 (註1) 1,930,776 (註1) 1,930,776 (註1)	1,930,776 (註2) 1,930,776 (註2) 1,930,776 (註2) 1,930,776 (註2) 1,930,776 (註2) 1,930,776 (註2)			
29	FINANCIERE AFG	ASTEELFLASH GROUP	其他應收款－關係人	是	102,293	65,836	1.25-1.75	短期融通	-	管理需要	-	-	3,024,728 (註1)	-	3,024,728 (註2)	3,024,728 (註2)
30	ASTEELFLASH FRANCE	ASTEELFLASH GROUP SER(註6)	其他應收款－關係人 其他應收款－關係人	是 是	273,264 442,248	249,256	1.25 1.00	短期融通 短期融通	- -	管理需要 管理需要	- -	- -	727,213 (註1) 727,213 (註1)	- -	727,213 (註2) 727,213 (註2)	727,213 (註2) 727,213 (註2)
31	ASTEELFLASH TECHNOLOGIE	ASTEELFLASH FRANCE	其他應收款－關係人	是	51,555	-	1.25	短期融通	-	管理需要	-	-	137,508 (註1)	-	137,508 (註2)	137,508 (註2)
32	ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE(註7)	ASTEEL ELECTRONIQUE FOUCHANA(註7)	其他應收款－關係人	是	134,980	-	1.25	短期融通	-	管理需要	-	-	182,554 (註1)	-	182,554 (註2)	182,554 (註2)
33	德銘電子（蘇州）有限公司	ASTEELFLASH GROUP Universal Global Technology Co., Limited	其他應收款－關係人 其他應收款－關係人	是 是	1,284,075 1,253,250	- 1,245,600	2.00 1.00	短期融通 短期融通	- -	管理需要 管理需要	- -	- -	1,831,617 (註1) 1,831,617 (註1)	- -	1,831,617 (註2) 1,831,617 (註2)	1,831,617 (註2) 1,831,617 (註2)
34	ASTEELFLASH GERMANY GmbH	ASTEELFLASH EBERBACH GmbH ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBURG GmbH	其他應收款－關係人 其他應收款－關係人	是 是	79,051 30,933	72,106 28,215	1.25-1.75 1.25-1.75	短期融通 短期融通	- -	管理需要 管理需要	- -	- -	186,424 (註1) 186,424 (註1)	- -	186,424 (註2) 186,424 (註2)	186,424 (註2) 186,424 (註2)
35	砂品	砂品科技（蘇州）有限公司 本公司	其他應收款－關係人 其他應收款－關係人	是 是	1,392,500 10,000,000	1,384,000 10,000,000	0.63-3.49 0.59	短期融通 短期融通	- -	管理需要 管理需要	- -	- -	37,530,555 (註1) 37,530,555 (註1)	- -	37,530,555 (註2) 37,530,555 (註2)	37,530,555 (註2) 37,530,555 (註2)

註 1：子公司對個別對象資金貸與限額為不超過該貸出資金之公司淨值之百分之四十。

註 2：因公司間或與行號間有短期融通資金之必要而將資金貸與他人之總額度為該貸出資金之公司淨值之百分之四十。

註 3：有關本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間或本公司之國內公開發行子公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對該國內公開發行子公司從事資金貸與，其資金貸與總額及個別對象之限額，以不超過貸出企業最近期財務報表淨值之百分之百為限。

註 4：已於編製合併報告時沖銷。

註 5：編號 13、15、16 和 17：本集團於 110 年 12 月將日月光半導體（昆山）有限公司、日月光半導體（威海）有限公司、日榮半導體（上海）有限公司及蘇州日月新半導體有限公司處分子北京智路資產管理有限公司之指定從屬公司，自 110 年 12 月起不納入本集團合併個體。

註 6：編號 30 之貸出資金之公司 ASTEELFLASH FRANCE 已於 110 年 12 月吸收合併貸與對象 SER 公司。

註 7：編號 32 之貸出資金之公司 ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE 及貸與對象 ASTEEL ELECTRONIQUE FOUCHANA，均已於 110 年 12 月由其母公司 ASTEELFLASH TUNISIE S.A.(Tunisia)吸收合併。其資金貸與總額及個別對象之限額，以其母公司淨值計算表達。

日月光投資控股股份有限公司及轉投資公司
為他人背書保證

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表二

單位：新台幣千元

編號	背書保證公司名稱	被背書公司名稱	背書名稱	關係	對象單一企業背書保證金額（註1） \$	本年度最 高 度 餘 額 \$	年度最 高 度 餘 額 \$	年底 實 際 支 出 餘 額 \$	以財產擔保之 背書保證金額 \$	累計背書保證 金額佔最近期 財務報表淨值 之比率（%）	背書保證最高 額（註2） \$	屬母公司對子公司 背書保證 是	屬子公司對母公司 背書保證 否	屬對大陸地區 背書保證 否
1	USI Enterprise Limited	Universal Scientific Industrial (France)	元隆電子公司	間接持有表決權股份 超過50%之子公司	68,711,282	1,221,428	1,184,830	1,184,830	-	2.41	73,619,231	是	否	否
2	元隆電子公司	ASTEELFLASH GROUP	ASTEELFLASH USA CORP.	（註3） 間接持有表決權股份 超過50%之子公司	262,742	103,500	-	-	-	-	281,510	否	否	否
3	ASTEELFLASH GROUP	ASTEELFLASH GERMANY GmbH	ASTEELFLASH HERSFELD GmbH	直接持有表決權股份 超過50%之子公司	6,757,717	142,675	138,400	138,400	-	2.87	7,240,412	是	否	否
			ASTEELFLASH BONN GmbH	間接持有表決權股份 超過50%之子公司	6,757,717	223,405	203,777	203,777	-	7.09	7,240,412	是	否	否
			ASTEELFLASH EBERBACH GmbH	間接持有表決權股份 超過50%之子公司	6,757,717	223,405	203,777	203,777	-	7.09	7,240,412	是	否	否
			ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	直接持有表決權股份 超過50%之子公司	6,757,717	223,405	203,777	203,777	-	7.09	7,240,412	是	否	否
			ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.	直接持有表決權股份 超過50%之子公司	6,757,717	134,980	125,401	125,401	-	9.69	7,240,412	是	否	否
4	FINANCIERE AFG	ASTEELFLASH FRANCE	ASTEELFLASH GROUP	間接持有表決權股份 超過50%之子公司	10,586,548	236,215	219,453	219,453	-	2.90	11,342,730	是	否	否
			ASTEELFLASH HERSFELD GmbH	直接持有表決權股份 超過50%之子公司	10,586,548	236,215	219,453	219,453	-	2.90	11,342,730	是	否	否
			ASTEELFLASH EBERBACH GmbH	間接持有表決權股份 超過50%之子公司	10,586,548	236,215	219,453	219,453	-	5.80	11,342,730	是	否	否
			ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBURG GmbH	間接持有表決權股份 超過50%之子公司	10,586,548	236,215	219,453	219,453	-	5.80	11,342,730	是	否	否
5	飛旭電子（蘇州）有限公司	Universal Scientific Industrial (France)	元隆電子公司	間接對公司持有表決權之股份 超過50%之公司	6,410,660	1,653,506	-	-	-	-	6,868,565	否	是	否
6	ASTEELFLASH USA CORP.	Universal Scientific Industrial (France)	ASTEELFLASH GROUP	間接對公司持有表決權之股份 超過50%之公司	627,507	642,676	-	-	-	-	672,329	否	是	否
7	ASTEELFLASH EBERBACH GmbH	Universal Scientific Industrial (France)	ASTEELFLASH HERSFELD GmbH	間接對公司持有表決權之股份 超過50%之公司	126,071	201,066	-	-	-	-	135,077	否	是	否
8	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	Universal Scientific Industrial (France)	ASTEELFLASH BONN GmbH	間接對公司持有表決權之股份 超過50%之公司	638,938	455,912	-	-	-	-	684,576	否	是	否

註 1： 依本公司「背書保證作業程序」，子公司對單一企業之背書保證額度以不超過該公司最近期財務報表淨值之百分之一百四十為限。

註 2： 依本公司「背書保證作業程序」，子公司背書保證責任總額以不超過該公司最近期財務報表淨值之百分之五百五十為限。

註 3： 元隆電子公司背書保證之原因係為融資之目的而開立本票予非金融事業作擔保。

日月光投資控股股份有限公司及轉投資公司
年底持有有價證券情形明細表
民國 110 年 12 月 31 日

附表三

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

持 有 之 公 司	有 價 證 券 種 類 及 名 稱	與 有 價 證 券 發 行 人 之 關 係	目 錄 科 別	生 股 數 ／ 單 位	帳 數	面 金 額	持 股 比 率 (%)	底	
								允 公	價 值 備 註
日 月 光	神通資訊科技公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	2,521	\$	30	-	\$	30
	亞太新興產業創業投資公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,814,200		30,757	7		30,757
	晶錡科技公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	333,334		-	6		-
	有限合夥 Ripley Cable Holdings I, L.P.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	-		-	4		-
台 灣 福 雷 電 子 公 司	最 終 母 公 司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	5,489,388		584,620	-		584,620
	實德電化材科技公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	33,560,184		-	2		-
	神通資訊科技公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	680,017		8,006	-		8,006
	Ainos Inc.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	100,000,000		203,787	15		203,787
	新展資本公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	20,000,000		133,978	17		133,978
	匯豐控股有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	400,000		66,579	-		66,579
	騰訊控股有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	194,000		305,284	-		305,284
	中國工商銀行公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	11,000,000		172,162	-		172,162
	中國平安保險（集團）公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	1,000,000		199,809	-		199,809
	中國建設銀行公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	10,402,000		199,350	-		199,350
	友邦保險控股有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	300,000		84,271	-		84,271
	招商銀行公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	2,200,000		472,372	-		472,372
	中國人壽保險公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	1,000,000		45,782	-		45,782
	中銀香港（控股）有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	1,900,000		172,623	-		172,623
	中國移動通信集團公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	600,000		100,188	-		100,188

(接次頁)

(承前頁)

持 有 之 公 司	有 價 證 券 種 類 及 名 稱	與 有 價 證 券 發 行 人 之 關 係	帳 目	年 度 數 / 單 位 數	帳 面 金 額	持 股 比 率 (%)	公 允 價 值	備 註
	長江和記實業有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－ 流動	200,000	\$ 36,342	-	\$ 36,342	
	中國農業銀行公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－ 流動	16,300,000	155,613	-	155,613	
	中國銀行公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－ 流動	16,700,000	167,729	-	167,729	
	阿里巴巴集團控股有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－ 流動	360,000	140,413	-	140,413	
特 別 股	漢通創業投資公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－ 非流動	25,000,000	275,000	25	275,000	
公 司 債	南山人壽保險股份有限公司105年度第 一期無到期日累積次順位公司債	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產－非流動	1,000	1,076,458	-	1,076,458	
基 金	元大高股息優質龍頭基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－ 流動	5,000,000	71,350	-	71,350	
股 票	力晶科技公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產－非流動	1,016,060	37,118	-	37,118	
	力晶積成電子製造公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產－非流動	1,434,320	102,124	-	102,124	
股 票	聯華電子公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－ 流動	89,659	5,828	-	5,828	
	鴻海精密工業公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－ 流動	568	59	-	59	
	華邦電子公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－ 流動	5,893	200	-	200	
A.S.E. Holding Limited	SiPhoton, Inc.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產－非流動	544,800	-	4	-	
	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－ 流動	37,766	880千元	-	美金 880千元	
J & R Holding Limited	本公司	最終母公司	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產－非流動	23,351,881	美金 89,847千元	1	美金 89,847千元	
有限合夥	Crimson Velocity Fund, L.P.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產－非流動	-	美金 333千元	-	美金 333千元	
私募基金	Wise Road Industry Investment Fund I, L.P.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－ 非流動	-	美金 22,315千元	6	美金 22,315千元	

(接次頁)

(承前頁)

持 有 之 公 司	有 價 證 券 種 類 及 名 稱	與 有 價 證 券 發 行 人 之 關 係	帳 列 科 目	生 股 數 / 單 位 數	帳 面 金 額	持 股 比 率 (%)	公 允 價 值	備 註
ASE Test Limited	本公司股票	最終母公司	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	44,100,236 (註)	美金	1	169,678千元	
	特別股 SVXR, Inc.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	8,831,377	-	13	-	
ASE Corporation	特別股 靈峰計算(香港)公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	1,630,444	美金	4	3,000千元	
日月光半導體(上海)有限公司	債券 環旭電子公司無擔保可轉換公司債券	子公司	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	283,970	人民幣	1	34,508千元	
環電公司	股票 全球創業投資公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	6,200,000	\$	5	35,408	35,408
	行動檢測服務公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	275,000	-	4	-	-
	威力賜公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	500,744	13,188	1	13,188	13,188
	精磁科技公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	733,000	-	2	-	-
	特別股 愛微科公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	180,000	95	1	95	95
Huntington Holdings International Co. Ltd.	股票 Superactive Group Company Limited	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	5,548,800	美金	-	144千元	144千元
	Cadence Design SYS Inc.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	9,633	美金	-	1,795千元	1,795千元
	Solid Gain Investments Ltd.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	1,291,400	美金	20	474千元	474千元
	特別股 Techgains I Corporation	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	518,316	美金	10	170千元	170千元
	Techgains II Corporation	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	653,998	美金	4	114千元	114千元
Unittech Holdings International Co., Ltd.	股票 Superactive Group Company Limited	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	5,613,600	美金	-	146千元	146千元
	Wacom Co., Ltd.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	1,200,000	美金	1	9,550千元	9,550千元
	Sequans Communications SA	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	370,554	美金	-	439千元	439千元
	Asia Global Venture Co., Ltd.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	445,740	美金	10	565千元	565千元

(接次頁)

(承前頁)

持 有 之 公 司	有 價 證 券 種 類 及 名 稱	與 有 價 證 券 發 行 人 之 關 係	目 錄 列 示	年 度 數 量 / 單 位 數	帳 面 金 額	持 股 比 率 (%)	底 價		
							公 允 價 值	備 註	備 註
USI Enterprise Limited	特別股 MoBagel, Inc.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	391,318	美金	2	美金	119千元	
	私募基金 All-Stars Investment Private Partners Fund L.P.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	-	美金	2	美金	10,706千元	
	基金 JPM環球債券收益(美元)—A股	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	1,048,218	美金	-	美金	9,497千元	
	債券 環旭電子公司無擔保可轉換公司債券	子公司	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	26,418,020	美金	77	美金	503,524千元	
環旭電子公司	私募基金 蘇州耀途股權投資合夥企業	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	-	人民幣	4	人民幣	1,000元	
環海電子公司	股票 蘇州迅通半導體科技有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	257,937	人民幣	1	人民幣	20,000元	
環鴻科技公司	私募基金 PHI FUND, L.P.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	-	美金	29	美金	14,607元	
Universal Global Technology Co., Limited	股票 士鼎創業投資公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	29,285,000	\$	5	\$	329,767	
	特別股 氩化錄有限公司	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	589,622	美金	1	美金	5,000千元	

註：ASE Test Limited 持有本公司股票 44,100,236 股，係全數以非保留運用決定權信託專戶保管。

日月光投資控股股份有限公司及轉投資公司
重大累積買進或賣出同一有價證券明細表

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表四

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

買、賣、重之公司	有價證券名稱及編號	係屬類別	科目	日交易對象	關係	件數 或股數／單位數	金額 (註1)	初買 股數／單位數	金額	入 額	賣 股數／單位數	售價	帳面 成本	處分 (損)	出 品	年 度	
J&R Holding Limited	股票 Global Advanced Packaging Technology Limited	採權益法之長期股權投資	投資	註3、註4	-	207,370,000	美金 581,630千元	168,670,939	美金 440,014千元	-	-	-	美金	美金	-	376,040,939	美金 1,660,891千元
Global/Advanced Packaging Technology Limited	股票 蘇州日月新半導體有限公司	採權益法之長期股權投資	投資	註4	-	-	美金 231,121千元	-	美金	-	-	美金	259,163千元	美金	註4	-	美金
	日月光半導體（威海）有限公司	採權益法之長期股權投資	投資	註4	-	-	美金	-	美金	162,805千元	-	美金	165,601千元	美金	註4	-	美金 註5
	股票 GAPT Holding Limited	採權益法之長期股權投資	投資	註3、註4	-	-	美金	430,247,551	美金 440,014千元	430,247,551	-	美金	483,999千元	美金	-	-	美金
GAPT Holding Limited	日月光半導體（威海）有限公司	採權益法之長期股權投資	投資	註4	-	-	美金	-	美金	162,805千元	-	美金	165,601千元	美金	註4	-	美金
	日榮半導體（上海）有限公司	採權益法之長期股權投資	投資	註4、註5	-	-	美金 117,509千元	-	美金	-	-	美金	143,350千元	美金	註4、註5	-	美金
	股票 Global Advanced Packaging Test (Hongkong) Limited	採權益法之長期股權投資	投資	註3、註4	-	-	美金	429,995,184	美金 439,764千元	429,995,184	-	美金	-	美金	-	-	美金
Global/Advanced Packaging Test (Hongkong) Limited	日月光半導體（威海）有限公司	採權益法之長期股權投資	投資	註4	-	-	美金	-	美金	162,805千元	-	美金	165,601千元	美金	註4	-	美金
	股票 蘇州日月新半導體有限公司	採權益法之長期股權投資	投資	註4	-	-	美金	-	美金	259,163千元	-	美金	-	美金	-	-	美金
	日月光半導體（威海）有限公司	採權益法之長期股權投資	投資	註4	-	-	美金	-	美金	162,805千元	-	美金	-	美金	註4	-	美金
Alto Enterprises Limited	股票 日月光半導體（昆山）有限公司	採權益法之長期股權投資	投資	註4、註5	-	-	美金 54,498	-	美金	-	-	美金	57,406千元	美金	註4、註5	-	美金 註4、註5
	股票 日月光半導體（昆山）有限公司	採權益法之長期股權投資	投資	註4、註5	-	-	美金	117,222	美金	-	-	美金	106,094千元	美金	註4、註5	-	美金 註4、註5
	股票 日月光半導體（上海）有限公司	採權益法之長期股權投資	投資	註4、註5	-	-	美金	66,053	美金	-	-	美金	69,572千元	美金	註4、註5	-	美金 註4、註5
ASE Investment (Kunshan) Limited	股票 日月光半導體（上海）有限公司	採權益法之長期股權投資	投資	註4、註5	-	-	美金	-	美金	139,248千元	-	美金	-	美金	註4、註5	-	美金 註4、註5
	股票 日月光半導體（上海）有限公司	採權益法之長期股權投資	投資	註4	-	-	美金	140,623	美金	-	-	美金	165,601千元	美金	註4	-	美金
	債 環旭電子股份有限公司無擔保可轉換公司債	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	投資	環旭電子公司 子公司	-	-	美金	26,418,020	美金	408,238千元	-	美金	-	美金	-	26,418,020	美金 503,524千元
環旭電子公司	股票 Universal Global Technology Co., Limited	採權益法之長期股權投資	投資	註3	-	2,044,111,775	人民幣 4,309,681千元	505,636,330	人民幣 421,086千元	-	-	人民幣	-	人民幣	-	2,549,748,125	人民幣 5,116,197千元

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券名稱	種類	交易對象	開	生		買		入		出		成		生	
					債	股數／單位數	金額	(註1)	股數／單位數	金額	債	股數／單位數	金額	(註1)	股數／單位數	金額
					-	135,000,000	人民幣	131,263千元	325,000,000	人民幣	-	人民幣	-	人民幣	446,215千元	(註1)
Universal Global Technology Co., Limited	股票	採權益法之長期股權投資	環球電子(惠州)有限公司	註3	-	40,000,000	美金	39,493千元	40,000,000	美金	-	美金	-	美金	80,000,000	72,748千元
矽品	股票	採權益法之長期股權投資	Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited	註3	-	251,374,822	美金	302,611千元	70,000,000	美金	-	美金	-	美金	321,374,822	378,644千元
SPTL (B.V.I.) Holding Limited	股票	採權益法之長期股權投資	SPTL(B.V.I.) Holding Limited	註2、註3	-	319,400,000	\$	17,648,701	15,000,000	\$	-	\$	3,843,450	\$	199,400,000	\$ 16,340,566
SPTL(Cayman) Holding Limited	股票	採權益法之長期股權投資	SPTL(Cayman) Holding Limited	註2、註3	-	321,200,000	\$	17,489,648	15,000,000	\$	-	\$	3,843,450	\$	201,200,000	\$ 16,102,196
SPTL(Cayman) Holding Limited	股票	採權益法之長期股權投資	矽品科技(蘇州)有限公司	註3	-	-	-	13,274,459	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$ 15,740,362

註 1：採權益法之長期股權投資金額係包括權益法認列之投資損益及股東權益相關調整項目等。透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動則包括以公平價值衡量之評價調整數。

註 2：係辦理減資匯回。

註 3：係辦理現金增資。

註 4：係以股份交換方式進行集團組織架構調整。

註 5：母公司日月光控股公司董事會於 110 年 12 月決議處分子公司 GAP T Holding Limited (及其子公司) 及日月光半導體 (昆山) 有限公司 100% 股權，並已於 110 年 12 月完成交易並移轉控制。

日月光投資控股股份有限公司及轉投資公司
 取得不動產之金額達新台幣 3 億或實收資本額 20%以上
 民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表五

單位：新台幣千元

取得不動產公司	財產名稱	事實發生日期	交易金額 (未稅)	價支 情形	交易對象	關係	交易對象為關係人者，其前次移轉資料			價格決定之參考	取得之目的及用途	其他約定事項
							所有權人	與關係人關係	移轉日期	金額		
日月光	高雄廠及中壢廠設備及工程等	110.01.01 ~ 110.12.31	\$ 973,001	尚餘145,102千元將於驗收後付款	帆宣系統科技公司	無	-	-	-	\$ -	依詢、比、議價	無
	大社區5筆土地	110.08.04	1,070,031	已付訖	建昌工業公司	無	-	-	-	-	參酌專業機構出具之鑑價報告議定之	無
	楠梓科技產業園區第2園區科技路2及6號	110.07.23	2,362,000	已付訖	宏環建設公司	關聯企業	-	-	-	-	參酌專業機構出具之鑑價報告議定之	無
	高雄廠供營業用之廠務設備及工程等	110.01.01 ~ 110.12.31	343,180	尚餘50,725千元將於驗收後付款	長頂工程有限公司	無	-	-	-	-	依詢、比、議價	無
環泰電子（惠州）有限公司	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	888,038	依雙方合約約定之付款條件支付對價	龍海建設集團有限公司	無	-	-	-	-	依詢、比、議價	無
	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	922,617	依雙方合約約定之付款條件支付對價	L&K ENGINEERING VIETNAM CO., LTD.	無	-	-	-	-	依詢、比、議價	無
	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	3,750,668	依雙方訂購單約定之付款條件支付對價	麗明營造公司	無	-	-	-	-	依詢、比、議價	無
	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	2,048,210	依雙方訂購單約定之付款條件支付對價	中源機電顧問公司	無	-	-	-	-	依詢、比、議價	無
矽品	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	1,843,658	依雙方訂購單約定之付款條件支付對價	聖暉工程科技公司	無	-	-	-	-	依詢、比、議價	無
	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	833,555	依雙方訂購單約定之付款條件支付對價	勝義發營造公司	無	-	-	-	-	依詢、比、議價	無
	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31	1,232,695	依雙方訂購單約定之付款條件支付對價	中國二十冶集團有限公司	無	-	-	-	-	依詢、比、議價	無
	廠務工程	110.01.01 ~ 110.12.31										

日月光投資控股股份有限公司及轉投資公司

重大與關係人進、銷貨明細表

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表六

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

進 (銷) 貨之公司	交易對象名稱	關係人	交易			情形			交易條件與一般交易不同之情形	應收 (付)	票據、帳款		註
			金額	進 (銷) 貨	貨金	估總進之比率	%授信	期間			票據、帳款之總比率 (%)	備	
日月光	日月光半導體 (上海) 有限公司	子公司	\$ 1,161,007	進貨	\$	2	2	月結60天	\$ -	(\$ 297,217)	(-)	2	註
	日月光電子公司	子公司	2,287,840	進貨		4	4	月結60天	-	(644,578)	(-)	4	註
	台灣瑞雷電子公司	子公司	119,396	進貨		-	-	月結60天	-	(340)	(-)	-	註
	環隆電子公司	合併子公司	4,983,863	銷貨	(	3	3	月結60天	-	818,677	3	3	註
	環海科技公司	合併子公司	1,605,789	銷貨	(	1	1	月結60天	-	670,697	2	2	註
日榮半導體 (上海) 有限公司	日月光半導體 (上海) 有限公司	合併子公司	144,249	進貨		20	20	月結60天	-	-	-	-	註
日月光半導體 (香港) 有限公司	日月光半導體 (上海) 有限公司	母公司	606,020	進貨		100	100	月結90天	-	(53,347)	(-)	100	註
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	日月光電子公司	合併子公司	342,264	進貨		15	15	發票日後80天	-	(87,160)	(-)	20	註
日月光半導體 (上海) 有限公司	日月光	母公司	1,161,007	銷貨	(	24	24	月結60天	-	309,642	26	26	註
日榮半導體 (上海) 有限公司	日月光半導體 (上海) 有限公司	合併子公司	144,249	銷貨	(	3	3	發票日後80天	-	-	-	-	註
日月光半導體 (香港) 有限公司	日月光半導體 (香港) 有限公司	子公司	606,020	銷貨	(	12	12	月結90天	-	55,537	5	5	註
日月光電子公司	日月光	母公司	2,287,840	銷貨	(	46	46	月結60天	-	693,989	48	48	註
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd. 矽 品	日月光	合併子公司	342,264	銷貨	(	7	7	發票日後80天	-	87,597	6	6	註
		合併子公司	511,676	銷貨	(	10	10	月結60天	-	152,253	11	11	註
台灣瑞雷電子公司	日月光	母公司	252,304	銷貨	(	2	2	月結60天	-	2,925,929	64	64	註
環隆電氣公司	日月光	合併子公司	4,983,863	進貨		27	27	月結60天	-	(817,727)	(-)	36	註
	環海科技公司	母公司	227,466	進貨		2	2	75天	-	(24,878)	(-)	1	註
環旭電子公司	環隆電子 (上海) 有限公司	子公司	752,855	銷貨	(	1	1	75天	-	148,625	1	1	註
	環海科技公司	子公司	313,769	進貨	(	-	-	75天	-	-	-	-	註
			1,418,806	銷貨	(	2	2	75天	-	-	-	-	註
環鴻電子 (昆山) 有限公司	環海科技公司	合併子公司	221,717	進貨	(	1	1	75天	-	-	-	-	註
			17,565,672	銷貨	(	70	70	75天	-	-	-	-	註
	泰德興瑞雷電子 (昆山) 有限公司	採權益法之長投一合資子公司	144,970	進貨	(	1	1	月結120天	-	(79,386)	(-)	1	註
	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	合併子公司	111,358	銷貨	(	-	-	75天	-	4,648	-	-	註
環隆電子 (上海) 有限公司	環旭電子公司	母公司	752,855	進貨		2	2	75天	-	(148,625)	(-)	2	註
環勝電子 (深圳) 有限公司	環海科技公司	合併子公司	227,435	進貨	(	1	1	75天	-	-	-	-	註
			8,617,408	銷貨	(	48	48	75天	-	-	-	-	註
	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	合併子公司	479,785	銷貨	(	3	3	75天	-	78,621	2	2	註

(接次頁)

日月光投資控股股份有限公司及轉投資公司

重大應收關係人款項明細表

民國 110 年 12 月 31 日

附表七

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

帳列應收款項之公司	交易對象	稱名	關係人	應收款項餘額	關額(註1)	人連轉率(次) (註2)	逾期應收關係人款項金額(註1)	應收關係人款項金額	提列帳額	抵
本公司	日月光		子公司	\$ 213,161	(註5)	-	\$ -	\$ -	\$ -	-
日月光	環隆電氣公司		合併子公司	818,677	(註5)	3	24,553	152,621	持續催收	-
	環鴻科技公司		合併子公司	670,807	(註5)	2	30,477	149,912	持續催收	-
日月光電子公司	日月光矽品		母公司	702,275	(註5)	4	5,020	159,202	持續催收	-
	本公司		合併子公司	152,253	(註5)	4	-	49,386	-	-
			最終母公司	780,000	(註3及5)	-	-	130,000	-	-
ASE Singapore Pte. Ltd.	J&R Holding Limited		母公司	1,190,240	(註3及5)	-	-	-	-	-
	ASE Test Limited		母公司	498,240	(註3及5)	-	-	359,840	-	-
ISE Labs. Inc.	日月光 ASE Test Limited		母公司	840,146	(註3及5)	5	-	-	-	-
			母公司	332,160	(註3及5)	-	-	-	-	-
A.S.E. Holding Limited	ASE Test Limited		子公司	1,503,024	(註3及5)	-	-	-	-	-
台灣福雷電子公司	日月光 本公司		母公司	2,991,826	(註4及5)	-	9,923	934,767	持續催收	-
			最終母公司	1,525,000	(註3及5)	-	-	544,000	-	-
ASE Test Limited	USI Enterprise Limited		合併子公司	4,124,320	(註3及5)	-	-	276,800	-	-
	J&R Holding Limited		母公司	3,847,520	(註3及5)	-	-	83,040	-	-
ASE (U.S.) Inc.	日月光		母公司	283,537	(註3及5)	11	-	55,385	-	-
ASE (Korea) Inc.	日月光		母公司	8,073,241	(註3及5)	-	-	8,027,200	-	-
Global Advanced Packaging Technology	日月光封裝測試(上海)有限公司		子公司	22,199,570	(註5)	-	-	-	-	-
	日月光		母公司	885,760	(註3及5)	-	-	-	-	-
	USI Enterprise Limited		合併子公司	2,768,000	(註3及5)	-	-	-	-	-
ASE Japan Co., Ltd.	日月光		母公司	481,000	(註3及5)	-	-	-	-	-
ASE Mauritius Inc.	日月光封裝測試(上海)有限公司		合併子公司	1,251,955	(註5)	-	-	-	-	-
日月光投資(昆山)有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司		合併子公司	1,906,603	(註5)	-	1,906,603	-	持續催收	-
Alto Enterprises Limited	日月光封裝測試(上海)有限公司		合併子公司	1,032,862	(註5)	-	-	-	-	-
日月光半導體(上海)有限公司	日月光		母公司	309,642	(註5)	3	-	11,443	-	-
無錫通芯微電子有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司		母公司	198,936	(註3及5)	-	-	-	-	-
日月集成電路製造(中國)有限公司	矽品科技(蘇州)有限公司		合併子公司	916,060	(註3及5)	-	-	-	-	-
	日月光封裝測試(上海)有限公司		合併子公司	1,209,139	(註3及5)	-	-	-	-	-
上海鼎耀房地產開發有限公司	上海鼎威房地產開發有限公司		子公司	1,964,437	(註3及5)	-	-	-	-	-
	昆山鼎泓房地產開發有限公司		子公司	354,390	(註3及5)	-	-	6,109	-	-
	上海鼎裕房地產開發有限公司		子公司	440,582	(註3及5)	-	-	-	-	-
	上海鼎堯置業發展有限公司		子公司	136,085	(註3及5)	-	-	6,109	-	-

(接次頁)

(承前頁)

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係人	應收款項餘額	關聯額(註1)	人週轉率(次) (註2)	逾期應收關係人款項 金額	應收關係人款項 方式	應收後收	項額	提列帳	抵備金
Real Tech Holdings Limited	USI Enterprise Limited	子公司	\$	1,079,520 (註3及5)	-	\$	-	\$	-	\$	-
USI Enterprise Limited	環電公司	母公司	1,661,982 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環隆電氣公司	環鴻科技公司	母公司	901,652 (註3及5)	-	-	-	-	-	404,859	-	-
環勝電子(深圳)有限公司	環榮電子(惠州)有限公司	合併子公司	155,114 (註5)	1	-	-	-	-	693,211	-	-
環鴻電子(惠州)有限公司	環鴻科技公司	合併子公司	1,958,870 (註5)	-	-	-	-	-	1,892,110	-	-
環勝電子(深圳)有限公司	環勝電子(深圳)有限公司	合併子公司	5,931,095 (註5)	-	-	-	-	-	152,529	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	407,021 (註5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	1,107,200 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	451,195 (註5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	812,385 (註5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	553,600 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	1,522,400 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	1,661,570 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	193,760 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	1,248,783 (註3及5)	-	-	-	-	-	1,245,600	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	4,506,391 (註5)	-	-	-	-	-	1,556	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	1,882,240 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	148,625 (註5)	4	-	-	-	-	42,668	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	852,834 (註5)	-	-	-	-	-	334,968	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	832,409 (註3及5)	-	-	-	-	-	326	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	230,733 (註5)	-	-	-	-	-	12,395	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	875,265 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	736,734 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	398,150 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	285,288 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	104,511 (註5)	5	-	-	-	-	818	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	132,290 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	133,578 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	117,436 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	614,893 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	1,245,600 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	261,711 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	1,555,900 (註3及5)	2	-	-	-	-	36,887	-	-
環鴻電子(深圳)有限公司	環鴻電子(深圳)有限公司	合併子公司	10,000,000 (註3及5)	-	-	-	-	-	-	-	-

(接次頁)

(承前頁)

註 1：係包含應收帳款及其他應收款。

註 2：不含其他應收款。

註 3：主係應收融資款（詳附表一說明）或設備款。

註 4：主係 Turnkey 代收代付。

註 5：已於編製合併報表時沖銷。

(承前頁)

投資公司名稱	被投資公司名稱	編所在地區	主要業務	資本項目	原 始 年 度	投 入 年 度	資 金 年 度	額 年 度	特 面 帳 數 比	有 限 公 司 額 年 度	公 司 年 度	本 年 度 認 列 之 損 益 (註 1)	備 註
ASE Test Holdings, Ltd.	ISE Labs, Inc.	美國	半導體產品測試服務	美國	美金 221,145千元	美金 221,145千元	美金 221,145千元	26,250,000	100	美金 107,247千元	美金 1,970千元	註2	子公司
ISE Labs, Inc.	ISE Services, Inc.	美國	晶圓代購及客戶產品管理服務	美國	美金 0,001千元	美金 0,001千元	美金 0,001千元	1,000	100	美金 384千元	美金 71千元	註2	子公司
	Chipfritz, Inc.	美國	從事晶圓晶圓基板設計	美國	美金 8,000千元	美金 -千元	美金 -千元	3,245,436	21	美金 7,621千元	美金 1,822千元	註2	廠投資公司
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd.	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	馬來西亞	各類精體電路之製造、組裝、加工、測試及銷售	馬來西亞	美金 60,000千元	美金 60,000千元	美金 60,000千元	159,715,000	100	美金 180,949千元	美金 23,699千元	註2	子公司
Omniquest Industrial Limited	ASE Corporation	開曼群島	從事專業性投資活動	開曼群島	美金 356,284千元	美金 356,284千元	美金 356,284千元	356,284,067	100	美金 619,659千元	美金 21,236千元	註2	子公司
ASE Corporation	ASE Mauritius Inc.	模里西斯	從事專業性投資活動	模里西斯	美金 217,800千元	美金 217,800千元	美金 217,800千元	217,800,000	100	美金 477,013千元	美金 7,681千元	註2	子公司
	ASE Labuan Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動	馬來西亞	美金 126,184千元	美金 126,184千元	美金 126,184千元	126,184,067	100	美金 139,181千元	美金 13,562千元	註2	子公司
ASE Labuan Inc.	日月光電子公司	台灣	電子材料批發業、電子材料零售業及國際貿易業	台灣	美金 125,813千元	美金 125,813千元	美金 125,813千元	398,981,900	100	美金 138,637千元	美金 13,571千元	註2	子公司
Imesource Limited	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動	英屬維京群島	美金 74,000千元	美金 74,000千元	美金 74,000千元	74,000,000	21	美金 127,846千元	美金 21,237千元	註2	子公司
日月光半導體 (上海) 有限公司	日月光半導體 (香港) 有限公司	香港	從事貿易相關業務活動	香港	美金 1,000千元	美金 1,000千元	美金 1,000千元	-	100	美金 10,279千元	美金 61千元	註2	子公司
環電公司	Huntington Holdings International Co. Ltd.	英屬維京群島	控股公司	英屬維京群島	\$ 8,370,606	\$ 8,370,606	\$ 8,370,606	255,856,840	100	\$ 50,843,262	\$ 5,224,257	註2	子公司
Huntington Holdings International Co. Ltd.	Unitech Holdings International Co. Ltd.	英屬維京群島	控股公司	英屬維京群島	美金 3,000千元	美金 3,000千元	美金 3,000千元	3,000,000	100	美金 12,569千元	(美金 633千元)	註2	子公司
	Real Tech Holdings Limited	英屬維京群島	控股公司	英屬維京群島	美金 149,151千元	美金 149,151千元	美金 149,151千元	149,151,000	100	美金 1,818,908千元	美金 187,513千元	註2	子公司
	Universal ABT Holding Co., Ltd.	開曼群島	控股公司	開曼群島	美金 28,125千元	美金 28,125千元	美金 28,125千元	90,000,000	100	美金 13千元	美金 -千元	註2	子公司
Real Tech Holdings Limited	USI Enterprise Limited	香港	投資諮詢服務及倉儲管理服務	香港	美金 210,900千元	美金 210,900千元	美金 210,900千元	210,900,000	100	美金 1,773,166千元	美金 195,623千元	註2	子公司
環旭電子公司	Universal Global Technology Co., Limited	香港	控股公司	香港	人民幣 2,189,946千元	人民幣 2,189,946千元	人民幣 2,189,946千元	2,549,748,125	100	人民幣 5,116,197千元	人民幣 318,449千元	註2	子公司
	Financiere AFG	法國	控股公司	法國	人民幣 393,342千元	人民幣 393,342千元	人民幣 393,342千元	8,317,462	10	人民幣 382,633千元	人民幣 136,175千元	註2	子公司
Universal Global Technology Co., Limited	環旭科技公司	香港	貿易及投資控股公司	香港	美金 11,000千元	美金 11,000千元	美金 11,000千元	85,800,000	100	美金 14,272千元	美金 628千元	註2	子公司
	環海電子公司	香港	接單並委外加工、銷售電子產品，提供技術諮詢服務	香港	美金 51,000千元	美金 47,000千元	美金 51,000千元	51,000,000	100	美金 55,284千元	美金 7,062千元	註2	子公司
	M-Univers Investments Pte. Ltd.	新加坡	有線通信機械器材、無線通信機械器材、電子零組件、電腦及其週邊設備、汽車及其零件製造業、產品設計業及研究發展服務業	台灣	美金 58,688千元	美金 58,688千元	美金 58,688千元	59,157,419	42	美金 67,180千元	美金 5,775千元	註2	廠投資公司
	環海科技公司	台灣	設計業及研究發展服務業	台灣	美金 62,235千元	美金 62,235千元	美金 62,235千元	198,000,000	100	美金 312,142千元	美金 43,534千元	註2	子公司
USI Japan Co., Ltd.	USI Japan Co., Ltd.	日本	電腦資訊之週邊設備、軟體、電子零件等之製造買賣	日本	美金 885千元	美金 885千元	美金 885千元	6,400	100	美金 1,142千元	美金 92千元	註2	子公司
Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	墨西哥	主機板及電腦系統組裝	墨西哥	美金 63,963千元	美金 63,963千元	美金 63,963千元	1,258,077,325	100	美金 70,988千元	(美金 7,677千元)	註2	子公司
USI America Inc.	USI America Inc.	美國	新型主機板組裝與製作、無線通訊產品製作、維修服務	美國	美金 9,500千元	美金 9,500千元	美金 9,500千元	250,000	100	美金 6,952千元	美金 157千元	註2	子公司
Universal Scientific Industrial (France)	Universal Scientific Industrial (France)	法國	控股公司	法國	美金 372,200千元	美金 372,200千元	美金 286,968千元	321,374,822	100	美金 378,644千元	美金 6,793千元	註2	子公司
Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited	Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited	越南	穿戴電子設備晶片製造和組裝	越南	美金 80,000千元	美金 80,000千元	美金 40,000千元	80,000,000	100	美金 72,488千元	(美金 6,745千元)	註2	子公司
環旭科技有限公司	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	墨西哥	主機板及電腦系統組裝	墨西哥	美金 -千元	美金 -千元	美金 -千元	1	-	美金 -千元	(美金 7,677千元)	註2	子公司
環鴻科技公司	環聖電氣公司	台灣	從事各種電腦及週邊設備之製造、加工維修及銷售等業務	台灣	\$ 1,791,208	\$ 1,791,208	\$ 1,791,208	139,972,740	100	\$ 3,279,991	\$ 186,668	註2	子公司
環海電子公司	Universal Scientific Industrial Poland Sp. z o.o.	波蘭	提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器件等業務	波蘭	美金 34,656千元	美金 34,656千元	美金 34,656千元	1,617,046	100	美金 34,875千元	美金 6,549千元	註2	子公司
Universal Scientific Industrial (France)	Financiere AFG	法國	控股公司	法國	歐元 318,899千元	歐元 318,899千元	歐元 318,899千元	71,530,174	90	歐元 325,996千元	歐元 17,799千元	註2	子公司
矽 品	SPIL (B.V.) Holding Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動	英屬維京群島	美金 199,400千元	美金 199,400千元	美金 199,400千元	199,400,000	100	\$ 16,340,566	\$ 2,133,271	註2	子公司
	矽品投資公司	台灣	從事專業性投資活動	台灣	\$ 2,401,000	\$ 2,401,000	\$ 2,401,000	116,241,300	100	\$ 10,262,612	\$ 110,484	註2	子公司
	南茂科技公司	台灣	半導體產品封裝及測試服務	台灣	1,309,699	1,309,699	1,309,699	78,910,390	11	2,730,466	註3	註2	廠投資公司
	Vertical Circuits, Inc.	美國	封裝服務	美國	美金 5,000千元	美金 5,000千元	美金 5,000千元	15,710,000	31	-	-	註2	廠投資公司
矽品投資公司	晟元投資公司	台灣	從事專業性投資活動	台灣	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	48,000,000	29	\$ 10,164,945	\$ 373,486	註2	廠投資公司
SPIL (B.V.) Holding Limited	Siliconware USA, Inc.	美國	北美地區行銷業務服務	美國	美金 1,250千元	美金 1,250千元	美金 1,250千元	1,250,000	100	272,369	32,604	註2	子公司
	SPIL (Cayman) Holding Limited	開曼群島	從事專業性投資活動	開曼群島	美金 201,200千元	美金 201,200千元	美金 321,200千元	201,200,000	100	16,102,196	2,100,984	註2	子公司

(接次頁)

(承前頁)

註 1：本年度認列之投資（損）益業已考量公司間交易之未實現損益之影響數。

註 2：該被投資公司之損益業已包含於其投資公司，為避免混淆，於此不再另行表達。

註 3：請參閱公開資訊觀測站。

日月光投資控股股份有限公司及轉投資公司

大陸投資資訊

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表九

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本年增資金額	本年匯出或收回投資金額	本年自台灣匯出金額	本年自台灣匯入金額	本公司直接或間接持股比例(%)	本年度認列投資損益	年底資產負債表價值	截至本年底已匯回投資收益
大陸被投資公司名稱 日月光半導體(上海)有限公司	從事半導體材料製造業務	\$ 4,349,312 (美金 148,496千元) (註7)	1.(1)	\$ 4,782,216 (美金 149,800千元) (註7)	-	\$ 4,782,216 (美金 149,800千元) (註7)	\$ 4,782,216 (美金 149,800千元) (註7)	100	\$ 351,259 (美金 12,591千元) (註3)	\$ 12,470,014 (美金 450,506千元)	無
日月光半導體(昆山)有限公司	從事半導體材料製造及半導體產品之封裝測試業務	- (註11)	1.(2)	\$ 8,350,204 (美金 268,000千元) (註8)	-	\$ 8,350,204 (美金 268,000千元) (註8)	\$ 8,350,204 (美金 268,000千元) (註8)	-	\$ 80,889 (美金 -2,990千元) (註2)	- (註11)	無
日月光封裝測試(上海)有限公司	半導體產品封裝測試業務及廠房出租業務	\$ 3,117,117 (美金 103,580千元) (註10)	1.(3)	\$ 2,574,458 (美金 80,000千元) (註10)	-	\$ 2,574,458 (美金 80,000千元) (註10)	\$ 2,574,458 (美金 80,000千元) (註10)	100	\$ 23,637 (美金 -895千元) (註2)	\$ 12,769,641 (美金 461,331千元)	無
蘇州日月新半導體有限公司	從事半導體封裝測試及技術諮詢服務等業務	- (註11)	1.(4)	\$ 711,180 (美金 21,600千元) (註11)	-	\$ 711,180 (美金 21,600千元) (註11)	\$ 711,180 (美金 21,600千元) (註11)	-	\$ 209,040 (美金 -7,883千元) (註3)	- (註11)	無
日月光半導體(威海)有限公司	一般類之分離式元件封裝及測試業務	- (註11)	1.(4)	\$ 1,295,307 (美金 40,000千元) (註11)	-	\$ 1,295,307 (美金 40,000千元) (註11)	\$ 1,295,307 (美金 40,000千元) (註11)	-	\$ 489,687 (美金 17,407千元) (註3)	- (註11)	無
上海鼎匯房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理	\$ 16,345,070 (人民幣 3,600,000千元)	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	- (註1.2)	100	\$ 726,660 (人民幣 -167,711千元) (註3)	\$ 19,572,037 (人民幣 4,508,144千元)	無
上海鼎成房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理	\$ 8,061,489 (人民幣 1,798,000千元)	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	- (註1.2)	100	\$ 258,048 (人民幣 -59,433千元) (註3)	\$ 5,911,071 (人民幣 1,361,532千元)	無
上海鼎裕房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理	\$ 4,936,588 (人民幣 1,100,000千元)	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	- (註1.2)	100	\$ 141,862 (人民幣 -32,799千元) (註3)	\$ 4,512,763 (人民幣 1,039,452千元)	無
昆山鼎泓房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理	\$ 3,139,662 (人民幣 670,000千元)	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	- (註1.2)	100	\$ 85,149 (人民幣 -19,607千元) (註3)	\$ 2,834,349 (人民幣 652,853千元)	無
日月光集成電路製造(中國)有限公司	從事半導體封裝測試、售後服務、諮詢及廠房出租	\$ 3,149,000 (美金 100,000千元)	1.(5)	\$ 3,149,000 (美金 100,000千元)	-	\$ 3,149,000 (美金 100,000千元)	\$ 3,149,000 (美金 100,000千元)	100	\$ 64,079 (美金 2,312千元) (註2)	\$ 3,025,109 (美金 109,289千元)	無
日月光投資(昆山)有限公司	從事投資控股業務	\$ 4,312,518 (美金 142,000千元) (註9)	1.(6)	\$ 3,717,318 (美金 122,000千元) (註8)	-	\$ 3,717,318 (美金 122,000千元) (註8)	\$ 3,717,318 (美金 122,000千元) (註8)	100	\$ 139,843 (美金 -5,080千元) (註2)	\$ 3,220,832 (美金 116,360千元)	無
無錫達芯微電子有限公司	半導體產品封裝及測試業務	\$ 356,682 (人民幣 73,461千元)	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	- (註1.2)	100	\$ 11,823 (人民幣 2,766千元) (註2)	\$ 402,711 (人民幣 92,759千元)	無
上海鼎祺物業管理有限公司	物業管理、房地產經紀等業務	\$ 5,078 (人民幣 1,000千元)	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	- (註1.2)	100	\$ 11,345 (人民幣 -2,632千元) (註3)	\$ 10,352 (人民幣 -2,384千元)	無
上海鼎凡商業管理有限公司	商業綜合體管理服務及百貨貿易等相關業務	\$ 9,487 (人民幣 2,000千元)	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	- (註1.2)	100	\$ 1,299 (人民幣 -299千元) (註3)	\$ 2,897 (人民幣 667千元)	無

(接次頁)

大陸被投資公司名稱 上海鼎昶物業管理有限公司	主要營業項目 物業管理、房地產經紀等業務	實收資本額 \$ 22,860 (人民幣 5,000千元)	投資方式 (註1)	2	本年自 台灣匯出 金額 \$ - (註1.2)	本年度匯出或 收回投資金額 \$ -	本年自 台灣匯出 金額 \$ - (註1.2)	本年度匯出或 收回投資金額 \$ -	本公司直接 或間接投資 之持股比例 (%)	本公司直接 或間接投資 之持股比例 (%)	本年認列投資 損益 (人民幣) \$ 4,643 (人民幣 1,065千元) (註3)	年底 價值 (人民幣) \$ 37,170 (人民幣 8,562千元)	截至本年底 已匯回投資收益 無
上海月芯半導體科技有限責任 公司	半導體科技領域內之技術開發 及測試設備之研發等業務	432,703 (人民幣 100,000千元)	2	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	100	100	2,359 (人民幣 526千元) (註2)	426,996 (人民幣 98,352千元)	無
上海鼎堯置業發展有限公司	從事物業管理業務	42,142 (人民幣 10,000千元)	2	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	100	100	203,772 (人民幣 -47,157千元) (註3)	188,696 (人民幣 -43,464千元)	無
日榮半導體(上海)有限公司	從事半導體產品封裝及測試 業務	- (註11)	2	2	3,218,072 (美金 100,000千元) (註10)	-	-	-	-	-	339,847 (美金 12,107千元) (註2)	- (註11)	無
環鼎電子(深圳)有限公司	生產經營電腦主機板、其他 相關電腦週邊設備及通訊 工業控制等產品之設計、 製造及銷售	2,270,625 (美金 750,000千元)	1(7)	1(7)	1,180,746	-	1,180,746	-	78	78	764,158 (美金 27,336千元) (註4)	4,626,591 (美金 167,146千元)	\$ 1,842,387 (美金 62,297千元)
環旭電子公司	提供電子產品設計製造服務 ，生產及加工新型電子元 器件、計算機高性能主機 板、無線網路通信元器件等	10,798,199 (人民幣 2,210,173千元)	1(7)	1(7)	1,668,233	-	1,668,233	-	78	78	5,982,492 (美金 214,525千元) (註4)	44,269,728 (美金 1,599,340千元)	349,290 (美金 10,955千元)
環鴻電子(昆山)有限公司	提供電子產品設計及製造服務	2,488,323 (人民幣 550,000千元)	2	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	78	78	988,811 (人民幣 228,130千元) (註4)	4,823,532 (人民幣 1,111,029千元)	無
環納電子(上海)有限公司	電子產品的研發及製造，新型 電子元器件、計算機高性能 主機板、無線網路通信元器 件、移動通信產品及模塊、 零配件的加工及維修，電子 產品、通訊產品及零配件的 銷售，第三方物流服務，從 事貨物及技術的進出口業務	6,652,140 (人民幣 1,330,000千元)	2	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	78	78	1,057,590 (人民幣 244,454千元) (註4)	6,083,283 (人民幣 1,401,194千元)	無
環泰電子(上海)有限公司	電子元器件、計算機軟硬件 、通訊設備及配件的銷售， 第三方物流服務，從事貨物 及技術的進出口業務，轉口 貿易，區內企業間貿易及貿 易代理	240,850 (人民幣 50,000千元)	2	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	78	78	77,739 (人民幣 1,792千元) (註4)	210,575 (人民幣 48,503千元)	無
中科泓泰電子有限公司	伺服器及其主機板產品製造 、加工、維修服務等	963,033 (人民幣 220,000千元)	2	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	38	38	20,221 (人民幣 4,660千元)	386,281 (人民幣 88,974千元)	無
環聚電子(惠州)有限公司	研發及生產經營新型電子元器 件、通信類、電腦類及其他 電子產品，從事電子類產品 維修檢測及進出口寄配套服 務	2,005,773 (人民幣 460,000千元)	2	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	78	78	31,405 (人民幣 -7,500千元) (註4)	1,508,919 (人民幣 347,557千元)	無
環旭(深圳)電子材料有限公司	電子產品設計、技術服務及技 術諮詢；電子產品、通訊產 品及相關零配件的批發、經 營進出口業務；物業管理等	43,687 (人民幣 10,000千元)	2	2	- (註1.2)	-	- (註1.2)	-	78	78	3,720 (人民幣 864千元) (註4)	37,940 (人民幣 8,739千元)	無

(承前頁)

註 2：依經台灣母公司簽證會計師查核之財務報告揭露。

註 3：依經與中華民國會計師事務所所有合作關係之國際性會計師事務所查核之財務報告揭露。

註 4：依經台灣母公司簽證會計師所屬事務所之其他會計師查核之財務報告揭露。

註 5：依經濟部投審會規定，本公司赴大陸地區投資投資限額係依經濟部 97 年 8 月 29 日經審字第 09704604680 號令修正發布並自同年 8 月 1 日生效之「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」第參點，取得經經濟部工業局核發符合營運總部營業範圍證明文件並具跨國企業條件之公司，是以對大陸地區投資金額無上限之規定。

註 6：茲將台灣福雷電子子公司赴大陸地區投資投資限額計算如下： $\$28,672,916 \times 60\% = 17,203,750$

註 7：經濟部投審會核准投資金額與累計自台灣匯出投資金額之差異總計美金 357,345 千元，係包括：

(1) ASE (Korea) Inc.直接匯出美金 100,000 千元。

(2) ASE (Korea) Inc.借予日月光半導體（威海）有限公司之債權轉作為股本美金 25,000 千元。

(3) ASE Mauritius Inc.向日月光封裝測試（上海）有限公司與日月光電子元器件（上海）有限公司買入日月光半導體（上海）有限公司股權及日月光半導體（上海）有限公司吸收合併日月光電子元器件（上海）有限公司，投審會認定因股權移轉而增加之淨投資分別為美金 707 千元及美金 6,777 千元。

(4) J&R Holding Limited 以美金 127,113 千元購入 NXP B.V.所持有之蘇州日月新 40%股權並於 107 年 5 月 30 日經投審會核准在案。

(5) J&R Holding Limited 以美金 97,748 千元購入北京紫光資本管理有限公司所持有之蘇州日月新 30%股權並於 108 年 10 月 30 日經投審會核准在案。

註 8：係同一筆資金由台灣福雷電子公司透過第三地區間接增資日月光投資（昆山）有限公司再轉增資日月光半導體（昆山）有限公司之投資金額。

註 9：日月光封裝測試（上海）有限公司新增轉投資日月光投資（昆山）有限公司再轉投資日月光半導體（昆山）有限公司美金 2,000 萬元。

註 10：日月光封裝測試（上海）有限公司分割減少資本美金 1 億元予 Global Advanced Packaging Technology Limited 設立之子公司日榮半導體（上海）有限公司。

註 11：本集團於 110 年 12 月將日月光半導體（昆山）有限公司、日月光半導體（威海）有限公司、日榮半導體（上海）有限公司及蘇州日月新半導體有限公司處分予北京智路資產管理有限公司之指定從屬公司，自 110 年 12 月起不納入本集團合併個體。

註 12：經濟部投審會核准投資金額與累計自台灣匯出投資金額之差異總計美金 29,577 千元，係為盈餘轉增美金 29,577 千元。

註 13：依經其他簽證會計師查核之財務報告揭露。

註 14：本年度自子公司 SPIL(B.V.I.) Holding Limited 之轉投資公司 SPIL(Cayman) Holding Limited 收回減資款美金 135,000 千元，其中美金 90,000 千元係歸屬於矽品科技（蘇州）有限公司，美金 45,000 千元係歸屬於民國 109 年 10 月已處分之矽品電子（福建）有限公司。

日月光投資控股股份有限公司及轉投資公司

主要股東資訊

民國 110 年 12 月 31 日

附表十

主 要 股 東 名 稱	股 份	
	持 有 股 數 (股)	持 股 比 例 (%)
香港商微電子國際公司	684,327,886	15.52
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證	314,328,372	7.13
匯豐商業銀行受託保管價值投資公司投資專戶	265,024,820	6.01

註 1：本表主要股東資訊係由集保公司以每季底最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付（含庫藏股）之普通股及特別股合計達 5% 以上資料。本公司個體財務報告所記載股本與實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

註 2：上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過 10% 之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

§重要會計項目明細表目錄§

項	目	編 號 / 索 引
資產、負債及權益項目明細表		
採用權益法之投資變動明細表		一
長期借款明細表		二
應付公司債明細表		附註八
損益項目明細表		
管理費用明細表		三
其他收益及費損淨額明細表		附註十
本年度發生之員工福利費用功能別彙總表		四

日月光投資控股股份有限公司
採用權益法之投資變動明細表
民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

明細表一

單位：新台幣千元

被 普 通 股	投 資 公 司	年 股	初 數	餘 金	額	額	本 年 度 增 加	(註 1)	額	本 年 度 減 少	(註 1)	額	年 股	底 持 數	股 份 %	餘 金	額	單 價 (元)	股 權 淨 值 (元)	(註 2)	額	提 供 擔 保 或 質 押 情 形
未上市櫃公司 日 月 光 砂 品 環 電		5,994,143,764		\$ 106,873,386			-	\$	-				5,994,143,764	100	100	\$ 139,413,170	\$ 24.61	\$ 147,493,723		無		
		3,391,748,878		158,563,245		260,000,000	6,123,290	-	-				3,651,748,878	100	100	164,686,535	25.69	93,826,387		無		
		2,477,855,972		33,002,508		239,658,230	1,732,607	-	-				2,717,514,202	100	100	34,735,115	12.34	33,526,229		無		
				\$ 298,439,139			\$ 40,395,681		\$	-							\$ 338,834,820		\$ 274,846,339			

註 1：本年度變動包括採用權益法認列之子公司損益份額及其他綜合損益份額暨獲配子公司現金及股票股利等。

註 2：股權淨值係依據各被投資公司之財務報告及本公司持股比例計算。

日月光投資控股股份有限公司

長期借款明細表

民國 110 年 12 月 31 日

明細表二

單位：新台幣千元

債權銀行	原幣金額、契約期限及償還辦法	年利率（%）	年底餘額	抵押或擔保
週轉性借款				
星展銀行	將於 112 年 8 月到期一次償還	0.72	\$ 4,000,000	無
國泰銀行	將於 112 年 4 月到期一次償還	0.73	3,000,000	無
台灣銀行	將於 112 年 12 月到期一次償還	0.75	3,000,000	無
渣打銀行	將於 112 年 7 月到期一次償還	0.75	2,525,000	無
元大銀行	將於 112 年 7 月到期一次償還	0.74	2,000,000	無
遠東銀行	將於 112 年 7 月到期一次償還	0.75	2,000,000	無
三井住友銀行	將於 112 年 11 月到期一次償還	0.77	1,920,000	無
富邦銀行	將於 112 年 12 月到期一次償還	0.75	900,000	無
兆豐銀行	將於 112 年 11 月到期一次償還	0.88	500,000	無
長期應付票券				
兆豐票券	將於 112 年 3 月到期一次清償	0.65	2,000,000	無
中華票券	將於 112 年 3 月到期一次清償	0.65	2,000,000	無
國際票券	將於 112 年 3 月到期一次清償	0.65	1,500,000	無
大慶票券	將於 112 年 3 月到期一次清償	0.65	1,500,000	無
減：未攤銷折價			26,845,000	
			979	
			<u>\$ 26,844,021</u>	

日月光投資控股股份有限公司
管理費用明細表
民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

明細表三

單位：新台幣千元

項 目	金 額
薪 資	\$ 535,923
專業服務費	54,522
其 他（註）	<u>171,927</u>
	<u>\$ 762,372</u>

註：各項金額皆未超過本項目金額之 10%。

日月光投資控股股份有限公司
本年度發生之員工福利費用功能別彙總表
民國 110 及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

明細表四

單位：新台幣千元

項 目	110 年度	109 年度
	營 業 費 用	營 業 費 用
員工福利費用		
薪資費用	\$ 341,646	\$ 179,329
勞健保費用	16,554	10,040
退休金費用	3,596	2,728
董事酬金	194,277	109,815
其他員工福利費用（註）	<u>64,537</u>	<u>17,553</u>
	<u>\$ 620,610</u>	<u>\$ 319,465</u>

註：已減除子公司董監酬勞收入。

附註：

1. 本年度及前一年度之員工人數分別為 102 人及 88 人，其中未兼任員工之董事人數皆為 9 人。
2. 本公司股票已在證券交易所上市，另增加揭露以下資訊：
 - (1) 本年度平均員工福利費用 4,584 千元，前一年度平均員工福利費用 2,654 千元。
 - (2) 本年度平均員工薪資費用 3,674 千元，前一年度平均員工薪資費用 2,270 千元。
 - (3) 平均員工薪資費用調整變動情形 61.9%。
 - (4) 本公司已設置審計委員會，無支付予監察人酬金。
 - (5) 公司薪資報酬政策（包括董事、經理人及員工）

本公司董事會每年至少執行一次內部董事會績效評估，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次外部董事會績效評估。各酬金經過綜合考量後給予合理報酬，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事及經理人酬金制度。

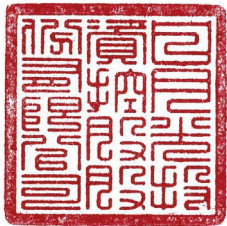
本公司獨立董事之報酬訂為每人每年定額，惟任期不滿一年者，以其實際所任天數按比例計算之；本公司獨立董事因兼任本公司薪資報酬委員會成員所得兼職酬金，亦為每人每年定額，惟任期不滿一年者，以其實際所任天數按比例計算之。

本公司執行長及總經理之薪資係經本公司董事會決議通過，另副總經理之酬金則參照同業水準訂定支付之，每年定期檢視與同業人才競爭廠商比較，確保薪酬的競爭性，其獎金之給付則視本公司盈餘多寡、個人經營績效優劣以達求才與留才之目的。

經理人之薪資報酬制度係與本公司其他員工適用相同之「員工酬勞發放辦法」辦理。

本公司董事、經理人及員工另依本公司章程規定，於本公司年度如有獲利，應提撥 0.01% 以上，1.00% 以下為員工酬勞，並提撥 0.75%（含）以下為董事酬勞。薪酬委員會會根據公司治理趨勢報告及整體薪酬市場競爭力檢視報告來定期評估董事及經理人薪資報酬。

日月光投資控股股份有限公司



負責人 | 張虔生



中華民國一一年二月二十八日 刊印

